

科创板投资风险提示

本次股票发行后拟在科创板市场上市，该市场具有较高的投资风险。科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。



合肥新汇成微电子股份有限公司

Union Semiconductor (Hefei) Co., Ltd.

(合肥市新站区合肥综合保税区内)

首次公开发行股票并在科创板上市

招股说明书（申报稿）

声明：本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。

保荐机构（主承销商）



(上海市广东路 689 号)

重要声明

中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。

保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。

本次发行概况

发行股票类型	人民币普通股（A股）
发行股数	发行人本次发行的股份数量不超过 222,627,542 股（行使超额配售选择权之前），不低于本次发行后总股本的 10%，不超过本次发行后总股本的 25%（行使超额配售选择权之前），并授予主承销商不超过前述发行的人民币普通股（A股）股数 15% 的超额配售选择权
每股面值	1.00 元
每股发行价格	【 】元
预计发行日期	【 】年【 】月【 】日
拟上市的交易所	上海证券交易所
拟上市的板块	科创板
发行后总股本	不超过 890,510,167 股（行使超额配售选择权之前）
保荐人（主承销商）	海通证券股份有限公司
招股说明书签署日期	2021 年【 】月【 】日
战略配售情况	本次发行及上市拟采用战略配售，战略配售的对象包括但不限于保荐机构相关子公司、公司的高级管理人员与核心员工依法设立的专项资产管理计划等，具体安排参照上海证券交易所相关规定执行。相应战略配售的对象后续将进一步明确参与本次发行战略配售的具体方案，并按规定向上海证券交易所提交相关文件并依法披露。

重大事项提示

本公司提醒投资者特别关注本次发行的以下事项和风险，并认真阅读招股说明书正文内容。

一、特别风险提示

本公司提醒投资者特别关注“风险因素”中的下列风险，并认真阅读本招股说明书“第四节 风险因素”中的全部内容。

（一）技术升级迭代的风险

随着集成电路制造工艺技术的不断发展，集成电路对端口密度、信号延迟及封装体积等提出了越来越高的要求，促进了先进封装如 Bumping、Flip Chip（包含 COG、COF 等）、WLCSP、2.5D、3D 等新型封装工艺及封装形式的出现和发展。

集成电路行业技术更新迭代快，目前发行人专注于显示驱动芯片先进封装领域，主要使用 Bumping、COG、COF 等技术。如果未来公司技术升级进度或成果未达预期、未能准确把握行业发展趋势，导致未能成功进行工艺及技术升级迭代，公司市场竞争力将受到不利影响。

（二）收入来源结构单一的风险

自成立以来，发行人一直专注于显示驱动芯片领域，由于公司目前阶段投资能力有限，尚未正式开展其他领域业务。报告期内，发行人主营业务收入均来源于显示驱动芯片领域的先进封装测试服务，收入来源结构较为单一。如果发行人在显示驱动芯片领域客户订单流失或议价能力下降，未能及时完成新领域产品封装工艺的研发及产业化，将可能对发行人的经营业绩产生不利影响。

（三）客户集中度较高的风险

报告期内，发行人对前五大客户的主营业务收入合计分别为 23,482.50 万元、30,483.40 万元、43,824.32 万元和 26,607.52 万元，占主营业务收入的比例分别为 87.63%、82.38%、76.21% 和 76.05%，客户集中度较高。如果未来发行人的主要

客户生产经营出现问题，导致其向发行人下达的订单数量下降，或发行人无法持续深化与现有主要客户的合作关系与合作规模、无法有效开拓新的客户资源，将可能对发行人经营业绩产生不利影响。

（四）供应商集中度较高的风险

报告期内，发行人向前五大原材料供应商采购额合计分别为 13,123.40 万元、17,621.61 万元、21,303.97 万元和 13,817.16 万元，占原材料采购总额的比例分别为 77.10%、79.92%、83.14%和 85.11%，原材料供应商集中度较高。如果公司主要供应商生产经营发生重大变化，或交付能力未能满足公司要求，或与公司业务关系发生变化，公司在短期内可能面临原材料短缺，从而对公司的生产经营产生不利影响。

（五）区域贸易政策变化导致的风险

集成电路封装测试行业对原材料和设备有较高要求，发行人报告期内 80% 以上生产设备与 50% 以上原材料均采购自中国境外（以日本为主，具体以设备与原材料原产地为统计口径）；同时，发行人的主要客户亦为境外企业（以中国台湾地区为主），报告期内，公司对境外客户（以直接客户注册所在地为统计口径）销售金额占主营业务收入的比例在 60% 以上。

如果未来相关国家或地区与中国的区域贸易政策发生重大变化，限制进出口或提高关税，公司可能面临生产设备、原材料短缺和客户流失等情形，进而导致公司生产受限、订单减少、成本增加，对公司的业务和经营产生不利影响。

（六）存在累计未弥补亏损的风险

公司于股改时存在累计未弥补亏损，主要系所处集成电路封装测试行业属于资金密集型及技术密集型行业，要形成规模化生产，需要进行大规模的固定资产投资及研发投入。同时，大规模的资金投入后，生产线从设备工艺调试，到产品下游验证，再到大规模量产，通常需要经历相对较长的达产期。因此，在达产期前期，长期资产折旧与摊销等固定成本较高，收入规模较小，销售收入不能覆盖同期发生的成本及研发支出，导致累计未弥补亏损金额较大。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司经审计的累计未弥补亏损为-29,316.93 万元，累计未弥补亏损的情形尚未消除。在首次公开发行股票并在科创板上市后，若公司短期内无法弥补累计亏损，将导致缺乏向股东现金分红的能力。

（七）“新冠疫情”引致的风险

2020 年初，国内突发新冠疫情，给全国乃至全球经济带来了巨大冲击。目前国内的新冠疫情状况已经得到有效控制，但仍然存在零星散发、局部爆发和境外输入的情形，尤其是 2021 年 7 月-8 月扬州爆发的疫情已对子公司江苏汇成的经营造成一定程度上的不利影响；同时，国外新冠疫情形势仍然严峻。若我国当前的新冠疫情防控成效不能保持或国外疫情形势加剧，可能会对宏观经济的正常运行以及公司的业务开展产生不利影响。

二、发行人控股股东所持发行人股份存在质押情形

（一）股份质押的基本情况

截至本招股说明书签署日，发行人控股股东所持发行人股份存在质押的情形，相关质押系为发行人获得银行贷款所提供的增信措施，具体情况如下：

单位：万元

股东名称	股份质押数量 (万股)	占发行人总股本比 例 (%)	该股份质押条件下剩 余需归还金额
扬州新瑞连	800.00	1.20	614.00
	1,200.00	1.80	1,536.00
合计	2,000.00	2.99	2,150.00

扬州新瑞连股份质押情况及目前进展具体如下：

1、扬州新瑞连所持发行人 800 万股之股份质押

2017 年 9 月 22 日，中国建设银行股份有限公司合肥龙门支行（以下简称“建设银行龙门支行”）向发行人发放固定资产贷款 6,800 万元，贷款期限为 6 年。合肥鑫城国有资产经营有限公司（以下简称“合肥鑫城”）接受发行人的委托为前述贷款提供连带责任保证。截至本招股说明书签署日，上述贷款尚有 614.00 万元未归还。根据合肥鑫城的要求，扬州新瑞连向合肥鑫城提供反担保措施，由扬州新瑞连以其持有的发行人 800 万股股份为合肥鑫城就上述贷款提供的连带

责任保证提供反担保。

2、扬州新瑞连所持发行人 1,200 万股之股份质押

2018 年 9 月 29 日，建设银行龙门支行向发行人发放固定资产贷款 8,200 万元，贷款期限为 60 个月。合肥鑫城接受发行人的委托为前述贷款提供连带责任保证。截至本招股说明书签署日，上述贷款尚有 1,536.00 万元未归还。根据合肥鑫城的要求，扬州新瑞连向合肥鑫城提供反担保措施，由扬州新瑞连以其持有的发行人 1,200 万股股份为合肥鑫城就上述贷款提供的连带责任保证提供反担保。

（二）股份质押发生的原因

控股股东相关股份质押主要系为发行人获得银行贷款所提供的增信措施。发行人在设立初期，一直处于亏损状态，且固定资产等持续投资规模较大，发行人有迫切向银行取得固定资产贷款的需求。合肥鑫城系合肥新站高新技术产业开发区国有资产管理局下设的全资子公司，发行人作为合肥市新站区招商引资的高科技企业，合肥鑫城对发行人的固定资产贷款予以担保以支持发行人的经营发展。同时，合肥鑫城作为国有独资公司，要求发行人控股股东提供反担保以控制担保风险，遂发生上述股份质押。

（三）股份质押的影响

发行人财务状况良好，目前已实现盈利，且 2020 年度、2021 年 1-6 月经营活动现金流量净额持续为正，具有相对较好的债务清偿能力。发行人信用记录良好，无法偿还对建设银行龙门支行借款的可能性较小，扬州新瑞连质押的发行人股份被强制处分的可能性较小。

实际控制人郑瑞俊、杨会夫妇合计控制发行人 38.78% 的表决权，其中控股股东扬州新瑞连所持发行人 2,000 万股股份存在质押情形，占发行人总股本的 2.99%，占实际控制人控制的表决权比例较小，因此扬州新瑞连上述股份质押不会影响发行人控制权的稳定。

三、本次发行相关主体作出的重要承诺

本公司提示投资者认真阅读本公司、股东、董事、监事、高级管理人员、核

心技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺以及未能履行承诺的约束措施，具体承诺事项请参见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“六、本次发行相关主体作出的重要承诺”。

四、本次发行完成前滚存利润的分配安排

经本公司上市相关股东大会决议通过：本次公开发行 A 股股票成功后，公司首次公开发行股票前滚存未分配利润由本次公开发行股票完成后的新老股东按照发行后的持股比例共享。

五、财务报告审计截止日后的主要经营情况

财务报告审计截止日至本招股说明书签署日，公司所处集成电路封装测试行业及市场发展情况较好，公司总体经营情况良好，经营模式未发生重大变化；公司客户结构稳定，主要供应商合作情况良好，不存在重大不利变化；公司研发投入、相关税收优惠政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项未发生重大变化。

目 录

重要声明	2
本次发行概况	3
重大事项提示	4
一、特别风险提示.....	4
二、发行人控股股东所持发行人股份存在质押情形.....	6
三、本次发行相关主体作出的重要承诺.....	7
四、本次发行完成前滚存利润的分配安排.....	8
五、财务报告审计截止日后的主要经营情况.....	8
目 录.....	9
第一节 释 义	14
第二节 概 览	25
一、发行人及本次发行的中介机构基本情况.....	25
二、本次发行概况.....	25
三、发行人主要财务数据及财务指标.....	27
四、发行人的主营业务经营情况.....	27
五、发行人技术先进性、研发技术产业化情况以及未来发展战略.....	28
六、发行人符合科创板定位相关情况.....	31
七、发行人选择的具体上市标准.....	32
八、发行人公司治理特殊安排等重要事项.....	32
九、募集资金用途.....	32
第三节 本次发行概况	34
一、本次发行的基本情况.....	34
二、本次发行的有关机构.....	35
三、发行人与有关中介机构的股权关系或其他权益关系.....	36
四、与本次发行上市有关的重要日期.....	37
第四节 风险因素	38
一、技术风险.....	38

二、经营风险.....	39
三、内控风险.....	42
四、财务风险.....	42
五、存在累计未弥补亏损的风险.....	44
六、募集资金投资项目风险.....	44
七、首次公开发行股票摊薄即期回报的风险.....	45
八、发行失败的风险.....	45
第五节 发行人基本情况	46
一、发行人基本情况.....	46
二、发行人设立及报告期内股本和股东变化情况.....	46
三、发行人报告期内的重大资产重组情况.....	68
四、发行人在其他证券市场的上市或挂牌情况.....	68
五、发行人股权结构.....	69
六、发行人控股、参股公司情况.....	69
七、持有发行人 5% 以上股份的股东及实际控制人的基本情况	74
八、发行人股本情况.....	81
九、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员.....	103
十、发行人本次公开发行前制定或实施的股权激励.....	118
十一、发行人的员工及社会保障情况.....	127
第六节 业务与技术	133
一、发行人主营业务、主要产品或服务的情况.....	133
二、发行人所处行业基本情况及其竞争状况.....	147
三、发行人销售情况和主要客户	188
四、发行人原材料采购和主要供应商.....	192
五、发行人主要固定资产、无形资产等资源要素.....	194
六、发行人核心技术及研发情况.....	200
七、发行人境外经营情况.....	225
第七节 公司治理与独立性	226
一、股东大会、董事会、监事会、独立董事和董事会秘书制度的建立健	

全及运行情况.....	226
二、发行人特别表决权股份情况.....	228
三、发行人协议控制架构情况.....	228
四、发行人内部控制情况.....	228
五、发行人报告期内违法违规行及受到处罚的情况.....	231
六、发行人报告期内资金占用和对外担保情况.....	232
七、面向市场独立持续经营的能力情况.....	233
八、同业竞争情况.....	234
九、关联方与关联关系.....	235
十、关联交易情况.....	242
十一、对关联交易决策权力与程序的制度安排.....	250
十二、报告期内关联交易决策程序的执行情况及独立董事对报告期内关联交易发表的意见.....	250
十三、规范和减少关联交易的措施.....	250
第八节 财务会计信息与管理层分析	252
一、注册会计师审计意见.....	252
二、经审计的财务报表.....	252
三、财务报表的编制基础.....	261
四、重要性水平及关键审计事项.....	261
五、发行人产品特点、业务模式、行业竞争程度、外部市场环境等因素及其变化趋势情况，及对未来盈利能力或财务状况可能产生的影响.....	264
六、报告期内采用的重要会计政策和会计估计.....	265
七、财务报告事项.....	276
八、主要财务指标.....	279
九、具有核心意义、或其变化对业绩变动具有较强预示作用的财务或非财务指标.....	281
十、经营成果分析.....	283
十一、资产质量分析.....	323
十二、偿债能力、流动性与持续经营能力分析.....	336

十三、重大资本性支出、重大资产重组或重大股权收购合并事项....	348
十四、资产负债表日后事项、或有事项、其他重要事项及重大担保、诉讼等事项.....	349
十五、盈利预测.....	350
第九节 募集资金运用与未来发展规划	351
一、募集资金运用概况.....	351
二、本次募集资金拟投资项目情况.....	353
三、未来发展规划.....	365
第十节 投资者保护	370
一、发行人投资者关系的主要安排.....	370
二、发行人的股利分配政策和决策程序.....	371
三、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序.....	374
四、发行人股东投票机制的建立情况.....	374
五、特别表决权股份、协议控制的特殊安排.....	376
六、本次发行相关主体作出的重要承诺.....	376
第十一节 其他重大事项	426
一、重要合同.....	426
二、对外担保事项.....	433
三、诉讼或仲裁事项.....	433
四、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员涉及行政处罚、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查的情况.....	433
五、公司控股股东、实际控制人重大违法的情况.....	433
第十二节 声明	434
一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明.....	434
二、发行人控股股东、实际控制人声明.....	437
三、保荐机构（主承销商）声明（一）	438
三、保荐机构（主承销商）声明（二）	439
四、发行人律师声明.....	440
五、承担审计业务的会计师事务所声明.....	441

六、承担评估业务的资产评估机构声明.....	442
七、承担验资业务的会计师事务所声明.....	443
第十三节 附件	444
一、备查文件.....	444
二、查阅时间和地点.....	444
附表一：专利.....	446
附表二：关联担保.....	460

第一节 释义

在本招股说明书中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义：

一、普通名词释义		
汇成股份、发行人、公司、股份公司	指	合肥新汇成微电子股份有限公司
汇成有限	指	合肥新汇成微电子有限公司，发行人前身
江苏汇成	指	江苏汇成光电有限公司，发行人全资子公司
扬州新瑞连	指	扬州新瑞连投资合伙企业（有限合伙），发行人控股股东
嘉兴高和	指	嘉兴高和股权投资基金合伙企业（有限合伙），发行人持股5%以上股东
志道投资	指	安徽志道投资有限公司，发行人持股5%以上股东
汇成投资	指	汇成投资控股有限公司，发行人持股5%以上股东
汇旌投资	指	上海汇旌投资有限公司，江苏汇成历史股东
扬州嘉慧	指	扬州嘉慧投资管理咨询有限公司，发行人历史股东
高投邦盛	指	江苏高投邦盛创业投资合伙企业（有限合伙），发行人持股5%以下股东
金海科贷	指	扬州市金海科技小额贷款有限公司，发行人历史股东
合肥创投	指	合肥市创业投资引导基金有限公司，发行人持股5%以下股东
邦盛聚源	指	南京邦盛聚源投资管理合伙企业（有限合伙），发行人持股5%以下股东
邦盛聚沣	指	南京邦盛聚沣创业投资合伙企业（有限合伙），高投邦盛有限合伙人
邦盛聚泽	指	苏州邦盛聚泽创业投资企业（有限合伙），高投邦盛有限合伙人
瑞成建筑	指	瑞成建筑工程（安徽）有限公司，实际控制人控制的企业
香港宝信	指	宝信国际投资有限公司，一家香港公司，员工持股平台
合肥芯成	指	合肥芯成企业管理咨询合伙企业（有限合伙），员工持股平台
上海宝芯	指	上海宝芯企业管理咨询合伙企业（有限合伙），合肥芯成的前身，员工持股平台
合肥汇芯	指	合肥汇芯企业管理咨询合伙企业（有限合伙），员工持股平台
合肥宝芯	指	合肥市宝芯企业管理咨询合伙企业（有限合伙），员工持股平台
Worth Plus	指	Worth Plus Holdings Limited，一家 BVI 公司，发行人持股5%以下股东
Great Title	指	Great Title Limited，一家 BVI 公司，发行人持股5%以下股东
Win Plus	指	Win Plus Corporation Limited，一家香港公司，发行人持股5%

		以下股东
上海享堃	指	上海享堃科技合伙企业（有限合伙），发行人持股 5% 以下股东
扬州盛畅	指	扬州盛畅科技合伙企业（有限合伙），上海享堃的前身
扬州和安	指	扬州和安商业运营管理合伙企业（有限合伙），发行人持股 5% 以下股东
扬州耕天下	指	扬州耕天下商业运营管理合伙企业（有限合伙），发行人持股 5% 以下股东
Advance	指	Advance Allied Limited，一家塞舍尔公司，发行人持股 5% 以下股东
华得富	指	Huadefu Co Limited，一家香港公司，发行人持股 5% 以下股东
蔚华电子	指	蔚华电子科技（上海）有限公司，发行人持股 5% 以下股东
Spirox	指	Spirox Cayman Corporation，一家开曼公司，蔚华电子之控股股东
蔚华科技	指	蔚华科技股份有限公司，中国台湾上市公司，股票代码：3055.TW，Spirox 之控股股东
国耀汇成	指	合肥国耀汇成股权投资合伙企业（有限合伙），发行人持股 5% 以下股东
鼎祥基金	指	四川鼎祥股权投资基金有限公司，发行人持股 5% 以下股东
旗昌投资	指	深圳市旗昌投资控股有限公司，发行人持股 5% 以下股东
十月吴巽	指	宁波十月吴巽股权投资合伙企业（有限合伙），发行人持股 5% 以下股东
拾岳禾安	指	六安拾岳禾安二期创业投资合伙企业（有限合伙），发行人持股 5% 以下股东
康启一号	指	芜湖康启一号股权投资合伙企业（有限合伙），发行人持股 5% 以下股东
旭鼎一号	指	芜湖旭鼎一号股权投资合伙企业（有限合伙），发行人持股 5% 以下股东
道银投资	指	宁波梅山保税港区道银投资合伙企业（有限合伙），发行人持股 5% 以下股东
惠友豪创	指	深圳市惠友豪创科技投资合伙企业（有限合伙），发行人持股 5% 以下股东
海通新动能	指	辽宁海通新动能股权投资基金合伙企业（有限合伙），发行人持股 5% 以下股东
海通新能源	指	海通新能源私募股权投资管理有限公司，海通新动能执行事务合伙人
海通开元	指	海通开元投资有限公司，海通证券全资子公司，海通新能源股东
昆桥基金	指	昆桥（深圳）半导体科技产业股权投资基金合伙企业（有限合伙），发行人持股 5% 以下股东
语音基金	指	安徽省智能语音及人工智能创业投资合伙企业（有限合伙），

		发行人持股 5% 以下股东
华登基金	指	合肥华登二期集成电路产业投资合伙企业（有限合伙），发行人持股 5% 以下股东
Strong Lion	指	Strong Lion Limited，一家塞舌尔公司，发行人持股 5% 以下股东
瑞成投资	指	瑞成投资控股有限公司，一家香港公司，实际控制人郑瑞俊控制的企业
香港瑞仕	指	香港瑞仕投资控股有限公司，一家香港公司，实际控制人郑瑞俊控制的企业
百瑞发投资	指	百瑞发投资股份有限公司，一家台湾公司，实际控制人郑瑞俊控制的企业
正奇控股	指	正奇控股股份有限公司，间接持股 5% 以上的其他股东
合肥鑫城	指	合肥鑫城国有资产经营有限公司
鑫天虹	指	鑫天虹（厦门）科技有限公司，香港瑞仕持股 10% 的企业
天虹科技	指	天虹科技股份有限公司
LB-Lusem	指	LB-Lusem，韩国上市公司，股票代码：376190.KS，韩国 LG 集团的生态内服务商
Steco	指	Steco，韩国三星集团的生态内服务商
联发科	指	台湾联发科技股份有限公司，中国台湾上市公司，股票代码：2454.TW
联咏科技	指	联咏科技股份有限公司，中国台湾上市公司，股票代码为：3034.TW，发行人客户
中颖电子	指	中颖电子股份有限公司，A 股上市公司，股票代码为：300327.SZ，发行人客户
格科微	指	格科微有限公司，A 股上市公司，股票代码为：688728.SH，发行人客户
明微电子	指	深圳市明微电子股份有限公司，A 股上市公司，股票代码为：688699.SH
华为	指	华为技术有限公司
中兴	指	中兴通讯股份有限公司，A 股上市公司，股票代码为：000063.SZ
捷达微	指	合肥捷达微电子有限公司，系深圳天德钰科技股份有限公司下属全资子公司，发行人客户
奇景光电	指	Himax Technologies Inc，奇景光电股份有限公司，美股上市公司，股票代码为：HIMX.O，发行人客户
天钰科技	指	天钰科技股份有限公司，中国台湾上市公司，股票代码：4961.TW，发行人客户
瑞鼎科技	指	瑞鼎科技股份有限公司，中国台湾上市公司，股票代码：3592.TWO，发行人客户
矽创电子	指	矽创电子股份有限公司，中国台湾上市公司，股票代码：8016.TW，发行人客户
晶门半导体	指	晶门半导体有限公司，中国香港上市公司，股票代码：

		2878.HK, 晶门科技有限公司、晶门科技（中国）有限公司、晶门科技（深圳）有限公司、东莞晶广半导体有限公司之控股股东，发行人客户
京东方	指	京东方科技集团股份有限公司，A 股上市公司，股票代码：000725.SZ，知名面板厂商
华星光电	指	TCL 华星光电技术有限公司，知名面板厂商，其控股股东 TCL 科技集团股份有限公司系 A 股上市公司，股票代码：000100.SZ
维信诺	指	维信诺科技股份有限公司，A 股上市公司，股票代码：002387.SZ，知名面板厂商
深天马	指	天马微电子股份有限公司，A 股上市公司，股票代码：000050.SZ，知名面板厂商
友达光电	指	友达光电股份有限公司，中国台湾上市公司，股票代码：2409.TW，知名面板厂商
惠科股份	指	惠科股份有限公司，知名面板厂商
集创北方	指	北京集创北方科技股份有限公司，知名显示驱动芯片设计公司，发行人客户
吉迪思	指	豪威触控与显示科技（深圳）有限公司，曾用名为深圳吉迪思电子科技有限公司，知名显示驱动芯片设计公司
奕斯伟	指	北京奕斯伟科技集团有限公司，集成电路领域产品和服务提供商
日月光	指	日月光投资控股股份有限公司，中国台湾上市公司，股票代码：3711.TW
Amkor	指	Amkor Technology Inc, 安靠科技，美股上市公司，股票代码：AMKR.O
颀邦科技	指	颀邦科技股份有限公司，中国台湾上市公司，股票代码：6147.TWO
南茂科技	指	南茂科技股份有限公司，中国台湾上市公司，股票代码：8150.TW
长电科技	指	江苏长电科技股份有限公司，A 股上市公司，股票代码：600584.SH
通富微电	指	通富微电子股份有限公司，A 股上市公司，股票代码：002156.SZ
华天科技	指	天水华天科技股份有限公司，A 股上市公司，股票代码：002185.SZ
晶方科技	指	苏州晶方半导体科技股份有限公司，A 股上市公司，股票代码：603005.SH
利扬芯片	指	广东利扬芯片测试股份有限公司，A 股上市公司，股票代码：688135.SH
气派科技	指	气派科技股份有限公司，A 股上市公司，股票代码：688216.SH
颀中科技	指	颀中科技（苏州）有限公司
晶合集成	指	合肥晶合集成电路股份有限公司，知名晶圆制造厂商，位于

		合肥市综合保税区，主要从事面板显示驱动芯片的晶圆代工
田中贵金属	指	田中贵金属（上海）有限公司，发行人供应商，其母公司为田中贵金属工业株式会社，隶属于日本田中贵金属集团
光洋科技	指	光洋应用材料科技股份有限公司，中国台湾上市公司，股票代码：1785.TW，光洋化学应用材料科技（昆山）有限公司与光洋新材料科技（昆山）有限公司之控股股东，发行人供应商
光洋化学	指	光洋化学应用材料科技（昆山）有限公司
利机股份	指	利机企业股份有限公司，中国台湾上市公司，股票代码：3444.TWO，发行人供应商
昇云半导体	指	昇云半导体科技（香港）有限公司，发行人供应商
怡康化工	指	上海怡康化工材料有限公司，发行人供应商，系中国台湾上市公司华立企业股份有限公司（3010.TW）集团内企业，是光刻胶领域巨头日本合成橡胶株式会社在中国大陆的代理商之一
迪思科科技	指	迪思科科技（中国）有限公司，发行人供应商。其控股股东 DISCO CORPORATION 系日本上市公司（6146.T），主要从事半导体制造设备、精密加工工具的制造和销售业务
京隆科技	指	京隆科技（苏州）有限公司，发行人供应商。其隶属于中国台湾上市公司京元电子股份有限公司（2449.TW）
伊藤忠	指	ITOCHU PLASTICS INC.，发行人供应商。其控股股东伊藤忠商事株式会社系日本上市公司（8001.T），业务范围广泛，涉及化工品、金属和能源等多领域
ADVANTEST	指	ADVANTEST CORPORATION，日本上市公司，（6857.T），是国际知名半导体测试设备供应商
《瓦森纳协定》	指	《关于常规武器和两用物品及技术出口控制的瓦森纳协定》，1996年7月以西方国家为主的33个国家在奥地利维也纳签署，目前共有包括美国、日本、英国、俄罗斯等40个成员国
《实体清单》	指	美国商务部针对中国企业、学术机构等组织公布的动态调整的出口管制实体清单，美国企业对清单内企业、机构及个人出口或转口受《出口管制条例》管制的产品需向美国商务部申请许可
WSTS	指	World Semiconductor Trade Statistics，世界半导体贸易统计协会，总部位于美国加利福尼亚州圣何塞市的非盈利组织，拥有超过深厚的全球半导体市场数据服务经验
中国半导体行业协会	指	由全国半导体界从事集成电路、半导体分立器件、半导体材料和设备的生产、设计、科研、开发、经营、应用、教学的单位、专家及其它相关的支撑企、事业单位自愿结成的行业性的全国性的非营利性的社会组织
Frost & Sullivan	指	弗若斯特沙利文公司，成立于1961年，总部位于美国纽约，是一家独立的国际咨询公司，在全球设立45个办公室，拥有超过2,000名咨询顾问，为多家全球1,000强公司、新兴企业和投资机构提供了市场投融资及战略与管理咨询服务

《公司章程》	指	合肥新汇成微电子股份有限公司现行章程
本次发行	指	发行人本次申请在上海证券交易所科创板发行并上市的行为
A 股	指	在中国境内证券交易所上市、以人民币标明面值、以人民币认购
合肥市国资委	指	合肥市人民政府国有资产监督管理委员会
保荐机构、保荐人、主承销商、海通证券	指	海通证券股份有限公司
发行人律师、天禾律师	指	安徽天禾律师事务所
审计机构、验资机构、天健会计师	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
资产评估机构、坤元评估	指	坤元资产评估有限公司
报告期、三年及一期	指	2018 年度、2019 年度、2020 年度和 2021 年 1-6 月
报告期各期末	指	2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日和 2021 年 6 月 30 日
同行业可比公司	指	同行业可比 A 股上市公司，为实现财务数据的可比性，不包括境外上市公司
元、万元	指	人民币元、万元
二、专业术语释义		
集成电路、芯片、IC	指	Integrated Circuit 的缩写，即集成电路，是一种将电路所需元器件及布线互连，集成在基片上并封装成具有所需电路功能的微型结构
吋	指	英寸的缩写，一寸等于 2.54 厘米
晶圆	指	制作硅半导体电路所用的硅晶片，由高纯度的硅晶棒研磨、抛光、切片后形成
调节器	指	将生产过程参数的测量值与给定值进行比较，得出偏差后输出信号推动执行器消除偏差量的控制原件
功率晶体管	指	一种高反压双极性大功率晶体模块，可作为放大器或半导体开关
扩展摩尔	指	通过将不同功能的芯片和元件组装拼接在一起封装，实现提升芯片功能的目的
延续摩尔	指	通过改变相关器件的结构和布局来实现不同功能的电子元件按设计组合成一块芯片
Bumping	指	在芯片上制作凸块，通过在芯片表面制作金属凸块提供芯片电气互连的“点”接口，反应了先进制程以“以点代线”的发展趋势，广泛应用于 FC、WLP、CSP、3D 等先进封装
Gold Bumping	指	金凸块制造，是一种利用金凸块接合替代引线键合实现芯片与基板之间电气互联的制造技术
CP	指	Chip Probing 的缩写，即晶圆测试，是一道用探针对每个晶粒上的接点进行接触测试其电气特性，标记出不合格的晶粒的工序
COG	指	Chip on Glass 的缩写，即玻璃覆晶封装，是一种将芯片直接

		绑定在玻璃上的封装技术
COF	指	Chip on Film/Flex 的缩写，即薄膜覆晶封装，是一种将芯片绑定在软性基板电路上的封装技术
引脚	指	集成电路内部电路与外围电路的接线
pin	指	指探针，连接晶圆管脚和探针卡的金属针
铝垫	指	金属铝制作的晶圆内部电路电信号输入输出的端口，即晶圆管脚
探针	指	一种测试接口，通过电气连接对芯片参数进行测试
I/O	指	Input/Output 的缩写，即输入输出端口
靶材	指	通过溅射在基板上形成各种功能薄膜的溅射源
电镀液	指	可以扩大金属的阴极电流密度范围、改善镀层的外观、增加溶液抗氧化的稳定性等特点的液体
光刻胶	指	在光线照射下，溶解度发生变化的耐蚀剂刻薄膜材料
UV	指	Ultraviolet, 紫外线
Tray 盘	指	晶粒盘，是用于承托晶粒（芯片）的托盘
ACF	指	Anisotropic Conductive Film 的缩写，异方性导电胶膜
电感	指	电感是一个物理量，用于描述由于线圈电流变化，在本线圈中或在另一线圈中引起感应电动势效应的电路参数
ITO	指	氧化铟锡，主要用于制作液晶显示器、平板显示器、有机发光二极管、各种光学镀膜
模组	指	由数个基础功能组件组成的特定功能组件，可用来组成具完整功能之系统、设备或程序
LCD	指	Liquid Crystal Display 的缩写，即液晶显示，是一种借助于薄膜晶体管驱动的有源矩阵液晶显示技术
OLED	指	Organic Light-Emitting Diode 的缩写，即有机发光二极管，属于一种电流型的有机发光显示技术
AMOLED	指	Active-Matrix Organic Light-Emitting Diode 的缩写，即有源矩阵有机发光二极管，其中 OLED（有机发光二极管）是描述薄膜显示技术的具体类型，AM（有源矩阵体或称主动式矩阵体）是指背后的像素寻址技术
Micro LED	指	Micro Light-Emitting Diode 的缩写，指微型发光二极管，高密度集成的 LED 阵列
COD	指	Chemical Oxygen Demand 的缩写，即化学需氧量，能被强氧化剂氧化的物质的氧当量，是污水管理中的一个有机物污染参数
SS	指	Suspended Solids 的缩写，即悬浮物，包括不溶于水中的无机物、有机物及泥砂、黏土、微生物等，衡量水污染程度的指标之一
4K	指	3840*2160 分辨率，属于超高清分辨率
8K	指	7680*4320 分辨率，为 4K 的 4 倍
IDM	指	Integrated Device Manufacture 的缩写，即整合设备制造，集

		芯片设计、制造、封装测试等多个环节于一身的模式
Fabless	指	仅进行芯片的设计、研发和销售，而将晶圆制造、封装和测试外包给专业的晶圆代工、封装测试厂商的经营模式
Foundry	指	专门负责晶圆制造的代工厂
OSAT	指	Outsourced Semiconductor Assembly and Testing 的缩写，即半导体封装测试外包，专门负责封装测试的代工厂
CCD	指	Charge-Coupled Device 的简写，由光电耦合器件构成，用于光学成像
CMOS	指	Complementary Metal Oxide Semiconductor 的缩写，即互补金属氧化物半导体，指制造大规模集成电路芯片用的一种技术或用这种技术制造出来的芯片
CMOS 图像传感器、CIS	指	采用 CMOS 工艺制造的图像传感器，CIS 是 CMOS Image Sensor 的简称
5G	指	5th Generation Mobile Networks，即第五代移动通信技术，是在商用的最新一代蜂窝移动通信技术
FC、Flip Chip	指	一种封装技术，FC 系 Flip Chip 的缩写，即倒装芯片封装工艺，在芯片上制作凸点，然后翻转芯片用回流焊等方式使凸点和 PCB、引线框等衬底相连接，电性能和热性能比较好，封装体可以做的比较小
WLCSP	指	一种封装技术，Wafer Level Chip Scale Packaging 的缩写，晶圆片级芯片规模封装，此技术是先在整片晶圆上进行封装测试，其后再切割成单个芯片
SoC	指	一种封装技术，System on Chip 的缩写，即系统级单芯片封装，是一个有专用目标的集成电路，其中包含完整系统并有嵌入软件的全部内容
MEMS	指	一种封装技术，Micro-Electro-Mechanical Systems 的缩写，微机电系统，是集微传感器、微执行器、微机械结构、微电源、微能源、信号处理和电路、高性能电子集成器件、接口、通信等于一体的微型器件或系统
TSV	指	一种封装技术，Through Silicon Via 的缩写，即晶圆级系统封装-硅通孔，是一种通过硅通道垂直穿过组成堆栈的不同芯片或不同层实现不同功能芯片集成的封装技术
Fan-Out	指	一种封装技术，扇外型集成电路封装，指基于晶圆重构技术，将芯片重新埋置到晶圆上，然后按照与标准 WLP 工艺类似的步骤进行封装，得到的实际封装面积要大于芯片面积，在面积扩展的同时也可以增加其它有源器件及无源元件形成 SiP
TO	指	一种封装技术，Transistor Outlin 的缩写，即晶体管封装，插入式封装之一，较早期的封装形式
DIP	指	一种封装技术，Dual In-line Package 的缩写，即双列直插式封装，插装型封装之一，引脚从封装两侧引出
CDIP	指	一种封装技术，Ceramic Dual In-line Package 的缩写，即陶瓷双列直插封装，一种 DIP 封装，芯片封装材料为陶瓷
PDIP	指	一种封装技术，Plastic Dual In-Line Package 的缩写，即塑料

		双列直插式封装，是一种 DIP 封装，芯片封装材料为塑料
SIP	指	一种封装技术，Single In-line 的缩写，即单列直插式封装，引脚从封装一个侧面引出，排列成一条直线，当装配到印刷基板上时封装呈侧立状
PLCC	指	一种封装技术，Plastic Leaded Chip Carrier 的缩写，即塑料有引线片式载体封装，表面贴装型封装形式之一，是一种带引线、塑料的芯片封装载体，引脚从封装的四个侧面引出，呈“丁”字形，外形尺寸比 DIP 封装小得多
QFP	指	一种封装技术，Quad Flat Package 的缩写，即方型扁平式封装，表面贴装型封装之一，引脚从四个侧面引出呈海鸥翼型
PQFP	指	一种封装技术，Plastic Quad Flat Package 的缩写，即塑料四边引线扁平封装，是一种 QFP 封装，芯片封装材料为塑料
SOP	指	一种封装技术，Small Outline Package 的缩写，即小外形表面封装，表面贴装型封装之一，引脚从封装两侧引出呈海鸥翼状（L 字形）
SOT	指	一种封装技术，Small Outline Transistor 的缩写，即小外形晶体管封装，一种 SOP 系列封装
QFN	指	一种封装技术，Quad Flat No-lead Package 的缩写，即方形扁平无引脚封装，封装四侧配置有电极触点，由于无引脚，贴装占有面积比 QFP 小，高度比 QFP 低
PQFN	指	一种封装技术，Power Quad Flat No-lead Package 的缩写，即功率方形扁平无引脚封装，是一种基于 QFN 封装的热性能增强版本，在四周底侧装有金属化端子
BGA	指	一种封装技术，Ball Grid Array Package 的缩写，即球栅阵列封装，圆形或柱状的焊点按阵列形式分布在基板下面的封装形式
PBGA	指	一种封装技术，Plastic Ball Grid Array Package 的缩写，即塑料焊球阵列封装，是一种 BGA 封装，芯片封装材料为塑料
CBGA	指	一种封装技术，Ceramic Plastic Ball Grid Array Package 的缩写，即陶瓷焊球阵列封装，是一种 BGA 封装，芯片封装材料为陶瓷
EBGA	指	一种封装技术，Enhanced Plastic Ball Grid Array Package 的缩写，即带散热器焊球阵列封装，是一种 BGA 封装，具有低功耗和高散热效果的特点
FC-BGA	指	一种封装技术，Flip Chip Ball Grid Array 的缩写，即倒装芯片焊球阵列封装，是图形加速芯片最主要的封装格式
LGA	指	一种封装技术，Land Grid Array 的缩写，即栅格阵列封装，是一种 BGA 封装
WLP	指	一种封装技术，Wafer Level Packaging 的缩写，即晶圆级封装，一般指直接在晶圆上进行大多数或是全部的封装测试程序，之后再行切割(Singulation)制成单颗组件的封装技术
CSP	指	一种封装技术，Chip Size Package 的缩写，即芯片级封装，是最新一代的内存芯片封装技术，可以让芯片面积与封装面

		积之比超过 1:1.14
MCM	指	一种封装技术，Multi-Chip Module 的缩写，即多芯组装，一种将多块半导体裸芯片组装在一块布线基板上的封装形式
SiP	指	一种封装技术，System In a Package的缩写，系统级封装，是将多种功能芯片和无源器件，包括处理器、存储器等功能芯片集成在一个封装内，实现一定功能的单个标准封装件，从而形成一个系统或者子系统
3D	指	一种封装技术，三维立体封装，是在2D的基础上进一步向Z方向发展的微电子组装高密度化封装形式，主要有埋置型、有源基板型与叠层型三种类型
TCP	指	一种封装技术，Tape Carrier Package的缩写，即带载封装技术，是LCD模块组装工序中封装有驱动芯片的TAB（Tape Automated Bonding带式自动组装）的一种封装方式
JEDEC 标准	指	半导体产业领导标准机构固态技术协会（JEDEC）指定的关于半导体行业产品性能、技术水平的行业标准
CIP	指	一种国际贸易交货方式，Carriage and Insurance Paid to的缩写，即卖方向其指定的承运人交货，期间卖方必须支付将货物运至目的地的运费，并办理买方货物在运输途中灭失或损坏风险的保险
FOB	指	一种国际贸易交货方式，Free On Board (named port of shipment)的缩写，即船上交货（指定装运港），又称离岸价，适用于海上和内河运输。
CIF	指	一种国际贸易交货方式，Cost, Insurance, and Freight (named port of destination)的缩写，中文译名是成本加保险费加运费（指定目的港），通常包含离岸价、到目的港的保险费和海运运费，适用于海上和内河运输。
DDU	指	一种国际贸易交货方式，Delivered Duty Unpaid的缩写，即未完税交货（指定目的地），卖方负责租订运输工具，在规定的时间内将已清关货物运抵指定的目的地，在运输工具上交货并承担交货前的费用、风险
DAP	指	一种国际贸易交货方式，Delivered at Place的缩写，即目的地交货，是指卖方已经用运输工具把货物运送到买方指定的目的地后，将装在运输工具上的货物（不用卸载）交由买方处置，即完成交货
EXW	指	一种国际贸易交货方式，EX Works的缩写，即工厂交货，卖方负有在其所在地即车间、工厂、仓库等把备妥的货物交付给买方的责任，但通常不负责将货物装上买方准备的车辆或办理货物结关
牛鞭效应	指	营销过程中的需求变异放大现象被通俗地称为“牛鞭效应”，指供应链上的信息流从最终客户向原始供应商端传递时候，由于无法有效地实现信息的共享，使得信息扭曲而逐渐放大，导致了需求信息出现越来越大的波动

本招股说明书中部分合计数与各单项数据之和在尾数上可能存在差异，这些差异是由于四舍五入原因所致。

第二节 概览

本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。

一、发行人及本次发行的中介机构基本情况

(一) 发行人基本情况			
发行人名称	合肥新汇成微电子股份有限公司	成立日期	2015年12月18日
注册资本	66,788.2625万元	法定代表人	郑瑞俊
注册地址	合肥市新站区合肥综合保税区内	主要生产经营地址	合肥市新站区合肥综合保税区内
控股股东	扬州新瑞连投资合伙企业（有限合伙）	实际控制人	郑瑞俊、杨会
行业分类	计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）	在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况	无
(二) 本次发行的有关中介机构			
保荐人	海通证券股份有限公司	主承销商	海通证券股份有限公司
发行人律师	安徽天禾律师事务所	其他承销机构	无
审计机构/验资机构	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	评估机构	坤元资产评估有限公司

二、本次发行概况

(一) 本次发行的基本情况

股票种类	人民币普通股（A股）		
每股面值	人民币1.00元		
发行股数	不超过222,627,542股（行使超额配售选择权之前）	占发行后总股本比例	不低于10%，不超过25%（行使超额配售选择权之前）
其中：发行新股数量	不超过222,627,542股（行使超额配售选择权之前）	占发行后总股本比例	不低于10%，不超过25%（行使超额配售选择权之前）
股东公开发售股份数量	不适用	占发行后总股本比例	不适用
发行后总股本	不超过890,510,167股（行使超额配售选择权之前）		
每股发行价格	【 】元		
战略配售情况	本次发行及上市拟采用战略配售，战略配售的对象包括但不限于保荐机构相关子公司、公司的高级管理人员与核心员工依法		

	设立的专项资产管理计划等，具体安排参照上海证券交易所相关规定执行。相应战略配售的对象后续将进一步明确参与本次发行战略配售的具体方案，并按规定向上海证券交易所提交相关文件并依法披露。		
发行市盈率	【 】倍		
发行前每股净资产	【 】元	发行前每股收益	【 】元
发行后每股净资产	【 】元	发行后每股收益	【 】元
发行市净率	【 】倍		
发行方式	本次发行将采取网下向询价对象申购配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的发行方式，或证券监管部门认可的其他发行方式		
发行对象	符合资格的询价对象和在中国证券登记结算有限公司开立账户的合格投资者或证券监管部门认可的其他发行对象		
承销方式	余额包销		
拟公开发售股份股东名称	不适用		
发行费用的分摊原则	本次发行的保荐费、承销费、审计及验资费、律师费、信息披露费、发行手续费等其他费用均由公司承担		
募集资金总额	【 】万元		
募集资金净额	【 】万元		
募集资金投资项目	12吋显示驱动芯片封测扩能项目		
	研发中心建设项目		
	补充流动资金		
发行费用概算	保荐及承销费用	【 】万元	
	审计及验资费	【 】万元	
	律师费用	【 】万元	
	与本次发行相关的信息披露费用	【 】万元	
	发行手续费等其他费用	【 】万元	

（二）本次发行上市的重要日期

刊登发行公告日期	【 】年【 】月【 】日
开始询价推介日期	【 】年【 】月【 】日
刊登定价公告日期	【 】年【 】月【 】日
申购日期和缴款日期	【 】年【 】月【 】日
股票上市日期	【 】年【 】月【 】日

三、发行人主要财务数据及财务指标

根据天健会计师事务所出具的标准无保留意见的《审计报告》（天健审〔2021〕10318号），报告期内发行人主要财务数据及财务指标如下：

项目	2021.6.30/ 2021年1-6月	2020.12.31/ 2020年度	2019.12.31/ 2019年度	2018.12.31/ 2018年度
资产总额（万元）	183,170.63	174,990.63	155,189.88	118,617.90
归属于母公司所有者权益（万元）	130,695.86	114,247.09	19,891.90	22,427.35
资产负债率（母公司）（%）	23.71	27.71	71.41	61.10
营业收入（万元）	35,875.90	61,892.67	39,420.66	28,558.35
净利润（万元）	5,881.79	-400.50	-16,402.95	-10,708.02
归属于母公司所有者的净利润（万元）	5,881.79	-400.50	-16,402.95	-10,708.02
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）	3,106.38	-4,190.82	-14,953.45	-11,545.62
基本每股收益（元）	0.09	/	/	/
稀释每股收益（元）	0.09	/	/	/
加权平均净资产收益率（%）	4.68	-0.96	-94.43	-39.16
经营活动产生的现金流量净额（万元）	13,457.43	15,109.00	-2,238.90	-1,559.50
现金分红（万元）	-	-	-	-
研发投入占营业收入的比例（%）	8.08	7.62	11.52	13.26

四、发行人的主营业务经营情况

公司是集成电路高端先进封装测试服务商，目前聚焦于显示驱动芯片领域，具有领先的行业地位。公司主营业务以前段金凸块制造（Gold Bumping）为核心，并综合晶圆测试（CP）及后段玻璃覆晶封装（COG）和薄膜覆晶封装（COF）环节，形成显示驱动芯片全制程封装测试综合服务能力。公司的封装测试服务主要应用于LCD、AMOLED等各类主流面板的显示驱动芯片，所封装测试的芯片系日常使用的智能手机、智能穿戴、高清电视、笔记本电脑、平板电脑等各类终端产品得以实现画面显示的核心部件。

公司是中国境内最早具备金凸块制造能力，及最早导入 12 吋晶圆金凸块产线并实现量产的显示驱动芯片先进封测企业之一，具备 8 吋及 12 吋晶圆全制程封装测试能力。2020 年度，公司显示驱动芯片封装出货量在全球显示驱动芯片封测领域排名第三，在中国境内排名第一，具有较强的市场竞争力。

公司在显示驱动芯片封装测试领域深耕多年，凭借先进的封测技术、稳定的产品良率与优质的服务能力，积累了丰富的客户资源。公司服务的客户包括联咏科技、天钰科技、瑞鼎科技、奇景光电等全球知名显示驱动芯片设计企业，所封测芯片已主要应用于京东方、友达光电等知名厂商的面板。2020 年度全球排名前五显示驱动芯片设计公司中三家系公司主要客户，2020 年度中国排名前十显示驱动芯片设计公司中九家系公司主要客户。

目前公司及子公司均已实现量产，并且基于多年的建设经营以及产能的转化，公司销售规模快速扩张，报告期内，公司主营业务收入均来自于对显示驱动芯片的封装测试，具体情况如下：

单位：万元

封测芯片种类	2021 年 1-6 月		2020 年度		2019 年度		2018 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
显示驱动芯片	34,987.81	100.00%	57,504.79	100.00%	37,001.73	100.00%	26,796.12	100.00%
合计	34,987.81	100.00%	57,504.79	100.00%	37,001.73	100.00%	26,796.12	100.00%

五、发行人技术先进性、研发技术产业化情况以及未来发展战略

（一）技术先进性

公司自创立以来始终坚持以技术创新为核心驱动力，致力于先进封装技术的研究与应用，深耕显示驱动芯片封装测试领域多年，在研发活动与生产制造过程中积累了大量非专利核心工艺与众多拥有自主知识产权的核心技术，在行业中具有领先地位。公司在高端先进封装领域拥有微间距驱动芯片凸块制造技术、高精度晶圆研磨薄化技术、高稳定性晶圆切割技术、高精度高效内引脚接合工艺、晶圆高精度稳定性测试技术等多项较为突出的先进技术与优势工艺，该部分技术在行业内处于发展的前沿，拥有较高的技术壁垒。

公司所掌握的凸块制造技术（Bumping）是高端先进封装的代表性技术之一，通过光刻与电镀环节在芯片表面制作金属凸块提供芯片电气互连的“点”接口，实现了封装领域以“以点代线”的技术跨越。公司目前在显示驱动芯片领域中应用的金凸块制造工艺可在单颗长约30mm、宽约1mm芯片上生成4,000余金凸块，在12吋晶圆上生成900万余金凸块，可实现金凸块宽度与间距最小至6 μm ，并且把整体高度在15 μm 以下的数百万金凸块高度差控制在2.5 μm 以内。公司通过凸块制造“以点代线”的技术创新，以几何倍数提高了单颗芯片引脚数的物理上限，进而大幅提高了芯片封装的集成度、缩小了模组体积。

公司一直专注于高端先进封装技术，主要封装工艺为玻璃覆晶封装（COG）和薄膜覆晶封装（COF），应用于显示驱动芯片封测领域，两者均使用高密度、细间距的倒装凸点互连芯片封装技术。公司上述工艺基于前沿的倒装芯片（FC）封装技术，结合自身生产工艺与设备进行优化，所封测的产品拥有I/O密度高、尺寸小、运算速度快、可靠性高和经济性佳等优势。公司研发的高精度晶圆研磨薄化技术可微量控制0.1 μm 等级的抛磨技术；提出的晶圆研磨前裂片异常处理方法可有效避免晶圆材料的浪费并保障产品良率；拥有的高精度高效内引脚接合工艺结合了高精度高可靠的芯片识别与挑拣、微米级的凸块定位与键合等技术，可实现单颗芯片上数以千计的金凸块与柔性基板上对应的内引脚精准、高效键合。

截至本招股说明书签署日，公司拥有259项专利和2项软件著作权，其中发明专利15项。自成立以来，公司对显示驱动芯片封装测试领域核心技术的发展持续关注并深入研究开发，通过不断加大技术研究和产品开发投入力度，对公司的工艺流程和产品技术不断进行改进和创新，公司的技术水平在行业中处于领先地位。

（二）研发技术产业化情况

公司在显示驱动芯片封测领域深耕多年，主营业务以前段金凸块制造（Gold Bumping）为核心，并综合晶圆测试（CP）及后段玻璃覆晶封装（COG）和薄膜覆晶封装（COF）环节，已形成显示驱动芯片全制程封装测试综合服务能力。

自成立以来，公司始终坚持以自主创新驱动发展，注重显示驱动芯片封装测试技术的产研融合。随着行业和技术进步，公司基于子公司江苏汇成所从事的

8 吋晶圆封装测试服务，前瞻性对 12 吋晶圆封装测试业务进行布局，是中国大陆最早导入 12 吋晶圆金凸块产线并实现量产的显示驱动芯片先进封测企业之一，具备 8 吋及 12 吋晶圆全制程封装测试能力。公司的封装测试工艺主要应用于 LCD、AMOLED 等各类主流面板的显示驱动芯片，所封装测试的芯片系日常使用的智能手机、智能穿戴、高清电视、笔记本电脑、平板电脑等各类终端产品得以实现画面显示的核心部件。

公司所掌握的微间距驱动芯片凸块制造技术等多项核心技术已实现产业化并形成核心技术产品收入，且为响应国家政策号召、紧抓行业发展机遇积极进行扩产，持续购置生产设备。报告期内，公司分别实现核心技术产品收入 26,796.12 万元、37,001.73 万元、57,504.79 万元与 34,987.81 万元，占营业收入比例为 93.83%、93.86%、92.91%与 97.52%，2018 年至 2020 年核心技术产品收入年均复合增长率达 46.49%。未来，公司将结合下游产品需求变化趋势合理安排规划产能，保持收入规模的稳健快速增长。

2020 年度，公司显示驱动芯片封装出货量在全球显示驱动芯片封测行业排名第三、在中国境内排名第一。公司正在逐步实现显示驱动芯片封装测试领域的进口替代，有效提高了中国大陆显示驱动芯片封装测试行业的自主产研水平。

（三）未来发展战略

集成电路产业是国家科技发展战略的重点之一，是彰显一个国家科技进步水平的先导产业，是先进制造、高端制造、智能制造的战略基础产业，在国民经济中有着十分重要的地位。公司以成为国内领先、世界一流的高端芯片封装测试服务商为愿景，以提升中国集成电路产业的全球竞争力为使命。未来，公司将依托核心优势、发挥管理团队和技术团队主观能动性，不断提升先进封装技术水平，引进不同的封装工艺，优化现有工艺的流程与效率，紧跟产品应用需求，开拓更为广阔的应用领域。

在技术研发方面，随着集成电路尺寸不断减小，摩尔定律逼近极限，技术瓶颈在制约工艺的发展，扩展摩尔与延续摩尔是目前业界认可较为容易实现突破的两大发展方向，其中，扩展摩尔是指通过将不同功能的芯片和元件组装拼接在一起封装以实现芯片功能提升的目的，倒装芯片封装工艺（FC）、扇外型集成电

路封装（Fan-out）、晶圆片级芯片规模封装（WLCSP）、2.5D/3D、系统级封装（SiP）等先进封装形式将极大程度的影响扩展摩尔能否在后摩尔时代实现突破。发行人所拥有的凸块制造（Bumping）工艺是实现前述先进封装工艺的关键技术，发行人目前已掌握倒装芯片封装工艺（FC）技术并成功实现产业化，未来将不断拓展技术边界，积极布局 Fan-out、2.5D/3D、SiP 等高端先进封装技术，为突破行业技术瓶颈奠定坚实的基础。

在产业化方面，公司将在保证封装测试服务质量的前提下，积极扩充 12 吋大尺寸晶圆的先进封装测试服务能力，并以市场为导向、技术为支撑大力拓展产品线，进军 CMOS 影像传感器、车载电子等新兴产品的芯片封测领域，不断跟随市场趋势丰富产品结构、提升产业链资源整合能力，为客户带来更全面、更优质的服务。

六、发行人符合科创板定位相关情况

（一）发行人符合科创板行业领域

发行人主营业务为显示驱动芯片的先进封装测试服务，属于集成电路制造业中的集成电路封装测试业，集成电路封装测试行业符合《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》（2021 年修订）中第四条第（一）款规定的新一代信息技术领域。

（二）发行人符合科创属性要求

发行人同时符合《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》（2021 年修订）第五条科创属性规定的 4 项指标，符合科创板定位，具体指标情况如下：

科创属性评价标准一	是否符合	指标情况
最近三年累计研发投入占最近三年累计营业收入比例≥5%，或最近三年累计研发投入金额≥6,000 万元	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	最近三年，公司研发投入分别为 3,787.27 万元、4,542.64 万元和 4,715.21 万元，最近三年累计研发投入金额为 13,045.12 万元，超过 6,000 万元；最近三年累计研发投入占最近三年累计营业收入的比例为 10.04%，超过 5%
研发人员占当年员工总数的比例>10%	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	截至 2020 年 12 月 31 日，研发人员占当年员工总数比例为 16.99%，超过 10%

科创属性评价标准一	是否符合	指标情况
形成主营业务收入的发明专利（含国防专利）≥5项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	形成主营业务收入的产品涉及15项发明专利，超过5项
最近三年营业收入复合增长率≥20%，或最近一年营业收入金额≥3亿	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	最近三年，公司营业收入分别为28,558.35万元、39,420.66万元、61,892.67万元，复合增长率为47.22%，超过20%；2020年实现营业收入61,892.67万元，超过3亿元

七、发行人选择的具体上市标准

公司根据《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》的要求，结合企业自身规模、经营情况、盈利情况、估值情况等因素综合考量，选择的具体上市标准为第四套标准：“预计市值不低于人民币30亿元，且最近一年营业收入不低于人民币3亿元。”

公司2020年度实现营业收入61,892.67万元，结合最近一次外部股权融资情况、可比公司的市场估值情况，发行人预计将满足上述上市标准。

八、发行人公司治理特殊安排等重要事项

截至本招股说明书签署日，发行人在公司治理中不存在特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排等需要披露的重要事项。

九、募集资金用途

本次公开发行所募集的资金主要投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资预算总额	募集资金投资总额	实施主体
1	12吋显示驱动芯片封测扩能项目	97,406.15	97,406.15	汇成股份
2	研发中心建设项目	8,980.84	8,980.84	汇成股份
3	补充流动资金	50,000.00	50,000.00	汇成股份
合计		156,386.99	156,386.99	

若本次募集资金不能满足上述拟投资项目的资金需求，公司将通过自筹方式解决资金缺口；如本次发行实际募集资金超过投资项目所需，公司将按照资金状况和募集资金管理制度，将多余部分用于与主营业务相关的项目，继续加大生产、

研发等方面的投入。本次发行募集资金到位前，公司将根据实际经营需要以自筹资金对上述项目进行前期投入，募集资金到位后，将按照《募集资金管理制度》的要求予以置换。

本次募集资金运用详细情况请参见本招股说明书“第九节 募集资金运用与未来发展规划”。

第三节 本次发行概况

一、本次发行的基本情况

股票种类	人民币普通股（A股）	
每股面值	人民币 1.00 元	
发行股数及其占发行后总股本的比例	发行人本次发行的股份数量不超过 222,627,542 股（行使超额配售选择权之前），不低于本次发行后总股本的 10%，不超过本次发行后总股本的 25%（行使超额配售选择权之前），并授予主承销商不超过前述发行的人民币普通股（A股）股数 15%的超额配售选择权	
每股发行价格	人民币【 】元	
战略配售情况	本次发行及上市拟采用战略配售，战略配售的对象包括但不限于保荐机构相关子公司、公司的高级管理人员与核心员工依法设立的专项资产管理计划等，具体安排参照上海证券交易所相关规定执行。相应战略配售的对象后续将进一步明确参与本次发行战略配售的具体方案，并按规定向上海证券交易所提交相关文件并依法披露。	
发行市盈率	【 】倍（每股发行价格除以每股收益，每股收益照【 】年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）	
发行后每股收益	【 】倍（按【 】年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）	
发行前每股净资产	【 】元（按公司【 】年【 】月【 】日经审计的归属于母公司所有者权益除以本次发行前总股本计算）	
发行后每股净资产	【 】元（按本次发行后归属于母公司所有者权益除以发行后总股本计算，其中，发行后归属于母公司所有者权益按公司【 】年【 】月【 】日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次募集资金净额之和计算）	
发行市净率	【 】倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算）	
发行方式	本次发行将采取网下向询价对象申购配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的发行方式，或证券监管部门认可的其他发行方式。	
发行对象	符合资格的询价对象和在中国证券登记结算有限公司开立账户的合格投资者或证券监管部门认可的其他发行对象。	
承销方式	余额包销	
发行费用概算	保荐及承销费用	【 】万元
	审计及验资费	【 】万元
	律师费用	【 】万元
	与本次发行相关的信息披露费用	【 】万元
	发行手续费等其他费用	【 】万元

二、本次发行的有关机构

（一）保荐人（主承销商）

机构名称	海通证券股份有限公司
法定代表人	周杰
住所	上海市广东路 689 号
联系电话	021-23219000
传真号码	021-63411627
保荐代表人	何立、吴俊
项目协办人	赵子馨
项目其他经办人员	张鹏、奚颢、叶晟、邢丞栋、张岩、李倩、邓欣、张旭鸿

（二）律师事务所

机构名称	安徽天禾律师事务所
机构负责人	卢贤榕
住所	合肥市庐阳区濉溪路 278 号财富广场 B 座东区 16 层
联系电话	0551-62642792
传真号码	0551-62620450
经办律师	卢贤榕、陈磊、孙静

（三）会计师事务所

机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
机构负责人	王国海
住所	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
联系电话	0571-88216888
传真号码	0571-88216999
经办注册会计师	向晓三、许红瑾

（四）资产评估机构

机构名称	坤元资产评估有限公司
法定代表人	俞华开
住所	杭州市西溪路 128 号 901 室
联系电话	0571-87559001

传真号码	0571-87178826
经办资产评估师	潘文夫、章波

（五）验资机构

机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
机构负责人	王国海
住所	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼
联系电话	0571-88216888
传真号码	0571-88216999
经办注册会计师	向晓三、许红瑾

（六）拟上市的证券交易所

机构名称	上海证券交易所
住所	上海市浦东新区浦东南路 528 号证券大厦
联系电话	021-68808888
传真号码	021-68804868

（七）股票登记机构

机构名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
住所	上海市浦东新区杨高南路 188 号
联系电话	021-68870204
传真号码	021-58899400

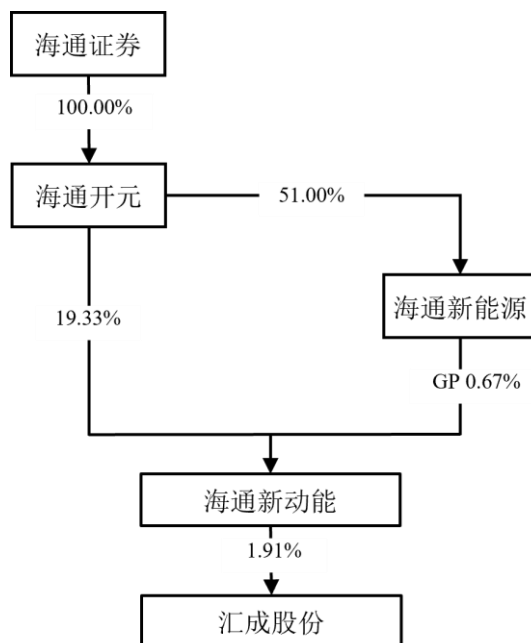
（八）收款银行

机构名称	【 】
户名	【 】
账号	【 】

三、发行人与有关中介机构的股权关系或其他权益关系

海通新动能共持有发行人 1.91% 股份。海通开元投资有限公司（以下简称“海通开元”）系保荐机构全资子公司，海通开元持有海通新能源 51.00% 股权，海通新能源系海通新动能执行事务合伙人并持股 0.67%；海通开元另持有海通新动

能 19.33% 股权。因此，保荐机构全资子公司海通开元通过海通新动能间接持有发行人 0.37% 的股份，通过海通新能源间接持有发行人 0.01% 的股份，保荐机构合计持有发行人 0.38% 的股份。



除上述情况外，截至本招股说明书签署日，发行人与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。

四、与本次发行上市有关的重要日期

刊登发行公告日期	【 】年【 】月【 】日
开始询价推介日期	【 】年【 】月【 】日
刊登定价公告日期	【 】年【 】月【 】日
申购日期和缴款日期	【 】年【 】月【 】日
股票上市日期	【 】年【 】月【 】日

第四节 风险因素

投资者在评价发行人此次发售的股票时，除本招股说明书提供的其他各项资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素。以下风险因素的披露根据重要性原则或可能影响投资决策的程度大小排序，但该排序不表示风险因素会依次发生。

一、技术风险

（一）技术升级迭代的风险

随着集成电路制造工艺技术的不断发展，集成电路对端口密度、信号延迟及封装体积等提出了越来越高的要求，促进了先进封装如 Bumping、Flip Chip（包含 COG、COF 等）、WLCSP、2.5D、3D 等新型封装工艺及封装形式的出现和发展。

集成电路行业技术更新迭代快，目前发行人专注于显示驱动芯片先进封装领域，主要使用 Bumping、COG、COF 等技术。如果未来公司技术升级进度或成果未达预期、未能准确把握行业发展趋势，导致未能成功进行工艺及技术升级迭代，公司市场竞争力将受到不利影响。

（二）核心技术泄密的风险

公司所处集成电路测试行业为典型的技术密集型行业，核心技术是公司保持竞争优势的有力保障，核心技术保密对公司的发展尤为重要。发行人在生产制造过程中研发并积累了较多的非专利核心技术与若干具有自主知识产权的核心技术，这是发行人保持行业竞争优势和核心竞争力的关键。若公司对核心技术保管不善，将会存在核心技术泄密的风险，对公司业务造成不利影响。

（三）技术人才流失的风险

公司所处行业对技术人员专业程度、经验水平均有较高要求。近年来，我国集成电路行业发展迅速，但相关人才储备仍有缺口，人员专业程度存在不足。目前集成电路行业人才争夺较为激烈、人员流动较为频繁。如果公司不能采取具有竞争力的激励措施以保持核心技术人员的稳定，技术人才存在流失的风险，可能

对公司技术研发和市场竞争产生不利影响。

二、经营风险

（一）收入来源结构单一的风险

自成立以来，发行人一直专注于显示驱动芯片领域，由于公司目前阶段投资能力有限，尚未正式开展其他领域业务。报告期内，发行人主营业务收入均来源于显示驱动芯片领域的先进封装测试服务，收入来源结构较为单一。如果发行人在显示驱动芯片领域客户订单流失或议价能力下降，未能及时完成新领域产品封装工艺的研发及产业化，将可能对发行人的经营业绩产生不利影响。

（二）客户集中度较高的风险

报告期内，发行人对前五大客户的主营业务收入合计分别为 23,482.50 万元、30,483.40 万元、43,824.32 万元和 26,607.52 万元，占主营业务收入的比例分别为 87.63%、82.38%、76.21% 和 76.05%，客户集中度较高。如果未来发行人的主要客户生产经营出现问题，导致其向发行人下达的订单数量下降，或发行人无法持续深化与现有主要客户的合作关系与合作规模、无法有效开拓新的客户资源，将可能对发行人经营业绩产生不利影响。

（三）供应商集中度较高的风险

报告期内，发行人向前五大原材料供应商采购额合计分别为 13,123.40 万元、17,621.61 万元、21,303.97 万元和 13,817.16 万元，占原材料采购总额的比例分别为 77.10%、79.92%、83.14% 和 85.11%，原材料供应商集中度较高。如果公司主要供应商生产经营发生重大变化，或交付能力未能满足公司要求，或与公司业务关系发生变化，公司在短期内可能面临原材料短缺，从而对公司的生产经营产生不利影响。

（四）区域贸易政策变化导致的风险

集成电路封装测试行业对原材料和设备有较高要求，发行人报告期内 80% 以上生产设备与 50% 以上原材料均采购自中国境外（以日本为主，具体以设备与原材料原产地为统计口径）；同时，发行人的主要客户亦为境外企业（以中国台

湾地区为主），报告期内，公司对境外客户（以直接客户注册所在地为统计口径）销售金额占主营业务收入的比例在 60% 以上。

如果未来相关国家或地区与中国的区域贸易政策发生重大变化，限制进出口或提高关税，公司可能面临生产设备、原材料短缺和客户流失等情形，进而导致公司生产受限、订单减少、成本增加，对公司的业务和经营产生不利影响。

（五）固定资产投资大，相关折旧对盈利能力影响较大的风险

公司所处集成电路封装测试行业属于资金密集型行业，要形成规模化生产，需要进行大规模的固定资产投资。同时，大规模的资金投入后，生产线从设备工艺调试，到产品下游验证，再到大规模量产，都需要技术人员对生产线各个环节的技术参数、制造工艺等进行不断的调整与严格的把控。基于该行业特点，集成电路封装测试的生产线安装后由于设备调试、生产组织、操作人员的熟练度等因素通常需要经历一段达产期。

报告期内，公司持续加大投资力度，固定资产规模持续增加，对应所产生的折旧费用保持在较高水平，各期折旧费用金额分别为 6,891.57 万元、9,834.00 万元、13,859.70 万元和 7,889.05 万元。因此，在达产期前期，大额的长期资产折旧与摊销等固定成本将在一定程度上影响公司的盈利能力。

（六）市场竞争加剧的风险

近年来，集成电路封装测试行业竞争日趋激烈，尤其是高端封测领域资本不断涌入。一方面，长电科技、通富微电、华天科技等在封测领域横跨众多产品线的行业龙头企业先后上市募集资金，并通过新建生产线、升级改造技术和产品以及对外收购等手段不断扩充产能，提升产品质量和技术水平，若上述行业龙头企业进军显示驱动芯片封测领域，公司业务将受到一定冲击。另一方面，外资与合资封装测试企业进一步布局中国境内市场，若其涉足显示驱动芯片封测领域，将加大行业竞争程度。

如果未来公司在研发能力、质量管理、成本管控、产能扩充等方面不能保持良好的竞争力，将可能导致公司市场竞争力下降，进而对公司的经营业绩产生不利影响。

（七）宏观经济和行业周期波动的风险

公司所封装测试的芯片广泛应用于智能手机、智能穿戴、高清电视、笔记本电脑、平板电脑等各类终端消费产品。受全球宏观经济的波动、行业景气度等因素影响，上述终端产品消费存在一定周期性，而消费市场周期会通过供应链的“牛鞭效应”放大传递至集成电路行业，集成电路行业的发展与宏观经济及终端市场整体发展密切相关。

如果宏观经济波动较大或长期处于低谷，集成电路行业的市场需求也将随之受到影响；另外下游市场需求的波动和低迷亦会导致集成电路产品的需求下降，进而影响集成电路封装测试企业的盈利能力。因此，宏观经济环境以及终端市场的整体波动可能对公司的经营业绩产生一定的影响。

（八）产业政策变化的风险

集成电路产业作为信息产业的基础和核心，是国民经济和社会发展的战略性新兴产业。近年来，国家出台了包括《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》《关于支持集成电路产业和软件产业发展进口税收政策的通知》等在内的一系列政策，从财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权、市场等方面为集成电路企业提供了更多的支持，以推动集成电路行业发展，增强信息产业创新能力和国际竞争力。如果未来国家相关产业政策出现重大不利变化，将对公司发展产生一定不利影响。

（九）“新冠疫情”引致的风险

2020年初，国内突发新冠疫情，给全国乃至全球经济带来了巨大冲击。目前国内的新冠疫情状况已经得到有效控制，但仍然存在零星散发、局部爆发和境外输入的情形，尤其是2021年7月-8月扬州爆发的疫情已对子公司江苏汇成的经营造成一定程度上的不利影响；同时，国外新冠疫情形势仍然严峻。若我国当前的新冠疫情防疫成效不能保持或国外疫情形势加剧，可能会对宏观经济的正常运行以及公司的业务开展产生不利影响。

三、内控风险

（一）实际控制人稳定性风险

本次公开发行人前，实际控制人郑瑞俊、杨会夫妇合计共同控制发行人 38.78% 的表决权，本次公开发行人后控制比例将进一步下降。虽然目前公司其他直接或间接股东控制的表决权比较分散且远低于实际控制人，公司仍存在因实际控制人控制的表决权相对较低而导致控制权变化的风险，可能会对公司业务开展和经营管理的稳定产生不利影响。

（二）公司规模扩张带来的管理风险

报告期初，公司业务规模持续扩张，运营管理处于逐步提升阶段，由于合肥生产基地实际订单数量与前期预测存在一定偏差，导致人员储备有所冗余，出现人力成本过高、边际产出下降等现象，进而造成公司盈利能力较弱。2020 年以来公司已通过提升管理水平与生产效率、优化人员结构等措施解决上述问题。

本次发行上市后，公司的资产和业务规模将进一步增长，这将对公司经营管理、资源整合、内部控制、财务规范等方面都提出更高的要求，公司的内部协调和风险控制难度将进一步加大，对公司管理层的管理水平及控制经营风险的能力带来更大的挑战。未来，如果公司的管理水平不能满足业务规模扩大对公司各项规范治理的要求，不能有效执行内部管理制度，将会对公司的业务、财务状况及经营业绩造成不利影响，制约公司的长远发展。

（三）财务内控不规范的风险

在公司发展过程中，公司因资金链紧张、融资渠道少等客观原因，发生了如转贷、资金拆借等财务内控不规范的行为。针对上述内控问题，公司已积极进行整改，但若未来财务内控制度不能得到有效执行或内控不规范的情形再度发生，可能存在导致公司利益受损进而损害投资者利益的风险。

四、财务风险

（一）汇率波动风险

公司的记账本位币为人民币，主要交易采用美元、日元等外币计价。报告期

内，受汇率波动的影响，公司汇兑损益分别为-345.61万元、404.48万元、520.87万元和97.33万元。如果未来境内外经济环境、政治形势、货币政策等因素发生变化，使得外币汇率大幅波动，公司将面临汇兑损失的风险。

（二）业绩波动的风险

报告期内，公司营业收入分别为28,558.35万元、39,420.66万元、61,892.67万元和35,875.90万元，净利润分别为-10,708.02万元、-16,402.95万元、-400.50万元和5,881.79万元，业绩波动较大。2018-2020年各期净利润均为负，主要系公司处于持续的客户验证及产品导入阶段，销售收入不能覆盖同期发生的成本及研发支出，长期资产折旧与摊销金额等成本较高所致。如果未来宏观经济景气度下行、国家产业政策出现变化、行业竞争加剧等原因导致市场对公司主要产品供需关系发生变化，可能对公司业务产生影响，公司存在业绩波动的风险。

（三）政府补助政策变化的风险

集成电路行业系国家重点战略产业，各级政府或主管部门给予的补助政策较多，报告期内，公司计入当期损益的政府补助分别为840.72万元、665.29万元、4,370.80万元和2,775.63万元。如果未来相关政策发生变化，公司政府补助规模无法延续，将对公司经营业绩造成一定影响。

（四）应收账款无法收回的风险

报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为5,044.98万元、8,765.94万元、15,501.74万元和15,570.59万元，占各期末流动资产的比例分别为21.55%、26.60%、38.51%和38.10%。随着公司经营规模的扩大，公司应收账款规模可能进一步增加。如果短期内公司主要客户出现财务状况的不利变化，无法按时支付款项，则存在应收账款逾期或无法收回进而发生坏账的可能性，将对公司经营业绩产生不利影响。

（五）存货跌价风险

报告期各期末，公司存货账面价值分别为10,262.82万元、14,176.49万元、12,439.05万元和15,324.68万元，占各期末流动资产的比例分别为43.84%、43.02%、30.90%和37.50%。公司期末存货金额较大，占比较高，并且公司存货

金额可能随着公司业务规模扩大进一步增长，占用公司较多的经营资金。如果未来市场需求、价格发生不利变动，可能导致公司存货积压、跌价，公司营运资金压力增加，从而对公司经营业绩造成不利影响。

五、存在累计未弥补亏损的风险

公司于股改时存在累计未弥补亏损，主要系所处集成电路封装测试行业属于资金密集型及技术密集型行业，要形成规模化生产，需要进行大规模的固定资产投资及研发投入。同时，大规模的资金投入后，生产线从设备工艺调试，到产品下游验证，再到大规模量产，通常需要经历相对较长的达产期。因此，在达产期前期，长期资产折旧与摊销等固定成本较高，收入规模较小，销售收入不能覆盖同期发生的成本及研发支出，导致累计未弥补亏损金额较大。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司经审计的累计未弥补亏损为-29,316.93 万元，累计未弥补亏损的情形尚未消除。在首次公开发行股票并在科创板上市后，若公司短期内无法弥补累计亏损，将导致缺乏向股东现金分红的能力。

六、募集资金投资项目风险

（一）募集资金投资项目的市场风险

本次募集资金拟主要投资于公司的扩产项目建设。本次募集资金投资项目金额较大，投资回收期较长，募集资金投资项目是基于当前市场环境、技术发展趋势等因素所作出的安排，项目实施与未来行业竞争情况、市场供求状况、技术进步等因素密切相关。如果募集资金投资项目未能按照计划顺利实施，公司则可能面临无法按既定计划实现预期收益的风险。

（二）募投项目新增折旧摊销影响公司盈利能力的风险

本次募集资金投资项目规模较大，募投项目实施后固定资产规模将大幅增加。公司主要募投项目“12 吋显示驱动芯片封测扩能项目”建设投资为 93,004.85 万元，根据公司折旧政策，项目达产后将每年新增折旧摊销费用 8,189.05 万元，而项目产生收益需要一定的时间，因此在短期内募投项目新增折旧和摊销将对发行人经营业绩产生一定的影响。

七、首次公开发行股票摊薄即期回报的风险

本次公开发行股票后，公司的总股本及净资产都将大幅增加。由于募集资金投资项目的实施需要一定时间，在项目建成投产后才能产生效益，公司短期内存在因股本总额及净资产增加导致每股收益、净资产收益率等即期回报指标被摊薄的风险。

八、发行失败的风险

股票公开发行是充分市场化的经济行为，如果出现预计发行后总市值不满足选定市值与财务指标上市标准，或首次公开发行股票网下投资者申购数量低于网下初始发行量等情况，按照《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》等相关法律法规的规定，应当中止发行，公司存在发行失败的风险。

第五节 发行人基本情况

一、发行人基本情况

公司名称	合肥新汇成微电子股份有限公司
英文名称	Union Semiconductor (Hefei) Co., Ltd.
注册资本	66,788.2625 万元
法定代表人	郑瑞俊
有限公司成立日期	2015 年 12 月 18 日
股份公司成立日期	2021 年 3 月 30 日
住所	合肥市新站区合肥综合保税区内
邮政编码	230012
电话	0551-67139968-7099
传真	0551-67139968-7099
公司网址	www.unionsemicon.com.cn
电子信箱	zhengquan@unionsemicon.com.cn
负责信息披露和投资者关系的部门	董事会办公室
负责信息披露和投资者关系的部门负责人	施周峰
负责信息披露和投资者关系的部门联系电话	0551-67139968-7099

二、发行人设立及报告期内股本和股东变化情况

（一）有限责任公司的设立

汇成有限系由扬州新瑞连、嘉兴高和、扬州嘉慧、高投邦盛、金海科贷共同出资设立，设立时注册资本为 100.00 万元，均为货币出资。2015 年 12 月 15 日，全体股东召开首次股东会并通过决议，一致同意设立汇成有限。2015 年 12 月 18 日，汇成有限完成工商设立登记程序。

汇成有限设立时的股本结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	扬州新瑞连	50.45	50.45
2	嘉兴高和	25.99	25.99

3	扬州嘉慧	15.90	15.90
4	高投邦盛	3.84	3.84
5	金海科贷	3.82	3.82
合计		100.00	100.00

（二）股份有限公司的设立

汇成股份系根据汇成有限截至 2021 年 1 月 31 日经审计的净资产折股整体变更设立的股份有限公司。其设立的具体情况如下：

汇成有限以 2021 年 1 月 31 日作为审计评估基准日，聘请专业机构对其进行审计评估。

2021 年 3 月 10 日，天健会计师就发行人整体变更出具了天健审〔2021〕9313 号审计报告，确认汇成有限截至审计基准日的账面净资产为 150,301.33 万元。

2021 年 3 月 10 日，坤元评估就发行人整体变更出具了坤元评报〔2021〕624 号资产评估报告，确认汇成有限截至评估基准日的净资产评估值为 167,175.81 万元。

2021 年 3 月 10 日，汇成有限召开临时股东会，决议通过：同意将汇成有限整体变更为股份公司，由汇成有限的全体股东作为发起人，以其各自在汇成有限的出资额所对应的净资产认购股份公司股份，各发起人按原持有有限公司的股权比例持有股份公司股份；以汇成有限截至 2021 年 1 月 31 日经审计的账面净资产 150,301.33 万元为依据，按比例折股为股份公司 66,788.26 万股，每股面值 1 元，超出股本的净资产余额作为资本公积。同日，全体发起人签署发起人协议书。

2021 年 3 月 26 日，汇成股份召开创立大会暨首次股东大会，一致同意将汇成有限整体变更为股份有限公司。

2021 年 3 月 26 日，天健会计师出具天健验〔2021〕469 号验资报告，确认上述整体变更出资到位，公司已根据上述折股方案进行折股。

2021 年 3 月 30 日，汇成股份就上述事项办理了工商变更登记手续，取得了合肥市市场监督管理局核发的营业执照。

本次变更完成后，汇成股份的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	扬州新瑞连	17,410.36	26.07
2	嘉兴高和	6,000.00	8.98
3	志道投资	4,000.00	5.99
4	汇成投资	3,771.67	5.65
5	Advance	2,800.00	4.19
6	Great Title	2,500.39	3.74
7	Worth Plus	2,438.06	3.65
8	杨会	2,359.39	3.53
9	鼎祥基金	1,818.18	2.72
10	蔚华电子	1,700.00	2.55
11	扬州耕天下	1,500.00	2.25
12	扬州和安	1,485.00	2.22
13	惠友豪创	1,454.55	2.18
14	上海亨堃	1,375.00	2.06
15	旗昌投资	1,272.73	1.91
16	海通新动能	1,272.73	1.91
17	香港宝信	1,250.00	1.87
18	高投邦盛	1,204.02	1.80
19	合肥创投	1,200.00	1.80
20	合肥芯成	1,109.70	1.66
21	华得富	1,000.00	1.50
22	华登基金	1,000.00	1.50
23	Win Plus	930.18	1.39
24	拾岳禾安	909.09	1.36
25	康启一号	727.27	1.09
26	昆桥基金	727.27	1.09
27	语音基金	666.67	1.00
28	杨绍校	666.67	1.00
29	道银投资	545.45	0.82
30	国耀汇成	400.00	0.60

31	十月吴巽	363.64	0.54
32	田林林	300.00	0.45
33	旭鼎一号	300.00	0.45
34	刘汉滨	200.00	0.30
35	Strong Lion	100.00	0.15
36	邦盛聚源	30.24	0.05
合计		66,788.26	100.00

（三）有限责任公司整体变更为股份有限公司的基准日未分配利润为负的情况

1、股改基准日未分配利润为负的形成原因

2021年3月10日，天健会计师出具天健审〔2021〕9313号审计报告，确认截至股改基准日2021年1月31日，汇成有限母公司经审计的账面净资产为150,301.33万元，其中实收资本66,788.26万元，资本公积113,553.53万元，未分配利润-30,040.46万元。

股改基准日未分配利润为负主要受行业特点和产能释放进程影响：公司所处集成电路封装测试行业属于资金密集型及技术密集型行业，要形成规模化生产，需要进行大规模的固定资产投资及研发投入。同时，大规模的资金投入后，生产线从设备工艺调试，到产品下游验证，再到大规模量产，通常需要经历相对较长的达产期。因此，在达产期前期，长期资产折旧与摊销等固定成本较高，收入规模较小，销售收入不能覆盖同期发生的成本及研发支出，导致股改前累计未弥补亏损金额较大。

随着产能的持续释放，公司销售收入快速增加，2020年度和2021年1-6月经营活动现金流量净额大幅改善，规模效应已逐步显现，生产经营效益持续提升。

2、未分配利润为负的情形消除情况，整体变更后的变化情况和趋势，与报告期内盈利水平变动的匹配关系，对未来盈利能力的影响

通过整体变更，股改基准日母公司账面累计未弥补亏损为负的情形已经消除。截至2021年6月30日，公司合并口径未分配利润为-29,316.93万元，公司合并未分配利润为负的情形尚未消除。

报告期内，公司累计未弥补亏损变化情况与盈利水平变动具体如下：

单位：万元

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
本年归属于母公司所有者净利润	5,881.79	-400.50	-16,402.95	-10,708.02
加：年初累计未弥补亏损余额	-65,239.19	-64,838.68	-48,435.74	-37,727.71
减：净资产折股	-30,040.46	-	-	-
期末累计未弥补亏损余额	-29,316.93	-65,239.19	-64,838.68	-48,435.74
经营活动现金流量净额	13,457.43	15,109.00	-2,238.90	-1,559.50

报告期内，随着显示面板下游市场需求的增加和公司生产工艺的优化、产能的持续释放，公司技术水平和产品质量得到市场认可，收入规模快速增长，经营状况持续好转。报告期内，公司的经营活动现金流量净额分别为-1,559.50万元、-2,238.90万元、15,109.00万元和13,457.43万元，系公司经营状况持续向好，经营活动现金流量净额大幅增长；公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为-11,545.62万元、-14,953.45万元、-4,190.82万元和3,106.38万元，2021年1-6月已实现盈利。公司未分配利润为负情形对公司的业务发展和未来盈利能力不构成重大不利影响。

3、整体变更的具体方案及相应的会计处理

2021年3月10日，汇成有限全体股东共同签署发起人协议书，将汇成有限经天健会计师审计的截至2021年1月31日的净资产150,301.33万元按比例折为股份公司股本66,788.26万元，剩余部分转做资本公积。母公司在股改基准日账面的累计未弥补亏损-30,040.46万元作为净资产折股的一部分通过整体变更计入资本公积。

公司整体变更时母公司的具体会计处理如下：

单位：万元

项目	变更前	变更后	变动
实收资本	66,788.26	66,788.26	-

资本公积	113,553.53	83,513.07	-30,040.46
未分配利润	-30,040.46	-	30,040.46
净资产合计	150,301.33	150,301.33	-

4、整体变更为股份公司的合法合规性

汇成有限整体变更设立股份有限公司相关事项经股东会、创立大会表决通过，相关程序合法合规。公司整体变更中不存在侵害债权人合法利益情形，与债权人不存在纠纷。同时公司各发起人签署的发起人协议系各发起人真实意思表示，符合有关法律、法规和规范性文件的规定；公司创立大会的召开程序及所议事项、决议符合相关法律法规和规范性文件的规定；公司的设立履行了审计、评估、验资及必要的内部决策程序，且履行了工商税务变更登记等手续；公司的设立程序、条件、方式及发起人资格等均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件的规定。

（四）报告期内的股本和股东变化情况

1、报告期期初，汇成有限的股权结构

2018年1月1日，汇成有限的股权结构具体如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	扬州新瑞连	17,410.36	43.35
2	嘉兴高和	8,359.39	20.81
3	合肥创投	8,000.00	19.92
4	扬州嘉慧	4,160.00	10.36
5	高投邦盛	1,204.02	3.00
6	金海科贷	1,000.00	2.49
7	邦盛聚源	30.24	0.08
合计		40,164.02	100.00

2、2018年11月，汇成有限第一次股权转让

合肥创投与扬州新瑞连等汇成有限股东于2016年10月签署投资协议，约定汇成有限股东扬州新瑞连、嘉兴高和、高投邦盛、邦盛聚源有权自合肥创投增资完成之日（即2016年11月17日）起60个月内回购合肥创投持有的全部或部分汇成有限股权。经协商一致，扬州新瑞连于2018年10月决定行使前述回购权。

2018年10月15日，扬州新瑞连与合肥创投签署股权转让协议，约定合肥创投将其持有的汇成有限16.93%股权（对应出资额6,800万元）转让给扬州新瑞连，股权转让价格为2.50元/注册资本附加相应的利息。

2018年10月15日，汇成有限召开股东会并决议通过上述股权转让事项，其他股东放弃优先购买权。

2018年11月20日，汇成有限就上述事项办理了工商变更登记手续。

本次股权转让完成后，汇成有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	扬州新瑞连	24,210.36	60.28
2	嘉兴高和	8,359.39	20.81
3	扬州嘉慧	4,160.00	10.36
4	高投邦盛	1,204.02	3.00
5	合肥创投	1,200.00	2.99
6	金海科贷	1,000.00	2.49
7	邦盛聚源	30.24	0.08
合计		40,164.02	100.00

3、2019年6月，汇成有限第二次股权转让

2019年5月15日，汇成有限召开股东会，决议通过：同意扬州新瑞连将其持有的汇成有限16.93%股权（对应出资额6,800万元）转让给汇成投资，其他股东放弃优先购买权。扬州新瑞连为杨会控制的企业，汇成投资为郑瑞俊控制的企业，本次股权转让系实际控制人控制的企业间股权调整，未实际支付股权转让款项。

本次股权转让完成后，公司性质变更为中外合资经营企业。就前述公司性质变更事项，汇成有限相应办理了外商投资企业设立备案手续（备案编号：合商外资备201900123）。

2019年6月19日，汇成有限就上述事项办理了工商变更登记手续。

本次股权转让完成后，汇成有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	扬州新瑞连	17,410.36	43.35
2	嘉兴高和	8,359.39	20.81
3	汇成投资	6,800.00	16.93
4	扬州嘉慧	4,160.00	10.36
5	高投邦盛	1,204.02	3.00
6	合肥创投	1,200.00	2.99
7	金海科贷	1,000.00	2.49
8	邦盛聚源	30.24	0.08
合计		40,164.02	100.00

4、2019年9月，汇成有限第一次增资及第三次股权转让

2019年9月1日，汇成有限召开董事会，决议通过：同意香港宝信、合肥芯成、Great Title、Worth Plus、Win Plus 作为新股东加入公司，其中香港宝信、合肥芯成成为员工持股平台；同意公司注册资本由 40,164.02 万元增至 45,164.02 万元，新增注册资本 5,000 万元由上述新增股东以货币认缴；同意汇成投资将其持有的汇成有限 6.71% 股权（对应出资额 3,028.33 万元）转让给 Great Title、Worth Plus、Win Plus，其他股东放弃优先购买权。

本次增资的具体情况如下：

序号	股东名称	增资总额（万元）	认缴新增注册资本（万元）	增资价格（元/注册资本）
1	香港宝信	3,125.00	1,250.00	2.50
2	合肥芯成	2,774.25	1,109.70	2.50
3	Great Title	3,305.56	1,322.22	2.50
4	Worth Plus	2,746.86	1,098.74	2.50
5	Win Plus	548.33	219.33	2.50
合计		12,500.00	5,000.00	-

同日，汇成投资与 Great Title、Worth Plus、Win Plus 签署股权转让协议，本次股权转让的具体情况如下：

序号	转让方	受让方	转让金额（万元）	转让注册资本（万元）	转让价格（元/注册资本）
----	-----	-----	----------	------------	--------------

1	汇成投资	Worth Plus	2,848.29	1,139.32	2.50
2		Great Title	2,945.42	1,178.17	2.50
3		Win Plus	1,777.13	710.85	2.50
合计			7,570.83	3,028.33	-

就本次增资及股权转让事项，汇成有限相应办理了外商投资企业设立备案手续（备案编号：合商外资备 201900142）。

2019 年 9 月 24 日，汇成有限就上述事项办理了工商变更登记手续。

本次增资及股权转让完成后，汇成有限的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	扬州新瑞连	17,410.36	38.55
2	嘉兴高和	8,359.39	18.51
3	扬州嘉慧	4,160.00	9.21
4	汇成投资	3,771.67	8.35
5	Great Title	2,500.39	5.54
6	Worth Plus	2,238.06	4.96
7	香港宝信	1,250.00	2.77
8	高投邦盛	1,204.02	2.67
9	合肥创投	1,200.00	2.66
10	合肥芯成	1,109.70	2.46
11	金海科贷	1,000.00	2.21
12	Win Plus	930.18	2.06
13	邦盛聚源	30.24	0.07
合计		45,164.02	100.00

天健会计师已出具验资报告，经审验确认：股东香港宝信、合肥芯成、Great Title、Worth Plus、Win Plus 已向汇成有限足额缴纳了本次出资，均以货币出资。

5、2020 年 1 月，汇成有限第四次股权转让

2020 年 1 月 8 日，汇成有限召开董事会，决议通过：同意嘉兴高和将其持有的汇成有限 5.22% 股权（对应出资额 2,359.39 万元）转让给杨会；同意扬州嘉

慧将其持有的汇成有限 9.21% 股权（对应出资额 4,160 万元）转让给扬州耕天下、许帮林、上海享塋、扬州和安；其他股东放弃优先购买权。

本次股权转让前，扬州耕天下、许帮林、上海享塋、扬州和安均为扬州嘉慧的股东。扬州嘉慧本次股权转让旨在将其股东由间接持股变更为直接持股，故扬州嘉慧本次股权转让的相关方均未实际支付股权转让款项。

2020 年 1 月 14 日，本次股权转让各方相应签署股权转让协议，约定本次股权转让的具体情况如下：

序号	转让方	受让方	转让注册资本 (万元)	占公司注册资 本的比例 (%)	转让价格 (元/注册资本)
1	嘉兴高和	杨会	2,359.39	5.22	3.00
2	扬州嘉慧	扬州耕天下	150.00	0.33	/
3	扬州嘉慧	许帮林	550.00	1.22	/
4	扬州嘉慧	上海享塋	1,975.00	4.37	/
5	扬州嘉慧	扬州和安	1,485.00	3.29	/
合计			6,519.39	14.43	-

2020 年 1 月 14 日，汇成有限就上述事项办理了工商变更登记手续。

本次股权转让完成后，汇成有限的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	持股比例（%）
1	扬州新瑞连	17,410.36	38.55
2	嘉兴高和	6,000.00	13.28
3	汇成投资	3,771.67	8.35
4	Great Title	2,500.39	5.54
5	杨会	2,359.39	5.22
6	Worth Plus	2,238.06	4.96
7	上海享塋	1,975.00	4.37
8	扬州和安	1,485.00	3.29
9	香港宝信	1,250.00	2.77
10	邦盛创投	1,204.02	2.67
11	合肥创投	1,200.00	2.66
12	合肥芯成	1,109.70	2.46

13	金海科贷	1,000.00	2.21
14	Win Plus	930.18	2.06
15	许帮林	550.00	1.22
16	扬州耕天下	150.00	0.33
17	邦盛聚源	30.24	0.07
合计		45,164.02	100.00

6、2020年3月，汇成有限第二次增资及第五次股权转让

2020年1月14日，汇成有限召开董事会，决议通过：同意华得富、Advance作为新股东加入公司；同意公司注册资本由45,164.02万元增至48,964.02万元，新增注册资本3,800万元由新股东华得富、Advance以货币认缴；并同意上海享堃、许帮林将其持有的汇成有限股权转让给扬州耕天下，其他股东放弃优先购买权。

本次增资的具体情况如下：

序号	股东名称	增资总额（万元）	认缴新增注册资本（万元）	增资价格（元/注册资本）
1	华得富	3,000.00	1,000.00	3.00
2	Advance	8,400.00	2,800.00	3.00
合计		11,400.00	3,800.00	-

2020年1月14日，上海享堃、许帮林分别与扬州耕天下签署股权转让协议，约定向扬州耕天下转让其持有的汇成有限股权，具体情况如下：

序号	转让方	受让方	转让金额（万元）	转让注册资本（万元）	转让价格（元/注册资本）
1	许帮林	扬州耕天下	2,750.00	550.00	5.00
2	上海享堃		300.00	100.00	3.00
合计			3,050.00	650.00	-

许帮林因投资时间较长，基于其对公司发展的预期寻求完全退出，拟出让其持有的全部股权，为实现投资收益对出让价格的要求较高；上海享堃因资金周转需要，拟出让少量股权以回收资金，故参考同期增资价格定价；扬州耕天下因看好公司发展前景，陆续向许帮林、上海享堃、金海科贷等多位汇成有限股东收购

公司股权，收购价格为 3.00-5.00 元/注册资本不等。扬州耕天下与许帮林、上海享堃系分别协商定价，故本次股权转让价格存在不一致的情况。

2020 年 3 月 9 日，汇成有限就上述事项办理了工商变更登记手续。

本次增资及股权转让完成后，汇成有限的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	扬州新瑞连	17,410.36	35.56
2	嘉兴高和	6,000.00	12.25
3	汇成投资	3,771.67	7.70
4	Advance	2,800.00	5.72
5	Great Title	2,500.39	5.11
6	杨会	2,359.39	4.82
7	Worth Plus	2,238.06	4.57
8	上海享堃	1,875.00	3.83
9	扬州和安	1,485.00	3.03
10	香港宝信	1,250.00	2.55
11	高投邦盛	1,204.02	2.46
12	合肥创投	1,200.00	2.45
13	合肥芯成	1,109.70	2.27
14	金海科贷	1,000.00	2.04
15	华得富	1,000.00	2.04
16	Win Plus	930.18	1.90
17	扬州耕天下	800.00	1.63
18	邦盛聚源	30.24	0.06
	合计	48,964.02	100.00

天健会计师已出具验资报告，经审验确认：股东华得富、Advance 已向汇成有限足额缴纳了本次出资，均以货币出资。

7、2020年4月，汇成有限第三次增资

2020年3月16日，汇成有限召开董事会，决议通过：同意志道投资作为新股东加入公司；同意公司注册资本由48,964.02万元增至52,964.02万元，新增注册资本由新股东志道投资以4.50元/注册资本的价格认缴。

2020年4月16日，汇成有限就上述事项办理了工商变更登记手续。

本次增资完成后，汇成有限的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	扬州新瑞连	17,410.36	32.87
2	嘉兴高和	6,000.00	11.33
3	志道投资	4,000.00	7.55
4	汇成投资	3,771.67	7.12
5	Advance	2,800.00	5.29
6	Great Title	2,500.39	4.72
7	杨会	2,359.39	4.45
8	Worth Plus	2,238.06	4.23
9	上海享塋	1,875.00	3.54
10	扬州和安	1,485.00	2.80
11	香港宝信	1,250.00	2.36
12	高投邦盛	1,204.02	2.27
13	合肥创投	1,200.00	2.27
14	合肥芯成	1,109.70	2.10
15	金海科贷	1,000.00	1.89
16	华得富	1,000.00	1.89
17	Win Plus	930.18	1.76
18	扬州耕天下	800.00	1.51
19	邦盛聚源	30.24	0.06
合计		52,964.02	100.00

天健会计师已出具验资报告，经审验确认：股东志道投资已向汇成有限足额缴纳了本次出资，均以货币出资。

8、2020年5月，汇成有限第六次股权转让

2020年5月20日，汇成有限召开董事会，决议通过：同意金海科贷将其持有的汇成有限1.89%股权（对应出资额1,000万元）转让给扬州耕天下，其他股东放弃优先购买权。同日，金海科贷与扬州耕天下相应签署股权转让协议，约定本次股权转让的价格为3.00元/注册资本。

金海科贷向扬州耕天下转让股权主要系由于其投资时间较长，决定寻求退出回收投资。金海科贷与扬州耕天下于2019年12月即达成本次股权转让的意向，参考同期其他股东股权转让的价格确定本次交易价格，并通过了金海科贷股东会决议。

2020年5月28日，汇成有限就上述事项办理了工商变更登记手续。

本次股权转让完成后，汇成有限的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	扬州新瑞连	17,410.36	32.87
2	嘉兴高和	6,000.00	11.33
3	志道投资	4,000.00	7.55
4	汇成投资	3,771.67	7.12
5	Advance	2,800.00	5.29
6	Great Title	2,500.39	4.72
7	杨会	2,359.39	4.45
8	Worth Plus	2,238.06	4.23
9	上海享埜	1,875.00	3.54
10	扬州耕天下	1,800.00	3.40
11	扬州和安	1,485.00	2.80
12	香港宝信	1,250.00	2.36
13	高投邦盛	1,204.02	2.27
14	合肥创投	1,200.00	2.27
15	合肥芯成	1,109.70	2.10
16	华得富	1,000.00	1.89
17	Win Plus	930.18	1.76

18	邦盛聚源	30.24	0.06
合计		52,964.02	100.00

9、2020年9月，汇成有限第七次股权转让

2020年8月30日，汇成有限召开股东会，决议通过：扬州耕天下将其持有的汇成有限0.57%股权（对应出资额300万元）转让给田林林，其他股东放弃优先购买权。同日，扬州耕天下与田林林相应签署股权转让协议，约定本次股权转让的价格为4.20元/注册资本。

田林林因看好公司发展前景拟投资入股；扬州耕天下出于控制投资规模考虑降低持股比例，故双方经协商一致，参考同期其他股东增资价格确定本次交易价格，由扬州耕天下向田林林转让其持有的部分股权。

2020年9月22日，汇成有限就上述事项办理了工商变更登记手续。

本次股权转让完成后，汇成有限的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	扬州新瑞连	17,410.36	32.87
2	嘉兴高和	6,000.00	11.33
3	志道投资	4,000.00	7.55
4	汇成投资	3,771.67	7.12
5	Advance	2,800.00	5.29
6	Great Title	2,500.39	4.72
7	杨会	2,359.39	4.45
8	Worth Plus	2,238.06	4.23
9	上海享塋	1,875.00	3.54
10	扬州耕天下	1,500.00	2.83
11	扬州和安	1,485.00	2.80
12	香港宝信	1,250.00	2.36
13	高投邦盛	1,204.02	2.27
14	合肥创投	1,200.00	2.27
15	合肥芯成	1,109.70	2.10
16	华得富	1,000.00	1.89

17	Win Plus	930.18	1.76
18	田林林	300.00	0.57
19	邦盛聚源	30.24	0.06
合计		52,964.02	100.00

10、2020年11月，汇成有限第四次增资及第八次股权转让

2020年11月11日，汇成有限股东会决议通过：同意蔚华电子、Strong Lion、国耀汇成作为新股东加入公司；同意公司注册资本由52,964.02万元增至55,364.02万元，新增注册资本2,400万元由蔚华电子、Strong Lion、国耀汇成、Worth Plus以货币认缴；同意上海享堃将其持有的汇成有限股权转让给刘汉滨，其他股东放弃优先购买权。

本次增资的具体情况如下：

序号	股东名称	增资总额（万元）	认缴新增注册资本（万元）	增资价格（元/注册资本）
1	蔚华电子	8,500.00	1,700.00	5.00
2	国耀汇成	2,000.00	400.00	5.00
3	Worth Plus	1,000.00	200.00	5.00
4	Strong Lion	500.00	100.00	5.00
合计		12,000.00	2,400.00	-

2020年11月7日，上海享堃与刘汉滨签署股权转让协议，约定上海享堃将其持有的汇成有限0.36%股权（对应出资额200万元）以5元/注册资本的价格转让给刘汉滨。

2020年11月23日，汇成有限就上述事项办理了工商变更登记手续。

本次增资及股权转让完成后，汇成有限的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	扬州新瑞连	17,410.36	31.45
2	嘉兴高和	6,000.00	10.84
3	志道投资	4,000.00	7.22
4	汇成投资	3,771.67	6.81

5	Advance	2,800.00	5.06
6	Great Title	2,500.39	4.52
7	Worth Plus	2,438.06	4.40
8	杨会	2,359.39	4.26
9	蔚华电子	1,700.00	3.07
10	上海享塋	1,675.00	3.03
11	扬州耕天下	1,500.00	2.71
12	扬州和安	1,485.00	2.68
13	香港宝信	1,250.00	2.26
14	高投邦盛	1,204.02	2.17
15	合肥创投	1,200.00	2.17
16	合肥芯成	1,109.70	2.00
17	华得富	1,000.00	1.81
18	Win Plus	930.18	1.68
19	国耀汇成	400.00	0.72
20	田林林	300.00	0.54
21	刘汉滨	200.00	0.36
22	Strong Lion	100.00	0.18
23	邦盛聚源	30.24	0.05
合计		55,364.02	100.00

天健会计师已出具验资报告，经审验确认：股东蔚华电子、Strong Lion、国耀汇成、Worth Plus 已向汇成有限足额缴纳了本次出资，均以货币出资。

11、2020 年 12 月，汇成有限第五次增资

2020 年 11 月 26 日，汇成有限召开股东会，决议通过：同意鼎祥基金、惠友豪创、旗昌投资、海通新动能、拾岳禾安、昆桥基金、康启一号、道银投资、十月吴巽作为新股东加入公司；同意公司注册资本由 55,364.02 万元增至 64,454.93 万元，新增注册资本 9,090.91 万元均由鼎祥基金等 9 名新股东以货币认缴。本次增资的具体情况如下：

序号	股东名称	增资总额（万元）	认缴新增注册资本（万元）	增资价格（元/注册资本）
----	------	----------	--------------	--------------

序号	股东名称	增资总额（万元）	认缴新增注册资本（万元）	增资价格（元/注册资本）
1	鼎祥基金	10,000.00	1,818.18	5.50
2	惠友豪创	8,000.00	1,454.55	5.50
3	旗昌投资	7,000.00	1,272.73	5.50
4	海通新动能	7,000.00	1,272.73	5.50
5	拾岳禾安	5,000.00	909.09	5.50
6	昆桥基金	4,000.00	727.27	5.50
7	康启一号	4,000.00	727.27	5.50
8	道银投资	3,000.00	545.45	5.50
9	十月吴巽	2,000.00	363.64	5.50
	合计	50,000.00	9,090.91	-

2020年12月9日，汇成有限就上述事项办理了工商变更登记手续。

本次增资完成后，汇成有限的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	扬州新瑞连	17,410.36	27.01
2	嘉兴高和	6,000.00	9.31
3	志道投资	4,000.00	6.21
4	汇成投资	3,771.67	5.85
5	Advance	2,800.00	4.34
6	Great Title	2,500.39	3.88
7	Worth Plus	2,438.06	3.78
8	杨会	2,359.39	3.66
9	鼎祥基金	1,818.18	2.82
10	蔚华电子	1,700.00	2.64
11	上海亨塋	1,675.00	2.60
12	扬州耕天下	1,500.00	2.33
13	扬州和安	1,485.00	2.30
14	惠友豪创	1,454.55	2.26
15	旗昌投资	1,272.73	1.97
16	海通新动能	1,272.73	1.97
17	香港宝信	1,250.00	1.94

18	高投邦盛	1,204.02	1.87
19	合肥创投	1,200.00	1.86
20	合肥芯成	1,109.70	1.72
21	华得富	1,000.00	1.55
22	Win Plus	930.18	1.44
23	拾岳禾安	909.09	1.41
24	康启一号	727.27	1.13
25	昆桥基金	727.27	1.13
26	道银投资	545.45	0.85
27	国耀汇成	400.00	0.62
28	十月吴巽	363.64	0.56
29	田林林	300.00	0.47
30	刘汉滨	200.00	0.31
31	Strong Lion	100.00	0.16
32	邦盛聚源	30.24	0.05
合计		64,454.93	100.00

天健会计师已出具验资报告，经审验确认：股东鼎祥基金、惠友豪创、旗昌投资、海通新动能、拾岳禾安、昆桥基金、康启一号、道银投资、十月吴巽已向汇成有限足额缴纳了本次出资，均以货币出资。

12、2020年12月，汇成有限第六次增资

2019年8月28日，语音基金与汇成有限及其当时的全体股东签署可转债投资协议，约定语音基金以可转债的方式对汇成有限进行投资，向汇成有限提供4,000万元借款；语音基金有权自汇成有限收到借款之日起48个月内将前述贷款按3.00元/注册资本的价格转变为对汇成有限的增资款；语音基金有权将该协议项下的可转股债权及对应的债转股权利转让给其指定第三方。

2020年末，语音基金拟根据前述协议行使转股权利，为控制投资规模，拟将其对汇成有限的2,000万元债权转为增资款，并对外转让剩余2,000万元债权及对应的债转股权利。杨绍校系汇成有限股东嘉兴高和的实际控制人，嘉兴高和曾于2020年1月向杨会转让部分股权以收回投资，此后由于汇成有限进行多次增资，嘉兴高和在汇成有限的持股比例被稀释，有增持汇成有限股权的意向。经

与语音基金协商一致，拟由杨绍校受让语音基金对汇成有限的 2,000 万元债权及对应的债转股权利。2020 年 12 月，杨绍校与语音基金签署可转债转让协议，约定语音基金将其对汇成有限 2,000 万元可转债债权及对应的转股权利转让给杨绍校，转让价格为 2,000 万元借款本金及相应利息。

2020 年 12 月 9 日，汇成有限召开股东会，决议通过：同意语音基金将其对公司 2,000 万元可转债债权及对应的债转股权利转让给杨绍校；同意语音基金、杨绍校作为新股东加入公司；同意公司注册资本由 64,454.93 万元增至 65,788.26 万元，新增注册资本 1,333.33 万元均由语音基金、杨绍校以其享有的对汇成有限的债权认缴。

根据中水致远资产评估有限公司出具的中水致远评报字[2020]第 020703 号《资产评估报告》，确认截至 2020 年 12 月 24 日汇成有限拟进行债转股涉及的相关债务评估值为 4,000 万元。

本次增资的具体情况如下：

序号	股东名称/姓名	增资总额（万元）	认缴新增注册资本（万元）	增资价格（元/注册资本）
1	语音基金	2,000.00	666.67	3.00
2	杨绍校	2,000.00	666.67	3.00
	合计	4,000.00	1,333.33	-

2020 年 12 月 28 日，汇成有限就上述事项办理了工商变更登记手续。

本次增资完成后，汇成有限的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	持股比例（%）
1	扬州新瑞连	17,410.36	26.46
2	嘉兴高和	6,000.00	9.12
3	志道投资	4,000.00	6.08
4	汇成投资	3,771.67	5.73
5	Advance	2,800.00	4.26
6	Great Title	2,500.39	3.80
7	Worth Plus	2,438.06	3.71

8	杨会	2,359.39	3.59
9	鼎祥基金	1,818.18	2.76
10	蔚华电子	1,700.00	2.58
11	上海享堃 ^(注)	1,675.00	2.55
12	扬州耕天下	1,500.00	2.28
13	扬州和安	1,485.00	2.26
14	惠友豪创	1,454.55	2.21
15	旗昌投资	1,272.73	1.93
16	海通新动能	1,272.73	1.93
17	香港宝信	1,250.00	1.90
18	高投邦盛	1,204.02	1.83
19	合肥创投	1,200.00	1.82
20	合肥芯成	1,109.70	1.69
21	华得富	1,000.00	1.52
22	Win Plus	930.18	1.41
23	拾岳禾安	909.09	1.38
24	康启一号	727.27	1.11
25	昆桥基金	727.27	1.11
26	语音基金	666.67	1.01
27	杨绍校	666.67	1.01
28	道银投资	545.45	0.83
29	国耀汇成	400.00	0.61
30	十月吴巽	363.64	0.55
31	田林林	300.00	0.46
32	刘汉滨	200.00	0.30
33	Strong Lion	100.00	0.15
34	邦盛聚源	30.24	0.05
合计		65,788.26	100.00

天健会计师已出具验资报告，经审验确认：股东语音基金、杨绍校已向汇成有限足额缴纳了本次出资，均以债权出资。

13、2021年1月，汇成有限第七次增资及第九次股权转让

2021年1月18日，汇成有限召开股东会，决议通过：同意华登基金、旭鼎一号作为新股东加入公司；同意公司注册资本由65,788.26万元增至66,788.26万元，新增注册资本1,000万元由新股东华登基金以5.50元/注册资本的价格认缴；同意上海享莛将其持有的汇成有限0.45%股权（对应出资额300万元）转让给旭鼎一号，其他股东放弃优先购买权。同日，上海享莛与旭鼎一号相应签署股权转让协议，约定本次股权转让的价格为5.00元/注册资本。

2021年1月26日，汇成有限就上述事项办理了工商变更登记手续。

本次增资及股权转让完成后，汇成有限的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	扬州新瑞连	17,410.36	26.07
2	嘉兴高和	6,000.00	8.98
3	志道投资	4,000.00	5.99
4	汇成投资	3,771.67	5.65
5	Advance	2,800.00	4.19
6	Great Title	2,500.39	3.74
7	Worth Plus	2,438.06	3.65
8	杨会	2,359.39	3.53
9	鼎祥基金	1,818.18	2.72
10	蔚华电子	1,700.00	2.55
11	扬州耕天下	1,500.00	2.25
12	扬州和安	1,485.00	2.22
13	惠友豪创	1,454.55	2.18
14	上海享莛	1,375.00	2.06
15	旗昌投资	1,272.73	1.91
16	海通新动能	1,272.73	1.91
17	香港宝信	1,250.00	1.87
18	高投邦盛	1,204.02	1.80
19	合肥创投	1,200.00	1.80
20	合肥芯成 ^(注)	1,109.70	1.66

21	华得富	1,000.00	1.50
22	华登基金	1,000.00	1.50
23	Win Plus	930.18	1.39
24	拾岳禾安	909.09	1.36
25	康启一号	727.27	1.09
26	昆桥基金	727.27	1.09
27	语音基金	666.67	1.00
28	杨绍校	666.67	1.00
29	道银投资	545.45	0.82
30	国耀汇成	400.00	0.60
31	十月吴巽	363.64	0.54
32	田林林	300.00	0.45
33	旭鼎一号	300.00	0.45
34	刘汉滨	200.00	0.30
35	Strong Lion	100.00	0.15
36	邦盛聚源	30.24	0.05
合计		66,788.26	100.00

天健会计师已出具验资报告，经审验确认：股东华登基金已向汇成有限足额缴纳了本次出资，系以货币出资。

14、2021年3月，整体变更为股份有限公司

汇成有限于2021年3月整体变更为股份有限公司，本次整体变更的具体情况详见本节“二、发行人设立及报告期内股本和股东变化情况”之“（二）股份有限公司的设立”部分。

三、发行人报告期内的重大资产重组情况

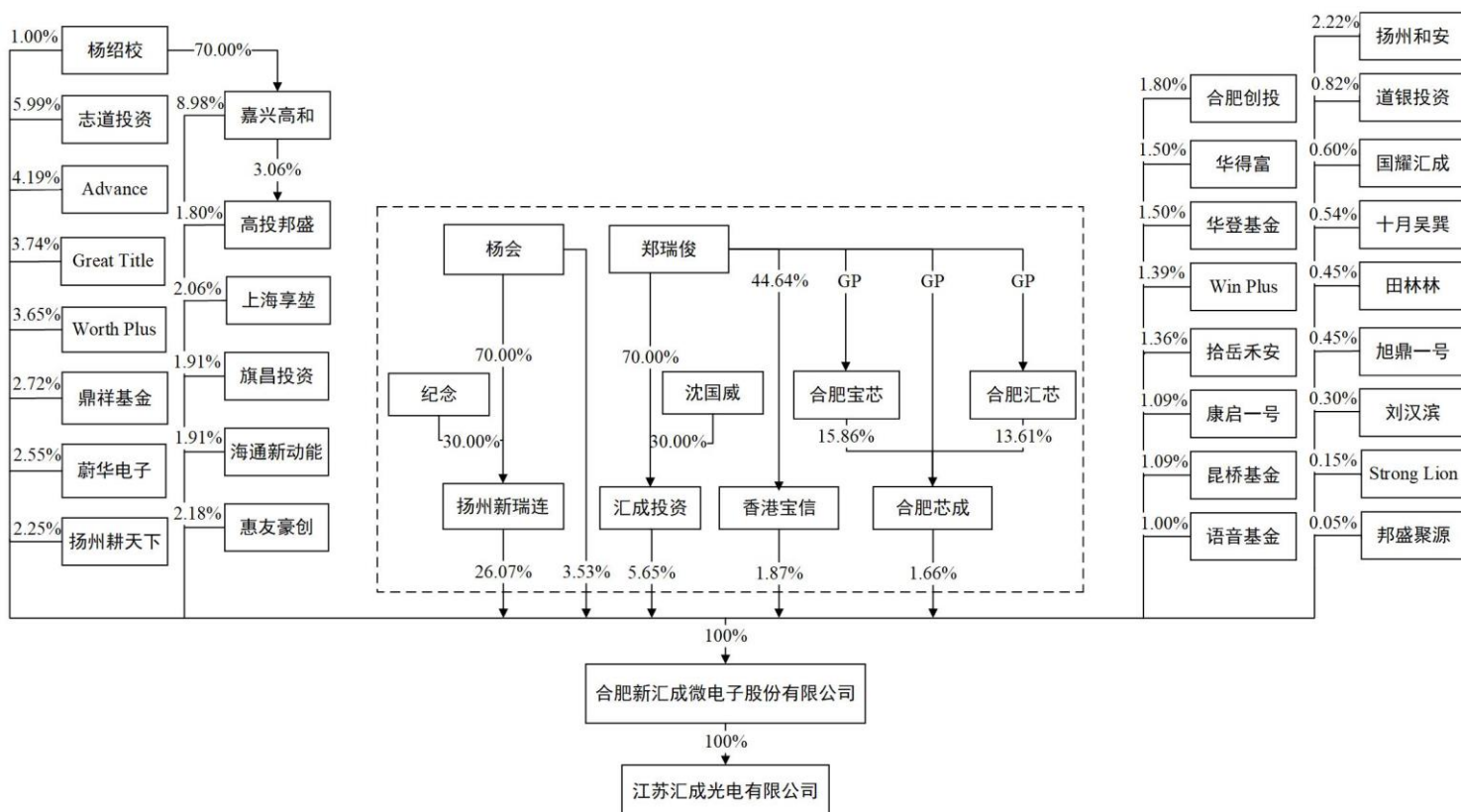
报告期内，发行人不存在重大资产重组的情况。

四、发行人在其他证券市场的上市或挂牌情况

报告期内，发行人不存在在其他证券市场的上市或挂牌情况。

五、发行人股权结构

截至本招股说明书签署日，发行人的股权结构如下图所示：



六、发行人控股、参股公司情况

截至本招股说明书签署日，公司有一家全资子公司江苏汇成，无参股公司。全资子公司江苏汇成具体情况如下：

（一）基本情况

公司名称	江苏汇成光电有限公司
统一社会信用代码	91321000581042566E
成立日期	2011年8月29日
注册资本	26,164.02万元
实收资本	26,164.02万元
注册地址	扬州高新区金荣路19号
主要生产经营地	扬州高新区金荣路19号
法定代表人	郑瑞俊

股东构成	汇成股份持有 100% 股权
经营范围	半导体（硅片及化合物半导体）集成电路产品及半导体专用材料的开发、生产、封装和测试，销售本公司自产产品及售后服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
与发行人主营业务关系	从事显示驱动芯片的金凸块制造及封装测试服务，主要封装测试 8 吋晶圆，系发行人主营业务的组成部分

（二）历史沿革

江苏汇成自设立之日起至今的简要历史沿革情况如下：

1、2011 年 8 月，江苏汇成设立

江苏汇成系由汇旌投资和汇成投资于 2011 年 8 月 29 日共同出资设立。

2011 年 8 月 15 日，江苏省工商行政管理局核发名称预先核准通知书，预先核准名称为“江苏汇成光电有限公司”。

2011 年 8 月 18 日，扬州市商务局出具《关于同意设立江苏汇成有限公司的批复》（扬商行服[2011]306 号），同意汇旌投资与汇成投资共同出资设立江苏汇成；江苏汇成设立时注册资本为 1 亿元，其中汇旌投资以货币出资 6,000 万元，汇成投资以美元现汇出资 4,000 万元。

2011 年 8 月 19 日，江苏汇成取得江苏省人民政府核发的《台港澳侨投资企业批准证书》（商外资苏府资字[2011]89990 号）。

2011 年 8 月 29 日，江苏汇成完成工商设立登记程序。

江苏汇成设立时的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	汇旌投资	6,000.00	60.00
2	汇成投资	4,000.00	40.00
	合计	10,000.00	100.00

2、2011年12月，江苏汇成第一次增资

2011年9月27日，江苏汇成召开董事会并决议通过：同意江苏汇成注册资本由10,000万元增至12,000万元；新增注册资本由汇旌投资认缴1,200万元，汇成投资认缴800万元，增资价格为1元/注册资本，均以货币出资。

2011年10月20日，江苏省商务厅核准本次增资。

2011年12月16日，江苏汇成完成本次增资的工商变更登记手续。

本次增资完成后，江苏汇成的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	汇旌投资	7,200.00	60.00
2	汇成投资	4,800.00	40.00
合计		12,000.00	100.00

3、2015年1月，江苏汇成第二次增资

2014年9月8日，江苏汇成召开董事会并决议通过：同意扬州新瑞连、嘉兴高和作为新股东加入公司；同意江苏汇成注册资本由12,000万元增至20,000万元；新增注册资本由扬州新瑞连认缴4,800万元，嘉兴高和认缴3,200万元，增资价格为1元/注册资本，均以货币出资。

2014年11月27日，扬州市商务局核准本次增资。

2015年1月9日，江苏汇成完成本次增资的工商变更登记手续。

本次增资完成后，江苏汇成的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	汇旌投资	7,200.00	36.00
2	汇成投资	4,800.00	24.00
3	扬州新瑞连	4,800.00	24.00
4	嘉兴高和	3,200.00	16.00
合计		20,000.00	100.00

4、2015年4月，江苏汇成第三次增资

2014年11月6日，江苏汇成召开董事会并决议通过：同意高投邦盛、扬州嘉慧、金海科贷作为新股东加入公司；同意江苏汇成注册资本由20,000万元增至26,164.02万元；新增注册资本由高投邦盛、扬州嘉慧、金海科贷以货币认缴，具体情况如下：

序号	股东名称	增资总额 (万元)	认缴新增注册资本 (万元)	增资价格 (元/注册资本)
1	扬州嘉慧	10,000.00	4,160.00	2.40
2	高投邦盛	2,500.00	1,004.02	2.49
3	金海科贷	2,500.00	1,000.00	2.50
合计		15,000.00	6,164.02	-

2015年3月16日，扬州市商务局核准本次增资。

2015年4月15日，江苏汇成完成本次增资的工商变更登记手续。

本次增资完成后，江苏汇成的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	汇旌投资	7,200.00	27.52
2	汇成投资	4,800.00	18.35
3	扬州新瑞连	4,800.00	18.35
4	扬州嘉慧	4,160.00	15.90
5	嘉兴高和	3,200.00	12.23
6	高投邦盛	1,004.02	3.84
7	金海科贷	1,000.00	3.82
合计		26,164.02	100.00

5、2015年8月，江苏汇成第一次股权转让

2015年7月10日，江苏汇成召开董事会并决议通过：同意汇旌投资将其持有的江苏汇成13.76%股权（对应出资额3,600万元）转让给扬州新瑞连，将其持有的江苏汇成13.76%股权（对应出资额3,600万元）转让给嘉兴高和；其他股东放弃优先购买权。2015年7月15日，汇旌投资与扬州新瑞连、嘉兴高和相应签

署股权转让协议，约定转让价格为 1 元/注册资本。

本次股权转让前，汇旌投资的股东为扬州新瑞连、杨绍校，杨绍校系嘉兴高和的实际控制人。本次股权转让旨在将汇旌投资的股东由间接持股变更为直接持股。

2015 年 8 月 20 日，扬州市商务局核准本次股权转让。

2015 年 8 月 31 日，江苏汇成完成本次股权转让的工商变更登记手续。

本次股权转让完成后，江苏汇成的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	扬州新瑞连	8,400.00	32.11
2	嘉兴高和	6,800.00	25.99
3	汇成投资	4,800.00	18.35
4	扬州嘉慧	4,160.00	15.90
5	高投邦盛	1,004.02	3.84
6	金海科贷	1,000.00	3.82
合计		26,164.02	100.00

6、2016 年 7 月，江苏汇成第二次股权转让

2016 年 3 月 6 日，江苏汇成召开董事会并决议通过：同意扬州新瑞连、汇成投资、嘉兴高和、高投邦盛、扬州嘉慧、金海科贷将其持有的江苏汇成全部股权转让给汇成有限，转让价格均为 1 元/注册资本。2016 年 4 月 5 日，本次股权转让相关方相应签署股权转让协议。

2016 年 4 月 6 日，扬州市商务局核准本次股权转让，同意江苏汇成公司性质由外商投资企业变更为国内有限公司。

2016 年 7 月 26 日，江苏汇成完成本次股权转让的工商变更登记手续。

本次股权转让完成后，江苏汇成成为汇成有限的全资子公司。

（三）简要财务数据

最近一年及一期，江苏汇成的主要财务数据（已经天健会计师审计）如下：

单位：万元

项目	2021.6.30/2021年1-6月	2020.12.31/2020年度
总资产	52,005.30	53,250.59
净资产	2,980.25	1,460.80
净利润	1,223.72	1,254.78

七、持有发行人5%以上股份的股东及实际控制人的基本情况

（一）控股股东、实际控制人基本情况

1、控股股东

截至本招股说明书签署日，扬州新瑞连持有发行人 17,410.36 万股股份，占发行人股本总额的 26.07%，系发行人控股股东，扬州新瑞连具体情况如下：

企业名称	扬州新瑞连投资合伙企业（有限合伙）
成立时间	2014年5月13日
认缴出资额	50万元
实缴出资额	50万元
注册地址	扬州高新技术产业开发区纵一路与横三路交界处管委会大楼内12楼1202室
执行事务合伙人	杨会
经营范围	从事非证券股权投资活动及相关咨询服务。
主营业务	投资管理
与发行人主营业务关系	无

截至本招股说明书签署日，扬州新瑞连的合伙人构成如下：

序号	合伙人姓名	合伙人性质	出资额（万元）	出资比例（%）
1	杨会	普通合伙人	35.00	70.00
2	纪念	有限合伙人	15.00	30.00
合计			50.00	100.00

最近一年及一期，扬州新瑞连的主要财务数据（经安徽皖瑞会计师事务所审计）如下：

单位：万元

项目	2021.6.30/2021年1-6月	2020.12.31/2020年度
----	---------------------	-------------------

总资产	39,802.72	38,306.74
净资产	52.02	52.03
净利润	-0.02	0.15

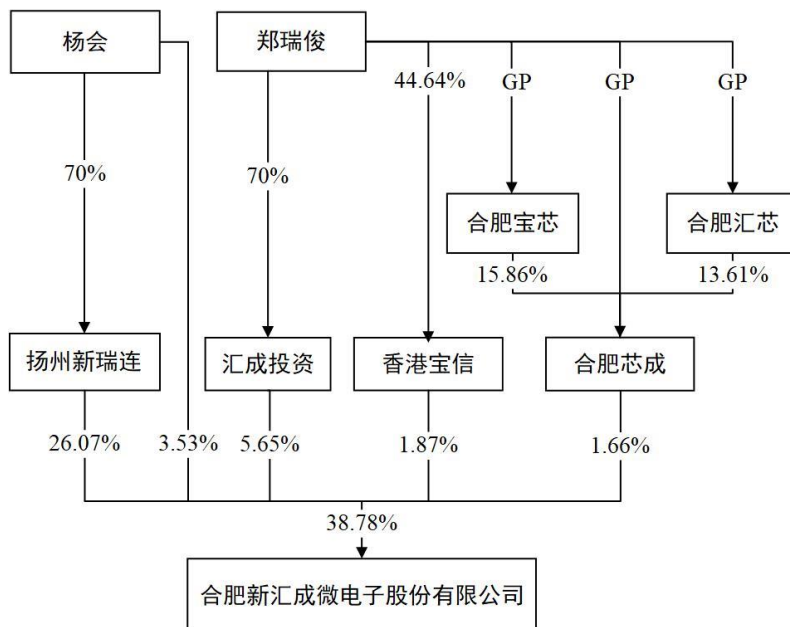
2、实际控制人

郑瑞俊、杨会系夫妻关系。

截至本招股说明书签署日，郑瑞俊持有汇成投资 70% 的股份，为汇成投资的实际控制人，并通过汇成投资间接控制发行人 5.65% 的股份；郑瑞俊持有香港宝信 44.64% 的股份，为香港宝信第一大股东，且香港宝信其他股东持股较为分散，故郑瑞俊为香港宝信的实际控制人，通过香港宝信间接控制发行人 1.87% 的股份；郑瑞俊担任合肥芯成的执行事务合伙人，为合肥芯成的实际控制人，并通过合肥芯成间接控制发行人 1.66% 的股份。

截至本招股说明书签署日，杨会直接持有发行人 3.53% 的股份；同时，杨会担任扬州新瑞连的执行事务合伙人，为扬州新瑞连的实际控制人，通过扬州新瑞连间接控制发行人 26.07% 的股份。

郑瑞俊、杨会直接持有及间接控制发行人股份的情况具体如下图所示：



综上，郑瑞俊、杨会夫妇合计共同控制发行人 38.78% 的股份表决权，同时郑瑞俊担任发行人董事长、总经理，对公司重大决策及经营管理具有决定性影响，

郑瑞俊、杨会为公司共同实际控制人。

公司实际控制人的基本信息如下：

郑瑞俊先生，中国台湾籍，台湾居民来往大陆通行证号 0070*****。

杨会女士，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码 341127198205*****。

（二）控股股东及实际控制人控制的其他主要企业的情况

控股股东扬州新瑞连除持有发行人股份外无其他对外投资。

除扬州新瑞连、汇成股份及其控制的子公司江苏汇成以外，截至本招股说明书签署日，公司实际控制人控制的其他主要企业情况如下：

1、合肥芯成

合肥芯成系发行人员工持股平台，截至本招股说明书签署日，郑瑞俊担任合肥芯成执行事务合伙人，并持有合肥芯成 37.37% 财产份额，合肥芯成的具体情况详见本节“十、发行人本次公开发行前制定或实施的股权激励”之“（一）发行人本次发行前已实施的员工持股计划”之“1、发行人员工持股平台的人员构成”。

2、合肥宝芯

合肥宝芯系发行人员工持股平台，截至本招股说明书签署日，郑瑞俊担任合肥宝芯执行事务合伙人，并持有合肥宝芯 19.32% 财产份额，合肥宝芯的具体情况详见本节“十、发行人本次公开发行前制定或实施的股权激励”之“（一）发行人本次发行前已实施的员工持股计划”之“1、发行人员工持股平台的人员构成”。

3、合肥汇芯

合肥汇芯系发行人员工持股平台，截至本招股说明书签署日，郑瑞俊担任合肥汇芯执行事务合伙人，并持有合肥汇芯 13.91% 财产份额，合肥汇芯的具体情况详见本节“十、发行人本次公开发行前制定或实施的股权激励”之“（一）发行人本次发行前已实施的员工持股计划”之“1、发行人员工持股平台的人员构

成”。

4、香港宝信

香港宝信系发行人员工持股平台，截至本招股说明书签署日，郑瑞俊担任香港宝信董事，并持有香港宝信 44.64% 股权，香港宝信的具体情况详见本节“十、发行人本次公开发行前制定或实施的股权激励”之“（一）发行人本次发行前已实施的员工持股计划”之“1、发行人员工持股平台的人员构成”。

5、汇成投资

截至本招股说明书签署日，郑瑞俊担任汇成投资董事，并持有汇成投资 70% 股权，汇成投资的具体情况详见本节“七、持有发行人 5% 以上股份的股东及实际控制人的基本情况”之“（四）持有发行人 5% 以上股份的股东”。

6、瑞成建筑

公司名称	瑞成建筑工程（安徽）有限公司
成立时间	1994 年 7 月 12 日
注册资本	700.00 万美元
法定代表人	沈建纬
注册地址	安徽省合肥市宿州路 72 号宏图大厦 19 层
股东构成	郑瑞俊持股 80.00%、沈建纬持股 20.00%
主营业务	建筑装饰、工业与民用建筑、市政土木工程，室内外装饰设计
与发行人主营业务关系	无

7、瑞成投资

公司名称	瑞成投资控股有限公司
成立时间	2009 年 7 月 27 日
发行股本	1.00 万股（每股面值 1 港币）
董事	郑瑞俊
注册地址	Room 1002, 10/F, Easey Commercial Building, 253-261 Hennessy Road, Wan Chai, Hong Kong
股东构成	郑瑞俊持股 70.00%，沈建纬持股 30.00%
主营业务	对外投资
与发行人主营业务关系	无

8、香港瑞仕

公司名称	香港瑞仕投资控股有限公司
成立时间	2018年10月11日
发行股本	100.00万股（每股面值1美元）
董事	郑瑞俊
注册地址	22/F, 3 Lockhart Road, Wan Chai, Hong Kong
股东构成	郑瑞俊持股 100.00%
主营业务	对外投资
与发行人主营业务关系	无

9、百瑞发投资

公司名称	百瑞发投资股份有限公司
成立时间	2021年3月16日
实收资本	700.00万新台币
法定代表人	郑瑞俊
注册地址	台湾省新竹县竹北市东平里嘉政一街1号4楼
股东构成	郑瑞俊持股 99.86%，郑光耀持股 0.14%
主营业务	对外投资
与发行人主营业务关系	无

10、海口三立现代办公设备有限公司

公司名称	海口三立现代办公设备有限公司 ^(注1)
成立时间	1992年7月11日
注册资本	100.00万美元
法定代表人	郑瑞俊
注册地址	海南省海口市和平南路67号六合大厦
股东构成	壹路发房屋中介公司 ^(注2) 持股 100.00%
主营业务	从事现代办公设备的生产开发销售
与发行人主营业务关系	无

注 1：海口三立现代办公设备有限公司已于 1993 年 3 月因逾期未年检被吊销，正在办理注销登记手续。

注 2：壹路发房屋中介公司系郑瑞俊曾持股 100.00% 的台湾公司，已于 1997 年撤销。

（三）控股股东及实际控制人直接或间接持有发行人的股份质押情况

截至本招股说明书签署日，发行人控股股东所持发行人股份存在质押的情形，相关质押系为发行人获得银行贷款所提供的增信措施，具体情况参见本招股说明书“重大事项提示”之“二、发行人控股股东所持发行人股份存在质押情形”。

除上述情况外，控股股东及实际控制人郑瑞俊和杨会直接或间接持有发行人的股份不存在质押或其他有争议的情况。

（四）持有发行人 5%以上股份的股东

1、直接持有发行人 5%以上股份股东的基本情况

截至本招股说明书签署日，直接持有发行人 5%以上股份的股东为扬州新瑞连、嘉兴高和、汇成投资和志道投资，其持股情况如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	扬州新瑞连	17,410.36	26.07
2	嘉兴高和	6,000.00	8.98
3	志道投资	4,000.00	5.99
4	汇成投资	3,771.67	5.65
	合计	31,182.03	46.69

（1）扬州新瑞连

参见本节之“七、持有发行人 5%以上股份的股东及实际控制人的基本情况”之“（一）控股股东、实际控制人基本情况”之“1、控股股东”。

（2）嘉兴高和

企业名称	嘉兴高和股权投资基金合伙企业（有限合伙）
成立时间	2014年9月19日
出资额	3,880.00万元
执行事务合伙人	杨绍校
注册地址	浙江省嘉兴市南湖区广益路705号嘉兴世界贸易中心1号楼2206室-6
出资结构	杨绍校为普通合伙人，持有70.00%出资份额 杨绍会为有限合伙人，持有30.00%出资份额

经营范围	非证券类业务的投资、投资管理、咨询
与发行人主营业务关系	无

（3）志道投资

公司名称	安徽志道投资有限公司
成立时间	2013年3月25日
注册资本	60,000.00万元
法定代表人	李德和
注册地址	合肥市庐阳区临泉路7363号正奇金融广场A座15层
股东构成	正奇控股持股100.00%
经营范围	股权投资，项目投资（除专项许可），资产管理；企业并购与重组；投资管理及咨询
与发行人主营业务关系	无

（4）汇成投资

公司名称	汇成投资控股有限公司
成立时间	2010年6月11日
发行股本	1,300股（每股面值1美元）
董事	郑瑞俊、沈国威
注册地址	Room 1002, 10/F, Easey Commercial Building, 253-261 Hennessy Road, Wan Chai, Hong Kong
股东构成	郑瑞俊持股70.00%、沈国威持股30.00%
主营业务	对外投资
与发行人主营业务关系	无

2、间接持有发行人5%以上股份自然人股东的基本情况

截至本招股说明书签署日，间接持有发行人5%以上股份的自然人股东为杨会、郑瑞俊、纪念、杨绍校。

（1）杨会

参见本节之“七、持有发行人5%以上股份的股东及实际控制人的基本情况”之“（一）控股股东、实际控制人基本情况”之“2、实际控制人”。

（2）郑瑞俊

参见本节之“七、持有发行人 5% 以上股份的股东及实际控制人的基本情况”之“（一）控股股东、实际控制人基本情况”之“2、实际控制人”。

（3）纪念

纪念，1986 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码 32050419860115****。

（4）杨绍校

杨绍校，1970 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码 513027197006*****。

八、发行人股本情况

（一）本次发行前后的股本情况

本次发行前公司总股本为 667,882,625 股，本次拟公开发行新股不超过 222,627,542 股，本次发行的股票数量不低于本次发行后总股本的 10%，不超过本次发行后总股本的 25%（行使超额配售选择权之前），不涉及股东公开发售股份。

本次发行可以行使超额配售选择权，采用超额配售选择权发行股票数量不超过首次公开发行股票数量的 15%。若公司本次发行股份数量为 222,627,542 股，本次发行前后公司的股本结构变化情况如下：

序号	股东名称	本次发行前		本次发行后	
		持股数量（股）	持股比例（%）	持股数量（股）	持股比例（%）
1	扬州新瑞连	174,103,622	26.07	174,103,622	19.55
2	嘉兴高和	60,000,000	8.98	60,000,000	6.74
3	志道投资	40,000,000	5.99	40,000,000	4.49
4	汇成投资	37,716,667	5.65	37,716,667	4.24
5	Advance	28,000,000	4.19	28,000,000	3.14
6	Great Title	25,003,889	3.74	25,003,889	2.81
7	Worth Plus	24,380,610	3.65	24,380,610	2.74

8	杨会	23,593,934	3.53	23,593,934	2.65
9	鼎祥基金	18,181,818	2.72	18,181,818	2.04
10	蔚华电子	17,000,000	2.55	17,000,000	1.91
11	扬州耕天下	15,000,000	2.25	15,000,000	1.68
12	扬州和安	14,850,000	2.22	14,850,000	1.67
13	惠友豪创	14,545,455	2.18	14,545,455	1.63
14	上海享埜	13,750,000	2.06	13,750,000	1.54
15	旗昌投资	12,727,273	1.91	12,727,273	1.43
16	海通新动能	12,727,273	1.91	12,727,273	1.43
17	香港宝信	12,500,000	1.87	12,500,000	1.40
18	高投邦盛	12,040,200	1.80	12,040,200	1.35
19	合肥创投	12,000,000	1.80	12,000,000	1.35
20	合肥芯成	11,097,000	1.66	11,097,000	1.25
21	华得富	10,000,000	1.50	10,000,000	1.12
22	华登基金	10,000,000	1.50	10,000,000	1.12
23	Win Plus	9,301,834	1.39	9,301,834	1.04
24	拾岳禾安	9,090,909	1.36	9,090,909	1.02
25	康启一号	7,272,727	1.09	7,272,727	0.82
26	昆桥基金	7,272,727	1.09	7,272,727	0.82
27	语音基金	6,666,667	1.00	6,666,667	0.75
28	杨绍校	6,666,667	1.00	6,666,667	0.75
29	道银投资	5,454,545	0.82	5,454,545	0.61
30	国耀汇成	4,000,000	0.60	4,000,000	0.45
31	十月吴巽	3,636,364	0.54	3,636,364	0.41
32	田林林	3,000,000	0.45	3,000,000	0.34
33	旭鼎一号	3,000,000	0.45	3,000,000	0.34
34	刘汉滨	2,000,000	0.30	2,000,000	0.22
35	Strong Lion	1,000,000	0.15	1,000,000	0.11
36	邦盛聚源	302,444	0.05	302,444	0.03
37	本次发行股份	-	-	222,627,542	25.00
合计		667,882,625	100.00	890,510,167	100.00

（二）本次发行前的前十名股东

本次发行前，公司前十名股东持股情况如下表所示：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	扬州新瑞连	17,410.36	26.07
2	嘉兴高和	6,000.00	8.98
3	志道投资	4,000.00	5.99
4	汇成投资	3,771.67	5.65
5	Advance	2,800.00	4.19
6	Great Title	2,500.39	3.74
7	Worth Plus	2,438.06	3.65
8	杨会	2,359.39	3.53
9	鼎祥基金	1,818.18	2.72
10	蔚华电子	1,700.00	2.55
合计		44,798.05	67.07

（三）前十名自然人股东持股及任职情况

截至本招股说明书签署日，本次发行前公司直接自然人股东为杨会、杨绍校、田林林和刘汉滨，均未在发行人处任职。

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）	发行人处任职
1	杨会	2,359.39	3.53	无
2	杨绍校	666.67	1.00	无
3	田林林	300.00	0.45	无
4	刘汉滨	200.00	0.30	无
合计		3,526.06	5.28	-

（四）国有股份及外资股份情况

1、国有股份情况

2021年9月27日，合肥市国资委出具《关于合肥新汇成微电子股份有限公司国有股东标识有关问题的批复》（合国资产权[2021]85号），根据该批复，确认合肥创投持有的汇成股份的股份界定为国有法人股，其证券账户应标识为“SS”。除合肥创投外，公司股份无其他国有股份。

截至本招股说明书签署日，公司国有股东情况如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	合肥创投（SS）	1,200.00	1.80

2、外资股份情况

截至本招股说明书签署日，公司外资股东为汇成投资、Advance、Great Title、Worth Plus、香港宝信、华得富、Win Plus、Strong Lion，具体情况如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	汇成投资	3,771.67	5.65
2	Advance	2,800.00	4.19
3	Great Title	2,500.39	3.74
4	Worth Plus	2,438.06	3.65
5	香港宝信	1,250.00	1.87
6	华得富	1,000.00	1.50
7	Win Plus	930.18	1.39
8	Strong Lion	100.00	0.15
合计		14,790.30	22.14

（五）最近一年新增股东的情况

1、最近一年新增股东的持股数量及变化等情况

截至本招股说明书签署日，发行人最近一年新增股东情况如下：

序号	股东名称	取得股份方式	取得股份时间	取得股份数量（万股）	取得价格（元/股）	定价依据
1	蔚华电子	增资	2020.11	1,700.00	5.00	协商确定
2	国耀汇成	增资	2020.11	400.00	5.00	协商确定
3	Worth Plus	增资	2020.11	200.00	5.00	协商确定
4	Strong Lion	增资	2020.11	100.00	5.00	协商确定
5	刘汉滨	股权转让	2020.11	200.00	5.00	协商确定
6	鼎祥基金	增资	2020.12	1,818.18	5.50	协商确定
7	惠友豪创	增资	2020.12	1,454.55	5.50	协商确定
8	旗昌投资	增资	2020.12	1,272.73	5.50	协商确定
9	海通新动能	增资	2020.12	1,272.73	5.50	协商确定

10	拾岳禾安	增资	2020.12	909.09	5.50	协商确定
11	昆桥基金	增资	2020.12	727.27	5.50	协商确定
12	康启一号	增资	2020.12	727.27	5.50	协商确定
13	道银投资	增资	2020.12	545.45	5.50	协商确定
14	十月吴巽	增资	2020.12	363.64	5.50	协商确定
15	语音基金	债转股	2020.12	666.67	3.00	协议约定
16	杨绍校	债转股	2020.12	666.67	3.00	协议约定
17	华登基金	增资	2021.01	1,000.00	5.50	协商确定
18	旭鼎一号	股权转让	2021.01	300.00	5.00	协商确定

注：语音基金、杨绍校通过债转股的方式取得发行人股份，取得价格为 3.00 元/注册资本，低于同期增资价格，主要系：语音基金于 2019 年 8 月 28 日与公司及相关方签署了可转债投资协议，约定语音基金有权自汇成有限收到借款之日起 48 个月内将其对公司的 4,000 万元债权转为对公司的增资款，增资价格为 3 元/注册资本，2020 年 12 月，语音基金将其对公司的 2,000 万元债权及对应的债转股权利转让给自然人杨绍校。同时，语音基金、杨绍校分别将其对公司的 2,000 万元债权转为对公司的股权。

2、最近一年新增股东的基本情况

(1) 蔚华电子

公司名称	蔚华电子科技（上海）有限公司
统一社会信用代码	91310115782440819Q
企业类型	有限责任公司（外国法人独资）
注册资本	700.00 万美元
法定代表人	陈有谅
成立日期	2005 年 11 月 16 日
营业期限	2005 年 11 月 16 日至 2035 年 11 月 15 日
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区祖冲之路 1077 号 2 幢 3101A 室
经营范围	集成电路相关软件的研发、设计；集成电路制造专用设备、测试仪器、集成电路检测技术的研发；并提供相关的技术咨询和技术服务；集成电路机械设备、电子元器件、测试仪器及零配件的批发、进出口和佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务，自有集成电路机械设备、测试仪器的租赁（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按照国家有关规定办理申请）

截至本招股说明书签署日，蔚华电子的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万美元）	出资比例（%）
1	Spirox	700.00	100.00
	合计	700.00	100.00

(2) 国耀汇成

企业名称	合肥国耀汇成股权投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91340100MA2WDRAWXX
企业类型	有限合伙企业
认缴出资总额	2,010.00 万元
执行事务合伙人	合肥国耀资本投资管理有限公司
成立日期	2020 年 11 月 10 日
合伙期限	2020 年 11 月 10 日至 2027 年 11 月 9 日
住所	中国（安徽）自由贸易试验区合肥市高新区望江西路 860 号合芜蚌实验区科技创新公共服务和应用技术研发中心 D 座 503 室
经营范围	股权投资（未经金融监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；企业管理咨询服务（涉及行政许可的凭许可证经营）

截至本招股说明书签署日，国耀汇成的出资结构如下：

序号	合伙人名称	合伙人性质	出资额（万元）	出资比例（%）
1	合肥国耀资本投资管理有限公司	普通合伙人	10.00	0.50
2	合肥市创新科技风险投资有限公司	有限合伙人	2,000.00	99.50
合计			2,010.00	100.00

(3) Worth Plus

企业名称	Worth Plus Holdings Limited
公司编号	1653091
发行股本	5.00 万股（每股面值 1 美元）
董事	黄明端
成立日期	2011 年 6 月 8 日
注册地址	Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands
主营业务	对外投资

截至本招股说明书签署日，Worth Plus 的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例（%）
----	------	---------	---------

1	黄明端	2.50	50.00
2	李芝兰	2.50	50.00
合计		5.00	100.00

(4) Strong Lion

企业名称	Strong Lion Limited
公司编号	175659
法定股本	500.00 万股（每股面值 1 美元）
董事	叶培城
成立日期	2015 年 11 月 26 日
注册地址	The office of First Island Trust(Seychelles) Ltd. Of Suite 309, Capital City Building, Independence Avenue, Victoria, Mah é Republic of Seychelles.
主营业务	对外投资

截至本招股说明书签署日，Strong Lion 的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万美元）	出资比例（%）
1	叶培城	500.00	100.00
合计		500.00	100.00

(5) 刘汉滨

刘汉滨, 1947 年 2 月出生, 中国台湾籍, 台湾居民来往大陆通行证号 0005****。

(6) 鼎祥基金

公司名称	四川鼎祥股权投资基金有限公司
统一社会信用代码	9151010039659035XT
企业类型	有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本	50,000.00 万元
法定代表人	朱维
成立日期	2014 年 7 月 17 日
营业期限	2014 年 7 月 17 日至无固定期限
注册地址	中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段 1700 号 1 栋 2 单元 11 层 1108、1110-1116 号

经营范围	对非上市企业的股权、上市公司非公开发行的股权等非公开交易的股权投资以及相关咨询服务（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）
-------------	---

截至本招股说明书签署日，鼎祥基金的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	宋佳骏	40,000.00	80.00
2	宋玢阳	10,000.00	20.00
合计		50,000.00	100.00

（7）惠友豪创

企业名称	深圳市惠友豪创科技投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91440300MA5G7CPA2R
企业类型	有限合伙企业
认缴出资总额	120,000.01 万元
执行事务合伙人	深圳市惠友创盈投资管理有限公司
成立日期	2020年5月28日
合伙期限	2020年5月28日至无固定期限
注册地址	深圳市前海深港合作区南山街道桂湾片区二单元前海卓越金融中心（一期）8号楼 606A-15
经营范围	科技项目投资；投资兴办实业；投资咨询；科技信息咨询（以上不含限制类项目）

截至本招股说明书签署日，惠友豪创的出资结构如下：

序号	合伙人名称	合伙人性质	出资额（万元）	出资比例（%）
1	深圳市惠友创盈投资管理有限公司	普通合伙人	0.01	0.00
2	杨庆	有限合伙人	49,000.00	40.83
3	周祥书	有限合伙人	12,000.00	10.00
4	杨林	有限合伙人	10,000.00	8.33
5	深圳市创荟投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	8,800.00	7.33
6	共青城坤翎豪创投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	7,200.00	6.00
7	孙义强	有限合伙人	5,000.00	4.17

8	刘晨露	有限合伙人	5,000.00	4.17
9	深圳市伯翰创盈信息服务合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	5,000.00	4.17
10	深圳市瑞成永泽投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	5,000.00	4.17
11	深圳市创欣诚创业投资合伙企业(有限合伙)	有限合伙人	5,000.00	4.17
12	深圳市前海君爵投资管理有限公司	有限合伙人	5,000.00	4.17
13	苏州锦天前程投资管理中心(有限合伙)	有限合伙人	1,000.00	0.83
14	深圳市新思哲投资管理有限公司	有限合伙人	1,000.00	0.83
15	刘军	有限合伙人	1,000.00	0.83
合计			120,000.01	100.00

(8) 旗昌投资

公司名称	深圳市旗昌投资控股有限公司
统一社会信用代码	91440300MA5G4ATP98
企业类型	有限责任公司（法人独资）
注册资本	100,000.00 万元
法定代表人	郭健
成立日期	2020年4月2日
营业期限	2020年4月2日至2050年3月31日
注册地址	深圳市盐田区海山街道鹏湾社区海景二路1025号壹海国际中心2201
经营范围	受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理及其他限制项目）；股权投资、受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）

截至本招股说明书签署日，旗昌投资的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	招商局资本控股有限责任公司	100,000.00	100.00
合计		100,000.00	100.00

(9) 海通新动能

企业名称	辽宁海通新动能股权投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91210106MA106PA11U
企业类型	有限合伙企业
认缴出资总额	150,000.00 万元
执行事务合伙人	海通新能源私募股权投资管理有限公司
成立日期	2020 年 1 月 20 日
合伙期限	2020 年 1 月 20 日至 2027 年 1 月 20 日
注册地址	辽宁省沈阳经济技术开发区开发二十五号路 91-B80 号
经营范围	股权投资

截至本招股说明书签署日，海通新动能的出资结构如下：

序号	合伙人名称	合伙人性质	出资额（万元）	出资比例（%）
1	海通新能源私募股权投资管理有限公司	普通合伙人	1,000.00	0.67
2	辽宁控股（集团）有限责任公司	有限合伙人	35,000.00	23.33
3	辽宁交通投资有限责任公司	有限合伙人	30,000.00	20.00
4	海通开元投资有限公司	有限合伙人	29,000.00	19.33
5	辽宁省国有资产经营有限公司	有限合伙人	25,000.00	16.67
6	辽宁省水资源管理集团有限责任公司	有限合伙人	10,000.00	6.67
7	本钢集团有限公司	有限合伙人	10,000.00	6.67
8	辽宁省工程咨询集团有限责任公司	有限合伙人	5,000.00	3.33
9	辽宁省国际经济技术合作集团有限责任公司	有限合伙人	5,000.00	3.33
合计			150,000.00	100.00

（10）拾岳禾安

企业名称	六安拾岳禾安二期创业投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91341503MA2U9DU703
企业类型	有限合伙企业
认缴出资总额	35,510.00 万元
执行事务合伙人	合肥拾岳投资管理合伙企业（有限合伙）

成立日期	2019年11月6日
合伙期限	2019年11月6日至2039年10月25日
注册地址	六安市梅山南路农业科技大厦6楼
经营范围	股权投资

截至本招股说明书签署日，拾岳禾安的出资结构如下：

序号	合伙人名称	合伙人性质	出资额（万元）	出资比例（%）
1	合肥拾岳投资管理合伙企业（有限合伙）	普通合伙人	360.00	1.01
2	安徽省中小企业发展基金有限公司	有限合伙人	17,150.00	48.30
3	六安市产业投资基金有限公司	有限合伙人	7,000.00	19.71
4	桐城经开区产城一体化建设投资有限公司	有限合伙人	4,000.00	11.26
5	张驰	有限合伙人	3,000.00	8.45
6	安徽鑫涌聚实业有限公司	有限合伙人	1,000.00	2.82
7	华芳集团有限公司	有限合伙人	1,000.00	2.82
8	合肥拾岳谦淼创业投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	1,000.00	2.82
9	安徽金瑞投资集团有限公司	有限合伙人	1,000.00	2.82
合计			35,510.00	100.00

（11）昆桥基金

企业名称	昆桥（深圳）半导体科技产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91440300MA5G18CB47
企业类型	有限合伙企业
认缴出资总额	168,000.00 万元
执行事务合伙人	昆桥资本股权投资管理（深圳）有限公司
成立日期	2019年12月31日
合伙期限	2019年12月31日至2027年12月26日
注册地址	深圳市南山区粤海街道麻岭社区深南大道9966号威盛科技大厦26层
经营范围	受托资产管理、投资管理（不得从事信托、金融资产管理、证

	券资产管理及其他限制项目）；股权投资、受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务）
--	--

截至本招股说明书签署日，昆桥基金的出资结构如下：

序号	合伙人名称	合伙人性质	出资额（万元）	出资比例（%）
1	昆桥资本股权投资管理（深圳）有限公司	普通合伙人	3,037.00	1.81
2	深圳市引导基金投资有限公司	有限合伙人	42,000.00	25.00
3	深圳威盛上华科技有限公司	有限合伙人	33,500.00	19.94
4	合肥旭徽联芯管理咨询有限公司	有限合伙人	33,500.00	19.94
5	深圳市创新投资集团有限公司	有限合伙人	20,000.00	11.90
6	深圳市汇通金控基金投资有限公司	有限合伙人	15,663.00	9.32
7	OPPO 广东移动通信有限公司	有限合伙人	5,000.00	2.98
8	北京凡山金石投资发展合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	4,400.00	2.62
9	昆仲（深圳）财务顾问企业（有限合伙）	有限合伙人	2,700.00	1.61
10	世芯电子（上海）有限公司	有限合伙人	2,700.00	1.61
11	武汉市长飞资本管理有限责任公司	有限合伙人	2,500.00	1.49
12	泉恩集团有限公司	有限合伙人	2,000.00	1.19
13	上海昂昶企业管理合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	1,000.00	0.60
合计			168,000.00	100.00

（12）康启一号

企业名称	芜湖康启一号股权投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91340202MA2W9NA054
企业类型	有限合伙企业
认缴出资总额	14,200.00 万元
执行事务合伙人	芜湖宇歌企业管理有限公司
成立日期	2020 年 9 月 30 日
合伙期限	2020 年 9 月 30 日至 2040 年 9 月 29 日

注册地址	安徽省芜湖市镜湖区荆西社区小微企业孵化园 237-2 号
经营范围	企业投资、项目投资、股权投资（涉及前置许可的除外）（未经金融等监管部门的批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）

截至本招股说明书签署日，康启一号的出资结构如下：

序号	合伙人名称	合伙人性质	出资额（万元）	出资比例（%）
1	芜湖宇歌企业管理有限公司	普通合伙人	100.00	0.70
2	江苏青和投资管理有限公司	有限合伙人	4,000.00	28.17
3	蔡伟江	有限合伙人	2,000.00	14.08
4	北海太元投资有限公司	有限合伙人	1,700.00	11.97
5	陈秀萍	有限合伙人	1,000.00	7.04
6	方俊生	有限合伙人	1,000.00	7.04
7	谭皓兰	有限合伙人	1,000.00	7.04
8	林鸽	有限合伙人	600.00	4.23
9	郭丙合	有限合伙人	500.00	3.52
10	苏卫宏	有限合伙人	500.00	3.52
11	齐鸣	有限合伙人	500.00	3.52
12	韩俊霄	有限合伙人	500.00	3.52
13	和泓控股集团有限公司	有限合伙人	500.00	3.52
14	袁志明	有限合伙人	200.00	1.41
15	范向阳	有限合伙人	100.00	0.70
合计			14,200.00	100.00

（13）道银投资

企业名称	宁波梅山保税港区道银投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91330206MA29088016
企业类型	有限合伙企业
认缴出资总额	3,110.00 万元
执行事务合伙人	信达风投资管理有限公司
成立日期	2017 年 4 月 25 日
合伙期限	2017 年 4 月 25 日至 2027 年 4 月 24 日

注册地址	浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 A 区 F2699
经营范围	实业投资、投资管理、投资咨询（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）

截至本招股说明书签署日，道银投资的出资结构如下：

序号	合伙人名称	合伙人性质	出资额（万元）	出资比例（%）
1	信达风投资管理有限公司	普通合伙人	100.00	3.22
2	东吴创新资本管理有限责任公司	有限合伙人	1,500.00	48.23
3	泰州东部新城发展集团有限公司	有限合伙人	1,000.00	32.15
4	李从军	有限合伙人	400.00	12.86
5	吴昊	有限合伙人	110.00	3.54
合计			3,110.00	100.00

（14）十月吴巽

企业名称	宁波十月吴巽股权投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91330201MA2AG7T94X
企业类型	有限合伙企业
认缴出资总额	34,100.00 万元
执行事务合伙人	宁波十月桐生投资管理合伙企业（有限合伙）
成立日期	2017 年 12 月 8 日
合伙期限	2017 年 12 月 8 日至 2037 年 12 月 7 日
注册地址	浙江省宁波市北仑区新碶进港路 406 号 2 号楼 3016-3 室
经营范围	股权投资（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集融资等金融业务）

截至本招股说明书签署日，十月吴巽的出资结构如下：

序号	合伙人名称	合伙人性质	出资额（万元）	出资比例（%）
1	宁波十月桐生投资管理合伙企业（有限合伙）	普通合伙人	300.00	0.88
2	姜煜峰	有限合伙人	10,800.00	31.67
3	东吴创新资本管理有限责任公司	有限合伙人	9,900.00	29.03

4	华芳创业投资有限公司	有限合伙人	5,000.00	14.66
5	刘胜昔	有限合伙人	4,000.00	11.73
6	崔岭	有限合伙人	1,600.00	4.69
7	龚寒汀	有限合伙人	1,300.00	3.81
8	李华贞	有限合伙人	1,000.00	2.93
9	彭焱	有限合伙人	200.00	0.59
合计			34,100.00	100.00

（15）语音基金

企业名称	安徽省智能语音及人工智能创业投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91340100MA2T0XK12L
企业类型	有限合伙企业
认缴出资总额	100,099.00 万元
执行事务合伙人	合肥国耀资本投资管理有限公司
成立日期	2018 年 8 月 21 日
合伙期限	2018 年 8 月 21 日至 2025 年 8 月 20 日
注册地址	合肥市高新区创新大道 2800 号创新产业园二期 E1 栋基金大厦 539 室
经营范围	股权投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等相关金融业务）；资产管理；投资咨询；企业管理咨询

截至本招股说明书签署日，语音基金的出资结构如下：

序号	合伙人名称	合伙人性质	出资额（万元）	出资比例（%）
1	合肥国耀资本投资管理有限公司	普通合伙人	100.00	0.10
2	合肥高新建设投资集团公司	有限合伙人	40,000.00	39.96
3	合肥市创业投资引导基金有限公司	有限合伙人	25,000.00	24.98
4	安徽省中小企业发展基金有限公司	有限合伙人	20,000.00	19.98
5	合肥市工业投资控股有限公司	有限合伙人	14,999.00	14.98
合计			100,099.00	100.00

（16）杨绍校

杨绍校，1970年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码513027197006*****。

（17）华登基金

企业名称	合肥华登二期集成电路产业投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91340100MA2WBXE765
企业类型	有限合伙企业
认缴出资总额	180,727.68 万元
执行事务合伙人	青岛华盈华创投资管理中心（有限合伙）
成立日期	2020年10月26日
合伙期限	2020年10月26日至2027年10月25日
注册地址	中国（安徽）自由贸易试验区合肥市高新区创新大道2800号创新产业园二期E1栋基金大厦647室
经营范围	汽车电子及半导体行业的投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等相关金融业务）；企业管理咨询

截至本招股说明书签署日，华登基金的出资结构如下：

序号	合伙人名称	合伙人性质	出资额（万元）	出资比例（%）
1	青岛华盈华创投资管理中心（有限合伙）	普通合伙人	1,807.28	1.00
2	合肥华登华芯集成电路产业投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	65,220.40	36.09
3	青岛半导体产业发展基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	49,000.00	27.11
4	西藏芯康瑞企业管理合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	20,000.00	11.07
5	矽力杰半导体技术（杭州）有限公司	有限合伙人	20,000.00	11.07
6	珠海横琴任君兴泰创业投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	6,568.63	3.63
7	鹰潭榕棠达鑫企业服务中心（有限合伙）	有限合伙人	5,700.00	3.15
8	珠海横琴任君兴安创业投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	4,931.37	2.73
9	共青城小叶紫檀五号投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	4,000.00	2.21
10	共青城智信卓远投资合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	3,500.00	1.94

合计	180,727.68	100.00
----	------------	--------

(18) 旭鼎一号

企业名称	芜湖旭鼎一号股权投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91340202MA2WE17M3H
企业类型	有限合伙企业
认缴出资总额	1,590.00 万元
执行事务合伙人	北京朗姿韩亚资产管理有限公司
成立日期	2020 年 11 月 11 日
合伙期限	2020 年 11 月 11 日至 2040 年 11 月 10 日
注册地址	安徽省芜湖市镜湖区荆山街道荆西社区小微企业孵化园 227-6 号
经营范围	企业投资、项目投资、股权投资（涉及前置许可的除外）（未经金融等监管部门的批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）

截至本招股说明书签署日，旭鼎一号的出资结构如下：

序号	合伙人名称	合伙人性质	出资额（万元）	出资比例（%）
1	北京朗姿韩亚资产管理有限公司	普通合伙人	10.00	0.63
2	林春良	有限合伙人	737.33	46.37
3	杨毅	有限合伙人	372.63	23.44
4	朱海玉	有限合伙人	287.38	18.07
5	吴少平	有限合伙人	182.66	11.49
合计			1,590.00	100.00

(六) 本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例

截至本招股说明书签署日，本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例具体如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）	关联关系
1	扬州新瑞连	17,410.36	26.07	1、杨会持有扬州新瑞连 70.00% 的出资额，郑瑞俊持有汇成投资 70.00% 的股权，郑瑞俊持有香港宝信 44.64% 的股权，郑瑞俊持有合肥芯成 37.37% 的出资额且担任执行事务合伙人，郑瑞俊担任执行事务合伙人的合肥宝芯、合肥汇芯系合肥芯成有限合伙人，郑瑞俊、
	杨会	2,359.39	3.53	
	汇成投资	3,771.67	5.65	
	香港宝信	1,250.00	1.87	

	合肥芯成	1,109.70	1.66	杨会系夫妻关系； 2、纪念持有扬州新瑞连 30.00%的出资额，沈国威持有汇成投资 30.00%的股权，沈国威、纪念系夫妻关系。
2	嘉兴高和	6,000.00	8.98	1、杨绍校担任嘉兴高和执行事务合伙人，持有嘉兴高和 70.00%的出资额； 2、嘉兴高和系高投邦盛的有限合伙人，持有高投邦盛 3.06%的出资额； 3、苏州邦盛聚泽创业投资企业（有限合伙）系高投邦盛的有限合伙人，持有高投邦盛 9.18%的出资额，嘉兴高和持有邦盛聚泽 3.33%的出资额，杨会持有邦盛聚泽 9.98%的出资额； 4、杨会持有南京邦盛聚洋创业投资企业（有限合伙）37.04%的出资额，邦盛聚洋持有高投邦盛 24.49%的出资额； 5、高投邦盛的执行事务合伙人江苏邦盛股权投资基金管理有限公司的控股股东为南京邦盛投资管理有限公司；邦盛聚源的执行事务合伙人同为南京邦盛投资管理有限公司。
	高投邦盛	1,204.02	1.80	
	杨绍校	666.67	1.00	
	杨会	2,359.39	3.53	
	邦盛聚源	30.24	0.05	
3	合肥创投	1,200.00	1.80	1、合肥创投与语音基金的基金管理人均为合肥产投资本管理有限公司； 2、语音基金与国耀汇成的执行事务合伙人均为合肥国耀资本投资管理有限公司； 3、合肥创投、合肥产投资本管理有限公司及合肥国耀资本投资管理有限公司均为合肥市产业投资控股（集团）有限公司控制的企业。
	语音基金	666.67	1.00	
	国耀汇成	400.00	0.60	
4	拾岳禾安	909.09	1.36	拾岳禾安、十月吴巽的实际控制人均为龚寒汀。
	十月吴巽	363.64	0.54	
5	康启一号	727.27	1.09	康启一号私募基金管理人芜湖元祐投资管理有限公司为旭鼎一号私募基金管理人北京朗姿韩亚资产管理有限公司的全资子公司。
	旭鼎一号	300.00	0.45	
6	蔚华电子	1,700.00	2.55	Strong Lion 是蔚华电子控股股东蔚华科技的董事叶培城控制的企业。
	Strong Lion	100.00	0.15	

除上述情况外，截至本招股说明书签署日，不存在其他应予以披露的各股东间的关联关系。

（七）股东基金备案情况及穿透计算的股东人数

1、股东基金备案情况

截至本招股说明书签署日，发行人股东中共有 14 家股东属于私募基金规则所规范的私募投资基金，均已完成基金管理人登记及基金备案的手续，具体情况如下：

序号	股东名称	基金编号	备案时间	基金管理人名称	管理人编号
1	高投邦盛	S20237	2014/8/18	江苏邦盛股权投资基金管理有限公司	P1001650
2	合肥创投	SD4606	2014/10/15	合肥产投资本管理有限公司	P1071755
3	国耀汇成	SNJ019	2020/12/24	合肥国耀资本投资管理有限公司	P1070881
4	鼎祥基金	SJ8599	2016/7/14	四川鼎祥股权投资基金有限公司	P1017268
5	十月吴巽	SCC708	2018/1/11	宁波十月桐生投资管理合伙企业（有限合伙）	P1065078
6	拾岳禾安	SJJ558	2019/12/4	合肥拾岳投资管理合伙企业（有限合伙）	P1069486
7	康启一号	SNB444	2020/11/5	芜湖元祐投资管理有限公司	P1066906
8	惠友豪创	SLE922	2020/6/24	深圳市惠友创盈投资管理有限公司	P1023992
9	昆桥基金	SGY603	2020/1/14	昆桥资本股权投资管理（深圳）有限公司	P1070031
10	语音基金	SGD978	2019/6/20	合肥产投资本管理有限公司	P1071755
11	华登基金	SNC493	2020/12/18	华芯原创（青岛）投资管理有限公司	P1060141
12	旭鼎一号	SNT016	2021/1/21	北京朗姿韩亚资产管理有限公司	P1069524
13	海通新动能	SJX017	2020/5/18	海通新能源股权投资管理有限公司	GC1900031593
14	道银投资	SND885	2020/10/30	信达风投资管理有限公司	P1004370

2、穿透计算的股东人数

根据《非上市公众公司监管指引第4号—股东人数超过200人的未上市股份有限公司申请行政许可有关问题的审核指引》（中国证监会公告[2013]54号，以下简称《非上市公众公司监管指引第4号》），以私募股权基金、资产管理计划以及其他金融计划进行持股的，如果该金融计划是依据相关法律法规设立并规范运作，且已经接受证券监督管理机构监管的，可不进行股份还原或转为直接持股。

根据《上海证券交易所科创板股票发行上市审核问答》第11条的相关规定，公司在申报前实施员工持股计划，员工持股计划遵循“闭环原则”的，在计算股东人数时，按一名股东计算。

按照上述规定，截至本招股说明书签署日，穿透计算发行人股东人数如下表所示：

序号	股东名称/姓名	穿透后股东情况	最终计算人数
1	扬州新瑞连	杨会等2名自然人	2

序号	股东名称/姓名	穿透后股东情况	最终计算人数
2	嘉兴高和	杨绍校等 2 名自然人	2
3	志道投资	不需要穿透，不是单纯以持有公司股权为目的的公司	1
4	汇成投资	郑瑞俊等 2 名自然人	2
5	Advance	陈玉琴等 4 名自然人	4
6	Great Title	童富等 5 名自然人	5
7	Worth Plus	黄明端等 2 名自然人	2
8	杨会	1 名自然人（不重复计算）	0
9	鼎祥基金	已备案私募基金	1
10	蔚华电子	不需要穿透，不是单纯以持有公司股权为目的的公司	1
11	扬州耕天下	林瑞琪等 2 名自然人	2
12	扬州和安	潘进等 2 名自然人	2
13	惠友豪创	已备案私募基金	1
14	上海享埜	戴嘉慧等 2 名自然人	2
15	旗昌投资	不需要穿透，不是单纯以持有公司股权为目的的公司	1
16	海通新动能	已备案私募基金	1
17	香港宝信	郑瑞俊等 22 名自然人（郑瑞俊不重复计算）	21
18	高投邦盛	已备案私募基金	1
19	合肥创投	已备案私募基金	1
20	合肥芯成 ^注	公司员工持股平台，符合“闭环原则”，按一名股东计算	1
21	华得富	彭升华等 12 名自然人	12
22	华登基金	已备案私募基金	1
23	Win Plus	徐盛育等 12 名自然人	12
24	拾岳禾安	已备案私募基金	1
25	康启一号	已备案私募基金	1
26	昆桥基金	已备案私募基金	1
27	语音基金	已备案私募基金	1
28	杨绍校	1 名自然人（不重复计算）	0
29	道银投资	已备案私募基金	1
30	国耀汇成	已备案私募基金	1
31	十月吴巽	已备案私募基金	1
32	田林林	1 名自然人	1
33	旭鼎一号	已备案私募基金	1

序号	股东名称/姓名	穿透后股东情况	最终计算人数
34	刘汉滨	1名自然人	1
35	Strong Lion	叶培城 1名自然人	1
36	邦盛聚源	穿透后普通合伙人为南京邦盛投资管理有限公司（已登记私募基金管理人），有限合伙人为丁炜鉴等 10 名自然人	11
合计			100

注：合肥芯成由公司持股平台合肥宝芯、合肥汇芯及其他自然人员工持股。合肥芯成、合肥宝芯和合肥汇芯均符合“闭环原则”的规定，在计算公司股东人数时，合肥芯成按一名股东计算。

综上，公司股东穿透计算后的人数为 100 名，未超过 200 人。

（八）发行人历史上签署的对赌协议及其解除情况

发行人控股股东扬州新瑞连、实际控制人郑瑞俊、杨会与部分股东曾经签订了存在特殊股东权利条款的协议（以下简称“对赌协议”），具体情况如下：

涉及股东名称	签署时间	约定的特殊权利	解除情况
合肥创投	2016年10月	扬州新瑞连等原股东股权回购及反稀释权、限制出售权、优先出售权、优先清算权、限制分红权等	合肥创投已于 2021 年 7 月出具书面确认，确认对赌协议自汇成股份正式递交上市申报材料之日起效力终止，若汇成股份未能完成合格上市，则相关对赌协议效力恢复
嘉兴高和	2019年7月	控股股东股权回购及董事、监事委派权、现金退出选择权、跟随出售权等投资者权益	嘉兴高和与相关各方已于 2021 年 7 月签署补充协议，约定对赌协议彻底解除
语音基金	2019年8月	实际控制人股权回购及反稀释权、限制出售权、优先出售权、优先清算权等	语音基金与相关各方已于 2021 年 7 月签署补充协议，确认对赌协议自汇成股份正式递交上市申报材料之日起效力终止，若汇成股份未能完成合格上市，则相关对赌协议效力恢复
志道投资	2020年3月	控股股东、实际控制人回购及反稀释权、限制出售权、优先出售权、优先清算权等	志道投资与相关各方已于 2021 年 7 月签署补充协议，约定对赌协议彻底解除
Strong Lion	2020年11月	控股股东、实际控制人回购	Strong Lion 与相关各方已于 2021 年 7 月签署补充协议，约定对赌协议彻底解除
蔚华电子	2020年11月	控股股东、实际控制人回购	蔚华电子与相关各方已于 2021 年 7 月签署补充协议，约定对赌协议彻底解除

国耀汇成	2020年11月	控股股东、实际控制人回购	国耀汇成与相关各方已于2021年7月签署补充协议，确认对赌协议自汇成股份正式递交上市申报材料之日起效力终止，若汇成股份未能完成合格上市，则相关对赌协议效力恢复
拾岳禾安 十月吴巽	2020年11月	控股股东、实际控制人回购及反稀释权、限制出售权、优先出售权、优先清算权等	拾岳禾安、十月吴巽与相关各方已于2021年7月签署补充协议，确认对赌协议自汇成股份正式递交上市申报材料之日起效力终止，若汇成股份未能完成合格上市，则相关对赌协议效力恢复
昆桥基金	2020年11月	控股股东、实际控制人回购及反稀释权、限制出售权、优先出售权、优先清算权等	昆桥基金与相关各方已于2021年7月签署补充协议，确认对赌协议自汇成股份正式递交上市申报材料之日起效力终止，若汇成股份未能完成合格上市，则相关对赌协议效力恢复
海通新动能	2020年11月	控股股东、实际控制人回购及反稀释权、限制出售权、优先出售权、优先清算权等	海通新动能与相关各方已于2021年7月签署补充协议，确认对赌协议自汇成股份正式递交上市申报材料之日起效力终止，若汇成股份未能完成合格上市，则相关对赌协议效力恢复
道银投资	2020年11月	控股股东、实际控制人回购及反稀释权、限制出售权、优先出售权、优先清算权等	道银投资与相关各方已于2021年7月签署补充协议，确认对赌协议自汇成股份正式递交上市申报材料之日起效力终止，若汇成股份未能完成合格上市，则相关对赌协议效力恢复
惠友豪创	2020年11月	控股股东、实际控制人回购及反稀释权、限制出售权、优先出售权、优先清算权等	惠友豪创与相关各方已于2021年7月签署补充协议，确认对赌协议自汇成股份正式递交上市申报材料之日起效力终止，若汇成股份未能完成合格上市，则相关对赌协议效力恢复
旗昌投资	2020年11月	控股股东、实际控制人回购及反稀释权、限制出售权、优先出售权、优先清算权等	旗昌投资与相关各方已于2021年7月签署补充协议，确认对赌协议自汇成股份正式递交上市申报材料之日起效力终止，若汇成股份未能完成合格上市，则相关对赌协议效力恢复
鼎祥基金	2020年11月	控股股东、实际控制人回购及反稀释权、限制出售权、优先出售权、优先清算权等	鼎祥基金与相关各方已于2021年7月签署补充协议，确认对赌协议自汇成股份正式递交上市申报材料之日起效力终止，若汇成股份未能完成合格上市，则相关对赌协议效力恢复
康启一号	2020年11月	控股股东、实际控制人回购及反稀释权、限制出售权、优先出售权、优先清算权等	康启一号与相关各方已于2021年7月签署补充协议，确认对赌协议自汇成股份正式递交上市申报材料之日起效力

			终止，若汇成股份未能完成合格上市，则相关对赌协议效力恢复
华登基金	2021年1月	控股股东、实际控制人回购及反稀释权、限制出售权、优先出售权、优先清算权等	华登基金与相关各方已于2021年7月签署补充协议，确认对赌协议自汇成股份正式递交上市申报材料之日起效力终止，若汇成股份未能完成合格上市，则相关对赌协议效力恢复

公司控股股东、实际控制人等相关方与嘉兴高和、志道投资、Strong Lion、蔚华电子签订的对赌协议已彻底解除。

根据公司控股股东、实际控制人等相关方与合肥创投、语音基金、国耀汇成、拾岳禾安、十月吴巽、昆桥基金、海通新动能、道银投资、惠友豪创、旗昌投资、鼎祥基金、康启一号、华登基金等股东签署的补充协议，相关对赌协议自汇成股份正式递交上市申报材料之日起效力终止，若出现汇成股份自行撤回首次公开发行上市申请，或汇成股份首次公开发行上市申请未获得证券监管机构的同意/核准/批准，或汇成股份未能成功发行股份等原因致使汇成股份未能完成上市的情形，相关对赌协议效力恢复。

发行人未作为相关对赌协议的当事人，无需承担任何权利义务；相关对赌协议不存在可能导致公司控制权变化的约定；相关对赌协议不与市值挂钩；相关对赌协议不存在严重影响发行人持续经营能力或者其他严重影响投资者权益的情形。因此，上述对赌协议虽未彻底解除，但不存在可能导致公司控制权变化、不存在其他严重影响发行人持续经营能力或者其他严重影响投资者权益的情形，符合《科创板股票发行上市审核问答（二）》的相关要求。

九、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员

（一）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况

1、董事

截至本招股说明书签署日，发行人董事会由7名董事组成，其中独立董事3人，具体情况如下：

序号	姓名	现任职务	提名人	本届任职期间
----	----	------	-----	--------

1	郑瑞俊	董事长	扬州新瑞连	2021年3月26日-2024年3月25日
2	沈建纬	董事	扬州新瑞连	2021年3月26日-2024年3月25日
3	赵亚彬	董事	志道投资	2021年3月26日-2024年3月25日
4	吴海龙	董事	合肥创投	2021年3月26日-2024年3月25日
5	杨辉	独立董事	扬州新瑞连	2021年3月26日-2024年3月25日
6	程敏	独立董事	扬州新瑞连	2021年3月26日-2024年3月25日
7	蔺智挺	独立董事	扬州新瑞连	2021年6月30日-2024年3月25日

公司现任董事的简历如下：

（1）郑瑞俊，男，1963年1月出生，中国台湾籍，硕士学历。1994年7月至今，历任瑞成建筑董事长、董事等职；2011年8月至今，历任江苏汇成董事、董事长、执行董事、总经理等职；2016年6月至2020年9月，任汇成有限董事长；2020年9月至2021年3月，任汇成有限董事长、总经理；2021年3月至今，任汇成股份董事长、总经理。

（2）沈建纬，男，1959年4月出生，中国台湾籍，高中学历。1987年11月至1993年5月，任建纬机械有限公司总经理；1993年5月至1999年7月，从事房产投资业务；1999年7月至今，历任瑞成建筑总经理、副董事长、董事长等职；2011年8月至2020年8月，任江苏汇成董事；2016年6月至2021年3月，任汇成有限董事；2021年3月至今，任汇成股份董事。

（3）赵亚彬，男，1967年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1988年7月至1994年7月，任中国银行安徽省分行国际业务部职员；1994年7月至1997年9月，任安徽省化工轻工总公司职员；1997年9月至2004年7月，任安徽省华物期货经纪有限责任公司部门经理；2004年7月至2009年10月，任合肥信息投资有限公司副总经理；2009年10月至2013年3月，任安徽新华长江投资有限公司副总经理；2013年4月至今，历任正奇股权投资总监、副总裁；2021年3月至今，任汇成股份董事。

（4）吴海龙，男，1988年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，美国特许金融分析师（CFA），金融风险管理师。2013年5月至2014年6月，任东方金诚国际信用评估有限公司安徽分公司分析师；2014年6月至2015

年3月，任合肥市国有资产控股有限公司投资部助理业务员；2015年3月至2019年11月，历任合肥市产业投资控股（集团）有限公司基金部投资经理、高级投资经理、副总经理（主持工作）；2019年12月至今，任合肥产投资本管理有限公司董事、副总经理；2021年3月至今，任汇成股份董事。

（5）杨辉，男，1964年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1987年7月至1999年12月，任合肥经济技术学院教师；1999年12月至今，历任中国科学技术大学管理学院副教授、法律硕士教育中心主任、公共事务学院副教授；2021年3月至今，任汇成股份独立董事。

（6）程敏，女，1966年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1987年7月至2000年7月，任安徽省财政学校教师；2000年7月至今，任安徽大学会计系副教授；2021年3月至今，任汇成股份独立董事。

（7）藺智挺，男，1981年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2009年3月至2011年9月，任中国科学技术大学计算机科学与技术系博士后；2011年10月至今，历任安徽大学电子信息工程学院讲师、副教授、教授；2021年6月至今，任汇成股份独立董事。

2、监事

截至本招股说明书签署日，发行人监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1人，具体情况如下：

序号	姓名	职位	提名人	本届任职期间
1	杨欢	监事会主席	嘉兴高和	2021年3月26日-2024年3月25日
2	赵志清	监事	扬州新瑞连	2021年3月26日-2024年3月25日
3	程红艳	职工代表监事	职工代表大会	2021年3月26日-2024年3月25日

公司现任监事的简历如下：

（1）杨欢，男，1987年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，电气工程师。2009年6月至今，历任浙江高和羊毛科技有限公司电气技术员、车间主任助理、副总助理、副总助理兼车间主任、产品总监；2021年3月至今，任汇成股份监事。

(2) 赵志清，男，1979年12月出生，中国台湾籍，本科学历。2007年6月至2012年2月，任巨奕科技股份有限公司工程经理；2012年4月至2021年3月，历任江苏汇成业务营销部经理、总监；2021年3月至今，任汇成股份监事、业务营销部总监。

(3) 程红艳，女，1983年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2006年4月至2015年2月，任合肥金屯旅游服务有限公司主管；2015年6月至2016年6月，任合肥洁家卫生材料有限公司主管；2016年7月至2017年7月，任合肥通升捷电子有限公司人事行政科长；2017年9月至2021年3月，任汇成有限行政管理部专案专员；2021年3月至今，任汇成股份职工代表监事、行政管理部专案专员。

3、高级管理人员

截至本招股说明书签署日，发行人高级管理人员包括：总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。公司共有高级管理人员5名，具体情况如下：

序号	姓名	职位	本届任职期间
1	郑瑞俊	总经理	2021年3月26日-2024年3月25日
2	林文浩	副总经理	2021年3月26日-2024年3月25日
3	钟玉玄	副总经理	2021年3月26日-2024年3月25日
4	马行天	副总经理	2021年3月26日-2024年3月25日
5	施周峰	财务总监、董事会秘书	2021年3月26日-2024年3月25日

公司现任高级管理人员的简历如下：

(1) 郑瑞俊，简历参见本节“九、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员”之“（一）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况”之“1、董事”。

(2) 林文浩，男，1970年11月出生，中国台湾籍，本科学历。2001年7月至2003年5月，任华辰科技股份有限公司工程课课长；2003年5月至2005年9月，任和舰科技（苏州）有限公司工程部经理；2005年9月至2009年8月，任硕中科技（苏州）有限公司工程部经理；2009年9月至2014年11月，任昆山龙腾光电股份有限公司专案经理；2014年12月至2016年4月，任苏州顺惠

有色金属制品有限公司厂长；2016年4月至2016年8月，任丽智电子（昆山）有限公司供应链处长；2016年9月至2021年3月，任汇成有限生产制造部总监、研发中心主任；2021年3月至今，任汇成股份副总经理、研发中心主任。

（3）钟玉玄，女，1963年3月出生，中国台湾籍，专科学历。1990年2月至2003年3月，任京元电子股份有限公司生产部经理；2003年3月至2006年9月，任华阳电子股份有限公司协理；2006年9月至2013年9月，任颀邦科技股份有限公司生产部资深处长；2013年10月至2015年4月，任江苏汇成生产制造部总监；2017年3月至2019年4月，任江苏汇成生产制造部总监；2019年4月至2021年3月，任汇成有限生产制造部总监、研发中心副主任；2021年3月至今，任汇成股份副总经理、生产制造部总监、研发中心副主任。

（4）马行天，男，1966年5月出生，中国台湾籍，本科学历。1989年12月至1991年9月，任联华电子股份有限公司高级工程师；1991年10月至1997年8月，任旺宏电子股份有限公司项目经理；1997年9月至2011年11月，任联华电子股份有限公司亚太业务处副处长；2011年12月至2012年8月，任联华骐商贸（北京）有限责任公司总经理；2012年9月至2013年7月，任智原科技股份有限公司业务支援总监；2014年1月至2014年8月，任星展通有限公司负责人；2014年9月至2015年10月，任联华电子股份有限公司亚太业务处处长；2015年11月至2017年9月，任联曝半导体（山东）有限公司业务副总经理；2017年12月至2020年8月，任九佳科技股份有限公司业务副总经理；2020年8月至2021年3月，任汇成有限业务营销部总监；2021年3月至今，任汇成股份副总经理。

（5）施周峰，男，1982年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。2006年7月至2008年11月，就职于宁波天邦股份有限公司；2008年11月至2015年5月，任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理、项目总监等职；2015年6月至2019年10月，任国元证券股份有限公司投资银行部高级项目经理；2019年11月至2021年3月，任汇成有限财务负责人；2021年3月至今，任汇成股份财务总监、董事会秘书。

4、核心技术人员

公司核心技术人员的认定标准为：在公司产品相关的技术领域有对口的专业背景和深厚的技术基础，长期从事公司产品领域的技术工作；有一定的技术开发组织管理能力；所从事技术领域的产品对公司的营收贡献较大。根据认定标准，截至本招股说明书签署日，发行人核心技术人员共 4 名，具体情况如下：

序号	姓名	职位
1	林文浩	副总经理、研发中心主任
2	钟玉玄	副总经理、生产制造部总监、研发中心副主任
3	许原诚	生产制造部总监、研发中心总监
4	陈汉宗	生产制造部总监、研发中心总监

公司核心技术人员的简历如下：

（1）林文浩，简历参见本节“九、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员”之“（一）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况”之“3、高级管理人员”。

（2）钟玉玄，简历参见本节“九、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员”之“（一）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况”之“3、高级管理人员”。

（3）许原诚，男，1971 年 11 月出生，中国台湾籍，硕士学历。2000 年 5 月至 2002 年 5 月，任远东纺织化纤股份有限公司品保科长；2002 年 5 月至 2008 年 6 月，任米辑科技股份有限公司黄光科科长；2008 年 6 月至 2010 年 10 月，任飞信半导体股份有限公司黄光科副理；2010 年 10 月至 2015 年 4 月，任颀邦科技股份有限公司专案副理；2015 年 5 月至 2016 年 4 月，任职于联立（徐州）半导体有限公司；2016 年 6 月至 2021 年 3 月，任汇成有限生产制造部总监、研发中心总监；2021 年 3 月至今，任汇成股份生产制造部总监、研发中心总监。

（4）陈汉宗，男，1971 年 12 月出生，中国台湾籍，本科学历。2000 年 8 月至 2003 年 6 月，任联华电子股份有限公司测试设备工程师；2003 年 6 月至 2011 年 10 月，任颀邦科技股份有限公司测试制造主任、产品工程主管；2012 年 5 月

至 2017 年 2 月，任群雅电子股份有限公司产品主管、制造经理；2017 年 2 月至 2018 年 2 月，任立卫科技股份有限公司生产经理；2018 年 3 月至 2019 年 11 月，任东莞矽德半导体有限公司研发副处长；2019 年 12 月至 2021 年 3 月，任汇成有限生产制造部总监、研发中心总监；2021 年 3 月至今，任汇成股份生产制造部总监、研发中心总监。

（二）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的兼职情况

截至本招股说明书签署日，发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的兼职情况及所兼职单位与发行人的关联关系情况如下：

姓名	兼职单位	兼职职务	兼职单位与发行人关系
郑瑞俊	合肥芯成	执行事务合伙人	发行人员工持股平台
	合肥宝芯	执行事务合伙人	发行人员工持股平台
	合肥汇芯	执行事务合伙人	发行人员工持股平台
	香港宝信	董事	发行人员工持股平台
	汇成投资	董事	实际控制人控制的企业
	瑞成建筑	董事	实际控制人控制的企业
	瑞成投资	董事	实际控制人控制的企业
	香港瑞仕	董事	实际控制人控制的企业
	百瑞发投资	董事长	实际控制人控制的企业
	海口三立现代办公设备有限公司 ^(注1)	董事长	实际控制人控制的企业
	本溪瑞成房地产开发经营有限公司 ^(注2)	副董事长	无其他关联关系
	海南巨东房地产开发有限公司 ^(注3)	副董事长	无其他关联关系
沈建纬	瑞成建筑	董事长、总经理	实际控制人控制的企业
赵亚彬	正奇控股	副总裁	间接持股 5% 以上股东
	志道投资	董事兼总经理	持股 5% 以上股东
	西藏志道企业管理有限公司	董事长兼总经理	持股 5% 以上股东控制的企业
	武汉正奇志道投资有限公司	执行董事兼总经理	持股 5% 以上股东控制的企业
	合肥质然房地产开发有限公司	董事	无其他关联关系
	正奇（上海）股权投资管理有限公司	董事兼总经理	
	合肥工大高科信息科技股份有限公司	董事	

	安徽新华国金小额贷款有限公司	总经理	
	安徽九华山旅游发展股份有限公司	董事	
	安徽正奇资产管理有限公司	董事兼总经理	
	一拓通信集团股份有限公司	董事	
	圣湘生物科技股份有限公司	监事	
吴海龙	合肥市东芯信息技术有限公司	董事	无其他关联关系
	合肥新站众智创业投资有限公司	董事	
	合肥产投资本管理有限公司	董事兼副总经理	
	合肥中科环境监测技术国家工程实验室有限公司	董事长	
	安徽易芯半导体有限公司	董事	
	安徽省信息产业投资控股有限公司	董事	
	合肥北航通航产业技术有限公司	董事	
杨辉	安徽金禾实业股份有限公司	独立董事	无其他关联关系
	国元农业保险股份有限公司	独立董事	
	安徽金田高新材料股份有限公司	独立董事	
	中国科学技术大学	公共事务学院副教授	
程敏	合肥常青机械股份有限公司	独立董事	无其他关联关系
	芜湖富春染织股份有限公司	独立董事	
	安徽大学	会计系副教授	
蔺智挺	安徽麦种科技有限公司	技术总监	无其他关联关系
	安徽大学	电子信息工程学院教授	

注 1：海口三立现代办公设备有限公司已于 1993 年 3 月因逾期未年检被吊销，正在办理注销登记手续；

注 2：本溪瑞成房地产开发经营有限公司已于 2001 年 6 月因逾期未年检被吊销；

注 3：海南巨东房地产开发有限公司已于 1999 年 12 月因逾期未年检被吊销。

（三）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互间亲属关系

截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互间不存在亲属关系。

（四）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员与公司签订的协议及履行情况

截至本招股说明书签署日，在发行人处任职的董事、监事、高级管理人员及

核心技术人员均与公司签署了劳动合同、保密协议，公司核心技术人员与公司签订了竞业禁止协议。自前述协议签订以来，发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员均严格履行协议约定的义务和职责，遵守相关承诺。

除上述协议外，发行人未与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签订其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的协议。

（五）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所持股份被质押、冻结或发生诉讼纠纷的情形

截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均未直接持有公司股份。

公司董事长、总经理郑瑞俊的配偶杨会控制的扬州新瑞连所持公司股份存在股份质押情形，详见本招股说明书“重大事项提示”之“二、发行人控股股东所持发行人股份存在质押情形”。

除上述情形外，截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所持股份不存在被质押、冻结或发生诉讼纠纷的情况。

（六）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在最近两年内的变动情况、原因以及对公司的影响

公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近 24 个月内无重大变化。2021 年 3 月之前，汇成有限设董事 5 名、高级管理人员 2 名。公司整体改制成股份公司之后，完善了公司治理结构，构建了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理框架，发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员变动情况如下：

1、发行人董事最近两年的变动情况

2019 年 1 月至 2019 年 5 月，汇成有限的董事会成员为郑瑞俊、沈建纬、袁飞、杨绍校、郭小鹏、谈林、萧明山。

2019 年 5 月，公司为提高决策效率，董事席位由 7 名减少至 5 名，杨绍校、谈林不再担任董事职务，汇成有限的董事会成员变更为郑瑞俊、沈建纬、袁飞、

郭小鹏、萧明山。

2020年9月，萧明山因个人精力有限从公司离职并辞去董事职务，汇成有限召开股东会补选赵亚彬为公司董事，汇成有限的董事会成员变更为郑瑞俊、沈建纬、袁飞、郭小鹏、赵亚彬。

2021年3月，汇成有限整体变更为股份有限公司，发行人召开创立大会暨首次股东大会选举郑瑞俊、沈建纬、赵亚彬、吴海龙、杨辉、程敏、TIEER GU（顾铁）为发行人第一届董事会成员。公司整体改制成股份公司后，为进一步完善公司治理结构，引入了独立董事制度，并相应调整了董事会人员结构，董事会人员组成由5名非独立董事调整为4名非独立董事及3名独立董事，新增董事中，杨辉、程敏、TIEER GU（顾铁）系独立董事。同日，发行人召开第一届董事会第一次会议，选举郑瑞俊为董事长。

2021年6月，原独立董事TIEER GU（顾铁）因个人事务繁忙，没有足够时间及精力履行独立董事职责，为确保公司独立董事切实履行相关职责，充分发挥独立董事的作用，向公司辞去董事职务，发行人召开2020年年度股东大会补选蔺智挺为公司第一届董事会独立董事。

自2021年6月起至今，发行人董事未再发生变动。

2、发行人监事最近两年的变动情况

2019年1月，汇成有限未设监事会，设监事1人，由杨毅梅担任。

2021年3月，发行人召开职工代表大会，会议选举程红艳为公司第一届监事会职工代表监事。

2021年3月，为建立健全股份公司治理架构，发行人召开创立大会暨首次股东大会，选举杨欢、赵志清为汇成股份第一届监事会成员，与职工代表监事程红艳，共同组成汇成股份第一届监事会。同日，发行人召开第一届监事会第一次会议，选举杨欢为监事会主席。

自2021年3月起至今，发行人监事未再发生变动。

3、发行人高级管理人员最近两年的变动情况

2019年1月至2019年10月，汇成有限高级管理人员为总经理萧明山、财务负责人庄子昉。

2019年10月，庄子昉因自身原因辞职，汇成有限于2019年11月聘任施周峰为财务负责人。汇成有限高级管理人员变更为总经理萧明山、财务负责人施周峰。

2020年9月，萧明山因个人精力有限从公司离职并辞任总经理职务，汇成有限聘任董事长郑瑞俊为总经理。汇成有限高级管理人员变更为总经理郑瑞俊、财务负责人施周峰。

2021年3月，汇成有限整体变更为股份有限公司，发行人召开第一届董事会第一次会议聘任郑瑞俊为发行人总经理，林文浩、钟玉玄、马行天为副总经理，施周峰为财务总监兼董事会秘书。

自2021年3月起至今，发行人高级管理人员未再发生变动。

4、发行人核心技术人员最近两年的变动情况

截至本招股说明书签署日，公司核心技术人员共4名，分别为林文浩、钟玉玄、许原诚、陈汉宗，其中，陈汉宗系最近两年加入公司的核心技术人员；其余核心技术人员最近两年均未发生变化。

综上所述，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近24个月内无重大变化，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的变动均依法履行了《公司法》及《公司章程》规定的程序，且该等变动未对发行人的法人治理结构、经营政策的延续性产生重大不利影响。

（七）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的对外投资情况

截至本招股说明书签署日，除本公司以外，公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的其他直接对外投资情况如下：

姓名	在发行人处担任职务	对外投资企业名称	出资总额/注册资本（万元）	出资比例/持股比例（%）

郑瑞俊	董事长、总经理	合肥芯成	500.00	37.37
		合肥宝芯	1.00	19.32
		合肥汇芯	1.00	13.91
		香港宝信	3,524.34 万港币	44.64
		汇成投资	0.13 万美元	70.00
		瑞成建筑	700 万美元	80.00
		瑞成投资	1 万港币	70.00
		香港瑞仕	100 万美元	100.00
		百瑞发投资	700 万新台币	99.86
		天虹科技	4,310 万新台币	10.69
沈建纬	董事	瑞成建筑	700 万美元	20.00
		瑞成投资	1 万港币	30.00
赵亚彬	董事	安徽大湖诚文化传媒有限公司	500.00	45.00
		合肥梓宸财务咨询服务有 限公司	10.00	35.00
		太和县鑫丰典当有限责任 公司	2,300.00	4.35
		天津德善信息咨询服 务合伙企业（有限合 伙）	12,674.48	7.51
蔺智挺	独立董事	安徽麦种科技有限公司	500.00	45.00

发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的上述对外投资与发行人不存在利益冲突。

（八）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有发行人股份情况

1、直接持股情况

截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接持有发行人股份情况如下：

序号	姓名	职务/亲属关系	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	杨会	系董事长、总经理郑瑞俊的配偶	2,359.39	3.53

截至本招股说明书签署日，上述人员直接持有的发行人股份不存在质押、冻结或权属不清的情况。

2、间接持股情况

截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属间接持有发行人股份情况如下：

序号	姓名	职务/ 亲属关系	间接持股 公司	持股情况	
1	郑瑞俊	董事长、总经理	汇成投资	持有汇成投资 70.00%的股权，汇成投资持有发行人 5.65%的股份	间接持股比例合计 5.49%
			香港宝信	持有香港宝信 44.64%的股权，香港宝信持有发行人 1.87%的股份	
			合肥芯成	持有合肥芯成 37.37%的财产份额，合肥芯成持有发行人 1.66%的股份	
				持有合肥宝芯 19.32%的财产份额，合肥宝芯持有合肥芯成 15.86%的财产份额，合肥芯成持有发行人 1.66%的股份	
2	杨会	郑瑞俊配偶	扬州新瑞连	持有扬州新瑞连 70.00%的财产份额，扬州新瑞连持有发行人 26.07%的股份	间接持股比例合计 18.43%
			高投邦盛	持有邦盛聚沣 37.04%的财产份额，邦盛聚沣持有高投邦盛 24.49%的财产份额，高投邦盛持有发行人 1.80%的股份	
				持有邦盛聚泽 9.98%的财产份额，邦盛聚泽持有高投邦盛 9.18%的财产份额，高投邦盛持有发行人 1.80%的股份	
3	沈国威	董事沈建纬之子	汇成投资	持有汇成投资 30.00%的股权，汇成投资持有发行人 5.65%的股份	间接持股比例为 1.70%
4	纪念	董事沈建纬儿媳	扬州新瑞连	持有扬州新瑞连 30.00%的财产份额，扬州新瑞连持有发行人 26.07%的股份	间接持股比例为 7.82%
5	赵亚彬	董事	志道投资	持有天津德善信息咨询服务合伙企业（有限合伙）7.51%的财产份额，天津德善信息咨询服务合伙企业（有限合伙）持有正奇控股 3.07%	间接持股比例为 0.01%

				的股权，正奇控股持有志道投资100.00%的股权，志道投资持有发行人5.99%的股份	
6	赵志清	监事	香港宝信	持有香港宝信4.80%的股权，香港宝信持有发行人1.87%的股份	间接持股比例为0.09%
7	程红艳	监事	合肥芯成	持有合肥汇芯2.65%的财产份额，合肥汇芯持有合肥芯成13.61%的财产份额，合肥芯成持有发行人1.66%的股份	间接持股比例为0.01%
8	林文浩	副总经理、核心技术人员	香港宝信	持有香港宝信4.80%的股权，香港宝信持有发行人1.87%的股份	间接持股比例为0.09%
9	钟玉玄	副总经理、核心技术人员	香港宝信	持有香港宝信8.00%的股权，香港宝信持有发行人1.87%的股份	间接持股比例为0.15%
10	马行天	副总经理	香港宝信	持有香港宝信4.00%的股权，香港宝信持有发行人1.87%的股份	间接持股比例为0.07%
11	施周峰	财务总监、董事会秘书	合肥芯成	持有合肥芯成9.01%的财产份额，合肥芯成持有发行人1.66%的股份	间接持股比例合计0.15%
12	许原诚	核心技术人员	香港宝信	持有香港宝信2.40%的股权，香港宝信持有发行人1.87%的股份	间接持股比例合计0.04%
13	陈汉宗	核心技术人员	香港宝信	持有香港宝信1.60%的股权，香港宝信持有发行人1.87%的股份	间接持股比例合计0.03%

公司董事长、总经理郑瑞俊的配偶杨会控制的扬州新瑞连所持公司股份存在股份质押情形，详见本招股说明书“重大事项提示”之“二、发行人控股股东所持发行人股份存在质押情形”。除该情形外，截至本招股说明书签署日，上述人员间接持有的发行人股份不存在质押、冻结或权属不清的情况。

（九）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况

1、薪酬组成、确定依据、所履行的程序

在公司任职的董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬由工资和奖金组成，薪酬系根据其各自所在岗位职务和职级，参考公司所处行业及地区的薪酬水平，结合公司实际经营情况确定。公司独立董事领取独立

董事固定津贴。

根据公司章程，公司董事、监事的报酬事项由股东大会审议决定，公司高级管理人员的报酬事项和奖惩事项由董事会审议决定。根据《薪酬与考核委员会工作细则》，薪酬与考核委员会负责制定、审查公司董事、监事、高级管理人员的考核标准、薪酬政策和实施方案，进行考核并提出建议。

2、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬总额及占比

报告期内，董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬总额占发行人当年利润总额的比例情况如下：

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
薪酬总额（万元）	265.47	421.01	405.78	337.48
利润总额（万元）	5,881.79	-400.50	-16,402.95	-10,708.02
薪酬总额占利润总额的比例	4.51%	/	/	/

3、最近一年领取薪酬情况

2020年度，发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员从发行人及其关联企业领取薪酬情况如下：

单位：万元

姓名	职务	从发行人处领取的薪酬	是否从关联企业领取薪酬
郑瑞俊	董事长、总经理	38.06	否
沈建纬	董事	-	是，从瑞成建筑领取薪酬
赵亚彬	董事	-	是，从正奇控股领取薪酬
吴海龙	董事	-	是，从合肥产投领取薪酬
杨辉	独立董事	-	否
程敏	独立董事	-	否
蔺智挺	独立董事	-	否
杨欢	监事会主席	-	是，从浙江高和羊毛科技有限公司领取薪酬
赵志清	监事	41.67	否
程红艳	监事	8.25	否
林文浩	副总经理	48.95	否
钟玉玄	副总经理	59.51	否
马行天	副总经理	22.86	否

施周峰	财务总监、董事会秘书	51.43	否
陈汉宗	核心技术人员	43.51	否
许原诚	核心技术人员	48.86	否
萧明山	原董事、总经理（于 2020 年 9 月离职）	57.91	否
袁飞	原董事（自 2021 年 3 月起不再担任董事）	-	是，从合肥产投领取薪酬
郭小鹏	原董事（自 2021 年 3 月起不再担任董事）	-	是，从江苏邦盛股权投资基金管理有限公司领取薪酬
杨毅梅	原监事（自 2021 年 3 月起不再担任监事）	-	是，从浙江扳鞍实业发展有限公司领取薪酬
合计		421.01	-

注 1：郑瑞俊自 2020 年 9 月起任公司总经理，未领取 2020 年完整年度薪酬。

注 2：沈建纬、赵亚彬、吴海龙为股东委派董事，杨欢为股东委派监事，不在公司担任具体职务。

注 3：杨辉、程敏、蔺智挺均于 2021 年成为公司独立董事，不在公司领取 2020 年度独立董事薪酬，独立董事固定津贴为 5 万元/年。

注 4：马行天于 2020 年 9 月入职公司，未领取 2020 年完整年度薪酬。

注 5：袁飞、郭小鹏曾为股东委派董事，杨毅梅曾为股东委派监事，未在公司担任过具体职务。

除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未享受其他待遇或退休金计划。

十、发行人本次公开发行前制定或实施的股权激励

（一）发行人本次发行前已实施的员工持股计划

公司采用员工持股平台的方式对高级管理人员和重要员工等进行股权激励，充分调动员工的积极性和创造性，建立健全公司长效激励机制，同时肯定员工对公司做出的贡献，与员工分享公司的经营成果，提升团队凝聚力，有利于稳定重要员工和持续改善公司的经营状况。截至本招股说明书签署日，合肥芯成、合肥宝芯、合肥汇芯、香港宝信均系主要由发行人员工持股，以持有发行人股份为目的的设立的持股平台，具体情况如下：

1、发行人员工持股平台的基本情况及其人员构成

（1）合肥芯成

企业名称	合肥芯成企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
------	----------------------

统一社会信用代码	91310120MA1HT4JD0Y
企业类型	有限合伙企业
成立时间	2019年7月23日
认缴出资总额	500.00万元
执行事务合伙人	郑瑞俊
注册地址	合肥市新站区新站工业物流园内A组团E区宿舍楼15幢3层503室
经营范围	企业管理咨询
主营业务及与发行人主营业务关系	发行人员工持股平台

截至本招股说明书签署日，合肥芯成共有46名合伙人，公司实际控制人郑瑞俊担任普通合伙人，45名有限合伙人中合肥宝芯、合肥汇芯为员工持股平台，其余43名为公司员工，具体情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人性质	出资额 (万元)	出资比例 (%)	职务/人员类别
1	郑瑞俊	普通合伙人	186.85	37.37	董事长、总经理
2	合肥宝芯	有限合伙人	79.30	15.86	员工持股平台
3	合肥汇芯	有限合伙人	68.04	13.61	员工持股平台
4	施周峰	有限合伙人	45.06	9.01	财务总监、董事会秘书
5	姜红涛	有限合伙人	5.41	1.08	研发中心副总监
6	莫雷清	有限合伙人	4.51	0.90	研发中心经理
7	韩慧	有限合伙人	4.51	0.90	研发中心经理
8	刘明群	有限合伙人	4.51	0.90	研发中心副总监
9	周海	有限合伙人	4.51	0.90	研发中心经理
10	陈新路	有限合伙人	4.51	0.90	财务部经理
11	梁华	有限合伙人	3.83	0.77	生产制造部副总监
12	何根余	有限合伙人	3.60	0.72	研发中心经理
13	申厚安	有限合伙人	3.60	0.72	研发中心经理
14	陆秀丽	有限合伙人	3.60	0.72	人力资源部经理
15	孟强	有限合伙人	3.60	0.72	研发中心经理
16	于杰	有限合伙人	3.60	0.72	研发中心经理
17	李江峰	有限合伙人	3.15	0.63	研发中心经理
18	朱睿达	有限合伙人	2.70	0.54	内审部专案经理

19	苏宋燕	有限合伙人	2.70	0.54	物料采购部经理
20	刘祥峰	有限合伙人	2.70	0.54	研发中心经理
21	张鹏	有限合伙人	2.70	0.54	研发中心经理
22	朱锦健	有限合伙人	2.70	0.54	研发中心经理
23	张卫国	有限合伙人	2.70	0.54	研发中心经理
24	周悦	有限合伙人	2.70	0.54	物料采购部经理
25	汤宏娟	有限合伙人	2.70	0.54	研发中心副经理
26	赵原	有限合伙人	2.70	0.54	研发中心经理
27	徐秋兰	有限合伙人	2.70	0.54	财务部专员
28	郭龙芹	有限合伙人	2.70	0.54	行政管理部经理
29	蒋爱娣	有限合伙人	2.70	0.54	研发中心经理
30	孟祉廷	有限合伙人	2.48	0.50	行政管理部经理
31	顾叶翔	有限合伙人	2.25	0.45	物料采购部经理
32	于为安	有限合伙人	2.25	0.45	生产制造部经理
33	徐春艳	有限合伙人	2.25	0.45	品质保障部经理
34	许俊	有限合伙人	2.25	0.45	生产制造部经理
35	龚胜利	有限合伙人	2.25	0.45	研发中心经理
36	刘雨	有限合伙人	2.25	0.45	行政管理部经理
37	沈媛媛	有限合伙人	2.25	0.45	研发中心副经理
38	曹小方	有限合伙人	2.25	0.45	人力资源部副经理
39	郝斐	有限合伙人	2.25	0.45	行政管理部专员
40	高美山	有限合伙人	1.80	0.36	研发中心经理
41	顾言川	有限合伙人	1.80	0.36	生产制造部副经理
42	薛冬霞	有限合伙人	1.80	0.36	研发中心副经理
43	吕霞	有限合伙人	1.80	0.36	品质保障部副经理
44	应纹	有限合伙人	1.80	0.36	业务营销部副经理
45	王志亮	有限合伙人	1.80	0.36	研发中心副经理
46	杜俊坤	有限合伙人	1.80	0.36	研发中心副经理
合计			500.00	100.00	-

（2）合肥宝芯

在合肥芯成合伙人中，合肥宝芯持有其 79.30 万元出资额，占合肥芯成出资总额的 15.86%。合肥宝芯的基本情况如下：

企业名称	合肥市宝芯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91340100MA2WGBFK6U
企业类型	有限合伙企业
成立时间	2020年12月3日
认缴出资总额	1.00万元
执行事务合伙人	郑瑞俊
注册地址	合肥市新站区新站工业物流园内A组团E区宿舍楼15幢
经营范围	企业管理咨询
主营业务及与发行人主营业务关系	发行人员工持股平台

截至本招股说明书签署日，合肥宝芯共有33名合伙人，公司实际控制人郑瑞俊担任普通合伙人，其余32名有限合伙人均为公司员工，具体情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人性质	出资额 (元)	出资比例 (%)	职务/人员类别
1	郑瑞俊	普通合伙人	1,931.79	19.32	董事长、总经理
2	徐伟	有限合伙人	5,681.82	56.82	董事长助理
3	乔春娟	有限合伙人	170.45	1.70	研发中心工程师
4	胡婷婷	有限合伙人	113.64	1.14	研发中心科长
5	郑波	有限合伙人	113.64	1.14	研发中心科长
6	孙晓鹏	有限合伙人	113.64	1.14	业务营销部科长
7	谢平	有限合伙人	113.64	1.14	研发中心科长
8	袁银明	有限合伙人	113.64	1.14	研发中心科长
9	陈超	有限合伙人	113.64	1.14	研发中心科长
10	姚永丽	有限合伙人	113.64	1.14	财务部科长
11	徐秋宝	有限合伙人	73.86	0.74	生产制造部高级工程师
12	王凤	有限合伙人	73.86	0.74	财务部高级专员
13	项加宏	有限合伙人	73.86	0.74	生产制造部高级工程师
14	赵新鹏	有限合伙人	68.18	0.68	行政管理部高级专员
15	朱伟	有限合伙人	68.18	0.68	行政管理部高级专员
16	王婷婷	有限合伙人	68.18	0.68	人力资源部高级专员
17	蔡羽萍 ^(注1)	有限合伙人	68.18	0.68	品质保障部高级工程师
18	尤丹	有限合伙人	68.18	0.68	业务营销部高级工程师
19	张燕 ^(注2)	有限合伙人	62.50	0.63	物料采购部高级工程师

20	路迪	有限合伙人	56.82	0.57	物料采购部高级专员
21	罗会群	有限合伙人	56.82	0.57	生产制造部高级工程师
22	姜苏柳	有限合伙人	56.82	0.57	研发中心工程师
23	邹园	有限合伙人	56.82	0.57	行政管理部科长
24	陈飞	有限合伙人	56.82	0.57	研发中心高级工程师
25	江东飞	有限合伙人	56.82	0.57	行政管理部专员
26	王贺	有限合伙人	56.82	0.57	研发中心科长
27	姚辉	有限合伙人	56.82	0.57	物料采购部科长
28	叶文霞	有限合伙人	56.82	0.57	物料采购部工程师
29	孔繁焘	有限合伙人	56.82	0.57	研发中心高级工程师
30	韦磊	有限合伙人	56.82	0.57	研发中心高级工程师
31	袁青	有限合伙人	56.82	0.57	研发中心高级工程师
32	李媛	有限合伙人	56.82	0.57	研发中心高级工程师
33	韩进东	有限合伙人	56.82	0.57	研发中心科长
合计			10,000.00	100.00	-

注 1：蔡羽萍于 2021 年 9 月离职，拟向郑瑞俊转让其持有的全部合肥宝芯财产份额，正在办理相应的变更登记手续。

注 2：张燕于 2021 年 4 月去世，其持有的全部合肥宝芯财产份额均由其配偶陈广顺（公司在职工）继承，正在办理相应的继承手续。

（3）合肥汇芯

在合肥芯成合伙人中，合肥汇芯持有其 68.04 万元出资额，占合肥芯成出资总额的 13.61%。合肥汇芯的基本情况如下：

企业名称	合肥汇芯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91340100MA2WGB9Y2Q
企业类型	有限合伙企业
成立时间	2020 年 12 月 3 日
认缴出资总额	1.00 万元
执行事务合伙人	郑瑞俊
注册地址	合肥市新站区新站工业物流园内 A 组团 E 区宿舍楼 15 幢
经营范围	企业管理咨询
主营业务及与发行人主营业务关系	发行人员工持股平台

截至本招股说明书签署日，合肥汇芯共有 44 名合伙人，公司实际控制人郑

瑞俊担任普通合伙人，其余 43 名有限合伙人均为公司员工，具体情况如下：

序号	合伙人名称	合伙人性质	出资额 (元)	出资比例 (%)	职务/人员类别
1	郑瑞俊	普通合伙人	1,390.63	13.91	董事长、总经理
2	涂可嘉	有限合伙人	331.13	3.31	研发中心科长
3	丁江	有限合伙人	298.01	2.98	研发中心副经理
4	聂存香	有限合伙人	298.01	2.98	研发中心科长
5	程红艳	有限合伙人	264.90	2.65	行政管理部专案专员
6	杨爱平	有限合伙人	264.90	2.65	研发中心科长
7	田周	有限合伙人	264.90	2.65	研发中心经理
8	陈立梅	有限合伙人	264.90	2.65	生产制造部科长
9	崔福娣	有限合伙人	264.90	2.65	生产制造部科长
10	张雨晴	有限合伙人	264.90	2.65	生产制造部科长
11	陈广顺	有限合伙人	198.68	1.99	研发中心科长
12	谢文娟	有限合伙人	198.68	1.99	人力资源部科长
13	刘磊	有限合伙人	198.68	1.99	研发中心副经理
14	吴展超	有限合伙人	198.68	1.99	研发中心科长
15	张永进	有限合伙人	198.68	1.99	研发中心科长
16	葛小虎	有限合伙人	198.68	1.99	研发中心科长
17	刘燕	有限合伙人	198.68	1.99	物料采购部经理
18	蒋波	有限合伙人	198.68	1.99	研发中心科长
19	贾晶	有限合伙人	198.68	1.99	物料采购部科长
20	方正	有限合伙人	198.68	1.99	生产制造部科长
21	王双喜	有限合伙人	198.68	1.99	生产制造部科长
22	尚雯	有限合伙人	198.68	1.99	品质保障部副经理
23	汤方宝	有限合伙人	198.68	1.99	生产制造部科长
24	王徐	有限合伙人	198.68	1.99	研发中心科长
25	贾飞	有限合伙人	198.68	1.99	生产制造部科长
26	甄爽爽	有限合伙人	198.68	1.99	品质保障部科长
27	王冬冬	有限合伙人	198.68	1.99	研发中心科长
28	梅苏仪	有限合伙人	198.68	1.99	生产制造部科长
29	丁霞	有限合伙人	198.68	1.99	行政管理部副经理
30	王飞	有限合伙人	198.68	1.99	研发中心专案科长

31	张琪	有限合伙人	198.68	1.99	财务部科长
32	张婷	有限合伙人	198.68	1.99	研发中心科长
33	朱军	有限合伙人	198.68	1.99	生产制造部科长
34	涂朝柏	有限合伙人	198.68	1.99	生产制造部经理
35	胡守松	有限合伙人	132.45	1.32	行政管理部科长
36	姚江英	有限合伙人	132.45	1.32	人力资源部专案科长
37	朱翔宇	有限合伙人	132.45	1.32	研发中心科长
38	吴志慧	有限合伙人	132.45	1.32	行政管理部专案科长
39	李潮	有限合伙人	132.45	1.32	研发中心科长
40	秦奥	有限合伙人	132.45	1.32	研发中心科长
41	陶健	有限合伙人	132.45	1.32	物料采购部科长
42	刘骏	有限合伙人	132.45	1.32	物料采购部科长
43	钱玉	有限合伙人	132.45	1.32	物料采购部科长
44	薛步云	有限合伙人	132.45	1.32	人力资源部科长
合计			10,000.00	100.00	-

合肥芯成、合肥宝芯、合肥汇芯均为发行人员工持股平台，仅以其自有资金认购发行人股份，不开展除投资发行人以外的其他任何业务，不开展其他证券投资活动，不存在以任何公开或非公开方式向投资者募集资金的情形，不存在资产由私募投资基金管理人管理的情形，亦不存在担任任何私募投资基金产品的管理人的情形，不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法》规定的私募投资基金产品或私募投资基金管理人，无需履行基金管理人登记或基金备案程序。

（4）香港宝信

公司名称	宝信国际投资有限公司
公司编号	2261496
公司类型	有限公司
成立日期	2015年7月10日
发行股本	3,524.34 万股（每股面值 1 港币）
董事	郑瑞俊
注册地址	Room 1002, 10/F, Easey Commercial Building, 253-261 Hennessy Road, Wan Chai, Hong Kong

主营业务及与发行人 主营业务关系	发行人员工持股平台
---------------------	-----------

截至本招股说明书签署日，香港宝信的股权结构如下：

序号	股东名称	持股数 (万股)	持股比例 (%)	职务/人员类别
1	郑瑞俊	1,573.27	44.64	董事长、总经理
2	萧明山	281.95	8.00	原董事、总经理 (2020年9月离职)
3	钟玉玄	281.95	8.00	副总经理、生产制造部总监、 研发中心副主任
4	赵志清	169.17	4.80	监事、业务营销部总监
5	林文浩	169.17	4.80	副总经理、研发中心主任
6	孙雅萍	140.97	4.00	江苏汇成副总经理
7	马行天	140.97	4.00	副总经理
8	许秀真	140.97	4.00	生产制造部总监
9	江民禾	84.58	2.40	业务营销部资深经理
10	许原诚	84.58	2.40	生产制造部总监、研发中心总 监
11	陈汉宗	56.39	1.60	生产制造部总监、研发中心总 监
12	吴世茂	56.39	1.60	研发中心副总监
13	萧纹生	56.39	1.60	品质保障部总监
14	李司元	47.93	1.36	生产制造部资深经理
15	彭炜棠	42.29	1.20	研发中心副总监
16	林峻弘	42.29	1.20	原行政管理部总监 (2020年2月离职)
17	吴国庆	33.83	0.96	研发中心副总监
18	邱川益	28.19	0.80	研发中心经理
19	陈姿羽	28.19	0.80	业务营销部高级工程师
20	姚有鸿	28.19	0.80	研发中心专案经理
21	洪雪美	28.19	0.80	原生产制造部副总监 (2020年8月离职)
22	刘圣杰	8.46	0.24	原行政管理部副经理 (2020年6月离职)
合计		3,524.34	100.00	-

香港宝信为发行人员工持股平台，香港宝信仅以其自有资金认购发行人股份，不开展除投资发行人以外的其他任何业务，不开展其他证券投资活动，不存在以任何公开或非公开方式向投资者募集资金的情形，不存在资产由私募投资基金管

理人管理的情形，亦不存在担任任何私募投资基金产品的管理人的情形，不属于《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法》规定的私募投资基金产品或私募投资基金管理人，无需履行基金管理人登记或基金备案程序。

根据《证券法》及《首发业务若干问题解答》关于员工持股计划计算股东人数的相关规定：“1、依法以公司制企业、合伙制企业、资产管理计划等持股平台实施的员工持股计划，在计算公司股东人数时，按一名股东计算。2、参与员工持股计划时为公司员工，离职后按照员工持股计划章程或协议约定等仍持有员工持股计划权益的人员，可不视为外部人员。3、新《证券法》施行之前（即2020年3月1日之前）设立的员工持股计划，参与人包括少量外部人员的，可不作清理，在计算公司股东人数时，公司员工部分按照一名股东计算，外部人员按实际人数穿透计算。”

序号	股东名称	合伙人数量/ 股东数量	是否遵循闭 环原则	上市后锁定期	穿透计算股东 人数
1	合肥芯成	46	是	36个月	1
2	合肥宝芯	33	是	36个月	0
3	合肥汇芯	44	是	36个月	0
4	香港宝信	22	否	36个月	22

员工持股平台合肥芯成、合肥宝芯、合肥汇芯的激励对象均为发行人员工，且合肥宝芯、合肥汇芯为合肥芯成的有限合伙人。故在计算公司股东人数时，合肥芯成、合肥宝芯、合肥汇芯合并按一名股东计算。

2、员工持股计划的限售解除安排及人员离职后的股份处理

（1）限售解除安排

合肥芯成、合肥宝芯、合肥汇芯、香港宝信承诺自发行人股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接及间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不提议由发行人回购该部分股份。

（2）离职后的股份处理

发行人于2019年12月实施的股权激励未就本次股权激励事宜制定任何员工

持股计划、员工激励计划或类似文件，对激励对象离职后的股权处理不存在特殊规定。

发行人于 2020 年 12 月实施的股权激励计划中的激励对象离职时，公司及实际控制人有权要求激励对象将其持有的激励股权无偿转让给实际控制人或其指定主体，该等主体的范围不应超出公司或其下属企业的在职员工。

3、对公司经营状况、财务状况、控制权变化等方面的影响

公司员工持股计划，在提升公司价值的同时为员工带来增值利益，实现员工与公司共同发展，将持股对象利益与股东价值紧密联系起来，使持股对象的行为与公司的战略目标保持一致，促进公司可持续发展。

员工持股计划对发行人财务状况的影响参见本招股说明书“第八节 财务会计信息与管理层分析”之“十、经营成果分析”之“（六）股份支付”部分。

公司实施的员工持股计划对公司经营状况无重大影响，公司控制权未因员工持股计划的实施而发生变更。

（二）发行人本次公开发行前已制定的期权激励计划

发行人本次公开发行前，不存在已制定的期权激励计划及相关安排。

十一、发行人的员工及社会保障情况

（一）员工情况

1、员工人数

报告期内，公司员工人数情况如下：

项目	2021.6.30	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
员工总人数（人）	962	918	1,128	998

公司报告期内员工人数变动的主要原因如下：

（1）由于生产经营管理能力尚处于提升阶段，公司人员储备在 2018、2019 年大于实际需求

公司合肥生产基地自 2017 年起逐步投产，是国内较早投产的 12 吋晶圆先进封装测试产线，具备技术先进性，产线人员配置等各项生产管理环节尚处于磨合提升阶段。为此，公司在 2018、2019 年储备了相对较多的人员，其中以生产人员为主，人员储备大于实际生产用工需求，因此 2018、2019 年用工人数相对较多。

（2）基于生产经营管理水平提升及经验曲线效应，为提高人员效率，公司自 2020 年初起筹划人员优化

合肥生产基地自 2017 年投产后，基于经验曲线效应，公司生产经营管理水平处于逐步提升阶段，生产效率相应提升。同时，由于合肥生产基地实际订单数量与前期预测存在一定偏差，导致生产人员储备有所冗余。为提高人员效率，公司自 2020 年初起筹划人员优化，因此 2020 年起用工人数下降较多。

（3）叠加 2020 年 1 月起新冠疫情影响，较多非本地员工未返岗，进一步促进公司实施人员优化策略

受 2020 年 1 月起新冠疫情影响，公司较多非本地员工在春节后因无法及时返岗选择离职，进一步促进公司实施人员优化策略，当年度根据实际生产经营需求新招聘人员相对较少，导致当年度员工人数下降较多。

（4）随着营收规模的大幅提升，公司 2021 年用工人数有所增加

随着显示面板下游市场需求增加，公司 2020 年度营收规模大幅提升，为快速响应客户需求，公司自 2021 年初起加大了招聘力度，用工人数有所增加。

2、员工专业结构

截至 2021 年 6 月 30 日，公司员工专业构成情况如下：

岗位类别	人数（人）	占比（%）
生产人员	676	70.27
管理人员	84	8.73
研发人员	185	19.23
销售人员	17	1.77
合计	962	100.00

3、员工受教育程度

截至 2021 年 6 月 30 日，公司员工受教育程度情况如下：

学历	人数（人）	占比（%）
硕士及以上	16	1.66
本科	186	19.33
专科及以下	760	79.00
合计	962	100.00

4、员工年龄分布

截至 2021 年 6 月 30 日，公司员工年龄分布情况如下：

年龄	人数（人）	占比（%）
30 岁及以下	440	45.74
30-40（含）岁	409	42.52
40-50（含）岁	94	9.77
50 岁以上	19	1.98
合计	962	100.00

（二）员工社会保险及住房公积金缴纳情况

1、社会保险缴纳情况

报告期内，发行人为员工缴纳社会保险的情况如下：

单位：人

社会保险缴费情况	2021.6.30	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
员工人数	962	918	1,128	998
实缴人数	855	877	1,080	927
社会保险缴纳比例	88.88%	95.53%	95.74%	92.89%
未缴人数	107	41	48	71
其中：中国台湾籍员工	26	25	33	38
新入职员工	80	15	14	32
退休返聘人员	1	1	0	0
其他	0	0	1	1

报告期各期末，公司员工社会保险缴纳覆盖率分别为 92.89%、95.74%、95.53% 和 88.88%。报告期内，公司存在未为部分员工缴纳社会保险的情况，主要包括中国台湾籍员工、新入职员工、退休返聘人员，以及个别不愿缴纳的员工。2021 年 6 月，公司社会保险缴纳比例有所下降，主要系因订单增加，为快速响应客户需求，新招聘员工较多所致。

报告期内，公司已为中国台湾籍员工购买了商业保险。截至本招股说明书签署日，公司已为中国台湾籍员工（已达退休年龄的除外）缴纳了社会保险。

除上述情形外，公司已为其他全部员工缴纳社会保险。

2、住房公积金缴纳情况

报告期内，发行人为员工缴纳住房公积金的情况如下：

单位：人

住房公积金缴费情况	2021.6.30	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
员工人数	962	918	1,128	998
实缴人数	811	865	1,062	927
住房公积金缴纳比例	84.30%	94.23%	94.15%	92.89%
未缴人数	151	53	66	71
其中：中国台湾籍员工	26	25	33	38
新入职员工	82	23	19	32
退休返聘	1	1	0	0
其他	42	4	14	1

报告期各期末，公司员工住房公积金缴纳覆盖率分别为 92.89%、94.15%、94.23% 和 84.30%。报告期内，公司存在未为部分员工缴纳住房公积金的情况，主要包括中国台湾籍员工、新入职员工、退休返聘人员，以及自愿放弃缴纳的员工。2021 年 6 月，发行人员工住房公积金缴纳比例有所下降，主要系因订单增加，为快速响应客户需求，新招聘员工较多所致。

报告期各期末，公司分别有 38 名、33 名、25 名和 26 名中国台湾籍员工未缴纳住房公积金。根据《建设部、财政部、中国人民银行关于住房公积金管理几个具体问题的通知》（建金管[2006]52 号），《住房公积金管理条例》所称“在

职职工”不包括外方及港、澳、台人员，因此中国台湾籍员工未缴纳住房公积金未违反国家相关规定。

除上述情形外，公司已为其他全部员工缴纳住房公积金。

3、社会保障及住房公积金相关守法情况

发行人及其子公司已就社会保险缴纳、住房公积金缴存事宜取得了主管部门的合规证明。根据相关主管部门出具的合规证明，报告期内公司及子公司不存在因违反人力资源和社会保障法律法规而受到行政处罚的记录；公司及子公司已开立住房公积金账户且正常缴存，报告期内不存在住房公积金重大违法违规记录。

4、实际控制人关于社会保险和住房公积金事项的承诺

截至本招股说明书签署日，公司及子公司已经按照所在地的相关规定为员工缴纳了社会保险及住房公积金。对于公司报告期内欠缴员工的社会保险或住房公积金，公司实际控制人郑瑞俊、杨会已就相关事项做出承诺，具体参见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“六、本次发行相关主体作出的重要承诺”之“（十一）其他承诺事项”之“3、关于社保和住房公积金缴纳情况的承诺”。

（三）劳务派遣情况

1、发行人劳务派遣的基本情况

报告期内，因一线生产人员招聘日趋困难，为满足临时用工需求及加大人员供给，发行人采取劳务派遣作为用工的补充。劳务派遣员工主要为生产人员，参与辅助性岗位工作。报告期各期末，公司劳务派遣人员数量情况如下表所示：

单位：人

项目	2021.6.30	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
劳务派遣员工总数	82	75	229	90
正式员工数	962	918	1,128	998
用工总数	1,044	993	1,357	1,088
劳务派遣员工占用工总数比例	7.85%	7.55%	16.88%	8.27%

2019年末劳务派遣人数增加较多，主要系由于2019年合肥生产基地客户订

单导入，存在业绩增长的预期，公司预计短期用工需求会大幅提升，故增加了劳务派遣员工作为储备。

2、劳务派遣的合规性说明

截至 2021 年 6 月 30 日，发行人的劳务派遣员工为 82 人，占用工总数的比例为 7.85%，未超过 10%。

发行人报告期内曾存在劳务派遣用工人数占用工总数的比例超过 10% 的情形，发行人已调整用工方案并持续规范劳务派遣用工人数。根据劳动主管部门出具的证明，报告期内发行人及子公司不存在因违反相关劳动法律法规而受到重大行政处罚的情形。

截至本招股说明书签署日，发行人不存在劳务派遣人数超过其用工总数 10% 的情形，并将持续保持劳务派遣用工合法合规。

3、劳务派遣定价及资质情况

发行人劳务派遣员工的薪酬均参考市场价格并综合考虑用工人数、期间、地点、岗位等因素后协商确定，劳务派遣用工人员的平均时薪接近于相同或相似岗位正式员工的平均时薪。相关劳务派遣公司均持有有效的劳务派遣经营许可证。

4、实际控制人关于劳务派遣事项的承诺

发行人实际控制人郑瑞俊、杨会已就劳务派遣事项出具承诺，具体参见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“六、本次发行相关主体作出的重要承诺”之“（十一）其他承诺事项”之“7、关于劳务派遣事项的承诺”。

第六节 业务与技术

一、发行人主营业务、主要产品或服务的情况

（一）主营业务、主要产品或服务的基本情况

1、公司主营业务情况

公司是集成电路高端先进封装测试服务商，目前聚焦于显示驱动芯片领域，具有领先的行业地位。公司主营业务以前段金凸块制造（Gold Bumping）为核心，并综合晶圆测试（CP）及后段玻璃覆晶封装（COG）和薄膜覆晶封装（COF）环节，形成显示驱动芯片全制程封装测试综合服务能力。公司的封装测试服务主要应用于 LCD、AMOLED 等各类主流面板的显示驱动芯片，所封装测试的芯片系日常使用的智能手机、智能穿戴、高清电视、笔记本电脑、平板电脑等各类终端产品得以实现画面显示的核心部件。

公司是中国境内最早具备金凸块制造能力，及最早导入 12 吋晶圆金凸块产线并实现量产的显示驱动芯片先进封测企业之一，具备 8 吋及 12 吋晶圆全制程封装测试能力。2020 年度，公司显示驱动芯片封装出货量在全球显示驱动芯片封测领域排名第三¹，在中国境内排名第一，具有较强的市场竞争力。²

公司在显示驱动芯片封装测试领域深耕多年，凭借先进的封测技术、稳定的产品良率与优质的服务能力，积累了丰富的客户资源。公司服务的客户包括联咏科技、天钰科技、瑞鼎科技、奇景光电等全球知名显示驱动芯片设计企业，所封测芯片已主要应用于京东方、友达光电等知名厂商的面板。2020 年度全球排名前五显示驱动芯片设计公司中三家系公司主要客户，2020 年度中国排名前十显示驱动芯片设计公司中九家系公司主要客户。

公司经过多年持续的研发投入及技术沉淀，形成了微间距驱动芯片凸块制造

¹ 此处排名仅统计专业对外提供显示驱动封装测试服务的厂商，如韩国 LB-Lusem 与 Steco 公司分别系 LG 与三星生态内的显示驱动芯片封测服务商，不对外部的显示驱动芯片设计公司提供服务，因此未列入排名。


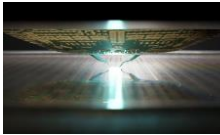
² 相关数据及排名统计来源于独立第三方知名机构 Frost & Sullivan《中国显示驱动芯片封测代工行业·独立市场研究》。


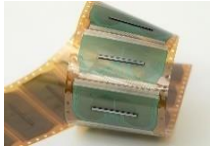
技术、凸块高可靠性结构及工艺、高精度晶圆研磨薄化技术、高稳定性晶圆切割技术、晶圆高精度稳定性测试技术等多项核心技术，目前已授权专利达 259 项，在行业内具有技术领先优势。公司围绕集成电路封装测试的行业特性，在生产工艺及生产装置等环节持续研发改进，追求高精度、高良率、高可靠性的封装测试核心能力，为显示驱动芯片的大批量国产化应用奠定了坚实的技术基础。

公司以成为国内领先、世界一流的高端芯片封装测试服务商为愿景，以提升中国集成电路产业的全球竞争力为使命。未来，公司将积极扩充 12 吋大尺寸晶圆的先进封装测试服务能力，保持行业及产品的领先地位，同时将进行持续的研发投入，不断拓宽封测服务的产品应用领域，积极拓展以 CMOS 影像传感器、车载电子等为代表的新兴产品领域。

2、公司主要产品或服务情况

公司目前主要所封装测试的产品应用于显示驱动领域，以提供全制程封装测试为目标，涉及的封装测试服务按照具体工艺制程包括金凸块制造（Gold Bumping）、晶圆测试（CP）、玻璃覆晶封装（COG）和薄膜覆晶封装（COF），具体情况如下：

工艺制程	具体介绍	功能特点	应用范围或领域	完成相关制程后的产品图示
Gold Bumping	金凸块制造是指通过溅镀、曝光显影、电镀和蚀刻等制程，在晶圆的焊垫上制作金凸块，可达到高效的电性传输，替代了传统封装中的导线键合。公司凸块制造工艺可实现金凸块宽度与间距最小至 6 μm、单片 12 吋晶圆上制造 900 余万金凸块	该工艺可大幅缩小芯片模组的体积，具有密度大、散热佳、高可靠性等优点	主要应用于显示驱动芯片领域，适用于覆晶封装（FC）技术	
CP	晶圆测试是指用探针与晶圆上的每个晶粒接触进行电气连接以检测其电气特性，对于检测不合格的晶粒用点墨进行标识，在切割环节被淘汰，不再进行下一个制程	该工艺不仅可以鉴别出合格的芯片，直接计算出良率，还可以减少后续不必要的操作，有效降低整体封装的成本	是大多数封装工艺必经的前道工序	

COG	玻璃覆晶封装是指将芯片上的金凸块与玻璃基板上的引脚进行接合并利用胶质材料进行密封隔绝的技术，由封装厂商负责切割成型，面板或模组厂商等负责芯片与面板的接合	是目前较为传统的屏幕封装工艺，也是最具有性价比的解决方案，但由于芯片直接放置在玻璃基板上，占用较大空间，故屏占比不高	主要应用于小尺寸面板，如手机、平板电脑、数码相机等	
COF	薄膜覆晶封装是指将芯片的金凸块与卷带上的内引脚接合，之后由面板或模组厂商等将外引脚与玻璃基板接合	具有高密度、高可靠性、轻薄短小、可弯曲等优点，有利于缩小屏幕边框，提高屏占比	主要应用于电视等大尺寸面板和全面屏手机等	

显示驱动芯片是显示面板成像系统的重要组成部分之一，目前常见的显示驱动芯片包括 LCD 驱动芯片和 OLED 驱动芯片。LCD 驱动芯片通过接收控制芯片输出的指令，决定施加何种程度的电压到每个像素的晶体管，从而改变液晶分子排列/扭转程度，由每个像素的透光率高低实现色彩变化，进而构成显示画面。OLED 驱动芯片通过向 OLED 单元背后的薄膜晶体管发送指令，控制 OLED 子像素的亮度进而发出不同颜色的光。公司目前所封装测试的显示驱动芯片被广泛应用于智能手机、智能穿戴、高清电视、笔记本电脑、平板电脑等显示面板中。



3、公司主营业务收入构成

报告期内，公司主营业务收入均来自于对显示驱动芯片的封装测试，具体情况如下：

单位：万元

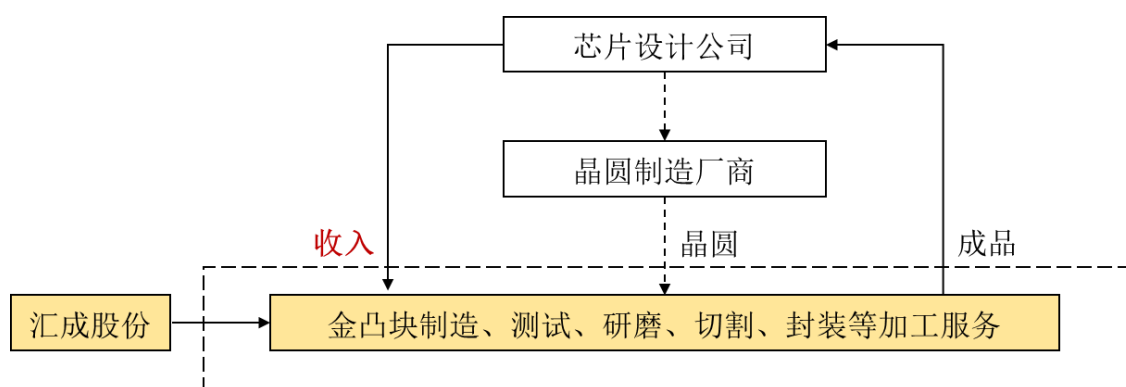
封测芯片种类	2021年1-6月		2020年度		2019年度		2018年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
显示驱动芯片	34,987.81	100.00%	57,504.79	100.00%	37,001.73	100.00%	26,796.12	100.00%
合计	34,987.81	100.00%	57,504.79	100.00%	37,001.73	100.00%	26,796.12	100.00%

（二）主要经营模式

1、盈利模式

公司属于集成电路行业的封装测试服务环节企业，采用行业惯用的 OSAT（半导体封装测试外包）模式，在 OSAT 模式下，公司业务不涉及集成电路设计环节和晶圆制造环节，专门为集成电路设计公司提供封装测试服务。

公司根据客户需求，通过工艺设计，利用封装测试设备，自行购买封装测试原辅料，对客户提供的晶圆进行金凸块制造、晶圆测试、研磨、切割、封装等一系列的定制化精密加工及成品测试服务。公司系根据所提供服务收取加工服务费的方式以获取收入和利润。具体图示如下：



2、采购模式

公司的采购模式为按需采购，由物料采购部门统计生产有关的物料耗材需求并编制需求单，根据需求单向供应商下达采购订单并签约。具体的采购情况如下：

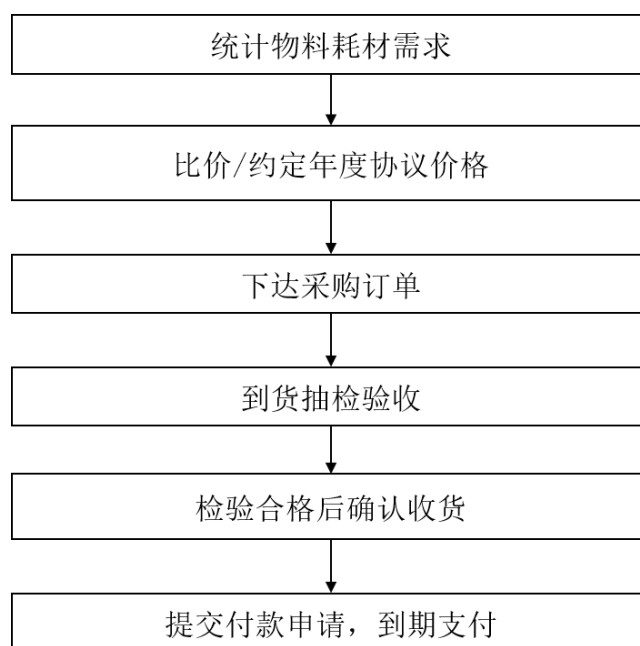
（1）各工艺制程的主要采购内容

工艺制程	采购的原材料种类
Gold Bumping	电镀液、金盐、金靶、钛钨靶、光刻胶、蚀刻液等
CP	墨水等
COG	切割刀片、蓝色胶带、UV 胶带、Tray 盘、研磨轮等
COF	COF 胶材等

（2）采购流程

对于主要采购材料，公司一般会与供应商约定年度协议价格，未约定年度协议价格的则进行比价选定。采购材料根据合同要求付款，由物料采购部根据合同约定制作付款申请单、经系统签核后，到期支付款项。

采购材料到货后由品质保障部进行验收，品质保障部核对供应商提供的出货检测报告后进行分类抽检，检验合格后在系统中制作验收单，经系统签核后确认收货。



（3）设备采购

根据公司生产以及扩产需求，相关请购部门提出设备采购申请，经批准后，由物料采购部统计采购需求统一下达正式订单给供应商，供应商安排生产、交货。

（4）代理采购

由于公司位于合肥市综合保税区内，公司为提高经营效率、节省管理成本，报告期早期存在部分物料委托第三方供应链企业提供代理采购服务的情况，相关第三方供应链企业主要提供入区物料的报关、报检等申报工作等。

（5）供应商管理制度

公司建立了供应商认证准入机制和考核机制，以保证供应质量及供应稳定性。公司仅向评估合格的供应商进行采购，评估内容包括供应商资质、材料质量、采购效益等，并且在采购的过程中持续考核其产品质量及服务等方面，对质量问题实时反馈并要求修正。

3、生产模式

公司目前采用行业普遍的“客户定制，以销定产”受托加工生产模式，即由客户提出需求并提供晶圆、卷带等制造材料，公司自行外购电镀液、金属靶材等封装测试原辅料，接着根据客户需求完成相应工艺制程，而后将成品交付予客户或指定面板厂商等第三方。

公司专注于提供高端封装和测试服务，拥有专业的工程技术和生产管理团队，并配备了专业的高精度自动化生产设备，可以为客户提供多样化、针对性、差异化及个性化的封装测试服务。

4、销售模式

公司采用直销模式进行销售，并制定了相应的销售管理制度，具体的销售流程和定价策略如下：

（1）销售流程

作为集成电路封装测试企业，公司需要对客户的技术需求进行工艺验证，验证通过后方能与客户开始合作。公司在获取客户具体订单后完成封装测试服务，并依据客户的具体要求将封装完成的芯片交付。公司依据与客户的具体约定进行销售结算及收款。

（2）定价策略

基于定制化的受托加工模式，公司的销售定价主要由自行采购的材料成本以及根据客户对工艺的要求协商达成的加工服务费共同构成。由于每个客户的芯片封装测试方案都具有定制化、个性化的特点，整体定价在衡量客户订单规模、公司产能综合利用情况并结合市场供需行情等因素下，与客户协商确定。后续亦会根据客户的特定工艺要求等做相应调整。

金凸块制造的定价基于耗用的原材料成本及相应的加工服务费确定，含金原料是金凸块制造环节的主要材料成本，定价结合黄金的市场价格及不同规格芯片所需耗用的黄金用量确定。

晶圆测试、玻璃覆晶封装与薄膜覆晶封装主要基于不同芯片的具体工艺要求，综合考虑加工设备类型、加工时长及市场供需行情的因素下，与客户协商确定。

5、研发模式

公司主要通过自主研发的模式持续对先进封装测试工艺进行研发活动，夯实已有技术基础的同时进一步提高技术壁垒，并保障研发项目成功投产转化。公司主要基于客户产品或技术方案的最新趋势，进行相应的研发投入。公司制定的研发流程主要包括项目调研、项目立项、工艺设计与开发、样品试制和研发结项等阶段，具体情况如下：

（1）项目调研

公司的研发项目主要来源于以下渠道：一是研发中心会定期调研行业发展趋势，结合公司发展战略及现有技术基础，选择相应的新工艺、新产品的研发立项；二是业务营销部在市场开拓过程中会有意收集客户需求信息，形成对市场需求的综合判断，针对市场需求集中的新产品提出立项建议。

（2）项目立项

研发中心在项目调研或收到立项建议后，将先进行初步论证，如初步论证可行，则会同公司管理层共同讨论立项建议，根据开发产品、工艺的技术指标、技术难点、成本效益等内容进行评判，确定具体研发内容，进而对资源配置、执行周期、项目人员等进行部署，形成研发项目立项书后正式启动项目研发工作。

（3）工艺设计与开发

公司根据项目立项书及技术可行性分析的要求，开展设计开发工作。由研发中心设立专项课题小组，积极调动各种资源以配合专项课题小组的活动。工艺设计开发完成后，将召开评审会议，对项目取得相应的研发成果予以评定。专项课题小组根据会议评审结果，对项目设计与开发方案予以进一步修改、完善，并及时反馈给研发中心相关负责人。

（4）样品试制

专项课题小组会同生产制造部根据评审会议确定的技术参数和开发方案进行样品试制，专项课题小组辅以监督和技术指导，试制完成的样品由品质保障部进行质量及性能的检验。若该研发样品是根据客户需求开发的，则样品还需经过客户验证。

（5）研发结项

在验证合格后，研发中心将召开项目评审会，对样品的性能参数予以全面评估。评审会通过专项课题小组提交研发结项报告，项目研发工作结束。

6、公司采用目前经营模式的原因及未来变化趋势

公司结合国家集成电路产业政策、集成电路产业链分工模式、上下游发展状况、市场供需情况、自身主营业务以及发展阶段等因素，形成了目前的 OSAT 经营模式。报告期内，公司现有经营模式取得了良好的效果，主营业务快速发展，影响经营模式的关键因素在报告期内保持稳定，未发生重大变化，在可预见的未来也不会发生重大变化。

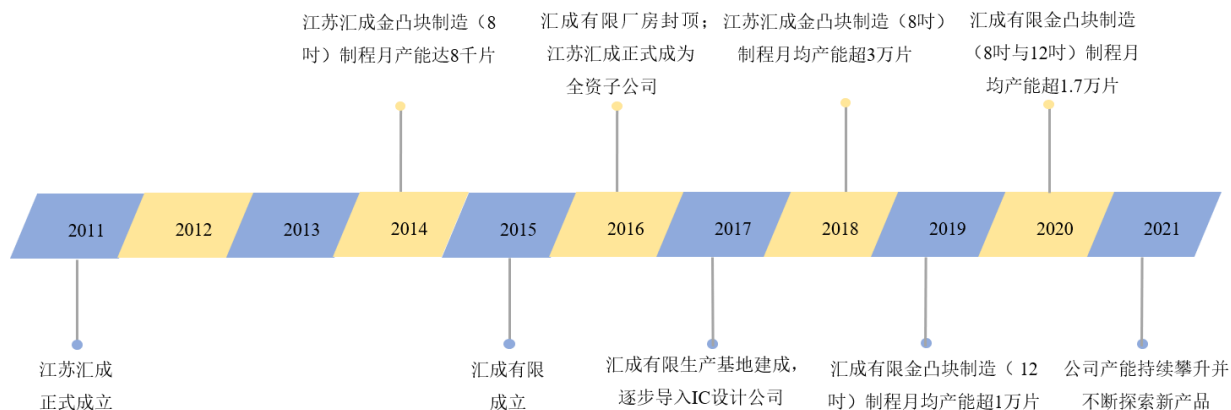
（三）设立以来主营业务、主要产品或服务、主要经营模式的演变情况

公司主营业务为显示驱动芯片的先进封装测试服务，业务覆盖全制程封测服务，主营业务自设立以来未发生重大变化。子公司江苏汇成主要从事 8 吋晶圆的封装测试服务，随着行业和技术进步，公司前瞻性地对 12 吋晶圆封装测试业务进行布局。相较于 8 吋晶圆，12 吋晶圆的封装测试效率更高，对生产工艺的要求以及产品良率管理的要求更高，也更加符合客户需求和行业发展趋势。

公司自设立以来始终采用 OSAT 模式，主要经营模式未发生变化。在 OSAT 模式下，公司业务不涉及集成电路设计环节和晶圆制造环节，专门为集成电路设计公司提供封装测试服务。

公司在显示驱动芯片封测领域深耕多年，2011 年江苏汇成设立，2015 年汇成有限成立，2016 年汇成有限合肥生产基地封顶，江苏汇成正式成为全资子公司，其后两厂持续扩产。2017 年起汇成有限合肥生产基地逐步导入知名 IC 设计公司，2019 年汇成有限金凸块制造（12 吋）制程月均产能超 1 万片。未来公司拟延伸产品线，进军先进封装测试行业其他细分领域，不断跟随市场趋势丰富产品结构、提升技术实力和产业链资源整合能力。

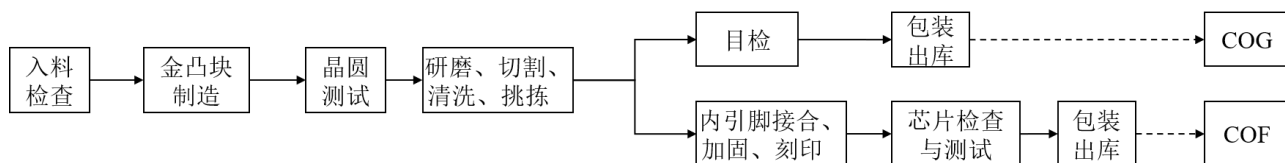
公司具体的产品发展及产能变化情况如下图所示：



（四）主要产品工艺流程图

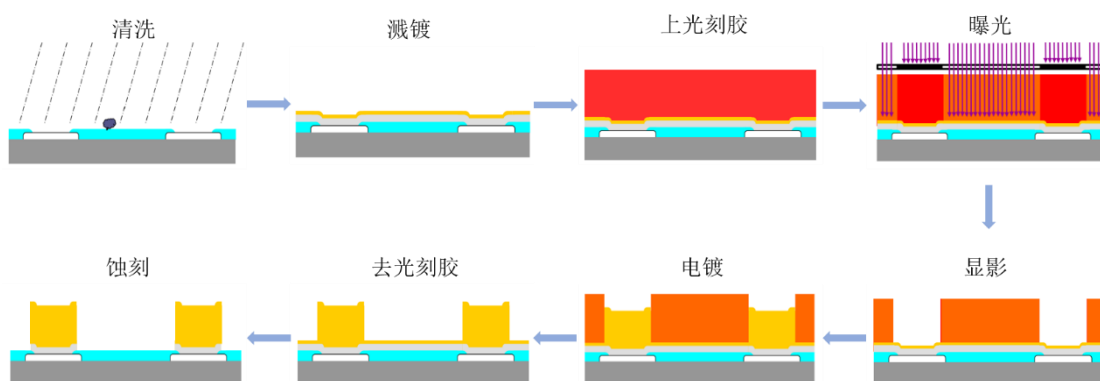
显示驱动芯片的封装成型需要经过多道工序的协同配合。首先，对客供晶圆进行微观检测，观察其是否存在产品缺陷；对于检验合格的晶圆，在其表面制作金凸块作为芯片接合的基础；其后，对晶圆上的每个晶粒用探针进行接触，测试其电气特性，对不合格的晶粒进行墨点标识；接着，将晶圆研磨至客户需要的厚度再进行切割，仅将合格的芯片挑拣出来；最后，客户要求玻璃基板上进行接合的则在完成切割、挑拣后包装出库（COG），由面板或模组厂商负责芯片与玻璃基板的接合；客户要求卷带上进行接合的则需要先将芯片内引脚与卷带接合并涂胶烘烤牢固，进行芯片成品测试后再包装出库（COF）。在整道生产流程中还包含多次的人工目检以及光学自动检测，以保障产品的质量。

公司主要工序流程如下图所示：



1、金凸块制造（Gold Bumping）

金凸块制造是晶圆入料检查完成后的首道工序，制造出的金凸块是后续引脚接合的基础，制作过程复杂，其中主要步骤的工艺流程图如下：



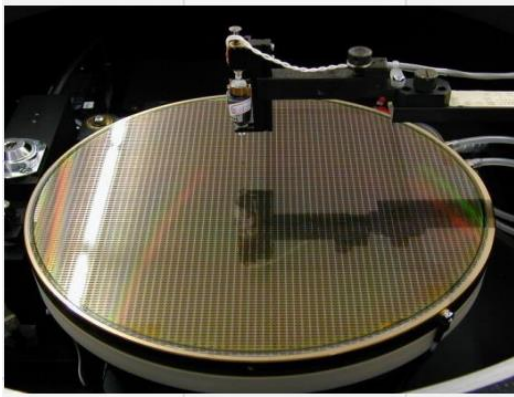
具体过程如下：

- （1）清洗：用去离子水清洗入料检验合格的晶圆，去除表面杂质。
- （2）溅镀：用高速离子对金属靶材进行轰击，将钛钨金靶材溅射至硅片表面，形成凸块底部金属层。
- （3）上光刻胶、曝光、显影：涂布光刻胶，并透过光掩模板对涂胶的硅片进行曝光，使光刻胶发生化学反应，再将其浸入显影液中则只有部分会溶解，从而得以在光刻胶上对凸块的位置开窗。
- （4）电镀：将晶圆浸入电镀液中，通电后电镀液中的金属离子，在电位差的作用下将移动到开窗部位形成金凸块。
- （5）去光刻胶、蚀刻：去除光刻胶，并通过蚀刻精准去除金凸块周围的金属层和钛钨层，金凸块则制作完成。
- （6）良品测试：对晶圆表面金凸块的各项测量规格如高度、长宽尺寸、硬

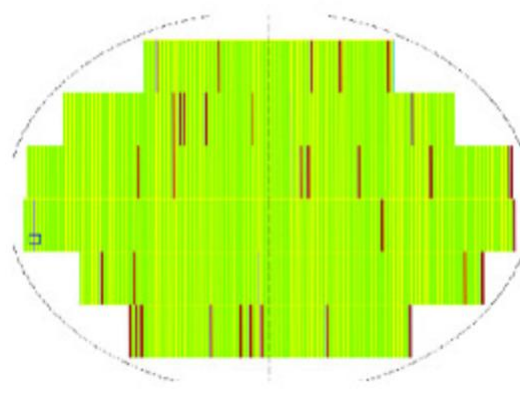
度、表面粗糙度、剪应力等进行良品测试后则可进入晶圆测试制程。

2、晶圆测试（CP）

晶圆测试是指用探针与晶圆上的每个晶粒接触进行电气连接以检测其电气特性，对于检测不合格的晶粒用点墨进行标识，通过点墨标识一方面可以直接计算出晶圆的良率，另一方面可以减少后续工序的工作量，提高封装的效率，有效降低整体封装的成本。该工序主要通过测试设备与探针台协同完成。



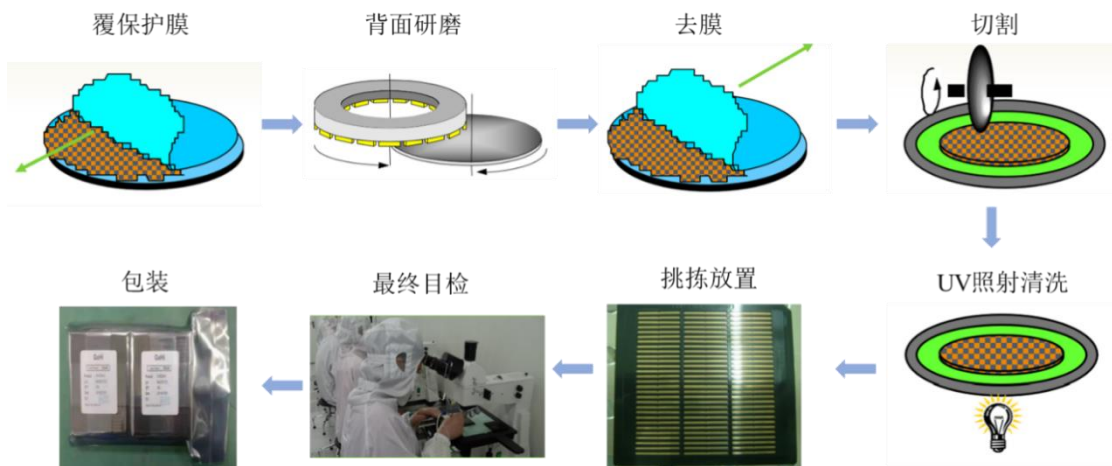
正在测试的晶圆



点墨标识后的显示图

3、玻璃覆晶封装（COG）

玻璃覆晶封装是指将芯片上的金凸块与玻璃基板进行接合的先进封装技术，由封装测试厂商将芯片研磨、切割成型后，由面板或模组厂商将芯片与玻璃基板相结合。公司的玻璃覆晶封装制程主要包括研磨、切割和挑拣等环节，主要步骤的工艺流程图如下：



具体过程如下：

（1）覆保护膜：将胶膜覆于晶圆正面，胶膜可以在研磨过程中保护晶圆表面免受损伤与污染。

（2）背面研磨：将晶圆背面朝上进行研磨，研磨至客户要求的厚度。

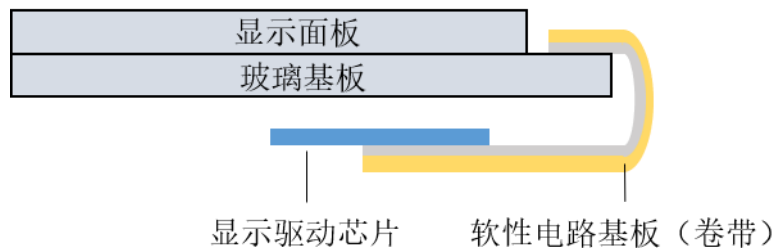
（3）去膜、切割：去掉保护膜后，将晶圆置于铁框内，用钻石刀片将晶圆切割成相应规格的芯片，切割后再次观测其是否存在碎裂、裂痕、刮伤、金属翘起等缺陷。

（4）UV 照射清洗：UV 照射清除表面有机污染物，减弱胶层强度以便后续挑拣。

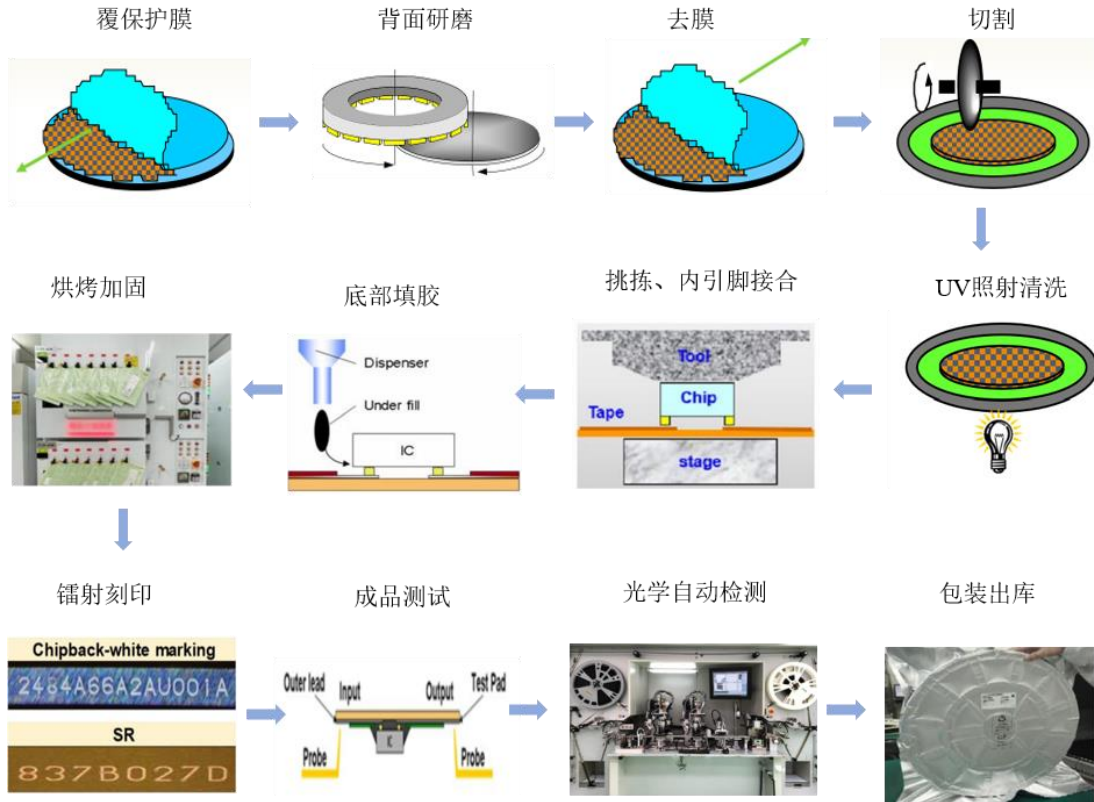
（5）挑拣放置、最终目检：将切割好的清洁的芯片挑拣放置于盛载盘上，最终通过显微镜进一步目检。

4、薄膜覆晶封装（COF）

薄膜覆晶封装与玻璃覆晶封装的工艺差别在于与芯片直接接合的基板不同，以及薄膜覆晶封装需进行芯片成品测试。玻璃覆晶封装是将芯片引脚直接与玻璃基板接合，故只需切割成型，后续引脚接合由面板或模组厂商负责，而薄膜覆晶封装的软性电路板（卷带）上通常会设计输入端和输出端引脚，需要公司先将芯片的金凸块与卷带上的内引脚接合，之后由面板或模组厂商将外引脚与玻璃基板接合，如下图所示：



薄膜覆晶封装主要步骤的工艺流程图如下



具体过程如下：

（1）覆保护膜：将胶膜覆于晶圆正面，胶膜可以在研磨过程中保护晶圆表面免受损伤与污染。

（2）背面研磨：将晶圆背面朝上进行研磨，研磨至客户要求的厚度。

（3）去膜、切割：去掉保护膜后，将晶圆箍于铁框内，用钻石刀片将晶圆切割成相应规格的芯片，切割后再次观测其是否存在碎裂、裂痕、刮伤、金属翘起等缺陷。

（4）UV 照射清洗：UV 照射清除表面有机污染物，减弱胶层强度以便后续挑拣。

（5）挑拣、内引脚接合：将切割好的清洁的芯片挑拣出来把芯片上的金凸块与卷带的内引脚进行接合。

（6）底部填胶、烘烤加固：对准芯片周边底部进行填胶粘合，再置于烘烤设备中烘烤牢固。

(7) 镭射刻印：公司会对加工好的芯片镭射刻印编号，便于后续追溯到产品。

(8) 成品测试、光学自动检测及包装出库：利用检测设备进行芯片成品测试，检验其电气性、微观结构等，以及外观检测其是否存在缺陷，检验合格则可整卷包装出库。

（五）生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力

公司日常生产经营中会产生一定的废气、废水、固体废弃物和噪声，为此建立了严格的环境管理体制，能够及时有效地处理产出的环境污染物，公司及子公司均通过了环境管理体系认证，并取得相应排污许可证。

公司生产经营中涉及的主要污染物、处理设施及处理效果具体如下：

类别	来源	主要污染物	处理设施/措施	处理效果		
废气	含氰酸性 废气	含氰镀金废气	一级碱液处理、25m 排气筒	达标排放		
		电镀槽清洗		盐酸雾	达标排放	
	不含氰酸 碱废气	硫酸	硫酸雾	一级碱液处理、25m 排气筒	达标排放	
	有机废气	有机废气	挥发性有机物	有机废气处理系统 （二级活性炭装置 系统）、25m 排气 筒	达标排放	
		晶圆清洗液	挥发性有机物		达标排放	
	锅炉废气	天然气燃烧废气	二氧化硫、氮氧化物、 烟尘	15m 排气筒	达标排放	
一般废气	热力排气	水汽	一般排气筒	达标排放		
废水	含氰废水	电镀含氰废水	COD、SS、氰化物、 钛、钨	含氰废水处理系统 (二级破氰+混凝沉 淀)	回收利用	
		蚀刻废液			COD、SS、钛、钨	回收利用
		蚀刻清洗废水				回收利用
	有机废水	晶圆清洗废水	COD、SS、氨氮	有机废水处理系统 (电絮凝+沉淀)	达标排放	
		废显影液和清洗废水			达标排放	
		去光阻清洗废水			达标排放	
	一般废水	研磨废水	COD、SS、氨氮	一般废水处理系统 (絮凝沉淀)	回收利用	
		切割废水			回收利用	
		反冲洗废水			回收利用	

		办公楼、食堂等生活废水	经化粪池处理后，流入市政管网	达标排放
固体废物	危险废物	废光阻剂和清洗废液、废去光阻剂、金蚀刻废液、含氰废水处理污泥、有机废气处理污泥、废活性炭等	委托具备资质的第三方进行处理清运	清运
	一般废物	不合格晶圆、不良芯片、废纸箱、废胶带、一般废水处理污泥等	供货商/客户回收或委托环卫部门清运	清运
		员工生活垃圾和餐饮垃圾	由环卫部门统一收集清运	清运
噪声	设备噪声		减振台座、消声器、柔性接头、避振喉	达标排放

二、发行人所处行业基本情况及其竞争状况

（一）所属行业及确定所属行业的依据

根据证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）。根据《国民经济行业分类与代码》（GB/4754-2017），公司属于计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）下属的集成电路制造业（C3973），具体细分行业为集成电路封装测试业。根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类（2018）》，公司属于“1 新一代信息技术产业”之“1.2 电子核心产业”之“1.2.4 集成电路制造业”。根据《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》（2021年修订），公司属于第四条第（一）款规定的新一代信息技术领域。

（二）行业主管部门、监管体制、主要法律法规政策及对发行人经营发展的影响

1、行业主管部门

公司所处行业的主管部门是中华人民共和国工业和信息化部，主要负责对行业的发展方向进行宏观调控，包括提出优化产业布局、结构的政策建议和发展战略；制定并组织实施行业发展规划和产业政策；拟定行业技术标准，推动重大技术创新；组织实施与行业相关的国家科技重大专项研究，推进相关科研成果产业化，促进电子信息技术的推广应用。

公司所处行业的自律组织主要为中国半导体行业协会，负责行业的引导与服务。

务，包括贯彻落实政府半导体相关产业政策、开展产业及市场研究，根据授权开展行业统计，及时向会员单位和政府主管部门提供行业情况调查、市场发展趋势、经济运行预测等信息，提供咨询服务、行业自律管理以及代表会员单位向政府部门提出产业发展建议和意见等。

2、行业监管体制

集成电路行业的管理体制是国家产业宏观调控下的市场调节机制，由国家主管部门制定行业发展战略、发展规划及产业政策，对行业进行宏观调控；行业协会对行业进行自律规范管理；企业则面向市场自主经营并自主承担市场风险。

3、行业主要法律法规政策及对发行人经营发展的影响

（1）行业主要法律法规及政策

序号	文件名称	主要涉及的内容	颁布机构	颁布时间
1	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》	强化国家战略科技力量，瞄准人工智能、量子信息、集成电路、生命健康、脑科学、生物育种、空天科技、深地深海等前沿领域，实施一批具有前瞻性、战略性的国家重大科技项目。	第十三届全国人大第四次会议	2021 年 3 月
2	《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》	进一步优化集成电路产业和软件产业发展环境，深化产业国际合作，提升产业创新能力和发展质量，制定出台财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权、市场应用、国际合作等八个方面政策措施。	国务院	2020 年 7 月
3	《国家信息化发展战略纲要》	制定国家信息领域核心技术设备发展战略纲要，以体系化思维弥补单点弱势，打造国际先进、安全可控的核心技术体系，带动集成电路、基础软件、核心元器件等薄弱环节实现根本性突破。	中共中央、国务院	2016 年 7 月
4	《国家创新驱动发展战略纲要》	加大集成电路、工业控制等自主软硬件产品和网络安全技术攻关和推广力度，为我国经济转型升级和维护国家网络安全提供保障。	中共中央、国务院	2016 年 5 月
5	《中国制造 2025》	将集成电路及专用装备作为“新一代信息技术产业”纳入大力推动突破发展的重点领域。	国务院	2015 年 5 月
6	《国家鼓励的集成电路设计、装备、材料、封装、测试企业条件（2021 年	对符合条件的封装、测试企业进行所得税优惠	工信部、发改委、财政部、税务总局	2021 年 4 月

序号	文件名称	主要涉及的内容	颁布机构	颁布时间
	本)》			
7	《关于支持集成电路产业和软件产业发展进口税收政策的通知》	对符合条件的集成电路相关企业免征进口关税；符合条件的承建集成电路重大项目的企业进口新设备，对未缴纳税款提供海关认可的税款担保，可六年内分期缴纳进口环节增值税。	财政部、海关总署、税务总局	2021年3月
8	《关于做好享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作有关要求的通知》	为做好享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作，公布了有关程序、享受税收优惠政策的企业条件和项目标准。	发改委、工信部、财政部、海关总署、税务总局	2020年3月
9	《产业结构调整指导目录（2019年本）》	鼓励类产业中包括球栅阵列封装（BGA）、插针网格阵列封装（PGA）、芯片规模封装（CSP）、多芯片封装（MCM）、栅格阵列封装（LGA）、系统级封装（SiP）、倒装封装（FC）、晶圆级封装（WLP）、传感器封装（MEMS）等先进封装与测试。	发改委	2019年10月
10	《战略性新兴产业分类（2018）》	集成电路的制造被列为战略新兴产业	国家统计局	2018年11月
11	《关于集成电路生产企业有关企业所得税政策问题的通知》	对于满足要求的集成电路生产企业实行税收优惠减免政策，符合条件的集成电路生产企业可享受前五年免征企业所得税，第六年至第十年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止的优惠政策。	发改委、工信部、财政部、税务总局	2018年3月
12	《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版）》	重点支持电子核心产业，包括集成电路芯片封装，采用SiP、MCP、MCM、CSP、WLP、BGA、Flip Chip（倒装封装）、TSV等技术的集成电路封装。	发改委	2017年1月
13	《关于印发江苏省“产业链强链”三年行动计划（2021—2023年）的通知》	促进其中特高压设备、起重机、车联网、品牌服装、先进碳材料、生物医药、集成电路、高技术船舶、轨道交通装备、“大数据+”等10条产业链实现卓越提升。	江苏省政府办公厅	2020年12月
14	《关于加快集成电路产业发展的意见》	引进建设封装测试生产线，与8英寸或12英寸晶圆制造项目配套发展。鼓励发展晶圆级芯片尺寸封装、硅通孔、系统级封装等先进技术，支持封装工艺技术升级和产能扩充，提高测试技术水平和产业规模。	安徽省政府办公厅	2018年3月
15	《安徽省半导体产业发展规划（2018-2021年）》	提升封装测试业层次。依托长电科技、通富微电、新汇成等企业，大力发展凸块（Bumping）、倒装（Flip Chip）、晶圆级封装（WL-CSP）、硅通孔（TSV）等先进封装技术，支持建设先进封装测试生产线和封装测试技术研发中心。鼓励封装测试企业与设计企业、制造企业间的业务整合或并购，探索新兴产业业态和创新产品。建设封	安徽省政府办公厅	2018年2月

序号	文件名称	主要涉及的内容	颁布机构	颁布时间
		装测试产业技术平台，加强科研院所、封装测试代工企业、芯片设计企业的合作。		

（2）相关法律法规及政策对公司经营发展的影响

近年来，集成电路产业一直被视为国家层面的战略新兴产业，国家发展战略、行业发展规划、地方发展政策不断出台，为集成电路行业提供了财政、税收、投融资、知识产权、技术和人才等多方面的支持，推动集成电路行业的技术突破和整体提升，随之也推动了封装测试产业的快速发展，为公司创造了良好的经营环境，对公司经营发展产生积极影响。

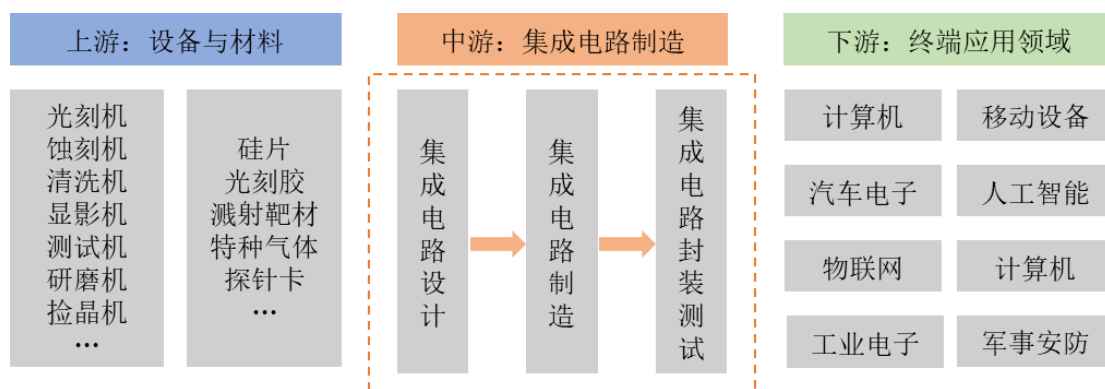
（三）行业发展情况与未来发展趋势

1、集成电路行业发展情况

（1）集成电路行业的基本情况

集成电路，又称 IC、芯片，是将晶体管、电阻、电容等电子元器件全部集成在微型基板上并形成电路互联，成为能执行特定电路或系统功能的一种微型结构，是半导体中的一种。集成电路是全球信息产业的基础与核心，在通信、计算机、消费电子、汽车电子、工业控制、军事等领域得到广泛应用，对经济建设、社会发展和国家安全具有重要战略意义，是国家现代化程度和综合实力的重要体现。

随着集成电路的结构越发复杂，产业结构趋向高度专业化，分工模式进一步细化，因而从产业链的上游到下游依次形成了集成电路的设计、晶圆制造以及封装测试三个子产业群。我国集成电路的产业格局也在根据各细分行业的资源要素进行逐步优化，集成电路设计业向产学研合作密集区域汇集，晶圆制造向资本密集度高的地区汇聚，封装测试业加快自主研发和并购整合，推动技术升级。我国已逐步形成了以芯片设计为龙头、封装测试为主体、晶圆制造重点统筹的产业布局，各细分行业协调发展，晶圆制造业以及封装测试业为芯片设计成果的产品转化提供了重要保障。

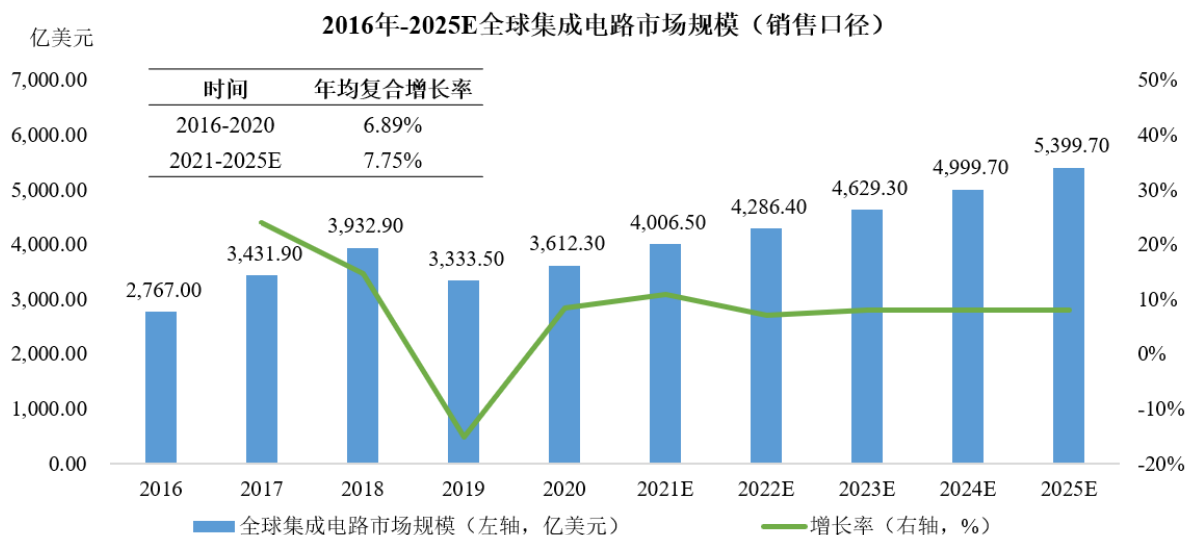


如今，全球集成电路产业逐渐向中国大陆转移，是市场需求、国家产业政策和资本驱动的综合结果，这也将带来产业发展方向的转变、纵向分工的深化、资源的重新配置，并给予新参与者切入市场的机会，进而推动产业链的全面发展。

(2) 全球集成电路行业发展情况

自 20 世纪 40 年代第一个晶体管的诞生，世界就步入了微电子时代。为了突破电子产品的体积限制，集成电路也应运而生，并且技术迭代加快，基本遵循摩尔定律，即晶体管集成度将会每 18 个月增加 1 倍。历经 70 多年的发展，全球集成电路行业已经较为成熟，整体市场规模较为稳定。

近年来，在物联网、5G 通信、人工智能、大数据以及医疗电子等新兴应用领域的强劲需求带动下，全球集成电路行业呈现快速增长趋势。根据 Frost & Sullivan 数据，全球集成电路行业销售额由 2016 年的 2,767.00 亿美元增长到 2018 年的 3,932.90 亿美元，年均复合增长率为 19.22%；2019 年受到中美贸易问题并叠加下游消费电子市场疲软、内存价格暴跌等影响，行业销售额稍有下滑；但 2020 年在疫情背景下，居家办公学习的需求推动了全球集成电路销售额的强力反弹，集成电路销售额回升至 3,612.30 亿美元，同比增长 8.36%。未来全球集成电路市场规模预计将以更快的速度，从 2021 年的 4,006.50 亿美元增长至 2025 年的 5,399.70 亿美元。



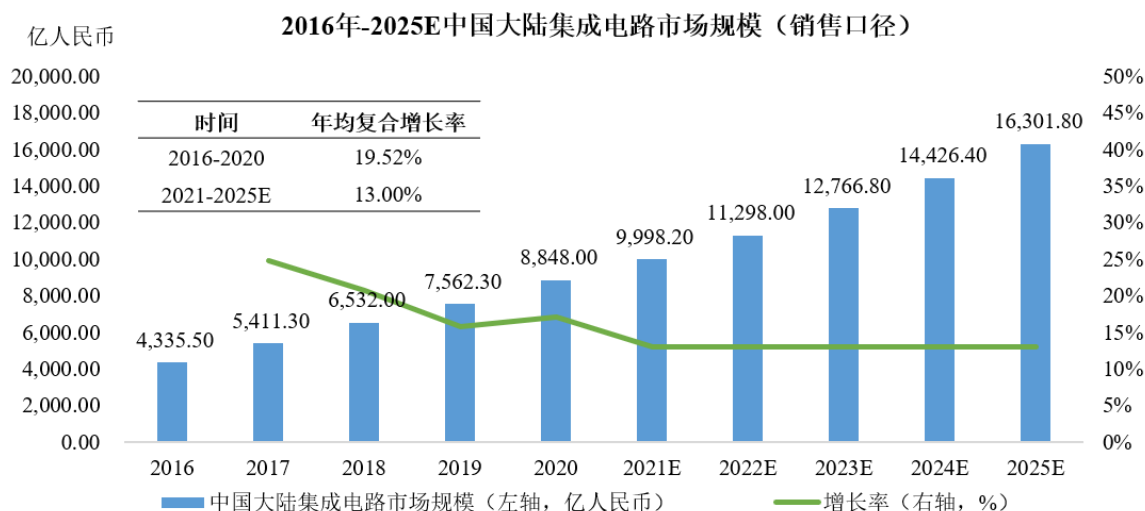
数据来源：Frost & Sullivan

（3）中国大陆集成电路行业发展情况

①中国大陆集成电路行业发展速度远高于全球水平

中国大陆的集成电路行业发展相对较晚，于 1965 年研制出第一块硅基数字集成电路，并且直到 20 世纪 90 年代才真正形成芯片设计、晶圆制造和封装测试的完整产业链，进入重点建设期。近年来借助着巨大的市场需求、丰富的人口红利、稳定的经济增长以及积极的产业政策扶持等优势，中国大陆集成电路产业实现了飞跃式的发展，增速远高于全球集成电路行业的增长水平，目前中国大陆在全球集成电路市场占据举足轻重的地位。

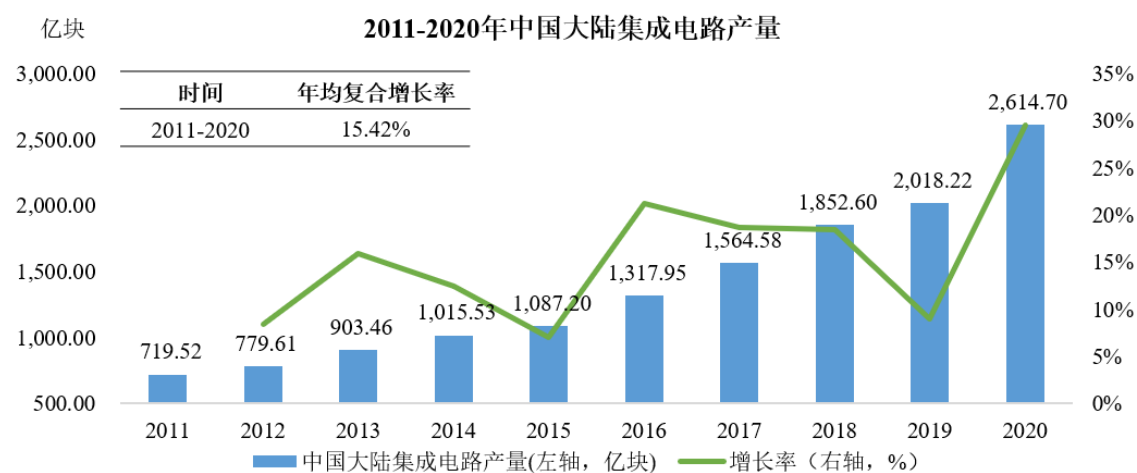
根据 Frost & Sullivan 数据，中国大陆集成电路行业销售额由 2016 年的 4,335.50 亿元增长至 2020 年的 8,848.00 亿元，复合增长率高达 19.52%。虽然 2019 年增长趋势有所放缓，但相比于全球市场的负增长而言仍然表现强势。2020 年疫情的爆发不仅没有带来消极影响，反而推动了物联网、云服务、人工智能等技术的迅速发展和广泛应用，同比增长率回升至 17.00%。未来，受进口替代的影响，中国大陆集成电路市场有望以 13.00% 的年复合增长率增长，仍保持为全球集成电路市场增长速度最快的地区。中国大陆集成电路市场规模预计将从 2021 年的 9,998.20 亿元增长至 2025 年的 16,301.80 亿元。



数据来源：Frost & Sullivan

②中国大陆集成电路行业产量规模较小，供需缺口依然较大

我国作为发展中国家，相对于旺盛的消费需求，集成电路产量规模还相对较小。根据国家统计局数据，2020年中国大陆集成电路的产量为2,614.70亿块，同比增长29.56%。在整体产量规模呈现逐年上升的趋势下，供需缺口依然较大，且与欧美发达国家在集成电路产业上的技术积累仍有差距，集成电路产业整体仍在跟随追赶阶段，因此我国生产所需的集成电路主要依赖进口。根据海关总署统计，2020年中国大陆进口集成电路5,435.00亿块，同比增长22.10%，我国集成电路的进口替代空间十分广阔，尤其是中美贸易摩擦的发生，更使得集成电路的自主可控迫在眉睫。



数据来源：国家统计局

2、集成电路封装测试行业发展情况

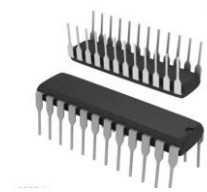
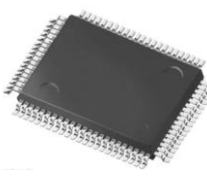
（1）集成电路封装测试行业的基本情况

集成电路制造产业链主要包括芯片设计、晶圆制造、封装测试三个子行业，封装测试行业位于产业链的中下游，该业务实质上包括了封装和测试两个环节，但由于测试环节一般也主要由封装厂商完成，因而一般统称为封装测试业。

封装是将芯片在基板上布局、固定及连接，并用绝缘介质封装形成电子产品的过程，目的是保护芯片免受损伤，保证芯片的散热性能，以及实现电信号的传输。经过封装的芯片可以在更高的温度环境下工作，抵御物理损害与化学腐蚀，带来更佳的性能表现与耐用度，同时也更便于运输和安装。测试则包括进入封装前的晶圆测试以及封装完成后的成品测试，晶圆测试主要检验的是每个晶粒的电性，成品测试主要检验的是产品电性和功能，目的是在于将有结构缺陷以及功能、性能不符合要求的芯片筛选出来，是节约成本、验证设计、监控生产、保证质量、分析失效以及指导应用的重要手段。

封装测试业是我国集成电路行业中发展最为成熟的细分行业，在世界上拥有较强竞争力，全球的封装测试产业正在向中国大陆转移。根据中国半导体行业协会统计数据，目前国内的集成电路产业结构中芯片设计、晶圆制造、封装测试的销售规模大约呈 4：3：3 的比例，产业结构的均衡有利于形成集成电路行业的内循环，随着上游芯片设计产业的加快发展，也能够推进处于产业链下游的封装测试行业的发展。

封装技术历经较长的发展过程，形成了复杂多样的封装形式，其发展历史如下：

阶段	时间	封装技术	具体封装形式	图示
第一阶段（传统封装）	20 世纪 70 年代前	通孔插装型封装	晶体管封装（TO）、双列直插封装（DIP）、陶瓷双列直插封装（CDIP）、塑料双列直插封装（PDIP）、单列直插式封装（SIP）	
第二阶段（传统封装）	20 世纪 80 年代以后	表面贴装型封装	塑料有引线片式载体封装（PLCC）、四边引脚扁平封装（QFP）、塑料四边引线扁平封装（PQFP）、小外形表面封装（SOP）、无引线四边扁平封装（PQFN）、小外形晶体管封装（SOT）、	

阶段	时间	封装技术	具体封装形式	图示
			双边扁平无引脚封装（DFN）	
第三阶段（先进封装）	20 世纪 90 年代以后	面积阵列型封装	球栅阵列封装（BGA）、塑料焊球阵列封装（PBGA）、陶瓷焊球阵列封装（CBGA）、带散热器焊球阵列封装（EBGA）、倒装芯片焊球阵列封装（FC-BGA）	
			晶圆级封装（WLP）	
			芯片级封装（CSP）	
第四阶段（先进封装）	20 世纪末开始	多芯组装（MCM）、系统级封装（SiP）、三维立体封装（3D）、凸块制造（Bumping）		
				以凸点（Bumping）为例
第五阶段（先进封装）	21 世纪前 10 年开始	系统级单芯片封装（SoC）、微电子机械系统封装（MEMS）、晶圆级系统封装-硅通孔（TSV）、倒装封装（FC）、扇外型封装（Fan-out）		
				以倒装（FC）为例

资料来源：《中国半导体封装业的发展》、Frost & Sullivan，海通证券整理

集成电路的封装形式多样复杂，基于国家发改委发布的《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，并结合行业内按照封装工艺分类的惯例，封装分为传统封装（第一阶段和第二阶段）及先进封装（第三至第五阶段），考虑到技术路径与指标的差异可将先进封装进一步细分，分为中端先进封装（第三阶段中大部分封装技术）与高端先进封装（第三阶段中少部分封装技术以及第四至第五阶段）。传统封装与先进封装的主要区别包括键合方式由传统的引线键合发展为球状凸点焊接，封装元件概念演变为封装系统，封装对象由单芯片向多芯片发展，由平面封装向立体封装发展。目前，全球封装行业的主流技术处于以 CSP、BGA 为主的第三阶段，并向以倒装封装（FC）、凸块制造（Bumping）、系统级封装（SiP）、系统级单芯片封装（SoC）、晶圆级系统封装-硅通孔（TSV）为代表的第四阶段和第五阶段封装技术迈进。

（2）凸块制造（Bumping）在先进封测技术中的重要性

①凸块制造的概念

凸块制造是一种新型的芯片与基板间电气互联的方式，这种技术通过在晶圆上制作金属凸块实现。具体工艺流程为：晶圆在晶圆代工厂完成基体电路后，由封测代工厂在切割之前进行加工，利用薄膜制程、黄光、化学镀制程技术及电镀、印刷技术、蚀刻制程，在芯片的焊垫上制作金属焊球或凸块。

相比传统的打线技术向四周辐射的金属“线连接”，凸块制造技术反映了以“以点代线”的发展趋势，可以大幅缩小芯片体积，具有密度大、低感应、低成本、散热能力优良等优点；且凸块阵列在芯片表面，引脚密度可以被做得极高，便于满足芯片性能提升的需求。此外，凸块的选材、构造、尺寸设计会受多种因素影响，例如封装大小、成本、散热等性能。

②凸块制造技术的起源

凸块制造技术起源于 20 世纪 60 年代。上世纪 60 年代，IBM 公司开发了倒装芯片技术，第一代倒装芯片为具有三个端口的晶体管产品。随着电子器件体积的不断减小以及 I/O 密度的不断增加，20 世纪 70 年代，IBM 公司将倒装芯片技术发展为应用在集成电路中的 C4 技术，C4 技术通过高铅含量的焊料凸块将芯片上的可润湿金属焊盘与基板上的焊盘相连，C4 焊球可以满足具有更细密焊盘的芯片的倒装焊要求。此后凸块制造技术进一步发展，利用熔融凸块表面张力以支撑晶片的重量及控制凸块的高度。

IBM 公司开发出的初代凸块制造技术奠定了凸块制造技术的底层工艺，并就该技术申请了发明专利。IBM 公司通过高铅焊料蒸镀工艺进行凸块加工，使用高温/低温共烧陶瓷载板（基板）进行互联，受该工艺方案限制，当时凸块间距较大（ $>250\ \mu\text{m}$ ）、焊接温度过高（ $>300^\circ\text{C}$ ），且生产成本高居不下，极大限制了凸块制造技术的推广和应用。

③凸块制造技术的发展

随着集成电路行业的发展，新的凸块制造工艺打破了初代技术的困局，其发展阶段与集成电路行业的两次重大产业转移以及显示面板产业的发展密切相关。

集成电路行业的第一次产业转移在 1970-1980 年代由美国至日本：美国作为集成电路的发源地，20 世纪 70 年代间，前 10 大集成电路制造商几乎均来自美国。日本在美国技术支持与本国政策与资金支持下，依托家电和工业级计算机产业繁荣发展实现反超，在 20 世纪 80 年代末，前 10 大集成电路制造商中有一半以上来自日本。与此同时，日本本土对面板智能化、轻薄化的需求增加，随之涌现大批日本封测技术厂商，凸块制造技术在这期间得到较大发展。

第二次集成电路行业产业转移在 20 世纪 80 年代-21 世纪初，由日本至韩国、中国台湾：凭借低廉人工成本及大量高素质人才，韩国顺应消费级 PC 的趋势快速发展，而中国台湾在晶圆代工厂、芯片封测领域的垂直分工下出现市场机会，韩国与中国台湾迅速取代日本在集成电路产业大部分的市场份额。面板产业亦转移至韩国与中国台湾，凸块制造技术在产业化及转移的过程中随着终端应用的需求不断被优化，溅射凸块底部金属工艺和电镀凸块工艺取代了原先成本高昂的蒸镀技术方案，并将凸块间距缩小至 200 μm 以下，原材料亦出现多元化，生产良率不断上升。

2010 年以来，全球集成电路产业与显示面板产业向中国大陆转移的趋势增强。随着集成电路晶圆制程技术从 2000 年左右的 300nm 发展到目前的 7nm，凸块间距也发展到 100 μm 以下的极细间距领域，单芯片上的金属凸块超过 1,500 个，需要每个凸块都同基板上的线路形成良好电气接触，高密度细间距凸块布局对封测企业的凸块制造技术提出了极高要求。目前凸块制造技术底层工艺专利已成为公开技术，国内外同行业公司凸块制造技术均在原有凸块制造底层工艺上进行各个环节的技术创新，以达到终端应用发展的需求。

④凸块制造技术是先进封装技术发展演变的重要基础

随着集成电路行业技术的进步与终端电子产品需求的提高，凸块制造技术也不断突破技术瓶颈、实现大规模产业化，并发展成为关键的高端先进封装技术之一。

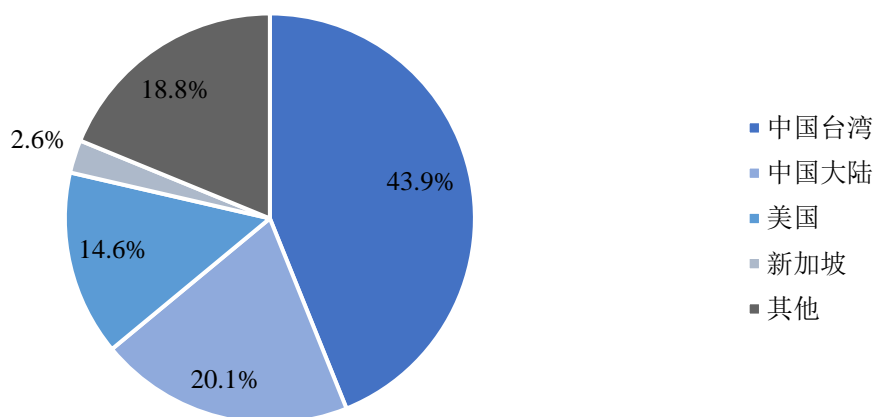
凸块制造技术的重要性在于它是各类先进封装技术得以实现进一步发展演化的基础。倒装芯片（FC）技术、扇外型（Fan-out）封装技术、扇进型（Fan-in）封装技术、芯片级封装（CSP）、三维立体封装（3D）、系统级封装（SiP）等

先进封装结构与工艺实现的关键技术均涉及凸块制造技术。硅通孔技术（TSV）、晶圆级封装（WLP）、微电子机械系统封装（MEMS）等先进封装结构与工艺均是凸块制造技术的演化延伸。

（3）全球集成电路封装测试行业发展情况

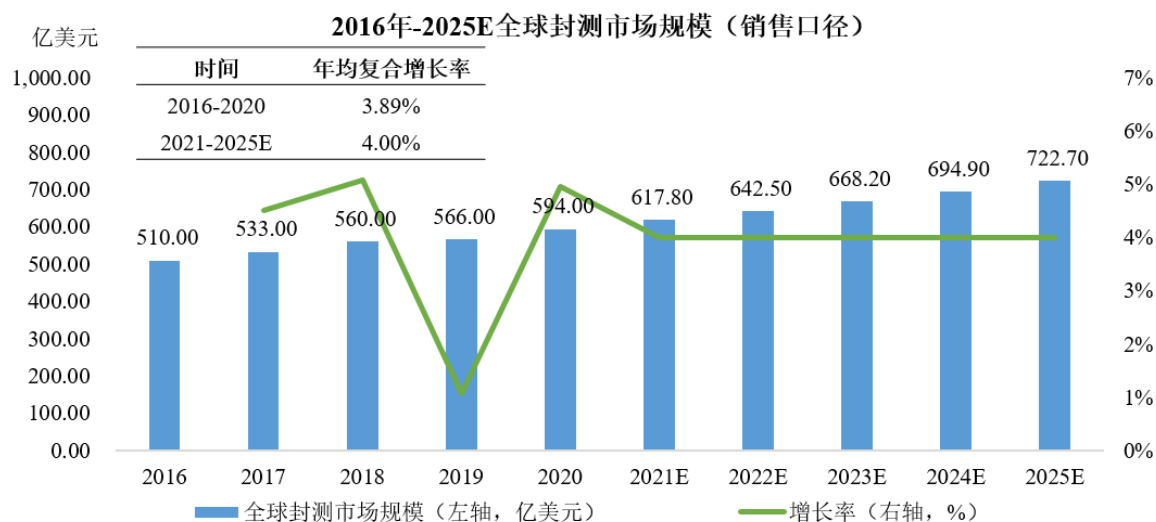
集成电路产业早期从欧美地区发展，随着产业的技术进步和资源要素的全球配置，封装测试环节的产能已逐渐由欧美地区转至中国台湾、中国大陆、新加坡、马来西亚等亚洲新兴市场区域，目前全球封装测试行业已形成了中国台湾、中国大陆、美国三足鼎立的局面。根据前瞻产业研究院数据，2019 年中国封装测试企业在全市场中的占有率高达 64.00%，其中中国台湾企业占 43.90%，中国大陆企业占 20.10%，均高于美国的 14.60%。

2019年全球封装测试企业市场份额分布



数据来源：前瞻产业研究院

全球封装测试市场行业销售额从 2016 年的 510.00 亿美元增长至 2020 年的 594.00 亿美元，保持着平稳增长；2020 年全球封测市场同比增速为 4.95%，高于 2019 年的 1.07%，在全球经济受新冠疫情影响下行时，逆势上升，主要由于以下几个原因：①全球由于贸易摩擦带来的芯片恐慌提高了芯片库存；②5G 的应用使得厂商加大了智能手机、电脑等的备货；③居家办公的政策刺激了电子产品的需求。

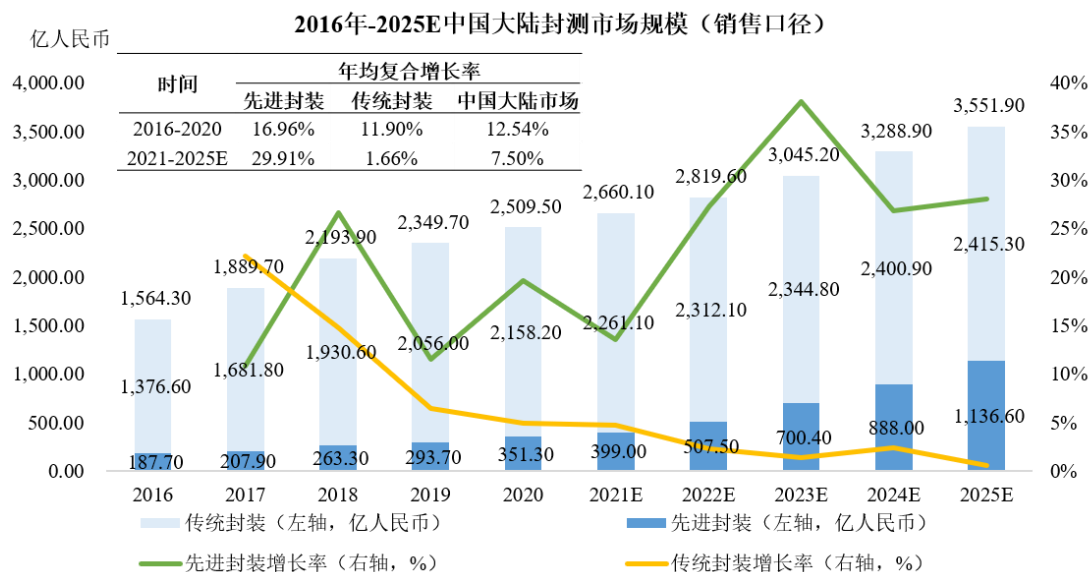


数据来源：Frost & Sullivan

未来，从供应端看，全球晶圆代工厂的持续扩产，将会有效缓解当前晶圆产能供不应求的状况。需求端来看，随着物联网、5G 通信、人工智能、大数据等新技术的不断成熟，全球集成电路行业进入新一轮的上升周期，封测行业也将受益，预计全球市场规模将在 2025 年达到 722.70 亿美元。同时，先进封装作为后摩尔时代的选择之一，将成为推动全球封测行业持续发展的新动力，预计将以 6.50% 的年复合增长率快速增长，2025 年在全球封测市场约占一半份额。

（4）中国大陆集成电路封装测试行业发展情况

受益于产业政策的大力支持以及下游应用领域的需求带动，境内封装测试市场跟随集成电路产业实现了高速发展。根据 Frost & Sullivan 数据，2016 年至 2020 年，中国大陆封测市场的年复合增长率为 12.54%，远高于全球封测市场 3.89% 的增长速度。从封测业务收入结构上来看，中国大陆封测市场依然主要以传统封装业务为主，但随着国内领先厂商不断通过海内外并购及研发投入，中国大陆先进封装业务有望快速发展。



数据来源：Frost & Sullivan

近年来，高通、华为海思、联发科、联咏科技等知名芯片设计公司逐步将封装测试订单转向中国大陆企业，同时国内芯片设计企业的规模也在逐步扩大，以及全球晶圆制造龙头企业也陆续在大陆建厂扩产，在此背景下，国内封装测试企业将会步入更为快速的发展阶段。同时，未来先进封装将为集成电路产业创造更多的价值，随着智能汽车、5G 手机等的先进封装需求增加，产能紧张，将会带动封测价格提升，国内提前布局先进封装业务的厂商将会受益。

根据 Frost & Sullivan 数据，未来五年中国大陆封测市场预计将保持 7.50% 的年均复合增长率，在 2025 年达到 3,551.90 亿元的市场规模，占全球封测市场比重约为 75.61%，其中先进封装将以 29.91% 年复合增长率持续高速发展，在 2025 年占中国大陆封测市场比重将达到 32.00%。

3、显示驱动芯片行业发展情况

(1) 显示驱动芯片的基本情况

显示驱动芯片是显示面板成像系统中的重要组成部分，芯片集成了电阻、调节器、比较器和功率晶体管等部件，控制着显示面板的发光线性度、功率、电磁兼容等关键因素，从而保证显示画面的均匀性和稳定性。

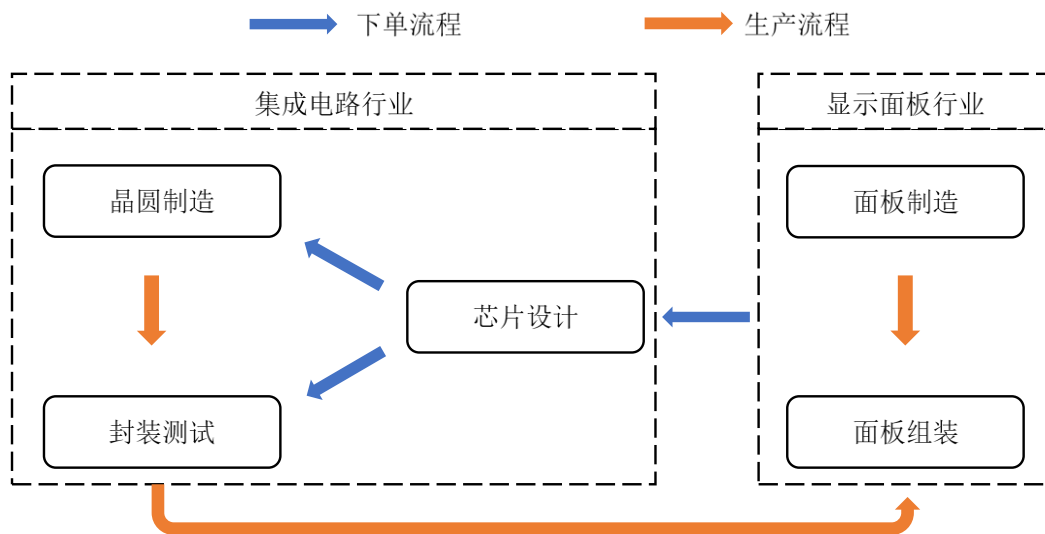
显示面板由百万级或千万级的像素组成，单颗显示驱动芯片可以控制众多像素，通常小尺寸面板仅需要一颗显示驱动芯片即可控制所有像素，大尺寸面板则

需要十几至几十颗显示驱动芯片，因此显示驱动芯片的引脚众多且排列紧密，对封装测试的技术要求也更高。

凸块制造技术使得传统封装的线连接变成了点连接，显著提高了引脚密度。在封装环节，目前主要采用玻璃覆晶封装（COG）和薄膜覆晶封装（COF）技术，玻璃覆晶封装减小了模组体积、良品率高、成本低且易于量产；薄膜覆晶封装可以为屏幕区域预留出更大的空间，在高清大屏或全面屏趋势下薄膜覆晶封装的应用比例逐步提高。

（2）显示驱动芯片产业链

在显示驱动芯片产业链中，一般由显示面板企业向芯片设计公司提出设计需求，芯片设计公司在完成设计后分别向晶圆制造代工厂和封装测试企业下订单，晶圆制造企业将制造好的晶圆成品交由封装测试企业，最后封测企业在完成凸块制造、封装测试环节后，直接将芯片成品发货至显示面板或模组厂商进行组装。



（3）显示驱动芯片行业主要下游市场发展情况

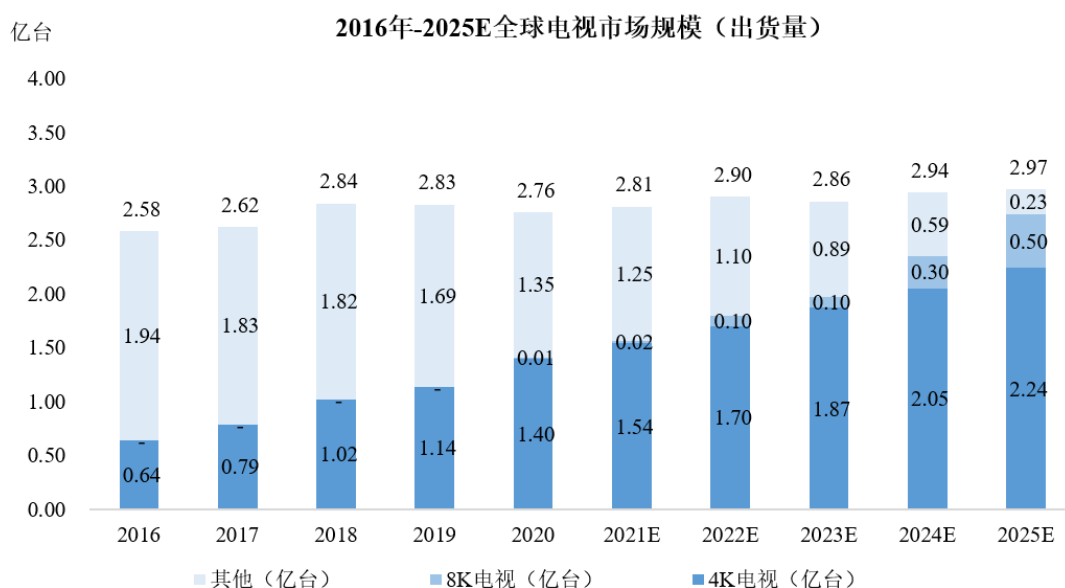
显示驱动芯片行业的发展与面板行业及其终端消费市场发展情况密切相关，主要的终端消费市场集中在电视、笔记本电脑、智能手机等。

①全球电视市场

全球电视的发展趋势为：4K 电视逐渐普及，出货量不断攀升，2016 年出货

量仅为 0.64 亿台，2020 年增长至 1.40 亿台，渗透率从 24.81% 增至 50.72%；8K 电视因价格过高，市场接受度较小，2018 年开始有小幅出货，2020 年出货量仅为 100 万台。预计 2021 年，全球电视的出货量上升至 2.81 亿台，其中 4K 电视出货量增至 1.54 亿台，8K 电视出货量增至 200 万台。

随着显示技术的发展和 8K 电视成本的降低，电视将继续朝更高分辨率的方向发展。预计 2025 年电视出货量为 2.97 亿台，4K 电视出货量增至 2.24 亿台，渗透率达 75.42%，8K 面板出货量增至 0.50 亿台，渗透率达 16.84%。



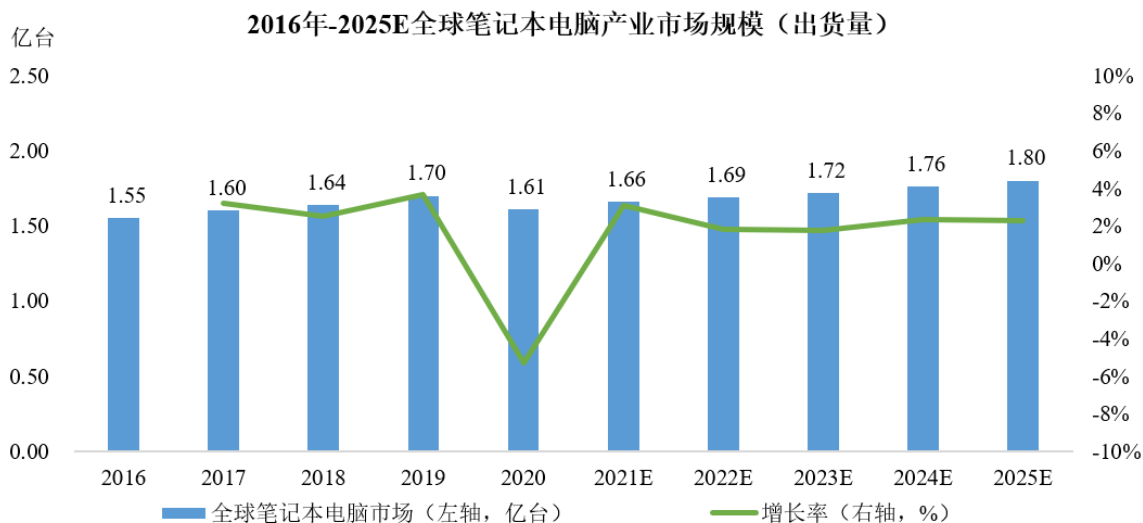
数据来源：Frost & Sullivan

随着电视面板分辨率的提升，每台电视所需显示驱动芯片颗数几乎成倍增加。每台高清、全高清或 2K 电视仅需 4-6 颗显示驱动芯片，但每台 4K 电视需使用 10-12 颗显示驱动芯片，而每台 8K 电视使用的显示驱动芯片高达 20 颗。因此，伴随着未来全球电视出货量的平稳增长以及更高分辨率电视渗透率比重的提升，所需显示驱动芯片数量将大幅增加。

②全球笔记本电脑市场

全球笔记本电脑市场规模近五年处于平稳增长状态，由于笔记本电脑新品硬件提升不明显、软件通过升级就能通用，相对延长了笔记本电脑产品的生命周期。预计 2021 年，笔记本电脑市场规模为 1.66 亿台，而随着折叠屏等技术发展，笔

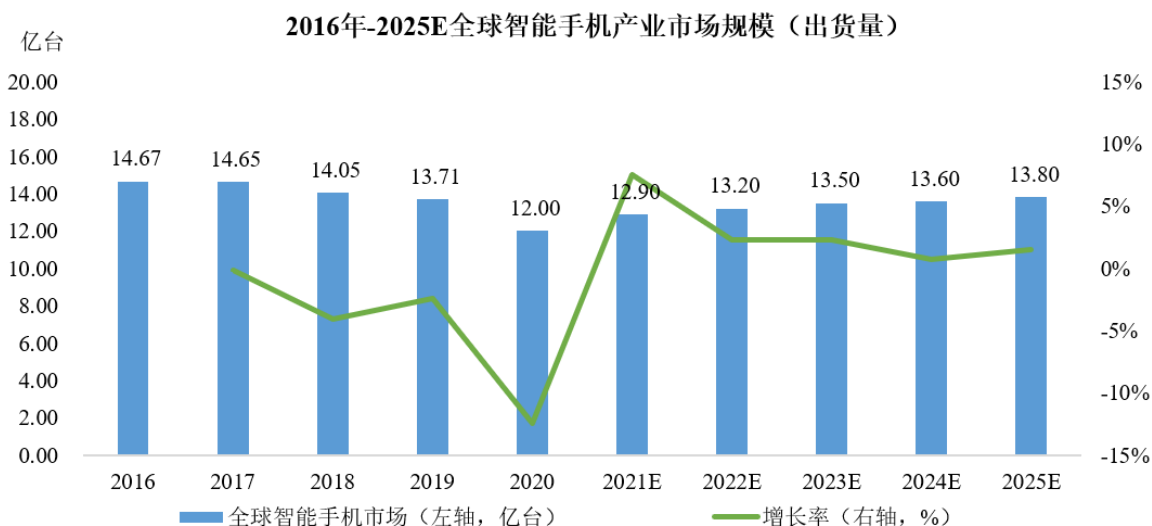
笔记本电脑有望迎来新的增长点，市场增长速度回暖，在 2025 年达到 1.80 亿台。



数据来源：Frost & Sullivan

③全球智能手机市场

全球智能手机市场规模近五年处于存量更换时代，2020年受到疫情的影响，智能手机的市场规模为 12.00 亿台，但未来随着 5G 应用的普及和新兴市场的需
求增长，全球智能手机市场将有所转暖，未来全球智能手机市场将维持平稳增长
态势，预计 2025 年出货量将稳步上升至 13.80 亿部。



数据来源：Frost & Sullivan

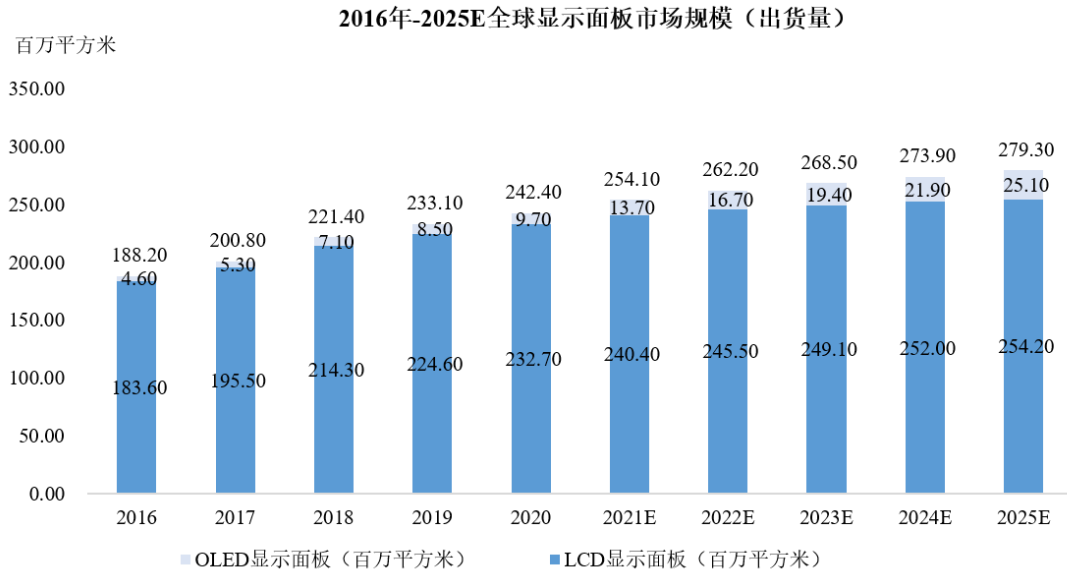
（4）显示驱动芯片行业市场规模及发展情况

全球显示驱动芯片的产业格局中，韩国厂商和中国台湾厂商占据主导地位，包括三星、联咏科技、奇景光电、瑞鼎科技等。近些年，随着中颖电子、格科微、明微电子等厂商的崛起，中国大陆的市场份额有所提升。未来随着我国芯片设计的人才资源逐步丰富、晶圆制造业的产能供给提升、封装测试技术的集成度进一步提高以及显示面板行业的持续快速发展，中国大陆的显示驱动芯片市场份额将持续增加。

①全球显示面板市场规模

根据 Frost & Sullivan 统计，随着终端需求的增加，全球显示面板市场规模从 2016 年的 1.88 亿平方米增长至 2020 年的 2.42 亿平方米，年复合增长率为 6.53%。随着技术的成熟发展和下游需求的增长，预计全球显示面板的出货量将从 2021 年的约 2.54 亿平方米增长至 2025 年的约 2.79 亿平方米。

全球显示面板市场主要分为 LCD 面板市场和 OLED 面板市场。其中，LCD 由于其技术的成熟性，以及在大屏幕显示领域如电视、笔记本电脑等的广泛应用，市场需求和占比较大。2020 年，全球 LCD 面板出货量高达 2.33 亿平方米，占全球显示面板 96.00% 的市场份额。LCD 面板保有量高，未来将继续稳定在高出货量水平，预计 2025 年将达到 2.54 亿平方米。OLED 因其独特的柔性特质，能满足曲面和折叠屏的需求，被广泛应用于手机等小屏幕产品，同时也应用于一些新兴的电子产品如智能穿戴和 VR 设备等。2020 年，全球 OLED 面板出货量仅为 9.70 百万平方米，但未来预计将以 16.34% 的年复合增长率增长，2025 年有望达到 25.10 百万平方米。

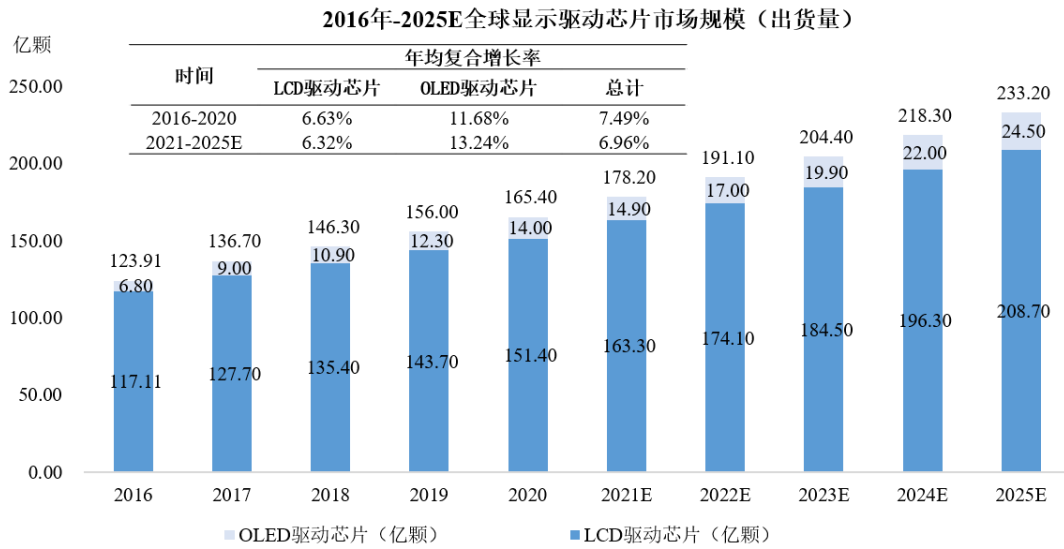


数据来源：Frost & Sullivan

②全球显示驱动芯片行业市场规模

受益于全球显示面板出货量的增长，显示驱动芯片市场规模也快速增长。根据 Frost & Sullivan 统计，全球显示驱动芯片出货量从 2016 年的 123.91 亿颗增长至 2020 年的 165.40 亿颗，年复合增长率为 7.49%。预计未来将持续增长，到 2025 年出货量增至 233.20 亿颗。

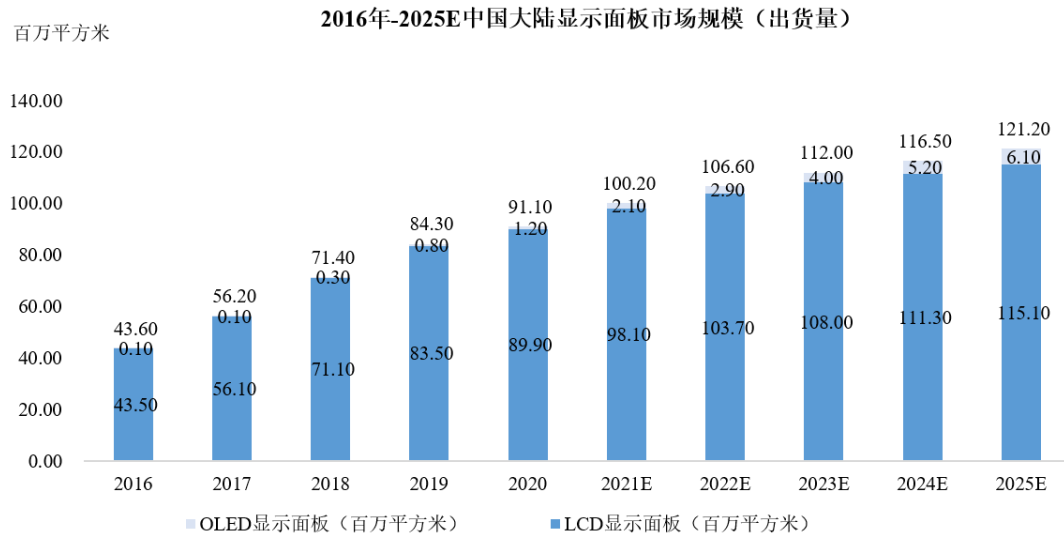
LCD 面板出货量稳步增长，带动 LCD 驱动芯片出货量逐步提升。2020 年，全球 LCD 驱动芯片出货量为 151.40 亿颗，预计未来将继续稳定在高出货量水平，到 2025 年增至 208.70 亿颗。得益于 OLED 屏幕的高速增长，OLED 驱动芯片出货量亦快速增长，预计到 2025 年将增至 24.50 亿颗，未来五年复合增长率达 13.24%。



数据来源：Frost & Sullivan

③中国大陆显示面板市场规模

相较于韩国与中国台湾，中国大陆显示面板发展较晚。随着京东方等国产面板厂商的崛起，中国大陆显示面板以 20.23% 的年复合增长率快速追赶，市场规模从 2016 年的 43.60 百万平方米增长至 2020 年的 91.10 百万平方米。未来，受益于行业整体的稳健增长与中国大陆市场的强劲需求，中国大陆显示面板市场规模预计 2025 年将增至 121.20 百万平方米。

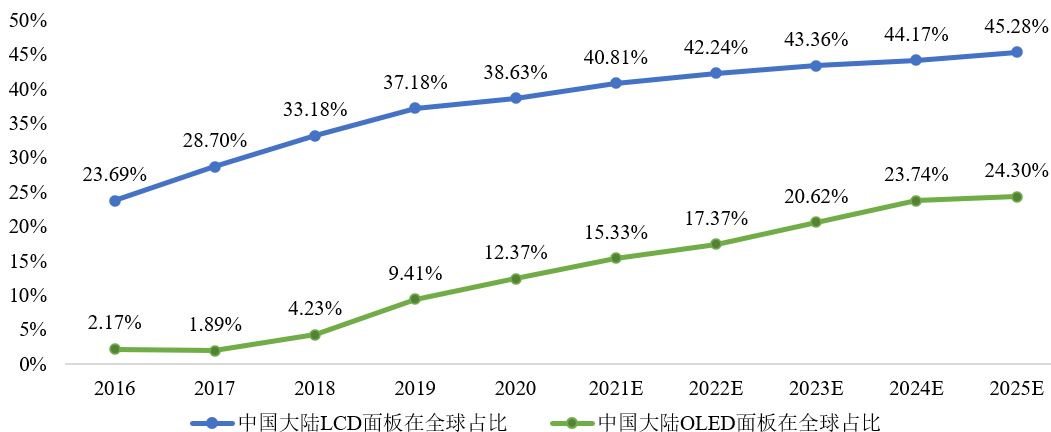


数据来源：Frost & Sullivan

中国大陆 LCD 面板的发展速度远高于全球平均水平，其在全球 LCD 市场的所占份额也逐年提高。据统计，中国大陆 LCD 面板 2016 年至 2020 年以 19.90%

的年复合增长率发展，2020年中国大陆LCD面板出货量为89.90百万平方米，占据全球38.63%的市场份额。预计未来，中国大陆LCD面板出货量将从2021年的98.10百万平方米增长至2025年的1.15亿平方米。2020年，中国大陆OLED面板出货量为1.20百万平方米，预计2025年将达到6.10百万平方米。整体而言，中国大陆显示面板市场发展迅速，LCD和OLED面板产量在全球的份额里都将逐渐提高，预计在2025年将分别达到45.28%和24.30%。

2016年-2025E中国大陆显示面板在全球份额

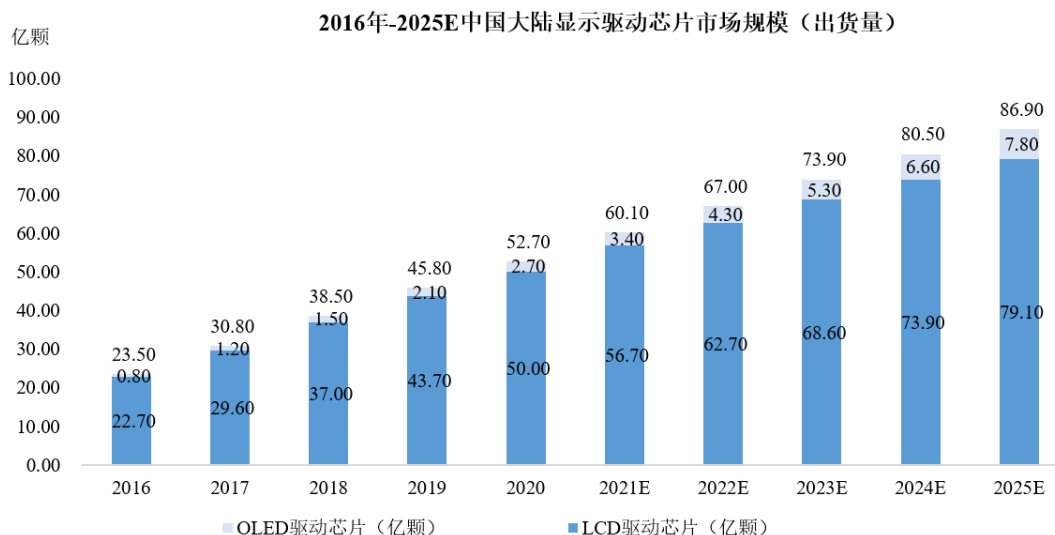


数据来源：Frost & Sullivan

④中国大陆显示驱动芯片行业市场规模

受下游显示面板市场增长的驱动，叠加国家政策利好及大量资本投入，中国大陆显示驱动芯片以高于全球平均速度增长。据统计，2016年中国大陆显示驱动芯片出货量仅为23.50亿颗，但2020年已增至52.70亿颗，年复合增长率高达22.37%。其中，LCD驱动芯片出货量从2016年的22.70亿颗增长至2020年的50.00亿颗，年复合增长率为21.82%；OLED驱动芯片从2016年的0.80亿颗增至2020年的2.70亿颗，年复合增长率为35.54%。

预计2025年中国大陆显示驱动芯片出货量将达到86.90亿颗，其中LCD驱动芯片产量将增至79.10亿颗，OLED驱动芯片产量将增至7.80亿颗。



数据来源：Frost & Sullivan

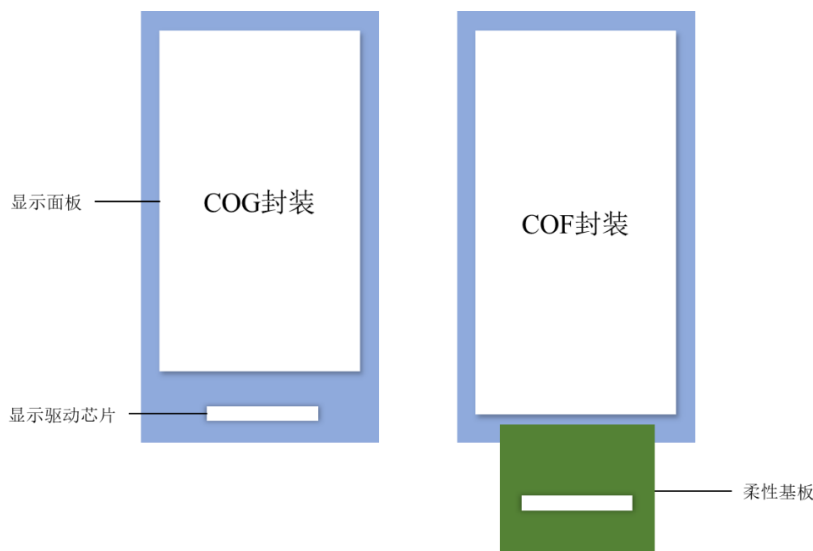
4、显示驱动芯片封装测试行业发展情况

（1）显示驱动芯片封装测试的基本情况

集成电路按照功能结构分类，可分为数字集成电路、模拟集成电路和数/模混合集成电路。数字集成电路的功能是运算、存储、传输及转换离散的数字信号；模拟集成电路的功能是处理光、声音、速度、温度等连续的自然模拟信号；数/模混合集成电路则兼具两者的功能。

显示驱动芯片属于数/模混合集成电路，其电信号经由芯片与基板的键合点、基板上的金属线路而到达被控制的像素点。随着对显示分辨率的要求越来越高，显示驱动芯片的 I/O 端口数越来越多，如此大规模的输入输出对芯片封装技术的要求很高，并且随着电子产品以轻薄短小为发展趋势，要求显示驱动芯片的体积进一步缩小，集成度进一步提高。

凸块制造工艺结合玻璃覆晶封装（COG）或薄膜覆晶封装（COF）凭借其多 I/O、高密度等特点，已经成为显示驱动芯片封装技术的主流，且其采用倒装芯片结构，无须焊线。玻璃覆晶封装主要用于小尺寸面板产品如手机、数码相机、平板电脑等，而薄膜覆晶封装将芯片封装在可弯曲的柔性基板上，故占用面积更小，主要应用于大尺寸面板产品如电视、电脑显示器等以及对边框要求更高的全面屏手机。



（2）显示驱动芯片封装测试行业的发展情况

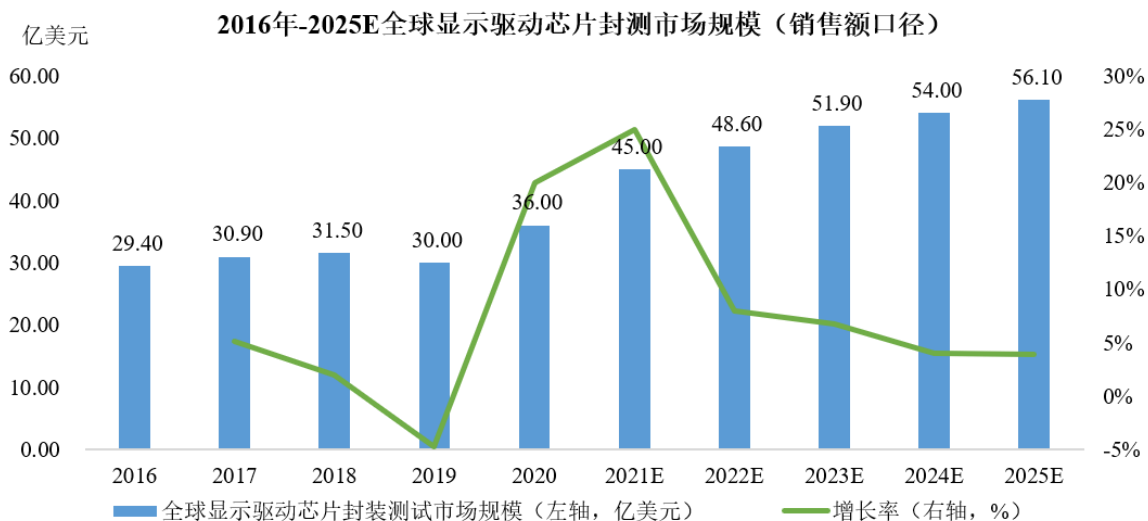
全球显示驱动芯片封测服务的产业格局中，中国台湾厂商占据主导地位，包括硕邦科技、南茂科技等。近些年，随着汇成股份等大陆厂商的崛起，中国大陆的市场份额有所提升。未来随着我国芯片设计的人才资源逐步丰富、晶圆制造业的产能供给提升、封装测试技术的集成度进一步提高，预计 2025 年中国大陆的显示驱动芯片封测服务销售份额将进一步提升。

①全球显示驱动芯片封装测试行业市场发展情况

2015 年起，由于京东方等国内领先面板厂商突破显示面板核心技术，面板实现大宗商品化，整体面板及其零部件处于一个价格下行时期，因此该阶段显示驱动芯片封测市场规模没有显著增长。2020 年，尽管新冠疫情给全球市场带来短期冲击，各国的经济停摆和隔离政策影响了全球贸易的正常进行，但居家隔离、远程办公刺激了电子产品等终端需求的爆发，一定程度上抵消了新冠疫情带来的负面影响。同时，由于晶圆代工厂产能紧张，整体芯片价格不断上涨，进一步带动了显示驱动芯片封测市场的增长，据统计，全球显示驱动芯片封测市场规模于 2020 年达到 36.00 亿美元，较 2019 年增长 20.00%。

未来从需求端来看，依然将有新增的面板产能释放，对于显示驱动芯片的需求持续走高。从供应端来看，晶圆代工厂虽然一直有新建产能投产，但多数都还未能实现量产，预计 2023 年晶圆产能才有望达到供需平衡。显示驱动芯片的产量不足，将持续推高销售价格，因此显示驱动芯片封测市场规模将也随之上涨，

预计在 2025 年达到 56.10 亿美元。



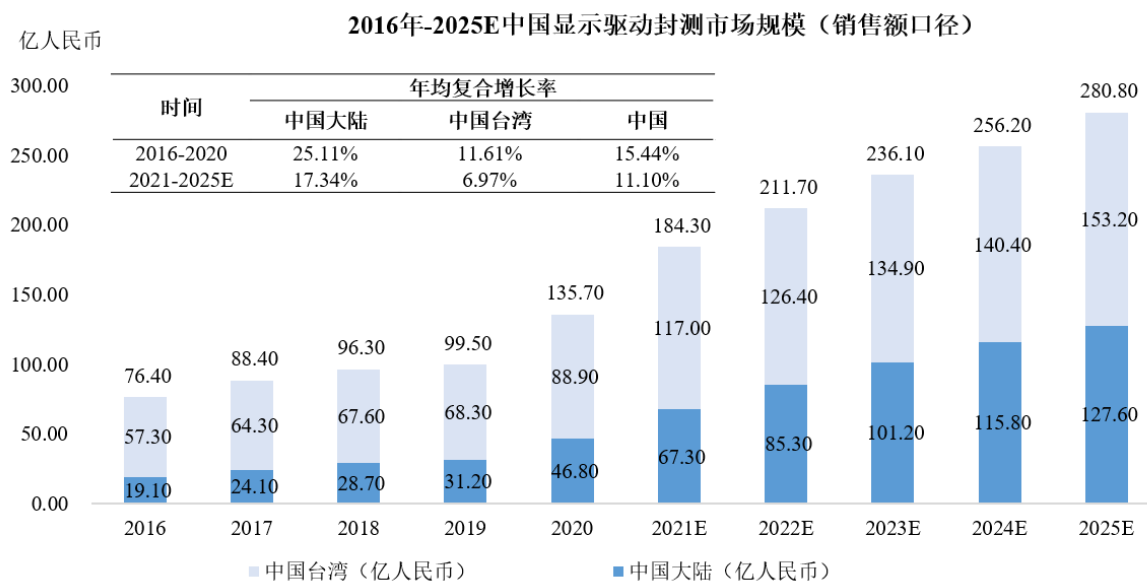
数据来源：Frost & Sullivan

②中国显示驱动芯片封装测试行业市场发展情况

中国显示驱动芯片封测行业涵盖中国大陆及中国台湾两个市场。得益于领先的晶圆代工厂及成熟的芯片设计产业，2016 年中国台湾的显示驱动芯片封测市场规模为 57.30 亿元，占据中国显示驱动芯片封测市场的 75.00%。2020 年，中国台湾显示驱动芯片封测行业在经过并购整合后，进一步增强了产业核心竞争力，市场规模达到了 88.90 亿元，年均复合增长率约为 11.61%。

相比之下，中国大陆相关厂商起步相对较晚，2016 年中国大陆的显示驱动芯片封测市场规模为 19.10 亿元。随着集成电路设计产业的快速成长和国内资本投入的提高，显示驱动芯片封测业务已逐渐开始转移至中国大陆。同时，受益于全球显示驱动芯片价格上涨，2020 年中国大陆显示驱动芯片封测市场规模达到 46.80 亿元，占中国显示驱动芯片封测市场的 34.49%。

未来随着国内芯片设计厂商的发展以及晶圆产能紧缺短期内难以改变的局，中国显示驱动芯片封测行业的需求将快速增长。预计中国整体显示驱动封测市场规模将从 2021 年的 184.30 亿元增长至 2025 年的 280.80 亿元，年均复合增长率约为 11.10%，2025 年中国显示驱动封测市场占全球市场比重将提升至 77.01%。



数据来源：Frost & Sullivan

（3）全球及中国显示驱动芯片封装测试竞争格局

全球显示驱动芯片封测行业集中度较高，头部效应明显，除部分专门提供对内显示驱动封测服务的厂商集中在韩国外，行业龙头企业均集中在中国台湾及大陆地区。中国台湾在经过行业整合后，中小型封测厂纷纷被大厂并购，目前仅剩硕邦科技、南茂科技两家全球领先的显示驱动芯片封测厂商。中国大陆起步相对较晚，且由于缺乏成熟的芯片设计厂商，市场需求不足，因此中国大陆地区的封测企业规模相对中国台湾地区的封测企业规模较小。随着中国大陆近年来对芯片设计企业的不断扶持和企业技术的不断成熟，急剧上升的显示驱动芯片封测需求将会推动现有显示驱动芯片封测厂商的持续扩产，并吸引更多领先的封测厂商进入行业。

根据 Frost & Sullivan 数据统计，2020 年全球显示驱动芯片封测行业中，独立对外提供服务且市场份额占比较高的企业包括硕邦科技、南茂科技、汇成股份、硕中科技与通富微电。其中，硕邦科技和南茂科技均为中国台湾上市公司；硕中科技原为硕邦科技境内子公司，后被境内其他股东收购；通富微电为中国 A 股上市公司。

5、行业未来发展趋势

（1）集成电路行业发展趋势分析

①产业政策扶持及中美贸易摩擦，加快集成电路进口替代进程

我国持续出台集成电路相关产业政策，将其列为国家重点战略产业，对集成电路企业在税收、人才、技术等多方面提供支持，在此政策红利下，我国集成电路企业逐渐转亏为盈并发展壮大，国际地位也有所提升，产能逐渐向中国大陆转移。另外，随着中美贸易摩擦的出现，美国限制了境内部分企业对芯片以及集成电路设备的进口，我国在集成电路各产业链环节实现自主可控已迫在眉睫。

2021年1月，工信部发布公告筹建全国集成电路标准化技术委员会，主要负责集成电路产业标准制修订工作，涵盖产业上游的材料和设备、制造过程中的“设计、流片、封测”、集成电路封装、产品配套应用等领域。行业标准的制定也彰显了进口替代已上升到国家政策层面。

②摩尔定律逼近极限，延续摩尔和扩展摩尔成为未来技术发展趋势

摩尔定律是一个基于集成电路实际生产所得出来的结果。随着集成电路尺寸不断减小，技术瓶颈在制约工艺的发展，当前产品换代速度已下降，目前延续摩尔以及扩展摩尔是业界认可较为容易实现集成电路突破的两大发展方向。延续摩尔是指通过改变相关器件的结构和布局来实现不同功能的电子元件按设计组合成一块芯片，系统芯片（SoC）是高度集成的芯片产品，是延续摩尔的一个重要应用。扩展摩尔是指通过将不同功能的芯片和元件组装拼接在一起封装，实现提升芯片功能的目的。其中，封装工艺技术将极大程度的影响扩展摩尔能否在后摩尔时代实现突破。未来，中长期来看，以小尺寸 SoC 为代表的延续摩尔，以及以系统级封装 SiP 技术为代表的扩展摩尔，将会是未来一段时间集成电路产业的发展趋势。

③新兴科技产业的发展带来新市场机遇

随着物联网、5G 通信、人工智能、大数据等新技术的不断成熟，消费电子、工业控制、汽车电子、医疗电子、智能制造等集成电路主要下游制造行业的产业升级进程加快。下游市场的革新升级强劲带动了集成电路行业内企业的规模增长。如在显示面板领域，随着电视面板分辨率的提升，每台电视所需显示驱动芯片颗

数几乎成倍增加，每台 4K 电视需使用 10-12 颗显示驱动芯片，而每台 8K 电视使用的显示驱动芯片高达 20 颗。新兴科技产业将成为行业新的市场推动力，并且随着国内企业技术研发实力的不断增强，国内集成电路行业将会出现发展的新契机。

(2) 封装测试行业发展趋势分析

①后摩尔定律时代，先进封装成为行业主流

随着集成电路器件性能的要求不断提高，促进了如 Bumping、Flip Chip、WLCSP、2.5D、3D 等先进封装技术的快速发展。后摩尔定律时代，由于先进制程的研发投入及难度不断提升，制程技术不能带来成本的有效降低，集成电路行业将更多依靠先进封装技术来实现硬件上的突破。先进封装在提升芯片性能方面具有巨大优势，可以在不依赖先进制程工艺前提下，提高芯片整体性能以及集成度，从而满足终端设备对于芯片体积、性能等不断提升的需求。

②产业链分工细化，专业封装测试企业市场地位稳固

随着产业规模的扩张、技术要求的提升，全球集成电路制造产业链分工进一步细化为 Fabless+Foundry+OSAT 的配合，每个环节的分工由此而明确。我国封装测试行业在全球产业链中占据重要地位，并且随着龙头企业的并购整合，市场份额将进一步扩大。另外，随着我国集成电路产业经历了低端制造承接、长期技术引进、高端人才培养等产业发展环节，我国集成电路产业结构逐步完善，形成了以芯片设计为龙头、封装测试为主体、晶圆制造重点统筹的产业布局。未来伴随中国大陆芯片设计业和晶圆制造业的逐步崛起，下游封装测试产业有望持续受益。

③集成电路产业重心转移带来进口替代巨大机遇

目前，中国大陆拥有全球最大且增速最快的集成电路消费市场，集成电路产业发展重心正逐渐转移至中国大陆。巨大的下游市场配合积极的国家产业政策与活跃的社会资本，正在全方位、多角度地支持集成电路行业发展。我国光伏、显示面板、LED 等高新技术行业经过多年发展已达到领先水平，也大力拉动了上游的功率半导体、显示驱动芯片、LED 驱动芯片等集成电路的国产化进程。随

着集成电路产业链相关技术的不断突破，加之中国大陆在物联网、人工智能、新能源汽车等下游市场持续加大布局，中国大陆有望在集成电路封测等更多细分市场实现进口替代。

（3）显示驱动芯片封装测试市场发展趋势分析

①行业呈现强者恒强的先发者优势

显示驱动芯片封测为集成电路封测行业内一个较为细分的市场，当前市场内主要企业均已具备成熟的工艺技术以及建立了长期而稳定的客户关系。相较于其他新兴市场，显示驱动芯片封测市场技术迭代相对较慢，前期设备研发投入较大，行业毛利率较低，需通过规模化生产来保证企业的健康发展。因此，行业内领先企业通过与显示驱动芯片设计公司的深度绑定，降低了研发周期，保证了订单的延续性，也增强了企业自身的核心竞争力。行业内新进入的竞争者需要较长时间来获得芯片设计厂商的信任，导致前期的生产需求不足，加大了对于资金的需求。未来，随着行业领先企业继续加深与已有芯片设计厂商的合作，有望进一步扩大市场份额，并对新进入者保持技术及规模优势。

②随着显示技术的不断拓展，显示驱动芯片封测向高度集成化发展

近些年来，国家大力推进超高清视频产业及相关领域的发展和应用，4K 和 8K 电视对高动态范围、高色域、高对比度、高光效、高分辨率等方面提出了新的要求，因此发展出了 AMOLED、Mini LED、Micro LED 等新型显示技术。面对新型显示技术，显示驱动芯片要突破尺寸缩小、电流显示均匀性好、芯片输出电流通道间相互串扰小、可靠性高等一系列难题，因此显示驱动芯片的封测需要集成更多数量晶体管以提升芯片性能，而且还需要将多个功能模块封装在同一个芯片里从而实现多功能集成，整体显示驱动芯片的封测向高度集成化发展。

6、公司的科技成果与产业深度融合情况

截至本招股说明书签署日，公司已取得授权专利 259 项。公司在坚持以自主创新驱动发展的过程中，掌握了微间距驱动芯片凸块制造等多项核心技术，积累了较多的非专利核心技术与自主知识产权，形成了自身在显示驱动芯片封装测试领域的竞争优势。公司核心技术在提高产品技术水平、生产效率和产品良率等方

面效果显著。公司已经构建了显示驱动芯片封装测试全流程生产线，并持续致力于在现有技术和设备的基础上进行新领域、新产品的开拓。

凭借深厚的科技成果积累，公司已成为国内领先的显示驱动芯片封装测试厂商，实现了科技成果与产业的深度融合。目前公司所封装测试的显示驱动芯片被广泛应用于智能手机、智能穿戴、高清电视、笔记本电脑、平板电脑等各类终端产品中。公司正在逐步实现显示驱动芯片封装测试领域的进口替代，有效提高了中国大陆在该行业的自主产研水平。

（四）公司产品的市场地位和技术水平

1、公司产品的市场地位

公司是中国境内最早具备金凸块制造能力，及最早导入 12 吋晶圆金凸块产线并实现量产的显示驱动芯片先进封测企业之一，具备 8 吋及 12 吋晶圆全制程封装测试能力。

随着合肥生产基地产能及产能利用率的稳步提升，公司封测出货量持续扩大，市场占有率逐步提高。根据 Frost & Sullivan 统计，2020 年全球显示驱动芯片出货量约 165.40 亿颗，中国大陆显示驱动芯片出货量约 52.70 亿颗。公司在 2020 年所封测显示驱动芯片出货量为 8.28 亿颗，据此测算，公司在显示驱动芯片封测领域全球市场占有率约为 5.01%，在中国大陆市场占有率约为 15.71%。公司 2020 年度显示驱动芯片封装出货量在全球显示驱动芯片封测行业排名第三、在中国境内排名第一。

基于产品质量以及交付速度等因素，公司积累了优质的客户资源，包括联咏科技、天钰科技、瑞鼎科技、奇景光电等知名芯片设计企业，公司产品服务质量已得到行业客户的高度认可。2020 年度全球排名前五显示驱动芯片设计公司中三家系公司主要客户，2020 年度中国排名前十显示驱动芯片设计公司中九家系公司主要客户。

2、公司产品的技术水平及特点

公司自创立以来始终坚持以技术创新为核心驱动力，致力于先进封装技术的研究与应用，深耕显示驱动芯片封装测试领域多年，在研发活动与生产制造过程

中积累了大量非专利核心工艺与众多拥有自主知识产权的核心技术，在行业中具有领先地位。公司在高端先进封装领域拥有微间距驱动芯片凸块制造技术、高精度晶圆研磨薄化技术、高稳定性晶圆切割技术、高精度高效内引脚接合工艺、晶圆高精度稳定性测试技术等多项较为突出的先进技术与优势工艺，该部分技术在行业内处于发展的前沿，拥有较高的技术壁垒。

公司所掌握的凸块制造技术（Bumping）是高端先进封装的代表性技术之一，通过光刻与电镀环节在芯片表面制作金属凸块提供芯片电气互连的“点”接口，实现了封装领域以“以点代线”的技术跨越。公司目前在显示驱动芯片领域中应用的金凸块制造工艺可在单颗长约30mm、宽约1mm芯片上生成4,000余金凸块，在12吋晶圆上生成900万余金凸块，可实现金凸块宽度与间距最小至6 μm ，并且把整体高度在15 μm 以下的数百万金凸块高度差控制在2.5 μm 以内。公司通过凸块制造“以点代线”的技术创新，以几何倍数提高了单颗芯片引脚数的物理上限，进而大幅提高了芯片封装的集成度、缩小了模组体积。

公司一直专注于高端先进封装技术，主要封装工艺为玻璃覆晶封装（COG）和薄膜覆晶封装（COF），应用于显示驱动芯片封测领域，两者均使用高密度、细间距的倒装凸点互连芯片封装技术。公司上述工艺基于前沿的倒装芯片（FC）封装技术，结合自身生产工艺与设备进行优化，所封测的产品拥有I/O密度高、尺寸小、运算速度快、可靠性高和经济性佳等优势。公司研发的高精度晶圆研磨薄化技术可微量控制0.1 μm 等级的抛磨技术；提出的晶圆研磨前裂片异常处理方法可有效避免晶圆材料的浪费并保障产品良率；拥有的高精度高效内引脚接合工艺结合了高精度高可靠的芯片识别与挑拣、微米级的凸块定位与键合等技术，可实现单颗芯片上数以千计的金凸块与柔性基板上对应的内引脚精准、高效键合。

截至本招股说明书签署日，公司拥有259项专利和2项软件著作权，其中发明专利15项。自成立以来，公司对显示驱动芯片封装测试领域核心技术的发展持续关注并深入研究开发，通过不断加大技术研究和产品开发投入力度，对公司的工艺流程和产品技术不断进行改进和创新，公司的技术水平在行业中处于领先地位。

（五）行业内主要企业情况

随着技术的创新发展，集成电路封装测试行业日益精细化，衍生出众多细分领域，公司目前聚焦于显示驱动芯片封测领域。在整个集成电路封测行业，主要公司有日月光、Amkor、长电科技、通富微电、华天科技、晶方科技、利扬芯片与气派科技等，其中，长电科技、通富微电、华天科技产品线横跨封测行业多个细分领域，晶方科技专注于 CMOS 图像传感器的封装和测试，利扬芯片专注于集成电路测试领域，气派科技系华南地区规模最大的内资集成电路封装测试企业之一。在细分行业显示驱动芯片封测领域，主要的公司有硕邦科技、南茂科技、汇成股份及硕中科技等，其中，硕邦科技和南茂科技均为中国台湾上市公司；硕中科技原为硕邦科技境内子公司，后被境内其他股东收购。

1、境外企业

全球封装测试行业的集中度较高，根据 Frost & Sullivan 数据统计，2020 年全球前十大封装测试企业销售额占全球销售额比例高达 84.00%。

（1）日月光（3711.TW/ASX.N）

日月光集团总部位于中国台湾，成立于 1984 年，于 1989 年在台湾证券交易所上市，后并购了福雷电子、摩托罗拉封测业务，并收购 ISE Labs 70% 的股权，2000 年在美国纳斯达克证券交易所上市，2003 年起成为全球第一大集成电路封装测试公司。日月光提供的服务包括晶圆前段测试、晶圆针测至后段封装及成品测试的统包服务。目前，日月光集团在上海市、苏州市、昆山市和威海市设有半导体封装、测试、材料、电子厂。2020 年营业收入为 47,697,871.00 万新台币。

（2）Amkor（AMKR.O）

Amkor（安靠科技）总部位于美国宾夕法尼亚州，成立于 1968 年，于 1998 年在美国纳斯达克证券交易所上市，是封装测试业务外包的领先公司。Amkor 先后收购了 AMD 半导体工厂、Citizen Watch 的半导体组装业务、IBM 在上海的半导体工厂以及在新加坡、日本、欧洲等地的封测厂商，用于发展其封测业务，并借此将业务扩展至中国、菲律宾、新加坡、日本等多个国家。2020 年营业收入为 505,058.90 万美元。

（3）颀邦科技（6147.TWO）

颀邦科技总部位于中国台湾，成立于1997年，于2002年在台湾证券交易所上市，为半导体凸块制造专业厂商，是全球最大规模的驱动芯片封装测试代工厂，主要提供凸块的制造销售并提供后段的卷带式软板封装（TCP）、卷带式薄膜覆晶封装（COF）、玻璃覆晶封装（COG）等服务，主要应用于LCD驱动芯片。目前也在合肥、苏州等大陆地区投资建厂。2020年营业收入为2,227,528.40万新台币。

（4）南茂科技（8150.TW）

南茂科技总部位于中国台湾，成立于1997年，于2013年在台湾证券交易所上市，是在半导体封装测试中具有领先地位的公司，主要提供高密度高层次的记忆体半导体、逻辑产品与混合信号产品的封装测试及后段的加工、配货服务，其中显示驱动芯片的封装测试产能位居全球第二。产品主要应用于计算机、通讯设备、办公室自动化以及消费电子等领域。2020年营业收入为2,301,138.10万新台币。

2、境内企业

境内封装测试企业是境内集成电路行业的重要主体之一，在世界上拥有较强的竞争力，以长电科技、通富微电、华天科技为代表的龙头企业名列全球前十名。除第一梯队外，境内也涌现出一批专业的封装测试企业。

（1）长电科技（600584.SH）

长电科技成立于1998年，于2003年在上海证券交易所上市，为境内第一大集成电路封装测试公司。长电科技在2015年并购了新加坡封装测试厂商星科金朋，使其营收规模在当年一跃成为全球第三，自此一直保持着境内龙头地位。长电科技主要提供微系统集成封装测试一站式服务，包含集成电路的设计与特性仿真、晶圆中道封装及测试、系统级封装及测试服务。产品技术主要应用于5G通讯网络、智能移动终端、汽车电子、大数据中心与存储、人工智能与工业自动化控制等电子整机和智能化领域。2020年营业收入为2,646,399.45万元。

（2）通富微电（002156.SZ）

通富微电成立于 1997 年，于 2007 年在深圳证券交易所上市，是专业从事集成电路封装测试的公司，其通过对 AMD 持有的苏州、槟城两厂的收购，将两厂先进的倒装芯片封测技术和原有技术进行优势互补，自此跃升为境内前三大封装测试企业。通富微电拥有 Bumping、WLCSP、FC、BGA、SiP 等先进封测技术，QFN、QFP、SO 等传统封测技术，以及圆片测试、系统测试等测试技术。2020 年营业收入为 1,076,870.00 万元。

（3）华天科技（002185.SZ）

华天科技成立于 2003 年，于 2007 年在深圳证券交易所上市，主要从事半导体集成电路、MEMS 传感器、半导体元器件的封装测试业务，包括封装设计、封装仿真、引线框封装、基板封装、晶圆级封装、晶圆测试及功能测试、物流配送等一站式服务。产品主要应用于计算机、网络通讯、消费电子及智能移动终端、物联网、工业自动化控制、汽车电子等电子整机和智能化领域。2020 年营业收入为 838,208.42 万元。

（4）晶方科技（603005.SH）

晶方科技成立于 2005 年，于 2014 年在上海证券交易所上市，主要针对 CMOS 图像传感器提供晶圆级封装服务，晶方科技投资了 TSV 技术，并开发出完整的晶圆级 CSP 封装工艺，为 2.5D 和 3D 先进封装的需求提供解决方案。产品主要应用于移动安全、汽车影像、运动传感等领域。2020 年营业收入为 110,352.88 万元。

（5）利扬芯片（688135.SH）

利扬芯片成立于 2010 年，于 2020 年在上海证券交易所科创板上市，是国内独立第三方集成电路测试技术服务商，主营业务包括集成电路测试方案开发、8 吋及 12 吋等晶圆测试服务、芯片成品测试服务以及与集成电路测试相关的配套服务。产品主要应用于通讯设备、计算机、消费电子、汽车电子及工业控制等领域。2020 年营业收入为 25,282.54 万元。

（6）气派科技（688216.SH）

气派科技成立于 2006 年，于 2021 年在上海证券交易所科创板上市，一直从

事集成电路的封装、测试业务，主营业务包括芯片封装测试和自购芯片封装测试。产品主要应用于消费电子领域、信息通讯、智能家居、物联网、汽车电子、工业应用等领域。2020 年营业收入为 54,800.45 万元。

（7） 颀中科技

颀中科技（苏州）有限公司成立于 2004 年 6 月，主要从事大规模集成电路产品和半导体专业材料的开发、生产、封装和测试，销售所生产的产品并提供售后服务，是国内驱动芯片封装测试主要服务商之一。

（六） 公司的竞争优势及劣势

1、 竞争优势

（1） 领先的技术研发优势

显示驱动芯片封测行业属于技术密集型行业，公司所应用的封测技术均属于高端先进封装形式。公司拥有微间距驱动芯片凸块制造技术、高精度晶圆研磨薄化技术、高稳定性晶圆切割技术、高精度高效内引脚接合工艺等多项较为突出的先进技术与优势工艺，该部分技术在行业内处于发展的前沿，拥有较高的技术壁垒。

公司所掌握的凸块制造技术（Bumping）是高端先进封装的代表性技术之一，通过凸块制造“以点代线”的技术创新，以几何倍数提高了单颗芯片引脚数的物理上限，进而大幅提高了芯片封装的集成度、缩小了模组体积。公司封装工艺中的玻璃覆晶封装（COG）和薄膜覆晶封装（COF）均使用高密度、细间距的倒装凸点互连芯片封装技术。上述工艺基于前沿的倒装芯片（FC）封装技术，结合自身生产工艺与设备进行优化，所封测的产品拥有 I/O 密度高、尺寸小、运算速度快、可靠性高和经济性佳等优势。

公司在研发活动与生产制造过程中积累了大量非专利核心工艺与众多拥有自主知识产权的核心技术，截至本招股说明书签署日，公司拥有已授权专利 259 项，其中发明专利 15 项、实用新型专利 244 项，在显示驱动芯片封装测试领域奠定了坚实的技术基础。

（2）专业的管理团队优势

公司拥有专业的管理团队，部分核心管理成员曾供职于显示驱动芯片封装测试领域的龙头企业，具备超过 15 年的技术研发或管理经验，具备行业内领先企业的发展视野。公司管理团队对于整个行业的发展以及公司的定位有着较为深刻的认识，是一支经验丰富、结构合理、优势互补的核心团队，为持续提升公司核心竞争力和开发新工艺提供了强有力的人力资源支持。

封测行业客户需求较为多样化，不同的产品需求往往需要不同的生产工艺、技术及管理队伍相匹配，这对封装企业的生产组织能力和质量管理提出了严格的要求。在公司专业管理团队的带领下，公司致力于持续提升生产管理水平、强化质量管理，已具备业内领先的产品品质管控能力，所封装产品具有集成度高、稳定性强、体积轻薄等客户需求的品质，产品良率高达 99.90% 以上，得到行业客户的高度认可。

（3）全流程统包生产优势

公司在显示驱动芯片封装测试领域具有领先地位，是中国大陆少数同时拥有 8 吋和 12 吋产线的显示驱动芯片全流程封测企业，业务覆盖了金凸块制造、晶圆测试、玻璃覆晶封装和薄膜覆晶封装完整四段工艺制程，是全球少数可以实现显示驱动芯片封装测试服务一体化的企业。公司提供的全流程服务有效提高了生产效率、缩短了交付周期、降低了生产成本，并且避免了晶圆测试与封装流程中间长距离周转而导致晶圆被污染的风险。

（4）知名客户的资源优势

显示驱动芯片的封装测试厂商需要经过芯片设计公司较长时间的工艺认可，而后才能达成长期合作意向，故存在较高的供应链门槛。凭借稳定的封测良率、灵活的封装设计实现性、生产一体化、不断提升的量产能力、交付及时性等，公司获得了行业内知名客户的广泛认可，已经建立了较强的资源优势。

自成立以来，公司与联咏科技、天钰科技、瑞鼎科技、奇景光电、晶门半导体等行业内知名芯片设计公司建立了稳定的合作关系，其中公司分别于 2020 年和 2021 年上半年获得联咏科技颁发的“最佳配合供应商奖”和“最佳品质供应

商奖”，公司所封测芯片已主要应用于京东方、友达光电等知名厂商的面板，2020年度全球排名前五显示驱动芯片设计公司中三家系公司主要客户，2020年度中国排名前十显示驱动芯片设计公司中九家系公司主要客户，深厚的客户资源将为公司的长期发展带来源源动力。

（5）地理与产业集群优势

公司位于中国集成电路产业中心城市合肥，合肥系“一带一路”和长江经济带战略双节点城市，也是长三角区域经济一体化重要城市。合肥市具有良好的产业基础和经营环境，政府大力推进集成电路产业的集群发展，着力打造以合肥为核心的“一核一弧”的集成电路产业空间分布格局。此外，长三角地区是我国集成电路产业集中度最高、产业链最完整、制造水平最高的区域，具有较为显著的范围经济效益，公司立足长三角有利于更贴近客户和原辅材料供应商，产生协同作用。

公司总部位于合肥市综合保税区，目前合肥的集成电路产业已初具规模，产业链上下游从芯片设计、晶圆制造、封装测试到配套材料设备或产成品应用等方面的企业已相对完整，公司上下游企业如晶合集成、京东方、维信诺等均落户合肥或建厂，因而公司深入产业集群之中，可以有效节省运输时间与成本，提高生产响应速度以加快产品交付，缩短供应链周期，有利于享受集成电路产业集群红利。

（6）持续扩大的规模优势

显示驱动芯片设计公司选择长期合作伙伴时，着重考虑封装测试厂商是否具备足够的产能规模，是否具备大批量、高品质供货的能力。公司随着合肥生产基地产能及产能利用率的稳步提升，出货规模持续扩大。2020年度，公司显示驱动芯片封装出货量在全球显示驱动芯片封测领域排名第三，在中国境内排名第一，具有较强的市场竞争力。同时，公司仍在持续购置先进生产设备进行产能扩充，将继续利用规模优势来巩固和提高在全球行业内的竞争地位。

2、竞争劣势

（1）融资渠道单一，运营资金不足

一方面，集成电路先进封装测试领域对技术要求高，公司为保有市场竞争力，需要不断提高研发实力，聘请技术人才，引进并升级研发设备，推动形成创新成果，因而需要大量资金投入研发活动。另一方面，公司正处于成长期，需要采购大量先进生产设备来扩大产能，且此类设备价格昂贵，成本较高。报告期内，公司尚未进入大规模盈利阶段，存在一定规模的累计未弥补亏损，外部融资渠道较为单一，融资能力和规模有限，导致公司运营资金不足。

（2）封测芯片种类单一

不同于长电科技、通富微电、华天科技等封测龙头企业，其产品涵盖了分立器件、传感器、CPU、电源管理芯片等多个领域，公司则专注于显示驱动芯片领域的先进封装测试业务，因而所封测产品较为单一。但公司在该细分领域内保持着较为领先的地位，并且公司未来将向集成电路封测行业其他细分领域拓展，以进一步提高竞争力。

（七）行业发展态势及面临的机遇与挑战

1、行业发展态势及面临的机遇

（1）各级政府的支持性政策推动集成电路行业快速发展

集成电路产业是信息产业的核心，是引领新一轮科技革命和产业变革的关键力量，近年来我国政府已把集成电路产业上升至国家战略高度，并连续出台了一系列产业政策。如 2020 年 8 月，国务院发布《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》，旨在进一步优化集成电路产业发展环境，深化产业国际合作，提升产业创新能力和发展质量。2021 年 3 月，全国人大发布《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》，提出强化国家战略科技力量，瞄准集成电路等前沿领域，实施一批具有前瞻性、战略性的国家重大科技项目。2018 年 12 月，《安徽省半导体产业发展规划（2018-2021 年）》，提出要提升封装测试业层次，依托长电科技、通富微电、新汇成等企业，大力发展凸块（Bumping）、倒装（Flip Chip）等先进封装技术。

国家及地方产业政策的大力支持，为推动我国集成电路产业快速、健康、有序发展奠定了坚实的基础，也为国内集成电路技术水平提升并达到或赶超国外技

术水平提供了良好的政策环境。

（2）显示面板产业链向国内转移推动显示驱动芯片行业发展

早年，我国显示面板产业曾面临“缺芯少屏”的局面。如今，随着京东方、华星光电、维信诺、惠科股份、深天马等本土面板厂的迅速发展，中国大陆的显示面板生产厂商正在逐渐解决“少屏”的问题，中国制造的显示屏在全球范围市场内占有率迅速增长，技术上加速赶超韩国及日本等传统强国。因此，显示驱动芯片设计公司在考虑到面板厂商的国内转移情况将会优选具备地缘优势的封测厂商，降低交通运输成本以及保证及时的沟通服务，显示面板产业链向国内转移有利于显示驱动芯片整体行业发展。

（3）中国大陆芯片设计公司逐渐成熟给本土封测厂商提供更多合作机会

由于中国大陆芯片设计行业发展较晚，显示驱动芯片设计厂商主要集中于中国台湾地区。而封测行业又遵循“就近原则”，就近晶圆制造代工厂，对显示驱动芯片设计公司而言可以缩短从晶圆制造厂到封装测试厂的交付周期、降低生产运输成本和晶圆污损风险。如今，随着集创北方、格科微、芯颖科技为代表的芯片设计厂商不断成长，中芯国际、华虹集团、晶合集成等大陆晶圆制造代工厂商持续发展，中国大陆逐渐具备比肩中国台湾地区芯片设计能力与晶圆代工能力。因此，中国大陆芯片设计公司的逐渐成熟将为本土封测厂商提供更多合作机会，增强封测厂商的竞争力。

（4）晶圆产能紧缺，带来新一轮芯片价格上升行情，封装测试市场发展前景广阔

随着全球晶圆产能紧张，集成电路行业迎来新一轮的上升周期，作为行业下游封测细分市场的显示驱动芯片封测厂商也因此受益。持续上涨的封测价格为企业带来了较高的毛利，减轻了前期投资所需带来的资金压力，加速了企业资金的回笼。未来，从需求端来看，依然将有新增的面板产能释放，对于显示驱动芯片的需求持续走高。从供应端来看，晶圆制造代工厂虽然一直有新建产能投产，但多数都还未能实现量产，预计全球晶圆产能紧张的情况将会持续较长一段时间。显示驱动芯片的产量不足，将持续推高驱动芯片的销售价格，显示驱动芯片封测

市场规模也将随之上涨。

2、面临的挑战

（1）生产设备及原材料进口受限

《实体清单》和《瓦森纳协定》等海外政府限制条款，旨在阻碍中国正在崛起的集成电路产业，尽管长远来看，对于自主研发的国产企业是利好，但短期内限制了我国集成电路行业的发展。当前，我国集成电路支撑性产业发展相对滞后，重要设备、原材料等自给率较低，如集成电路封装测试所需的测试机、晶圆自动光学检测机等设备和金属靶材、电镀液等原材料主要从日本等地进口，海外政府的制裁使得我国在上游原材料、核心元器件的获取以及中游制造技术方面在一定程度上遭到限制，核心部分更是几乎断绝了进口的可能，这对我国的集成电路制造行业短期来看有重大影响，也一定程度上波及显示驱动芯片封测行业。

（2）下游应用产品更新迭代速度快

基于消费需求的多样化，下游应用的新产品层出不穷，如智能手机的产品版本更新速度很快，产品性能上的提升要求芯片功能随之改进，对封装技术的要求也逐步提高。集成电路封装测试行业竞争激烈，先进封装形式多样，如果公司未来在研发能力、成本管控方面不能保持良好的竞争力，可能在未来的竞争中处于不利地位。

（八）公司与同行业可比公司的比较情况

1、经营情况等财务指标对比

综合考虑行业属性、封测产品种类、技术路径、经营规模、财务数据可比性等因素，基于全面性和可比性原则，公司选取了通富微电、晶方科技、利扬芯片和气派科技 4 家同行业可比 A 股上市公司进行经营情况等财务指标对比，同时增加 2 家中国台湾上市公司硕邦科技、南茂科技进行业务方面对比。经营情况等财务指标对比详见本招股说明书“第八节 财务会计信息与管理层分析”。

2、主要关键业务情况对比

（1）封装形式比较

集成电路的封装形式多样复杂，结合行业分类惯例，公司的 Bumping、COG、COF 均为高端先进封装形式。公司及同行业可比公司的封装形式具体对比如下：

项目	公司名称	封装技术分类	产品封装形式
同行业可比 A 股上市公司	通富微电	传统封装	QFP、SOT、TO、DIP、QFN 等系列
		中端先进封装	BGA 等系列
		高端先进封装	Bumping、WLCSP、FC、SiP、FC-BGA 等系列
	晶方科技	高端先进封装	WLCSP
	利扬芯片	专业的集成电路测试企业，不涉及封装业务	
	气派科技	传统封装	DIP、SOP、SOT、CPC、QFP、DFN/QFN 等系列
		中端先进封装	BGA 等系列
高端先进封装		FC 系列	
境外上市公司	颀邦科技	高端先进封装	TCP、FC、Bumping、WLCSP 等系列
	南茂科技	传统封装	SOP、DFN/QFN 等系列
		中端先进封装	BGA 等系列
		高端先进封装	TCP、FC、Bumping、WLCSP 等系列
发行人	高端先进封装	Bumping、FC（COG、COF）等系列	

数据来源：同行业公司公开披露的年度报告或招股说明书。

（2）封测性能比较

①行业规范 JEDEC 标准

集成电路封装测试行业共同遵照统一的行业规范 JEDEC 标准，客户普遍采用该标准对封测厂商进行评估和认证。相关的考核项目有恒温恒湿试验、高压蒸煮试验、高温贮存试验、冷热冲击试验、低温贮存试验等，公司通过了全部考核标准，并在部分考核项目中超过标准条件或达到最高考核条件，产品性能达成行业先进水平。具体考核结果如下：

考核项目	考核条件	参考标准	发行人考核结果
恒温恒湿试验	在温度 85℃、湿度 85% 的条件下试验 500 小时	JESD22-A101	超过标准要求，最高可试验 1,000 小时
高压蒸煮试验	在温度 121℃、湿度 100%、2 个标准大气压的条件下试验 96 小时	JESD22-A102	超过标准要求，最高可试验 168 小时
高温贮存试验	在温度 150℃ 条件下试验 500 小时	JESD22-A103	超过标准要求，最高可试验 1,000 小时
冷热冲击试验	在 -65℃~150℃ 温度条件下循环 500 次	JESD22-A104	超过标准要求，最高可循环 1,000 次
低温贮存试验	在温度 -65℃ 条件下试验 500 小时	JESD22-A119	超过标准要求，最高可试验 1,000 小时

②制程工艺水平

公司深耕显示驱动芯片封装测试领域多年，在长期的自主研发以及生产实践过程中，积累了大量非专利核心工艺与众多拥有自主知识产权的核心技术，在行业内中具有领先地位。公司在高端先进封装领域拥有多项较为突出的先进技术与优势工艺。

公司所掌握的凸块制造技术（Bumping）是高端先进封装的代表性技术之一，实现了封装领域以“以点代线”的技术跨越。公司目前在显示驱动芯片领域中应用的金凸块制造工艺可在单颗长约 30mm、宽约 1mm 芯片上生成 4,000 余金凸块，在 12 吋晶圆上生成 900 万余金凸块，可实现金凸块宽度与间距最小至 6 μ m，并且把整体高度在 15 μ m 以下的数百万金凸块高度差控制在 2.5 μ m 以内，上述技术指标达到行业领先水平。

公司玻璃覆晶封装（COG）和薄膜覆晶封装（COF）工艺均使用高密度、细间距的倒装凸点互连芯片封装技术，上述工艺基于前沿的倒装芯片（FC）封装技术，结合自身生产工艺与设备进行优化，可微量控制 0.1 μ m 等级的抛磨技术，可通过微米级的凸块定位与键合等技术，实现单颗芯片上数以千计的金凸块与柔性基板上对应的内引脚精准、高效键合。

综合考虑国际标准、行业技术指标等因素，公司 Bumping、COG、COF 等工序性能指标均达到行业领先或行业先进水平。

三、发行人销售情况和主要客户

（一）主要产品的产能、产量、销量及产能利用率情况

公司测试服务可分为两类：第一类为封测全流程统包服务，即封测一体，完成封装和测试整个流程；第二类为产品单独测试，即仅进行测试服务。公司非独立的测试企业，核心业务为封装服务且绝大部分产品均为封测一体，因此通过分析金凸块制造及封装产品数量来体现公司的产销情况。

报告期内，公司金凸块制造及封装的产能利用率、产销率情况如下：

项目		2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度	
Gold Bumping	8吋	产能（万片）	22.19	45.26	47.94	46.75
		产量（万片）	17.63	36.38	35.23	36.51
		销量（万片）	17.33	37.00	38.17	34.57
		产能利用率	79.45%	80.38%	73.49%	78.10%
		产销率	98.30%	101.70%	108.35%	94.69%
	12吋	产能（万片）	9.90	19.79	14.30	8.25
		产量（万片）	8.10	9.90	4.62	1.63
		销量（万片）	7.39	9.92	4.08	1.36
		产能利用率	81.82%	50.03%	32.31%	19.76%
		产销率	91.23%	100.20%	88.31%	83.44%
COG	产能（千颗）	420,076.21	891,849.92	817,537.20	659,979.10	
	产量（千颗）	319,102.14	605,679.10	546,647.24	509,149.17	
	销量（千颗）	322,634.74	606,819.32	578,683.42	498,203.25	
	产能利用率	75.96%	67.91%	66.87%	77.15%	
	产销率	101.11%	100.19%	105.86%	97.85%	
COF	产能（千颗）	166,377.13	295,981.68	205,056.48	98,819.66	
	产量（千颗）	138,691.82	215,476.62	128,974.57	79,027.87	
	销量（千颗）	131,890.21	221,276.48	119,987.12	77,984.25	
	产能利用率	83.36%	72.80%	62.90%	79.97%	
	产销率	95.10%	102.69%	93.03%	98.68%	

注1：制程i年度产能=∑（第j月（日工作时间÷设备k标准产出时间×设备k标准产出数量×设备k利用率×月工作日），i属于I，I包括Gold Bumping、COG、COF等主要制程；

j=1, 2, 3……12；公司各制程产能由各设备协同作用决定，k为制程i重要生产设备；

注2：制程i当期产能利用率=产量/产能；

注3：制程i当期产销率=产量/销量。

（二）主要产品销售情况

1、主营业务收入按产品类别分析

报告期内，公司主营业务收入均来自于对显示驱动芯片的封装测试，具体情况如下：

单位：万元

封测芯片种类	2021年1-6月		2020年度		2019年度		2018年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
显示驱动芯片	34,987.81	100.00%	57,504.79	100.00%	37,001.73	100.00%	26,796.12	100.00%
合计	34,987.81	100.00%	57,504.79	100.00%	37,001.73	100.00%	26,796.12	100.00%

公司对客供晶圆在完成客户约定的工艺制程并交付后确认收入。其中，主营业务收入若按工艺制程划分，可分属于金凸块制造、晶圆测试、玻璃覆晶封装与薄膜覆晶封装，具体情况如下：

单位：万元

工艺制程	2021年1-6月		2020年度	
	金额	占比	金额	占比
Gold Bumping	15,743.29	45.00%	26,951.88	46.87%
CP	8,273.71	23.65%	12,151.01	21.13%
COG	4,389.39	12.55%	6,967.70	12.12%
COF	6,581.42	18.81%	11,434.20	19.88%
合计	34,987.81	100.00%	57,504.79	100.00%
工艺制程	2019年度		2018年度	
	金额	占比	金额	占比
Gold Bumping	18,898.10	51.07%	14,294.14	53.34%
CP	6,732.71	18.20%	4,627.74	17.27%
COG	5,540.64	14.97%	4,206.04	15.70%
COF	5,830.27	15.76%	3,668.20	13.69%
合计	37,001.73	100.00%	26,796.12	100.00%

2、主营业务收入按境内外分析

报告期内，公司主营业务收入按客户归属地统计境内外收入情况如下：

单位：万元

区域	2021年1-6月		2020年度		2019年度		2018年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
境内	8,620.74	24.64%	16,466.00	28.63%	9,832.91	26.57%	8,883.91	33.15%
境外	26,367.07	75.36%	41,038.80	71.37%	27,168.81	73.43%	17,912.21	66.85%
合计	34,987.81	100.00%	57,504.79	100.00%	37,001.73	100.00%	26,796.12	100.00%

注：境内外划分以直接交易客户注册地址的境内外归属作为标准。

（三）主要产品销售价格情况

报告期内，公司主要提供显示驱动芯片全制程封装测试统包服务，公司会与客户在每个工艺制程约定服务价格，对客户晶圆在完成客户约定的工艺制程并交付后确认收入。公司各工艺制程服务价格具体情况如下：

单位：元/片、元/千颗

项目		2021年1-6月		2020年度		2019年度		2018年度
		单价	变动比例	单价	变动比例	单价	变动比例	单价
Gold Bumping	8吋	460.34	-0.18%	461.18	15.78%	398.34	5.20%	378.65
	12吋	1,051.04	5.42%	997.02	10.14%	905.25	2.43%	883.74
CP	8吋	205.79	-0.35%	206.52	10.88%	186.25	6.40%	175.04
	12吋	760.16	23.24%	616.83	-12.75%	706.97	-24.60%	937.64
COG		136.05	18.49%	114.82	19.92%	95.75	13.42%	84.42
COF		499.01	-3.43%	516.74	6.34%	485.91	3.30%	470.38

（四）前五大客户销售情况

报告期内，公司向前五大客户主营业务销售情况如下：

单位：万元

2021年1-6月			
序号	客户名称	销售金额	占主营业务收入比例
1	天钰	11,126.05	31.80%
2	联咏科技	8,811.12	25.18%
3	瑞鼎	2,607.64	7.45%
4	奇景光电	2,422.97	6.93%
5	爱协生	1,639.74	4.69%
合计		26,607.52	76.05%

2020 年度			
序号	客户名称	销售金额	占主营业务收入比例
1	天钰	18,845.58	32.77%
2	联咏科技	10,936.10	19.02%
3	奇景光电	6,794.32	11.82%
4	矽创	3,639.47	6.33%
5	瑞鼎	3,608.85	6.28%
合计		43,824.32	76.21%
2019 年度			
序号	客户名称	销售金额	占主营业务收入比例
1	天钰	15,230.98	41.16%
2	矽创	5,185.92	14.02%
3	奇景光电	4,937.44	13.34%
4	瑞鼎	3,162.86	8.55%
5	晶门	1,966.19	5.31%
合计		30,483.40	82.38%
2018 年度			
序号	客户名称	销售金额	占主营业务收入比例
1	天钰	11,982.65	44.72%
2	矽创	3,798.14	14.17%
3	瑞鼎	2,947.17	11.00%
4	晶门	2,567.69	9.58%
5	奇景光电	2,186.86	8.16%
合计		23,482.50	87.63%

注：上表中，客户按照同一控制下合并口径披露：①天钰包括天钰科技股份有限公司、合肥捷达微电子有限公司、深圳天德钰科技股份有限公司；②瑞鼎包括瑞鼎科技股份有限公司、昆山瑞创芯电子有限公司；③爱协生包括深圳市爱协生科技有限公司、马鞍山爱协生科技有限公司、东莞市爱协生智能科技有限公司、焯溢科技（香港）有限公司、华科供应链（香港）有限公司；④矽创包括矽创电子股份有限公司、力领科技股份有限公司；⑤晶门包括晶门科技有限公司、晶门科技（中国）有限公司、东莞晶广半导体有限公司、晶门科技（深圳）有限公司。

报告期内，公司向前五名客户合计销售金额占当期主营业务收入的比例分别为 87.63%、82.38%、76.21%和 76.05%，客户集中度较高，主要受下游知名显示驱动芯片设计公司较为集中所致。公司不存在向单个客户的销售比例超过总额 50%的情况，公司与各年度前五名客户之间不存在关联关系。公司董事、监事、

高级管理人员和核心技术人员，主要关联方或持有公司 5% 以上股份的股东均未在上述客户中占有权益。

四、发行人原材料采购和主要供应商

（一）主要原材料采购情况

报告期内，公司封装测试显示驱动芯片所采购的原材料主要包括含金电镀液、金盐、金靶等含金原料以及 Tray 盘、光刻胶、COG 胶带等，具体情况如下：

单位：万元

类别	2021 年 1-6 月		2020 年度		2019 年度		2018 年度	
	采购金额	占材料采购总额比	采购金额	占材料采购总额比	采购金额	占材料采购总额比	采购金额	占材料采购总额比
含金电镀液	6,846.44	42.17%	12,539.11	48.93%	9,862.68	44.73%	8,392.94	49.31%
金盐	5,404.66	33.29%	5,369.01	20.95%	4,523.62	20.52%	1,738.35	10.21%
金靶	462.67	2.85%	1,741.83	6.80%	1,726.08	7.83%	1,649.66	9.69%
Tray 盘	699.81	4.31%	926.06	3.61%	774.05	3.51%	643.93	3.78%
光刻胶	348.78	2.15%	575.87	2.25%	571.79	2.59%	463.38	2.72%
COG 胶带	269.24	1.66%	549.29	2.14%	463.77	2.10%	388.10	2.28%
总计	14,031.60	86.43%	21,701.16	84.69%	17,921.99	81.28%	13,276.36	78.00%

（二）主要原材料的价格变动情况

报告期内，公司主要原材料的平均采购价格变化情况如下：

类别	2021 年 1-6 月		2020 年度		2019 年度		2018 年度
	平均单价	变动	平均单价	变动	平均单价	变动	平均单价
含金电镀液（元/克）	397.70	-3.45%	411.93	23.36%	333.93	14.09%	292.69
金盐（元/克）	377.53	-2.65%	387.81	21.21%	319.96	23.20%	259.71
金靶（元/克）	321.81	-10.75%	360.56	35.43%	266.23	13.19%	235.21
Tray 盘（元/片）	1.30	15.04%	1.13	14.14%	0.99	5.32%	0.94
光刻胶（元/升）	3,030.84	6.79%	2,838.21	-7.37%	3,063.92	18.14%	2,593.49
COG 胶带（元/米）	24.13	-9.42%	26.64	1.33%	26.29	23.43%	21.30

报告期内，公司主要采购原材料中含金原料（含金电镀液、金盐、金靶）的采购价格变化主要受黄金市场价格影响，与市场价格变动趋势一致。

（三）主要能源供应情况

报告期内，公司主要采购能源为电，具体情况如下：

项目	电能			
	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
用电量（万度）	2,801.85	4,821.29	4,226.79	3,502.37
金额（万元）	1,812.78	3,225.73	2,927.54	2,483.54
平均单价（元/度）	0.65	0.67	0.69	0.71

注：2020年受疫情影响，电力企业对公司予以一定生产补贴，为更实际地反映公司产出与电费金额的匹配性，上表披露的电费金额为公司原缴金额，未剔除电力公司的生产补贴。

报告期内，公司用电量呈逐年增加趋势，主要系显示驱动芯片封装测试量持续增加所致。

（四）前五大原材料供应商采购情况

报告期内，公司向前五大原材料供应商的采购情况如下：

单位：万元

序号	供应商名称	采购金额	占原材料采购总额比例	主要采购内容
2021年1-6月				
1	田中贵金属	6,952.31	42.83%	含金电镀液等
2	光洋	5,867.33	36.14%	金盐、金靶
3	利机股份	480.63	2.96%	Tray 盘
4	怡康化工	271.13	1.67%	光刻胶
5	昇云半导体	245.77	1.51%	COG 胶带
合计		13,817.16	85.11%	-
2020年度				
1	田中贵金属	12,818.20	50.02%	含金电镀液等
2	光洋	7,110.84	27.75%	金盐、金靶
3	利机股份	520.25	2.03%	Tray 盘
4	昇云半导体	493.38	1.93%	COG 胶带
5	怡康化工	361.30	1.41%	光刻胶
合计		21,303.97	83.14%	-
2019年度				

1	田中贵金属	10,203.95	46.28%	含金电镀液等
2	光洋	6,249.70	28.34%	金盐、金靶
3	昇云半导体	413.07	1.87%	COG 胶带
4	怡康化工	381.56	1.73%	光刻胶
5	利机股份	373.33	1.69%	Tray 盘
合计		17,621.61	79.92%	-
2018 年度				
1	田中贵金属	8,662.28	50.89%	含金电镀液等
2	光洋	3,388.01	19.90%	金盐、金靶
3	利机股份	388.00	2.28%	Tray 盘
4	迪思科科技	355.06	2.09%	切割刀片、研磨轮
5	伊藤忠	330.05	1.94%	光刻胶、蚀刻液
合计		13,123.40	77.10%	-

注：上表中，供应商按照同一控制下合并口径披露，光洋包括光洋化学应用材料科技（昆山）有限公司、光洋新材料科技（昆山）有限公司。

报告期内，田中贵金属一直是公司第一大原材料供应商，公司主要向其主要采购含金电镀液用于显示驱动芯片前段的金凸块制造工艺制程。日本田中贵金属集团创立于 1885 年，是全球知名贵金属制造企业，在该领域位居前列，近年来产品在半导体制造等领域亦拥有较高市场占有率。公司与各年度前五名供应商之间不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员，主要关联方或持有本公司 5% 以上股份的股东也未在上述供应商中拥有权益。

五、发行人主要固定资产、无形资产等资源要素

（一）主要固定资产情况

1、固定资产整体情况

截至 2021 年 6 月 30 日，发行人的固定资产主要包括房屋建筑物、通用设备、专用设备、运输工具等，具体情况如下：

单位：万元

固定资产类别	账面原值	累计折旧	账面价值	成新率
房屋及建筑物	34,281.39	8,108.89	26,172.49	76.35%
通用设备	1,415.92	982.09	433.83	30.64%

专用设备	150,800.46	42,115.11	108,685.34	72.07%
运输工具	182.23	125.10	57.14	31.35%
合计	186,679.99	51,331.19	135,348.80	72.50%

2、主要机器设备

截至 2021 年 6 月 30 日，发行人自用的主要生产用机器设备具体如下：

单位：万元

项目	期末原值	累计折旧	账面价值	成新率
测试机	51,936.63	8,466.37	43,470.26	83.70%
探针台	14,262.97	2,341.46	11,921.51	83.58%
晶圆切割机	6,612.91	2,285.17	4,327.73	65.44%
内引脚接合机	6,846.95	1,740.27	5,106.68	74.58%
物理气象沉积设备	5,981.18	2,639.50	3,341.68	55.87%
晶圆自动光学检测机	2,932.87	1,162.24	1,770.63	60.37%
光刻机	2,829.41	1,408.06	1,421.35	50.23%
晶圆电镀机	2,607.50	730.20	1,877.30	72.00%
研磨机	1,895.16	844.71	1,050.45	55.43%
晶粒挑选机	1,310.11	516.17	793.93	60.60%
合计	97,215.67	22,134.15	75,081.52	77.23%

3、房屋建筑物

截至本招股说明书签署日，发行人自有及租赁的房屋建筑物具体情况如下：

（1）房屋所有权

序号	权利人	证书编号	坐落位置	用途	房屋建筑面积 (m ²)	他项权利
1	汇成股份	皖（2021）合不动产权第11223227号	新站区东方大道 1888 号合肥综合保税区项王路 8 号一期厂房新建工程 1 幢厂房 101/201/301	工业	8,225.99	已抵押
2		皖（2021）合不动产权第11223228号	新站区东方大道 1888 号合肥综合保税区项王路 8 号一期新建工程仓库 101/201		1,719.56	
3		皖（2021）合不动产权第11223229号	新站区东方大道 1888 号合肥综合保税区项王路 8 号一期新建工程门卫 101		112.84	
4		皖（2021）合不动产权第11223230号	新站区东方大道 1888 号合肥综合保税区项王路 8 号一期新建工		4,963.16	

			程动力楼-101/101/201				
5		皖（2021）合不动产权第11223231号	新站区东方大道 1888 号合肥综合保税区项王路 8 号一期厂房新建工程 2 幢厂房 101/201			19,393.55	
6	江苏汇成	扬房权证邗江字第 2012015390 号	邗江区兴农路 1 号	1 幢	厂房	5,678.44	已抵押
				2 幢	厂房	19,640.56	
				3 幢	动力楼	3,454.95	
				4 幢	仓库	590.49	
				5 幢	门卫	127.70	

（2）租赁房产

截至本招股说明书签署日，发行人正在租赁的房产情况如下：

序号	承租人	出租人	承租房产坐落	租赁期限	面积（m ² ）	租赁用途	是否备案
1	汇成股份	合肥市住房租赁发展股份有限公司	合肥市新站区龙子湖路 369 号平板显示基地 8#706、709、710、810、902、904、906、907、908 室	2021.01.01-2021.12.31	366.69	员工宿舍	是
2			合肥市新站区龙子湖路 369 号平板显示基地 8#1001、1004、1005、1008、1009、1010 室	2021.01.23-2022.01.22	244.46		是
3			合肥市新站区龙子湖路 369 号平板显示基地 8#1101、1102、1103、1105、1106、1107、1109 室	2021.02.27-2022.02.26	297.79		是
4			合肥市新站区龙子湖路 369 号平板显示基地 8#1206、1207、1209、1210 室	2021.06.15-2022.06.14	156.68		是
5			合肥市新站区龙子湖路 369 号平板显示基地公租房 8#705、707、708、805、807、808 室	2021.05.18-2022.05.17	263.34		是
6			合肥市新站区龙子湖路 369 号平板显示基地公租房 8#701-704、901、905、1002、1003、1006、1203-1205 室	2021.06.25-2022.06.24	526.68		是
7		合肥鑫城	新站区平板基地公租房	2021.09.01-2024.08.31	-	员工宿舍	是
8	江苏汇成	扬州高新技术产业开发区管理委员会	扬州高新区南园生活配套区“青年公寓”二期 17 号公寓 201-216、301-316、401-416 室共 48 间	2021.07.01-2021.12.31	2,640.00	员工宿舍	是

（二）主要无形资产情况

1、土地使用权

截至本招股说明书签署日，发行人已取得土地使用权情况如下：

序号	权利人	证书编号	坐落位置	用途	面积 (m ²)	使用期限至	他项权利
1	汇成股份	皖（2021）合不动产权第11223227号	新站区东方大道1888号合肥综合保税区项王路8号一期厂房新建工程1幢厂房101/201/301	工业用地	26,666.69	2067.3.10	已抵押
2		皖（2021）合不动产权第11223228号	新站区东方大道1888号合肥综合保税区项王路8号一期新建工程仓库101/201				
3		皖（2021）合不动产权第11223229号	新站区东方大道1888号合肥综合保税区项王路8号一期新建工程门卫101				
4		皖（2021）合不动产权第11223230号	新站区东方大道1888号合肥综合保税区项王路8号一期新建工程动力楼-101/101/201				
5		皖（2021）合不动产权第11223231号	新站区东方大道1888号合肥综合保税区项王路8号一期厂房新建工程2幢厂房101/201				
6	江苏汇成	扬邗国用（2012）第2012004号	扬州市邗江区经济开发区南园	工业用地	39,821.00	2062.7.30	已抵押

2、商标

截至本招股说明书签署日，发行人已取得注册商标1项，具体情况如下：

序号	权利人	注册号	商标	核定类别	有效期限	取得方式	他项权利
1	汇成股份	51359090		第9类	2021.08.07-2031.08.06	原始取得	无

3、专利

截至本招股说明书签署日，发行人已拥有259项授权专利，其中发明专利15项，实用新型244项，具体情况请参见本招股说明书“第十三节 附表一：专利”。

4、软件著作权

截至本招股说明书签署日，发行人共拥有 2 项软件著作权，具体情况如下：

序号	著作权人	软件名称	登记号	证书号	首次发表日期	著作权保护期限	取得方式	他项权利
1	汇成股份	缺陷检测结果的考核系统 V1.0	2019SR0156112	软著登字第 3576869 号	2018.05.11	首次发表之日起 50 年	原始取得	无
2	汇成股份	排货系统 V1.0	2020SR0587316	软著登字第 5466012 号	2020.03.17	首次发表之日起 50 年	原始取得	无

注：软件著作权保护期限为首次发表之日起 50 年。

（三）固定资产、无形资产与公司业务的内在联系、以及对公司持续经营的影响

公司固定资产主要为日常生产经营所需的房屋建筑物和主要机器设备，是保证日常生产经营的必要条件。

公司所拥有的主要无形资产与公司业务的内在联系情况，详见招股说明书本节“六、发行人核心技术及研发情况”之“（一）公司的核心技术情况”部分。

截至本招股说明书签署日，公司所拥有的主要固定资产、无形资产，不存在瑕疵、纠纷及潜在纠纷，也不存在对公司持续经营有重大不利影响的情形。

（四）业务许可或资质情况

截至本招股说明书签署日，发行人均已取得业务经营所必需的备案、许可或登记，并且该等备案、许可或登记均在有效期内，具体如下：

1、进出口经营权

（1）对外贸易经营者备案登记

序号	证书名称	证书编号	备案登记日期	持证人
1	对外贸易经营者备案登记表	02361997	2016.09.13	汇成股份
2	对外贸易经营者备案登记表	01827597	2016.08.15	江苏汇成

（2）出入境检验检疫报检企业备案

序号	证书名称	备案号码	备案日期	备案机构	持证人
1	自理报检企业备案登	3218603026	2011.11.21	国家质量监督	江苏汇成

记证明书			检验检疫总局	
------	--	--	--------	--

（3）海关报关单位注册登记

序号	证书名称	海关注册编码	核发日期	注册海关	持证人
1	中华人民共和国海关报关单位注册登记证书	3401660010	2016.09.23	合肥综合保税区	汇成股份
2	中华人民共和国海关报关单位注册登记证书	3210932605	2015.06.23	扬州海关	江苏汇成

注：根据《中华人民共和国海关报关单位注册登记管理规定》（海关总署令第221号）的相关规定，发行人上述证书长期有效。

2、高新技术企业证书

序号	公司	证书名称	证书编号	颁发日期	有效期	颁发单位
1	汇成股份	高新技术企业证书	GR201934001917	2019.11.20	三年	安徽省科学技术厅、财政厅、税务局
2	江苏汇成	高新技术企业证书	GR201832007193	2018.11.30	三年	江苏省科学技术厅、财政厅、税务局

3、管理体系认证

序号	公司	证书名称	编号	认证标准	适用产品或服务	有效期
1	汇成股份	环境管理体系认证	4410414820103-002	ISO 14001:2015	提供晶圆凸块，测试，研磨，切割，筛检与组装服务	2019.8.19-2022.8.18
2	汇成股份	质量管理体系认证	4410015820127-002	ISO 9001:2015	提供晶圆凸块，测试，研磨，切割，筛检与组装服务	2021.9.15-2024.9.14
3	江苏汇成	环境管理体系认证	4410414820103-001	ISO 14001:2015	提供晶圆凸块，测试，研磨，切割，筛检与组装服务	2019.8.19-2022.8.18
4	江苏汇成	质量管理体系认证	4410015820127-001	ISO 9001:2015	提供晶圆凸块，测试，研磨，切割，筛检与组装服务	2021.9.15-2024.9.14

4、排污许可证

序号	公司	证书名称	证书编号	颁发日期	有效期至	颁发单位
1	汇成股份	排污许可证	91340100MA2MRF2E6D001Q	2019.11.18	2022.11.17	合肥市生态环境局
2	江苏	排污许可证	91321000581042	2019.09.20	2022.09.19	扬州市生态

	汇成		566E001U			环境局
--	----	--	----------	--	--	-----

六、发行人核心技术及研发情况

（一）公司的核心技术情况

1、核心技术基本情况

（1）凸块制造与显示驱动芯片封装工艺

公司核心技术主要集中在金凸块制造、玻璃覆晶封装和薄膜覆晶封装等环节。公司基于微间距驱动芯片凸块制造技术等实现了显示驱动芯片的高密度细间距倒装封装。高密度细间距倒装封装是实现显示屏幕全面屏、薄型化和轻量化的关键性技术，极大地促进了下游显示面板市场的发展，在显示面板整体发展中起到重要作用。

公司金凸块制造、玻璃覆晶封装和薄膜覆晶封装的基本情况如下：

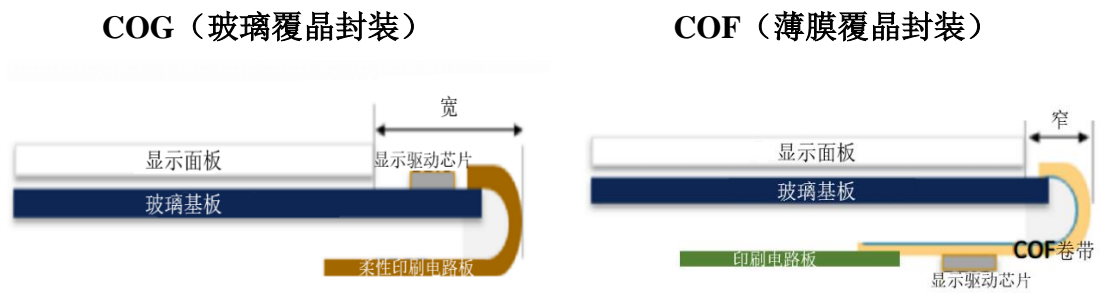
①**金凸块制造（Gold Bumping）**：金凸块制造是一种在晶圆上形成微小的焊球或金柱的制造工艺，为满足凸块侧壁垂直度、表面平整性与强度，以及凸块下金属层（UBM）的粘附性等指标要求，晶圆凸块的制造过程需要物理气相沉积（溅镀）、光刻与电镀工艺的紧密结合。首先基于物理气相沉积技术在晶圆表面形成 UBM，然后利用厚胶光刻技术在晶圆上刻画出凸块线路图，再采用电镀工艺获得一定高度的凸块。相较于传统打线、引脚封装等技术，通过凸块与电路板电气相连可实现更小线宽，大幅减小芯片模组体积，具备高密度、低电阻、低成本、散热能力强等优势。

②**玻璃覆晶封装（COG）**：显示驱动芯片封装工艺的一种，将芯片直接对准玻璃基板上的电极，利用异性导电膜材料作为接合的介面材料，使垂直方向的电极导通。由于玻璃基板不可弯折，因此使用 COG 技术封装的设备面板均保留了一定边框。目前，COG 封装技术主要应用于小尺寸面板，如手机、平板电脑、数码相机等。

③**薄膜覆晶封装（COF）**：显示驱动芯片封装工艺一种，利用 COG 技术的特点，将芯片贴装于卷带上，由于卷带具备可弯折性，因此可实现高密度、高屏

占比、轻薄化。目前，COF 封装技术主要应用于液晶电视和全面屏手机等电子设备，是显示驱动芯片封装中应用最广、发展前景最好的技术之一。

COG 与 COF 封装工艺差异具体如下所示：



（2）公司核心技术来源及研发成果

作为技术密集型企业，自有的技术基础和持续的研发实力是核心竞争力，公司深耕显示驱动芯片封装测试领域多年，在长期的自主研发以及生产实践过程中，积累了大量非专利核心工艺与众多拥有自主知识产权的核心技术，在行业内中具有领先地位。

公司目前主要聚焦于显示驱动芯片领域，申请专利的技术多为显示驱动芯片封装测试过程中某一具体环节技术突破或对某些生产装置的研发改进。对于公司生产研发过程中形成的如驱动芯片可靠性工艺、微间距驱动芯片凸块制造技术、凸块高可靠性结构及工艺、高精度晶圆研磨薄化技术、高精度高效内引脚接合工艺等涉及公司产品重要性能优势的核心技术，公司一方面将部分技术工艺申请专利作为防护措施，另一方面将其他核心工艺与技术要点作为公司专有工艺与技术进行保密管理。

截至本招股说明书签署日，公司自主研发的核心技术及对应主要知识产权情况具体如下：

序号	核心技术名称	来源	涉及的主要专利	工艺类型
1	驱动芯片可靠性工艺	自主研发	多段式液晶面板驱动芯片封装凸块结构（201420706075.7）	生产工艺改进
			两段式液晶面板驱动芯片封装凸块结构（201420706092.0）	生产工艺改进
			驱动 IC 封装凸块及封装结构（201220409071.3）	生产工艺改进
			一种多段式保护层液晶面板驱动芯片封装凸块结构（201620029828.4）	生产工艺改进

序号	核心技术名称	来源	涉及的主要专利	工艺类型
			提高驱动芯片可靠度的电浆源表面处理装置（202020394875.5）	生产装置改进
2	微间距驱动芯片凸块制造技术	自主研发	一种集成电路芯片的金凸块制造工艺（201810431710.8）	生产工艺改进
			一种微间距驱动芯片金凸块结构（201620159958.X）	生产工艺改进
			一种螺旋式光阻涂布结构及其制备装置（201920214825.1）	生产装置改进
			一种对凸块粗糙度改善的电流密度电镀装置（201920363202.0）	生产装置改进
			一种芯片涂胶机的涂胶平台（201420668554.4）	生产装置改进
			一种带漏涂侦测功能的涂胶装置（201920240031.2）	生产装置改进
			一种电镀辅助盐的分析装置（201920363635.6）	生产装置改进
			一种集成电路芯片光阻去除装置（201920494127.1）	生产装置改进
			一种具有防气泡效果的光刻胶缓冲罐（201821921679.8）	生产装置改进
			一种蚀刻槽体中的新型晶舟承载装置（201920359607.7）	生产装置改进
			一种蚀刻制程中的新型铁氟龙治具（201821921713.1）	生产装置改进
3	凸块高可靠性结构及工艺	自主研发	一种半导体晶圆湿法蚀刻装置（201821708415.4）	生产装置改进
			一种对凸块粗糙度改善的电流密度电镀装置（201920363202.0）	生产装置改进
			一种增加输入和输出凸点数量的集成电路芯片（201920161638.1）	生产工艺改进
			一种自动化晶圆转移方法（201811492066.1）	生产工艺改进
			一种减小凸块底切的结构（202020224706.7）	生产工艺改进
			一种缩小凸块底切的结构（202020224822.9）	生产工艺改进
			一种可消除气泡的电镀槽（201821921711.2）	生产装置改进
4	高精度晶圆研磨薄化技术	自主研发	一种晶圆研磨前裂片异常的处理方法（202010434613.1）	生产工艺改进
			一种半导体晶圆减薄装置（201721238327.8）	生产装置改进
			一种晶圆用合框装置（201920038462.0）	生产装置改进
			一种晶圆研磨抛光设备（201920038412.2）	生产装置改进
			一种晶圆贴底膜装置（201920038411.8）	生产装置改进
			一种晶圆合框撕胶装置（201920038280.3）	生产装置改进
			一种晶圆研磨胶膜撕胶用加热型压板（201920121314.5）	生产装置改进
			一种晶圆合框防二次撕胶装置（201920038245.1）	生产装置改进
			一种合框撕胶一体机传感器安全防护装置（202022609235.4）	生产装置改进
			一种晶圆胶膜抽水装置（201822111814.9）	生产装置改进
			一种晶圆撕胶废膜回收装置（202020136736.2）	生产装置改进
			一种研磨机主轴转速传感器保护装置（202021822687.4）	生产装置改进
			一种全自动贴胶机用工作盘装置（202010370518.X）	生产装置改进
			一种外定位框环贴底膜装置（201920038244.7）	生产装置改进

序号	核心技术名称	来源	涉及的主要专利	工艺类型
5	高稳定性晶圆切割技术	自主研发	一种应对真空异常的晶圆切割处理方法（201911051044.6）	生产工艺改进
			一种晶圆的三面切割方法（201910541212.3）	生产工艺改进
			一种半导体晶圆的切割装置（201721238001.5）	生产装置改进
			一种用于对胶膜进行切割的工具（201821718688.7）	生产装置改进
			一种晶圆共用背检平台（201921021380.1）	生产装置改进
			切割机刀片侦测装置（201220668978.1）	生产装置改进
			一种用于切割机进料手臂的吸料装置（201820279791.X）	生产装置改进
			一种切割刀片背面刮痕处理装置（202020859610.8）	生产装置改进
			一种切割机换刀用弹性三角夹具（202020137028.0）	生产装置改进
			一种可移动式晶背切割 IC 滴水检验治具（202021545530.1）	生产装置改进
6	高精度高效内引脚接合工艺	自主研发	一种可降低 Tape Bonding 工艺过程中抖动的机构（202011335523.3）	生产装置改进
			一种内引脚接合机料带标记料位识别机构（202022515538.X）	生产装置改进
			一种内引脚接合机料盘扩张轮机构（202120628338.7）	生产装置改进
			一种内引脚接合机收料端料盘定位组件（202021854314.5）	生产装置改进
			一种改良的内引脚接合机轨道（202120628500.5）	生产装置改进
			一种内引脚接合机放料端防料带粘黏装置（202120747178.8）	生产装置改进
			一种内引脚接合机之导轮机构（202020870268.1）	生产装置改进
			一种内引脚接合机保护带导向机构（202022517124.0）	生产装置改进
			一种内引脚接合机轨道机构（201921614298.X）	生产装置改进
			一种用于内引脚接合机的吸嘴安装座装置（202020338509.8）	生产装置改进
			一种真空吸笔测量仪（201920444253.6）	生产装置改进
			一种吸芯顶针机构（201821447142.2）	生产装置改进
			一种内引脚接合机台颗粒排除装置（202022199948.8）	生产装置改进
			一种基于内引脚接合机用卡锁装置（202020508956.3）	生产装置改进
			一种基于内引脚接合机用拆装方便的黏轮安装装置（202010273698.X）	生产装置改进
			一种内引脚接合机弹簧组件承接保护装置（202022517144.8）	生产装置改进
			一种内引脚接合机急停按钮防误触保护罩（202022658643.9）	生产装置改进
			一种内引脚接合机开关控制箱保护壳装置（202020716295.3）	生产装置改进
			一种新型顶针帽机构（202020332477.0）	生产装置改进
			一种用于内引脚接合机的单排顶针座装置（202020338536.5）	生产装置改进
一种用于内引脚接合机的胡椒罐装置（202020338540.1）	生产装置改进			
一种用于内引脚接合机的双排顶针座装置（202020338528.0）	生产装置改进			
一种内引脚接合机放料机构（201921285137.0）	生产装置改进			
一种内引脚接合机台开关防误触装置（202022543711.7）	生产装置改进			

序号	核心技术名称	来源	涉及的主要专利	工艺类型
7	高精度柔性基板封装工艺中微尘防护技术	自主研发	COF 覆晶结合前柔性电路板及芯片表面微尘清除器（201420008630.9）	生产装置改进
			一种基于内引脚接合机的保护放料端承接板（202020508945.5）	生产装置改进
			覆晶芯片与柔性电路板间的封胶前除尘装置（201420008413.X）	生产装置改进
			一种内引脚接合机传送带用盖板结构（202020870687.5）	生产装置改进
			一种内引脚接合机之轴心保护盖装置（202020870666.3）	生产装置改进
			IC 晶粒防刮伤吸取装置（201420668953.0）	生产装置改进
			一种防 OTP 产品接触紫外线的治具（202021544906.7）	生产装置改进
			一种卷绕机台料带防尘装置（202020872237.X）	生产装置改进
8	晶圆清洁技术	自主研发	洗除氧化钨的洗液及清洗附着有氧化钨生产工具的方法（201810093214.6）	生产工艺改进
			一种干式晶圆自动清洁机（201821688068.3）	生产装置改进
			一种半导体晶圆清洗装置（201721238357.9）	生产装置改进
			一种用于清洁治具的工作桌（201920914554.0）	生产装置改进
9	集成电路封装微尘管理技术	自主研发	一种硅片封装结构（201920223070.1）	生产工艺改进
			一种柔性电路板表面微尘清除器（201310055567.4）	生产装置改进
			一种保护带自动清洁卷绕机（201920492263.7）	生产装置改进
			一种集成电路封测凸块供气管路（201821996488.8）	生产装置改进
			一种料带清洁箱（201921785304.8）	生产装置改进
			一种柔性电路板表面微尘清除器（201320080278.5）	生产装置改进
			一种无尘室专用钻孔加工辅助治具（201921109400.0）	生产装置改进
			一种自动清洁保护带的装置（201921785283.X）	生产装置改进
10	晶圆高精度稳定性测试技术	自主研发	一种 AOI 特殊扫描作业的方法（202011549759.7，专利正在申请中，目前已公告）	生产工艺改进
			晶圆测试探针卡（201210527894.0）	生产装置改进
			一种 Prober 点墨器的新型调节打点稳定装置（202011460367.3）	生产装置改进
			一种半导体晶圆的检测装置（201721238078.2）	生产装置改进
			晶圆测试探针卡（201220676323.9）	生产装置改进
			一种带真空传感器的显微镜（201821922365.X）	生产装置改进
			一种 UV 机灯管照度检测装置（201720080940.5）	生产装置改进
			一种晶圆观察检测装置（201820074444.3）	生产装置改进
			一种厚度量测仪量测治具（201820143581.8）	生产装置改进
			一种晶圆框架平整度检测治具（201821179642.2）	生产装置改进

2、核心技术取得专利情况或其他技术保护措施

（1）申请专利保护

公司为保障核心技术的权属完整与清晰，对研发项目成果的分配都做出了相应的权属分配条款规定，对于通过内部审查的技术发明，会以公司为主体向国家知识产权局申请注册专利。公司专利及核心技术对应专利情况分别参见本招股说明书“第十三节 附表一：专利”和本节“（一）公司的核心技术情况”之“1、核心技术基本情况”之“（2）公司核心技术来源及研发成果”。

（2）员工股权激励

公司为保持技术人员的稳定，防止人员流动导致的技术泄露，制定了一系列员工股权激励计划，股权激励计划的详细情况参见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“十、发行人本次公开发行前制定或实施的股权激励”。

（3）核心技术保密制度

为防范核心技术泄露，公司建立了核心技术保密制度，与主要技术人员均签订了保密协议和竞业禁止协议，约定了研发成果归属、保密义务、竞业限制义务等。

3、核心技术产品收入情况

报告期内，公司核心技术均涉及显示驱动芯片封装测试业务，上述业务实现的销售收入均纳入主营业务收入核算，具体情况如下：

单位：万元

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
核心技术产品收入	34,987.81	57,504.79	37,001.73	26,796.12
营业收入	35,875.90	61,892.67	39,420.66	28,558.35
核心技术产品收入占营业收入比例	97.52%	92.91%	93.86%	93.83%

2018年至2020年，公司核心技术产品的销售数量在细分行业显示驱动芯片封测领域的市场占有率情况如下：

单位：亿颗

期间	主要核心技术产品	销量	中国大陆出货量	全球出货量	市场占有率	
					中国大陆市场	全球市场
2018 年度	显示驱动芯片封装测试	5.76	38.50	146.30	14.97%	3.94%
2019 年度	显示驱动芯片封装测试	6.99	45.80	156.00	15.25%	4.48%
2020 年度	显示驱动芯片封装测试	8.28	52.70	165.40	15.71%	5.01%

注：2018 年至 2020 年中国大陆出货量及全球出货量数据来源于 Frost & Sullivan。

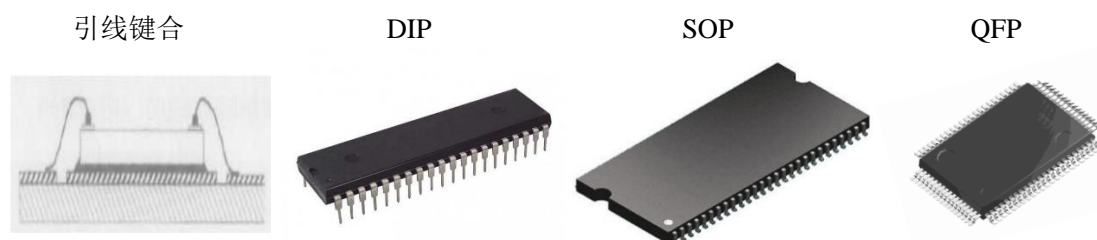
（二）公司技术先进性及具体表征

公司通过核心技术与生产装置协同作用，可实现年封装测试数亿颗显示驱动芯片，同时保证生产良率 99.90% 以上。尤其是公司所掌握的凸块制造技术是高端先进封装的代表性技术之一，通过光刻与电镀环节在芯片表面制作金属凸块，提供芯片电气互连的“点”接口，实现了封装领域以“以点代线”的技术跨越，以几何倍数提高了单颗芯片引脚数的物理上限，进而大幅提高了芯片封装的集成度、缩小了模组体积。

1、凸块制造制程（Bumping）核心技术

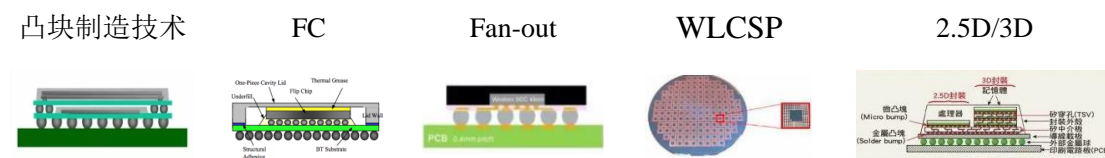
（1）核心技术背景

迄今为止全球集成电路封装技术一共经历了五个发展阶段，第一阶段至第三阶段的封装技术路径主要围绕芯片引线键合连接工艺进行优化，工艺流程主要是将晶圆切割为晶粒后，使晶粒贴合到相应的基板架上，再利用导线将接合焊盘与基板的引脚相连，实现电气连接，最后用外壳加以保护，典型封装方式有 DIP、SOP 和 QFP 等。具体如下图所示：



凸块制造技术作为高端先进封装的代表性技术之一，通过光刻与电镀环节在芯片表面制作金属凸块提供芯片电气互连的“点”接口，实现了封装领域以“以

点代线”的技术跨越。凸块制造技术提供了芯片之间、芯片和基板之间的“点连接”，避免了传统引线键合向四周辐射的金属“线连接”，可以大幅缩小芯片体积，并具低感应、低成本、散热能力优良等优点，此外凸块阵列在芯片表面，引脚密度可以做得很高，便于满足芯片性能提升的需求，广泛应用于 FC、Fan-out、WLCSP、2.5D/3D 等高端先进封装形式中。具体如图所示：



公司所掌握的凸块制造技术中，金凸块制造（Gold Bumping）主要应用于显示驱动芯片封装领域，是一种为适应显示面板驱动的一系列需求而特别设计的封装工艺。金凸块制造技术以黄金作为凸块的材料，具有出色的导电性、机械加工性以及散热性能，可以起到界面之间的电气互联和应力缓冲的作用。公司金凸块制造技术可在单颗长约 30mm、宽约 1mm 芯片上生成 4,000 余金凸块，在 12 吋晶圆上生成 900 万余金凸块，可实现金凸块宽度与间距最小至 6 μm ，并且把整体高度在 15 μm 以下的数百万金凸块高度差控制在 2.5 μm 以内。

公司的金凸块制造主要使用电镀工艺进行生产，按照流程可分为物理气相沉积（溅镀）、光刻（曝光显影）、电镀和蚀刻工艺段，每一段工艺都有其特定的设备，例如光刻主要使用光刻机、光刻胶涂布设备、UV 光源、显影设备，蚀刻主要使用去胶设备、蚀刻设备等。

（2）技术创新

凸块制造技术是影响显示驱动芯片封测厂商发展的最大瓶颈。公司在凸块制造技术方面深耕多年，拥有较为先进、完整的技术框架，并通过对凸块制造技术持续的研究、优化和创新，积累了驱动芯片可靠性工艺、微间距驱动芯片凸块制造技术、凸块高可靠性结构及工艺等先进创新技术，制造出了微间距、细宽度、高可靠的凸块，达到行业领先水平，同时缩短了生产周期，提高了产品良率及交付效率。

①驱动芯片可靠性工艺

在物理气相沉积（溅镀）环节，针对单层钛钨合金保护层，保护层与铝垫、导电层的结合力较差，凸块结合不牢固，导致可靠性不高以及沉积厚度较厚等问题，公司创新研发了多段式钛钨合金保护层溅射沉积技术。该技术通过多段溅射沉积以及改变每层钛钨合金保护层的厚度，改善保护层承受应力的可靠性，增加保护层与铝垫以及导电层的结合力，同时有效阻挡金跟铝形成合金，与单层钛钨合金保护层相比在相同应力下厚度可大幅减少。

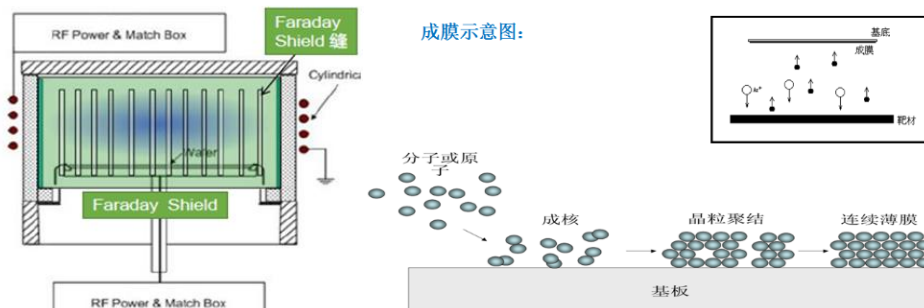
A、晶圆溅镀环节工作原理

金凸块制造的溅镀环节分为预置清洁、物理气相沉积溅镀钛钨靶（TIW）及金靶（AU）等步骤。

在预置清洁阶段，预清洗腔分别采用了两种特定频率的射频电源生成等离子体源，以及形成一个负偏压用来提高氩离子的轰击能量，其中等离子体由线圈产生的电磁场穿透法拉第盾缝（Faraday Shield）激发。

物理气相沉积（溅镀）指在真空条件下将材料汽化成原子、分子或使其电离成离子，并通过气相过程，在材料表面沉积一层具有某些特殊性能的薄膜，其是由原子、分子或离子沉积在基片表面形成的二维材料。

物理气相沉积溅镀靶材的主要过程为：入射离子与靶材碰撞后，将动量传递给靶材原子，使其获得的能量超过靶材原子的结合能，从而使其溅射出来。射出的表面原子中以荷能中性粒子的形式沉积到基片或其他某些部位上，即溅射镀膜的过程。具体如下图所示：

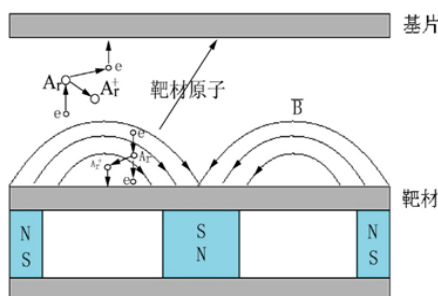


B、公司多段式钛钨合金保护层溅射沉积技术先进性

公司创新的多段式钛钨合金保护层溅射沉积技术，是通过控制舱室等离子能

量微变化，变化性控量打断靶材上原子之间的键，靶材上的原子分布层变化形成多层合金保护层。

多段式钛钨合金保护层溅射沉积技术通过磁场改变电子的运动方向，并束缚和延长电子的运动轨迹，提高了电子对工作气体的电离几率，有效利用了电子的能量，从而使正离子对靶材轰击所引起的靶材溅射更加有效，同时受正交电磁场束缚的电子又只能在其能量耗尽时才能沉积在基片上，通过微量控制工作气体量分段式溅镀，使其沉积基材表面的材料呈现多段式复合层。具体如下图所示：



②微间距驱动芯片凸块制造技术

公司目前所封测的产品为显示驱动芯片，主要使用黄金作为凸块原料。在光刻环节具体可分为金凸块分布路线设计、光刻胶涂布、光刻机曝光、显影等四道工序，公司通过设计与排布让金凸块能够上下交错排列以缩小间距，螺旋涂布方式提升光刻胶分辨率，调适高精密度光刻机参数以改善曝光方式，将金凸块宽度与间距最小可缩至 $6\mu\text{m}$ 。

A、微间距驱动芯片金凸块结构

由于显示屏的分辨率不断提高，显示驱动芯片讯号输出 / 输入端口的数量不断增加，相邻金凸块之间的间距不断减小，使得封装过程中相邻金凸块之间易发生短路。为了避免相邻金凸块发生短路，并加大后续封装的制程空间，公司设计出金凸块微间距排列结构。

B、螺旋式光阻涂布工艺及装置

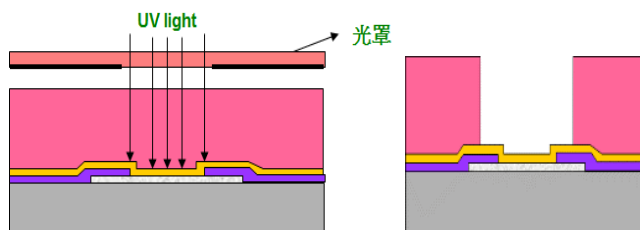
光刻胶涂布的目的是在晶圆表面形成厚度均匀、附着性强且没有缺陷的光刻胶薄膜。在凸块制造工艺中，光刻胶的作用之一是在蚀刻或离子注入过程中保护

其被覆盖的材料，因此光刻胶与晶圆表面需牢固的粘附，而且胶层的厚度、均匀性和缺陷密度对光刻工艺质量影响很大。

公司创新出的螺旋光阻涂布工艺及装置，利用高精度机械手臂将光刻胶喷在晶圆上特定位置，再通过特定转速使光刻胶均匀涂布在晶圆表面，有效提高晶圆表面光刻胶均匀性，使其后段制程曝光精度得以提升，且较传统涂布方式制程时间缩短 20% 以上。

C、曝光工艺优化

公司通过调适高精密度光刻机参数，令 UV 光源在光刻胶曝光阶段从窗口呈垂直角度射入，将光罩上的凸块路线图精准地转移到光刻胶表面，以确保显影工序后光刻胶凹槽壁光滑且垂直于晶圆表面，进而保障电镀工序后金凸块的优质形状与稳定的微间距。具体图示如下：

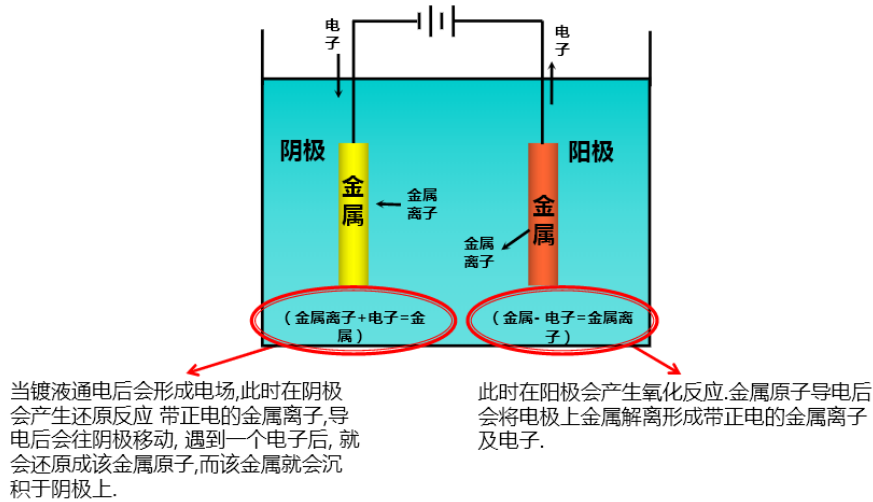


③凸块高可靠性结构及工艺

在显示驱动芯片晶圆电镀环节，针对现有单段式高密度电流电镀沉积金凸块晶粒较大，与溅射金晶粒差异较大，回火时两种晶粒不易重组，从而导致金凸块可靠性较差等问题，公司创新出两段式金凸块电镀技术增加了产品的可靠性，与单段式相比可靠性试验时间提高近 50%，同时可以进一步防止铝垫裸露。

A、晶圆电镀环节工作原理

金凸块制造的晶圆电镀环节分为等离子预置清洁、高纯水高压分布清洁与电镀等步骤。等离子预置清洁阶段通过线圈产生的电磁场穿透石英激发等离子体进行电镀前清洁。高纯水高压分布清洁过程为在特定角度、流量、压力下，使用高纯度水对光刻显影后深度为 10-15 μm 的线槽进行喷洗。电镀原理是基于电化学反应理论，将一种金属包封到另一种金属表面上的过程。电镀原理具体图示如下：



B、两段式金凸块电镀技术先进性

公司创新的两段式金凸块电镀技术,通过精准控制电流密度大小调整电镀还原反应过程中,金属离子移动速率的大小。依次采用低密度电流和高密度电流在导电层上沉积低、高晶格密度的金凸块,回火后高晶格密度金凸块与导电层之间的低晶格密度金凸块会再次重组,增加了产品的可靠性,与单段式相比可靠性试验时间提高近 50%,同时可以进一步防止铝垫裸露。

2、封装制程（COG+COF）核心技术

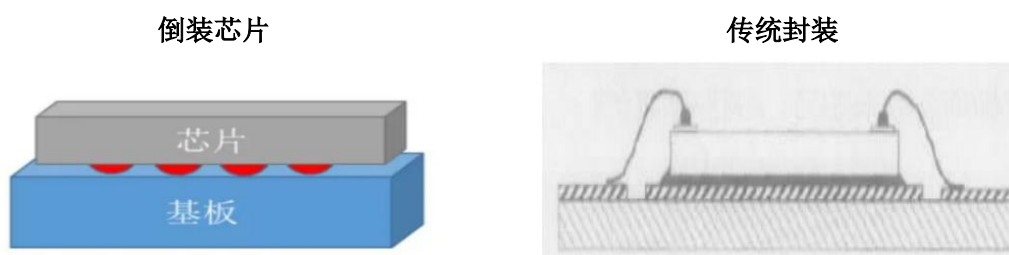
（1）核心技术背景

倒装芯片（FC）技术无需使用传统焊线工艺（Wire Bond）的引线连接,可使芯片和电路基板之间形成最短的连接通路,是适应电子封装产品小型化发展趋势封装技术。传统封装技术是将芯片的有源区面朝上,背对电路基板贴合,之后通过引线与电路基板连接;倒装芯片技术则将芯片有源区面对着基板,通过芯片上呈阵列排列的凸块实现芯片与电路基板的互联,连接长度大幅缩短,有效减小了电阻与电感、提高了电性能。

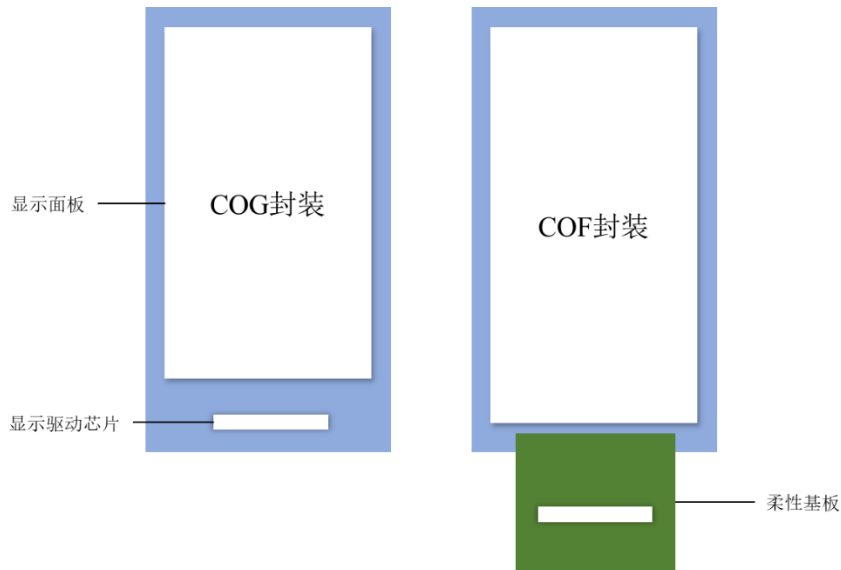
倒装芯片迎合了集成电路追求更高 I/O 密度、更小尺寸、更快运算速度、更高可靠性和更佳经济性的发展趋势。高密度细间距倒装凸点互连芯片封装技术作为高端先进封装代表性技术之一,被广泛应用于显示驱动芯片、图像处理芯片、CMOS 影像传感器芯片和人工智能芯片等领域,并具备以下优点:

①封装密度的限制较小，能够增加单位面积内的 I/O 数量，拥有较高密度的 I/O；②减小了封装组件的尺寸和重量，倒装占有面积和芯片大小几乎一致；③散热性能较好，芯片中产生的热量通过焊料凸点直接传输到封装衬底进行散热；④采用了凸块结构，芯片与电路板连接长度大幅缩短、电阻与电感减小，封装的电性能得到极大提升；⑤提高了信号完整性，频率特性更好。

倒装芯片技术与传统封装技术的工艺差异如图所示：



公司一直专注于高端先进封装技术，主要封装工艺为玻璃覆晶封装（COG）和薄膜覆晶封装（COF），应用于显示驱动芯片封测领域，两者均使用高密度细间距倒装凸点互连芯片封装技术，对于设备、封装工艺等有着较高的要求。玻璃覆晶封装主要应用于小型显示面板，直接通过各项异性导电胶将芯片封装在玻璃上，实现芯片导电凸块与玻璃上的 ITO 透明导电焊盘互连封装在一起。薄膜覆晶封装主要应用于大屏的柔性基板，将芯片通过导电胶键合方式直接封装到软性基板（卷带）上，达到高封装密度，减轻重量，缩小体积，能自由弯曲安装的目的，发行人薄膜覆晶封装技术是实现显示面板终端无边框的技术基础，例如全面屏智能手机。



（2）技术优化

玻璃覆晶封装和薄膜覆晶封装共用前端的研磨薄化、切割工序，晶圆被分割为单个芯片后进行各自独有的后端工序。在封装制程中，发行人通过技术研发、工艺优化与设备改良等途径，精益求精、不断创新突破玻璃覆晶封装与薄膜覆晶封装的技术上限，积累了高精度晶圆研磨薄化技术、高稳定性晶圆切割技术与高精度高效内引脚接合工艺等多项先进工艺。

①高精度晶圆研磨薄化技术

A、裂片晶圆研磨处理技术

公司自主创新的晶圆研磨前裂片异常的处理方法可有效提高产出效益。在金凸块制造、晶圆测试等制程中，晶圆有可能因故障破裂，而晶圆的研磨薄化是通过真空陶瓷面吸附晶圆进行的，此时破裂的晶圆因结构不完整，无法将晶圆可靠地固定在真空陶瓷面上，从而无法进行研磨薄化工序。在研磨薄化工序中，通常遇到此类破裂的晶圆，因结构不完整不能执行下一道制程而报废。

公司提出的一种晶圆研磨前裂片异常的处理方法通过裂片拼接技术较好地解决前述问题，对于已出现破裂而无法被吸附固定进行研磨的晶圆，可通过定位、合框、切割、重组等操作将缺失的晶圆拼接填补全再固定进行研磨，有效地提升了产品良率。

B、高精度性半导体晶圆薄化技术

公司研发的晶圆薄化技术采用高精度激光研磨装置微量控制 $0.10\mu\text{m}$ 等级的抛磨技术，可完成高精度的硅晶薄化作业。薄化装置各部件通过控制程序进行讯号连接实现统一控制，依靠一系列过程控制将晶圆以微米级刨除背面硅晶成分，并时刻监控晶圆厚度，在减薄时可以更加稳固硅片、提高平整度，从而精准控制硅片的厚度，确保产品达到客户需求，公司研磨工艺可实现晶圆最薄研磨至 $150\mu\text{m}$ ，而且可保证研磨后晶圆背面的粗糙度在 7.5nm 以内。

②高稳定性晶圆切割技术

随着光电产业的迅猛发展，高集成和高性能的晶圆需求日益增大，为大幅度节约成本并提高制造效率，在先进制程的生产环节中往往先在晶圆上沉积集成电路芯片或电路组件结构，之后再分割成晶粒，最后进行封装和焊接。因此，晶圆切割工艺对提高成品率和封装效率有着重要影响。

公司在晶圆切割方面拥有专业的技术方案和生产装置以保障晶圆切割质量。公司发明的应对真空异常的晶圆切割处理方法，能够解决晶圆在真空吸附释放过程受胶膜延展性的影响切割位置偏移的问题，可以避免切割出的晶粒受损。公司的晶圆切割装置可实现多设备统一控制、协同运作，有效提高切割效率、降低人工操作失误、大幅提升切割精度，切割出来的芯片更加圆润无毛边。

③高精度高效内引脚接合工艺

随着终端产品的多元化与技术要求的提高，封装工艺在逐步朝向高密度化、高引脚数化、微间距化方向发展，显示驱动芯片线路中心到中心距（Pitch）、间距（Spacing）等日益微细化，芯片与基板的键合是制约封装工艺发展的关键技术之一。

公司拥有的高精度高效内引脚接合工艺，可通过高精度高可靠的芯片识别与挑拣、微米级的凸块定位与键合等技术，实现在长约 30mm 、宽约 1mm 的单颗芯片上，数千颗宽度与间隔仅为 $6\mu\text{m}$ 的凸块与柔性基板（卷带）上对应的内引脚精准高效键合，公司生产工艺与创新装置的协同使得内引脚接合时运转效率更加高效稳定。

3、晶圆高精度稳定性测试技术

公司在晶圆测试环节拥有丰富经验的技术团队，对晶圆测试和芯片成品测试领域核心技术的发展持续跟踪并进行深入研究，不断加大技术研发投入力度，目前已拥有晶圆高精度稳定性测试技术，具备测试设备改造升级能力，可满足客户芯片测试的多样化需求。

（1）Wafer Saw AOI 特殊扫描技术

市场上现有的 AOI 扫描作业可对晶圆正面进行 100% 检验，但是作业模式单一，无法实现晶圆分区域扫描的功能，并且在异常处理时 100% 区域扫描以及复检耗费时间较长，无法满足客户不同的检验需求。

公司发明的 Wafer Saw AOI 特殊扫描技术，可通过调整 Map 以实现分区域作业的功能，解决了现有 AOI 扫描技术作业模式单一的问题，大幅拓宽了该技术的应用场景，从而满足客户的定制化需求。

（2）测试探针卡技术

在显示驱动芯片的测试过程中探针卡是不可或缺的关键配件。晶圆上每一颗显示驱动芯片都必须通过特有的探针卡测试，测试过程需在长约 30mm、宽约 1mm 的单颗芯片上，将数以千计的 I/O Pin 针分布与待测芯片的凸块布局一一对应，根据相对应位置制作的专用探针卡才能对每一颗芯片进行测试，而且探针卡属于生产耗材，高端的测试探针卡成本不菲。

公司拥有的探针卡升级改造技术、异常处理与日常维护技术，可保障公司在探针卡使用周期及微间距产品测试稳定性上处于行业内先进水平。

4、系统级无尘工艺

封装工艺逐渐朝着更高密度线路的趋势发展，尤其是细间距产品线路间距仅 6-20 μm ，其对于污物与微尘防护的要求更高。公司在显示驱动芯片封测领域深耕多年，通过技术创新、工艺优化与设备改良等途径建立起了多层次、全流程的污物与微尘防护系统，有力保障了公司的产品良率。

（1）晶圆清洁技术

①干式晶圆自动清洁机

晶圆在封装测试中需要进行多次高精度清洁，行业内一般使用超声波清洗机清洁晶圆，其不足之处在于：使用纯水进行晶圆表面微尘去除，需另外进行甩干作业，故清洗后无法立即使用，在等待或运送过程中可能再次被污染；单片式清洗作业时间长，作业效率较低；清洁设备体积较大且需要排水系统排污，易造成环境污染。

公司发明的干式晶圆自动清洁机有效提升了清洁流程的效率与产出效益，清洗完毕后可跳过甩干步骤立即投入使用，简化工序以缩短生产周期，且可以节约水资源、避免二次污染。

②高效洗除氧化钨的洗液及方法

在金凸块制造工序中，使用双氧水蚀刻钛钨层时会生成副产物三氧化钨，极易污染生产设备与芯片。为较好地解决该问题，公司经过反复试验发明的洗除三氧化钨洗液及方法可通过 IA 族金属的氢氧化物、氨水与三氧化钨的双物料反应等一系列化学反应在常温下快速有效地 100% 去除三氧化钨污物，清洗效率较高。

（2）高精度柔性基板封装工艺中微尘防护技术

鉴于产品及机台生产运转期间皆有产生微尘污染产品的风险，公司自主研发出多项防护技术与装置以保障产品免受污染而稳定良率，具体如下：

①柔性电路板及芯片表面微尘清除器能够有效避免芯片与卷带结合前，多个过程造成的再次污染；②放料端承接板用以防护尚未与芯片键合之柔性基板；③轴心保护盖装置则完整包覆放/收料端旋转马达轴心，使轴心作动过程中产生的微尘抑制于防护区域内，而不飘散至产品上；④传送带用盖板则为柔性基板于机台内部传送期间提供全面的防护，可避免传送机工作过程产生的微尘落于产品上。

公司通过研究开发的包括上述技术在内的防护技术，有效提升了防护覆盖率并避免晶粒裸露于环境中遭受污染。

（3）集成电路封装微尘管理技术

高密度的集成电路容易受到微尘损害，其对于微尘的敏感度取决于特征尺寸

（即半导体器件中的最小尺寸）和芯片表面沉积层的薄度，故集成电路行业对微尘的管理相当严格。

公司制定了严格的微尘管理制度，并在多个工序环节设计了微尘清除装置，也在工序制作过程同步监控微尘的数量，以保障产品免受污染，确保良率稳定。公司的生产场所均为百级或千级无尘净化车间，工作人员需穿戴覆盖全身的防护衣物，净手并在风室除尘后方可进入。

（三）公司科研实力和成果情况

公司汇聚了行业内优秀的集成电路封装测试研发、工程和管理人员，部分核心成员曾供职于显示驱动芯片封装测试领域的龙头企业，具备超过 15 年的集成电路技术研发或管理经验，对于整个行业的发展以及企业的定位有着较为深刻的认识。

公司始终将技术创新作为价值创造的源动力，自创立伊始，公司即规划并组建了研发中心，制定一系列研发管理条例，并形成了完善的研发创新体系以保障研发工作的高效有序进行。经过近几年的有效运作，研发中心在提高企业技术水平和市场竞争力方面起到重要作用：公司相继获得安徽省企业技术中心、江苏省显示屏驱动芯片先进凸块封测工程技术研究中心、安徽省专精特新企业、2020 年度中国隐形独角兽 500 强与联咏科技 2021 上半年度最佳品质供应商等荣誉。

截至本招股说明书签署日，发行人及实际控制人获得的主要奖项及荣誉情况如下：

序号	荣誉名称	颁发单位	获奖对象	时间
1	2021 上半年度最佳品质供应商	联咏科技	汇成股份	2021 年
2	2020 年年度最佳配合供应商	联咏科技	汇成股份	2020 年
3	安徽省专精特新中小企业	安徽省经济和信息化厅	汇成股份	2020 年
4	合肥市专精特新中小企业	合肥市经济和信息化局	汇成股份	2020 年
5	合肥市智能工厂和数字化车间	合肥市经济和信息化局	汇成股份	2020 年
6	中国隐形独角兽 500 强	中国隐形独角兽 500 强大会	汇成股份	2020 年
7	安徽省企业技术中心	安徽省经济和信息化厅、安徽省发展和改革委员会、安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、国家税	汇成股份	2019 年

		务总局安徽省税务局、中华人民共和国合肥海关		
8	合肥市企业技术中心	合肥市经济和信息化局、合肥市发展和改革委员会、合肥市科学技术局、合肥市财政局、安徽省合肥市国家税务局、安徽省合肥市地方税务局、合肥市统计局	汇成股份	2018年
9	2017年度新站高新技术产业开发区“招商引资突出贡献个人”	合肥新站高新技术产业开发区管委会	郑瑞俊	2018年
10	2018年扬州市工业智能制造十佳企业	扬州市人民政府	江苏汇成	2019年
11	2018年江苏省示范智能车间	江苏省工业和信息化厅	江苏汇成	2019年
12	江苏省显示屏驱动芯片先进凸块封测工程技术研究中心	江苏省科学技术厅	江苏汇成	2019年
13	高新技术产品认定证书（高密度金凸块软板覆晶结合芯片）	江苏省科学技术厅	江苏汇成	2014年
14	江苏省信息化与工业化融合试点企业	江苏省经济和信息化委员会	江苏汇成	2014年
15	扬州市显示屏先进封装测试工程技术研究中心	扬州市科学技术局	江苏汇成	2014年
16	高新技术产品认定证书（高密度柔性封装金凸块）	江苏省科学技术厅	江苏汇成	2013年
17	2012年科技创新先进单位	中共扬州市邗江区委经济开发区（汉河街道）工作委员会、江苏扬州邗江经济开发区管理委员会	江苏汇成	2013年

（四）公司正在从事的研发项目

公司自设立以来即高度重视研发工作，将技术、产品创新作为核心竞争力，每年投入大量的资源开展新产品、新工艺、新技术的研发工作。

截至本招股说明书签署日，公司正在研发的主要项目如下表所示：

单位：万元

序号	项目名称	研发内容	所处阶段	相关人员	经费预算	拟达到的目标
1	减小凸块底切的结构及其制造方法	减小凸块底切的结构，使得凸块结构更加牢固，避免芯片受应力作用导致凸块脱落，提高芯片凸块结构的可靠性	样品试制	林文浩、刘祥峰等	400.00	回火后高晶格密度金凸块与金导电层之间的晶格再次重组，提高结构牢固性和产品可靠性

序号	项目名称	研发内容	所处阶段	相关人员	经费预算	拟达到的目标
2	晶圆图像坐标自动输出研发	光学自动检测输出的标识图在后段挑拣中起重要作用，本课题拟设计出一种输出标识图可区分金凸块制造和晶圆测试两段制程瑕疵裸晶坐标位置的自动点墨功能	样品试制	许原诚等	750.00	提高挑选准确度与自动化程度，缩减人力成本
3	晶圆级测试微弱电流漏电改善装置研发	现有探针卡清洁设备对探针卡进行检测和清洁过程存在缺陷，清洁后仍会产生微弱电流泄露，导致送原厂维修停机时间偏长，影响生产效率，故本课题拟设计一种探针卡泄露改善装置提高探针卡稳定度	样品试制	林文浩、陈汉宗等	750.00	提高探针卡清洁与检修效率，以及生产效率
4	先进封装领域一种芯片反向机制研发	对现有晶粒挑选机台进行改造，针对晶粒挑选机入料研究开发快速准确放置托盘的装置设计	样品试制	钟玉玄、吴世茂等	500.00	减少晶粒反向的几率，优化相关产品
5	高精度卷带覆晶封装工艺关键技术的研发	通过设计的颗粒收集防护装置有效的避免设备传动产生的尘埃落入柔性线路基板的引脚上或引脚之间，提升产品良率及稳定度	样品试制	林文浩、高美山等	300.00	封装过程中避免尘埃以提升产品良率及稳定度
6	CMOS 影像传感器工艺	在微尘管控与去除方案上采取突破传统单颗芯片处理手法，利用机台快速且多颗芯片同时进行清洁处理，也同步节省人工成本并提升作业效率	样品试制	钟玉玄、陈汉宗等	700.00	完成 200 万/500 万/800 万像素 CMOS 传感器的封装生产
7	提高驱动芯片可靠性装置及工艺的研发	本课题拟研究开发一种提高驱动芯片可靠度的电浆源表面处理装置与处理方法：通过反应室对晶圆进行处理，利用氮气电浆降低金凸块阻障层的钛或钛钨氧化成氧化钛，以提高显示驱动芯片金凸块的可靠性	样品试制	林文浩、许原诚等	500.00	提高产品的可靠性

序号	项目名称	研发内容	所处阶段	相关人员	经费预算	拟达到的目标
8	柔性基板封装工艺辅助治具技术的研发	为提高柔性基板封装工艺产品品质与生产良率，本课题拟开发设计以下专用的治具：一是设计柔性基板封装工艺专用运输、存放与换胶治具，增加防护能力与生产稳定性；二是设计亚克力板材防护治具，避免检修设备造成的产品品质问题	样品试制	林文浩、刘明群等	500.00	提高柔性基板封装工艺产品品质与生产良率
9	金凸块表面粗糙度改善工艺研发	通过调整电镀设备的参数，实现对上层管路、中层管路以及下层管路中电镀液流量的调节，在电镀槽中形成向上平稳流动状态，同时在光阻喷涂、芯片曝光、显影处理等步骤上进一步优化和调整，降低金凸块表面粗糙度、缩短生产周期	样品试制	林文浩、莫雷清等	600.00	改善金凸块表面粗糙度，缩短生产周期

（五）公司报告期内的研发投入情况

为了保证持续的技术和产品创新，保持产品和服务的技术领先水平和市场竞争优势，公司一贯重视研发的投入。报告期内公司研发投入情况如下：

单位：万元

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
研发投入	2,898.95	4,715.21	4,542.64	3,787.27
营业收入	35,875.90	61,892.67	39,420.66	28,558.35
研发投入占营业收入比例	8.08%	7.62%	11.52%	13.26%

（六）公司合作研发情况

报告期内，公司不存在合作研发，曾委托西安电子科技大学工程技术研究院有限公司进行金凸点电场流场工艺模拟仿真的研究开发，共支付研究开发经费10万元。具体情况如下：

序号	项目名称	受托方	主要委托研究内容	研究成果的分配	保密措施
1	关于金凸点电场流场工艺仿真项目	西安电子科技大学工程技术研究院有限公司	(1)电镀流场与金凸块均匀性模拟(2)电镀电场与金凸块均匀性模拟(3)金凸块制造过程中电镀金可靠度模拟	专利权及有关利益由江苏汇成享有	约定保密条款

在委托研究过程中，江苏汇成还从西安电子科技大学处受让取得一项发明专利，专利号为“ZL201410064678.6”的“一种用于微结构三维形变和位移测试的干涉测量系统”，可进行芯片微结构的面内-离面形变与位移，以及静态三维形貌测试等，具体情况如下：

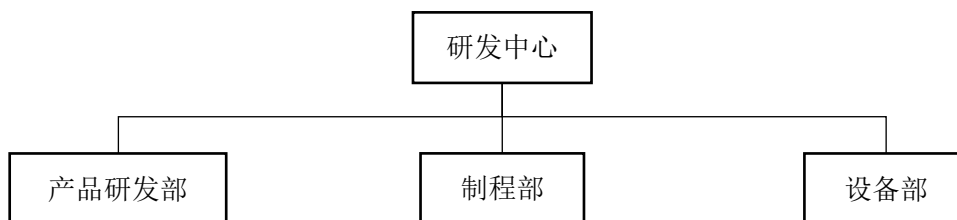
2018年9月10日，江苏汇成与西安电子科技大学签订了《技术转让（专利权）合同》，约定西安电子科技大学将上述发明专利转让给江苏汇成，转让价格为5万元。2018年10月8日，江苏汇成支付了上述转让款，并于2018年10月23日办理了专利权人变更手续。

（七）公司核心技术人员及研发人员情况

1、研发中心组织架构及研发人员情况

公司设有专门的研发中心，全面负责推进产品技术升级、生产工艺改良及设备装置改造，推动封装测试技术的持续更新优化。研发中心根据市场前景和客户需求开展技术和产品研发，研发流程主要包括项目调研、项目立项、工艺设计与开发、样品试制和研发结项等阶段。

（1）研发组织结构



研发中心各部门职责如下：

序号	部门	职责
----	----	----

1	产品研发部	<p>（1）主要负责组织调研封装测试技术的市场发展趋势，学习先进封装技术，并根据封装行业发展趋势、公司现有技术水平、产品路线的战略规划，结合调研结果和客户要求提出升级优化方案，制订产品开发方向，确定研发产品的种类，制定研发产品的相关标准与研发工作计划，并开展相关研究工作；</p> <p>（2）基于公司现有技术基础，提出新技术的开拓方案，并针对技术难点、资源配置、成本效益等进行可行性分析，立项通过后开展自主研发或合作研发，积极推进公司产品的创新，并不断积累技术以实现新封装技术的开发</p>
2	制程部	<p>（1）主要负责新技术及制程技术的导入，并进行工艺整合，保障工艺流程的合理性及高效运作；</p> <p>（2）稳定并提升生产工艺水平，推动产品质量和成本的持续改善，根据公司现有工艺流程、设备人员配置等，不断优化生产流程；</p> <p>（3）确保新产品快速平稳地实现大规模批量化生产，并以零缺陷为目标，推动良率不断提升；</p> <p>（4）对生产和技术人员提供培训，持续提升产线作业能力和工艺水平</p>
3	设备部	<p>（1）主要负责设计开发生产设备及配件以不断提高生产效率、优化生产流程，推动良率持续提升；</p> <p>（2）维持生产部门设备的正常运转；</p> <p>（3）负责设备的稼动率管理与编程调试；</p> <p>（4）审核并执行设备相关维护计划，对设备维修进行监管；</p> <p>（5）分析及改善设备备件的耗用</p>

（2）研发人员情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司在职工工共 962 名，其中研发人员 185 名，占比 19.23%。具体人员结构如下：

学历结构	人数（人）	占比
硕士及以上	10	5.41%
本科	85	45.95%
专科及以下	90	48.65%
合计	185	100.00%
年龄结构	人数（人）	占比
30 岁及以下	76	41.08%
30-40（含）岁	92	49.73%
40-50（含）岁	13	7.03%
50 岁以上	4	2.16%
合计	185	100.00%

2、核心技术人员情况

公司的核心技术人员共 4 名，包括林文浩、钟玉玄、许原诚和陈汉宗，上述核心技术人员的简历参见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“九、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员”之“（一）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况”之“4、核心技术人员”。

核心技术人员的重大科研成果及对公司研发活动的贡献情况如下：

姓名	核心技术人员的重大科研成果、对公司研发活动的贡献
林文浩	<p>1) 研发项目：作为项目负责人主导了“半导体晶圆高效精度减薄工艺的研发”、“半导体刻蚀设备管路排水优化的设计”等数十个研发项目。作为主要项目成员参与了“蚀刻制程中的光阻层显影处理技术的研究”等多个研发项目。</p> <p>2) 研发成果：参与了公司多项核心技术的研发和专利申请工作，为“一种半导体晶圆级封装结构（ZL201721238003.4）、一种半导体晶圆封装结构（ZL201721238104.1）”等专利主要发明人之一。</p>
钟玉玄	<p>1) 研发项目：作为项目负责人主导了“高精度柔性基板高良率封装工艺及检测装置的研发”、“多规格柔性基板自动清洁技术的研发”等 10 余项先进封装工艺相关的研发项目。作为项目组成员参与了“先进封装领域一种芯片反向机制研发”、“晶圆研磨共享背检装置的研发”等多个研发项目。</p> <p>2) 研发成果：参与了公司多项核心技术的研发和专利申请工作，包括高稳定性晶圆切割技术、高精度柔性基板封装工艺中微尘防护技术等多项核心技术的专利申请，在显示驱动芯片封装行业从业多年，为公司多项核心技术的研发和封装技术的改进工作提供了重要指导意见。</p>
许原诚	<p>1) 研发项目：作为项目负责人主导了“金凸块高均匀性制程工艺及蚀刻槽铣槽工艺的研发”等多项金凸块制造工艺相关的重要研发项目。作为项目组成员参与了“高精度自动化防破损晶圆定位转移装置的研发”等多项研发项目。</p> <p>2) 研发成果：参与了公司多项核心技术的研发和专利申请工作，为“一种集成电路芯片的金凸块制造工艺（ZL201810431710.8）”和“洗除氧化钨的洗液及清洗附着有氧化钨生产工具的方法（ZL201810093214.6）”等多项与微间距驱动芯片凸块制造技术和晶圆清洁技术相关专利的发明人之一，拥有丰富的金凸块制造工艺经验，为公司金凸块工艺制造技术的研发改进作出了重要贡献。</p>
陈汉宗	<p>1) 研发项目：作为项目负责人主导并参与了“晶圆级测试微弱电流漏电改善装置研发”等多项晶圆封测工艺改进相关的重要研发项目。</p> <p>2) 研发成果：参与了公司多项核心技术的研发和专利申请工作，包括晶圆高精度稳定性测试技术等多项核心技术的专利申请，在显示驱动芯片封测领域拥有丰富的技术经验，为发行人测试工艺改进及封装技术研发作出了重要贡献。</p>

3、公司对核心技术人员实施的约束激励措施

（1）薪酬激励与科技成果奖励并行

公司对核心技术人员提供较为丰厚的薪酬待遇，并且对于科技创新成果设置奖励以提高员工积极性，实行分级管理分级奖励的原则。

（2）制定员工股权激励计划

公司为稳定核心技术人员，防止人员流动导致的技术泄露，制定了一系列员工股权激励计划，股权激励计划的详细情况参见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“十、发行人本次公开发行前制定或实施的股权激励”。

（3）建立核心技术保密制度

为防范核心技术泄露，公司建立了核心技术保密制度，与主要技术人员均签订了保密协议和竞业禁止协议，约定了研发成果归属、保密义务、竞业限制义务等。

（八）公司的技术创新机制、技术储备及技术创新的安排

公司自成立以来，高度重视技术创新工作，经过多年的实践与积累，已建立了一套以自身研发实力为基础、以客户市场需求为导向、以高端人才为核心的技术创新机制，为公司的技术进步和工艺水平提升提供了制度保障。

1、创新激励机制

公司对各部门研发技术人员和生产管理人员等员工采取必要的激励制度和措施，一方面对于研发人员的薪酬设置为工资薪金加项目提成的方式以激励员工创新，另一方面设立科技成果奖，实行分级管理、分级奖励的原则，积极引导员工在研发上紧跟技术发展趋势、贴近市场需求，提高研发的成功率和市场效益，从而对研发创新形成了有效的激励机制。

2、技术交流培训

公司鼓励并积极组织研发技术人员参与各类技术培训活动、学术交流活动等，促使研发技术人员对行业技术发展趋势有更加深入的了解，通过集体学习提升自身技术水平与行业需求相适应，并保障研发技术人员在技术职务领域具有畅通的晋升渠道和广阔的发展空间。

3、创新战略规划

一方面，公司积极培养年轻技术人员，在日常的研发活动中，资历较深的技术人员会负责带教后辈，丰富的技术储备为持续的自主研发创新打下坚实的基础；另一方面，公司加大产品技术方面的人才引进，改善研发队伍人才结构，致力于

提升研发成果的质量。

4、技术储备

公司根据行业发展的趋势和下游客户的需求，围绕现有产品和技术成果，在现有产品结构设计、工艺优化以及新产品开发等方面不断创新，从而使公司现有产品技术水平保持行业领先地位并拓展新的应用领域和产品类型。公司在现有凸块制造技术的基础上，已在 CMOS 影像传感器封装领域形成一定的技术储备，主要包括适用于 CMOS 影像传感器的封装技术。

七、发行人境外经营情况

截至本招股说明书签署日，公司无境外经营情况。

第七节 公司治理与独立性

一、股东大会、董事会、监事会、独立董事和董事会秘书制度的建立健全及运行情况

（一）报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况

根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规及规范性文件的要求及《公司章程》，发行人建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理框架，董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制。

自公司法人治理结构相关制度制定以来，公司股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书等机构和人员均能够严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定诚信勤勉、履职尽责、有效制衡，保证了公司依法、规范和有序运作，没有违法违规的情形发生。

（二）股东大会制度的建立健全及运行情况

公司制定了《股东大会议事规则》。发行人自股份公司成立以来共召开 3 次股东大会。发行人历次股东大会的召集、提案、通知、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照有关法律、法规、《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定执行。股东认真履行股东义务，依法行使股东权利。股东大会制度的建立健全对完善公司治理结构和规范运作起到了积极作用。

（三）董事会制度的建立健全及运行情况

公司制定了《董事会议事规则》。发行人自股份公司成立以来共召开 4 次董事会。发行人历次董事会的召集、提案、通知、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照有关法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定执行。董事认真履行董事义务，依法行使董事权利。董事会制度的建立健全，对完善公司治理结构和规范运作起到了积极作用。

（四）监事会制度的建立健全及运行情况

公司制定了《监事会议事规则》。发行人自股份公司成立以来共召开 3 次监事会。发行人历次监事会的召集、提案、通知、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照有关法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定执行。监事认真履行监事义务，依法行使监事权利。监事会对公司董事会工作、高级管理人员行为、公司重大生产经营决策、关联交易的执行、公司主要管理制度的制定、重大项目的投向等事宜实施了有效监督。监事会制度的建立健全，对完善公司治理结构和规范运作起到了积极作用。

（五）独立董事制度的建立健全及运行情况

公司制定了《独立董事工作制度》，规定了独立董事的独立性及任职资格，独立董事的提名、选举和更换，独立董事的职责，独立董事的权利和义务等。

公司独立董事自上任以来严格按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定认真履行独立董事职责，在规范公司运作、加强风险管理、完善内部控制、保障中小股东利益及提高董事会决策水平等方面起到了积极作用。

（六）董事会秘书制度

公司制定了《董事会秘书工作细则》，规定了董事会秘书的任职资格、董事会秘书的职责、董事会秘书的任免等。

公司董事会秘书依据《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件、《公司章程》《董事会秘书工作细则》等公司规章制度，负责公司信息披露事务、组织筹备董事会会议和股东大会等工作，对公司的规范运作起到了重要作用。

（七）董事会专门委员会的设置情况

2021 年 3 月 26 日，公司召开第一届董事会第一次会议，审议通过了四个专门委员会委员的选举及各专门委员会工作细则。公司董事会设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，委员会成员由董事组成，其中提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会独立董事占半数以上且由

独立董事担任召集人。

截至本招股说明书签署日，各专门委员会的人员构成情况如下表所示：

序号	委员会名称	委员	召集人
1	战略委员会	郑瑞俊、沈建纬、蔺智挺	郑瑞俊
2	审计委员会	程敏、蔺智挺、吴海龙	程敏
3	提名委员会	杨辉、程敏、沈建纬	杨辉
4	薪酬与考核委员会	杨辉、蔺智挺、赵亚彬	杨辉

自设立以来，公司的董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会严格按照相关法律、法规及《公司章程》《战略委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《审计委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定规范运作，运行情况良好。

二、发行人特别表决权股份情况

截至本招股说明书签署日，发行人不存在特别表决权股份或类似安排的情况。

三、发行人协议控制架构情况

截至本招股说明书签署日，发行人不存在协议控制架构的情况。

四、发行人内部控制情况

（一）发行人管理层对内部控制的自我评估意见

发行人认为，根据《企业内部控制基本规范》及相关规定，公司内部控制于2021年6月30日在所有重大方面是有效的。

（二）注册会计师对发行人内部控制的鉴证意见

2021年9月18日，天健会计师出具了天健审〔2021〕10319号《关于合肥新汇成微电子股份有限公司内部控制的鉴证报告》，认为汇成股份按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于2021年6月30日在所有重大方面保持了有效的内部控制。

（三）报告期内发行人财务内控不规范情形及整改情况

1、转贷事项

（1）转贷的基本情况背景

报告期内，公司存在为满足贷款银行受托支付要求，通过供应商或第三方取得银行贷款的情形（以下简称“转贷”）。相关转贷行为发生在 2018 年 1 月至 2020 年 7 月（贷款发生期间以银行实际放款日期计算），通过转贷共取得贷款总额 37,765.28 万元。

发生转贷行为的背景和原因如下：公司所处的集成电路封装测试行业属于资金密集型行业，需要较大规模的资金进行设备投入。报告期内公司业务规模增长较快，为满足生产经营活动的需要，公司通过银行融资的方式缓解经营资金紧张的局面。根据贷款银行的政策要求，贷款需以受托支付的形式发放，由于贷款发放时间与公司用款时间不匹配，为缓解公司资金周转压力及提高资金使用效率，公司通过转贷的方式取得银行贷款。

公司通过转贷取得的银行贷款主要用于购买固定资产以及补充运营资金等生产经营活动，具备按时、足额偿还贷款本息的能力，且在申请贷款时提供了相关担保，不存在骗取贷款银行发放贷款的意图或将该等贷款非法据为己有的目的，上述银行贷款均已按期偿还。

（2）整改情况

2020 年 8 月起，公司新增贷款未再出现转贷情形。公司制定了相关整改措施：一是组织管理层认真学习《贷款通则》《流动资金贷款管理暂行办法》等相关法律法规，确保银行借款规范使用；二是完善公司资金管理制度，细化资金贷款的规范要求，杜绝通过第三方周转贷款；三是强化制度执行，责令发行人内审部对资金贷款事项进行审计监督，确保上述有关制度得到执行。

公司已通过停止转贷行为、归还贷款、组织董事、监事、高级管理人员及财务人员学习相关法律法规、加强内部控制等方式进行积极整改。截至 2021 年 6 月 30 日，转贷所涉银行贷款均已归还完毕，公司与贷款银行无任何争议、诉讼。审计截止日后公司能够持续符合财务内控规范性要求。

（3）相关说明

公司已取得转贷所涉贷款银行分别出具的情况说明，确认上述转贷所涉及的贷款均能按照借款合同还本付息，未发生逾期还款或其他违约情形，资金结算方面无不良记录，无违反银行结算制度规定的行为，资金信誉情况良好。

公司实际控制人郑瑞俊、杨会已针对转贷事项出具承诺函，承诺若发行人及其子公司因前述不规范贷款行为承担任何责任或受到任何处罚，从而使公司遭受任何损失，将无条件承担公司因此产生的费用、罚款或其他经济损失，并保证今后不会就此向公司进行追偿。

综上，公司上述转贷行为不构成重大违法违规行为，不存在被处罚的情形或风险，亦无其他重大风险隐患；公司已建立健全贷款相关的各项制度并有效执行。公司的转贷行为不会构成本次发行的实质性障碍。

2、与关联方或第三方直接进行资金拆借

（1）与关联方或第三方直接进行资金拆借的背景

公司存在与关联方或第三方直接进行资金拆借的原因如下：①公司所处的集成电路封装测试行业属于资金密集型行业，需要较大规模的资金进行设备投入；②报告期内公司业务规模增长较快，营运资金需求较大；③2020年前公司营业收入规模相对较小，公司经营未能达到收支平衡，导致公司流动资金较为紧张。

（2）与关联方、比照关联方直接进行的资金拆借情况

具体情况参见本招股说明书本节“十、关联交易情况”之“（二）偶发性关联交易”之“2、关联方资金拆入”及“（四）比照关联交易披露的交易”之“4、比照关联方资金拆入”。

（3）与第三方直接进行的资金拆借情况

资金拆出方	拆借金额（万元）	借款日期	还款本金（万元）	还款日期
苏明德	500.00	2019.3.29	176.90	2020.10.21
			133.40	2020.11.24
			189.70	2020.11.25
江苏耀达石油化工有限公司	500.00	2018.6.22	500.00	2018.7.30

上海绿远环保科技有限公司	1,200.00	2018.12.25	1,200.00	2019.4.1
--------------	----------	------------	----------	----------

注 1：扬州新瑞连和郑瑞俊为苏明德的拆借款提供连带责任担保。

注 2：江苏耀达石油化工有限公司曾用名江苏耀达石化集团有限公司。

（4）整改情况

截至本招股说明书签署日，公司与关联方、第三方之间的资金拆借均已得到清偿，不存在任何因资金拆借行为导致的现实或潜在的纠纷。同时为规范公司资金拆借行为，公司制定了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》和《关联交易决策制度》等制度，规定了关联交易审批权限、流程、关联方回避等内容，从制度上规范关联交易。此外，公司还制定了货币资金管理相关的内部规章制度，规范公司货币资金内部控制及管理行为，该等制度的制定及落实能有效保障公司对于资金使用的行为规范。

（5）相关说明

公司与关联方或第三方之间的资金拆借均系基于日常经营所产生的借款，未用于套利等非法活动，且均已清偿。根据《合同法》和《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》等法律法规，相关借贷行为合法有效。

综上，上述资金拆借行为不会构成本次发行上市的实质性障碍，不会对公司的生产经营状况、财务状况和持续经营能力产生重大不利影响。

五、发行人报告期内违法违规行及受到处罚的情况

最近三年内，发行人不存在重大违法违规行为，也不存在受到相关主管机关重大处罚情况。报告期内，发行人子公司江苏汇成曾受到过 1 次行政处罚，自该行政处罚执行完毕之日起至本招股说明书签署日已逾三年，具体情况如下：

2018 年 9 月 18 日，国家外汇管理局扬州市中心支局下发扬汇检罚[2018]4 号《行政处罚决定书》，因江苏汇成存在违反规定办理贸易融资的行为，根据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十八条之规定给予江苏汇成 15 万元的处罚。2018 年 9 月 30 日，江苏汇成就上述违规行为已足额缴纳罚款并完成整改。

根据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十八条规定：“有下列情形之一的，由外汇管理机关责令改正，给予警告，对机构可以处 30 万元以下的罚款，

对个人可以处 5 万元以下的罚款：……（三）未按照规定提交有效单证或者提交的单证不真实的；……”。该条规定对机构的罚款上限为 30 万元，江苏汇成的处罚金额为 15 万元，未达到处罚上限标准。

根据当时适用的《行政处罚法（2017 年修订）》第四十二条：“行政机关作出责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚决定之前，应当告知当事人有要求举行听证的权利”。根据《国家外汇管理局关于印发〈检查处理违反外汇管理行为办案程序〉的通知（2008 修订）》（汇发[2008]50 号）第六十二条：“有下列情形之一的，外汇局在作出行政处罚决定之前，应当告知违反外汇管理行为的当事人有要求举行听证的权利：……（三）拟给予法人或者其他组织等值 100 万元人民币以上罚（没）款处罚的；……。”本次处罚金额为 15 万元，未达到 100 万元，《行政处罚告知书》中未告知江苏汇成有要求举行听证的权利，因此不属于较大数额的行政处罚。

综上，报告期内，发行人子公司江苏汇成曾受到过 1 次行政处罚，上述行政处罚执行完毕之日起至本招股说明书签署日已逾三年，该行政处罚事项情节较轻，罚款金额未达到处罚上限标准。江苏汇成已及时缴清罚款并完成整改，报告期内未再发生类似违规行为。上述行为不属于重大违法违规行为，不构成本次发行上市的法律障碍。

六、发行人报告期内资金占用和对外担保情况

报告期内，发行人不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情况。

报告期内，公司曾作为担保方为扬州新瑞连支付合肥创投股权转让款事项提供担保，截至本招股说明书签署日，上述担保事项已解除，具体参见本招股说明书“第十三节 附表二：关联担保”之“（二）公司作为担保方的关联担保”。

除上述担保事项外，发行人不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况。

七、面向市场独立持续经营的能力情况

公司自成立以来，严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定规范运作，建立健全了公司的法人治理结构，在资产、人员、财务、机构、业务方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业相互独立，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

（一）资产完整

公司由汇成有限整体变更设立，拥有独立完整的资产，具备与生产经营有关的主要生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的主要土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。

（二）人员独立

公司董事、监事、高级管理人员的产生符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。公司的高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

（三）财务独立

公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员，已建立独立的财务核算体系、能够独立作出财务决策、具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度；公司未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户。

（四）机构独立

公司设有股东大会、董事会、监事会、经理层及生产经营必需的职能部门，明确了各机构的职权范围，已建立健全内部经营管理机构。公司独立行使经营管理职权，与控股股东和实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形。

（五）业务独立

公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在对公司构成重大不利影响的同业竞争，以及严重影响独立性或者显失公平的关联交易

（六）主营业务、控制权、管理团队和核心技术人员稳定

公司主营业务、控制权、管理团队和核心技术人员稳定，最近 2 年内主营业务和董事、高级管理人员及核心技术人员均没有发生重大不利变化；控股股东和受控股股东、实际控制人支配的股东所持发行人的股份权属清晰，最近 2 年实际控制人没有发生变更，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷。

（七）对持续经营有重大影响的事项

公司不存在主要资产、核心技术、商标的重大权属纠纷，重大偿债风险，重大担保、诉讼、仲裁等或有事项，经营环境已经或将要发生的重大变化等对持续经营有重大影响的事项。

八、同业竞争情况

（一）发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争

截至本招股说明书签署日，发行人控股股东、实际控制人及其近亲属控制的除纳入发行人合并报表范围内的其他企业情况如下：

序号	企业名称	主营业务
1	扬州新瑞连	对外投资
2	合肥芯成	发行人员工持股平台
3	合肥宝芯	发行人员工持股平台
4	合肥汇芯	发行人员工持股平台
5	香港宝信	发行人员工持股平台
6	瑞成建筑	建筑装饰、工业与民用建筑、市政土木工程，室内外装饰设计
7	汇成投资	对外投资
8	瑞成投资	对外投资

9	香港瑞仕	对外投资
10	百瑞发投资	对外投资
11	海口三立现代办公设备有限公司	从事现代办公设备的生产开发销售

注：海口三立现代办公设备有限公司已于 1993 年 3 月因逾期未年检被吊销，未实际经营，正在办理注销登记手续。

发行人主营业务为显示驱动芯片的先进封装测试服务，发行人控股股东、实际控制人及其近亲属控制的除纳入发行人合并报表范围内的其他企业与发行人主营业务不同，相关企业主要从事投资、建筑工程等业务，与发行人不构成同业竞争。

（二）避免同业竞争的承诺

为避免同业竞争，公司控股股东扬州新瑞连及实际控制人郑瑞俊、杨会已分别出具关于避免同业竞争的承诺，具体内容参见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“六、本次发行相关主体作出的重要承诺”之“（十一）其他承诺事项”之“1、关于避免同业竞争的承诺”。

九、关联方与关联关系

按照《公司法》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等对关联方的披露要求，公司主要关联方及关联关系列示如下：

（一）控股股东、实际控制人相关

1、控股股东、实际控制人

序号	关联方名称/姓名	关联关系	备注
1	扬州新瑞连	控股股东	直接持有公司 26.07% 的股份，杨会为执行事务合伙人
2	郑瑞俊	实际控制人	担任公司董事长、总经理，通过汇成投资间接控制公司 5.65% 的股份，通过合肥芯成间接控制公司 1.66% 的股份，通过香港宝信间接控制公司 1.87% 的股份，与杨会合计共同控制公司 38.78% 的股份
3	杨会	实际控制人	直接持有公司 3.53% 的股份，通过扬州新瑞连间接控制公司 26.07% 的股份，与郑瑞俊合计共同控制公司 38.78% 的股份

2、控股股东、实际控制人控制的其他企业

序号	关联方名称	关联关系	备注
1	合肥芯成	实际控制人控制的其他企业	郑瑞俊为执行事务合伙人，并持有 37.37% 合伙份额
2	合肥宝芯	实际控制人控制的其他企业	郑瑞俊为执行事务合伙人，并持有 19.32% 合伙份额
3	合肥汇芯	实际控制人控制的其他企业	郑瑞俊为执行事务合伙人，并持有 13.91% 合伙份额
4	香港宝信	实际控制人控制的其他企业	郑瑞俊持股 44.64%，为第一大股东，并担任董事
5	汇成投资	实际控制人控制的其他企业	郑瑞俊持股 70%，并担任董事
6	瑞成投资	实际控制人控制的其他企业	郑瑞俊持股 70%，并担任董事
7	香港瑞仕	实际控制人控制的其他企业	郑瑞俊持股 100%，并担任董事
8	瑞成建筑	实际控制人控制的其他企业	郑瑞俊持股 80%，并担任董事
9	百瑞发投资	实际控制人控制的其他企业	郑瑞俊持股 99.86%，并担任董事长
10	海口三立现代办公设备有限公司	实际控制人控制的其他企业	壹路发房屋中介公司 ^(注) 持股 100%，已于 1993 年 3 月因逾期未年检被吊销，正在办理注销登记手续

注：壹路发房屋中介公司系郑瑞俊曾持股 100% 的台湾公司，已于 1997 年撤销。

3、控股股东、实际控制人担任董事、高级管理人员或施加重大影响的其他企业

序号	关联方名称	关联关系	备注
1	本溪瑞成房地产开发经营有限公司	实际控制人郑瑞俊担任副董事长的企业	已于 2001 年 6 月因逾期未年检被吊销
2	海南巨东房地产开发有限公司	实际控制人郑瑞俊担任副董事长的企业	已于 1999 年 12 月因逾期未年检被吊销
3	江苏越莱萤环保科技有限公司	实际控制人杨会持股 50% 的企业	正在办理注销登记手续

(二) 持有发行人 5% 以上股份的其他股东相关

1、直接或间接持有发行人 5% 以上股份的自然人的自然人

序号	姓名	关联关系	备注
1	纪念	间接持股 5% 以上的其他股东	通过扬州新瑞连间接持有发行人 7.82% 股份
2	杨绍校	间接持股 5% 以上的其他股东	直接持有发行人 1.00% 股份；通过嘉兴高和间接持有发行人 6.29% 股份；通过高投邦盛间接

序号	姓名	关联关系	备注
			持有发行人 0.04% 股份，合计持有发行人 7.33% 股份

2、直接或间接持有发行人 5% 以上股份的法人或其他组织

序号	公司名称	关联关系	备注
1	嘉兴高和	直接持股 5% 以上的其他股东	直接持有发行人 8.98% 股份，杨绍校为执行事务合伙人
2	志道投资	直接持股 5% 以上的其他股东	直接持有发行人 5.99% 股份，赵亚彬担任董事及总经理
3	汇成投资	直接持股 5% 以上的其他股东	直接持有发行人 5.65% 股份，郑瑞俊担任董事
4	正奇控股	间接持股 5% 以上的其他股东	持有志道投资 100% 股权，通过志道投资间接持有发行人 5.99% 股份，赵亚彬担任副总裁
5	联想控股股份有限公司	间接持股 5% 以上的其他股东	持有正奇控股 86.85% 股权，通过正奇控股间接持有发行人 5.20% 股份

3、直接或间接持有发行人 5% 以上股份的自然人直接或者间接控制的，或者担任董事、高级管理人员的法人或其他组织

序号	公司名称	关联关系
1	浙江红太阳毛纺织有限公司	杨绍校担任执行董事
2	浙江茂森置业有限公司	杨绍校持股 10% 并担任董事
3	Deep Blue International Investment Holding Ltd.	杨绍校持股 100% 并担任董事
4	品德国际投资控股（香港）有限公司	杨绍校持股 100% 并担任董事
5	浙江高和羊毛科技有限公司	品德国际投资控股（香港）有限公司持股 100%
6	浙江扳鞍实业发展有限公司	嘉兴高和持股 100%
7	珠海扳鞍资产管理有限公司	浙江扳鞍实业发展有限公司持股 100%
8	扳鞍智慧供应链（嘉兴）有限公司	浙江扳鞍实业发展有限公司持股 100%
9	扳鞍羊毛工业（嘉兴综合保税区）有限公司	扳鞍智慧供应链（嘉兴）有限公司持股 100%
10	浙江阳光普泽融资担保有限公司	浙江扳鞍实业发展有限公司持股 82%
11	桐乡市民间融资服务中心有限公司	浙江扳鞍实业发展有限公司持股 70%
12	浙江扳鞍资产管理有限公司	嘉兴高和持股 83%，杨绍校持股 17%

4、直接持有发行人 5%以上股份的法人或其他组织直接或者间接控制的法人或其他组织

序号	公司名称	关联关系
1	珠海市横琴惟诚股权投资合伙企业（有限合伙）	志道投资担任执行事务合伙人并持有 1.34% 合伙份额
2	安徽嘉润金地企业管理有限公司	志道投资持股 100%
3	合肥泰兴商业运营管理有限公司	安徽嘉润金地企业管理有限公司持股 100%
4	铜陵志道商业运营管理有限公司	安徽嘉润金地企业管理有限公司持股 100%
5	铜陵惟道商业运营管理有限公司	安徽嘉润金地企业管理有限公司持股 100%
6	武汉正奇志道投资有限公司	志道投资持股 100%，赵亚彬担任执行董事及总经理
7	西藏志道企业管理有限公司	志道投资持股 88.67%，赵亚彬担任董事长及总经理
8	安徽惟本投资中心（有限合伙）	志道投资担任执行事务合伙人并持有 10.57% 合伙份额
9	安徽省龙图健康产业投资有限公司	安徽惟本投资中心（有限合伙）持股 80%
10	安徽正乾股权投资合伙企业（有限合伙）	志道投资担任执行事务合伙人并持有 5% 合伙份额
11	安徽惟道投资中心（有限合伙）	志道投资担任执行事务合伙人并持有 3.74% 合伙份额
12	安徽正坤创业投资中心（有限合伙）	志道投资担任执行事务合伙人并持有 1.33% 合伙份额
13	安徽正臻创业投资中心（有限合伙）	志道投资担任执行事务合伙人并持有 1.33% 合伙份额
14	天津正奇壹号产业投资合伙企业（有限合伙）	志道投资担任执行事务合伙人并持有 1% 合伙份额
15	哈尔滨祥冠股权投资中心（有限合伙）	志道投资担任执行事务合伙人并持有 1% 合伙份额

（三）发行人的子公司、联营企业、合营企业

序号	公司名称	关联关系
1	江苏汇成	子公司

（四）发行人董事、监事及高级管理人员

公司董事、监事、高级管理人员的具体情况参见本招股说明书“第五节发行人基本情况”之“九、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员”。

序号	姓名	发行人处任职
1	郑瑞俊	董事长、总经理
2	沈建纬	董事
3	赵亚彬	董事
4	吴海龙	董事
5	杨辉	独立董事
6	程敏	独立董事
7	蔺智挺	独立董事
8	杨欢	监事会主席
9	赵志清	监事
10	程红艳	职工代表监事
11	林文浩	副总经理
12	钟玉玄	副总经理
13	马行天	副总经理
14	施周峰	财务总监、董事会秘书

（五）其他关联方

除上述关联方外，公司关联方还包括上述关联自然人关系密切的家庭成员，包括配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母，及其直接或者间接控制的或者担任董事、高级管理人员的，除公司及其子公司以外的法人或者其他组织。

其中，报告期内曾与公司发生关联交易的关联自然人如下：

序号	姓名	关联关系
1	沈郑秀连	董事沈建纬的配偶

除此之外，截至本招股说明书签署日，公司关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事、高级管理人员的，或者关联自然人投资的且报告期内曾与发行人发生关联交易的法人或其他组织如下：

序号	公司名称	关联关系
1	合肥质然房地产开发有限公司	赵亚彬担任董事的企业
2	正奇（上海）股权投资管理有限公司	赵亚彬担任董事、总经理的企业

3	合肥工大高科信息科技股份有限公司	赵亚彬担任董事的企业
4	安徽新华国金小额贷款有限公司	赵亚彬担任总经理的企业
5	安徽九华山旅游发展股份有限公司	赵亚彬担任董事的企业
6	安徽正奇资产管理有限公司	赵亚彬担任董事、总经理的企业
7	一拓通信集团股份有限公司	赵亚彬担任董事的企业
8	安徽大湖诚文化传媒有限公司	赵亚彬持股 45%，为第一大股东
9	合肥市东芯信息技术有限公司	吴海龙担任董事的企业
10	合肥新站众智创业投资有限公司	吴海龙担任董事的企业
11	合肥产投资本管理有限公司	吴海龙担任董事、副总经理的企业
12	合肥中科环境监测技术国家工程实验室有限公司	吴海龙担任董事长的企业
13	安徽易芯半导体有限公司	吴海龙担任董事的企业
14	安徽省信息产业投资控股有限公司	吴海龙担任董事的企业
15	合肥北航通航产业技术有限公司	吴海龙担任董事的企业
16	沈阳云智科技有限公司	蔺智挺配偶的哥哥姜金竹持股 57%，并担任执行董事
17	北京华拓云智科技有限公司	蔺智挺配偶的哥哥姜金竹持股 80%，并担任执行董事兼经理
18	艾科微电子（深圳）有限公司	马行天的弟弟马行健担任董事的企业
19	杭州热娱文化创意有限公司	施周峰的哥哥施周军担任执行董事、总经理的企业
20	申和正（上海）皮具贸易有限公司	施周峰的哥哥施周军担任董事的企业，该公司已吊销尚未注销

（六）报告期内曾存在的关联方

截至本招股说明书签署日，因发生离职、离任、股份稀释、法人资格注销等情形导致关联关系消除的历史关联方情况如下：

序号	姓名/名称	与发行人的关联关系	报告期内是否存在交易
1	谈林	报告期内曾担任发行人董事，已于 2019 年 6 月离任	否
2	庄子祊	报告期内曾担任发行人财务负责人，已于 2019 年 10 月离职	否
3	萧明山	报告期内曾担任发行人董事、总经理，已于 2020 年 9 月离职	是
4	袁飞	报告期内曾担任发行人董事，已于 2021 年 3 月离任	否
5	郭小鹏	报告期内曾担任发行人董事，已于 2021 年 3 月离任	否

6	杨毅梅	报告期内曾担任发行人监事，已于 2021 年 3 月离任	否
7	Tieer Gu（顾铁）	报告期内曾担任发行人独立董事，已于 2021 年 6 月离任	否
8	合肥创投	报告期内曾持有发行人 5% 以上股权，自 2018 年 11 月起持股比例低于 5%	否
9	扬州嘉慧	报告期内曾持有发行人 5% 以上股权，自 2020 年 1 月起持股比例低于 5%	否
10	Great Title	报告期内曾持有发行人 5% 以上股权，自 2020 年 4 月起持股比例低于 5%	否
11	童富	报告期内童富及其关系密切的家庭成员曾通过 Great Title 持有发行人 5% 以上股权	是
12	Advance	报告期内曾持有发行人 5% 以上股权，自 2020 年 12 月起持股比例低于 5%	否
13	陈玉琴	报告期内陈玉琴及其关系密切的家庭成员曾通过 Advance 持有发行人 5% 以上股权	是
14	张兆文	陈玉琴的配偶	是
15	上海泰菱金属制品有限公司	张兆文控制的企业	是
16	上海汇旌投资有限公司	扬州新瑞连持股 50%，杨会担任执行董事的企业，已于 2018 年 1 月注销	否
17	浙江扳鞍金融服务有限公司	桐乡市民间融资服务中心有限公司持股 70% 的企业，已于 2019 年 9 月注销	否
18	嘉兴弘道股权投资基金合伙企业（有限合伙）	志道投资为执行事务合伙人，并持有 6.67% 合伙份额的企业，已于 2021 年 5 月注销	否
19	珠海市横琴惟信股权投资合伙企业（有限合伙）	志道投资为执行事务合伙人，并持有 5% 合伙份额的企业，已于 2021 年 4 月注销	否
20	正奇（深圳）投资控股有限公司	赵亚彬曾任总经理的企业，已于 2020 年 7 月离任	否
21	安徽省皖煤投资有限责任公司	赵亚彬曾任董事的企业，已于 2020 年 7 月离任	否
22	合肥雪祺电气有限公司	赵亚彬曾任董事的企业，已于 2021 年 4 月离任	否
23	安徽统唯新材料科技股份有限公司	赵亚彬曾任董事的企业，已于 2021 年 4 月离任	否
24	浙江祥邦科技股份有限公司	赵亚彬曾担任董事，已于 2021 年 6 月离任	否
25	合肥智聚晟宝股权投资有限公司	吴海龙曾担任执行董事兼总经理的企业，已于 2020 年 9 月离任	否
26	合肥市国正资产经营有限公司	袁飞曾任董事长的企业，已于 2019 年 7 月离任	是

除上述已披露关联方外，发行人的关联方还包括根据实质重于形式原则认定的其他与发行人有特殊关系，可能导致发行人利益对其倾斜的自然人、法人或其

他组织，以及在交易发生之日前 12 个月内，或相关交易协议生效或安排实施后 12 个月内，具有前述情形之一的法人、其他组织或自然人（视同发行人的关联方）。

十、关联交易情况

报告期内，公司发生的关联交易事项简要汇总如下：

单位：万元

关联方	关联交易内容	2021年 1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
（一）经常性关联交易					
关键管理人员	薪酬	219.92	328.64	356.21	292.63
（二）偶发性关联交易					
郑瑞俊、杨会、扬州新瑞连、瑞成建筑	关联担保	为发行人提供担保			
扬州新瑞连、瑞成建筑、郑瑞俊、杨会、志道投资、张兆文、陈玉琴、上海泰菱金属制品有限公司、浙江阳光普泽融资担保有限公司、沈郑秀连、萧明山、童富、合肥市国正资产经营有限公司	资金拆入	为发行人提供资金支持			
萧明山	无偿赠与	无偿赠与运输工具			
（三）比照关联方交易					
蔚华科技、天虹	采购商品	2,399.05	141.33	1,650.29	2,132.87
天虹	销售商品	-	20.00	-	-
Spirox、Strong Lion、Worth Plus、语音基金、正奇融资租赁（天津）有限公司、安徽正奇融资租赁有限公司、正奇国际商业保理有限公司、黄俏瑜、戴嘉慧、潘进、彭升华	资金拆入	为发行人提供资金支持			
安徽创新融资担保有限公司	融资担保	为发行人提供担保并收取融资担保费用			

（一）经常性关联交易

报告期内，公司的经常性关联交易为关键管理人员薪酬。

单位：万元

名称	2021年1-6月		2020年度		2019年度		2018年度	
	金额	占营业成本比例	金额	占营业成本比例	金额	占营业成本比例	金额	占营业成本比例
关键管理人员薪酬	219.92	0.86%	328.64	0.66%	356.21	0.95%	292.63	1.06%

注：公司股改后聘任的关键管理人员报酬在报告期内连续计算。

报告期内，公司向关键管理人员支付的薪酬分别为 292.63 万元、356.21 万元、328.64 万元和 219.92 万元。

（二）偶发性关联交易

1、关联担保情况

报告期内，汇成股份及江苏汇成发生的关联担保情况如下：

（1）公司作为被担保方的关联担保

报告期内，扬州新瑞连、郑瑞俊、杨会、瑞成建筑等关联方存在为汇成股份及江苏汇成提供担保的情形，具体情况参见本招股说明书“第十三节 附表二：关联担保”之“（一）公司作为被担保方的关联担保”。

（2）公司作为担保方的关联担保

报告期内，公司曾作为担保方为扬州新瑞连支付合肥创投股权转让款事项提供担保，截至本招股说明书签署日，上述担保事项已解除，具体参见本招股说明书“第十三节 附表二：关联担保”之“（二）公司作为担保方的关联担保”。

2、关联方资金拆入

（1）直接进行资金拆入

报告期内，公司向关联方直接进行资金拆入具体情况如下：

单位：万元

拆出方	期初数	本期拆入	本期应计利息	本期减少	本期豁免利息	期末数	说明
2021年1-6月							
扬州新瑞连	1,182.85	1,500.00	36.18	682.85	36.18	2,000.00	注 1
瑞成建筑	1,000.00	-	28.90	300.00	28.90	700.00	注 1

合计	2,182.85	1,500.00	65.08	982.85	65.08	2,700.00	
2020 年度							
扬州新瑞连	10,122.94	3,400.00	484.81	12,340.09	484.81	1,182.85	注 1
郑瑞俊	2,429.33	2,446.14	73.32	4,948.79	-	-	
杨会	136.98	700.00	14.31	851.30	-	-	
瑞成建筑	5,000.00	250.00	260.61	4,250.00	260.61	1,000.00	注 1
志道投资	-	5,500.00	281.87	5,781.87	-	-	注 2
张兆文	2,997.04	-	79.42	3,076.47	-	-	
陈玉琴	532.16	-	24.92	557.08	-	-	
上海泰菱金属制品有限公司	3,314.64	200.00	124.66	3,639.30	-	-	
合计	24,533.10	12,496.14	1,343.93	35,444.89	745.42	2,182.85	
2019 年度							
扬州新瑞连	13,037.74	-	723.40	2,914.80	723.40	10,122.94	注 1
郑瑞俊	7,328.52	5,358.83	336.18	10,594.20	-	2,429.33	
杨会	2,275.93	-	61.06	2,200.00	-	136.98	
瑞成建筑	2,866.81	6,250.00	279.49	4,116.81	279.49	5,000.00	注 1
浙江阳光普泽融资担保有限公司	-	1,500.00	-	1,500.00	-	-	
沈郑秀连	-	100.00	-	100.00	-	-	
萧明山	-	98.00	-	98.00	-	-	
张兆文	2,828.95	-	168.10	-	-	2,997.04	
陈玉琴	502.14	-	30.02	-	-	532.16	
上海泰菱金属制品有限公司	902.19	2,300.00	112.45	-	-	3,314.64	
童富	600.00	500.00	12.48	1,112.48	-	-	
合计	30,342.29	16,106.83	1,723.17	22,636.29	1,002.90	24,533.10	
2018 年度							
扬州新瑞连	-	14,140.00	699.04	1,102.26	699.04	13,037.74	注 1
郑瑞俊	2,389.18	8,327.75	292.74	3,681.14	-	7,328.52	
杨会	594.15	2,700.00	31.77	1,050.00	-	2,275.93	
瑞成建筑	2,076.81	3,213.80	178.82	2,423.80	178.82	2,866.81	注 1
张兆文	-	2,800.00	28.95	-	-	2,828.95	

陈玉琴	-	500.00	2.14	-	-	502.14	
上海三菱金属制品有限公司	-	900.00	2.19	-	-	902.19	
童富	-	600.00	-	-	-	600.00	
合计	5,060.14	33,181.55	1,235.66	8,257.20	877.87	30,342.29	

注 1：豁免的拆借款利息计入资本公积。

注 2：汇成股份向志道投资拆入 5,500 万元，郑瑞俊和杨会为该借款提供连带责任担保。

公司上述资金拆借已经于 2021 年 7 月全部归还，审计基准日后未新增财务内控不规范情形。

（2）委托贷款形式拆入

报告期内，公司通过委托贷款形式拆入资金情况具体如下：

单位：万元

委托方	贷款银行	借款年度	贷款金额
合肥市国正资产经营有限公司	华夏银行股份有限公司 合肥高新区支行	2017 年度	3,000.00
		2018 年度	6,000.00
		2019 年度	3,000.00
		2020 年度	8,000.00
		2021 年度	8,000.00
	合肥科技农村商业银行 股份有限公司	2018 年度	4,000.00
		2019 年度	3,000.00
安徽新安银行股份有限公司	2019 年度	3,000.00	
合计			38,000.00

合肥市国正资产经营有限公司系合肥市国资委下属公司，公司出于日常经营资金需求与其签订委托贷款合同，合肥市国正资产经营有限公司通过委托贷款方式向本公司提供借款。

3、无偿赠与

2020 年度，公司原董事、总经理萧明山因个人精力有限辞去公司职务。为答谢其对公司的贡献，公司无偿赠与其一辆汽车。

（三）关联方应付款项余额

报告期各期末，公司对关联方应付款项情况如下：

单位：万元

项目名称	关联方	2021.6.30	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
应付账款	瑞成建筑	-	-	-	3,530.45
合计	-	-	-	-	3,530.45
其他应付款	扬州新瑞连	2,000.00	1,182.85	10,122.94	13,037.74
	郑瑞俊	-	-	2,429.33	7,328.52
	杨会	-	-	136.98	2,275.93
	瑞成建筑	700.00	1,000.00	5,000.00	2,866.81
	合肥芯成	-	-	164.65	-
	张兆文	-	-	2,997.04	2,828.95
	陈玉琴	-	-	532.16	502.14
	上海泰菱金属制品有限公司	-	-	3,314.64	902.19
	童富	-	-	-	600.00
合计	-	2,700.00	2,182.85	24,697.75	30,342.29

注：合肥芯成系员工持股平台，2019年末，公司应付合肥芯成期末余额为164.65万元，根据持股平台实际股权登记情况，公司已于2020年度向合肥芯成归还上述差额增资款项。

瑞成建筑主营建筑装饰等服务，报告期前瑞成建筑曾为公司提供建筑工程服务。截至2018年末，公司尚欠瑞成建筑工程款3,530.45万元，上述工程款已于2019年度归还完毕。

其他应付款中，公司应付款项主要系资金拆借形成，截至本招股说明书签署日，上述其他应付款均已归还完毕。

（四）比照关联交易披露的交易

1、交易对方情况

序号	公司名称	与本公司关系
1	蔚华电子	持有公司2.55%股份的股东
2	Spirox	蔚华电子之母公司
3	蔚华科技	Spirox之母公司

4	蔚华国际有限公司	蔚华电子之关联公司
5	鑫天虹	郑瑞俊控制的香港瑞仕持股 10%的企业
6	传晶电子（上海）有限公司	鑫天虹的全资子公司
7	天虹科技	郑瑞俊直接持股 10.69%，其控制的百瑞发投资持股 0.87%的企业，与鑫天虹系受同一控制下的企业
8	Strong Lion	持有公司 0.15%股份的股东
9	Worth Plus	持有公司 3.65%股份的股东
10	语音基金	持有公司 1.00%股份的股东
11	正奇融资租赁（天津）有限公司	持股 5%以上股东志道投资的关联公司
12	安徽正奇融资租赁有限公司	持股 5%以上股东志道投资的关联公司
13	正奇国际商业保理有限公司	持股 5%以上股东志道投资的关联公司
14	安徽创新融资担保有限公司	持股 5%以上股东志道投资的关联公司
15	黄俏瑜	通过股东扬州耕天下间接持有公司股份
16	戴嘉慧	通过股东上海享堃间接持有公司股份
17	潘进	通过股东扬州和安间接持有公司股份
18	彭升华	通过股东华得富间接持有公司股份

2、采购商品

单位：万元

公司名称	交易内容	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
蔚华	设备	2,367.37	97.74	1,584.43	775.36
	材料及费用	-	-	0.20	5.52
天虹	设备	-	-	-	1,344.66
	材料及费用	31.68	43.59	65.66	7.33
合计	-	2,399.05	141.33	1,650.29	2,132.87

注：上表中，按照同一控制下合并口径披露，蔚华包括蔚华科技股份有限公司、蔚华电子科技（上海）有限公司和蔚华国际有限公司；天虹包括天虹科技股份有限公司、鑫天虹（厦门）科技有限公司和传晶电子（上海）有限公司。

（1）蔚华科技系中国台湾上市公司，系专业集成电路设备代理商。报告期内，受限于全球及中国集成电路行业的发展情况，公司直接向境外的集成电路设备厂商购置设备需有较长的交期，蔚华科技作为专业的集成电路设备代理商，拥有丰富的集成电路设备渠道资源，可提高公司的设备采购效率。上述交易价格系双方根据市场公允价格协商确定。

（2）天虹科技、鑫天虹系集成电路设备制造商。报告期内，公司曾向天虹科技、鑫天虹采购物理气象沉积设备、零星配件等。上述采购价格系双方根据市场公允价格协商确定。

3、销售设备

2020 年度，公司因机器设备更新换代，向天虹科技出售了个别二手设备。双方根据公允价值约定交易价格 20 万元。

4、比照关联方资金拆入

报告期内，公司向比照关联方拆借资金具体情况如下：

单位：万元

拆借单位名称/自然人姓名	期初数	本期拆入	本期应计利息	本期减少	本期豁免利息	期末数	说明
2021 年 1-6 月							
Spirox	99.81	-	-	99.81	-	-	
Strong Lion	35.62	-	-	35.62	-	-	
合计	135.43	-	-	135.43	-	-	
2020 年度							
Spirox	8,599.81	-	-	8,500.00	-	99.81	
Strong Lion	1,014.78	-	20.84	1,000.00	-	35.62	
Worth Plus	1,031.16	-	-	1,000.00	31.16	-	注 1
语音基金	4,134.44	-	372.22	4,000.00	506.67	-	注 2
正奇融资租赁（天津）有限公司	22,595.83	-	17.14	22,612.98	-	-	
安徽正奇融资租赁有限公司	-	44,000.00	600.00	44,600.00	-	-	
正奇国际商业保理有限公司	-	3,000.00	95.00	3,095.00	-	-	注 3
黄俏瑜	840.09	500.00	15.07	1,355.16	-	-	
合计	38,216.11	47,500.00	1,120.28	86,163.13	537.82	135.43	
2019 年度							
Spirox	-	8,500.00	163.91	64.10	-	8,599.81	注 4
Strong Lion	-	1,000.00	26.56	11.78	-	1,014.78	注 4
Worth Plus	-	1,000.00	43.45	12.30	-	1,031.16	注 4

语音基金	-	4,000.00	134.44	-	-	4,134.44	注 5
正奇融资租赁（天津）有限公司	-	22,000.00	595.83	-	-	22,595.83	
黄俏瑜	3,288.25	3,800.00	151.84	6,400.00	-	840.09	
戴嘉慧	188.80	-	1.33	190.13	-	-	
潘进	21.53	-	-	21.53	-	-	
合计	3,498.58	40,300.00	1,117.37	6,699.84	-	38,216.11	
2018 年度							
黄俏瑜	2,529.85	1,400.00	158.40	800.00	-	3,288.25	
戴嘉慧	649.50	-	39.30	500.00	-	188.80	
潘进	1,044.66	-	22.99	1,046.12	-	21.53	
彭升华	-	400.00	-	400.00	-	-	
合计	4,224.01	1,800.00	220.69	2,746.12	-	3,498.58	

注 1：豁免的拆借款利息计入资本公积。

注 2：豁免的拆借款利息计入资本公积，本期减少的 4,000 万元实际系债转股转入实收资本和资本公积。

注 3：江苏汇成向正奇国际商业保理有限公司拆入 3,000 万元，郑瑞俊和杨会为该借款提供连带责任担保。

注 4：扬州新瑞连和郑瑞俊为该等借款提供连带责任担保，江苏汇成设备提供抵押担保。

注 5：汇成股份向语音基金拆入 4,000 万元，郑瑞俊和杨会为该借款提供连带责任担保。

5、融资担保

报告期内，安徽创新融资担保有限公司为发行人取得银行借款提供融资担保。2020 年与 2021 年 1-6 月，公司分别向安徽创新融资担保有限公司支付了融资担保手续费 140.00 万元、140.00 万元。

（五）关联交易对发行人财务状况和经营成果的影响

报告期内，公司关联交易主要集中于资金拆借、关联担保层面，主要系报告期在陆续引入外部股东之前，面临企业融资难、企业生产销售规模尚处于起步阶段等问题。发行人为维持公司的正常生产、研发以及保证前期借款的持续滚动，与关联方之间发生了频繁且数额较大的资金拆借和往来，围绕着融资产生了实际控制人等为发行人进行关联担保的情形。公司与关联方产生的交易具备必要性与合理性，不存在损害公司及其他股东利益的情形，对公司的财务状况和经营成果无重大不利影响。

十一、对关联交易决策权力与程序的制度安排

公司现行的《公司章程》对规范和减少关联交易进行了制度性的安排，对关联交易决策权力与程序作出了明确规定，对关联股东或有利益冲突的董事在关联交易表决中的回避或做必要的公允声明均有规定，对关联交易的回避要求、表决程序等进行了详细的制度性安排，以保证关联交易的公允，保护本公司及中小股东的利益不受侵害。

十二、报告期内关联交易决策程序的执行情况及独立董事对报告期内关联交易发表的意见

股份公司设立以来，公司关联交易履行了《公司章程》规定的程序。报告期内已发生关联交易的审议程序如下：

2021年9月18日，发行人召开第一届董事会第四次会议，审议通过了《关于确认公司报告期内关联交易事项的议案》，关联董事在董事会审议该议案时回避表决，并同意将其提交发行人股东大会审议。

2021年10月8日，发行人召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于确认公司报告期内关联交易事项的议案》，关联股东在股东大会审议该议案时回避表决。

发行人全体独立董事就上述关联交易事项发表了独立意见，认为：报告期内，公司与关联方发生的关联交易系公司正常生产经营活动所需，交易遵循公平、公正、公允的市场原则，没有对公司财务状况和经营成果产生不利影响，没有损害公司及非关联股东的利益。

十三、规范和减少关联交易的措施

公司在业务发展过程中将首先考虑业务的独立性，尽量减少关联交易的发生，对于不可避免的关联交易，公司将严格按照相关制度规定的程序规范操作。

公司已建立独立董事制度，有利于公司保证董事会的独立性和完善公司治理机制，公司的独立董事将在避免同业竞争、规范和减少关联交易方面发挥重要作用。

用。

公司控股股东扬州新瑞连及实际控制人郑瑞俊、杨会已分别出具关于规范和减少关联交易的承诺，具体内容参见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“六、本次发行相关主体作出的重要承诺”之“（十一）其他承诺事项”之“2、关于规范和减少关联交易的承诺”。

第八节 财务会计信息与管理层分析

本节财务会计数据及相关财务信息非经特别说明均依据经注册会计师审计的财务报表及其附注得出。除另有注明外，公司财务数据和财务指标等均以合并报表的数据为基础进行计算。本节的财务会计数据及有关说明反映了公司报告期内经审计财务报表及附注的主要内容，公司提醒投资者关注财务报告和审计报告全文，以获取全部的财务资料。

一、注册会计师审计意见

天健会计师作为公司本次发行的审计机构，对本公司 2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日及 2021 年 6 月 30 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年 1-6 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并出具了天健审〔2021〕10318 号标准无保留意见审计报告。

天健会计师认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日及 2021 年 6 月 30 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年 1-6 月的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、经审计的财务报表

（一）合并财务报表

1、合并资产负债表

单位：元

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：				
货币资金	27,850,473.91	49,516,796.11	27,441,468.76	5,756,087.84
应收票据	-	361,494.47	-	-
应收账款	155,705,917.05	155,017,424.23	87,659,366.30	50,449,835.34
应收款项融资	-	-	361,020.00	-
预付款项	4,038,021.85	12,979,364.37	1,573,227.40	2,759,743.19

其他应收款	1,751,671.86	481,743.86	1,515,261.00	835,643.22
存货	153,246,778.84	124,390,509.00	141,764,880.92	102,628,176.08
其他流动资产	66,114,097.49	59,816,088.29	69,255,043.39	71,693,619.76
流动资产合计	408,706,961.00	402,563,420.33	329,570,267.77	234,123,105.43
非流动资产：				
长期应收款	-	3,998,685.33	3,586,360.75	-
固定资产	1,353,487,976.19	1,197,802,575.72	1,026,299,372.62	732,248,041.93
在建工程	39,716,485.03	25,881,579.03	134,618,907.89	111,715,369.00
无形资产	17,872,092.75	18,996,661.21	20,178,941.98	19,564,724.81
其他非流动资产	11,922,770.61	100,663,427.13	37,644,922.00	88,527,776.07
非流动资产合计	1,422,999,324.58	1,347,342,928.42	1,222,328,505.24	952,055,911.81
资产总计	1,831,706,285.58	1,749,906,348.75	1,551,898,773.01	1,186,179,017.24
流动负债：				
短期借款	202,540,111.33	119,783,883.74	133,305,456.11	151,301,220.00
应付账款	75,357,577.57	53,306,011.66	106,880,307.50	101,450,852.10
预收款项	-	-	549,384.59	5,386,693.54
合同负债	517,333.15	465,615.31	-	-
应付职工薪酬	9,422,564.51	9,846,985.34	13,085,710.46	10,247,482.39
应交税费	748,343.79	975,106.01	853,111.53	803,804.49
其他应付款	28,654,962.76	24,095,500.98	714,532,219.98	431,913,133.53
一年内到期的非流动负债	26,125,388.00	55,979,214.41	131,701,711.90	17,000,000.00
其他流动负债	-	362,499.51	-	-
流动负债合计	343,366,281.11	264,814,816.96	1,100,907,902.07	718,103,186.05
非流动负债：				
长期借款	79,142,248.46	234,868,298.41	206,855,904.81	233,000,000.00
长期应付款	-	4,448,884.41	18,359,214.66	-
递延收益	102,239,132.64	103,303,439.61	26,856,762.69	10,802,354.23
非流动负债合计	181,381,381.10	342,620,622.43	252,071,882.16	243,802,354.23
负债合计	524,747,662.21	607,435,439.39	1,352,979,784.23	961,905,540.28
股东权益：				
股本	667,882,625.00	648,882,624.40	443,686,849.08	401,640,200.00
资本公积	932,245,311.73	1,145,980,150.80	403,618,981.33	306,990,631.79

其他综合收益	-	-	-	-
盈余公积	-	-	-	-
未分配利润	-293,169,313.36	-652,391,865.84	-648,386,841.63	-484,357,354.83
归属于母公司股东权益合计	1,306,958,623.37	1,142,470,909.36	198,918,988.78	224,273,476.96
股东权益合计	1,306,958,623.37	1,142,470,909.36	198,918,988.78	224,273,476.96
负债和所有者权益总计	1,831,706,285.58	1,749,906,348.75	1,551,898,773.01	1,186,179,017.24

2、合并利润表

单位：元

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
一、营业收入	358,759,023.20	618,926,702.71	394,206,603.32	285,583,481.91
二、营业总成本	301,202,041.36	640,784,105.21	559,101,560.43	376,240,438.73
其中：营业成本	256,604,568.95	498,798,642.77	374,857,837.35	275,105,861.24
税金及附加	1,157,153.67	2,374,103.01	2,202,254.85	2,181,902.97
销售费用	2,750,630.37	3,130,246.99	12,891,987.89	7,501,555.58
管理费用	18,550,598.22	39,333,827.93	53,875,546.61	31,736,105.97
研发费用	28,989,543.75	47,152,121.03	45,426,425.01	37,872,701.10
财务费用	-6,850,453.60	49,995,163.48	69,847,508.72	21,842,311.87
其中：利息费用	-8,486,821.20	39,831,889.19	65,440,581.40	24,756,453.61
利息收入	663,285.54	487,242.89	400,014.98	42,639.84
加：其他收益	7,873,663.46	24,990,190.98	5,882,142.53	2,407,517.54
投资收益（损失以“-”号填列）	-57,369.44	-	-	-
其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-57,369.44	-	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-120,822.59	-3,768,408.61	-1,982,729.32	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,372,345.43	-2,490,988.48	-4,879,693.02	-18,799,226.56
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-102,586.56	-1,065,884.83	1,778,050.62	15,743.24
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	58,777,521.28	-4,192,493.44	-164,097,186.30	-107,032,922.60
加：营业外收入	40,409.26	271,158.51	89,681.36	124,967.35
减：营业外支出	12.26	83,689.28	21,981.86	172,259.32

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	58,817,918.28	-4,005,024.21	-164,029,486.80	-107,080,214.57
减：所得税费用	-	-	-	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	58,817,918.28	-4,005,024.21	-164,029,486.80	-107,080,214.57
持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	58,817,918.28	-4,005,024.21	-164,029,486.80	-107,080,214.57
归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	58,817,918.28	-4,005,024.21	-164,029,486.80	-107,080,214.57
少数股东损益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
七、综合收益总额	58,817,918.28	-4,005,024.21	-164,029,486.80	-107,080,214.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	58,817,918.28	-4,005,024.21	-164,029,486.80	-107,080,214.57
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-	-
八、每股收益				
基本每股收益	0.09	/	/	/
稀释每股收益	0.09	/	/	/

3、合并现金流量表

单位：元

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量				
销售商品、提供劳务收到的现金	358,726,207.08	557,513,901.52	354,201,815.60	283,489,331.97
收到的税费返还	5,093,497.49	19,068,499.73	11,976,512.30	16,908,449.61
收到其他与经营活动有关的现金	28,070,846.16	41,176,742.16	26,326,183.33	20,249,509.10
经营活动现金流入小计	391,890,550.73	617,759,143.41	392,504,511.23	320,647,290.68
购买商品、接受劳务支付的现金	192,030,848.76	348,421,538.25	265,270,018.53	213,769,610.03
支付给职工以及为职工支付的现金	55,051,567.96	99,500,004.61	121,509,139.81	98,591,725.20
支付的各项税费	1,440,946.34	2,381,483.10	2,293,765.51	1,894,236.50

支付其他与经营活动有关的现金	8,792,843.62	16,366,114.99	25,820,630.99	21,986,736.61
经营活动现金流出小计	257,316,206.68	466,669,140.95	414,893,554.84	336,242,308.34
经营活动产生的现金流量净额	134,574,344.05	151,090,002.46	-22,389,043.61	-15,595,017.66
二、投资活动产生的现金流量				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,800,426.90	3,103,061.89	7,051,834.46	3,986.35
取得投资收益收到的现金	-	-	-	-
投资活动现金流入小计	3,800,426.90	3,103,061.89	7,051,834.46	3,986.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	146,963,668.09	319,271,266.99	373,173,227.60	364,029,039.12
投资支付的现金	-	-	-	-
投资活动现金流出小计	146,963,668.09	319,271,266.99	373,173,227.60	364,029,039.12
投资活动产生的现金流量净额	-143,163,241.19	-316,168,205.10	-366,121,393.14	-364,025,052.77
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金	99,952,836.87	888,872,251.03	105,646,028.78	-
取得借款收到的现金	202,458,056.92	305,944,229.17	414,007,941.72	343,271,464.80
收到其他与筹资活动有关的现金	18,250,000.00	609,961,400.00	646,627,100.00	366,815,490.00
筹资活动现金流入小计	320,660,893.79	1,804,777,880.20	1,166,281,070.50	710,086,954.80
偿还债务支付的现金	280,268,429.94	377,217,802.29	358,408,046.92	204,796,911.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,424,263.35	30,605,009.90	33,950,433.90	16,018,113.78
支付其他与筹资活动有关的现金	54,043,864.64	1,204,095,337.68	358,179,854.75	117,361,480.38
筹资活动现金流出小计	344,736,557.93	1,611,918,149.87	750,538,335.57	338,176,505.56
筹资活动产生的现金流量净额	-24,075,664.14	192,859,730.33	415,742,734.93	371,910,449.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,602,527.32	-5,407,734.21	-4,044,792.34	5,080,170.58
五、现金及现金等价物净增加额	-34,267,088.60	22,373,793.48	23,187,505.84	-2,629,450.61
加：期初现金及现金等价物余额	49,011,075.94	26,637,282.46	3,449,776.62	6,079,227.23

六、期末现金及现金等价物余额	14,743,987.34	49,011,075.94	26,637,282.46	3,449,776.62
----------------	---------------	---------------	---------------	--------------

（二）母公司财务报表

1、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年6月30日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：				
货币资金	21,208,092.12	28,717,036.03	20,023,197.33	815,616.18
应收票据	-	210,242.90	-	-
应收账款	106,498,147.23	78,524,067.28	35,067,044.15	13,054,117.43
应收款项融资	-	-	361,020.00	-
预付款项	2,990,840.17	2,731,206.91	276,751.57	1,045,939.16
其他应收款	440,496,452.92	445,764,234.23	379,821,206.50	317,764,359.82
存货	80,915,003.45	66,981,960.80	75,436,008.60	35,204,445.07
其他流动资产	4,159,631.88	2,846,676.85	1,243,866.98	182,812.33
流动资产合计	656,268,167.77	625,775,425.00	512,229,095.13	368,067,289.99
非流动资产：				
长期应收款	-	3,998,685.33	3,586,360.75	-
长期股权投资	280,176,413.10	277,219,216.39	276,715,200.00	261,640,200.00
固定资产	1,051,313,127.12	906,899,766.67	692,381,484.91	354,655,112.70
在建工程	32,437,281.01	25,881,579.03	134,618,907.89	111,715,369.00
无形资产	11,523,597.78	12,252,160.74	12,931,425.34	12,970,505.22
其他非流动资产	9,527,860.68	91,538,724.66	37,582,860.70	85,497,660.30
非流动资产合计	1,384,978,279.69	1,317,790,132.82	1,157,816,239.59	826,478,847.22
资产总计	2,041,246,447.46	1,943,565,557.82	1,670,045,334.72	1,194,546,137.21
流动负债：				
短期借款	184,714,656.98	90,756,555.54	110,369,722.22	110,000,000.00
应付账款	60,769,703.42	40,777,683.49	92,698,453.36	82,176,315.78
预收款项	-	-	47,183.72	1,088,110.40
合同负债	455,081.54	414,842.63	-	-
应付职工薪酬	5,706,751.99	5,972,859.87	7,670,380.86	4,236,169.23
应交税费	490,064.79	722,199.86	601,913.47	534,745.56

其他应付款	27,283,400.31	23,337,866.82	627,959,817.62	271,688,313.60
一年内到期的非流动负债	26,125,388.00	43,455,629.34	122,684,730.65	17,000,000.00
其他流动负债	-	210,242.90	-	-
流动负债合计	305,545,047.03	205,647,880.45	962,032,201.90	486,723,654.57
非流动负债：				
长期借款	79,142,248.46	227,353,975.84	186,817,997.17	233,000,000.00
长期应付款	-	4,448,884.41	18,359,214.66	-
递延收益	99,226,602.27	101,032,741.13	25,296,949.25	10,141,243.12
非流动负债合计	178,368,850.73	332,835,601.38	230,474,161.08	243,141,243.12
负债合计	483,913,897.76	538,483,481.83	1,192,506,362.98	729,864,897.69
股东权益：				
股本	667,882,625.00	648,882,624.40	443,686,849.08	401,640,200.00
资本公积	839,876,826.81	1,053,611,665.88	314,773,363.08	218,203,777.43
其他综合收益	-	-	-	-
盈余公积	-	-	-	-
未分配利润	49,573,097.89	-297,412,214.29	-280,921,240.42	-155,162,737.91
股东权益合计	1,557,332,549.70	1,405,082,075.99	477,538,971.74	464,681,239.52
负债和所有者权益总计	2,041,246,447.46	1,943,565,557.82	1,670,045,334.72	1,194,546,137.21

2、母公司利润表

单位：元

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
一、营业收入	209,565,677.73	299,356,344.29	113,492,829.21	26,492,219.68
二、营业总成本	168,944,911.25	334,769,628.03	240,255,990.88	101,197,168.41
其中：营业成本	145,637,597.90	244,325,081.91	127,482,807.12	50,921,809.44
税金及附加	644,960.01	1,369,682.36	1,101,844.71	1,142,796.56
销售费用	1,453,030.98	2,027,072.78	2,729,918.02	785,826.95
管理费用	10,602,502.46	20,342,941.18	25,965,023.15	14,317,132.36
研发费用	19,004,232.48	27,588,626.02	23,797,076.39	17,684,266.31
财务费用	-8,397,412.58	39,116,223.78	59,179,321.49	16,345,336.79
其中：利息费用	-9,712,135.05	33,286,369.25	54,939,664.96	18,677,857.40
利息收入	637,322.00	471,754.73	381,019.69	25,088.30

加：其他收益	6,984,624.44	22,903,253.74	4,019,031.70	1,040,827.65
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,135,622.48	-2,701,572.11	-1,247,704.21	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,176,829.97	-1,315,244.54	-3,095,714.13	-15,052,804.96
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,249,237.33	-4,134.51	1,314,897.87	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	46,542,175.80	-16,530,981.16	-125,772,650.44	-88,716,926.04
加：营业外收入	38,514.44	123,696.57	21,122.49	5,882.00
减：营业外支出	12.26	83,689.28	6,974.56	12,196.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	46,580,677.98	-16,490,973.87	-125,758,502.51	-88,723,240.94
减：所得税费用	-	-	-	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46,580,677.98	-16,490,973.87	-125,758,502.51	-88,723,240.94
持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	46,580,677.98	-16,490,973.87	-125,758,502.51	-88,723,240.94
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
七、综合收益总额	46,580,677.98	-16,490,973.87	-125,758,502.51	-88,723,240.94

3、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量				
销售商品、提供劳务收到的现金	187,292,284.93	248,959,190.01	84,497,745.79	20,947,179.63
收到的税费返还	1,190,199.36	2,188,379.87	1,383,617.95	940,910.20
收到其他与经营活动有关的现金	25,339,474.76	38,026,780.54	21,661,661.69	17,613,041.07
经营活动现金流入小计	213,821,959.05	289,174,350.42	107,543,025.43	39,501,130.90
购买商品、接受劳务支付的现金	92,996,685.84	137,586,242.17	85,698,952.86	51,910,667.82

支付给职工以及为职工支付的现金	32,428,556.16	55,558,341.87	55,472,543.24	33,349,010.48
支付的各项税费	926,045.18	1,353,171.94	1,170,721.55	833,672.20
支付其他与经营活动有关的现金	4,543,754.30	8,435,905.55	11,378,489.53	7,595,622.77
经营活动现金流出小计	130,895,041.48	202,933,661.53	153,720,707.18	93,688,973.27
经营活动产生的现金流量净额	82,926,917.57	86,240,688.89	-46,177,681.75	-54,187,842.37
二、投资活动产生的现金流量				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,383,434.41	12,411,830.12	16,400,379.86	98,690.08
收到其他与投资活动有关的现金	6,546,794.81	-	-	57,101,326.36
投资活动现金流入小计	17,930,229.22	12,411,830.12	16,400,379.86	57,200,016.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	128,058,420.45	310,325,455.19	374,693,052.56	284,033,841.65
支付其他与投资活动有关的现金	-	66,789,115.09	61,469,048.13	-
投资活动现金流出小计	128,058,420.45	377,114,570.28	436,162,100.69	284,033,841.65
投资活动产生的现金流量净额	-110,128,191.23	-364,702,740.16	-419,761,720.83	-226,833,825.21
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金	99,952,836.87	888,872,251.03	105,646,028.78	-
取得借款收到的现金	184,491,260.00	260,000,000.00	282,000,000.00	232,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	18,250,000.00	558,461,400.00	514,088,300.00	170,077,490.00
筹资活动现金流入小计	302,694,096.87	1,707,333,651.03	901,734,328.78	402,077,490.00
偿还债务支付的现金	231,500,000.00	328,500,000.00	237,000,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,207,753.29	27,949,285.58	30,865,177.81	14,066,131.24
支付其他与筹资活动有关的现金	54,043,864.64	1,062,477,723.30	145,037,158.79	28,988,312.00
筹资活动现金流出小计	294,751,617.93	1,418,927,008.88	412,902,336.60	123,054,443.24
筹资活动产生的现金流量净额	7,942,478.94	288,406,642.15	488,831,992.18	279,023,046.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-850,149.19	-950,752.18	-3,985,008.45	2,734,330.30

五、现金及现金等价物净增加额	-20,108,943.91	8,993,838.70	18,907,581.15	735,709.48
加：期初现金及现金等价物余额	28,717,036.03	19,723,197.33	815,616.18	79,906.70
六、期末现金及现金等价物余额	8,608,092.12	28,717,036.03	19,723,197.33	815,616.18

三、财务报表的编制基础

（一）编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定，以及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

（二）持续经营能力评价

公司不存在可能导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

（三）合并财务报表编制方法、范围及变化情况

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。报告期内，公司合并财务报表的合并范围包括公司及子公司江苏汇成光电有限公司。

四、重要性水平及关键审计事项

（一）重要性水平

公司在本节披露的与财务会计信息相关的重大事项标准为当年营业收入金额的0.5%，或者虽未达到当年营业收入金额的0.5%，但公司认为较为重要的相关事项。

（二）关键审计事项

天健会计师在审计过程中识别出的关键审计事项如下：

1、收入确认

（1）相关会计年度：自 2020 年度起

公司的营业收入主要来自于为客户提供集成电路封装测试服务。2020 年度和 2021 年 1-6 月，公司营业收入分别为 61,892.67 万元和 35,875.90 万元，其中封装测试服务业务收入分别为 57,504.79 万元和 34,987.81 万元。

公司收入确认具体方法参见本节之“六、报告期内采用的重要会计政策和会计估计”之“（一）收入确认的具体原则”之“1、2020 年度起适用”。

（2）相关会计年度：2018 年度、2019 年度。

2018 年度和 2019 年度，公司营业收入分别为 28,558.35 万元和 39,420.66 万元，其中封装测试服务业务收入分别为 26,796.12 万元和 37,001.73 万元。

公司收入确认具体方法参见本节之“六、报告期内采用的重要会计政策和会计估计”之“（一）收入确认的具体原则”之“2、2018 年度和 2019 年度适用”。

由于营业收入是公司关键业绩指标之一，可能存在管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，天健会计师将收入确认确定为关键审计事项。

针对上述收入确认事项，天健会计师实施的审计程序主要包括：

（1）了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

（2）测试信息系统一般控制、与收入确认流程相关的应用控制；

（3）检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；

（4）对营业收入及毛利率按月度、产品、客户等实施分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

（5）对于境内收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、出库单、销售发票及物流签收单等；对于境外收入，获取电子

口岸信息并与账面记录核对，并以抽样方式检查销售合同、订单、出库单、销售发票、出口报关单据、货运提单等支持性文件；

（6）结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证报告期销售额；

（7）对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试，评价营业收入是否在恰当期间确认；

（8）对主要客户进行实地走访或视频访谈；

（9）检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

2、固定资产账面价值确定

相关会计年度：2018 年度、2019 年度、2020 年度、2021 年 1-6 月。

截至报告期各期末，公司固定资产账面价值分别为 73,224.80 万元、102,629.94 万元、119,780.26 万元和 135,348.80 万元，占资产总额的比例分别为 61.73%、66.13%、68.45% 和 73.89%。

管理层对确定在建工程转入固定资产和开始计提折旧的时点、估计相应固定资产的经济可使用年限及残值等方面的判断，会对固定资产的账面价值确定造成影响。

由于确认固定资产的账面价值涉及重大的管理层判断，且其对财务报表具有重要性，天健会计师将公司固定资产账面价值确定识别为关键审计事项。

针对固定资产账面价值的确定，天健会计师实施的审计程序主要包括：

（1）了解与固定资产确认相关的关键内部控制（包括估计经济可使用年限及残值等），评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

（2）基于天健会计师对同行业做法的了解，评价管理层对固定资产的经济可使用年限及残值的估计；

（3）通过核对固定资产采购合同、发票等资料，抽查测试其入账价值及会计处理是否正确；抽查固定资产验收单据，分析在建工程转入固定资产的时点是

否异常；

（4）复核折旧费用的计提与分配是否正确；

（5）对固定资产进行监盘；

（6）检查与固定资产相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

五、发行人产品特点、业务模式、行业竞争程度、外部市场环境等因素及其变化趋势情况,及对未来盈利能力或财务状况可能产生的影响

（一）产品特点的影响

公司是集成电路高端先进封装测试服务商，目前聚焦于显示驱动芯片领域，主营业务以前段金凸块制造为核心，形成显示驱动芯片全制程封装测试综合服务能力。金凸块制造技术是影响显示驱动芯片封测厂商发展的最大瓶颈，公司在凸块制造技术方面深耕多年，拥有较为先进、完整的技术框架，并通过对凸块制造技术持续的研究、优化和创新，制造出了微间距、细宽度、高可靠的金凸块，达到行业领先水平。

随着集成电路封装测试技术的不断演进，对凸块制造技术的指标要求也在提高。公司未来的财务状况和经营成果，一定程度上取决于公司凸块制造技术的先进性，这对公司继续保持充足的研发投入、并在新产品、新指标持续突破上提出了较高的要求。

（二）业务模式的影响

公司采用集成电路封装测试行业惯用的 OSAT 模式，在该模式下，公司根据客户需求，通过工艺设计，利用封装测试设备，自行购买封装测试原辅料，对客户提供的晶圆进行金凸块制造、晶圆测试、研磨、切割、封装等一系列的定制化精密加工及成品测试服务。公司系根据所提供服务的收取加工服务费的方式以获取收入和利润。

公司所处行业属于资金密集型行业，需要较大规模的资金进行设备投入，存在一定的资金门槛，且显示驱动芯片的封装测试厂商往往需要经过芯片设计公司较长时间的工艺认可，而后才能达成长期合作意向，故存在较高的供应链门槛。

公司的前段金凸块制造工序复杂，因此一旦通过工艺认可并进入量产阶段，较难被其他新进入者取代。公司已经与联咏科技、天钰科技、瑞鼎科技、奇景光电、晶门半导体等行业内知名芯片设计公司建立了稳定的合作关系，具有较强的客户资源优势，确保了公司在行业内的领先地位。

（三）行业竞争程度的影响

公司是中国境内最早具备金凸块制造能力，及最早导入 12 吋晶圆金凸块产线并实现量产的显示驱动芯片先进封测企业之一，具备 8 吋及 12 吋晶圆全制程封装测试能力。公司在显示驱动芯片封装测试行业中的竞争对手主要包括中国台湾上市公司颀邦科技、南茂科技以及颀中科技、通富微电等。

近年来，集成电路封装测试行业竞争日趋激烈，尤其是高端封测领域资本不断涌入。一方面，国内封测行业龙头企业通过新建生产线、升级改造技术和产品以及对外收购等手段不断扩充产能，提升产品质量和技术水平，若上述行业龙头企业进军显示驱动芯片封测领域，公司业务将受到一定冲击。另一方面，外资与合资封装测试企业进一步布局中国境内市场，若其涉足显示驱动芯片封测领域，将加大行业竞争程度。

（四）外部市场环境的影响

自 2010 年起，我国持续出台集成电路相关产业政策，将其列为国家重点战略产业，对集成电路企业在税收、人才、技术等多方面提供支持，在此政策红利下，我国集成电路企业逐渐转亏为盈并发展壮大，国际地位也有所提升，产能逐渐向中国大陆转移，公司的业务是面向国家重大需求，符合国家战略发展方向的。现阶段，随着全球集成电路产业链分工的逐步细化，我国集成电路产业经历了低端制造承接、长期技术引进、高端人才培育等产业发展环节，目前在集成电路的封装测试细分行业内已位居全球领先地位。未来伴随中国大陆芯片设计业和晶圆制造业的逐步崛起，下游封装测试产业有望持续受益。

六、报告期内采用的重要会计政策和会计估计

天健审〔2021〕10318 号审计报告详细列示了发行人主要会计政策和会计估计，报告期内发行人采用的重要会计政策和会计估计情况如下：

（一）收入确认的具体原则

1、2020 年度起适用

公司集成电路封装测试属于在某一时点履行的履约义务，具体的收入确认时点如下：

境内销售以商品发运并取得客户或其指定的其他方确认时确认收入；

境外销售以商品发出后，根据不同的贸易方式确定相应的收入确认时点：

①在 FOB、CIF、CIP 贸易模式下，公司将货物交付运输公司并完成报关手续后，货物的主要风险报酬和控制权转移给客户，公司在完成报关手续，取得货物出口报关单及提单时确认收入；

②在 DDU、DAP 贸易模式下，以货物送到客户指定地点，货物的主要风险报酬和控制权转移给客户，公司在将货物运送至客户指定地点时确认收入；

③在 EXW 贸易模式下，公司将货物于工厂处交付给客户指定的承运人后，货物的主要风险报酬和控制权转移给客户，公司在将货物于工厂交付给承运人时确认收入。

2、2018 年度和 2019 年度适用

公司具体的收入确认时点如下：

境内销售以商品发运并取得客户或其指定的其他方确认时确认收入；

境外销售以商品发出后，根据不同的贸易方式确定相应的收入确认时点：

①在 FOB、CIF、CIP 贸易模式下，公司将货物交付运输公司并完成报关手续后，货物的主要风险报酬转移给客户，公司在完成报关手续，取得货物出口报关单及提单时确认收入；

②在 DDU、DAP 贸易模式下，以货物送到客户指定地点，货物的主要风险报酬转移给客户，公司在将货物运送至客户指定地点时确认收入；

③在 EXW 贸易模式下，公司将货物于工厂处交付给客户指定的承运人后，货物的主要风险报酬转移给客户，公司在将货物于工厂交付给承运人时确认收入。

（二）外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

（三）应收款项坏账准备

1、2019年1月1日起适用

（1）金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对应收款项及合同资产进行减值处理并确认损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于应收款项及合同资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损

失准备。

（2）按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——合并范围内 关联往来组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——账龄组合	账龄	
长期应收款——融资租赁组合	款项性质	

（3）按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

①具体组合及计量预期信用损失的方法

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——合并范围内 关联往来组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

②应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	应收账款预期信用损失率（%）
1年以内（含，下同）	5
1-2年	10
2-3年	30
3年以上	100

2、2018 年度适用

（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 100 万元以上（含）且占应收款项账面余额 10% 以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

①具体组合及坏账准备的计提方法

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄分析法

②账龄分析法

账龄	应收商业承兑汇票计提比例（%）	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1 年以内	5	5	5
1-2 年	10	10	10
2-3 年	30	30	30
3 年以上	100	100	100

（3）单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

对应收银行承兑汇票、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

（四）存货

1、存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2、发出存货的计价方法

发出存货采用移动加权平均法。

3、存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4、存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品按照一次转销法进行摊销。

（2）包装物按照一次转销法进行摊销。

（五）固定资产

1、固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

2、各类固定资产的折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20-30	5.00	4.75-3.17
通用设备	年限平均法	3-5	5.00	31.67-19.00

专用设备	年限平均法	2-10	5.00	47.50-9.50
运输工具	年限平均法	5	5.00	19.00

（六）在建工程

1、在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2、在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

（七）无形资产

1、无形资产包括土地使用权和软件等，按成本进行初始计量。

2、使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。公司无形资产摊销年限具体如下：

项目	摊销年限（年）
土地使用权	50
软件	3-5

（八）部分长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

（九）股份支付

1、股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2、实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

（1）以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

（2）以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

（3）修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可

行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

（十）政府补助

1、政府补助在同时满足下列条件时予以确认：

（1）公司能够满足政府补助所附的条件；（2）公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关

或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4、与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

5、政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

（十一）重大会计政策和会计估计变更

1、重大会计政策变更

（1）新金融工具准则

公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以下简称“新金融工具准则”）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整 2019 年 1 月 1 日的留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益（处置

时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益），且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

①执行新金融工具准则对公司 2019 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

单位：万元

项目	资产负债表		
	2018 年 12 月 31 日	新金融工具准则 调整影响	2019 年 1 月 1 日
短期借款	15,130.12	46.14	15,176.27
其他应付款	43,191.31	-82.10	43,109.22
一年内到期的非 流动负债	1,700.00	2.43	1,702.43
长期借款	23,300.00	33.52	23,333.52

②2019 年 1 月 1 日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：

单位：万元

项目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	货币资金	575.61	摊余成本	575.61
应收账款	贷款和应收款项	5,044.98	摊余成本	5,044.98
其他应收款	贷款和应收款项	83.56	摊余成本	83.56
短期借款	其他金融负债	15,130.12	摊余成本	15,176.27
应付账款	其他金融负债	10,145.09	摊余成本	10,145.09
其他应付款	其他金融负债	43,191.31	摊余成本	43,109.22
一年内到期的 非流动负债	其他金融负债	1,700.00	摊余成本	1,702.43
长期借款	其他金融负债	23,300.00	摊余成本	23,333.52

（2）新收入准则

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》（以下简称“新收入准则”）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整 2020 年 1 月 1 日的留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新收入准则对公司 2020 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

单位：万元

项目	资产负债表		
	2019 年 12 月 31 日	新收入准则调整影响	2020 年 1 月 1 日
预收款项	54.94	-54.94	-
合同负债	-	54.94	54.94

（3）新租赁准则

公司自 2021 年 1 月 1 日起执行经修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称“新租赁准则”）。

公司作为承租人，根据新租赁准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新租赁准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新租赁准则对公司 2021 年 1 月 1 日财务报表无影响。

2、重大会计估计变更

报告期内公司无会计估计变更事项。

3、会计差错更正

报告期内公司无会计差错更正事项。

七、财务报告事项

（一）非经常性损益

1、注册会计师鉴证的非经常性损益情况

报告期内，公司经天健会计师鉴证后的非经常性损益情况如下：

单位：万元

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
非流动资产处置损益	-10.26	-106.59	177.81	1.57
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	2,775.63	4,370.80	665.29	840.72
债务重组损益	-5.74	-	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4.04	18.75	6.77	-4.73
其他符合非经常性损益定义的损益项目	11.74	-492.64	-2,299.37	0.04
小计	2,775.41	3,790.32	-1,449.50	837.60
减：所得税影响数	-	-	-	-
归属于母公司股东的非经常性损益净额	2,775.41	3,790.32	-1,449.50	837.60
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	3,106.38	-4,190.82	-14,953.45	-11,545.62

2、非经常性损益对经营成果的影响

报告期各期，公司非经常性损益分别为 837.60 万元、-1,449.50 万元、3,790.32 万元和 2,775.41 万元。公司非经常性损益主要为股份支付、政府补助以及非流动资产处置损益等。股份支付的详细情况参见本节“十、经营成果分析”之“（六）股份支付”。

公司作为从事显示驱动芯片的先进封测业务的领先企业，持续得到政府部门的重点支持。2020 年度及 2021 年 1-6 月，计入当期损益的政府补助较多，因此非经常性损益金额较大。

随着公司生产规模逐年扩大，公司盈利能力不断提升，公司经营活动产生的现金流量持续向好，非经常性损益对经营成果的影响将逐渐降低。

（二）公司适用的税率及优惠政策

1、主要税种和税率

报告期内，公司适用的主要税种及税率情况如下：

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%、16% ^{注1} 、13% ^{注2}
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴	1.2%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

注1：根据财政部、税务总局《关于调整增值税税率的通知》（财税〔2018〕32号）的有关规定，从2018年5月1日起，公司发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用17%税率的，税率调整为16%。

注2：根据《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部、税务总局、海关总署公告2019年第39号）的有关规定，从2019年4月1日起，增值税一般纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用16%税率的，税率调整为13%。

报告期内，不同税率的纳税主体企业所得税税率情况如下：

纳税主体名称	企业所得税税率			
	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
汇成股份	15%	15%	15%	25%
江苏汇成	15%	15%	15%	15%

2、主要税收优惠政策及批文

（1）汇成股份企业所得税优惠

根据安徽省科技厅、安徽省财政厅、安徽省税务局公示《关于公布安徽省2019年第二批高新技术企业认定名单的通知》，汇成股份在2019年被认定为高新技术企业（证书编号：GR201934001917），按税法规定2019-2021年度减按15%的税率计缴企业所得税。

（2）江苏汇成企业所得税优惠

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室公示《关于公示江苏省2018年第三批拟认定高新技术企业名单的通知》，江苏汇成在2018年被认定为高新技术企业（证书编号：GR201832007193），按税法规定2018-2020年度减

按 15% 的税率计缴企业所得税。

根据国家税务总局《关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告》（国家税务总局公告 2017 年第 24 号）的规定，江苏汇成高新技术企业资格期满当年，重新认定前，其企业所得税暂按 15% 的税率预缴。

3、税收优惠的影响及可持续性

税收优惠政策对报告期内发行人经营成果不构成重大影响，发行人对税收优惠不存在严重依赖。

近年来，国家陆续颁布了集成电路税收优惠支持政策，其中，根据国务院《关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策》（国发〔2020〕8 号）的通知内容规定，为支持集成电路设计和软件产业发展，国家鼓励的集成电路设计、装备、材料、封装、测试企业和软件企业，自获利年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照 25% 的法定税率减半征收企业所得税。公司属于先进封装测试服务商，符合上述减免条件，但由于前期亏损未能享受该优惠。随着公司的盈利能力陆续提高，未来将适用该减免政策享受优惠。

八、主要财务指标

（一）主要财务指标

项目	2021.6.30 /2021 年 1-6 月	2020.12.31 /2020 年度	2019.12.31 /2019 年度	2018.12.31 /2018 年度
流动比率（倍）	1.19	1.52	0.30	0.33
速动比率（倍）	0.74	1.05	0.17	0.18
资产负债率（母公司）（%）	23.71	27.71	71.41	61.10
资产负债率（合并）（%）	28.65	34.71	87.18	81.09
应收账款周转率（次/年）	2.19	4.84	5.42	6.43
存货周转率（次/年）	1.78	3.58	2.76	2.75
息税折旧摊销前利润（万元）	13,044.03	17,674.39	153.22	-1,203.57
归属于发行人股东的净利润（万元）	5,881.79	-400.50	-16,402.95	-10,708.02
归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润（万元）	3,106.38	-4,190.82	-14,953.45	-11,545.62
研发投入占营业收入的比例	8.08%	7.62%	11.52%	13.26%

项目	2021.6.30 /2021年1-6月	2020.12.31 /2020年度	2019.12.31 /2019年度	2018.12.31 /2018年度
每股经营活动产生的现金流量(元)	0.20	/	/	/
每股净现金流量(元)	-0.05	/	/	/
归属于发行人股东的每股净资产(元)	1.96	/	/	/

注：上述财务指标计算公式如下：

- (1) 流动比率=流动资产/流动负债
- (2) 速动比率=(流动资产-存货)/流动负债
- (3) 资产负债率=(负债总额/资产总额)×100%
- (4) 应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额
- (5) 存货周转率=营业成本/存货平均余额
- (6) 息税折旧摊销前利润=利润总额+利息费用+固定资产折旧+无形资产摊销
- (7) 研发投入占营业收入的比例=研发费用/营业收入
- (8) 每股经营活动产生的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额
- (9) 每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末股本总额
- (10) 归属于发行人股东的每股净资产=归属于公司股东的所有者权益/期末股本总额

(二) 净资产收益率和每股收益

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率与每股收益的计算与披露》（2010年修订），公司报告期内净资产收益率及每股收益如下：

时间	项目	加权平均净资产收益率	每股收益(元/股)	
			基本	稀释
2021年1-6月	归属于公司普通股股东的净利润	4.68%	0.09	0.09
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.47%	0.05	0.05
2020年度	归属于公司普通股股东的净利润	-0.96%	/	/
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-10.02%	/	/
2019年度	归属于公司普通股股东的净利润	-94.43%	/	/
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-86.09%	/	/
2018年度	归属于公司普通股股东的净利润	-39.16%	/	/
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-42.23%	/	/

注：1、加权平均净资产收益率= $P_0 / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$

其中：P₀ 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP为归属于公司普通股股东的净利润；E₀为归属于公司普通股股东的

期初净资产； E_i 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产； E_j 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产； M_0 为报告期月份数； M_i 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数； M_j 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数； E_k 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动； M_k 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

2、基本每股收益= $P_0 \div S$

$S=S_0+S_1+Si \times Mi \div M_0-Sj \times Mj \div M_0-Sk$

其中： P_0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润； S 为发行在外的普通股加权平均数； S_0 为期初股份总数； S_1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； S_j 为报告期因回购等减少股份数； S_k 为报告期缩股数； M_0 为报告期月份数； M_i 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数； M_j 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

3、稀释每股收益= $P_1 / (S_0+S_1+Si \times Mi \div M_0-Sj \times Mj \div M_0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)$

其中， P_1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

九、具有核心意义、或其变化对业绩变动具有较强预示作用的财务或非财务指标

根据公司所处行业及自身业务特点，公司主营业务毛利率、主营业务收入增长率和经营活动产生的现金流量净额等财务指标的变动对公司业绩变动具有较强的预示作用，具体情况如下：

财务指标	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
主营业务毛利率	28.91%	21.39%	5.28%	4.98%
主营业务收入增长率	/	55.41%	38.09%	/
经营活动产生的现金流量净额（万元）	13,457.43	15,109.00	-2,238.90	-1,559.50

同时，公司封装测试技术水平及研发能力、客户稳定性等非财务指标对公司具有核心意义，是对业绩变动具有较强预示作用的非财务指标。

（一）财务指标

1、主营业务毛利率

公司主营业务毛利率是判断业务竞争力和盈利能力的重要指标，报告期内分

别为 4.98%、5.28%、21.39%和 28.91%。自 2020 年起，随着订单持续增长产生的规模效应以及客户结构的调整，公司毛利率持续改善。主营业务毛利率变动原因参见本节“十、经营成果分析”之“（三）毛利与毛利率分析”。如果未来公司主营业务毛利率发生较大变动，将会对公司的盈利能力产生重大影响。

2、主营业务收入增长率

主营业务收入增长率是判断公司发展趋势的重要指标。公司主营业务与行业整体的景气程度密切相关。2019 年度和 2020 年度，公司主营业务收入同比分别增长 38.09%和 55.41%，主营业务收入增长率维持在较高水平。报告期内，公司主营业务收入变动原因参见本节“十、经营成果分析”之“（一）营业收入分析”之“1、营业收入构成及其变化”。如果未来公司主营业务收入出现下滑，将会对公司的盈利能力产生重大影响。

3、经营活动产生的现金流量净额

经营活动产生的现金流量净额是评价公司经营能力的重要指标。2018 年度、2019 年度，公司经营活动产生的现金流量净额为负，主要系合肥生产基地建成投产不久，尚处于初步发展阶段，收入规模较小；2020 年度和 2021 年 1-6 月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 15,109.00 万元和 13,457.43 万元，公司营运能力逐渐向好，主要系客户的持续导入及营业收入快速增长所致。具体原因参见本节“十二、偿债能力、流动性与持续经营能力分析”之“（四）现金流量分析”之“1、经营活动产生的现金流量分析”。如果未来公司的经营活动产生的现金流量净额下降，将会对公司的营运能力产生重大影响。

（二）非财务指标

公司封装测试的技术水平及研发能力、客户稳定性等非财务指标对公司具有核心意义。

1、技术水平及研发能力

公司所处集成电路封装测试行业为技术密集型行业，技术创新是企业持续成长的主要动力。自成立以来，公司通过长期的研发投入及技术积累，在显示驱动芯片封装测试领域已形成一定的技术优势。

技术水平与研发能力系公司保持核心竞争力的重要非财务指标，具体参见本招股说明书“第六节 业务与技术”之“六、发行人核心技术及研发情况”之“（一）公司的核心技术情况”。

2、客户稳定性

公司的下游行业集中度较高，客户稳定性是公司保持可持续发展的重要非财务指标。公司目前服务的客户包括联咏科技、天钰科技、瑞鼎科技、奇景光电等全球知名显示驱动芯片设计企业，2020 年度全球排名前五显示驱动芯片设计公司中三家系公司主要客户，2020 年度中国排名前十显示驱动芯片设计公司中九家系公司主要客户。凭借先进的封测技术及优质的产品服务，报告期内公司主要客户的订单持续放量增长。

十、经营成果分析

报告期内，公司营业收入分别为 28,558.35 万元、39,420.66 万元、61,892.67 万元和 35,875.90 万元，归属于母公司所有者的净利润分别为-10,708.02 万元、-16,402.95 万元、-400.50 万元和 5,881.79 万元，取得上述经营成果的逻辑系：

公司合肥生产基地建成后，迎合了客户对 12 吋晶圆先进封装测试服务的需求。凭借先进的金凸块制造与全流程封装服务能力，并随着中国大陆的显示驱动芯片封装测试需求快速增长、主要客户的订单持续增加以及新客户的不断导入，公司产量保持快速增长的趋势，呈现明显的规模效应，营收规模持续提高，盈利能力不断提升。

（一）营业收入分析

1、营业收入构成及其变化

报告期内，公司营业收入构成如下表所示：

单位：万元

项目	2021 年 1-6 月		2020 年度	
	金额	占比	金额	占比
主营业务收入	34,987.81	97.52%	57,504.79	92.91%
其他业务收入	888.09	2.48%	4,387.88	7.09%

合计	35,875.90	100.00%	61,892.67	100.00%
项目	2019 年度		2018 年度	
	金额	占比	金额	占比
主营业务收入	37,001.73	93.86%	26,796.12	93.83%
其他业务收入	2,418.93	6.14%	1,762.23	6.17%
合计	39,420.66	100.00%	28,558.35	100.00%

公司主营业务为显示驱动芯片的先进封装测试服务。报告期内，公司主营业务收入分别为 26,796.12 万元、37,001.73 万元、57,504.79 万元和 34,987.81 万元，占营业收入的比例均在 90% 以上，主营业务突出。公司其他业务收入主要系出售含金废液等所产生的收入，占营业收入的比例较低。

报告期内，公司主营业务收入保持快速增长态势，具体原因如下：

（1）境内显示面板的高速发展及显示驱动芯片产业向境内的转移推动公司收入增长

随着国家产业政策的扶持鼓励以及终端应用领域的需求提升，境内显示面板行业实现了高速发展，仅中国大陆显示面板市场规模就从 2016 年的 43.60 百万平方米增长至 2020 年的 91.10 百万平方米，年复合增长率 20.23%。受益于此，境内显示驱动芯片及其封装测试需求相应增长，2016 年至 2020 年度中国大陆显示驱动封测市场年均复合增长率达到 25.11%。

显示驱动芯片的引脚众多且排列紧密，对封装测试的技术要求也更高，金凸块制造技术实现了“以点代线”的技术跨越，可以显著提高产品性能。公司是中国境内较早具备金凸块制造能力并实现量产的显示驱动芯片先进封测企业之一，拥有合肥与扬州两座封测基地，随着全球显示驱动芯片产业逐渐向境内转移，公司报告期内的收入增长迅速。

（2）合肥 12 吋封测基地建成投产迎合客户需求，订单快速增长

报告期内，合肥 12 吋封测基地建成投产后收入增长迅速。一方面，合肥封测基地逐步导入联咏科技、天钰科技、奇景光电等全球知名显示驱动芯片设计企业，公司产品线不断增加；另一方面，由于 12 吋晶圆较 8 吋晶圆具备更高的经济效益，下游客户对 12 吋晶圆的的需求快速增长，但其对生产工艺、产品良率管

理的要求也更高。公司凭借稳定可控的 12 吋晶圆加工良率与优质的服务能力，12 吋晶圆封测服务订单快速增长。2018 年至 2020 年，12 吋晶圆封测服务的收入从 1,314.37 万元上涨至 25,227.55 万元。

（3）集成电路产业集聚优势带来合肥封测基地收入规模攀升

报告期内，合肥封测基地凭借集成电路产业集聚优势，收入规模攀升。一方面，合肥封测基地与部分客户所合作的晶圆制造商同位于合肥产业集聚群，对显示驱动芯片设计公司而言，封测厂商靠近晶圆制造厂可以缩短晶圆从制造厂到封装测试厂的交付周期、降低生产运输成本；另一方面，合肥封测基地可以提供 12 吋晶圆的封测全制程统包服务，能提高封装测试环节的生产效率，缩短交付周期。

2、主营业务收入按产品类别分析

报告期内，公司主营业务收入均来自于对显示驱动芯片的封装测试，具体情况如下：

单位：万元

封测芯片种类	2021 年 1-6 月		2020 年度		2019 年度		2018 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
显示驱动芯片	34,987.81	100.00%	57,504.79	100.00%	37,001.73	100.00%	26,796.12	100.00%
合计	34,987.81	100.00%	57,504.79	100.00%	37,001.73	100.00%	26,796.12	100.00%

（1）主营业务收入按工艺制程划分

公司对客供晶圆在完成客户约定的工艺制程并交付后确认收入。其中，主营业务收入若按工艺制程划分，可分属于金凸块制造、晶圆测试、玻璃覆晶封装与薄膜覆晶封装，具体情况如下：

单位：万元

工艺制程	2021 年 1-6 月		2020 年度	
	金额	占比	金额	占比
Gold Bumping	15,743.29	45.00%	26,951.88	46.87%
CP	8,273.71	23.65%	12,151.01	21.13%

COG	4,389.39	12.55%	6,967.70	12.12%
COF	6,581.42	18.81%	11,434.20	19.88%
合计	34,987.81	100.00%	57,504.79	100.00%
工艺制程	2019 年度		2018 年度	
	金额	占比	金额	占比
Gold Bumping	18,898.10	51.07%	14,294.14	53.34%
CP	6,732.71	18.20%	4,627.74	17.27%
COG	5,540.64	14.97%	4,206.04	15.70%
COF	5,830.27	15.76%	3,668.20	13.69%
合计	37,001.73	100.00%	26,796.12	100.00%

公司以提供显示驱动芯片的全制程统包服务为目标。报告期内，公司围绕核心工序金凸块制造形成了完整的封装测试体系，成功导入优质客户并持续放量，其中合肥 12 吋封测基地的建成投产与工艺稳定成熟是收入增长的主要驱动因素。

（2）主营业务收入按所封测晶圆尺寸划分

公司主营业务收入具体按所封测晶圆尺寸统计如下：

单位：万元

封测晶圆尺寸	2021 年 1-6 月		2020 年度	
	金额	占比	金额	占比
12 吋	19,092.05	54.57%	25,227.55	43.87%
8 吋	15,895.76	45.43%	32,277.25	56.13%
合计	34,987.81	100.00%	57,504.79	100.00%
封测晶圆尺寸	2019 年度		2018 年度	
	金额	占比	金额	占比
12 吋	7,182.37	19.41%	1,314.37	4.91%
8 吋	29,819.36	80.59%	25,481.74	95.09%
合计	37,001.73	100.00%	26,796.12	100.00%

报告期内，公司对 12 吋晶圆封测的主营业务收入分别为 1,314.37 万元、7,182.37 万元、25,227.55 万元和 19,092.05 万元，占主营业务收入比重快速提升。

3、主要服务的销售数量、价格对主营业务收入的影响

报告期内，公司主要提供显示驱动芯片全制程封装测试统包服务，公司会与客户在每个工艺制程约定服务价格，对客户晶圆在完成客户约定的工艺制程并交付后确认收入。按工艺制程统计的销售数量、价格对主营业务收入的影响情况分析如下：

（1）金凸块制造（Gold Bumping）

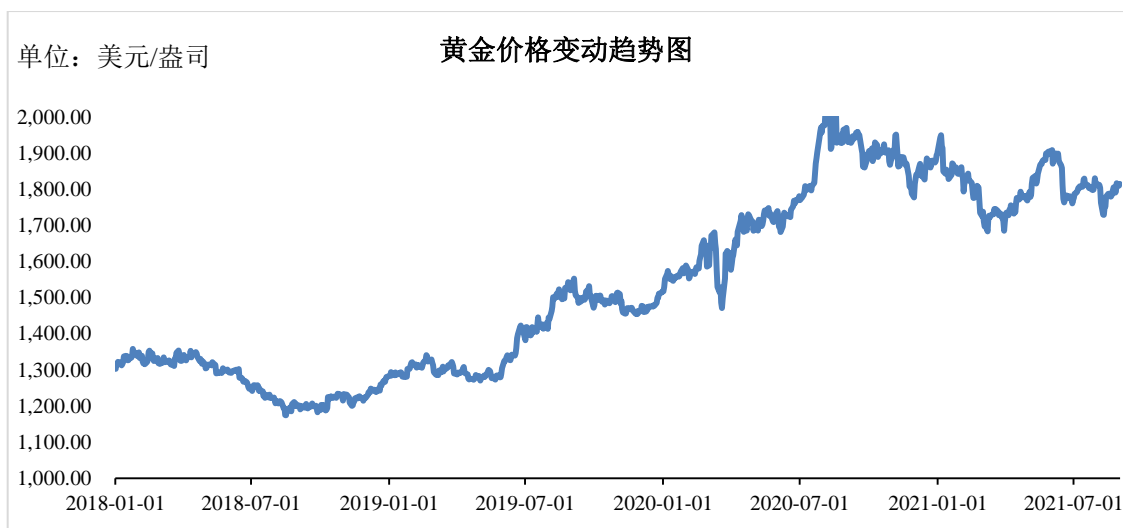
报告期内，公司金凸块制造收入分别为 14,294.14 万元、18,898.10 万元、26,951.88 万元和 15,743.29 万元，收入增长迅速。

报告期内，公司金凸块制造的收入、销量和单价的变动情况如下：

8 吋 Gold Bumping	2021 年 1-6 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
销售收入（万元）	7,975.81	17,065.54	15,204.89	13,089.22
销售量（万片）	17.33	37.00	38.17	34.57
销售均价（元/片）	460.34	461.18	398.34	378.65
12 吋 Gold Bumping	2021 年 1-6 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
销售收入（万元）	7,767.48	9,886.34	3,693.21	1,204.92
销售量（万片）	7.39	9.92	4.08	1.36
销售均价（元/片）	1,051.04	997.02	905.25	883.74

从销量角度分析，报告期内金凸块制造的销量呈快速增长趋势，主要系 12 吋晶圆金凸块制造的订单快速放量所致。

从价格角度分析，报告期内的金凸块制造销售均价呈上涨趋势，主要系含金原料是金凸块制造的主要原材料，金凸块制造销售价格随黄金市场价格的波动而调整。报告期内黄金市场价格总体呈上涨的趋势，带动报告期内金凸块制造的销售均价变化。



数据来源：Wind 资讯（黄金价格取伦敦金报价）

（2）晶圆测试（CP）

报告期内，公司晶圆测试收入分别为 4,627.74 万元、6,732.71 万元、12,151.01 万元和 8,273.71 万元，收入持续上升。

报告期内，公司晶圆测试的收入、销量和单价的变动情况如下：

8 吋 CP	2021 年 1-6 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
销售收入（万元）	2,787.48	5,378.75	4,888.18	4,586.20
销售量（万片）	13.54	26.04	26.25	26.20
销售均价（元/片）	205.79	206.52	186.25	175.04
12 吋 CP	2021 年 1-6 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
销售收入（万元）	5,486.23	6,772.26	1,844.54	41.55
销售量（万片）	7.22	10.98	2.61	0.04
销售均价（元/片）	760.16	616.83	706.97	937.64

从销量角度分析，报告期内 8 吋晶圆测试销售量稳定；12 吋晶圆测试销售量随着合肥 12 吋晶圆封测基地稳定投产后快速放量增长。

从价格角度分析，报告期内 8 吋晶圆测试销售均价总体呈上升趋势，带动其收入规模小幅上升；12 吋晶圆测试销售均价较高但受客户结构等因素影响存在波动，由于其快速放量使得整体晶圆测试收入呈较快上涨趋势。

（3）玻璃覆晶封装

报告期内，公司玻璃覆晶封装销售收入分别为 4,206.04 万元、5,540.64 万元、6,967.70 万元和 4,389.39 万元，收入规模稳定增长。

报告期内，公司玻璃覆晶封装的收入、销量和单价的变动情况如下：

项目	2021 年 1-6 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
销售收入（万元）	4,389.39	6,967.70	5,540.64	4,206.04
销售量（千颗）	322,634.74	606,819.32	578,683.42	498,203.25
销售均价（元/千颗）	136.05	114.82	95.75	84.42

玻璃覆晶封装技术在行业应用中成熟稳定，主要用于小尺寸面板产品如手机、数码相机、平板电脑等。报告期内，受下游客户需求的稳步提升，玻璃覆晶封装的销售量保持稳定增长，客户结构的变化导致销售均价有所提高，因此玻璃覆晶封装的收入规模持续扩大。

（4）薄膜覆晶封装

报告期内，公司薄膜覆晶封装销售收入分别为 3,668.20 万元、5,830.27 万元、11,434.20 万元和 6,581.42 万元，收入规模快速增长。

报告期内，公司薄膜覆晶封装的收入、销量和单价的变动情况如下：

项目	2021 年 1-6 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
销售收入（万元）	6,581.42	11,434.20	5,830.27	3,668.20
销售量（千颗）	131,890.21	221,276.48	119,987.12	77,984.25
销售均价（元/千颗）	499.01	516.74	485.91	470.38

薄膜覆晶封装技术主要应用于液晶电视和全面屏手机等电子设备，是在显示驱动芯片封装中应用最广、发展前景最好的技术之一。薄膜覆晶封装收入增长主要系：一方面，随着大屏及窄边框显示设备的消费规模增长，下游知名客户扩大了对上述显示设备的市场布局，带动薄膜覆晶封装的需求量大幅增长；另一方面，合肥封测基地对联咏科技、天钰科技、奇景光电等知名客户的成功导入以及公司稳定的品控管理带来了相关订单的放量增长。

4、主营业务收入按境内外分析

报告期内，公司主营业务收入按客户归属地统计境内外收入情况如下：

单位：万元

区域	2021年1-6月		2020年度	
	金额	占比	金额	占比
境内	8,620.74	24.64%	16,466.00	28.63%
华东地区	5,436.36	15.54%	14,394.63	25.03%
华南地区	3,141.82	8.98%	2,065.37	3.59%
其他地区	42.57	0.12%	6.00	0.01%
境外	26,367.07	75.36%	41,038.80	71.37%
中国台湾	24,500.56	70.03%	38,926.21	67.69%
中国香港	1,866.51	5.33%	2,112.58	3.67%
合计	34,987.81	100.00%	57,504.79	100.00%
区域	2019年度		2018年度	
	金额	占比	金额	占比
境内	9,832.91	26.57%	8,883.91	33.15%
华东地区	9,236.42	24.96%	8,809.18	32.87%
华南地区	596.43	1.61%	74.55	0.28%
其他地区	0.06	0.00%	0.18	0.00%
境外	27,168.81	73.43%	17,912.21	66.85%
中国台湾	25,289.93	68.35%	16,927.25	63.17%
中国香港	1,878.88	5.08%	984.95	3.68%
合计	37,001.73	100.00%	26,796.12	100.00%

注：境内外划分以直接交易客户注册地址的境内外归属作为标准。

报告期内，公司主要客户为中国台湾地区的知名显示驱动芯片设计公司，境外客户实现主营业务收入分别为 17,912.21 万元、27,168.81 万元、41,038.80 万元和 26,367.07 万元，占当期主营业务收入的比例分别为 66.85%、73.43%、71.37% 和 75.36%，随着主要客户的订单持续放量，境外客户收入的规模持续扩大，占比整体呈上升趋势。

5、主营业务收入季节性变化

报告期内，公司主营业务收入按季度划分如下：

单位：万元

项目	2021年1-6月	2020年度
----	-----------	--------

	金额	占比	金额	占比
第一季度	15,202.50	43.45%	11,355.46	19.75%
第二季度	19,785.31	56.55%	11,055.39	19.23%
第三季度	-	-	16,812.58	29.24%
第四季度	-	-	18,281.35	31.79%
合计	34,987.81	100.00%	57,504.79	100.00%
项目	2019 年度		2018 年度	
	金额	占比	金额	占比
第一季度	7,143.12	19.30%	3,930.50	14.67%
第二季度	7,305.14	19.74%	7,529.01	28.10%
第三季度	10,219.69	27.62%	7,131.68	26.61%
第四季度	12,333.77	33.33%	8,204.93	30.62%
合计	37,001.73	100.00%	26,796.12	100.00%

报告期内，公司收入存在季节性变动，第三、四季度收入占比高，主要系受终端行业需求和生产周期的影响。一方面，公司所封装测试的显示驱动芯片主要应用于日常使用的智能手机、智能穿戴、高清电视、笔记本电脑、平板电脑等各类终端产品，上述终端产品的需求旺季集中在第四季度与次年的第一季度；另一方面，受春节假期等因素影响，显示驱动设计公司一般会安排在第三、四季度提前备货生产以保证供应稳定，相应带动显示驱动芯片的封装测试需求。

6、第三方回款分析

报告期内，公司存在第三方回款的情形，主要为同一集团内代付货款和供应链物流代付款。具体情况如下：

单位：万元

项目	2021 年 1-6 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
①同一集团内公司代付货款	2,396.60	1,963.52	653.53	-
②供应链物流代付款	1,069.93	1,380.56	197.82	-
第三方回款合计	3,466.53	3,344.09	851.36	-
营业收入	35,875.90	61,892.67	39,420.66	28,558.35
第三方回款占营业收入比重	9.66%	5.40%	2.16%	-
其中：①同一集团公司代付占比	6.68%	3.17%	1.66%	-

②供应链物流代付占比	2.98%	2.23%	0.50%	-
------------	-------	-------	-------	---

报告期内，公司第三方回款产生的原因如下：

（1）客户根据自身的资金安排与经营需求，安排同一集团内的关联公司支付货款，自 2019 年起该类情况占营业收入比重分别为 1.66%、3.17% 和 6.68%。

（2）客户出于提高经营效率、节省管理成本等内部运营考虑，委托供应链物流公司代为支付货款，自 2019 年起该类情况占营业收入比重分别为 0.50%、2.23% 和 2.98%。

报告期内，公司第三方回款具有真实的业务背景和商业合理性，不存在虚构交易或调节账龄的情形。公司及控股股东、董事、监事、高级管理人员与第三方回款的支付方不存在关联关系或其他利益安排。

（二）营业成本分析

1、营业成本构成及其变化

报告期内，公司营业成本构成如下表所示：

单位：万元

项目	2021 年 1-6 月		2020 年度	
	金额	占比	金额	占比
主营业务成本	24,873.99	96.94%	45,203.22	90.62%
其他业务成本	786.47	3.06%	4,676.65	9.38%
合计	25,660.46	100.00%	49,879.86	100.00%
项目	2019 年度		2018 年度	
	金额	占比	金额	占比
主营业务成本	35,047.16	93.49%	25,462.85	92.56%
其他业务成本	2,438.62	6.51%	2,047.74	7.44%
合计	37,485.78	100.00%	27,510.59	100.00%

报告期内，公司主营业务成本分别为 25,462.85 万元、35,047.16 万元、45,203.22 万元和 24,873.99 万元，占营业成本的比例均在 90% 以上，与主营业务收入结构匹配。

2、主营业务成本构成及其变化

（1）主营业务成本按料工费结构分析

公司主营业务成本均为显示驱动芯片封装测试服务成本。其中，按料工费结构分析如下：

单位：万元

项目	2021年1-6月		2020年度	
	金额	占比	金额	占比
直接材料	11,779.67	47.36%	20,209.15	44.71%
直接人工	3,397.21	13.66%	6,707.06	14.84%
制造费用	9,267.34	37.26%	17,456.98	38.62%
运费保险费	429.77	1.73%	830.03	1.84%
合计	24,873.99	100.00%	45,203.22	100.00%
项目	2019年度		2018年度	
	金额	占比	金额	占比
直接材料	13,503.41	38.53%	10,733.02	42.15%
直接人工	8,717.61	24.87%	6,389.68	25.09%
制造费用	12,826.14	36.60%	8,340.14	32.75%
运费保险费	-	-	-	-
合计	35,047.16	100.00%	25,462.85	100.00%

注1：公司自2020年1月1日起执行新收入准则，将与合同履行直接相关的运费与保险费计入成本，报表列示为营业成本。

注2：出于报告期内主营业务成本可比性考虑，如无特别说明，在以下各工艺制程的主营业务成本变动分析及毛利率分析中，剔除与合同履行直接相关的运费与保险费。

公司主营业务成本由直接材料、直接人工、制造费用和运费保险费构成，其中直接材料与制造费用是最主要的构成部分。

报告期内，公司直接材料成本分别为10,733.02万元、13,503.41万元、20,209.15万元和11,779.67万元。公司的直接材料成本主要来自于金凸块制造环节，直接材料主要包括含金原料（含金电镀液、金盐和金靶等）、Tray盘和光刻胶等。直接材料占主营业务成本比例高，主要系金凸块制造使用的含金原料价值较高所致。2019年度，直接材料占主营业务成本较2018年度有所下降，主要系当年专用设备增加较多，折旧费用快速上升导致的短期结构性变化。

报告期内，公司直接人工分别为 6,389.68 万元、8,717.61 万元、6,707.06 万元和 3,397.21 万元。2020 年度，公司直接人工成本较 2019 年度大幅下降，一方面，随着生产工人熟练度的增加以及生产工艺的优化，公司当年度对生产人员需求量有所下降；另一方面，受 2020 年度疫情影响，部分非本地生产人员未及时返岗且公司根据实际生产经营筹划人员优化。因此，当期生产人员数量与薪酬均有所降低。

报告期内，公司制造费用分别为 8,340.14 万元、12,826.14 万元、17,456.98 万元和 9,267.34 万元，占主营业务成本的比例分别为 32.75%、36.60%、38.62% 和 37.26%，占比整体呈上升趋势，主要系公司为扩充产能，持续购置生产设备，折旧规模不断增加所致。

（2）主营业务成本按工艺制程的料工费结构分析

报告期内，公司主营业务成本料工费结构按工艺制程分析如下：

①金凸块制造

单位：万元

项目	2021 年 1-6 月		2020 年度		2019 年度		2018 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
直接材料	10,133.07	78.89%	17,038.33	75.10%	11,341.59	66.30%	8,979.61	65.77%
直接人工	764.72	5.95%	1,530.29	6.75%	2,153.51	12.59%	1,919.77	14.06%
制造费用	1,947.36	15.16%	4,117.50	18.15%	3,610.61	21.11%	2,752.84	20.16%
合计	12,845.15	100.00%	22,686.13	100.00%	17,105.70	100.00%	13,652.22	100.00%

报告期内，金凸块制造的主营业务成本主要由直接材料构成，直接材料占金凸块制造的成本比例分别为 65.77%、66.30%、75.10% 和 78.89%，占比逐年提高。金凸块制造的主要原材料为含金原料，报告期内的黄金市场价格总体呈上涨趋势，导致采购成本增加，直接材料占比提高。

②晶圆测试

单位：万元

项目	2021 年 1-6 月		2020 年度		2019 年度		2018 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比

直接材料	77.04	1.73%	125.18	1.50%	57.67	0.94%	45.38	1.24%
直接人工	649.16	14.60%	1,305.98	15.70%	1,745.15	28.33%	1,346.36	36.69%
制造费用	3,721.52	83.67%	6,888.21	82.80%	4,356.69	70.73%	2,277.62	62.07%
合计	4,447.72	100.00%	8,319.37	100.00%	6,159.52	100.00%	3,669.37	100.00%

晶圆测试工艺需使用各种型号的测试机台、探针台，因此，其主营业务成本主要由制造费用构成。报告期内，制造费用占晶圆测试主营业务成本的比例分别为 62.07%、70.73%、82.80% 和 83.67%，占比逐年增加，主要系公司持续购置先进的测试机台等生产设备，折旧费用快速增长所致。晶圆测试工艺制程里折旧费用占其制造费用的比例如下：

单位：万元

项目	2021 年 1-6 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
折旧费用	2,676.55	4,981.33	2,647.94	1,147.52
制造费用	3,721.52	6,888.21	4,356.69	2,277.62
折旧费用占制造费用比重	71.92%	72.32%	60.78%	50.38%

③玻璃覆晶封装

单位：万元

项目	2021 年 1-6 月		2020 年度		2019 年度		2018 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
直接材料	880.45	29.82%	1,695.80	30.25%	1,343.91	22.37%	1,185.70	24.98%
直接人工	820.54	27.79%	1,561.21	27.85%	2,362.19	39.31%	1,879.68	39.60%
制造费用	1,251.70	42.39%	2,348.45	41.90%	2,302.87	38.32%	1,681.38	35.42%
合计	2,952.69	100.00%	5,605.46	100.00%	6,008.98	100.00%	4,746.76	100.00%

报告期内，玻璃覆晶封装直接材料主要由胶带和其他辅材构成，直接材料的金额逐年上涨，与销量的变动情况一致；2020 年度，直接材料占主营业务成本的比例较 2019 年度上升，主要系直接人工成本的降低间接提高了直接材料占比。

2020 年度，玻璃覆晶封装的直接人工费用较 2019 年度明显减少，占主营业务成本比例相应降低。主要系随着生产人员熟练度提升及专用设备的持续购入，一线生产人员数量有所优化。

报告期内，玻璃覆晶封装的制造费用逐年上涨，占主营业务成本的比例逐年

增高，主要系玻璃覆晶封装生产过程涉及到研磨切割环节，需使用高精度研磨及切割设备，因此产生了较多的折旧费用。

④薄膜覆晶封装

单位：万元

项目	2021年1-6月		2020年度		2019年度		2018年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
直接材料	689.11	16.41%	1,349.84	17.39%	760.23	13.17%	522.33	15.39%
直接人工	1,162.79	27.69%	2,309.57	29.75%	2,456.76	42.56%	1,243.86	36.64%
制造费用	2,346.77	55.89%	4,102.83	52.86%	2,555.97	44.27%	1,628.29	47.97%
合计	4,198.67	100.00%	7,762.24	100.00%	5,772.96	100.00%	3,394.49	100.00%

报告期内，薄膜覆晶封装的主营业务成本主要由制造费用与直接人工构成。制造费用占薄膜覆晶封装主营业务成本的比例分别为 47.97%、44.27%、52.86% 和 55.89%，占比较高，主要系生产过程中使用的内引脚接合机等专用设备价值较高，产生的折旧费用较多所致；直接人工占薄膜覆晶封装主营业务成本的比例分别为 36.64%、42.56%、29.75% 和 27.69%，占比整体呈下降趋势，主要与公司人员结构调整变化及自动化程度提升有关。

3、主要原材料和能源采购情况

报告期内，公司主要原材料和能源采购情况参见本招股说明书“第六节 业务与技术”之“四、发行人原材料采购和主要供应商”相关内容。

4、成本核算方法

公司主营业务成本主要包括直接材料、直接人工及制造费用等，具体核算方法如下：

(1) 直接材料

直接材料包括主要材料和辅助材料，主要材料具体为电镀液、金盐、金靶等，辅助材料主要为 Tray 盘等材料。直接材料根据生产部门当月实际领用数量归集，并以移动加权平均法核算成本。

主要材料通过 BOM 表（物料清单）归集至各产品，并于月末根据实际耗用与标准耗用的差异，按照各产品标准耗用进行再分摊。已完工产品的主要材料成本计入产成品成本，未完工产品的主要材料成本计入在产品成本。

辅助材料根据产品实际领用对象归集，并按照当月完工产品的数量在完工产品之间分摊。

（2）直接人工

直接人工主要核算生产人员的工资、奖金、社保、公积金及福利等薪酬费用。直接人工按照生产相关人员当月实际发生的薪酬费用归集，并按照各产品机器耗用工时占当期机器耗用工时总额的比例进行分配。已完工产品的直接人工成本计入产成品成本，未完工产品的直接人工成本计入在产品成本。

（3）制造费用

制造费用主要核算与生产活动相关的固定资产折旧费用、低值易耗品摊销和水电等费用。公司将实际发生的制造费用按各产品机器耗用工时占当期机器耗用工时总额的比例进行分配。已完工产品的制造费用计入产成品成本，未完工产品的制造费用计入在产品成本。

（三）毛利与毛利率分析

1、毛利及毛利率构成

报告期内，公司毛利及毛利率的构成情况如下：

单位：万元

项目	2021 年 1-6 月		2020 年度		2019 年度		2018 年度	
	毛利	毛利率	毛利	毛利率	毛利	毛利率	毛利	毛利率
主营业务	10,113.82	28.91%	12,301.58	21.39%	1,954.57	5.28%	1,333.27	4.98%
其他业务	101.63	11.44%	-288.77	-6.58%	-19.69	-0.81%	-285.51	-16.20%
合计	10,215.45	28.47%	12,012.81	19.41%	1,934.88	4.91%	1,047.76	3.67%

报告期内，公司毛利分别为 1,047.76 万元、1,934.88 万元、12,012.81 万元和 10,215.45 万元，综合毛利率分别为 3.67%、4.91%、19.41% 和 28.47%。

2018 年与 2019 年，合肥封测基地尚处于初期发展阶段，产能利用率较低导致产品的单位成本较高，因此公司整体主营业务毛利率较低。自 2020 年度起，随着合肥封测基地的产能利用率不断提高，公司主营业务毛利率较 2018 年度和 2019 年度明显提升，主要原因如下：

（1）合肥 12 吋封测基地产量持续提高产生规模效应，单位固定成本下降

显示驱动芯片封测服务成本结构中的制造费用占比较高，主要系各制程使用的高值专用设备较多，产生的折旧费用较高所致。报告期内，随着合肥 12 吋封测基地建成投产，公司成功导入知名客户并持续放量，合肥 12 吋封测基地的订单快速增长，产销量持续提高产生规模效应，单位固定成本下降。

（2）人员整体熟练度提高，公司适时筹划人员优化

合肥生产基地自 2017 年起逐步投产，产线人员配置等各项生产管理环节尚处于磨合提升阶段，为此在 2018、2019 年储备了相对较多的人员，人员储备大于实际生产用工需求。随着生产人员工艺熟练度的增加、人机磨合度的持续提高带来的生产效率提升，为提高人员效率，公司自 2020 年初起筹划人员优化，同时叠加 2020 年 1 月起新冠疫情影响，较多非本地员工未返岗，公司根据实际生产经营需求控制新招聘人员数量，因此 2020 年起用工人数下降较多。随着产量的快速增长，单位人工成本下降。

2、主营业务毛利构成及毛利率变化情况

报告期内，公司主营业务毛利及主营业务毛利率按照工艺制程分类情况如下：

单位：万元

工艺制程	2021 年 1-6 月		2020 年度		2019 年度		2018 年度	
	毛利	毛利率	毛利	毛利率	毛利	毛利率	毛利	毛利率
Gold Bumping	2,898.15	18.41%	4,265.76	15.83%	1,792.40	9.48%	641.91	4.49%
CP	3,825.99	46.24%	3,831.65	31.53%	573.20	8.51%	958.37	20.71%
COG	1,436.70	32.73%	1,362.24	19.55%	-468.34	-8.45%	-540.71	-12.86%
COF	2,382.75	36.20%	3,671.96	32.11%	57.31	0.98%	273.70	7.46%
合计	10,543.59	30.14%	13,131.60	22.84%	1,954.57	5.28%	1,333.27	4.98%

注：基于同期数据的可比性，以下分工艺制程的主营业务毛利及毛利率分析不考虑运费保险

费的影响。

报告期内，公司以金凸块制造为核心，带动其他工艺制程的毛利快速上涨，推动了整体毛利的上升，各类工艺制程毛利率变动原因分析情况如下：

（1）金凸块制造

项目		2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
毛利率		18.41%	15.83%	9.48%	4.49%
平均销售单价	8吋销售均价（元/片）	460.34	461.18	398.34	378.65
	12吋销售均价（元/片）	1,051.04	997.02	905.25	883.74
平均销售成本	8吋单位成本（元/片）	393.59	383.35	353.43	343.57
	12吋单位成本（元/片）	815.37	857.26	886.17	1,302.39

报告期内，公司金凸块制造毛利率分别为 4.49%、9.48%、15.83% 和 18.41%，毛利率呈上升趋势，主要系 12 吋金凸块制造业务的销售占比与规模快速增长，带动了整体毛利率的快速提升。

从单位成本角度分析，一方面，公司人员结构的调整导致单位人工成本下降明显；另一方面，随着产量的快速增长产生规模效应，单位固定成本有所降低。

（2）晶圆测试

项目		2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
毛利率		46.24%	31.53%	8.51%	20.71%
销售收入	8吋晶圆（万元）	2,787.48	5,378.75	4,888.18	4,586.20
	12吋晶圆（万元）	5,486.23	6,772.26	1,844.54	41.55
平均销售单价	8吋销售均价（元/片）	205.79	206.52	186.25	175.04
	12吋销售均价（元/片）	760.16	616.83	706.97	937.64
平均销售成本	8吋单位成本（元/片）	98.54	111.25	155.99	137.77
	12吋单位成本（元/片）	431.32	493.84	791.63	1,347.70

报告期内，公司晶圆测试毛利率分别为 20.71%、8.51%、31.53% 和 46.24%。

2018 年，8 吋晶圆测试收入占比较高，晶圆测试毛利率整体受 8 吋晶圆测试业务影响较大。12 吋晶圆测试的业务量较小，销售均价与销售成本与其他年度相比不具有可比性。

2019 年度晶圆测试毛利率较 2018 年度明显下降，主要系公司持续购置晶圆测试设备，导致新增折旧费用较多。

2020 年度晶圆测试毛利率较 2019 年度显著上升，主要系人员结构变化、产量增长带来规模效应所致。

2021 年 1-6 月晶圆测试毛利率较 2020 年度亦有所上涨。主要系 2021 年集成电路行业整体供应紧缺，客户对封装测试服务需求量持续上升，公司对主要客户的服务单价有所提高。同时，公司的晶圆测试产量较上年同期增长明显，规模效应导致单位固定成本亦有所下降。

（3）玻璃覆晶封装

项目		2021 年 1-6 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
毛利率		32.73%	19.55%	-8.45%	-12.86%
价格变动因素	销售均价（元/千颗）	136.05	114.82	95.75	84.42
	价格变动比例	18.49%	19.92%	13.42%	/
成本变动因素	单位成本（元/千颗）	91.52	92.37	103.84	95.28
	成本变动比例	-0.92%	-11.05%	8.98%	/

报告期内，公司玻璃覆晶封装的毛利率分别为-12.86%、-8.45%、19.55%和 32.73%，毛利率呈上升趋势。2018 年与 2019 年，玻璃覆晶封装的毛利率为负，主要系合肥生产基地尚处于初期发展阶段，产量较小导致整体单位成本较高，使得该制程整体处于亏损状态。

2020 年度玻璃覆晶封装毛利率较 2019 年度增长较快，一方面系客户结构变化带来的销售均价上涨；另一方面系单位人工成本的下降所致。

2021 年 1-6 月玻璃覆晶封装毛利率较 2020 年度持续增长，主要系受集成电路行业景气，客户的服务单价提高以及客户结构的变化所致。

（4）薄膜覆晶封装

项目		2021 年 1-6 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
毛利率		36.20%	32.11%	0.98%	7.46%
价格变	销售均价（元/千颗）	499.01	516.74	485.91	470.38

动因素	价格变动比例	-3.43%	6.34%	3.30%	/
成本变动因素	单位成本（元/千颗）	318.35	350.79	481.13	435.28
	成本变动比例	-9.25%	-27.09%	10.53%	/

报告期内，公司薄膜覆晶封装的毛利率分别为 7.46%、0.98%、32.11% 和 36.20%。2019 年较 2018 年有所下降，主要系该产线当年新增较多生产人员，但产能利用率不饱满造成了一定程度的人员冗余，导致单位人工成本较高。

2020 年度薄膜覆晶封装毛利率较 2019 年度大幅提高，一方面，公司人员结构调整导致单位人工成本有所下降；另一方面，随着客户的导入以及产量的快速增长，产生规模效应导致单位固定成本下降；最后，客户结构变化又带动了销售均价的上涨，因此毛利率明显提升。

2021 年 1-6 月薄膜覆晶封装毛利率较 2020 年度小幅上涨，主要系产量持续增长，规模效应导致单位人工与单位固定成本有所下降。

3、毛利率与同行业可比公司的比较分析

（1）同行业可比公司的选择依据、选取范围及合理性

公司考虑了行业属性、封测产品种类、技术路径、经营规模、财务数据可比性等因素，基于全面性和可比性原则，选取了集成电路封装测试行业的国内 A 股上市公司通富微电、晶方科技、利扬芯片和气派科技作为同行业可比公司。

①通富微电

通富微电专业从事集成电路封装测试，在行业内具备知名度，2020 年度其集成电路封装测试业务收入达到 105.36 亿元。同时，目前 A 股上市公司中通富微电已开始布局显示驱动芯片金凸块制造业务，因此公司将其纳入可比范围。

②晶方科技

晶方科技专业从事晶圆级芯片封装测试，2020 年度主营业务收入为 10.85 亿元，与公司同属高端先进封装领域，均具备 8 吋与 12 吋晶圆的封装测试能力，因此公司将其纳入可比范围。

③利扬芯片

利扬芯片系专业从事晶圆测试与芯片测试服务的科创板上市公司，能同时提供 8 吋晶圆与 12 吋晶圆的测试服务，2020 年度的主营业务收入为 2.44 亿元。公司同样具备 8 吋与 12 吋晶圆的测试能力，因此公司将其纳入可比范围。

④气派科技

气派科技系专业从事集成电路的封装、测试业务的科创板上市公司，其业务范围中亦提供部分显示驱动芯片的封装测试服务，2020 年度的营业收入为 5.48 亿元，整体业务规模与公司接近，因此公司将其纳入可比范围。

(2) 公司毛利率与同行业可比公司的比较情况

报告期内，公司与同行业可比公司的毛利率对比情况如下：

公司名称	主营业务	2021 年 1-6 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
通富微电	集成电路封装测试	17.74%	15.01%	12.70%	15.56%
晶方科技	集成电路封装测试	53.13%	49.92%	38.78%	27.85%
利扬芯片	集成电路测试	50.40%	46.99%	53.83%	39.87%
气派科技	集成电路封装测试	32.00%	28.33%	20.75%	18.93%
平均值		38.32%	35.06%	31.52%	25.55%
公司	显示驱动芯片封装测试	30.14%	22.84%	5.28%	4.98%
其中：Gold Bumping		18.41%	15.83%	9.48%	4.49%
CP		46.24%	31.53%	8.51%	20.71%
COG		32.73%	19.55%	-8.45%	-12.86%
COF		36.20%	32.11%	0.98%	7.46%

注 1：数据来源于同行业可比公司公开披露数据。

注 2：2021 年 1-6 月、2020 年度公司显示驱动芯片封测毛利率及其各制程毛利率均不含运费保险费。

公司与同行业可比公司毛利率存在差异，主要系上述同行业可比公司的业务类型与公司的主营业务不完全一致。通富微电除先进封装业务还有较大规模的传统封装业务；晶方科技主要从事 CMOS 影像传感器的封装测试服务；利扬芯片主营晶圆测试与芯片测试服务，不涉及封装业务；气派科技主营业务中传统封装占比 80% 以上。

2018 年度和 2019 年度，公司的主营业务毛利率明显低于同行业毛利率水平，

主要系公司所处行业属于资金密集型行业，在建设初期需要大规模的固定资产投入。合肥 12 吋封测基地建成后，公司根据规划产能持续购置生产设备，固定资产折旧较高，导致单位固定成本较高。

自 2020 年度起，随着公司业务规模增长，销售收入快速增加，规模效应逐步显现，产品单位固定成本大幅下降，毛利率得到大幅改善，但仍低于同行业平均值。公司的核心业务围绕金凸块制造技术展开，提供全制程统包服务，同行业可比公司中仅通富微电涉及少量金凸块制造业务。金凸块制造工艺制程占公司主营业务收入比重较高，但其直接材料主要为含金原料，材料成本占比较高，导致该工艺制程毛利率相对较低，从而拉低了公司整体毛利率。

2021 年 1-6 月，随着公司盈利能力的持续改善，晶圆测试、玻璃覆晶封装和薄膜覆晶封装业务毛利率已与同行业平均值接近。

（四）期间费用分析

报告期内，公司期间费用的构成及变动情况如下：

单位：万元

项目	2021 年 1-6 月		2020 年度		2019 年度		2018 年度	
	金额	占营业收入比例	金额	占营业收入比例	金额	占营业收入比例	金额	占营业收入比例
销售费用	275.06	0.77%	313.02	0.51%	1,289.20	3.27%	750.16	2.63%
管理费用	1,855.06	5.17%	3,933.38	6.36%	5,387.55	13.67%	3,173.61	11.11%
研发费用	2,898.95	8.08%	4,715.21	7.62%	4,542.64	11.52%	3,787.27	13.26%
财务费用	-685.05	-1.91%	4,999.52	8.08%	6,984.75	17.72%	2,184.23	7.65%
合计	4,344.03	12.11%	13,961.14	22.56%	18,204.15	46.18%	9,895.27	34.65%

报告期各期，公司期间费用合计分别为 9,895.27 万元、18,204.15 万元、13,961.14 万元和 4,344.03 万元，占营业收入的比例分别为 34.65%、46.18%、22.56% 和 12.11%。

2019 年度，公司期间费用较 2018 年度明显增长，一方面系公司实施股权激励，对相关人员确认了较大金额的股份支付费用；另一方面系公司有息负债增加，导致利息支出增加。

2020 年度公司期间费用较 2019 年度明显下降，一方面系公司根据新收入准则将原通过“销售费用”核算的运输费和保险费调整至“合同履约成本”，不再纳入销售费用核算；另一方面系公司当期收到大额财政贴息费用，财务费用下降明显。

2021 年 1-6 月公司财务费用为负，一方面系公司于 2020 年底归还了大部分资金拆借款，利息支出有所下降；另一方面，公司于 2021 年 4 月收到了 2,000 万元的财政贴息。

1、销售费用

（1）销售费用变动分析

报告期各期，公司销售费用的构成及变动情况如下：

单位：万元

项目	2021 年 1-6 月		2020 年度		2019 年度		2018 年度	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
运输费	-	-	-	-	658.91	51.11	473.93	63.18
职工薪酬	171.68	62.41	259.02	82.75	232.20	18.01	194.02	25.86
股份支付	69.90	25.41	11.65	3.72	285.00	22.11	-	-
保险费	-	-	-	-	50.85	3.94	45.22	6.03
业务招待费	20.49	7.45	24.46	7.81	25.99	2.02	13.39	1.78
办公差旅费	9.74	3.54	13.45	4.30	22.69	1.76	18.77	2.50
其他费用	3.26	1.19	4.45	1.42	13.55	1.05	4.83	0.64
合计	275.06	100.00	313.02	100.00	1,289.20	100.00	750.16	100.00

注：公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，根据规定将控制权转移给客户之前发生的运输活动等相关成本作为合同履约成本，在营业成本中列示。公司将运费和与销售相关的保险费改列至营业成本。

公司销售费用主要由职工薪酬、运输费和股份支付等构成。报告期各期，公司销售费用分别为 750.16 万元、1,289.20 万元、313.02 万元和 275.06 万元，占当期营业收入的比例分别为 2.63%、3.27%、0.51% 和 0.77%。

报告期内，主要销售费用的变化情况如下：

①职工薪酬

报告期内，公司销售费用中的职工薪酬分别为 194.02 万元、232.20 万元、259.02 万元和 171.68 万元，职工薪酬金额逐年增长，主要系公司销售规模扩大，公司适度增加销售人员所致。

②运输费

2018 年度、2019 年度，公司销售费用中运输费分别为 473.93 万元、658.91 万元。自 2020 年度起，公司根据新收入准则将原通过“销售费用”核算的运输费用调整至“合同履约成本”并进而结转至营业成本，不再纳入销售费用核算。2020 年度和 2021 年 1-6 月，公司通过营业成本核算的运输费用分别为 768.04 万元、396.01 万元。

报告期内，公司运输费用稳步增长，主要系公司业务规模逐步扩大，出货量增加所致。

③股份支付

公司于 2019 年和 2020 年分别对核心员工进行了股权激励，自 2019 年度起确认的股份支付费用计入销售费用的金额分别为 285.00 万元、11.65 万元和 69.90 万元，具体情况请参见本节之“十、经营成果分析”之“（六）股份支付”。

（2）销售费用率与同行业可比公司比较

公司的销售费用率与同行业可比公司对比如下：

公司名称	2021 年 1-6 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
通富微电	0.40%	0.50%	0.69%	0.74%
晶方科技	0.21%	0.06%	0.19%	0.36%
利扬芯片	3.23%	1.98%	3.78%	4.48%
气派科技	1.51%	1.74%	1.69%	1.78%
平均值	1.34%	1.07%	1.59%	1.84%
发行人	0.77%	0.51%	3.27%	2.63%

注：数据来源于同行业可比公司公开披露数据。

报告期内，公司的销售费用率均处于同行业可比公司的区间范围内。

2018 年度和 2019 年度，公司的销售费用率高于行业平均值，主要系合肥生

产基地尚处于初创阶段，营业收入较低，导致销售费用率较高。

2020年度和2021年1-6月，公司销售费用率大幅下降。一方面系随着新客户的导入以及原有客户的订单持续增加，公司营业收入快速增长；另一方面系公司的下游为显示驱动芯片设计行业，行业集中度较高，成功导入客户后的持续开拓成本相对较低。

2、管理费用

（1）管理费用变动分析

报告期各期，公司管理费用的构成及变动情况如下：

单位：万元

项目	2021年1-6月		2020年度		2019年度		2018年度	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
职工薪酬	723.07	38.98	1,432.61	36.42	1,769.89	32.85	1,420.26	44.75
折旧摊销费	373.94	20.16	777.71	19.77	766.68	14.23	731.17	23.04
股份支付	163.59	8.82	27.27	0.69	1,395.00	25.89	-	-
中介机构费	113.85	6.14	306.22	7.79	499.10	9.26	304.45	9.59
物业服务费	56.79	3.06	112.74	2.87	114.66	2.13	114.67	3.61
办公差旅费	133.30	7.19	231.39	5.88	318.26	5.91	289.60	9.13
业务招待费	115.45	6.22	97.84	2.49	53.45	0.99	37.61	1.19
环安费、维修费	161.23	8.69	367.40	9.34	429.62	7.97	196.91	6.20
补偿款	-	-	498.00	12.66	-	-	-	-
其他费用	13.84	0.75	82.22	2.09	40.90	0.76	78.95	2.49
合计	1,855.06	100.00	3,933.38	100.00	5,387.55	100.00	3,173.61	100.00

公司管理费用主要包括职工薪酬、折旧摊销费、股份支付和中介机构费等。报告期各期，公司管理费用分别为3,173.61万元、5,387.55万元、3,933.38万元和1,855.06万元，占当期营业收入的比例分别为11.11%、13.67%、6.36%和5.17%。剔除股份支付后，管理费用占营业收入占比呈下降趋势，主要系公司业务规模扩大，营业收入规模增长，规模效应逐步体现，管理费用率逐年下降。

报告期内，主要管理费用的变化情况如下：

①职工薪酬

报告期各期，公司计入管理费用的职工薪酬分别为 1,420.26 万元、1,769.89 万元、1,432.61 万元和 723.07 万元。报告期初，由于生产经营管理能力尚处于提升阶段，公司人员储备在 2018、2019 年大于实际需求，后伴随着经营管理水平的提升，公司对部分管理人员有所优化。

②股份支付

公司于 2019 年和 2020 年分别对核心员工进行了股权激励，自 2019 年度起确认的股份支付计入管理费用的金额分别为 1,395.00 万元、27.27 万元和 163.59 万元，具体情况请参见本节之“十、经营成果分析”之“（六）股份支付”。

③中介机构费

报告期各期，公司中介机构费分别为 304.45 万元、499.10 万元、306.22 万元和 113.85 万元，主要系支付的审计律师费和劳务派遣居间费等。2019 年度中介机构费较高，主要系公司当年筹划资本市场运作事项，支付了相关的前期中介机构尽调费用。

④补偿款

2014 年 12 月至 2017 年 1 月期间，实际控制人郑瑞俊向公司及子公司当时在职的部分员工出具了赠股协议，拟向员工无偿赠股。公司自 2019 年 12 月起正式实施员工股权激励，对于原未实际实施的股权激励不再执行，经协商，彼时仍在职的员工通过设立的员工持股平台取得激励股权。针对彼时已离职的 19 名员工，由郑瑞俊通过协商以支付补偿款的方式对相关协议进行解除。郑瑞俊于 2020 年度向相关员工支付补偿款折合合计 498.00 万元。实际控制人因员工股权激励产生的费用视作对公司的投入，公司在前述补偿款实际支付当期计入管理费用及资本公积。

（2）管理费用率与同行业可比公司比较

公司的管理费用率与同行业可比公司对比如下：

公司名称	2021 年 1-6 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
------	--------------	---------	---------	---------

通富微电	2.95%	3.34%	3.84%	4.27%
晶方科技	2.98%	2.91%	7.17%	6.95%
利扬芯片	10.15%	12.07%	9.09%	11.48%
气派科技	4.13%	4.40%	4.43%	7.45%
平均值	5.05%	5.68%	6.13%	7.54%
发行人	5.17%	6.36%	13.67%	11.11%

注：数据来源于同行业可比公司公开披露数据。

2018年度和2019年度，公司总体收入规模较低，规模效应未充分体现，同时2019年度计入管理费用的股份支付为1,395.00万元，管理费用率高于同行业可比公司平均值。2020年度和2021年1-6月，随着公司收入规模快速增长，公司管理费用率大幅下降，与同行业可比公司的平均水平趋同。

3、研发费用

(1) 研发费用变动分析

报告期各期，公司研发费用的构成及变动情况如下：

单位：万元

项目	2021年1-6月		2020年度		2019年度		2018年度	
	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)	金额	占比(%)
职工薪酬	1,126.20	38.85	1,838.72	39.00	1,919.93	42.26	1,357.66	35.85
折旧与摊销	974.05	33.60	1,581.67	33.54	1,308.48	28.80	1,216.91	32.13
直接投入	561.44	19.37	1,169.47	24.80	931.50	20.51	1,040.51	27.47
股份支付	166.04	5.73	28.99	0.61	220.00	4.84	-	-
其他	71.22	2.46	96.37	2.04	162.73	3.58	172.20	4.55
合计	2,898.95	100.00	4,715.21	100.00	4,542.64	100.00	3,787.27	100.00

公司研发费用主要包括职工薪酬、折旧与摊销、直接投入等。报告期各期，公司的研发费用分别为3,787.27万元、4,542.64万元、4,715.21万元和2,898.95万元，占当期营业收入的比例分别为13.26%、11.52%、7.62%和8.08%，公司高度重视技术研发投入和产品应用开发，报告期内研发投入持续增加。

报告期内，主要研发费用的变化情况如下：

①职工薪酬

报告期各期，公司研发费用中的职工薪酬分别为 1,357.66 万元、1,919.93 万元、1,838.72 万元和 1,126.20 万元，占当期研发费用的比例分别为 35.85%、42.26%、39.00%和 38.85%，2019 年度，研发费用中的职工薪酬较 2018 年度大幅增加，主要系研发人员数量增加及薪酬水平提升所致；2020 年度，研发费用中的职工薪酬较 2019 年度小幅下降，主要受新冠疫情影响，相关人员社保减免所致。

②折旧与摊销

报告期各期，公司研发费用中的折旧与摊销费用分别为 1,216.91 万元、1,308.48 万元、1,581.67 万元和 974.05 万元，占当期研发费用的比例分别为 32.13%、28.80%、33.54%和 33.60%。报告期各期，折旧与摊销金额呈上升趋势，主要系公司高度重视技术和产品创新，研发设备投入逐年增加所致。

③直接投入

报告期各期，公司研发费用中的直接投入主要系材料和能源投入，分别为 1,040.51 万元、931.50 万元、1,169.47 万元和 561.44 万元，占当期研发费用的比例分别为 27.47%、20.51%、24.80%和 19.37%。报告期各期，直接投入金额总体呈上升趋势，主要系公司研发项目持续增加，耗用材料和能源增加所致。

(2) 报告期内研发费用对应的研发项目情况

报告期内，公司研发项目主要围绕现有产品的升级和新工艺、新产品的研发，具体预算及研发费用投入情况如下：

单位：万元

项目名称	整体预算	研发费用				实施进度	是否主要围绕核心技术及其相关产品
		2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度		
半导体晶圆高效精度减薄工艺的研究	350.00	-	-	-	316.14	已结项	是
半导体蚀刻设备管路排水优化的设计	450.00	-	-	-	427.20	已结项	是
半导体晶圆的表面处理技术的研究	450.00	-	-	-	422.49	已结项	是
半导体缺陷检测结果的考核系统研究	200.00	-	-	-	186.30	已结项	是

高密度液晶屏幕驱动芯片高可靠性封测技术研发及产业化	半导体晶圆高效精度研磨减薄关键技术工艺研发	500.00	-	-	-	490.34	已结项	是
	高可靠晶圆贴底缺陷检测系统的研发	250.00	-	-	-	228.40	已结项	是
	高精度高效率低耗材螺旋式光阻涂布工艺的研发	750.00	-	-	468.98	229.95	已结项	是
	高可靠性晶圆载台边缘防护防滑脱关键技术研发	550.00	-	-	577.93	-	已结项	是
	应对真空异常优化晶圆切割品质关键技术研发	150.00	-	-	136.36	-	已结项	是
高精度自动化防破损晶圆定位转移装置的研发	450.00	-	-	-	420.68	已结项	是	
高精度半导体晶圆凸块表面处理及高效的氧化钨清洗工艺的研发	400.00	-	-	-	335.92	已结项	是	
蚀刻制程中的光阻层显影处理技术的研究	500.00	-	-	263.07	235.29	已结项	是	
晶圆研磨工艺的研究	450.00	-	-	224.61	181.00	已结项	是	
高精度柔性基板高良率封装工艺及检测装置的研发	450.00	-	-	74.14	313.55	已结项	是	
集成电路晶圆涂布工艺的研发	195.00	-	-	173.46	-	已结项	是	
集成电路晶圆电镀工艺的研发	600.00	-	-	592.69	-	已结项	是	
高应力玻璃覆晶芯片封装工艺关键技术研发	400.00	-	-	389.27	-	已结项	是	
捡晶品质优化装置及关键技术研发	320.00	-	-	301.69	-	已结项	是	
晶圆修正齿轮运转偏心治具的研发	200.00	-	-	176.75	-	已结项	是	
半导体晶圆 8 吋&12 吋共享之铁框变形检测装置的研发	200.00	-	-	152.84	-	已结项	是	
晶圆 12 吋铁框于提篮反向装置的研发	200.00	-	-	186.87	-	已结项	是	
集成电路晶圆蚀刻工艺的研发	850.00	-	395.69	405.99	-	已结项	是	
晶圆研磨共享背检装置的研发	870.00	-	638.49	203.43	-	已结项	是	
多规格柔性基板自动清洁技术的研发	490.00	-	249.26	214.57	-	已结项	是	
高精度柔性基板封装工艺中 particle 防护的研发	700.00	-	694.31	-	-	已结项	是	
提高柔性基板键合长芯片拾取稳定性工艺的研发	420.00	-	415.11	-	-	已结项	是	
减少电镀均匀性异常及工艺研发	650.00	-	615.26	-	-	已结项	是	

高可靠微型底切结构凸块及工艺的研发	500.00	-	482.34	-	-	已结项	是
切割刀片背面缺陷处理及刀片侦测装置的研发	150.00	-	113.61	-	-	已结项	是
金凸块高可靠性贴膜工艺的研发	300.00	-	295.48	-	-	已结项	是
金凸块高均匀性制程工艺及蚀刻槽铣槽工艺的研发	620.00	162.89	410.67	-	-	已结项	是
细长型柔性基板封装工艺关键技术的研发	720.00	194.26	404.98	-	-	已结项	是
减小凸块底切的结构及其制造方法	400.00	169.98	-	-	-	在研	是
晶圆图像坐标自动输出研发	750.00	413.04	-	-	-	在研	是
晶圆级测试微弱电流漏电改善装置研发	750.00	276.50	-	-	-	在研	是
先进封装领域一种芯片反向机制研发	500.00	369.34	-	-	-	在研	是
高精度卷带覆晶封装工艺关键技术的研发	300.00	258.88	-	-	-	在研	是
CMOS 影像传感器工艺	700.00	466.79	-	-	-	在研	是
提高驱动芯片可靠性装置及工艺的研发	500.00	82.96	-	-	-	在研	是
柔性基板封装工艺辅助治具技术的研发	500.00	129.57	-	-	-	在研	是
金凸块表面粗糙度改善工艺研发	600.00	374.75	-	-	-	在研	是
合计	19,285.00	2,898.95	4,715.21	4,542.64	3,787.27	-	-

（3）研发费用率与同行业可比公司比较

公司的研发费用率与同行业可比公司对比如下：

公司名称	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
通富微电	7.30%	6.91%	8.33%	7.78%
晶方科技	11.71%	12.44%	21.99%	21.52%
利扬芯片	10.50%	9.80%	9.48%	9.08%
气派科技	5.73%	6.39%	6.64%	5.77%
平均值	8.81%	8.89%	11.61%	11.04%
发行人	8.08%	7.62%	11.52%	13.26%

注：数据来源于同行业可比公司公开披露数据。

由于营收规模与业务聚焦不同，同行业可比公司间研发费用率均存在差异。晶方科技专注于 CMOS 传感器的封装测试，其研发费用率较高；利扬芯片营业收入规模较小，因此其研发费用率也较高；通富微电和气派科技各年度研发费用率较为平稳。

报告期内，公司研发费用率均处于同行业可比公司的区间范围内。2018 年度，公司研发费用率高于同行业可比公司平均水平，主要系公司专注于高端先进封装测试领域，研发投入规模较大且合肥生产基地尚处于客户导入阶段，总体收入规模较低所致。2019 年度起，公司研发费用率与同行业可比公司平均水平基本持平。

（4）研发支出核算方法

①研发费用的范围

公司的研发费用主要包括：研发材料和能耗投入、研发人员薪酬、研发设备的折旧和摊销和其他与研发活动相关的费用等。

②研发费用的归集与分配方法

1) 职工薪酬

根据研发人员名单归集职工薪酬，并按照研发人员实际参与项目研发情况，按工时分配至各研发项目。

2) 直接投入

研发直接投入系通过研发工单按研发项目进行归集。直接投入分为研发专用领料和共用领料。研发专用领料：根据研发项目实际所需材料，经审批后直接领用，并据此计入研发项目直接投入；共用领料：根据实际发生的直接投入，在生产工单和研发工单中按工时进行分配，研发工单所用直接投入，计入研发费用。公司按照研发工单实际工时比例分摊各月实际发生的水电等能源费用。

3) 折旧与摊销

根据设备使用部门可划分为研发专用设备与共用设备。研发专用设备是由研发中心专门管理和使用的设备，其折旧直接计入研发费用；共用设备是指既用于研发活动又从事生产活动的机器设备，按照研发工单工时耗用比例对设备折旧进行分摊。

4) 其他

研发人员差旅费、物料耗用等费用根据实际发生金额计入研发费用并合理归集到相应研发项目中。

4、财务费用

报告期内，公司财务费用主要构成明细如下：

单位：万元

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
利息支出	-848.68	3,983.19	6,544.06	2,475.65
减：利息收入	66.33	48.72	40.00	4.26
银行手续费	13.64	20.09	26.88	25.63
汇兑损益	97.33	520.87	404.48	-345.61
融资担保手续费	119.00	524.09	49.33	32.83
合计	-685.05	4,999.52	6,984.75	2,184.23

公司财务费用主要包括利息支出、汇兑损益和融资担保手续费等。报告期各期，公司财务费用分别为 2,184.23 万元、6,984.75 万元、4,999.52 万元和-685.05 万元，占当期营业收入的比例分别为 7.65%、17.72%、8.08%和-1.91%。

报告期内，公司收到的财政贴息金额分别为 600.00 万元、77.71 万元、1,877.14 万元、2,000.00 万元，公司收到财政贴息后冲减当年度财务费用，并计入非经常性损益。

2019 年度，公司利息支出较 2018 年度增长较快，主要系有息负债的利息增加所致；2020 年度和 2021 年 1-6 月，公司利息支出大幅减少，一方面系公司于 2020 年起获得多笔外部股权融资，归还了大部分资金拆借款，利息支出相应减少；另一方面系当期获得了大额的财政贴息所致。

（五）其他影响利润的因素分析

1、税金及附加

单位：万元

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
房产税	85.25	170.50	170.21	170.21
印花税	17.27	41.10	23.84	28.66

其他	13.19	25.81	26.18	19.33
合计	115.72	237.41	220.23	218.19

报告期内，公司税金及附加主要由房产税和印花税构成。

2、信用减值损失及资产减值损失

单位：万元

项目	类型	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
信用减值损失	坏账损失	-12.08	-376.84	-198.27	-
资产减值损失	坏账损失	-	-	-	-103.76
	存货跌价损失	-637.23	-249.10	-487.97	-1,776.16
合计		-649.32	-625.94	-686.24	-1,879.92

注：2019年起因执行新金融工具准则，坏账损失计入信用减值损失核算。

报告期内，公司坏账损失分别为-103.76万元、-198.27万元、-376.84万元和-12.08万元，系按照会计政策计提的应收款项坏账损失。

报告期内，公司存货跌价损失分别为-1,776.16万元、-487.97万元、-249.10万元和-637.23万元。报告期各期末，公司对存货计提了一定规模的跌价准备，具体情况参见本节“十一、资产质量分析”之“（二）流动资产结构及其变化分析”之“5、存货”。

3、其他收益

报告期内，公司其他收益构成情况如下：

单位：万元

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
与资产相关的政府补助	736.43	1,583.39	219.38	35.84
与收益相关的政府补助	39.19	910.27	368.20	204.87
其他	11.74	5.35	0.63	0.04
合计	787.37	2,499.02	588.21	240.75

报告期内，公司其他收益分别为240.75万元、588.21万元、2,499.02万元和787.37万元，主要系公司从政府部门取得的补助款。政府补助具体构成情况如下：

单位：万元

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度	与资产相关/ 与收益相关
----	-----------	--------	--------	--------	-----------------

2018 年安徽省制造强省建设资金项目	8.35	16.71	16.71	5.57	与资产相关
2018 年江苏省级工业转型升级专项资金	-	-	-	13.00	与收益相关
2018 年扬州科技发展计划项目专项资金	-	-	-	12.00	与收益相关
	3.78	7.56	7.56	1.89	与资产相关
2018 年度江苏省企业研发费用补助	-	-	30.00	-	与收益相关
2019 年承接产业转移促进加工贸易创新发展专项资金	-	55.95	-	-	与收益相关
2019 年度邗江区创新主体培育资助	-	20.00	-	-	与收益相关
2019 年度支持工业设计政策奖励	-	10.00	-	-	与收益相关
2019 年合肥事后奖补类小微企业提档升级项目资金	-	10.00	-	-	与收益相关
2019 年重大研发项目补助	-	20.00	-	-	与收益相关
2020 年安徽省级电子商务发展资金	-	144.20	-	-	与收益相关
2020 年邗江区高质量发展专项资金	14.96	-	-	-	与资产相关
	20.00	-	-	-	与收益相关
安徽省集成电路产业政策资金	34.60	43.11	-	-	与资产相关
	-	200.00	-	-	与收益相关
高企奖励	-	20.00	5.00	-	与收益相关
合肥市工业发展政策项目补助	122.65	167.00	117.28	1.67	与资产相关
合肥市经信局研发设备补助	92.49	61.30	25.54	-	与资产相关
合肥市外贸促进政策资金	-	148.23	61.27	25.00	与收益相关

合肥市外资专项工作激励资金	-	144.20	-	-	与收益相关
合肥市先进制造业发展政策补助资金	34.19	-	-	-	与资产相关
技能培训补贴	-	-	-	17.84	与收益相关
江苏省工业技术改造奖补资金	-	33.70	-	-	与收益相关
江苏省双创计划补助	-	15.00	35.00	20.00	与收益相关
绿色发展奖	5.00	-	-	-	与收益相关
绿扬金凤补助	-	11.80	-	20.00	与收益相关
失业保险费返还	-	14.47	4.15	-	与收益相关
稳岗补贴	4.69	12.87	11.13	10.76	与收益相关
先进技术创新补助款	-	-	100.00	-	与收益相关
新站发展局发展专项资金	-	-	-	25.50	与收益相关
新站区环保设备改造补贴	1.80	2.40	-	-	与资产相关
新站区经贸发展局“三重一创”	22.75	37.32	37.32	26.72	与资产相关
新站区经贸局2018年度承接产业转移促进加工贸易创新发展专项资金	-	-	38.98	-	与收益相关
新站区经贸局疫情补贴	-	10.00	-	-	与收益相关
新站区研发补贴	363.78	1,214.85	-	-	与资产相关
扬州市级先进制造业发展引导资金	37.08	33.16	14.97	-	与资产相关
	-	39.00	-	-	与收益相关
扬州市商务发展专项补助	1.50	-	70.51	59.47	与收益相关
转型升级做大做强补助	-	-	10.00	-	与收益相关
2020年度邗江区专利专项资金	6.94	-	-	-	与收益相关
其他	1.06	0.85	2.16	1.30	与收益相关

总计	775.63	2,493.66	587.58	240.72	-
-----------	---------------	-----------------	---------------	---------------	----------

注：上表不含公司收到的财政贴息，公司收到财政贴息后冲减当年度财务费用，并已计入非经常性损益。报告期内，公司收到的财政贴息金额分别为 600.00 万元、77.71 万元、1,877.14 万元、2,000.00 万元。

报告期内，公司科研项目相关的政府补助具体情况如下：

单位：万元

科研项目名称	项目类别	实施周期	总预算	财政预算金额	计入当期损益的金额			
					2021年1-6月	2020年	2019年	2018年
高密度液晶屏幕驱动芯片高可靠性封测技术研发及产业化	扬州市科技计划项目	2018年7月-2020年6月	2,200.00	80.00	3.78	7.56	7.56	13.89

公司所有计入当期损益的科研项目相关的政府补助均作为非经常性损益。

4、资产处置收益

单位：万元

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
固定资产处置收益	-10.26	-106.59	177.81	1.57
合计	-10.26	-106.59	177.81	1.57

报告期内，公司向第三方处置了部分生产设备，资产处置收益分别为 1.57 万元、177.81 万元、-106.59 万元和-10.26 万元。

5、营业外收支

（1）营业外收入

报告期内，公司营业外收入明细如下：

单位：万元

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
无需支付款项	-	6.34	4.80	8.01
其他	4.04	20.78	4.17	4.48
合计	4.04	27.12	8.97	12.50

报告期内，公司的营业外收入分别为 12.50 万元、8.97 万元、27.12 万元和 4.04 万元，金额相对较小。

（2）营业外支出

报告期内，公司营业外支出明细如下：

单位：万元

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
对外捐赠	-	8.00	1.00	1.00
罚款支出	-	-	-	15.00
其他	0.00	0.37	1.20	1.23
合计	0.00	8.37	2.20	17.23

2018年，公司罚款支出具体情况参见本招股说明书“第七节 公司治理与独立性”之“五、发行人报告期内违法违规行及受到处罚的情况”。

（六）股份支付

报告期内，公司采用员工持股平台的方式对高级管理人员和重要员工等进行股权激励，充分调动员工的积极性和创造性。相关股权激励的具体情况参见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“十、发行人本次公开发行前制定或实施的股权激励”，股权激励涉及的股份支付处理情况如下：

1、按历次授予确认的股份支付

（1）2019年股份支付

①合肥芯成

合肥芯成系发行人员工持股平台，2019年12月，实际控制人杨会将其通过合肥芯成间接持有的发行人100万元股权以零对价转让给施周峰，由于本次股权激励未设定服务期，因此未进行分期摊销，公司参考最近引入外部投资者入股价格2.50元/注册资本，于2019年度一次性确认股份支付费用250.00万元。

②香港宝信

香港宝信系发行人境外员工持股平台。2019年12月，实际控制人郑瑞俊将其通过香港宝信间接持有的发行人1,250万元股权以零对价转让给萧明山等公司员工，其中转让给萧明山的430万元股权系预留未来员工激励股权，实际授予被激励对象820万元股权。由于本次股权激励未设定服务期，因此未进行分期摊销。

公司参考最近引入外部投资者入股价格 2.50 元/注册资本，于 2019 年度一次性确认股份支付费用 2,050.00 万元（不含预留未来员工激励股权）。

（2）2020 年、2021 年 1-6 月股份支付

2020 年 12 月，公司股东会审议通过员工股权激励办法，通过合肥芯成、合肥宝芯、合肥汇芯、香港宝信四个主体实施员工股权激励。根据员工股权激励办法的相关要求，公司在境内首次公开发行股票并上市前或上市后持股平台持有公司股份解除锁定前，相关员工不得直接、间接或以其他方式转让其持股平台的出资份额；如果员工因离职等原因离开公司，公司及实际控制人有权要求激励对象将其持有的激励股权无偿转让给实际控制人或其指定主体，该等主体的范围不应超出公司或其下属企业的在职员工。

公司预计于 2022 年 12 月 31 日前完成发行上市工作。

①合肥芯成

2020 年 12 月，实际控制人杨会将其通过合肥芯成间接持有的发行人 282.50 万元股权以零对价转让给姜红涛等公司员工。公司股份支付分摊计算时预计上述员工的服务期为 61 个月。

公司参照最近引入外部投资者入股价格 5.50 元/注册资本，计算转让给姜红涛等公司员工股权公允价值为 1,553.75 万元，从 2020 年 12 月起按 61 个月进行摊销。2020 年度确认股份支付费用 25.47 万元；2021 年 1-6 月正常摊销 152.83 万元，冲回当期离职人员股份支付费用 6.00 万元，实际确认股份支付费用 146.83 万元。

②合肥宝芯

合肥宝芯系发行人员工持股平台，2020 年 12 月，实际控制人杨会将其通过合肥宝芯间接持有的发行人 145.00 万元股权以零对价转让给徐伟等公司员工。公司股份支付分摊计算时预计上述员工的服务期为 61 个月。

公司参照最近引入外部投资者入股价格 5.50 元/注册资本，计算转让股权公允价值 797.50 万元，从 2020 年 12 月起按 61 个月进行摊销。2020 年度确认股份

支付费用 13.07 万元；2021 年 1-6 月正常摊销 78.44 万元，冲回当期离职人员股份支付费用 2.59 万元，实际确认股份支付费用 75.85 万元。

③合肥汇芯

合肥汇芯系发行人员工持股平台，2020 年 12 月，实际控制人杨会将其通过合肥汇芯间接持有的发行人 145.00 万元股权以零对价转让给涂可嘉等公司员工。公司股份支付分摊计算时预计上述员工的服务期为 61 个月。

公司参照最近引入外部投资者入股价格 5.50 元/注册资本，计算转让股权公允价值为 797.50 万元，从 2020 年 12 月起按 61 个月进行摊销。2020 年度确认股份支付费用 13.07 万元；2021 年 1-6 月正常摊销 78.44 万元，冲回当期离职人员股份支付费用 3.79 万元，实际确认股份支付费用 74.66 万元。

④香港宝信

2020 年 12 月，实际控制人郑瑞俊将其通过香港宝信间接持有的发行人 395.00 万元股权以零对价转让给钟玉玄等公司员工。公司股份支付分摊计算时预计上述员工的服务期为 61 个月。

公司参照最近引入外部投资者入股价格 5.50 元/注册资本，计算转让股权公允价值为 2,172.50 万元，从 2020 年 12 月起按 61 个月进行摊销。2020 年度确认股份支付费用 35.61 万元；2021 年 1-6 月正常摊销 213.69 万元，冲回当期离职人员股份支付费用 4.42 万元，实际确认股份支付费用 209.27 万元。

2、按是否计入非经常性损益划分的股份支付

对于设定服务期的股权激励，公司在服务期内对员工服务成本或费用进行分摊确认，计入经常性损益；对于未设定服务期和限制性条件的股权激励，在授予当期一次性计入当期非经常性损益。报告期各期，公司股份支付按是否计入非经常性损益分类如下：

单位：万元

项目	2021 年 1-6 月	2020 年度	2019 年度
计入经常性损益的股份支付	506.61	87.23	-

计入非经常性损益的股份支付	-	-	2,300.00
合计	506.61	87.23	2,300.00

2019 年计入非经常性损益的股份支付金额较大，主要系当年合肥芯成与香港宝信所涉股份支付均未设定服务期，因此未进行分期摊销，一次性计入当期非经常性损益。

3、按费用归属划分的股份支付

公司按照股权激励授予对象所对应的费用归属，将股份支付分别计入销售费用、管理费用、研发费用和主营业务成本，具体分类如下：

单位：万元

项目	2021 年 1-6 月	2020 年度	2019 年度
管理费用	163.59	27.27	1,395.00
销售费用	69.90	11.65	285.00
研发费用	166.04	28.99	220.00
营业成本	107.09	19.33	400.00
合计	506.61	87.23	2,300.00

（七）存在累计未弥补亏损的影响

报告期内，公司营业收入、息税折旧摊销前利润、净利润、扣除非经常性损益后的净利润和累计未弥补亏损如下：

单位：万元

项目	2021 年 1-6 月/ 2021.6.30	2020 年度/ 2020.12.31	2019 年度/ 2019.12.31	2018 年度/ 2018.12.31
营业收入	35,875.90	61,892.67	39,420.66	28,558.35
息税折旧摊销前利润	13,044.03	17,674.39	153.22	-1,203.57
净利润	5,881.79	-400.50	-16,402.95	-10,708.02
扣除非经常性损益后的净利润	3,106.38	-4,190.82	-14,953.45	-11,545.62
累计未弥补亏损	-29,316.93	-65,239.19	-64,838.68	-48,435.74

截至 2021 年 6 月 30 日，公司累计未弥补亏损为-29,316.93 万元，2021 年 1-6 月已实现盈利但最近一期末仍存在累计未弥补亏损。

1、存在未弥补亏损的原因

公司存在未弥补亏损主要系前期亏损较多所致，具体原因参见“第五节 发行人基本情况”之“二、发行人设立及报告期内股本和股东变化情况”之“（三）有限责任公司整体变更为股份有限公司的基准日未分配利润为负的情况”。

母公司股改后，其账面累计未弥补亏损已消除。报告期末，公司存在累计未弥补亏损-29,316.93 万元，主要系子公司江苏汇成前期形成的累计未弥补亏损。

2、累计未弥补亏损的影响分析

随着显示面板下游市场需求的增加和公司生产工艺的优化、产能的持续释放，公司技术水平和产品质量得到市场认可，收入规模快速增长，经营状况持续好转。报告期内，公司的经营活动现金流量净额分别为-1,559.50 万元、-2,238.90 万元、15,109.00 万元和 13,457.43 万元，系公司经营状况持续向好；公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为-11,545.62 万元、-14,953.45 万元、-4,190.82 万元和 3,106.38 万元，2021 年 1-6 月已实现盈利。

报告期内，公司的经营规模和营业收入均实现了快速增长，在销售业绩及各渠道融资的支持下，公司在报告期内各经营环节运作良好，存在累计未弥补亏损的情形不会对公司的现金流、业务拓展、人才吸引、团队稳定性、研发投入、战略性投入、经营可持续性等方面产生重大不利影响。

3、累计未弥补亏损的变动趋势

报告期各期末，公司累计未弥补亏损分别为-48,435.74 万元、-64,838.68 万元、-65,239.19 万元和-29,316.93 万元；报告期内，公司净利润分别为-10,708.02 万元、-16,402.95 万元、-400.50 万元和 5,881.79 万元，已于 2021 年 1-6 月实现可观盈利。随着公司生产规模持续扩大，盈利能力的不断增强，预计未来累计未弥补亏损会逐步减少并消除。

4、风险提示

公司已就最近一期末存在累计未弥补亏损的事项分别在“重大事项提示”和“第四节 风险因素”中作出风险提示。

5、投资者保护措施及承诺

为增强公司盈利能力，充分保护投资者的合法权益，公司根据自身经营特点制定了相关措施，具体详见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“六、本次发行相关主体作出的重要承诺”之“（五）关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺”之“1、发行人承诺”部分。

公司控股股东、实际控制人和董事、监事、高级管理人员、核心技术人员按照相关规定作出的关于减持股份的特殊安排或承诺，详见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“六、本次发行相关主体作出的重要承诺”之“（一）关于所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及相关股东持股及减持意向的承诺”部分。

十一、资产质量分析

（一）资产构成及其变化分析

报告期各期末，公司资产构成如下：

单位：万元

项目	2021.6.30		2020.12.31		2019.12.31		2018.12.31	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
流动资产	40,870.70	22.31	40,256.34	23.00	32,957.03	21.24	23,412.31	19.74
非流动资产	142,299.93	77.69	134,734.29	77.00	122,232.85	78.76	95,205.59	80.26
合计	183,170.63	100.00	174,990.63	100.00	155,189.88	100.00	118,617.90	100.00

报告期各期末，公司资产总额分别为 118,617.90 万元、155,189.88 万元、174,990.63 万元和 183,170.63 万元，非流动资产在公司资产结构中占比较高。公司总资产规模随着业务规模逐步扩大，主要系公司持续购置专用设备扩产所致。

（二）流动资产结构及其变化分析

报告期各期末，公司流动资产的构成情况如下：

单位：万元

项目	2021.6.30		2020.12.31		2019.12.31		2018.12.31	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)

货币资金	2,785.05	6.81	4,951.68	12.30	2,744.15	8.33	575.61	2.46
应收票据	-	-	36.15	0.09	-	-	-	-
应收账款	15,570.59	38.10	15,501.74	38.51	8,765.94	26.60	5,044.98	21.55
应收款项融资	-	-	-	-	36.10	0.11	-	-
预付款项	403.80	0.99	1,297.94	3.22	157.32	0.48	275.97	1.18
其他应收款	175.17	0.43	48.17	0.12	151.53	0.46	83.56	0.36
存货	15,324.68	37.50	12,439.05	30.90	14,176.49	43.02	10,262.82	43.84
其他流动资产	6,611.41	16.18	5,981.61	14.86	6,925.50	21.01	7,169.36	30.62
合计	40,870.70	100.00	40,256.34	100.00	32,957.03	100.00	23,412.31	100.00

报告期各期末，公司流动资产金额分别为 23,412.31 万元、32,957.03 万元、40,256.34 万元和 40,870.70 万元，主要由货币资金、应收账款、存货和其他流动资产构成。

1、货币资金

报告期各期末，公司货币资金构成情况如下：

单位：万元

项目	2021.6.30		2020.12.31		2019.12.31		2018.12.31	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
库存现金	2.29	0.08	1.28	0.03	3.51	0.13	1.16	0.20
银行存款	1,472.10	52.86	4,899.82	98.95	2,660.22	96.94	343.82	59.73
其他货币资金	1,310.65	47.06	50.57	1.02	80.42	2.93	230.63	40.07
合计	2,785.05	100.00	4,951.68	100.00	2,744.15	100.00	575.61	100.00

报告期各期末，公司货币资金分别为 575.61 万元、2,744.15 万元、4,951.68 万元和 2,785.05 万元，占流动资产的比例分别为 2.46%、8.33%、12.30%和 6.81%。货币资金主要由银行存款和其他货币资金组成，其他货币资金主要系保函保证金。

2019 年末，公司银行存款较 2018 年末增加 2,316.40 万元，主要系公司当期融资活动增加所致；2020 年末银行存款期末余额较大，主要系公司经营情况向好，经营活动产生的现金流增加且当年发生多笔股权融资所致；2021 年 6 月末银行存款期末余额较 2020 年末下降明显，主要系公司归还贷款所致。

2021 年 6 月末，其他货币资金主要系公司将尚处于海关监管期的部分进口

减免税设备向境内银行办理抵押借款所缴纳的保函保证金。

2、应收账款

报告期各期末，公司应收账款情况如下：

单位：万元

项目	2021.6.30 /2021年1-6月	2020.12.31 /2020年度	2019.12.31 /2019年度	2018.12.31 /2018年度
应收账款账面余额	16,390.43	16,324.29	9,229.77	5,317.62
应收账款坏账准备	819.84	822.54	463.83	272.64
应收账款账面价值	15,570.59	15,501.74	8,765.94	5,044.98
营业收入	35,875.90	61,892.67	39,420.66	28,558.35
应收账款账面余额 占营业收入的比例	22.84%	26.38%	23.41%	18.62%

注：2021年6月末应收账款余额占当期营业收入比例系按照年化数据计算，即应收账款期末余额/（2021年1-6月营业收入*2）。

（1）应收账款规模及变动分析

报告期各期末，公司应收账款账面余额分别为5,317.62万元、9,229.77万元、16,324.29万元和16,390.43万元，占当期营业收入比例分别为18.62%、23.41%、26.38%和22.84%。报告期内，随着公司销售规模不断增加，应收账款期末余额逐年增加，与收入变动趋势相匹配。

（2）应收账款账龄及坏账准备计提分析

报告期各期末，公司应收账款按账龄组合计提坏账准备的明细如下：

单位：万元

账龄	账面余额	占比（%）	坏账准备	计提比例（%）
2021.6.30				
1年以内	16,384.05	99.96	819.20	5.00
1-2年	6.38	0.04	0.64	10.00
合计	16,390.43	100.00	819.84	5.00
2020.12.31				
1年以内	16,289.25	99.79	814.46	5.00
1-2年	12.15	0.07	1.22	10.00
2-3年	22.89	0.14	6.87	30.00

合计	16,324.29	100.00	822.54	5.04
2019.12.31				
1年以内	9,182.88	99.49	459.14	5.00
1-2年	46.89	0.51	4.69	10.00
合计	9,229.77	100.00	463.83	5.03
2018.12.31				
1年以内	5,310.51	99.87	265.53	5.00
3年以上	7.11	0.13	7.11	100.00
合计	5,317.62	100.00	272.64	5.13

报告期各期末，公司账龄 1 年以内的应收账款占账面余额的比例均在 99% 以上；账龄超过 1 年的应收账款金额较小，占比极低。公司制定的应收账款坏账计提政策符合公司实际情况，不存在因应收账款金额过大而影响公司持续经营能力的情形。

公司与同行业可比公司按账龄组合计提应收账款坏账准备的比例如下：

账龄	通富微电	晶方科技	利扬芯片	气派科技	公司
1年以内（含，下同）	5%	2%	3%	5%	5%
1-2年	15%	10%	10%	10%	10%
2-3年	50%	30%	30%	30%	30%
3-4年	100%	50%	100%	100%	100%
4-5年	100%	50%	100%	100%	100%
5年以上	100%	100%	100%	100%	100%

注：同行业可比公司数据均取自其公开披露数据；通富微电为 2018 年年报披露的比例，晶方科技为 2019 年年报披露的比例，利扬芯片、气派科技为招股说明书披露的比例。

由上表，公司坏账准备计提比例与同行业可比公司不存在重大差异。

（3）应收账款前五大客户情况

报告期各期末，公司应收账款前五大客户情况如下：

单位：万元

序号	公司名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例（%）
2021.6.30			
1	天钰	5,125.73	31.27

2	联咏科技	4,141.37	25.27
3	瑞鼎	1,849.49	11.28
4	奇景光电	1,061.20	6.47
5	爱协生	972.37	5.93
合计		13,150.16	80.22
2020.12.31			
1	天钰	4,943.52	30.28
2	联咏科技	2,556.44	15.66
3	奇景光电	1,823.46	11.17
4	瑞鼎	1,352.26	8.28
5	光洋	1,330.42	8.15
合计		12,006.09	73.54
2019.12.31			
1	天钰	2,585.58	28.01
2	奇景光电	1,554.47	16.84
3	瑞鼎	1,208.49	13.09
4	矽创	1,112.51	12.05
5	晶门	714.72	7.74
合计		7,175.77	77.73
2018.12.31			
1	瑞鼎	1,216.58	22.88
2	天钰	882.86	16.60
3	晶门	835.70	15.72
4	矽创	695.80	13.08
5	光洋	439.90	8.27
合计		4,070.84	76.55

注：上表中，客户按照同一控制下合并口径披露：①天钰包括天钰科技股份有限公司、合肥捷达微电子有限公司、深圳天德钰科技股份有限公司；②瑞鼎包括瑞鼎科技股份有限公司、昆山瑞创芯电子有限公司；③爱协生包括深圳市爱协生科技有限公司、马鞍山爱协生科技有限公司、东莞市爱协生智能科技有限公司、焯溢科技（香港）有限公司、华科供应链（香港）有限公司；④矽创包括矽创电子股份有限公司、力领科技股份有限公司；⑤晶门包括晶门科技有限公司、晶门科技（中国）有限公司、东莞晶广半导体有限公司、晶门科技（深圳）有限公司；⑥光洋包括光洋化学应用材料科技（昆山）有限公司、光洋新材料科技（昆山）有限公司。

截至 2021 年 6 月末，公司应收账款余额前五名合计 13,150.16 万元，占应收

账款余额的比例为 80.22%。应收账款前五大客户的占比较高，主要系公司客户集中度较高所致，公司主要客户多为显示驱动芯片设计领域知名上市公司，应收账款无法收回的风险较低。截至本招股说明书签署日，公司各期末应收账款回款状况良好。

（4）应收账款周转能力

单位：次/年

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
应收账款周转率	2.19	4.84	5.42	6.43

注：应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额

报告期内，公司主要客户的信用期在 60 天-120 天之间，应收账款周转率整体呈下降趋势主要系公司与行业知名客户的交易规模持续扩大，期末应收余额相应提高所致。

报告期内，公司应收账款周转率与同行业可比公司比较如下：

单位：次/年

公司名称	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
通富微电	3.97	6.13	4.85	4.29
晶方科技	4.29	9.49	6.36	7.07
利扬芯片	2.14	4.37	4.80	3.39
气派科技	3.17	5.60	5.18	5.20
平均值	3.39	6.40	5.30	4.99
发行人	2.19	4.84	5.42	6.43

注：同行业可比公司数据均取其公开披露数据。

2018 年公司应收账款周转率高于同行业可比公司平均水平，主要系合肥生产基地建成投产，处于客户导入、业务规模扩张阶段，当期应收账款平均余额较低所致；2019 年公司应收账款周转率与同行业可比公司平均水平基本持平；2020 年度至 2021 年 1-6 月，公司应收账款周转率低于同行业平均水平，但仍处于同行业可比公司范围之内。

3、预付款项

报告期各期末，公司预付款项情况如下：

单位：万元

账龄	2021.6.30		2020.12.31		2019.12.31		2018.12.31	
	账面余额	占比 (%)	账面余额	占比 (%)	账面余额	占比 (%)	账面余额	占比 (%)
1年以内	403.80	100.00	1,297.94	100.00	157.32	100.00	263.65	95.53
1-2年	-	-	-	-	-	-	12.33	4.47
合计	403.80	100.00	1,297.94	100.00	157.32	100.00	275.97	100.00

报告期各期末，公司预付账款金额分别为 275.97 万元、157.32 万元、1,297.94 万元和 403.80 万元，主要为预付的供应商货款。2020 年末，公司预付款项金额较高，主要系预付田中贵金属的含金原料款。

4、其他应收款

报告期各期末，公司其他应收款账面价值分别为 83.56 万元、151.53 万元、48.17 万元和 175.17 万元，主要系应收退税款、押金保证金以及应收暂付款。

5、存货

(1) 存货结构及变动情况分析

报告期各期末，公司存货结构及变动情况如下：

单位：万元

项目	账面余额	跌价准备	账面价值	占比 (%)
2021.6.30				
原材料	11,848.92	516.84	11,332.07	73.95
在产品	321.43	26.66	294.76	1.92
库存商品	3,641.94	138.90	3,503.05	22.86
发出商品	187.58	8.00	179.58	1.17
低值易耗品	15.21	-	15.21	0.10
合计	16,015.08	690.40	15,324.68	100.00
2020.12.31				
原材料	9,552.91	221.05	9,331.86	75.02
在产品	338.55	30.52	308.03	2.48
库存商品	2,920.45	158.32	2,762.13	22.21
发出商品	18.26	0.63	17.64	0.14

低值易耗品	19.38	-	19.38	0.16
合计	12,849.56	410.50	12,439.05	100.00
2019.12.31				
原材料	10,223.23	218.70	10,004.54	70.57
在产品	614.08	189.12	424.96	3.00
库存商品	3,991.95	400.83	3,591.12	25.33
发出商品	135.62	3.03	132.59	0.94
低值易耗品	23.28	-	23.28	0.16
合计	14,988.16	811.67	14,176.49	100.00
2018.12.31				
原材料	6,816.80	874.20	5,942.61	57.90
在产品	289.52	71.63	217.89	2.12
库存商品	5,014.21	938.75	4,075.47	39.71
发出商品	10.06	1.04	9.02	0.09
低值易耗品	17.83	-	17.83	0.17
合计	12,148.43	1,885.61	10,262.82	100.00

报告期各期末，公司存货主要由原材料及库存商品构成，原材料账面余额分别为 6,816.80 万元、10,223.23 万元、9,552.91 万元和 11,848.92 万元，总体呈上升趋势，主要系随着业务规模扩大，公司整体备货规模相应增加；库存商品账面余额分别为 5,014.21 万元、3,991.95 万元、2,920.45 万元和 3,641.94 万元，库存规模有所降低，主要系随着终端用户对芯片需求增长，客户缩短提货周期。

（2）存货跌价准备分析

公司在资产负债表日对存货按成本与可变现净值孰低计量。报告期各期末，公司存货跌价准备分别为 1,885.61 万元、811.67 万元、410.50 万元和 690.40 万元。

报告期各期末，公司存货跌价准备存在一定规模，主要系：一方面，公司原材料中含金成分较高，黄金价格的波动会影响公司账面持有含金原料的市场价值，各期末公司根据市场黄金价格测算跌价影响；另一方面，合肥生产基地 2018 年度和 2019 年度产销量较小，产成品所分摊的成本较高，因此产品可变现净值低于成本，产生一定的跌价准备。

报告期各期末，公司存货跌价计提比例与同行业可比公司对比情况如下：

公司名称	2021.6.30	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
通富微电	4.89%	5.67%	4.98%	6.81%
晶方科技	2.18%	2.96%	3.15%	1.63%
利扬芯片	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
气派科技	4.33%	4.74%	3.67%	4.69%
平均值	2.85%	3.34%	2.95%	3.28%
平均值 (剔除利扬芯片)	3.80%	4.46%	3.93%	4.38%
公司	4.31%	3.19%	5.42%	15.52%

注 1：同行业可比公司数据均取其公开披露数据。

注 2：由于利扬芯片各期末未计提存货跌价准备，在同行业对比时剔除利扬芯片。

报告期初期，公司的存货跌价准备计提比例高于同行业可比公司平均水平，主要系与同行业相比，公司仍存在快速发展阶段，而同行业可比公司均为成熟的上市公司，具备相对较强的营运及盈利能力。

2018 年末，公司存货跌价准备计提金额较大，主要系：一方面，合肥封测基地投产初期的订单较少，因产能利用率未饱和导致单位成本较高，基于谨慎性的原则，公司于期末对库存商品计提了存货跌价准备；另一方面，受 2018 年末黄金价格走势影响，公司对含金原料相应计提了存货跌价准备。

2019 年，虽然合肥封测基地的销量较 2018 年有所上升，但单位固定成本仍较高，仍存在一定的存货跌价损失。

（3）存货周转能力

单位：次/年

项目	2021 年 1-6 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
存货周转率	1.78	3.58	2.76	2.75

注：存货周转率 = 营业成本 / 存货平均余额

报告期内，公司存货周转率与同行业可比公司比较如下：

单位：次/年

公司	2021 年 1-6 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
通富微电	3.53	5.16	4.17	4.93

晶方科技	2.78	5.81	4.17	5.65
利扬芯片	11.50	26.92	19.73	18.01
气派科技	2.72	5.45	5.55	6.41
平均值	5.13	10.84	8.41	8.75
平均值 (剔除利扬芯片)	3.01	5.47	4.63	5.66
公司	1.78	3.58	2.76	2.75

注：同行业可比公司数据均取自其公开披露数据。

同行业可比公司中，利扬芯片仅从事测试业务，主营业务成本主要由机器设备折旧、直接人工和制造费用组成，原材料使用量较少，存货周转率远高于同行业可比公司。剔除利扬芯片后，报告期内公司存货周转率低于同行业可比公司，主要系公司封装测试的显示驱动芯片在金凸块制造环节所用含金原料价格较高，导致各期期末存货价值较高，存货周转率较低。

6、其他流动资产

公司其他流动资产的构成情况如下：

单位：万元

项目	2021.6.30	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
待抵扣进项税额	6,406.16	5,892.30	6,893.62	7,154.92
待摊融资担保费	186.67	81.67	-	-
待摊利息	-	-	28.89	14.44
待摊租赁费	18.58	7.64	3.00	-
合计	6,611.41	5,981.61	6,925.50	7,169.36

报告期各期末，公司其他流动资产主要为待抵扣进项税。公司所处行业属于重资产行业，固定资产投资额较大，账面存在一定规模的待抵扣进项税额，后续将依据税收法规陆续抵扣。

（三）非流动资产结构及其变化分析

报告期各期末，公司非流动资产的构成情况如下：

单位：万元

项目	2021.6.30		2020.12.31		2019.12.31		2018.12.31	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)

长期应收款	-	-	399.87	0.30	358.64	0.29	-	-
固定资产	135,348.80	95.12	119,780.26	88.90	102,629.94	83.96	73,224.80	76.91
在建工程	3,971.65	2.79	2,588.16	1.92	13,461.89	11.01	11,171.54	11.73
无形资产	1,787.21	1.26	1,899.67	1.41	2,017.89	1.65	1,956.47	2.05
其他非流动资产	1,192.28	0.84	10,066.34	7.47	3,764.49	3.08	8,852.78	9.30
合计	142,299.93	100.00	134,734.29	100.00	122,232.85	100.00	95,205.59	100.00

公司非流动资产主要由固定资产、在建工程和其他非流动资产构成。报告期各期末，公司非流动资产金额分别为 95,205.59 万元、122,232.85 万元、134,734.29 万元和 142,299.93 万元，逐年增加，主要系公司随着业务规模的扩大而持续购置专用设备所致。

1、长期应收款

报告期各期末，公司长期应收款占非流动资产的比例较低，主要系公司售后租回融资租赁形成的保证金。

2、固定资产

(1) 固定资产构成情况

报告期各期末，公司固定资产构成情况如下：

单位：万元

项目	2021.6.30	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
房屋及建筑物	26,172.49	26,712.25	27,987.82	27,936.45
通用设备	433.83	393.69	501.58	553.39
专用设备	108,685.34	92,604.20	74,046.09	44,636.36
运输工具	57.14	70.11	94.45	98.60
合计	135,348.80	119,780.26	102,629.94	73,224.80

公司固定资产主要由专用设备和房屋及建筑物构成。其中专用设备增长较快，主要系合肥封测基地建成投产后，公司购置先进专用设备扩充产能所致。

(2) 固定资产折旧及减值情况

单位：万元

项目	原值	累计折旧	减值准备	净值
----	----	------	------	----

2021.6.30				
房屋及建筑物	34,281.39	8,108.89	-	26,172.49
通用设备	1,415.92	982.09	-	433.83
专用设备	150,800.46	42,115.11	-	108,685.34
运输工具	182.23	125.10	-	57.14
合计	186,679.99	51,331.19	-	135,348.80
2020.12.31				
房屋及建筑物	34,182.30	7,470.05	-	26,712.25
通用设备	1,288.95	895.26	-	393.69
专用设备	127,786.95	35,182.75	-	92,604.20
运输工具	182.23	112.12	-	70.11
合计	163,440.44	43,660.18	-	119,780.26
2019.12.31				
房屋及建筑物	34,182.30	6,194.49	-	27,987.82
通用设备	1,272.22	770.64	-	501.58
专用设备	97,273.72	23,227.63	-	74,046.09
运输工具	190.38	95.94	-	94.45
合计	132,918.63	30,288.69	-	102,629.94
2018.12.31				
房屋及建筑物	32,914.79	4,978.34	-	27,936.45
通用设备	1,105.93	552.54	-	553.39
专用设备	59,666.32	15,029.96	-	44,636.36
运输工具	166.93	68.33	-	98.60
合计	93,853.98	20,629.17	-	73,224.80

公司于资产负债表日对各项固定资产进行减值测试，经测试未发现减值迹象，未计提减值准备。

（3）固定资产折旧政策及同行业比较分析

报告期内，公司与同行业可比公司固定资产折旧政策比较情况如下：

单位：年

项目	通富微电	晶方科技	利扬芯片	气派科技	发行人
房屋及建筑物	5-47	20-40	-	40	20-30

通用设备	2-8	3-5	3	5	3-5
专用设备	2-8	5-12	5-10	10	2-10
运输工具	5	5-10	4	5	5

注：同行业可比公司数据均取自其公开披露数据。

公司主要固定资产折旧年限与同行业可比公司不存在重大差异，符合所处行业生产经营的特点。

3、在建工程

报告期内，公司在建工程变动情况如下：

单位：万元

2021年1-6月					
项目	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数
在安装设备	2,588.16	24,821.56	23,438.07	-	3,971.65
零星工程	-	99.08	99.08	-	-
合计	2,588.16	24,920.65	23,537.16	-	3,971.65
2020年度					
项目	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数
在安装设备	13,461.89	20,885.77	31,751.72	7.77	2,588.16
合计	13,461.89	20,885.77	31,751.72	7.77	2,588.16
2019年度					
项目	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数
在安装设备	11,171.54	40,681.36	38,391.01	-	13,461.89
零星工程	-	1,269.42	1,269.42	-	-
合计	11,171.54	41,950.79	39,660.43	-	13,461.89
2018年度					
项目	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数
在安装设备	3,325.52	27,304.75	19,458.74	-	11,171.54
合计	3,325.52	27,304.75	19,458.74	-	11,171.54

报告期各期末，公司在建工程账面价值分别为 11,171.54 万元、13,461.89 万元、2,588.16 万元和 3,971.65 万元，主要为在安装设备。报告期内，公司持续购置生产设备，部分设备于报告期末尚处于安装调试阶段。公司在建工程无减值迹象，无需计提在建工程减值准备。

4、无形资产

报告期各期末，公司无形资产为土地使用权和软件，具体情况如下：

单位：万元

项目	2021.6.30	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
土地使用权	1,521.24	1,538.58	1,573.26	1,607.94
软件	265.97	361.09	444.64	348.54
合计	1,787.21	1,899.67	2,017.89	1,956.47

5、其他非流动资产

报告期各期末，公司其他非流动资产构成情况如下：

单位：万元

项目	2021.6.30	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
预付设备款	1,135.67	10,009.74	3,730.49	8,848.08
预付软件款	56.60	56.60	34.00	4.70
合计	1,192.28	10,066.34	3,764.49	8,852.78

公司其他非流动资产主要为预付设备款，系公司预付的高端测试机、内引脚接合机等专用设备款。

十二、偿债能力、流动性与持续经营能力分析

（一）负债状况分析

1、负债结构及构成变化分析

单位：万元

项目	2021.6.30		2020.12.31		2019.12.31		2018.12.31	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
流动负债	34,336.63	65.43	26,481.48	43.60	110,090.79	81.37	71,810.32	74.65
非流动负债	18,138.14	34.57	34,262.06	56.40	25,207.19	18.63	24,380.24	25.35
合计	52,474.77	100.00	60,743.54	100.00	135,297.98	100.00	96,190.55	100.00

报告期各期末，公司负债总额分别为 96,190.55 万元、135,297.98 万元、60,743.54 万元和 52,474.77 万元。2018 年末与 2019 年末，公司负债总额较高，

主要由流动负债构成，系合肥厂区前期建设投入较大，现金流较为紧张，公司对外筹措资金用于购置设备和生产经营所致。2020年起，公司获得了多笔外部股权融资并归还了大部分的流动负债，总体负债水平得到改善。

2、流动负债结构及构成变化分析

报告期各期末，公司流动负债结构如下：

单位：万元

项目	2021.6.30		2020.12.31		2019.12.31		2018.12.31	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
短期借款	20,254.01	58.99	11,978.39	45.23	13,330.55	12.11	15,130.12	21.07
应付账款	7,535.76	21.95	5,330.60	20.13	10,688.03	9.71	10,145.09	14.13
预收款项	-	-	-	-	54.94	0.05	538.67	0.75
合同负债	51.73	0.15	46.56	0.18	-	-	-	-
应付职工薪酬	942.26	2.74	984.70	3.72	1,308.57	1.19	1,024.75	1.43
应交税费	74.83	0.22	97.51	0.37	85.31	0.08	80.38	0.11
其他应付款	2,865.50	8.35	2,409.55	9.10	71,453.22	64.90	43,191.31	60.15
一年内到期的非流动负债	2,612.54	7.61	5,597.92	21.14	13,170.17	11.96	1,700.00	2.37
其他流动负债	-	-	36.25	0.14	-	-	-	-
合计	34,336.63	100.00	26,481.48	100.00	110,090.79	100.00	71,810.32	100.00

公司流动负债主要包括短期借款、应付账款、应付职工薪酬、其他应付款和一年内到期的非流动负债等。2018年与2019年，其他应付款余额较大主要系公司对外筹措资金用于购置设备与生产经营。

(1) 短期借款

报告期各期末，公司短期借款情况如下：

单位：万元

项目	2021.6.30	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
保证借款	8,516.81	8,000.00	11,000.00	11,000.00
抵押及保证借款	11,682.08	3,892.85	2,290.11	4,130.12
应付利息	55.12	85.54	40.43	-
合计	20,254.01	11,978.39	13,330.55	15,130.12

公司短期借款主要由保证借款、抵押及保证借款构成，2018年末至2020年末，整体负债规模略有降低。2021年6月末，短期借款期末余额较2020年期末增长明显，主要系公司通过短期借款置换长期借款以降低利息支出。抵押及保证借款中存在关联担保情形，具体参见本招股说明书“第十三节 附件”之“附表二：关联担保”。

报告期内，公司存在为满足贷款银行受托支付要求，通过供应商和第三方取得银行贷款的情形，具体情况参见“第七节 公司治理与独立性”之“四、发行人内部控制情况”之“（三）报告期内发行人财务内控不规范情形及整改情况”之“1、转贷事项”。

（2）应付账款

报告期各期末，公司应付账款构成如下：

单位：万元

项目	2021.6.30	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
设备工程款	4,725.07	2,850.08	7,507.66	7,507.35
货款	2,589.61	2,274.42	2,913.93	2,462.15
其他	221.08	206.10	266.44	175.58
合计	7,535.76	5,330.60	10,688.03	10,145.09

报告期各期末，公司应付账款余额分别为 10,145.09 万元、10,688.03 万元、5,330.60 万元和 7,535.76 万元，主要为应付设备工程款和材料货款。

2018 年末与 2019 年末应付账款余额较高，主要系部分设备工程款未支付。2020 年度，公司支付了上述款项，应付账款余额规模大幅减小。

（3）应付职工薪酬

报告期各期末，公司应付职工薪酬余额分别为 1,024.75 万元、1,308.57 万元、984.70 万元和 942.26 万元。2020 年末期末余额较 2019 年度下降，主要系期末人数减少所致，人员变动的原因为参见本招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“十一、发行人的员工及社会保障情况”之“（一）员工情况”之“1、员工人数”。

（4）其他应付款

报告期各期末，公司其他应付款构成如下：

单位：万元

项目	2021.6.30	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
应付利息	-	-	-	82.10
其他应付款项	2,865.50	2,409.55	71,453.22	43,109.22
合计	2,865.50	2,409.55	71,453.22	43,191.31

其他应付款由应付利息和其他应付款项组成，具体情况如下：

①应付利息

单位：万元

项目	2021.6.30	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
短期借款应付利息	-	-	-	46.14
长期借款应付利息	-	-	-	35.95
合计	-	-	-	82.10

②其他应付款项

单位：万元

项目	2021.6.30	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
拆借款	2,700.00	2,318.28	63,249.21	35,040.87
应付暂收款	105.25	-	164.65	-
待确认政府补助	-	-	8,000.00	8,000.00
押金保证金	1.00	1.00	-	-
其他	59.25	90.27	39.36	68.35
小计	2,865.50	2,409.55	71,453.22	43,109.22

2018年末、2019年末，公司其他应付款项余额较高，主要系拆借款与待确认政府补助。

2018年度与2019年度，公司对外筹措资金用于购置生产设备与日常经营，因此期末拆借款余额较大。2020年度、2021年1-6月，公司收入快速增长，经营性活动现金流快速好转，且公司通过股权融资的方式补充了营运资金，归还了大部分拆借款。

公司于 2017 年收到合肥市高新区管委会的待确认政府补助 8,000.00 万元。双方约定公司自合肥项目投产之日起 3 年内需达到 8,000 片/月的晶圆金凸块封装测试生产量且设立省级或省级以上研发中心，如公司完成上述约定则相关借款可以转为政府补助，否则需要按照约定利率归还借款。2020 年度，公司经管委会确认完成上述指标，相关借款转为政府补助。

（5）一年内到期的非流动负债

报告期各期末，公司一年内到期的非流动负债的具体构成如下：

单位：万元

项目	2021.6.30	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
一年内到期的长期借款	2,603.18	4,206.89	11,772.82	1,700.00
一年内到期的长期应付款	9.36	1,391.03	1,397.35	-
合计	2,612.54	5,597.92	13,170.17	1,700.00

一年内到期的非流动负债主要为一年内到期的长期借款，明细情况如下：

单位：万元

项目	2021.6.30	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
保证借款	2,600.00	2,400.00	1,600.00	700.00
抵押借款	-	-	-	1,000.00
抵押及保证借款	-	1,800.00	10,150.00	-
应付利息	3.18	6.89	22.82	-
合计	2,603.18	4,206.89	11,772.82	1,700.00

3、非流动负债结构及构成变化分析

报告期各期末，公司非流动负债的构成情况如下：

单位：万元

项目	2021.6.30		2020.12.31		2019.12.31		2018.12.31	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
长期借款	7,914.22	43.63	23,486.83	68.55	20,685.59	82.06	23,300.00	95.57
长期应付款	-	-	444.89	1.30	1,835.92	7.28	-	-
递延收益	10,223.91	56.37	10,330.34	30.15	2,685.68	10.65	1,080.24	4.43
合计	18,138.14	100.00	34,262.06	100.00	25,207.19	100.00	24,380.24	100.00

公司非流动负债由长期借款、长期应付款及递延收益构成。

（1）长期借款

报告期各期末，公司长期借款的具体构成情况如下：

单位：万元

项目	2021.6.30	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
保证借款	7,900.00	17,300.00	12,700.00	14,300.00
抵押借款	-	-	-	4,000.00
抵押及保证借款	-	6,150.00	7,950.00	5,000.00
应付利息	14.22	36.83	35.59	-
合计	7,914.22	23,486.83	20,685.59	23,300.00

2018年末至2020年末，公司长期借款的余额较大，主要系公司向金融机构取得的借款。公司所处行业属于重资产行业，需要大规模资金投入，公司积极通过各种渠道筹措资金并不断优化负债结构。2021年6月末，公司的长期借款期末余额下降明显，主要系公司通过短期借款置换长期借款所致。公司各项借款的抵押担保的具体情况参见本招股说明书“第十一节 其他重大事项”之“一、重要合同”之“（三）授信、借款及担保合同”和“第十三节 附件”之“附表二：关联担保”。

（2）长期应付款

公司长期应付款系机器设备售后租回形成的融资租赁款。2019年，公司与合肥兴泰科技融资租赁有限公司签署协议，约定公司向其转让一批自有生产设备，上述交易作价4,500.00万元。同时，公司再向合肥兴泰科技融资租赁有限公司融资租入上述生产设备，协议约定租赁期限为3年，上述资产转让不属于销售，公司继续确认被转让资产，同时确认一项金融负债。

（3）递延收益

报告期各期末，公司递延收益的具体构成情况如下：

单位：万元

项目	2021.6.30	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
政府补助	10,223.91	10,330.34	2,685.68	1,080.24

报告期内，公司递延收益的明细情况如下：

单位：万元

项目	期初递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末递延收益	与资产相关/ 与收益相关
2021年1-6月					
2018年安徽省制造强省建设资金项目	284.02	-	8.35	275.66	与资产相关
合肥市工业发展政策项目补助	1,751.30	-	122.65	1,628.65	与资产相关
新站区经贸发展局“三新一创”	244.35	-	22.75	221.60	与资产相关
2018年扬州科技发展计划项目专项资金	51.00	-	3.78	47.22	与资产相关
合肥市经信局研发设备补助	413.16	-	92.49	320.67	与资产相关
扬州市级先进制造业发展引导资金	176.07	50.85	37.08	189.84	与资产相关
安徽省集成电路产业政策资金	592.89	-	34.60	558.30	与资产相关
新站区环保设备改造补贴	32.40	-	1.80	30.60	与资产相关
新站区研发补贴	6,785.15	-	363.78	6,421.38	与资产相关
2020年邗江区高质量发展专项资金	-	79.15	14.96	64.19	与资产相关
合肥市先进制造业发展政策补助资金	-	500.00	34.19	465.81	与资产相关
合计	10,330.34	630.00	736.43	10,223.91	-
2020年度					
2018年安徽省制造强省建设资金项目	300.72	-	16.71	284.02	与资产相关
合肥市工业发展政策项目补助	1,472.84	445.46	167.00	1,751.30	与资产相关
新站区经贸发展局“三新一创”	281.68	-	37.32	244.35	与资产相关
2018年扬州科技发展计划项目专项资金	58.56	-	7.56	51.00	与资产相关
合肥市经信局研发设备补助	474.46	-	61.30	413.16	与资产相关
扬州市级先进制造业发展引导资金	97.43	111.80	33.16	176.07	与资产相关
安徽省集成电路产业政策	-	636.00	43.11	592.89	与资产相关

资金					
新站区环保设备改造补贴	-	34.80	2.40	32.40	与资产相关
新站区研发补贴	-	8,000.00	1,214.85	6,785.15	与资产相关
合计	2,685.68	9,228.06	1,583.39	10,330.34	-
2019 年度					
2018 年安徽省制造强省建设资金项目	317.43	-	16.71	300.72	与资产相关
合肥市工业发展政策项目补助	377.69	1,212.42	117.28	1,472.84	与资产相关
新站区经贸发展局“三重一创”	319.00	-	37.32	281.68	与资产相关
2018 年扬州科技发展计划项目专项资金	66.11	-	7.56	58.56	与资产相关
合肥市经信局研发设备补助	-	500.00	25.54	474.46	与资产相关
扬州市级先进制造业发展引导资金	-	112.40	14.97	97.43	与资产相关
合计	1,080.24	1,824.82	219.38	2,685.68	-
2018 年度					
2018 年安徽省制造强省建设资金项目	-	323.00	5.57	317.43	与资产相关
合肥市工业发展政策项目补助	-	379.36	1.67	377.69	与资产相关
新站区经贸发展局“三重一创”	-	345.72	26.72	319.00	与资产相关
2018 年扬州科技发展计划项目专项资金	-	68.00	1.89	66.11	与资产相关
合计	-	1,116.08	35.84	1,080.24	-

（二）偿债能力分析

报告期内，公司偿债能力指标如下：

偿债能力指标	2021.6.30/ 2021 年 1-6 月	2020.12.31/ 2020 年度	2019.12.31/ 2019 年度	2018.12.31/ 2018 年度
流动比率（倍）	1.19	1.52	0.30	0.33
速动比率（倍）	0.74	1.05	0.17	0.18
资产负债率（母公司口径）	23.71%	27.71%	71.41%	61.10%
资产负债率（合并口径）	28.65%	34.71%	87.18%	81.09%
息税折旧摊销前利润（万元）	13,044.03	17,674.39	153.22	-1,203.57

利息保障倍数（倍）	-5.93	0.90	-1.51	-3.33
利息保障倍数（剔除财政贴息影响）（倍）	6.11	0.93	-1.48	-2.48

注 1：利息保障倍数=（利润总额+利息费用）/利息费用

注 2：2021 年 1-6 月公司利润总额为正数，但利息保障倍数为负数，系公司当期收到财政贴息冲减财务费用，导致利息支出为负数。

1、公司偿债能力分析

报告期初期，公司对外负债水平较高，导致 2018 年末、2019 年末流动比率和速动比率较低。随着公司生产规模逐年扩大，营业收入迅速增长，经营性活动现金流快速好转，同时公司也通过股权融资优化资本结构，偿还了部分借款，因此 2020 年末公司的流动比率和速动比率大幅改善，资产负债结构有所优化。2021 年 6 月末，公司新增部分短期借款，导致流动比率与速动比率有所下降。

报告期内，公司息税折旧摊销前利润、利息保障倍数（剔除财政贴息影响）整体呈快速改善趋势，公司资产流动性稳步提升，偿债能力增强。

2、公司偿债能力指标与可比公司的比较分析

报告期内，公司与同行业可比公司的偿债能力指标比较如下：

指标	公司	2021.6.30	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
流动比率 （倍）	通富微电	1.21	1.23	0.84	0.95
	利扬芯片	4.77	7.10	1.63	3.26
	晶方科技	4.74	10.23	6.70	5.68
	气派科技	1.38	0.91	0.90	0.89
	平均值	3.02	4.87	2.52	2.70
	发行人	1.19	1.52	0.30	0.33
速动比率 （倍）	通富微电	1.00	1.03	0.57	0.68
	利扬芯片	4.67	7.03	1.58	3.11
	晶方科技	4.51	9.84	6.17	5.32
	气派科技	1.22	0.71	0.70	0.66
	平均值	2.85	4.65	2.26	2.44
	发行人	0.74	1.05	0.17	0.18
资产负债率 （合并口）	通富微电	56.01	52.83	59.76	53.45
	利扬芯片	14.12	10.60	21.81	12.47

径，%)	晶方科技	16.40	9.89	13.97	17.11
	气派科技	40.45	47.64	44.54	39.77
	平均值	31.75	30.24	35.02	30.70
	发行人	28.65	34.71	87.18	81.09

注：同行业可比公司数据均取自于公开披露数据。

2018年末与2019年末，公司偿债能力相关指标低于同行业平均水平，主要系合肥生产基地处于发展初期，公司进行大额固定资产投资以扩大生产规模，营运资金紧张导致负债水平较高。自2020年起，公司收入规模迅速增长，经营性活动现金流快速好转，且公司通过股权融资优化了负债结构，2020年末及2021年6月末，公司流动比率与速动比率已逐步和通富微电、气派科技接近，且资产负债率与行业平均水平已不存在明显差异，整体偿债能力得以持续增强。

（三）报告期内股利分配情况

报告期内，公司未进行股利分配。

（四）现金流量分析

报告期内，公司的现金流量简要情况如下：

单位：万元

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
经营活动产生的现金流量净额	13,457.43	15,109.00	-2,238.90	-1,559.50
投资活动产生的现金流量净额	-14,316.32	-31,616.82	-36,612.14	-36,402.51
筹资活动产生的现金流量净额	-2,407.57	19,285.97	41,574.27	37,191.04
现金及现金等价物净增加额	-3,426.71	2,237.38	2,318.75	-262.95

1、经营活动产生的现金流量分析

报告期内，公司经营活动产生的现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
销售商品、提供劳务收到的现金	35,872.62	55,751.39	35,420.18	28,348.93
收到的税费返还	509.35	1,906.85	1,197.65	1,690.84
收到其他与经营活动有关的现金	2,807.08	4,117.67	2,632.62	2,024.95
经营活动现金流入小计	39,189.06	61,775.91	39,250.45	32,064.73

购买商品、接受劳务支付的现金	19,203.08	34,842.15	26,527.00	21,376.96
支付给职工以及为职工支付的现金	5,505.16	9,950.00	12,150.91	9,859.17
支付的各项税费	144.09	238.15	229.38	189.42
支付其他与经营活动有关的现金	879.28	1,636.61	2,582.06	2,198.67
经营活动现金流出小计	25,731.62	46,666.91	41,489.36	33,624.23
经营活动产生的现金流量净额	13,457.43	15,109.00	-2,238.90	-1,559.50

2018 年度、2019 年度，公司经营活动产生的现金流量净额为负，主要系公司处于产能利用率爬坡阶段，公司产销量较小；自 2020 年度起，随着公司经营规模大幅增长，经营活动现金流入逐渐向好，经营活动产生的现金流量净额快速上升。

报告期内，公司净利润与经营活动产生的现金流量净额之间的差异如下表所示：

单位：万元

项目	2021 年 1-6 月	2020 年度	2019 年度	2018 年度
净利润	5,881.79	-400.50	-16,402.95	-10,708.02
加：资产减值准备	649.32	625.94	686.24	1,879.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,889.05	13,859.70	9,834.00	6,891.57
无形资产摊销	121.86	232.00	178.12	137.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	10.26	106.59	-177.81	-1.57
财务费用（收益以“-”号填列）	1,317.52	6,864.05	7,042.98	2,762.87
存货的减少（增加以“-”号填列）	-3,522.86	1,488.34	-4,401.64	-4,708.03
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-168.34	-7,091.51	-3,736.28	-1,678.43
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	772.22	-662.85	2,438.43	3,864.96
其他	506.61	87.23	2,300.00	-
经营活动产生的现金流量净额	13,457.43	15,109.00	-2,238.90	-1,559.50

由于公司系重资产投入行业，固定资产投入规模大且负债水平高，折旧费用与财务费用导致了经营活动产生的现金流量净额与净利润之间的差异。

2、投资活动产生的现金流量分析

报告期内，公司投资活动产生的现金流量如下：

单位：万元

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	380.04	310.31	705.18	0.40
投资活动现金流入小计	380.04	310.31	705.18	0.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,696.37	31,927.13	37,317.32	36,402.90
投资活动现金流出小计	14,696.37	31,927.13	37,317.32	36,402.90
投资活动产生的现金流量净额	-14,316.32	-31,616.82	-36,612.14	-36,402.51

报告期内，公司持续购置生产设备扩大产能，因此购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金金额较大。

3、筹资活动产生的现金流量分析

报告期内，公司筹资活动现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2021年1-6月	2020年度	2019年度	2018年度
吸收投资收到的现金	9,995.28	88,887.23	10,564.60	-
取得借款收到的现金	20,245.81	30,594.42	41,400.79	34,327.15
收到其他与筹资活动有关的现金	1,825.00	60,996.14	64,662.71	36,681.55
筹资活动现金流入小计	32,066.09	180,477.79	116,628.11	71,008.70
偿还债务支付的现金	28,026.84	37,721.78	35,840.80	20,479.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,042.43	3,060.50	3,395.04	1,601.81
支付其他与筹资活动有关的现金	5,404.39	120,409.53	35,817.99	11,736.15
筹资活动现金流出小计	34,473.66	161,191.81	75,053.83	33,817.65
筹资活动产生的现金流量净额	-2,407.57	19,285.97	41,574.27	37,191.04

2018-2020年度，公司筹资活动现金流入金额逐年增长，主要系公司通过股权融资和对外资金拆借等方式筹措资金，用于购置生产设备和日常经营。

2020年度，公司筹资活动现金流出较2019年度增长较大，主要系公司通过股权融资补充了部分货币资金，归还了大部分资金拆借款所致。

2021年1-6月，公司筹资活动现金为负数，主要系当期股权融资筹集的资金规模较小，同时公司归还了部分长期借款所致。

（五）持续经营能力分析

公司主要从事显示驱动芯片的金凸块制造及封装测试服务，是中国境内最早具备金凸块制造能力，及最早导入12吋晶圆金凸块产线并实现量产的显示驱动芯片先进封测企业之一，具备8吋及12吋晶圆全制程封装测试能力。公司所封装测试的芯片系日常使用的智能手机、智能穿戴、高清电视、笔记本电脑、平板电脑等各类终端产品得以实现画面显示的核心部件。公司具备先进的封测技术、稳定的产品良率与优质的服务能力，在显示驱动芯片封装测试领域具有较强的市场竞争力。

公司所处行业属于国家产业政策鼓励发展行业，且具备良好的成长性，公司自创立以来始终坚持以技术创新为核心驱动力，致力于先进封装技术的升级与应用，设立研发中心并积极引进高端技术人才，专注于自主研发，夯实核心技术储备，积极导入客户并丰富产品线，已积累了优质的客户资源。报告期内，公司营业收入快速增长，经营活动产生的现金流量净额持续向好，2021年1-6月已实现大幅盈利。

报告期内，公司未出现对持续经营能力产生重大不利影响的因素，根据所处行业发展趋势以及公司的业务发展状况，公司具备良好的持续经营能力。

十三、重大资本性支出、重大资产重组或重大股权收购合并事项

（一）资本性支出

1、报告期内重大资本性支出

报告期内，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为36,402.90万元、37,317.32万元、31,927.13万元和14,696.37万元。

公司属于先进封装测试服务商，集成电路封装测试行业对生产设备有较高要求，因此公司的生产设备投入规模大、占资产比重高，公司的资本性支出主要用于购置先进的生产设备。

2、未来可预见的重大资本性支出计划

截至本招股说明书签署日，公司未来可预见的重大资本性支出主要为本次募集资金投资项目的投资支出，详见本招股说明书“第九节 募集资金运用与未来发展规划”。

（二）重大资产重组或重大股权收购合并事项

报告期内，发行人未发生重大资产重组事项与重大股权收购合并事项。

十四、资产负债表日后事项、或有事项、其他重要事项及重大担保、诉讼等事项

（一）资产负债表日后事项

截至本招股说明书签署日，公司不存在资产负债表日后事项。

（二）承诺及或有事项

截至本招股说明书签署日，公司开具保函情况如下所示：

单位：万元

开证行	保函编号	受益人名称	保函金额	开立日期	失效日期
兴业银行合肥分行	215302 保 007	中华人民共和国 国庐州海关	1,260.00	2021/3/23	2022/12/31
中国银行股份有限公司 邗江支行营业部	GC0713917002060	中华人民共和国 国南京海关	50.00	2017/11/15	2023/1/4
合计	-	-	1,310.00	-	-

（三）重大担保、诉讼及其他重要事项

1、重大担保事项

报告期内，公司曾作为担保方为扬州新瑞连支付合肥创投支付股权转让款事项提供担保，截至本招股说明书签署日，上述担保事项已解除，具体参见本招股说明书“第十三节 附表二：关联担保”之“（二）公司作为担保方的关联担保”。

2、重大诉讼事项

截至本招股说明书签署日，公司不存在重大诉讼事项。

3、其他重要事项

截至本招股说明书签署日，公司不存在其他重要事项。

十五、盈利预测

发行人未编制盈利预测报告。

第九节 募集资金运用与未来发展规划

一、募集资金运用概况

（一）募集资金计划及投资项目概况

本次公开发行所募集的资金主要投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资预算总额	募集资金投资总额	实施主体
1	12吋显示驱动芯片封测扩能项目	97,406.15	97,406.15	汇成股份
2	研发中心建设项目	8,980.84	8,980.84	汇成股份
3	补充流动资金	50,000.00	50,000.00	汇成股份
合计		156,386.99	156,386.99	

注：在项目实施过程中根据实际情况可能会对资金使用计划做必要调整。

若本次募集资金不能满足上述拟投资项目的资金需求，公司将通过自筹方式解决资金缺口；如本次发行实际募集资金超过投资项目所需，公司将按照资金状况和募集资金管理制度，将多余部分用于与主营业务相关的项目，继续加大生产、研发等方面的投入。本次发行募集资金到位前，公司将根据实际经营需要以自筹资金对上述项目进行前期投入，募集资金到位后，将按照《募集资金管理制度》的要求予以置换。

（二）募集资金投资项目备案及批复情况

序号	项目名称	项目备案号	环评批复文号
1	12吋显示驱动芯片封测扩能项目	2106-340163-04-05-868647	环建审〔2021〕12034号
2	研发中心建设项目	2106-340163-04-05-926481	无需环评
3	补充流动资金	不涉及	不涉及

截至本招股说明书签署日，公司已完成“12吋显示驱动芯片封测扩能项目”的项目备案并取得环评批复；已完成“研发中心建设项目”的项目备案，根据合肥市新站高新技术产业开发区生态环境分局出具的情况说明，“研发中心建设项目”无需办理环境影响评价手续。

（三）募集资金投资项目对同业竞争和发行人独立性的影响

在募集资金投资项目实施后，发行人不会与控股股东及实际控制人控制的其他企业产生同业竞争，也不会对发行人的独立性产生不利影响。

（四）募集资金使用管理制度

发行人 2020 年年度股东大会审议通过了《关于制订〈合肥新汇成微电子股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》，建立了募集资金专项存储制度，对募集资金的专户存储、使用、投向变更、管理和监督进行了明确的规定。本次募集资金将严格按照规定存储在董事会指定的专门账户集中管理，专款专用，规范使用募集资金。

（五）募集资金投向科技创新领域的具体安排

公司募集资金投资项目系按照现有技术和客户基础、研发创新战略、业务发展规划等情况对现有先进封装业务进行的产能扩产和技术的延伸升级，有利于公司进一步提高先进封装测试领域的生产与研发实力。公司本次募投项目中除“补充流动资金”项目外，其他均属于科技创新领域，具体情况请参见本节之“二、本次募集资金拟投资项目情况”。

（六）募集资金投资项目与发行人现有主要业务、核心技术之间的关系

本次募集资金拟投资于“12 吋显示驱动芯片封测扩能项目”和“研发中心建设项目”，募集资金投资项目均围绕公司现有主要业务与核心技术展开，是公司主营业务的延伸和拓展，符合公司发展战略。

“12 吋显示驱动芯片封测扩能项目”是在公司现有产品、技术的基础上，充分发挥公司在显示驱动芯片封测领域的技术、工艺和产品优势，通过购买先进生产设备，扩大生产规模，缓解产能瓶颈，巩固并提升公司的市场地位和综合竞争力，提高相关产品的市场占有率。

“研发中心建设项目”将结合公司的产品规划及整体战略目标，引进先进研发设备、招募高素质研发人才，以公司现有核心技术为依托，开展金凸块制造、覆晶封装、CMOS 影像传感器封装等先进封装工艺的研发活动：一方面通过本项

目持续升级凸块制造（Bumping）技术，积极布局扇外型集成电路封装（Fan-out）、2.5D/3D、系统级封装（SiP）等高端先进封装技术，为突破行业技术瓶颈奠定坚实的技术基础；另一方面积极开发 CMOS 影像传感器封装技术，丰富公司产品结构，为公司的可持续发展提供有力的技术支撑。

公司本次募集资金投资项目以现有主营业务和核心技术为基础，拟实现公司优势产品扩产、提升公司技术水平，为公司在先进封装领域拓展产品线、丰富产品类型奠定坚实的基础，提高公司的核心竞争能力，保障公司未来销售及盈利规模的扩大。

二、本次募集资金拟投资项目情况

（一）12 吋显示驱动芯片封测扩能项目

1、项目概况

本项目以发行人为实施主体，建设周期为 18 个月，是公司利用现有厂区，在现有技术工艺的基础上进行的产能扩充。项目达产后，公司 12 吋晶圆金凸块制造、晶圆测试、玻璃覆晶封装与薄膜覆晶封装产能将大幅提升。

本项目总投资 97,406.15 万元，项目建设内容包括引进测试机、探针台、晶圆自动光学检测机、光刻机、内引脚接合机、物理气象沉积设备（溅镀机）、研磨机、晶粒挑选机、晶圆切割机等先进生产设备，同时新建并装修无尘室以解决生产场地问题，进一步提升现有产能，从而提高公司未来产品的市场占有率。

2、项目实施背景

集成电路行业属于国家战略性、先导性产业，是信息技术产业的核心。行业符合第十四个五年规划和 2035 年远景目标的发展方向，国家在投融资、税收、财政、人才、技术等多方面出台政策支持，为集成电路行业营造了良好的政策环境，为企业发展提供良机。同时，随着信息技术革命的深入，集成电路的市场规模也在逐年扩大，据 Frost & Sullivan 预测，全球集成电路行业预计将于 2025 年达到 5,399.70 亿美元的市场规模。封装测试行业作为集成电路产业链中的重要一环，市场规模也将随之扩大，据 Frost & Sullivan 预测，全球集成电路封装测试

市场规模预计将于 2025 年达到 722.70 亿美元。

显示技术的升级与下游应用的拓展将推动显示驱动芯片市场的进一步增长，据 Frost & Sullivan 预测，预计 2025 年显示驱动芯片全球出货量将达到 233.20 亿颗，2021 年至 2025 年的年均复合增长率预计为 6.96%，显示驱动芯片出货量的扩大将带动显示驱动芯片封装测试的规模。

基于显示技术以及终端应用需求的升级，目前市场上对于封装工艺的集成度要求逐渐提高，先进封装成为行业发展的主流趋势。除封装工艺外，行业整体在产品尺寸上也出现转型，目前市场上的晶圆以 8 吋和 12 吋为主，但芯片设计公司和晶圆制造厂商正逐步将生产重心转向 12 吋以提高生产效率，封装测试厂商为迎合客户需求，产线能力也将随之转移。封装测试行业内企业在 2015-2020 年间通过充分的资源整合和扩产浪潮，已形成全新的竞争格局，保留下的企业面临着新的资源分配，紧跟行业发展趋势，抓住先机布局，将是企业提升市场竞争力的关键因素。

3、项目建设的可行性分析

（1）发行人实施本项目的可行性

①国家政策的落地实施为项目建设奠定基础

集成电路产业是信息产业的核心，是引领新一轮科技革命和产业变革的关键力量，近年来我国政府已把集成电路产业上升至国家战略高度，并连续出台了一系列产业政策。2017 年 1 月，国家发改委发布《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》（2016 版），重点支持电子核心产业，包括集成电路芯片封装，采用 SiP、MCP、MCM、CSP、WLP、BGA、Flip Chip（倒装封装）、TSV 等技术的集成电路封装。2020 年 8 月，国务院发布《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》（国发[2020]8 号），旨在进一步优化集成电路产业和软件产业发展环境，深化产业国际合作，提升产业创新能力和发展质量。2021 年 3 月，全国人大发布《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》，提出强化国家战略科技力量，瞄准集成电路等前沿领域，实施一批具有前瞻性、战略性的国家重大科技项目。2021 年 4

月，工信部、发改委、财政部、税务总局联合发布《国家鼓励的集成电路设计、装备、材料、封装、测试企业条件（2021 年本）》，对符合条件的封装、测试企业进行所得税优惠。

本项目建设为上述政策中鼓励生产的集成电路先进封装测试，以上多项国家支持政策的落地实施，为我国集成电路产业和芯片封测产业提供了条件支撑，也为本项目建设创造了良好的政策保障。

②产业链聚集效应有助于项目享受外部经济性

随着我国集成电路产业在全球市场份额的提升，全球晶圆制造、封装测试及芯片设计产能或订单均呈现出逐渐向中国大陆转移的趋势。在产业供给端，众多境内外知名晶圆制造厂及封装测试厂商纷纷在中国大陆进行产能扩充，同时本土集成电路设计企业受到政策与市场环境的激励正在蓬勃发展。

公司总部位于合肥市综合保税区，目前合肥的集成电路产业已初具规模，产业链上下游从芯片设计、晶圆制造、封装测试到配套材料设备或产成品应用等方面的企业已相对完整，公司上下游企业如晶合集成、京东方、维信诺等均落户合肥或建厂，因而公司深入产业集群之中，可以有效节省运输时间与成本，提高生产响应速度以加快产品交付，缩短供应链周期，有利于充分享受产业链聚集效应带来的外部经济性。

③丰富的行业经验和先进管理模式保障生产流程的高效运转

公司主要管理团队曾供职于显示驱动芯片封装测试行业的龙头企业，在显示驱动封装测试行业从业超过 15 年，具备丰富的行业经验和专业知识，对于行业发展具有独到的见解，形成了科学合理的发展战略和经营理念。

在公司专业管理团队的带领下，公司致力于持续提升生产管理水平、强化质量管理，已具备业内领先的产品品质管控能力，所封装产品具有集成度高、稳定性强、体积轻薄等客户需求的品质，产品良率高达 99.90% 以上，有利于保障项目建成后的高效运转。

④优质的客户资源保障新增产能得到消化

由于集成电路的结构非常复杂，对相应的晶圆制造与封装测试的要求都很高，对于新客户的订单都需要经过长时间的工艺验证与导入，所以集成电路企业之间的合作关系均较为稳定，一旦完成工艺认证并大规模量产后，客户的黏性较大。因此对于专业封装测试企业来说，拥有优质的客户资源以及客户对产品的认可意味着更有力的市场竞争力。

公司在显示驱动芯片封装测试领域深耕多年，凭借先进的封测技术、稳定的产品良率与优质的服务能力，积累了丰富的客户资源。公司服务的客户包括联咏科技、天钰科技、瑞鼎科技、奇景光电等全球知名显示驱动芯片设计企业，所封测芯片已主要应用于京东方、友达光电等知名厂商的面板。2020 年度全球排名前五显示驱动芯片设计公司中三家系公司主要客户，2020 年度中国排名前十显示驱动芯片设计公司中九家系公司主要客户。这些优质的客户资源有助于本项目建成后的业务承接和产能消化。

⑤广阔的市场前景和领先的市场地位为项目的实施提供了市场保障

根据 Frost & Sullivan 分析，未来从需求端来看，依然将有新增的面板产能释放，对于显示驱动芯片的需求持续走高。从供应端来看，晶圆代工厂虽然一直有新建产能投产，但多数都还未能实现量产，预计 2023 年晶圆产能才有望达到供需平衡。显示驱动芯片的产量不足，将持续推高销售价格，因此显示驱动芯片封测市场规模将也随之上涨，预计在 2025 年达到 56.10 亿美元。

随着合肥生产基地产能的稳步提升，公司产品出货规模持续扩大，市场占有率有所提高。公司 2020 年度显示驱动芯片封装出货量为 8.28 亿颗，在全球显示驱动芯片封测行业排名第三、在中国境内排名第一。

显示驱动芯片封测行业广阔的市场前景与公司在业内领先的市场地位为项目的实施提供了市场保障。

（2）项目与发行人现有主要业务、核心技术之间的关系

本项目是基于公司目前的主营业务、核心技术及未来战略发展规划所制定，致力于扩大公司现有先进封装测试业务的产能。随着越来越多的晶圆制造厂商加大 12 吋晶圆的投产比例，针对 12 吋晶圆封装测试的需求也将日益增长。本项目

旨在提高 12 吋晶圆金凸块制造与封装测试产线的生产能力，以满足日益增长的市场需求，符合显示驱动芯片封装测试行业的发展趋势。

4、投资概算情况

本项目投资总额 97,406.15 万元，其中建设投资 93,004.85 万元，流动资金 4,401.30 万元，无建设期利息。项目投资概算具体如下：

单位：万元

序号	投资内容	投资金额	占比
1	建设投资	93,004.85	95.48%
	其中：设备购置费	84,597.15	86.85%
	安装工程费	4,229.86	4.34%
	预备费	2,708.88	2.78%
	工程建设其他费用	1,022.83	1.05%
	建筑工程费	446.13	0.46%
2	建设期利息	-	-
3	流动资金	4,401.30	4.52%
合计		97,406.15	100.00%

因本项目主要利用现有厂房，故项目的建设投资以设备购置为主，包括生产设备、公辅设备以及环保设备等，公司生产线接近全自动化，先进生产设备的增加将有效提高产能。

5、项目时间周期和时间进度

本项目建设期为 18 个月，具体进度如下：

序号	建设内容	月份								
		2	4	6	8	10	12	14	16	18
1	前期准备	■								
2	厂房改造装修		■	■	■	■	■			
3	设备采购、安装与调试				■	■	■	■	■	
4	人员招聘与培训							■	■	■

6、项目的选址情况

本项目选址位于合肥市新站高新区合肥综合保税区项王路 8 号，项目利用公

司现有厂区。发行人已通过出让方式取得项目用地的房地产权证。

7、环保情况及治理措施

（1）建设期污染物及治理措施

募集资金项目建设期间，主要的施工活动是厂房装修改造、设备搬运、设备安装，产生的污染物较少，对周边环境造成的影响较小。但各项施工活动不可避免地会对周围环境产生不同程度的影响，主要包括废气、粉尘、噪声、固体废弃物、废水等对周边环境的影响，而且以粉尘和施工噪声的影响尤为突出。建设期主要污染物及处理措施如下：

类别	污染物来源	治理措施
大气污染物	主要有废气和扬尘。施工过程中，运输车辆及工程机械以汽、柴油为燃料，交通尾气排放造成大气污染；进行室内改造装修会产生一定的粉尘和废气污染物	①施工现场道路及使用频繁的裸露地面，指定专人定期洒水清扫，形成制度，防止道路扬尘；②合理安排工期，加快施工速度，减少施工时间；③室内改造尽量使用环保材料，避免甲醛等化学品对员工产生伤害
噪声	施工过程中使用的运输车辆及装修设备等是噪声的产生源。施工现场机械噪声较高，而且实际施工过程中，往往是多种机械同时工作，各种噪声源辐射的相互叠加，噪声级将更高，辐射范围亦更大	①加强施工管理，合理安排施工作业时间，严格按照施工噪声管理的有关规定执行；②对产生噪声的施工机械要合理布局并采取降噪措施；③在高噪声设备周围设置掩蔽物；④做好劳动保护工作，在噪声源附近操作的作业人员配戴防护耳塞

（2）运营期污染物及治理措施

募集资金项目建成后，扩产过程中可能产生的污染物与报告期内生产经营中涉及的污染物一致，具体的污染物及处理措施详见本招股说明书“第六节 业务与技术”之“一、发行人主营业务、主要产品或服务的情况”之“（五）生产经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力”部分。

（二）研发中心建设项目

1、项目概况

本项目以发行人为实施主体，建设周期为 24 个月。项目建成后将大幅提高公司研发的软硬件基础，进一步提升研发实力。

本项目总投资 8,980.84 万元，针对凸块结构优化、测试效率提升、倒装技术

键合品质、CMOS 图像传感器封装工艺等加大研发投入，提升公司产品质量及生产效率，丰富公司产品结构，提升整体市场竞争力。

2、项目实施背景

随着信息技术以及显示技术的快速发展，消费者对终端显示产品的性能及外观提出了更高的要求，终端显示产品向大尺寸化、高清化、轻薄化发展，故显示驱动芯片的集成度水平需进一步提高，先进封装工艺需不断升级。在相同的技术水平下，生产效率和产品良率也是行业竞争中的重要因素。

除了显示驱动芯片外，图像传感器也是电子产品成像的重要零部件，主要分为 CCD 图像传感器和 CMOS 图像传感器，其中，由于 CMOS 图像传感器具有集成度高、标准化程度高、功耗低、成本低、体积小、图像信息可随机读取等一系列优点，逐渐被重视并获得大量研发资源，其市场份额占比逐年提升。根据 Frost & Sullivan 预测，2025 年全球 CIS 芯片市场规模将达到 330.70 亿美元，2021 年至 2025 年间年复合增长率达 10.06%；2025 年中国大陆 CIS 芯片市场规模预计上升至 138.50 亿美元，市场前景广阔。

3、项目建设的可行性分析

（1）发行人实施本项目的可行性

①公司核心技术积累及持续的技术创新能力为本项目实施提供了保障

集成电路封装测试属于技术密集型行业，公司自创立以来始终坚持以技术创新为核心驱动力，在研发活动与生产制造过程中积累了大量非专利核心工艺与众多拥有自主知识产权的核心技术，拥有微间距驱动芯片凸块制造技术、高精度晶圆研磨薄化技术、高稳定性晶圆切割技术、高精度高效内引脚接合工艺等多项较为突出的先进技术与优势工艺，逐步实现显示驱动芯片封装测试领域的进口替代，有效提高了中国大陆显示驱动芯片封装测试行业的自主产研水平。截至本招股说明书签署日，公司共获得授权专利 259 项，其中发明专利 15 项，实用新型专利 244 项。

公司核心技术的深厚积累及持续的技术创新能力为本项目建成后相关课题的研发提供了有利的保障。

②研发团队与研发机制为项目实施提供了人才与制度保障

公司汇聚了行业内优秀的集成电路封装测试研发、工程和管理人员，部分核心成员曾供职于显示驱动芯片封装测试领域的龙头企业，在凸块制造、晶圆测试、玻璃覆晶封装、薄膜覆晶封装等方面积累了丰富的研发经验。

自创立伊始，公司即规划并组建了研发中心，制定一系列研发管理条例，并形成了完善的研发创新体系以保障研发工作的高效有序进行。经过近几年的有效运作，研发中心在提高企业技术水平和市场竞争力方面起到重要作用：公司相继获得 2018 年江苏省示范智能车间、2019 年安徽省企业技术中心，江苏省显示屏驱动芯片先进凸块封测工程技术研究中心、安徽省专精特新企业等荣誉。

同时，公司积极培养年轻技术人员，在日常的研发活动中，资历较深的技术人员带教后辈，丰富的技术人才储备为持续的自主研发创新打下坚实的基础；另外，公司关注研发团队的人才结构，加大产品技术方面的人才引进，致力于提升研发成果的质量。

公司经验丰富的研发团队与富有成效的研发机制为本项目建成后相关课题的研发提供了人才与制度保障。

③公司研发方向符合集成电路封装测试行业技术发展趋势

随着半导体行业技术的进步与终端电子产品需求的提高，凸块制造（Bumping）技术也不断突破技术瓶颈、实现大规模产业化，并发展成为关键的高端先进封装技术之一。凸块制造技术的重要性在于它是各类先进封装技术得以实现进一步发展演化的基础。倒装芯片（FC）技术、扇外型（Fan-out）封装技术、扇进型（Fan-in）封装技术、芯片级封装（CSP）、三维立体封装（3D）、系统级封装（SiP）等先进封装结构与工艺实现的关键技术均涉及凸块制造技术。硅通孔技术（TSV）、晶圆级封装（WLP）、微电子机械系统封装（MEMS）等先进封装结构与工艺均是凸块制造技术的演化延伸。

CMOS 图像传感器具有集成度高、标准化程度高、功耗低、成本低、体积小、图像信息可随机读取等一系列优点，从 20 世纪 90 年代开始被重视并获得大量研发资源，其市场份额占比逐年提升，目前已广泛应用于智能手机、功能手机、平

板电脑、笔记本电脑、汽车电子、移动支付、医疗影像等应用领域，成为移动互联网和物联网应用的核心传感器件。

为适应集成电路封装测试行业发展趋势，本项目将引进先进的研发设备和高素质的研发人才，实现凸块制造（Bumping）技术的持续优化升级与 CMOS 图像传感器封测技术的开发。

（2）项目与发行人现有主要业务、核心技术之间的关系

本项目是基于公司现有核心技术、生产经验和未来发展规划制定的。一方面，公司现在所拥有的凸块制造（Bumping）工艺是实现倒装芯片封装工艺（FC）、扇外型集成电路封装（Fan-out）、2.5D/3D 封装、系统级封装（SiP）的关键技术，目前公司已掌握倒装芯片封装工艺（FC）技术并成功实现产业化，公司通过本项目持续升级 Bumping 技术，积极布局 Fan-out、2.5D/3D、SiP 等高端先进封装技术，为突破行业技术瓶颈奠定坚实的基础。另一方面，公司基于现有的对显示驱动芯片的生产技术和经验，加大 CMOS 影像传感器封装工艺、高阶影像封装技术的研发力度，扩充公司产品线，提升公司产品布局能力和市场竞争力。

4、投资概算情况

本项目投资总额 8,980.84 万元，全部为建设投资，无建设期利息和铺底流动资金。项目投资概算具体如下：

单位：万元

序号	投资内容	投资金额	占比
1	建设投资	8,980.84	100.00%
	其中：建筑工程费	718.00	7.99%
	设备购置费	6,892.20	76.74%
	安装工程费	344.61	3.84%
	工程建设其他费用	764.45	8.51%
	预备费	261.58	2.91%
2	建设期利息	-	-
3	铺底流动资金	-	-
合计		8,980.84	100.00%

因本项目主要利用现有厂房，研发过程中设计开发、样品试制等阶段均需要专业设备的投入，从而能够不断地实验、试制以达到最终的研发目的，故项目的建设投资以设备购置为主。

5、项目时间周期和时间进度

本项目建设期为 24 个月，具体进度如下：

序号	建设内容	月份											
		2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
1	项目前期准备、装修	■	■										
2	设备购置、安装及调试			■	■	■							
3	人员招聘与培训			■	■	■	■	■					
4	课题研究					■	■	■	■	■	■	■	■

6、研发中心主要研究内容和目标

研发中心顺应集成电路封装测试行业的技术发展方向，结合终端产品市场热点及需求，集中精力加大在凸块制造工艺、集成电路先进封装以及 CMOS 图像传感器封装等方面的研究力度，具体的研究课题内容及预期目标如下：

序号	课题	研发内容	研究方案	预期目标
1	一种凸块表面粒子结构优化技术研发	由于 COG 终端产品的尺寸逐步缩小，要求的凸块尺寸也越来越小，使得凸块与 ACF 导电粒子的有效压合面积随之缩小。若捕获的导电粒子数过少，则会直接影响导通效果。导电粒子的捕获数量与凸块表面粗糙度有关，故本课题拟研究降低凸块表面粗糙度的技术，以增加凸块对于 ACF 导电粒子的捕获能力	二次电流分布效应与电镀液的化学成分和浓度有关，因此可以通过改变电镀液流场的分布，进而影响晶圆表面电镀液浓度，从而调节二次电流分布效应，使得表面电流密度更加接近，镀层分布均匀	降低凸块表面粗糙度，改善压合效果，提升芯片导通效果
2	一种高温测试效率提升设计	由于电子产品存在长时间使用发热严重的共性问题，芯片应具有较好的耐热性能，该性能需在生产过程中通过测试来验证，以确保生产的芯片耐热性能满足终端产品要求；除此之外，驱动芯片尺寸日渐缩小，引脚高密度、微间距是发展的趋势，这要求提升晶圆测试效率与稳定性。本课题拟研究高温环境下，提高测试效率与稳定性的测试方案	依据驱动芯片凸块布局制作的专用探针卡须使用耐高温材质，防止融针及脆化情形，本课题计划与探针卡供应商一起合作研究，开发在高温环境下，提高测试效率与稳定性的探针卡及测试方案	提高在高温环境中测试效率与稳定性，缩短测试时间
3	先进封装倒装技术键合品质工艺的研	倒装工艺对芯片与柔性基板的接合平台光滑程度要求极高，目前平台表面高度差需控制在 2um 以内。随着封装工艺日益精进，柔性基板的线路间距也趋	光学检测设备是微米级别监测的有效工具，钨钢刷可以更好地清除掉接合平台上累积的异物且不对接合	通过监测与异物清洁方案及装置确保

序号	课题	研发内容	研究方案	预期目标
	发	于细微化，相同面积内线路密度更高，这要求接合平台在生产过程中要更加光滑并一直保持，任何导致平台高度差变大的异物都可能会导致键合过程金凸块压伤、变形，甚至线路短路从而影响产品品质。本课题拟研究出一种平台光滑度监测与异物清洁方案及装置以提高产品品质	平台造成损伤，因此可以对现有光学检测设备进行改造升级，监测到异物时控制钨钢刷自动清除异物，降低生产过程中因异物残留而导致产品报废的概率，有效提升产品品质与生产良率	生产过程中接合平台的光滑程度以提高封装产品品质
4	先进封装领域高晶圆吸附可靠性的结构及工艺研发	晶圆清洗是产品经过硅片减薄镜面处理工序后的重要环节，清洗台盘是清洗环节的重要治具。现有的机台清洗台盘作业过程中存在吸附性不强、易粘连异物等问题，故本课题拟设计开发不同的装置，提高晶圆吸附可靠性	通过设计修改清洗盘金属边缘环形槽型圈，增大产品与台盘的接触面积，采用整体不锈钢材质平面，减少卡片概率，提高吸附性；研究设计防止残胶与产品粘接，以及避免晶圆清洗后再次被传送时残胶遗留在台盘治具上的方案及装置，减少机台宕机率、保证机台正常运行	提升台盘吸附性与对晶圆的保护作用，避免等待时间过长导致晶圆被刮伤、污染
5	高阶影像封装技术研发	针对高阶影像类产品封测技术进行研究，高阶影像产品的每个像素点相对缩小，因此在生产管控方面难度相对提升，公司计划将现有有机台进行升级改造，大幅提升机器内无尘等级。同时需将市场大多数用于半导体封装的胶带进行验证，找出与影像类产品生产最适合的胶带，因为本身影像类产品芯片表面凸触多达 200 万颗，故作业过程中接触产品的胶带尤其重要	公司在驱动芯片封测领域经验丰富，对微尘的管控有深厚的经验累积，可在此基础上研发高阶影像类产品封装技术，同时公司拥有多年金凸块制造经验，可高效寻找与高阶影像产品封装相匹配的胶带	掌握高阶影像传感器封测技术，成功批量封测高阶影响类产品
6	高阶 CMOS 影像传感器工艺研究	图像传感器主要应用于多摄像头智能手机、安防监控、汽车车载等各领域，市场上可完成高阶 CMOS 影像传感器封装的企业屈指可数，主要是影像传感器对微尘的敏感度极高，因为在影像传感器接收光线时即使受到颗粒度极细的微尘遮蔽也会极大影响芯片对色彩的感应。故本课题拟在显示驱动芯片技术的基础上，研究开发新的封装工艺，并根据工艺要求对相应机台和作业区域提出设计改造方案，优化生产工作条件以达到高阶 CMOS 影像传感器的封装要求	利用公司显示驱动芯片封测的技术积累以及对微尘的管控经验，研究开发新的封装工艺，简化高阶 CMOS 影像传感器封装工艺流程，缩短生产周期、提高封测能力	研发新的封装工艺，提升作业环境以达到产品生产需求

7、项目的选址情况

本项目选址位于合肥市新站高新区合肥综合保税区项王路 8 号，项目利用公司现有厂房。发行人已通过出让方式取得项目用地的房地产权证。

（三）补充流动资金项目

1、项目概况

公司拟使用募集资金 50,000.00 万元补充流动资金，以优化财务结构、降低财务风险、满足公司后续生产经营发展的需求。

2、项目实施背景

随着公司经营规模的不断扩大，公司对日常运营资金的需求也随之增加，补充一定规模的流动资金既可以保障公司的正常运营、研发投入和未来发展规划的顺利实施，又可以优化资本结构、减轻财务压力，有利于提高公司的抗风险能力。

（1）公司核心业务快速发展对流动资金的需要

发行人作为高端先进封装测试企业，目前处于高速发展时期，充足的流动资金有利于公司保持行业的领先地位。随着公司业务规模的扩大和募投项目的逐渐达产，公司对营运资金的需求将大幅增加。

（2）公司持续研发投入对流动性资金的需求

公司目前主营业务聚焦于显示驱动芯片的封装测试业务，集成电路封装测试行业属于资本、技术密集型行业。公司需要通过持续的研发投入来维持竞争优势，因此公司需要充足的流动资金以支持公司持续研发创新的需求。

（3）优化公司财务结构、增强公司抗风险能力

本次发行股票募集资金部分用于补充流动资金，可进一步优化公司的财务结构，有利于降低公司的财务风险，提高公司的偿债能力和抗风险能力，保障公司稳定、持续、健康发展。

3、发行人实施本项目的可行性

公司建立了清晰的业务发展路径及目标，拥有完备的营运资金管理及使用规范，公司可以根据自身业务发展的需求以及既有的流程规范，及时确定营运资金的需求金额以及具体用途，公司将募集资金用于补充流动资金具备实施可行性。

三、未来发展规划

（一）发展战略目标

公司以成为国内领先、世界一流的高端芯片封装测试服务商为愿景，以提升中国集成电路半导体产业的全球竞争力为使命。公司深耕于显示驱动芯片的封装测试领域，在保证产品良率的同时，提升产品技术水平和生产效率，提供的产品与服务在市场上具备较强的竞争力。

未来，公司将不断提升先进封装技术水平，学习引进不同的封装工艺、优化现有工艺的流程与效率；积极扩充 12 吋大尺寸晶圆的先进封装测试服务能力，保持行业及产品的领先地位，同时将进行持续的研发投入，不断拓宽封测服务的产品应用领域，积极拓展以 CMOS 影像传感器、车载电子等为代表的新兴产品领域；加强市场开拓和品牌建设，夯实领先的成本管控和质量管理优势，致力于保持行业及产品的领先地位；逐步实现集成电路先进封装测试领域的进口替代，提高中国大陆集成电路先进封装测试行业的自主产研水平。

（二）报告期内为实现战略目标已采取的措施及实施效果

报告期内，发行人为实现战略目标采取的措施包括持续导入优质客户资源和扩充 12 吋晶圆封测产能、加强研发创新投入、建立员工激励制度、优化内部组织管理体系等，通过上述措施夯实了发行人的发展基础，形成阶段性的战略发展成果，为实现长期发展战略目标奠定基础。

1、持续导入优质客户资源和扩充 12 吋晶圆封测产能

报告期内，公司持续导入全球知名显示驱动芯片设计公司。截至本招股说明书签署日，公司与联咏科技、天钰科技、瑞鼎科技、奇景光电、晶门半导体等行业内知名芯片设计公司建立了稳定的合作关系，其中公司分别于 2020 年和 2021 年上半年获得联咏科技颁发的“最佳配合供应商奖”和“最佳品质供应商奖”，公司所封测芯片已主要应用于京东方、友达光电等知名厂商的面板，2020 年度全球排名前五显示驱动芯片设计公司中三家系公司主要客户，2020 年度中国排名前十显示驱动芯片设计公司中九家系公司主要客户。

公司是中国境内最早具备金凸块制造能力，及最早导入 12 吋晶圆金凸块产线并实现量产的显示驱动芯片先进封测企业之一，具备 8 吋及 12 吋晶圆制程封装测试能力。为响应国家政策号召、紧抓行业发展机遇，公司持续购置 12 吋晶圆封测生产设备、积极扩大产能。2018 年度至 2021 年 1-6 月，公司 12 吋晶圆金凸块制造产能持续攀升。

2、加强研发创新投入

持续的工艺创新和产品技术升级是维持公司行业地位的重要保障，自公司成立以来便组织建立健全研发项目管理制度，积极引进和培养技术人才，对实现的科研成果进行相应奖励，因而公司的创新产出效果显著。截至本招股说明书签署日，公司已取得授权专利 259 项，其中发明专利 15 项，实用新型 244 项，软件著作权 2 项，并形成相应核心技术，为公司的生产经营和持续发展做出卓越贡献。

3、建立员工培养和激励制度

公司鼓励并积极组织研发技术人员参与各类技术培训活动、学术交流活动等，促使研发技术人员对行业技术发展趋势有更加深入的了解，通过集体学习提升自身技术水平与行业需求相适应，并保障研发技术人员在技术职务领域具有畅通的晋升渠道和广阔的发展空间。

公司在薪酬设置方面采取工资薪金加提成的方式激励员工，并对优秀员工授予股权激励，充分调动员工的积极性和创造性，建立健全公司长效激励机制，同时肯定员工对公司做出的贡献，与员工分享公司的经营成果，提升团队凝聚力，有利于稳定重要员工和改善公司的经营状况。

4、优化内部组织管理体系

公司不断健全公司内部组织管理体系、提高管理水平以匹配公司长期战略发展的需求。2021 年 3 月，发行人召开创立大会完成股份制改制，选举独立董事，按照《公司章程》和上市公司的要求，持续完善法人治理结构，规范股东大会、董事会的运作，建立了股东大会、董事会和监事会议事规则和各项公司治理细则，形成了科学有效的公司决策机制。

（三）未来的具体发展规划与措施

报告期内，公司致力于显示驱动芯片的先进封装测试服务，未来公司拟进一步扩大 12 吋大尺寸晶圆的先进封测产能、持续优化升级凸块制造工艺以及进行 CMOS 影像传感器封装的技术研发，坚持以市场为导向、技术为支撑大力拓展产品线，不断跟随市场趋势丰富产品结构、提升产业链资源整合能力，为客户带来更全面、更优质的服务。

针对公司现有情况及未来发展规划，公司将采取如下具体措施：

1、扩大 12 吋晶圆封测规模，持续提高市场份额

公司是中国境内最早具备金凸块制造能力，及最早导入 12 吋晶圆金凸块产线并实现量产的显示驱动芯片先进封测企业之一。未来，公司将继续响应国家政策号召、紧抓行业发展机遇，结合下游产品需求变化趋势持续购置 12 吋大尺寸晶圆封测生产设备、扩大 12 吋产线的生产规模，在 12 吋晶圆的金凸块制造及封装测试领域的竞争中占据先机，提升公司产品技术水平，确立技术核心优势，实现以技术抢占市场的公司目标，进而提高公司市场占有率。

2、通过优化升级凸块制造技术积极布局高端先进封装测试

随着集成电路尺寸不断减小，摩尔定律逼近极限，技术瓶颈在制约工艺的发展，目前扩展摩尔与延续摩尔是业界认可较为容易实现突破的两大发展方向，其中，扩展摩尔是指通过将不同功能的芯片和元件组装拼接在一起封装以实现芯片功能提升的目的，倒装芯片封装工艺（FC）、扇外型集成电路封装（Fan-out）、晶圆片级芯片规模封装（WLCSP）、2.5D/3D 封装、系统级封装（SiP）等先进封装形式将极大程度的影响扩展摩尔能否在后摩尔时代实现突破。公司所拥有的凸块制造（Bumping）工艺是实现前述先进封装工艺的关键技术，发行人目前已掌握 FC 技术并成功实现产业化，未来将不断拓展技术边界，积极布局 Fan-out、2.5D/3D、SiP 等高端先进封装技术，为突破行业技术瓶颈奠定坚实的基础。

3、持续开展 CMOS 影像传感器封装工艺研发活动并实现产业化

CMOS 影像传感器行业的产业链可以分为三部分：产业链上游市场参与者为 CMOS 影像传感器芯片设计企业，负责提供图像处理解决方案；产业链中游环节

的参与主体为晶圆代工厂、封装测试厂商；产业链下游环节由模组厂商、系统厂商及终端厂商组成。CMOS 影像传感器低功耗、体积小、集成度高等优势明显，并将逐步取代 CCD 传感器成为市场主导产品。伴随人工智能、物联网等技术的飞速发展，智能家居、智能监控、智能汽车等领域的兴起为 CMOS 传感器提出更高的产品要求。在 CMOS 影像传感器封测领域，公司将在多摄像头手机的 CMOS 传感器、安防监控领域 CMOS 传感器与汽车车载领域 CMOS 传感器等方面持续开展研发活动并实现产业化。

4、加大研发投入，优化工艺流程、持续创新技术

不断提升研发创新能力一直是公司的核心竞争手段。公司未来也将持续增加研发投入，一方面巩固现有产品的技术优势，在现有工艺流程的基础上，设计开发工艺优化方案，以提高生产效率，保障产品品质。另一方面，紧跟行业技术发展趋势和市场需求情况，加强技术与产品创新，在充分评估项目先进性、可行性、市场应用前景、技术突破难点的基础上，推进研发项目的立项、设计开发与产业化，在技术环节、应用领域等方面取得突破。

5、持续优化人力资源配置

公司所处行业属于典型技术密集型行业，对于技术人员知识背景、研发能力及工作经验均有较高要求。随着经营规模的不断扩大和产品线的不断丰富，公司面临的挑战也愈发多样，而杰出的人才是公司未来稳健发展的关键。公司将根据未来发展的战略规划，持续优化人力资源配置，在进一步完善内部人才培养机制的同时，加大对国内外高端人才的引进力度，努力打造全球一流的研发和管理团队，为公司的可持续发展打下坚实基础。

6、拓宽业务范围，加强品牌建设

公司积极维护现有的优质客户，收集客户需求与产品质量反馈意见，并据此提出改进方案，以提升客户满意度，并为将来的业务拓展打下基础。同时，公司将加大营销力度，注重从技术水平的角度进行专业推广和品牌形象建设，进而提升公司在更广阔的产品领域和市场区域内的品牌影响力。

7、根据业务开展适时融资

为实现公司战略目标，未来公司将根据业务发展情况适时进行较大金额的固定资产投资。为应对潜在的资金短缺，公司拟选择适当的股权融资和债权融资方式，筹集长期资本和短期流动资金、设置合理的财务杠杆，保持稳健的资产负债结构，满足公司可持续发展中对资金的需求。

第十节 投资者保护

一、发行人投资者关系的主要安排

（一）信息披露制度和流程

公司已按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、部门规章及其他规范性文件制定了《合肥新汇成微电子股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称“《信息披露管理制度》”）。该制度明确了重大信息报告、审批及披露等相关内容，明确了公司管理人员在信息披露和投资者关系管理中的责任和义务。该制度有助于加强公司与投资者之间的信息沟通，提升规范运作和公司治理水平，切实保护投资者的合法权益。

本次公开发行股票上市后，公司将严格按照上述法律、规范性文件以及《公司章程》《信息披露管理制度》的规定，认真履行公司的信息披露义务，及时公告公司在涉及重要生产经营、重大投资、重大财务决策等方面的事项，包括公布定期报告（年度报告、中期报告、季度报告）和临时公告，确保披露信息的真实性、准确性、完整性和及时性，保证投资者能够公开、公正、公平的获取公开披露的信息。

（二）投资者沟通渠道的建立情况

为加强公司与投资者及潜在投资者之间的信息沟通，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的关系，提升公司的诚信形象，根据相关适用的法律、法规和规范性文件的规定，结合发行人实际情况，发行人制定了《合肥新汇成微电子股份有限公司投资者关系管理制度》（以下简称“《投资者关系管理制度》”），就投资者关系管理工作的原则和目的、投资者关系管理工作的对象、内容、职责及组织、投资者关系活动的方式以及相关机构和个人的管理等内容做出了明确规定。

根据《投资者关系管理制度》，公司设置了联系电话、网站、传真、电子邮箱等与投资者沟通的渠道。通过信息披露与交流，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平。

（三）未来开展投资者关系管理的规划

公司董事会秘书为投资者关系管理工作负责人，董事会办公室为公司投资者关系管理工作的部门，负责投资者关系的具体事务工作。未来，公司将通过证监会及上海证券交易所规定的信息披露渠道，积极做好信息披露工作，加强与投资者沟通工作，实现与投资者的良好沟通。公司本次发行上市后，将按照公平、公开、公正的原则开展投资者关系管理工作，平等对待所有投资者，并遵循相关法律、法规及中国证监会和上交所的相关规定，保障所有投资者的知情权和合法权益，并尽可能通过多种方式与投资者进行及时、深入和广泛的沟通。

二、发行人的股利分配政策和决策程序

（一）发行人本次发行前的股利分配政策和决策程序

根据《公司法》及公司现行有效的《公司章程》，公司本次发行前的股利分配政策如下：

“公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10% 列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50% 以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。

公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。

股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。”

（二）发行人本次发行后的股利分配政策和决策程序

根据《公司法》及《公司章程（草案）》，公司本次发行后的股利分配政策和决策程序如下：

“公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10% 列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50% 以上的，可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。

股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司股本。但是，资本公积金不得用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理、稳定投资回报，同时兼顾公司的可持续发展。

（一）利润分配的形式：公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润，并优先采用现金分红的方式，利润分配不得超过累计可分配利润

的范围，不得损害公司持续经营能力。

（二）股票股利分配条件：在公司经营状况良好且已充分考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素的前提下，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，董事会可以在满足上述现金分红的条件下，同时提出股票股利分配方案，并提交股东大会审议。

（三）现金分红比例及条件：

在公司当年财务报表经审计机构出具标准无保留意见的审计报告，当年实现的净利润为正数且当年未分配利润为正数，且无重大投资计划或重大资金支出安排的情况下，公司应当进行现金分红，公司根据盈利、资金需求、现金流等情况，可以进行中期分红。前述重大投资计划或重大资金支出安排指除募集资金投资项目以外的下述情形之一：

1、公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 5,000 万元；

2、公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%；

3、中国证监会或者证券交易所规定的其他情况。

公司最近三年以现金方式累计分配的利润原则上应不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%，具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。

（四）现金分红与股票股利的关系：

如公司同时采取现金及股票股利分配利润的，董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现

金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

（五）公司利润分配决策程序：

1、公司应当多渠道充分听取独立董事和中小股东对利润分配方案的意见，公司管理层结合公司股本规模、盈利情况、投资安排等因素提出利润分配建议，由董事会制订利润分配方案。

2、利润分配方案应当征询监事会及独立董事意见，独立董事应当对利润分配方案发表明确意见，董事会就利润分配方案形成决议后应提交股东大会审议。

3、公司应切实保障中小股东参与股东大会的权利，审议有关利润分配议案时，应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与表决。

4、独立董事和符合条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。

5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会必须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

6、独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。”

三、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序

2021 年 6 月 30 日，发行人召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》，决议公司首次公开发行股票前滚存未分配利润由本次公开发行股票完成后的新老股东按照发行后的持股比例共享。

四、发行人股东投票机制的建立情况

公司建立了完善的累积投票制度、中小投资者单独计票机制、网络投票制等

股东投票机制，保障投资者尤其是中小投资者参与公司重大决策等事项的权利。

（一）累积投票制度

公司股东大会选举二名及以上董事或监事时，出席股东大会的股东所持有的每一有效表决权拥有与该次股东大会应选董事或监事总人数相等的投票权。股东拥有的投票权等于该股东所持有的有表决权股份总数与应选董事或监事总人数的乘积，出席会议股东可以将其拥有的投票权集中投票选举一位董事或监事候选人，也可以将其拥有的投票权分散行使，投票给多位董事或监事候选人，按得票多少依次决定董事、监事人选。

（二）中小投资者单独计票机制

股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票，单独计票结果应当及时公开披露。

（三）网络投票的相关安排

股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会现场会议召开地点不得变更。确需变更的，召集人应当在现场会议召开日前至少 2 个工作日公告并说明原因。

公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的视为出席。通过网络或其他方式投票的公司股东或代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。

公司股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间以及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午 3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午 3:00。

（四）征集投票的相关安排

根据《公司章程（草案）》和《股东大会议事规则》，董事会、独立董事和符合相关规定的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。

公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

五、特别表决权股份、协议控制的特殊安排

根据《公司章程（草案）》，股东按其所持有股份的种类和份额享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同等义务。《公司章程（草案）》未针对特定股东设置特别表决权股份，公司股东亦不存在协议控制的特殊安排情况。

六、本次发行相关主体作出的重要承诺

（一）关于所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及相关股东持股及减持意向的承诺

1、控股股东扬州新瑞连的承诺

自汇成股份本次发行的股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的汇成股份本次发行前股份，也不得提议由汇成股份回购该部分股份。

如汇成股份上市后6个月内，汇成股份股票连续20个交易日的收盘价（汇成股份股票全天停牌的除外）均低于本次发行的发行价格，或者上市后6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于本次发行的发行价格，本企业持有汇成股份股票的锁定期将在上述锁定期限届满后自动延长6个月。如果因公司派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述发行价须按照有关规定作相应调整。

自锁定期届满之日起24个月内，若本企业试图通过任何途径或手段减持本企业在本次发行及上市前通过直接或间接方式已持有的发行人股份，则本企业的减持价格应不低于发行人的股票发行价格。若在本企业减持前述股份前，发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本企业的减持价格应不低于发行人的股票发行价格经相应调整后的价格。减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证券监督管理委员会及证券交易所相关规定的方式。本企业拟减持发行人股份时，将提前通知发行人并通过发行人予以公告。

汇成股份上市时未盈利的，在公司实现盈利前，本企业自公司股票上市之日起3个完整会计年度内，不减持首发前股份；自公司股票上市之日起第4个会计年度和第5个会计年度内，本企业每年减持的首发前股份不超过公司股份总数的2%。公司实现盈利后，本企业可以自当年年度报告披露后次日起减持首发前股份，并遵守上海证券交易所的相关规定。

如相关法律法规及规范性文件或中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等证券监管机构对股份锁定期和减持事项有其他要求，则本企业直接或间接所持发行人股份的锁定期、限售条件和减持事项按该等规定和要求相应调整执行。

本企业所持公司股份锁定期届满后，本企业减持公司股票时将严格遵守法律法规及上海证券交易所的规定。

如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，则本企业出售股票收益归公司所有，本企业将在5个工作日内将前述收益缴纳至公司指定账户。如因本企业未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本企业将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。本企业怠于承担前述责任，则公司有权在分红或支付本企业其他报酬时直接扣除相应款项。

2、实际控制人郑瑞俊、杨会的承诺

①实际控制人郑瑞俊承诺如下：

自汇成股份本次发行的股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的汇成股份本次发行前股份，也不得提议由汇成股份回购该部分股份。

如汇成股份上市后6个月内，汇成股份股票连续20个交易日的收盘价（汇成股份股票全天停牌的除外）均低于本次发行的发行价格，或者上市后6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于本次发行的发行价格，本人持有汇成股份股票的锁定期将在上述锁定期届满后自动延长6个月。如果因公司派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述发行价须按照有关规定作相应调整。

本人在任职期间（于本承诺中的所有股份锁定期结束后），每年转让持有的公司股份不超过本人直接及间接持有公司股份总数的25%；若在任期届满前离职的，在就任时确定的任期内和任期届满后6个月内，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的25%；离职后6个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。

自锁定期届满之日起24个月内，若本人试图通过任何途径或手段减持本人在本次发行及上市前通过直接或间接方式已持有的发行人股份，则本人的减持价格应不低于发行人的股票发行价格。若在本人减持前述股份前，发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本人的减持价格应不低于发行人的股票发行价格经相应调整后的价格。减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证券监督管理委员会及证券交易所相关规定的方式。本人拟减持发行人股份时，将提前通知发行人并通过发行人予以公告。

汇成股份上市时未盈利的，在公司实现盈利前，本人自公司股票上市之日起3个完整会计年度内，不减持首发前股份；自公司股票上市之日起第4个会计年度和第5个会计年度内，本人每年减持的首发前股份不超过公司股份总数的2%。公司实现盈利后，本人可以自当年年度报告披露后次日起减持首发前股份，并遵守上海证券交易所的相关规定。

如相关法律法规及规范性文件或中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等证券监管机构对股份锁定期和减持事项有其他要求，则本人直接或间接所持发行人股份的锁定期、限售条件和减持事项按该等规定和要求相应调整执行。

本人所持公司股份锁定期届满后，本人减持公司股票时将严格遵守法律法规及上海证券交易所的规定。

如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，则本人出售股票收益归公司所有，本人将在5个工作日内将前述收益缴纳至公司指定账户。如因本人未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。本人怠于承担前述责任，则公司有权在分红或支付本人其他报酬时直接扣除相应款项。

以上承诺为不可撤销之承诺，不因本人在公司职务变更、离职等原因而影响履行。

②实际控制人杨会承诺如下：

自汇成股份本次发行的股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的汇成股份本次发行前股份，也不得提议由汇成股份回购该部分股份。

如汇成股份上市后6个月内，汇成股份股票连续20个交易日的收盘价（汇成股份股票全天停牌的除外）均低于本次发行的发行价格，或者上市后6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于本次发行的发行价格，本人直接及间接持有汇成股份股票的锁定期将在上述锁定期届满后自动延长6个月。如果因公司派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述发行价须按照有关规定作相应调整。

自锁定期届满之日起24个月内，若本人试图通过任何途径或手段减持本人在本次发行及上市前通过直接或间接方式已持有的发行人股份，则本人的减持价格应不低于发行人的股票发行价格。若在本人减持前述股份前，发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本人的减持价格应不低于发行人的股票发行价格经相应调整后的价格。减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证券监督管理委员会及证券交易所相关规定的方式。本人拟减持发行人股份时，将提前通知发行人并通过发行人予以公告。

汇成股份上市时未盈利的，在公司实现盈利前，本人自公司股票上市之日起3个完整会计年度内，不减持首发前股份；自公司股票上市之日起第4个会计年度和第5个会计年度内，本人每年减持的首发前股份不超过公司股份总数的2%。公司实现盈利后，本人可以自当年年度报告披露后次日起减持首发前股份，并遵守上海证券交易所的相关规定。

如相关法律法规及规范性文件或中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等证券监管机构对股份锁定期和减持事项有其他要求，则本人直接或间接所持发行人股份的锁定期、限售条件和减持事项按该等规定和要求相应调整执行。

本人所持公司股份锁定期届满后，本人减持公司股票时将严格遵守法律法规及上海证券交易所的规定。

如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，则本人出售股票收益归公司所有，本人将在5个工作日内将前述收益缴纳至公司指定账户。如因本人未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。本人怠于承担前述责任，则公司有权在分红或支付本人其他报酬时直接扣除相应款项。

3、持股董事、监事、高级管理人员的承诺

①发行人监事赵志清、程红艳承诺如下：

自汇成股份股票上市之日起 12 个月内，不得转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的汇成股份本次发行前股份，也不得提议由汇成股份回购该部分股份。

本人在担任公司监事的任职期间（于本承诺中的所有股份锁定期结束后），如实并及时申报直接或间接持有公司股份及其变动情况，每年转让持有的公司股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%；若在任期届满前离职的，在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，每年转让的股份不得超过本人所直接或间接持有的发行人股份总数的 25%；离职后 6 个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。

汇成股份上市时未盈利的，在公司实现盈利前，本人自公司股票上市之日起 3 个完整会计年度内，不减持首发前股份，若本人在前述期间内离职的，本人将继续遵守本条承诺。公司实现盈利后，本人可以自当年年度报告披露后次日起减持首发前股份，并遵守上海证券交易所的相关规定。

如相关法律法规及规范性文件或中国证券监督管理委员会、证券交易所等证券监管机构对股份锁定期有其他要求，则本人直接和间接所持发行人股份的锁定期和限售条件按该等规定和要求相应调整执行。

本人所持发行人股份锁定期届满后，本人减持汇成股份的股份时将严格遵守法律法规及上海证券交易所的规定。

如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，则本人出售股票收益归公司所有，本人将在 5 个工作日内将前述收益缴纳至公司指定账户。如因本人未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。本人怠于承担前述责任，则公司有权在分红或支付本人其他报酬时直接扣除相应款项。

以上承诺为不可撤销之承诺，不因本人在公司职务变更、离职等原因而影响履行。

②发行人高管马行天承诺如下：

自汇成股份股票上市之日起 12 个月内，不得转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的汇成股份本次发行前股份，也不得提议由汇成股份回购该部分股份。

如汇成股份上市后 6 个月内，汇成股份股票连续 20 个交易日的收盘价（汇成股份股票全天停牌的除外）均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于本次发行的发行价格，本人持有汇成股份股票的锁定期限将在上述锁定期限届满后自动延长至少 6 个月。如果因公司派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述发行价须按照证券交易所的有关规定作相应调整。

本人在担任公司高级管理人员期间（于本承诺中的所有股份锁定期结束后），如实并及时申报直接或间接持有公司股份及其变动情况，每年转让持有的公司股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%；若在任期届满前离职的，在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，将继续遵守前述承诺；离职后 6 个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。

自锁定期届满之日起 24 个月内，若本人试图通过任何途径或手段减持本人在本次发行及上市前通过直接或间接方式已持有的发行人股份，则本人的减持价格应不低于发行人的股票发行价格。若在本人减持前述股份前，发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本人的减持价格应不低于发行人的股票发行价格经相应调整后的价格。减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、

协议转让及其他符合中国证券监督管理委员会及证券交易所相关规定的方式。本人任何时候拟减持发行人股份时，将提前通知发行人并通过发行人予以公告。

汇成股份上市时未盈利的，在公司实现盈利前，本人自公司股票上市之日起 3 个完整会计年度内，不减持首发前股份，若本人在前述期间内离职的，本人将继续遵守本条承诺。公司实现盈利后，本人可以自当年年度报告披露后次日起减持首发前股份，并遵守上海证券交易所的相关规定。

如相关法律法规及规范性文件或中国证券监督管理委员会、证券交易所等证券监管机构对股份锁定期有其他要求，则本人直接和间接所持发行人股份的锁定期和限售条件按该等规定和要求相应调整执行。

本人所持发行人股份锁定期届满后，本人减持汇成股份的股份时将严格遵守法律法规及上海证券交易所的规定。

如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，则本人出售股票收益归公司所有，本人将在 5 个工作日内将前述收益缴纳至公司指定账户。如因本人未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。本人怠于承担前述责任，则公司有权在分红或支付本人其他报酬时直接扣除相应款项。

以上承诺为不可撤销之承诺，不因本人在公司职务变更、离职等原因而影响履行。

③发行人高管兼核心技术人员林文浩、钟玉玄承诺如下：

自汇成股份股票上市之日起 12 个月内，不得转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的汇成股份本次发行前股份，也不得提议由汇成股份回购该部分股份。

如汇成股份上市后 6 个月内，汇成股份股票连续 20 个交易日的收盘价（汇成股份股票全天停牌的除外）均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于本次发行的发行价格，本人持有汇成股份股票的锁定期限将在上述锁定期限届满后自动延长至少 6 个月。如果因公司派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上

述发行价须按照证券交易所的有关规定作相应调整。

本人在担任公司高级管理人员期间（于本承诺中的所有股份锁定期结束后），如实并及时申报直接或间接持有公司股份及其变动情况，每年转让持有的公司股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%；若在任期届满前离职的，在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，将继续遵守前述承诺；离职后 6 个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。

本人在担任公司核心技术人员期间（于本承诺中的所有股份锁定期结束后），自汇成股份首次发行上市前股份自限售期满之日起 4 年内，每年转让的首发前股份不得超过公司股票在上海证券交易所上市时本人所持公司首发前股份总数的 25%，减持比例可以累积使用。

自锁定期届满之日起 24 个月内，若本人试图通过任何途径或手段减持本人在本次发行及上市前通过直接或间接方式已持有的发行人股份，则本人的减持价格应不低于发行人的股票发行价格。若在本人减持前述股份前，发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本人的减持价格应不低于发行人的股票发行价格经相应调整后的价格。减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证券监督管理委员会及证券交易所相关规定的方式。本人任何时候拟减持发行人股份时，将提前通知发行人并通过发行人予以公告。

汇成股份上市时未盈利的，在公司实现盈利前，本人自公司股票上市之日起 3 个完整会计年度内，不减持首发前股份，若本人在前述期间内离职的，本人将继续遵守本条承诺。公司实现盈利后，本人可以自当年年度报告披露后次日起减持首发前股份，并遵守上海证券交易所的相关规定。

如相关法律法规及规范性文件或中国证券监督管理委员会、证券交易所等证券监管机构对股份锁定期有其他要求，则本人直接和间接所持发行人股份的锁定期和限售条件按该等规定和要求相应调整执行。

本人所持发行人股份锁定期届满后，本人减持汇成股份的股份时将严格遵守法律法规及上海证券交易所的规定。

如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，则本人出售股票收益归公司所有，

本人将在 5 个工作日内将前述收益缴纳至公司指定账户。如因本人未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。本人怠于承担前述责任，则公司有权在分红或支付本人其他报酬时直接扣除相应款项。

以上承诺为不可撤销之承诺，不因本人在公司职务变更、离职等原因而影响履行。

④发行人财务总监兼董事会秘书施周峰承诺如下：

自汇成股份股票上市之日起 12 个月内，不得转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的汇成股份本次发行前股份，也不得提议由汇成股份回购该部分股份。

如汇成股份上市后 6 个月内，汇成股份股票连续 20 个交易日的收盘价（汇成股份股票全天停牌的除外）均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于本次发行的发行价格，本人持有汇成股份股票的锁定期限将在上述锁定期限届满后自动延长至少 6 个月。如果因公司派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述发行价须按照证券交易所的有关规定作相应调整。

本人在担任公司高级管理人员期间（于本承诺中的所有股份锁定期结束后），如实并及时申报直接或间接持有公司股份及其变动情况，每年转让持有的公司股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%；若在任期届满前离职的，在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，将继续遵守前述承诺；离职后 6 个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。

自锁定期届满之日起 24 个月内，若本人试图通过任何途径或手段减持本人在本次发行及上市前通过直接或间接方式已持有的发行人股份，则本人的减持价格应不低于发行人的股票发行价格。若在本人减持前述股份前，发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本人的减持价格应不低于发行人的股票发行价格经相应调整后的价格。减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证券监督管理委员会及证券交易所相关规定的方式。本

人任何时候拟减持发行人股份时，将提前通知发行人并通过发行人予以公告。

汇成股份上市时未盈利的，在公司实现盈利前，本人自公司股票上市之日起3个完整会计年度内，不减持首发前股份，若本人在前述期间内离职的，本人将继续遵守本条承诺。公司实现盈利后，本人可以自当年年度报告披露后次日起减持首发前股份，并遵守上海证券交易所的相关规定。

如相关法律法规及规范性文件或中国证券监督管理委员会、证券交易所等证券监管机构对股份锁定期有其他要求，则本人直接和间接所持发行人股份的锁定期和限售条件按该等规定和要求相应调整执行。

本人所持发行人股份锁定期届满后，本人减持汇成股份的股份时将严格遵守法律法规及上海证券交易所的规定。

如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，则本人出售股票收益归公司所有，本人将在5个工作日内将前述收益缴纳至公司指定账户。如因本人未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。本人怠于承担前述责任，则公司有权在分红或支付本人其他报酬时直接扣除相应款项。

以上承诺为不可撤销之承诺，不因本人在公司职务变更、离职等原因而影响履行。

4、核心技术人员的承诺

①发行人核心技术人员许原诚、陈汉宗承诺如下：

自汇成股份股票上市之日起12个月内和本人离职后6个月内，不得转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的汇成股份本次发行前股份，也不得提议由汇成股份回购该部分股份。

本人在担任公司核心技术人员期间（于本承诺中的所有股份锁定期结束后），自汇成股份首次发行上市前股份自限售期满之日起4年内，每年转让的首发前股份不得超过公司股票在上海证券交易所上市时本人所持公司首发前股份总数的25%，减持比例可以累积使用。

汇成股份上市时未盈利的，在公司实现盈利前，本人自公司股票上市之日起3个完整会计年度内，不减持首发前股份，若本人在前述期间内离职的，本人将继续遵守本条承诺。公司实现盈利后，本人可以自当年年度报告披露后次日起减持首发前股份，并遵守上海证券交易所的相关规定。

如相关法律法规及规范性文件或中国证券监督管理委员会、证券交易所等证券监管机构对股份锁定期有其他要求，则本人直接和间接所持发起人股份的锁定期和限售条件按该等规定和要求相应调整执行。

本人所持发起人股份锁定期届满后，本人减持汇成股份的股份时将严格遵守法律法规及上海证券交易所的规定。

如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，则本人出售股票收益归公司所有，本人将在5个工作日内将前述收益缴纳至公司指定账户。如因本人未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。本人怠于承担前述责任，则公司有权在分红或支付本人其他报酬时直接扣除相应款项。

以上承诺为不可撤销之承诺，不因本人在公司职务变更、离职等原因而影响履行。

②发行人核心技术人员林文浩、钟玉玄的承诺参见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“六、本次发行相关主体作出的重要承诺”之“（一）关于所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及相关股东持股及减持意向的承诺”之“3、持股董事、监事、高级管理人员的承诺”部分。

5、发行人持股5%以上股东的承诺

（1）公司持股5%以上股东汇成投资承诺：

自汇成股份本次发行的股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的汇成股份本次发行前股份，也不得提议由汇成股份回购该部分股份。

如汇成股份上市后6个月内，汇成股份股票连续20个交易日的收盘价（汇成股份股票全天停牌的除外）均低于本次发行的发行价格，或者上市后6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于本次发行的发行价格，本企业持有汇成股份股票的锁定期将在上述锁定期限届满后自动延长6个月。如果因公司派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，上述发行价须按照有关规定作相应调整。

自锁定期届满之日起24个月内，若本企业试图通过任何途径或手段减持本企业在本次发行及上市前通过直接或间接方式已持有的发行人股份，则本企业的减持价格应不低于发行人的股票发行价格。若在本企业减持前述股份前，发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本企业的减持价格应不低于发行人的股票发行价格经相应调整后的价格。减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证券监督管理委员会及证券交易所相关规定的方式。本企业拟减持发行人股份时，将提前通知发行人并通过发行人予以公告。

汇成股份上市时未盈利的，在公司实现盈利前，本企业自公司股票上市之日起3个完整会计年度内，不减持首发前股份；自公司股票上市之日起第4个会计年度和第5个会计年度内，本企业每年减持的首发前股份不超过公司股份总数的2%。公司实现盈利后，本企业可以自当年年度报告披露后次日起减持首发前股份，并遵守上海证券交易所的相关规定。

如相关法律法规及规范性文件或中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等证券监管机构对股份锁定期和减持事项有其他要求，则本企业直接或间接所持发行人股份的锁定期、限售条件和减持事项按该等规定和要求相应调整执行。

本企业所持公司股份锁定期届满后，本企业减持公司股票时将严格遵守法律法规及上海证券交易所的规定。

如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，则本企业出售股票收益归公司所有，本企业将在5个工作日内将前述收益缴纳至公司指定账户。如因本企业未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本企业将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。本企业怠于承担前述责任，则公司有权在分红或支付本企业其他报酬时直接扣除相应款项。

(2) 公司持股5%以上股东嘉兴高和、志道投资承诺：

自汇成股份股票上市之日起12个月内，不得转让或者委托他人管理本企业直接和间接持有的汇成股份本次发行前股份，也不得提议由汇成股份回购该部分股份。

在上述限售期届满后两年内，本企业若减持汇成股份的股份，减持价格、每年减持数量及减持程序将遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定。减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证券监督管理委员会及证券交易所相关规定的方式。本企业拟减持发行人股份时，将按规定通知发行人并通过发行人予以公告。

如相关法律法规及规范性文件或中国证券监督管理委员会、证券交易所等证券监管机构对股份锁定期和减持事项有其他要求，则本企业直接或间接所持发行人股份的锁定期、限售条件和减持事项按该等规定和要求相应调整执行。

本企业所持公司股份锁定期届满后，本企业减持公司的股票时将严格遵守法律法规及上海证券交易所的规定。

如以上承诺事项被证明不真实或未被遵守，则本企业出售股票收益归汇成股份所有，本企业将在5个工作日内将前述收益缴纳至汇成股份指定账户。如因本企业未履行上述承诺事项给汇成股份或者其他投资者造成损失的，本企业将向汇成股份或者其他投资者依法承担赔偿责任。本企业怠于承担前述责任，则汇成股份有权在分红时直接扣除相应款项。

6、申报前 12 个月入股股东的承诺

①公司申报前 12 个月入股股东 Strong Lion、道银投资、国耀汇成、海通新动能、华登基金、惠友豪创、康启一号、昆桥基金、旗昌投资、十月吴巽、拾岳禾安、鼎祥基金、蔚华电子、语音基金承诺：

自汇成股份完成本企业对于公司增资扩股工商变更登记手续之日起36个月内，本企业不转让或委托他人管理本企业持有的汇成股份本次发行前的股份，也不要求汇成股份回购该部分股份。

如相关法律法规及规范性文件或中国证券监督管理委员会、证券交易所等证券监管机构对股份锁定期有其他要求，则本企业直接或间接所持发行人股份的锁定期按该等规定和要求相应调整执行。

本企业所持公司股份锁定期届满后，本企业减持公司的股票时将严格遵守法律法规及上海证券交易所的规定。

②公司申报前12个月入股股东Worth Plus承诺：

对于本企业于2020年11月向公司增资扩股取得的发行人股份，自发行人完成增资扩股工商变更登记手续之日起36个月内，本企业不转让或委托他人管理本企业持有的上述发行人股份，也不要求汇成股份回购该部分股份。

除上述股份外，本企业直接和间接持有的发行人其余股份，自汇成股份股票上市之日起12个月内，不得转让或者委托他人管理，也不得提议由汇成股份回购该部分股份。

如相关法律法规及规范性文件或中国证券监督管理委员会、证券交易所等证券监管机构对股份锁定期有其他要求，则本企业直接或间接所持发行人股份的锁定期按该等规定和要求相应调整执行。

本企业上述所持公司股份锁定期届满后，本企业减持持有的上述公司的股票时将严格遵守法律法规及上海证券交易所的规定。

③公司申报前12个月入股股东杨绍校承诺：

对于本人于2020年12月向公司增资扩股取得的发行人股权，自发行人完成该次增资扩股工商变更登记手续之日起36个月内，本人不转让或委托他人管理本人持有的汇成股份该部分股份，也不要求汇成股份回购该部分股份。

如相关法律法规及规范性文件或中国证券监督管理委员会、证券交易所等证券监管机构对股份锁定期有其他要求，则本人直接或间接所持发行人股份的锁定期按该等规定和要求相应调整执行。

本人所持公司股份锁定期届满后，本人减持公司的股票时将严格遵守法律法规及上海证券交易所的规定。

④公司申报前12个月入股股东刘汉滨、旭鼎一号承诺：

自汇成股份完成本承诺人（或本企业）对于发行人股权转让工商变更登记手续之日起36个月内，本承诺人（或本企业）不转让或委托他人管理本承诺人（或本企业）持有的汇成股份本次发行前的股份，也不要求汇成股份回购该部分股份。

如相关法律法规及规范性文件或中国证券监督管理委员会、证券交易所等证券监管机构对股份锁定期有其他要求，则本承诺人（或本企业）直接或间接所持发行人股份的锁定期按该等规定和要求相应调整执行。

本承诺人（或本企业）所持公司股份锁定期届满后，本承诺人减持公司的股票时将严格遵守法律法规及上海证券交易所的规定。

7、其他股东的承诺

①公司其他股东Advance、Great Title、Win Plus、合肥创投、华得富、高投邦盛、邦盛聚源、上海享堃、扬州耕天下、扬州和安、田林林承诺：

自汇成股份股票上市之日起12个月内，不得转让或者委托他人管理本企业（或本人）直接和间接持有的汇成股份首发前股份，也不得提议由汇成股份回购该部分股份。

如相关法律法规及规范性文件或中国证券监督管理委员会、证券交易所等证券监管机构对股份锁定期有其他要求，则本企业（或本人）直接或间接所持汇成股份股份的锁定期按该等规定和要求相应调整执行。

本企业（或本人）所持公司股份锁定期届满后，本企业（或本人）减持公司的股票时将严格遵守法律法规及上海证券交易所的规定。

②公司其他股东香港宝信、合肥芯成承诺：

自汇成股份股票上市之日起36个月内，不得转让或者委托他人管理本企业直接和间接持有的汇成股份首发前股份，也不得提议由汇成股份回购该部分股份。

汇成股份上市时未盈利的，在公司实现盈利前，本企业自公司股票上市之日起3个完整会计年度内，不减持首发前股份；自公司股票上市之日起第4个会计年度和第5个会计年度内，本企业每年减持的首发前股份不超过公司股份总数的2%。公司实现盈利后，本企业可以自当年年度报告披露后次日起减持首发前股份，并遵守上海证券交易所的相关规定。

如相关法律法规及规范性文件或中国证券监督管理委员会、证券交易所等证券监管机构对股份锁定期有其他要求，则本企业直接或间接所持发起人股份的锁定期按该等规定和要求相应调整执行。

本企业所持公司股份锁定期届满后，本企业减持公司的股票时将严格遵守法律法规及上海证券交易所的规定。

③公司间接股东合肥汇芯、合肥宝芯承诺：

自汇成股份股票上市之日起36个月内，不得转让或者委托他人管理本企业直接持有的合肥芯成企业管理咨询合伙企业（有限合伙）份额及该部分份额对应的汇成股份首发前股份，也不得提议由汇成股份回购该部分股份。

汇成股份上市时未盈利的，在公司实现盈利前，本企业自公司股票上市之日起3个完整会计年度内，不减持首发前股份；自公司股票上市之日起第4个会计年度和第5个会计年度内，本企业每年减持的首发前股份不超过公司股份总数的2%。公司实现盈利后，本企业可以自当年年度报告披露后次日起减持首发前股份，并遵守上海证券交易所的相关规定。

如相关法律法规及规范性文件或中国证券监督管理委员会、证券交易所等证券监管机构对股份锁定期有其他要求，则本企业间接所持发行人股份的锁定期按该等规定和要求相应调整执行。

本企业所持公司股份锁定期届满后，本企业减持公司的股票时将严格遵守法律法规及上海证券交易所的规定。

（二）关于稳定公司股价的措施和承诺

为维护公司上市后股票价格的稳定，保护投资者利益，进一步明确公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的措施，按照中国证券监督管理委员会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证监会公告[2013]42号）的相关要求，结合公司实际情况，公司2020年年度股东大会审议通过了《合肥新汇成微电子股份有限公司关于首次公开发行股票并上市后三年内稳定公司股价的预案》的议案（以下简称“《稳定股价预案》”），具体情况如下：

1、启动股价稳定措施的具体条件

（1）预警条件

当公司股票连续5个交易日的收盘价低于最近一期定期报告披露的每股净资产（若发生除权除息事项，每股净资产相应调整，下同）的120%时，公司将在10个工作日内召开投资者见面会，与投资者就上市公司经营状况、财务指标、发展战略进行深入沟通。

（2）启动条件

当公司股票连续20个交易日的收盘价低于最近一期经审计每股净资产时，应当在30日内实施相关稳定股价的方案，并应提前公告具体实施方案。

2、稳定股价的具体措施

当上述触发稳定股价义务的条件成就时，公司将按下列顺序及时采取部分或全部措施稳定公司股价：

（1）公司回购股份

当达到启动条件时，公司将根据《上市公司回购社会公众股份管理办法》等相关法律法规的规定向社会公众股东回购公司部分股票，以稳定公司股价。

①启动稳定股价预案的程序

A、公司董事会办公室负责前述触发实施稳定股价方案条件的监测，在其监测到前述触发实施稳定股价方案条件成就时，公司于 10 日内召开董事会讨论稳定股价方案，并经公司董事会全体董事二分之一以上表决通过；

B、公司董事会应于董事会表决通过之日起 2 日内发出召开股东大会的通知，并于发出股东大会会议通知后的 15 日内召开股东大会审议；

C、公司股东大会对回购股份做出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；

D、公司应在股东大会决议做出之日起次日开始启动回购程序，并应在履行相关法定手续后的 30 个交易日内实施完毕；

E、公司回购方案实施完毕后，应在 2 个交易日内公告公司股份变动报告，并在 10 个交易日内依法注销所回购的股份，办理工商变更登记手续。

②公司回购股份的资金为自有资金，回购股份的方式为集中竞价交易方式或证券监督管理部门认可的其他方式。但如果股份回购方案实施前或实施过程中，公司股票价格连续 10 个交易日的收盘价均高于每股净资产，则公司可不再继续实施该方案。

③公司为稳定股价之目的进行股份回购的，除应符合相关法律法规之要求之外，还应符合下列各项条件：

A、公司单一会计年度用于回购股份的资金总额累计不超过上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 20%，且单次用于回购股份的资金总额不低于上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的 10%；

B、公司单次回购股份不超过当次股份回购方案实施前公司总股本的 1%；

C、公司回购股份不违反公司签署的相关协议的约定，且不会导致公司的股权分布不符合上市条件。

④若非因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等原因，公司未遵守上述承诺的，公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉，同时按中国证监会及其他有关机关

认定的实际损失向投资者进行赔偿，以尽可能保护投资者的权益。

（2）控股股东增持股份

若前述股价稳定措施已实施，再次触发股价稳定措施启动条件，且公司回购股份达到预案上限的，公司控股股东将按照有关法律法规的规定，增持公司股份。

①启动稳定股价预案的程序

A、控股股东将于触发实施稳定股价方案的 10 个交易日内通知公司董事会增持公司股份的计划，并通过公司发布增持公告；

B、控股股东将在增持公告发布之日起次日开始启动增持，并应在履行相关法定手续后的 30 个交易日内实施完毕。

②增持股份的方式为集中竞价交易方式或证券监督管理部门认可的其他方式。在增持股份不会导致公司的股权分布不符合上市条件的前提下，单次用于增持的资金总额不低于最近一个会计年度从公司获得的现金分红税后金额的 10%，单一会计年度内累计增持股份资金总额不超过最近一个会计年度从公司获得的现金分红税后金额的 40%。但如果股份增持方案实施前或实施过程中，公司股票价格连续 5 个交易日的收盘价均高于公司每股净资产，则可不再继续实施该方案。

③如未履行上述增持公司股份义务，控股股东将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；并将在前述事项发生之日起停止在公司处领取股东分红，同时控股股东持有的公司股份将不得转让，直至采取相应的稳定股价措施并实施完毕时为止。

（3）董事、高级管理人员增持公司股份

若前述股价稳定措施已实施，再次触发股价稳定措施启动条件，且公司控股股东增持股份达到预案上限的，公司董事（不包括独立董事，下同）、高级管理人员将按照有关法律法规的规定，增持公司股份。

①启动稳定股价预案的程序

A、公司董事、高级管理人员将于触发实施稳定股价方案的 10 个交易日内通知公司董事会增持公司股份的计划，并通过公司发布增持公告；

B、公司董事、高级管理人员将在增持公告发布之日起次日开始启动增持，并应在履行相关法定手续后的 30 个交易日内实施完毕。

②增持股份的方式为集中竞价交易方式或证券监督管理部门认可的其他方式。在增持股份不会导致公司的股权分布不符合上市条件的前提下，单次用于增持的资金总额不低于董事、高级管理人员在担任公司董事、高级管理人员期间上一会计年度从公司处领取的税后薪酬累计额的 10%，单一年度用以稳定股价所动用的资金应不超过董事、高级管理人员在担任公司董事、高级管理人员期间上一会计年度从公司处领取的税后薪酬累计额的 40%。但如果股份增持方案实施前或实施过程中，公司股票价格连续 5 个交易日的收盘价均高于公司每股净资产，则董事、高级管理人员可不再继续实施该方案。

③如未履行上述增持公司股份义务，董事、高级管理人员将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；并将在前述事项发生之日起停止在公司处领取薪酬（如有）及股东分红（如有），同时董事、高级管理人员持有的公司股份将不得转让，直至采取相应的稳定股价措施并实施完毕时为止。

3、发行人承诺

公司将严格按照《稳定股价预案》的要求，全面且有效地履行公司在《稳定股价预案》项下的各项义务和责任；

公司将极力敦促公司控股股东、实际控制人及相关方严格按照《稳定股价预案》之要求全面且有效地履行其在《稳定股价预案》项下的各项义务和责任；

若公司新聘任董事（不包括独立董事）、高级管理人员，公司将要求新聘任的董事、高级管理人员履行公司上市时董事、高级管理人员就《稳定股价预案》作出的相应承诺；

若公司未遵守上述承诺的，公司将依照未能履行承诺时的约束措施承担相应责任。

4、控股股东扬州新瑞连承诺

本企业将严格按照《稳定股价预案》的要求，全面且有效地履行本企业在《稳定股价预案》项下的各项义务和责任；

本企业将在股东大会、董事会审议《稳定股价预案》规定的回购公司股份事项时，对该事项议案投赞成票；

本企业将极力敦促公司及相关方严格按照《稳定股价预案》之要求全面且有效地履行其在《稳定股价预案》项下的各项义务和责任；

若本企业未遵守上述承诺的，本企业将依照未能履行承诺时的约束措施承担相应责任。

5、实际控制人郑瑞俊、杨会承诺

本人将严格按照《稳定股价预案》的要求，全面且有效地履行本人在《稳定股价预案》项下的各项义务和责任；

本人将在股东大会、董事会审议《稳定股价预案》规定的回购公司股份事项时，对该事项议案投赞成票；

本人将极力敦促公司及相关方严格按照《稳定股价预案》之要求全面且有效地履行其在《稳定股价预案》项下的各项义务和责任；

若本人未遵守上述承诺的，本人将依照未能履行承诺时的约束措施承担相应责任。

6、公司董事（不含独立董事）及高级管理人员承诺

本人将严格按照《稳定股价预案》之要求全面且有效地履行本人在《稳定股价预案》项下的各项义务和责任；

本人将在董事会审议《稳定股价预案》规定的回购公司股份事项时，对该事项议案投赞成票；

本人将极力敦促公司及相关方严格按照《稳定股价预案》之要求全面且有效地履行其在《稳定股价预案》项下的各项义务和责任；

若本人未遵守上述承诺的，本人将依照未能履行承诺时的约束措施承担相应责任。

（三）关于股份回购及股份购回的措施和承诺

为确保发行人履行《稳定股价预案》所规定的回购股份义务，以及确保公司、控股股东履行因公司不符合发行上市条件但以欺骗手段骗取首次公开发行股票发行注册被责令购回首次公开发行的股份义务，结合公司的实际情况，2021年6月10日，公司召开了第一届董事会第三次会议，审议通过了《合肥新汇成微电子股份有限公司关于回购和购回股份相关措施》的议案（以下简称“《回购及购回股份的措施》”，具体如下：

1、履行《稳定股价预案》规定的回购股份义务的具体措施

在公司首次公开发行股票并上市后三年内，如公司股票连续20个交易日的收盘价低于最近一期经审计每股净资产时，公司将于10日内召开董事会讨论回购公司股份事项，在董事会审议通过回购股份方案之日起2日内发出召开股东大会的通知，召开股东大会审议回购公司股份事项，相关议案内容将严格按《稳定股价预案》规定拟定。

公司董事应当在董事会审议《稳定股价预案》规定的回购公司股份事项时，对该事项议案投赞成票。

公司控股股东应当在股东大会审议《稳定股价预案》规定的回购公司股份事项时，对该事项议案投赞成票。

若公司未履行上述义务，则公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。

若公司董事或控股股东未履行上述义务，则相关董事、控股股东将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，同时将在前述事项发生之日起停止在公司处领取薪酬（如有）及股东分红（如有），所持公司股份将不得转让，直至相应义务履行完毕时为止。

2、履行中国证券监督管理委员会责令购回股份义务的具体措施

若因公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册，导致公司被中国证券监督管理委员会责令在一定期间购回首次公开发行的股票的，在公司履行购回义务前，公司累计未分配利润应优先用于履行购回首次公开发行股票义务，不得用于分红或其他用途。

若因公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册，导致控股股东被中国证券监督管理委员会责令在一定期间购回首次公开发行的股票的，在控股股东履行购回义务前，控股股东不得从公司领取薪酬（如有）及股东分红，所持公司股份不得转让，直至相应义务履行完毕时为止。

若公司或控股股东未履行上述义务，则未履行相应义务的主体将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉。

3、发行人承诺

若证券监督管理部门或其他有权部门认定《合肥新汇成微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》所载之内容存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，且该等情形对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大且实质影响的，则公司承诺将按照《合肥新汇成微电子股份有限公司关于依法承担赔偿责任或赔偿责任的承诺》依法购回本次发行的全部新股。

若中国证券监督管理委员会认定公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册，则公司承诺将在中国证监会等有权部门确认后5个工作日内启动股份购回程序，从投资者手中购回本次发行的全部新股。

当《合肥新汇成微电子股份有限公司关于首次公开发行股票并上市后三年内稳定公司股价的预案》中约定的预案触发条件成就时，公司将按照《合肥新汇成微电子股份有限公司关于首次公开发行股票并上市后三年内稳定公司股价的承诺》履行回购公司股份的义务。

若公司未能依照上述承诺履行相关义务的，公司将依照未能履行承诺时的约

束措施承担相应责任。

4、控股股东扬州新瑞连承诺

若证券监督管理部门或其他有权部门认定《合肥新汇成微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》所载之内容存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，且该等情形对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大且实质影响的，则本企业承诺将按照《合肥新汇成微电子股份有限公司控股股东关于依法承担赔偿责任或赔偿责任的承诺》极力促使公司依法购回或由本企业依法购回其本次公开发行的全部新股。

若中国证券监督管理委员会认定公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册，则本企业承诺将在中国证监会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程序，依法从投资者手中购回本次公开发行的全部新股。

当《合肥新汇成微电子股份有限公司关于首次公开发行股票并上市后三年内稳定公司股价的预案》中约定的预案触发条件成就时，本企业将按照《合肥新汇成微电子股份有限公司控股股东关于首次公开发行股票并上市后三年内稳定公司股价的承诺》履行回购公司股份的义务。

若本企业未能依照上述承诺履行相关义务的，本企业将依照未能履行承诺时的约束措施承担相应责任。

5、实际控制人郑瑞俊、杨会承诺

若证券监督管理部门或其他有权部门认定《合肥新汇成微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》所载之内容存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，且该等情形对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大且实质影响的，则本人承诺将按照《合肥新汇成微电子股份有限公司实际控制人关于依法承担赔偿责任或赔偿责任的承诺》极力促使公司依法购回或由本人依法购回其本次公开发行的全部新股。

若中国证券监督管理委员会认定公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册，则本人承诺将在中国证监会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程序，依法从投资者手中购回本次公开发行的全部新股。

当《合肥新汇成微电子股份有限公司关于首次公开发行股票并上市后三年内稳定公司股价的预案》中约定的预案触发条件成就时，本人将按照《合肥新汇成微电子股份有限公司实际控制人关于首次公开发行股票并上市后三年内稳定公司股价的承诺》履行回购公司股份的义务。

若本人未能依照上述承诺履行相关义务的，本人将依照未能履行承诺时的约束措施承担相应责任。

（四）关于对欺诈发行上市的股份购回承诺

1、发行人关于欺诈发行股份购回事项承诺如下

保证本公司符合发行上市的条件，本次发行的招股说明书及其他信息披露文件不存在隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容，不存在以欺骗手段骗取发行注册情形。

如本公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本公司将在中国证券监督管理委员会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程序，购回本公司本次公开发行的全部新股。购回价格按照发行价格加新股上市日至购回日期期间的同期银行活期存款利息或中国证券监督管理委员会认可的其他价格，并根据相关法律法规规定的程序实施。公司如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，前述价格应相应调整。

当公司未来涉及股份购回时，公司将同时遵守中国证券监督管理委员会及证券交易所等证券监管机构的相关规定。

除非法律另有规定，自本承诺函出具之日起，本承诺函及本承诺函项下之承诺均不可撤销；如法律另有规定，造成上述承诺的某些部分无效或不可执行时，不影响本公司在本承诺函项下的其它承诺。

2、发行人控股股东扬州新瑞连关于欺诈发行股份购回事项承诺如下

本企业保证汇成股份符合发行上市的条件，本次发行的招股说明书及其他信息披露文件不存在隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容，不存在以欺骗手段骗取发行注册情形。

如汇成股份不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本企业将在中国证券监督管理委员会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程序，购回汇成股份本次公开发行的全部新股。购回价格按照发行价格加新股上市日至购回日期间的同期银行活期存款利息或中国证券监督管理委员会认可的其他价格，并根据相关法律法规规定的程序实施。汇成股份如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，前述价格应相应调整。

当汇成股份未来涉及股份购回时，本企业将同时遵守中国证券监督管理委员会及证券交易所等证券监管机构的相关规定。

除非法律另有规定，自本承诺函出具之日起，本承诺函及本承诺函项下之承诺均不可撤销；如法律另有规定，造成上述承诺的某些部分无效或不可执行时，不影响本企业在本承诺函项下的其它承诺。

3、实际控制人郑瑞俊、杨会关于欺诈发行股份购回事项承诺如下

本人保证汇成股份符合发行上市的条件，本次发行的招股说明书及其他信息披露文件不存在隐瞒重要事实或者编造重大虚假内容，不存在以欺骗手段骗取发行注册情形。

如汇成股份不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本人将在中国证券监督管理委员会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份购回程序，购回汇成股份本次公开发行的全部新股。购回价格按照发行价格加新股上市日至购回日期间的同期银行活期存款利息或中国证券监督管理委员会认可的其他价格，并根据相关法律法规规定的程序实施。汇成股份如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，前述价格应相应调整。

当汇成股份未来涉及股份购回时，本人将同时遵守中国证券监督管理委员会及证券交易所等证券监管机构的相关规定。

除非法律另有规定，自本承诺函出具之日起，本承诺函及本承诺函项下之承诺均不可撤销；如法律另有规定，造成上述承诺的某些部分无效或不可执行时，不影响本人在本承诺函项下的其它承诺。

（五）关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺

1、发行人承诺

（1）加强募集资金管理，加快募投项目实施进度

公司将根据《募集资金管理制度》等内部规章制度和相关法律法规的要求，规范募集资金的使用和管理，开设募集资金专项账户，确保本次发行募集资金专款专用，及时存放募集资金于专项账户，严格使用募集资金，以保证募集资金按照原定用途得到充分有效利用。同时，本次募投项目围绕公司主营业务展开，其实施有利于提升公司的盈利能力。本次发行募集资金到位后，公司将加快推进募投项目建设，争取募投项目早日实现预期效益。

（2）加大研发投入，优化工艺流程、持续创新技术

不断提升研发创新能力一直是公司的核心竞争手段。公司未来也将持续增加研发投入，一方面巩固现有产品的技术优势，在现有工艺流程的基础上，设计开发工艺优化方案，以提高生产效率，保障产品品质。另一方面，紧跟行业技术发展趋势和市场需求情况，加强技术与产品创新，在充分评估项目先进性、可行性、市场应用前景、技术突破难点的基础上，推进研发项目的立项、设计开发与产业化，在技术环节、应用领域等方面取得突破。

（3）持续优化人力资源配置

公司所处行业属于典型技术密集型行业，对于技术人员知识背景、研发能力及工作经验均有较高要求。随着经营规模的不断扩大和产品线的不断丰富，公司面临的挑战也愈发多样，而杰出的人才是公司未来稳健发展的关键。公司将根据未来发展的战略规划，持续优化人力资源配置，在进一步完善内部人才培养机

制的同时，加大对国内外高端人才的引进力度，努力打造全球一流的研发和管理团队，为公司的可持续发展打下坚实基础。

（4）增强市场拓展能力，提高公司产品市场占有率

公司在产品的研发和技术、生产经验与客户资源等方面具有较强的竞争优势。未来，公司将发挥公司累积的技术成果、生产经验和客户资源，并进一步扩大规模经济效应和技术创新优势，不断开拓新的客户，进而提高公司产品的市场占有率。

（5）完善利润分配制度，强化投资者回报制度

公司上市后将严格按照《合肥新汇成微电子股份有限公司利润分配管理制度》的规定，完善对利润分配事项的决策机制，重视对投资者的合理回报，积极采取现金分红等方式分配股利，吸引投资者并提升公司投资价值。

（6）关于后续事项的承诺

公司承诺将根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等证券监管机构后续出台的相关规定（如有），持续完善填补被摊薄即期回报的各项措施。

2、公司控股股东扬州新瑞连承诺

（1）本企业承诺将忠实、勤勉地履行作为控股股东的职责，维护公司和全体股东的合法权益；

（2）本企业承诺不得越权干预公司经营管理活动，不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益；

（3）本企业承诺对本企业的职务消费行为进行约束；

（4）本企业承诺不得动用公司资产从事与本企业履行职责无关的投资、消费活动；

（5）本企业承诺推动公司薪酬制度的完善，使之更符合填补即期回报的要求；支持由董事会或董事会薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并严格遵守该等制度；

（6）本企业承诺在公司设立股权激励计划时（如有），应积极支持股权激励的行权条件与本公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

（7）本企业承诺将严格遵守公司制定的填补回报措施，将根据未来中国证券监督管理委员会、证券交易所等监管机构出台的相关规定，积极采取一切必要、合理措施，在本企业职权范围内督促公司制定的填补回报措施的执行；

（8）本承诺出具日后至公司首次公开发行股票完毕前，中国证券监督管理委员会作出关于填补回报措施及其承诺明确规定时，且上述承诺不能满足中国证券监督管理委员会该等规定时，本企业承诺届时将按中国证券监督管理委员会规定出具补充承诺；

（9）本企业承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本企业对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本企业违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本企业愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

3、实际控制人郑瑞俊、杨会承诺

（1）本人承诺将忠实、勤勉地履行作为实际控制人的职责，维护公司和全体股东的合法权益；

（2）本人承诺不得越权干预公司经营管理活动，不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益；

（3）本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；

（4）本人承诺不得动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；

（5）本人承诺推动公司薪酬制度的完善，使之更符合填补即期回报的要求；支持由董事会或董事会薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并严格遵守该等制度；

（6）本人承诺在公司设立股权激励计划时（如有），应积极支持股权激励的行权条件与本公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

（7）本人承诺将严格遵守公司制定的填补回报措施，将根据未来中国证券监督管理委员会、证券交易所等监管机构出台的相关规定，积极采取一切必要、合理措施，在本人职权范围内督促公司制定的填补回报措施的执行；

（8）本承诺出具日后至公司首次公开发行股票完毕前，中国证券监督管理委员会作出关于填补回报措施及其承诺明确规定时，且上述承诺不能满足中国证券监督管理委员会该等规定时，本人承诺届时将按中国证券监督管理委员会规定出具补充承诺；

（9）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

4、公司董事、高级管理人员承诺

（1）本人承诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不得采用其他方式损害公司利益；

（2）本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；

（3）本人承诺不得动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；

（4）本人承诺推动公司薪酬制度的完善，使之更符合填补即期回报的要求；支持由董事会或董事会薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并严格遵守该等制度；

（5）本人承诺在公司设立股权激励计划时（如有），应积极支持股权激励的行权条件与本公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

（6）本人承诺将严格遵守公司制定的填补回报措施，将根据未来中国证券监督管理委员会、证券交易所等监管机构出台的相关规定，积极采取一切必要、合理措施，在本人职权范围内督促公司制定的填补回报措施的执行；

（7）本承诺出具日后至公司首次公开发行股票完毕前，中国证券监督管理委员会作出关于填补回报措施及其承诺明确规定时，且上述承诺不能满足中国证券

监督管理委员该等规定时，本人承诺届时将按中国证券监督管理委员会规定出具补充承诺；

（8）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任

（六）关于利润分配政策的承诺

发行人关于利润分配政策的承诺如下：

本公司将严格按照相关法律法规、《合肥新汇成微电子股份有限公司章程（草案）》和《合肥新汇成微电子股份有限公司未来三年分红回报规划》等规定的利润分配政策向股东分配利润，严格履行利润分配方案的审议程序。如遇相关法律、法规及规范性文件修订的，本公司将及时根据该等修订调整公司利润分配政策并严格执行。

若本公司未能依照本承诺严格执行利润分配政策的，本公司将依照未能履行承诺时的约束措施承担相应责任。

（七）关于依法承担赔偿责任或赔偿责任的承诺

1、发行人关于依法承担赔偿责任或赔偿责任的承诺如下：

（1）招股说明书及其他信息披露资料所载之内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形，且本公司对招股说明书及其他信息披露资料所载之内容的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

（2）若招股说明书及其他信息披露资料所载之内容存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，且该等情形对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大且实质影响的，本公司承诺将依法购回本次公开发行的全部新股。

（3）若招股说明书及其他信息披露资料所载之内容存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。该等损失的金额以经人民法院认定或与公司协商确定的金额为准。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿顺序、赔偿金额、赔偿方式等细

节内容待上述情形实际发生时，依据最终确定的赔偿方案为准，或中国证券监督管理委员会、上海证券交易所或司法机关认定的方式或金额确定。

2、控股股东扬州新瑞连关于依法承担赔偿责任的承诺如下：

（1）招股说明书及其他信息披露资料所载之内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形，且本企业对于招股说明书及其他信息披露资料所载之内容真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

（2）若发行人招股说明书及其他信息披露资料所载之内容存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，且该等情形对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大且实质影响的，则本企业承诺将极力促使发行人依法购回或由本企业依法购回本次公开发行的全部新股，并将启动购回发行人本次公开发行股票时本公司已转让的全部原限售股份（如有）的程序。

（3）若发行人招股说明书及其他信息披露资料所载之内容存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本企业将依法赔偿投资者损失。该等损失的金额以经人民法院认定或与公司协商确定的金额为准。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿顺序、赔偿金额、赔偿方式等细节内容待上述情形实际发生时，依据最终确定的赔偿方案为准，或中国证券监督管理委员会、上海证券交易所或司法机关认定的方式或金额确定。

3、实际控制人郑瑞俊、杨会关于依法承担赔偿责任的承诺如下：

（1）招股说明书及其他信息披露资料所载之内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形，且本人对于招股说明书及其他信息披露资料所载之内容真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

（2）若发行人招股说明书及其他信息披露资料所载之内容存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，且该等情形对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大且实质影响的，则本人承诺将极力促使发行人依法购回或由本人依法购回本次公开发行的全部新股。

（3）若发行人招股说明书及其他信息披露资料所载之内容存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本

人将依法赔偿投资者损失。该等损失的金额以经人民法院认定或与公司协商确定的金额为准。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿顺序、赔偿金额、赔偿方式等细节内容待上述情形实际发生时，依据最终确定的赔偿方案为准，或中国证券监督管理委员会、上海证券交易所或司法机关认定的方式或金额确定。

4、公司全体董事、监事、高级管理人员关于依法承担赔偿责任的承诺如下：

（1）招股说明书及其他信息披露资料所载之内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形，且本人对招股说明书及其他信息披露资料所载之内容真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

（2）若招股说明书及其他信息披露资料所载之内容存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，致使投资者在证券交易中遭受损失的，且本人因此承担责任的，本人将依法赔偿投资者损失。该等损失的金额以经人民法院认定或与公司协商确定的金额为准。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿顺序、赔偿金额、赔偿方式等细节内容待上述情形实际发生时，依据最终确定的赔偿方案为准，或中国证券监督管理委员会、上海证券交易所或司法机关认定的方式或金额确定。

5、中介机构的承诺

（1）保荐机构承诺

海通证券承诺：

因本公司为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。

（2）发行人律师承诺

天禾律师承诺：

如因本所律师在发行人首次公开发行股票并在科创板上市工作期间未勤勉尽责，导致本所制出、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成实际损失的，在该等违法事实被认定为后，将依法赔偿投资者损失。

（3）审计机构、验资机构、验资复核机构承诺

天健会计师承诺：

如因本所会计师在发行人首次公开发行股票并在科创板上市工作期间未勤勉尽责，导致本所制出、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成实际损失的，在该等违法事实被认定为后，将依法赔偿投资者损失。

（4）评估机构承诺

坤元评估承诺：

如因本机构为发行人本次发行上市制作、出具的文件被中国证监会、上海证券交易所或司法机关认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本机构将依法赔偿投资者损失。

（八）关于未履行公开承诺约束措施的承诺

1、发行人关于未履行公开承诺约束措施的承诺如下：

（1）公司将严格履行在本次发行过程中所作出的全部公开承诺事项（以下简称“承诺事项”）中的各项义务和责任。公司已作出的承诺事项中已经包含约束措施的，则以该等承诺中明确的约束措施为准；若公司违反该等承诺，公司同意采取该等承诺中已经明确的约束措施。

（2）如公司非因不可抗力原因导致未能完全、有效地履行承诺事项中的各项义务或责任，公司将采取下述约束措施：

①公司将在有关监管机关要求的期限内予以纠正或及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺；

②如公众投资者因信赖公司承诺事项进行交易而遭受损失的，公司将依据证券监管部门或司法机关认定的方式及金额进行赔偿；

③自公司完全消除其未履行相关承诺事项所有不利影响之日起 12 个月内，公司不得发行证券，包括但不限于股票、公司债券、可转换的公司债券及证券监督管理部门认可的其他品种等；

④自公司未完全消除未履行相关承诺事项所有不利影响之前，公司不以任何形式向董事、监事、高级管理人员增加薪资或津贴。

(3) 如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等公司无法控制的客观原因导致公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行，公司将采取以下措施：

①在中国证券监督管理委员会指定媒体上公开说明承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；

②向公司及其股东提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护公司及其股东的权益。

2、控股股东扬州新瑞连关于未履行公开承诺约束措施的承诺如下：

(1) 本企业将严格履行在本次发行过程中所作出的承诺事项中的各项义务和责任。本企业已作出的承诺事项中已经包含约束措施的，则以该等承诺中明确的约束措施为准；若本企业违反该等承诺，本企业同意采取该等承诺中已经明确的约束措施。

(2) 如本企业非因不可抗力原因导致未能完全、有效地履行承诺事项中的各项义务或责任，本企业将采取下述约束措施：

①本企业将在有关监管机关要求的期限内予以纠正或向公司及其他股东及作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺；

②如公众投资者因信赖本企业承诺事项进行交易而遭受损失的，本企业将依据证券监管部门或司法机关认定的方式及金额进行赔偿；本企业若从汇成股份处领取薪酬、津贴，或直接或间接持有汇成股份股份，则本企业同意汇成股份停止向本企业发放薪酬、津贴以及本企业应获分配的现金分红，并将此直接用于执行本企业未履行的承诺或用于赔偿因本企业未履行承诺而给汇成股份及其股东造成的损失；

③本企业直接或间接持有公司股份的锁定期自动延长至本企业完全消除因本企业未履行相关承诺事项而产生的所有不利影响之日。

（3）如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本企业无法控制的客观原因导致本企业承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行，本企业将采取以下措施：

①在中国证券监督管理委员会指定媒体上公开说明承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；

②向公司及其股东提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护公司及其股东的权益。

3、实际控制人郑瑞俊、杨会关于未履行公开承诺约束措施的承诺如下：

（1）本人将严格履行在本次发行过程中所作出的承诺事项中的各项义务和责任。本人已作出的承诺事项中已经包含约束措施的，则以该等承诺中明确的约束措施为准；若本人违反该等承诺，本人同意采取该等承诺中已经明确的约束措施。

（2）如本人非因不可抗力原因导致未能完全、有效地履行承诺事项中的各项义务或责任，本人将采取下述约束措施：

①本人将在有关监管机关要求的期限内予以纠正或向公司及其他股东及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺；

②如公众投资者因信赖本人承诺事项进行交易而遭受损失的，本人将依据证券监管部门或司法机关认定的方式及金额进行赔偿；本人若从汇成股份处领取薪酬、津贴，或直接或间接持有汇成股份股份，则本人同意汇成股份停止向本人发放薪酬、津贴以及本人应获分配的现金分红，并将此直接用于执行本人未履行的承诺或用于赔偿因本人未履行承诺而给汇成股份及其股东造成的损失；

③本人直接或间接持有公司股份的锁定期自动延长至本人完全消除因本人未履行相关承诺事项而产生的所有不利影响之日。

（3）如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行，本人将采取以下措施：

①在中国证券监督管理委员会指定媒体上公开说明承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；

②向公司及其股东提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护公司及其股东的权益。

4、持股 5%以上的股东关于未履行公开承诺约束措施的承诺如下：

公司持股 5%以上股东嘉兴高和、汇成投资和志道投资承诺：

（1）本企业将严格履行其在本次发行过程中作出的承诺事项中的各项义务和责任。本企业已作出的承诺事项中已经包含约束措施的，则以该等承诺中明确的约束措施为准；若本企业违反该等承诺，本企业同意采取该等承诺中已经明确的约束措施。

（2）如本企业因自身原因导致未能完全、有效地履行承诺事项中的各项义务或责任，本企业将采取下述约束措施：

①本企业将在有关监管机关要求的期限内予以纠正或及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺；

②如公众投资者因信赖本企业承诺事项进行交易而遭受损失的，本企业将依据证券监管部门或司法机关认定的方式及金额进行赔偿；

③本企业直接或间接持有汇成股份股份的锁定期自动延长至本企业完全消除因本企业未履行相关承诺事项而产生的所有不利影响之日。

（3）如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本企业无法控制的客观原因导致本企业承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行，本企业将采取以下措施：

①在中国证券监督管理委员会指定媒体上公开说明承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；

②向汇成股份及其股东提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护汇成股份及其股东的权益。

5、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员关于未履行公开承诺约束措施的承诺如下：

（1）本人将严格履行在本次发行过程中所作出的承诺事项中的各项义务和责任。本人已作出的承诺事项中已经包含约束措施的，则以该等承诺中明确的约束措施为准；若本人违反该等承诺，本人同意采取该等承诺中已经明确的约束措施

（2）如本人非因不可抗力原因导致未能完全、有效地履行承诺事项中的各项义务或责任，本人将采取下述约束措施：

①本人将在有关监管机关要求的期限内予以纠正或向公司及其他股东及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺；

②因未履行相关承诺事项而获得收益的（如有），所获得收益归汇成股份所有；

③如公众投资者因信赖本人承诺事项进行交易而遭受损失的，本人将依据证券监管部门或司法机关认定的方式及金额进行赔偿；本人若从汇成股份处领取薪酬、津贴，或直接或间接持有汇成股份股份，则本人同意汇成股份停止向本人发放薪酬、津贴以及本人应获分配的现金分红，并将此直接用于执行本人未履行的承诺或用于赔偿因本人未履行承诺而给汇成股份及其股东造成的损失；

④若本人直接或间接持有公司股份，本人直接或间接持有公司股份的锁定期自动延长至本人完全消除因本人未履行相关承诺事项而产生的所有不利影响之日。

（3）如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行，本人将采取以下措施：

①在中国证券监督管理委员会指定媒体上公开说明承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；

②向公司及其股东提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护公司及其股东的

权益。

6、其他股东关于未履行公开承诺约束措施的承诺如下：

发行人其他股东语音基金、香港宝信、国耀汇成、华登基金、合肥创投、合肥芯成、华得富、高投邦盛、昆桥基金、海通新动能、刘汉滨、拾岳禾安、邦盛聚源、十月吴巽、上海享埜、惠友豪创、旗昌投资、鼎祥基金、田林林、蔚华电子、康启一号、旭鼎一号、扬州耕天下、扬州和安、杨绍校、Advance、Great Title、Strong Lion、Win Plus、Worth Plus 承诺：

（1）本企业/本人将严格履行其在公司首次公开发行股票并上市过程中所作出的承诺事项中的各项义务和责任。

（2）若本企业/本人因自身原因未能完全且有效地履行前述承诺事项中的各项义务或责任，则本企业/本人承诺将依法采取相关措施予以约束：

①自违约之日后本企业应得的现金分红由公司直接用于执行未履行的承诺或用于赔偿因本企业/本人未履行承诺而给公司或投资者带来的损失，直至本企业/本人履行承诺或弥补完公司、投资者的损失为止；

②本企业/本人所持公司股份的锁定期自动延长至本企业/本人未履行相关承诺事项所有不利影响完全消除之日。

（九）关于不谋求实际控制权的承诺

1、持股 5%以上直接股东承诺

公司持股 5%以上直接股东嘉兴高和、汇成投资和志道投资承诺如下：

本承诺人认可并尊重郑瑞俊、杨会在汇成股份自始的实际控制人地位，不对郑瑞俊、杨会在汇成股份经营发展中的实际控制地位提出异议；

本承诺人作为公司的财务投资人，不直接参与汇成股份日常经营管理，自投资汇成股份并成为其股东之日起未曾通过任何形式谋求公司控制权；

本承诺人承诺在持有公司股份期间，不通过任何方式单独或共同谋求对汇成股份的控制权，不通过协议、委托及其他任何安排与公司其他股东采取一致行动，

不通过协议、委托及其他任何安排与公司其他股东扩大其所能够支配的在公司股东大会或董事会上的表决权。

2、持股 5%以上间接自然人股东承诺

公司持股 5%以上间接自然人股东纪念、杨绍校承诺如下：

本承诺人认可并尊重郑瑞俊、杨会在汇成股份自始的实际控制人地位，不对郑瑞俊、杨会在汇成股份经营发展中的实际控制地位提出异议；

本承诺人作为公司的财务投资人，不直接参与汇成股份日常经营管理，自投资汇成股份并成为其股东之日起未曾通过任何形式谋求公司控制权；

本承诺人承诺在持有公司股份期间，不通过任何方式单独或共同谋求对汇成股份的控制权，不通过协议、委托及其他任何安排与公司其他股东采取一致行动，不通过协议、委托及其他任何安排与公司其他股东扩大其所能够支配的在公司股东大会或董事会上的表决权。

（十）关于申请首发上市股东信息披露的承诺函

发行人承诺如下：

（1）本公司股东中不存在法律法规及规范性文件规定的禁止持股的主体直接或间接持有本公司股份的情形；

（2）本次发行的保荐机构海通证券股份有限公司通过其控制的辽宁海通新动能股权投资基金合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股份，除此之外，本次发行的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员不存在直接或间接持有本公司股份的情形；

（3）本公司股东不存在以本公司股权进行不当利益输送的情形；

（4）本公司及本公司股东已及时向本次发行的中介机构提供了真实、准确、完整的资料，积极和全面配合了本次发行的中介机构开展尽职调查，依法在本次发行的申报文件中真实、准确、完整地披露了股东信息，履行了信息披露业务。

（十一）其他承诺事项

1、关于避免同业竞争的承诺

（1）控股股东承诺

发行人控股股东扬州新瑞连就关于避免同业竞争事项承诺如下：

①截至本承诺出具之日，本企业及本企业直接或间接控制的其他企业未直接或间接从事或参与与汇成股份及其控股子公司所从事的业务构成竞争关系的任何业务或活动，未持有与汇成股份及其控股子公司所从事的业务构成竞争关系的其他公司、企业或其他经济组织的权益；

②本企业及本企业直接或间接控制的其他企业，将不会在中国境内和境外，以任何形式直接或间接从事或参与与汇成股份及其控股子公司所从事的业务构成竞争关系的业务及活动，将不以任何形式持有与汇成股份及其控股子公司所从事的业务构成竞争关系的其他公司、企业或其他经济组织的权益，将不会向与汇成股份及其控股子公司构成或可能构成同业竞争的其他公司、企业或其他经济组织、个人提供任何资金、业务、技术、管理、商业机密等方面的帮助；

③本企业承诺，本企业将不利用对汇成股份的控制关系进行损害汇成股份及汇成股份其他股东利益的经营活动；

④如果本企业违反上述承诺，本企业将在公司股东大会和中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因，向股东和社会公众投资者道歉，并在限期内采取有效措施予以纠正；造成汇成股份或其他股东经济损失的，本企业将对汇成股份及其他股东因此受到的全部损失承担赔偿责任。

本承诺自出具之日起生效，直至本企业不再为汇成股份控股股东或者汇成股份终止在科创板上市时为止。本企业保证本承诺真实、有效，并愿意承担由于承诺不实给汇成股份及其他利益相关者造成的相关损失。

（2）实际控制人承诺

发行人实际控制人郑瑞俊、杨会就关于避免同业竞争事项承诺如下：

①截至本承诺出具之日，本人及本人直接或间接控制的其他企业未直接或间接从事或参与与汇成股份及其控股子公司所从事的业务构成竞争关系的任何业务或活动，未持有与汇成股份及其控股子公司所从事的业务构成竞争关系的其他公司、企业或其他经济组织的权益，未在该公司、企业或其他经济组织中担任董事、高级管理人员或核心技术人员等职务；

②本人及本人直接或间接控制的其他企业，将不会在中国境内和境外，以任何形式直接或间接从事或参与与汇成股份及其控股子公司所从事的业务构成竞争关系的业务及活动，将不以任何形式持有与汇成股份及其控股子公司所从事的业务构成竞争关系的其他公司、企业或其他经济组织的权益，将不会向与汇成股份及其控股子公司构成或可能构成同业竞争的其他公司、企业或其他经济组织、个人提供任何资金、业务、技术、管理、商业机密等方面的帮助；

③本人承诺，本人将不利用对汇成股份的控制关系进行损害汇成股份及汇成股份其他股东利益的经营活动；

④如果本人违反上述承诺，本人将在公司股东大会和中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因，向股东和社会公众投资者道歉，并在限期内采取有效措施予以纠正；造成汇成股份或其他股东经济损失的，本人将对汇成股份及其他股东因此受到的全部损失承担赔偿责任。

本承诺自出具之日起生效，直至本人不再为汇成股份实际控制人或者汇成股份终止在科创板上市时为止。本人保证本承诺真实、有效，并愿意承担由于承诺不实给汇成股份及其他利益相关者造成的相关损失。

2、关于规范和减少关联交易的承诺

（1）控股股东承诺

发行人控股股东扬州新瑞连就关于规范和减少关联交易事项承诺如下：

①截至本承诺出具之日，除已披露的情形外，本企业及本企业控制的其他企业与公司之间不存在任何依照相关法律、法规和规范性文件的规定应披露而未披露的关联交易；

②本企业将严格按照《公司法》等相关法律法规以及《合肥新汇成微电子股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）《合肥新汇成微电子股份有限公司关联交易决策制度》等有关规定，依法行使股东权利，同时承担相应的股东义务，在董事会、股东大会对涉及本企业及本企业控制的其他企业的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；

③本企业及本企业控制的其他企业承诺不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用公司及其下属企业资金，不在任何情况下要求公司及其下属企业为本企业及本企业控制的其他企业提供任何形式的担保；

④根据相关法律、法规和规范性文件，为减少并规范关联交易，本企业及本企业控制的其他企业将尽量避免或减少与公司及其子公司发生不必要的关联交易；对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开、价格公允的原则，依法签订协议，履行合法程序，按照《公司章程（草案）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和有关法律法规的规定办理有关审议程序，履行信息披露义务，保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益；

⑤若违反前述承诺造成公司或其他股东利益受损的，本企业将承担全额赔偿责任。

本承诺自出具之日起生效，直至本企业不再为汇成股份控股股东或汇成股份终止在科创板上市时为止。本企业保证本承诺真实、有效，并愿意承担由于承诺不实给汇成股份及其他利益相关者造成的相关损失。

（2）实际控制人承诺

发行人实际控制人郑瑞俊、杨会就关于规范和减少关联交易事项承诺如下：

①截至本承诺出具之日，除已披露的情形外，本人及本人控制的其他企业与公司之间不存在任何依照相关法律、法规和规范性文件的规定应披露而未披露的关联交易；

②本人将严格按照《公司法》等相关法律法规以及《合肥新汇成微电子股份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）《合肥新汇成微电子股份有限公司关联交易决策制度》等有关规定，依法行使股东权利，同时

承担相应的股东义务，在董事会、股东大会对涉及本人及本人控制的其他企业的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；

③本人及本人控制的其他企业承诺不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用公司及其下属企业资金，不在任何情况下要求公司及其下属企业为本人及本人控制的其他企业提供任何形式的担保；

④根据相关法律、法规和规范性文件，为减少并规范关联交易，本人及本人控制的其他企业将尽量避免或减少与公司及其子公司发生不必要的关联交易；对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开、价格公允的原则，依法签订协议，履行合法程序，按照《公司章程（草案）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和有关法律法规的规定办理有关审议程序，履行信息披露义务，保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益；

⑤若违反前述承诺造成公司或其他股东利益受损的，本人将承担全额赔偿责任。

本承诺自出具之日起生效，直至本人不再为汇成股份实际控制人或汇成股份终止在科创板上市时为止。本人保证本承诺真实、有效，并愿意承担由于承诺不实给汇成股份及其他利益相关者造成的相关损失。

3、关于社保和住房公积金缴纳情况的承诺

①发行人实际控制人郑瑞俊、杨会就社保和住房公积金缴纳相关事宜承诺如下：

如公司及子公司因首次公开发行股票并上市前未能遵守劳动与社会保障、住房公积金等有关法律法规而被政府主管部门要求缴纳罚款、补缴相关款项、滞纳金以及被要求承担其他经济赔偿责任的，本人将在公司及子公司收到政府主管部门的生效决定后，及时、足额地将等额与公司及子公司被要求缴纳、补缴的罚款、款项、滞纳金以及其他赔偿款支付给有关政府部门或公司及子公司，以避免公司及子公司遭受经济损失。如本人违反上述承诺导致公司及子公司发生经济损失的，公司有权等额扣留应向本人支付的薪酬及/或分红款用于弥补损失。

本人保证本承诺真实、有效，并愿意承担由于承诺不实给汇成股份及其他利

益相关者造成的相关损失。

②控股股东扬州新瑞连就社保和住房公积金缴纳相关事宜承诺如下：

如公司及子公司因首次公开发行股票并上市前未能遵守劳动与社会保障、住房公积金等有关法律法规而被政府主管部门要求缴纳罚款、补缴相关款项、滞纳金以及被要求承担其他经济赔偿责任的，本企业将在公司及子公司收到政府主管部门的生效决定后，及时、足额地将等额与公司及子公司被要求缴纳、补缴的罚款、款项、滞纳金以及其他赔偿款支付给有关政府部门或公司及子公司，以避免公司及子公司遭受经济损失。如本企业违反上述承诺导致公司及子公司发生经济损失的，公司有权等额扣留应向本企业支付的薪酬及/或分红款用于弥补损失。

本企业保证本承诺真实、有效，并愿意承担由于承诺不实给汇成股份及其他利益相关者造成的相关损失。

4、关于不占用公司资金的承诺

①发行人控股股东扬州新瑞连承诺如下：

（1）自汇成股份整体变更为股份公司之日起至本承诺函出具之日，本企业及本企业控制的除汇成股份及其子公司外的其他企业不存在以任何方式违规占用或使用汇成股份及其子公司的资金、资产和资源的情形，也不存在违规要求汇成股份及其子公司为本企业及本企业控制的其他企业的借款或其他债务提供担保的情形；

（2）自本承诺出具之日起，本企业及本企业控制的其他企业将严格遵守法律、法规、规范性文件以及公司相关规章制度的规定，不得以任何方式违规占用公司及其子公司的资金、资产和资源等，也不会违规要求公司或其子公司为本企业及本企业控制的其他企业的借款或其它债务提供担保；

（3）自公司首次公开发行股票并在科创板上市后，本企业将严格遵守中国证券监督管理委员会关于上市公司法人治理的有关规定，采取任何必要的措施保证不占用公司或其子公司的资金、资产和资源等，维护公司的独立性，不损害公司及其他股东利益；

（4）本企业将按《合肥新汇成微电子股份有限公司章程（草案）》的规定，在审议涉及要求公司或其子公司为本企业及本企业控制的其他企业提供担保的任何董事会、股东大会上回避表决；在审议涉及他人违规占用公司及其子公司资金、资产和资源的任何董事会、股东大会上投反对票，依法维护公司利益；

（5）若违反前述承诺，本企业将在公司股东大会和中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行的具体原因，向股东和社会公众投资者道歉，并在限期内采取有效措施予以纠正；造成公司或其他股东利益受损的，本企业将承担全额赔偿责任。

本企业保证本承诺真实、有效，并愿意承担由于承诺不实给汇成股份及其他利益相关者造成的相关损失。

②发行人实际控制人郑瑞俊、杨会承诺如下：

（1）自汇成股份整体变更为股份公司之日起至本承诺函出具之日，本人及本人控制的除汇成股份及其子公司外的其他企业不存在以任何方式违规占用或使用汇成股份及其子公司的资金、资产和资源的情形，也不存在违规要求汇成股份及其子公司为本人及本人控制的其他企业的借款或其他债务提供担保的情形。

（2）自本承诺出具之日起，本人及本人控制的其他企业将严格遵守法律、法规、规范性文件以及公司相关规章制度的规定，不得以任何方式违规占用公司及其子公司的资金、资产和资源等，也不会违规要求公司或其子公司为本人及本人控制的其他企业的借款或其它债务提供担保。

（3）自公司首次公开发行股票并在科创板上市后，本人将严格遵守中国证券监督管理委员会关于上市公司法人治理的有关规定，采取任何必要的措施保证不占用公司或其子公司的资金、资产和资源等，维护公司的独立性，不损害公司及其他股东利益。

（4）本人将按《合肥新汇成微电子股份有限公司章程（草案）》的规定，在审议涉及要求公司或其子公司为本人及本人控制的其他企业提供担保的任何董事会、股东大会上回避表决；在审议涉及他人违规占用公司及其子公司资金、资产和资源的任何董事会、股东大会上投反对票，依法维护公司利益。

（5）若违反前述承诺，本人将在公司股东大会和中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明未履行的具体原因，向股东和社会公众投资者道歉，并在限期内采取有效措施予以纠正；造成公司或其他股东利益受损的，本人将承担全额赔偿责任。

本人保证本承诺真实、有效，并愿意承担由于承诺不实给汇成股份及其他利益相关者造成的相关损失。

5、关于公司与中介机构无关联关系的声明

①发行人声明如下：

发行人及其控股股东扬州新瑞连、实际控制人郑瑞俊、杨会与本次首次公开发行的中介机构海通证券股份有限公司、天健会计师事务所（特殊普通合伙）、安徽天禾律师事务所、坤元资产评估有限公司及其高管、合伙人、签字人员无关联关系、无委托持股或者其他协议安排。

②发行人董事、监事和高级管理人员声明如下：

本人与本次首次公开发行的中介机构海通证券股份有限公司、天健会计师事务所（特殊普通合伙）、安徽天禾律师事务所、坤元资产评估有限公司及其高管、合伙人、签字人员无关联关系、无委托持股或者其他协议安排。

③发行人控股股东扬州新瑞连声明如下：

本企业本次首次公开发行的中介机构海通证券股份有限公司、天健会计师事务所（特殊普通合伙）、安徽天禾律师事务所、坤元资产评估有限公司及其高管、合伙人、签字人员无关联关系、无委托持股或者其他协议安排。

④发行人实际控制人郑瑞俊、杨会声明如下：

本人与本次首次公开发行的中介机构海通证券股份有限公司、天健会计师事务所（特殊普通合伙）、安徽天禾律师事务所、坤元资产评估有限公司及其高管、合伙人、签字人员无关联关系、无委托持股或者其他协议安排。

⑤发行人持股 5% 以上的股东安徽志道、汇成控股和嘉兴高和声明如下：

本企业/本人与合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“汇成股份”、“公司”、“发行人”）本次首次公开发行的中介机构海通证券股份有限公司、天健会计师事务所（特殊普通合伙）、安徽天禾律师事务所、坤元资产评估有限公司及其高管、合伙人、签字人员无关联关系、无委托持股或者其他协议安排。

⑥申报前 12 个月新增股东 Strong Lion、Worth Plus、道银投资、国耀汇成、华登基金、惠友豪创、康启一号、昆桥基金、刘汉滨、旗昌投资、十月吴巽、拾岳禾安、鼎祥基金、蔚华电子、旭鼎一号、杨绍校、语音基金声明如下：

本企业/本人与本次首次公开发行的中介机构海通证券股份有限公司、天健会计师事务所（特殊普通合伙）、安徽天禾律师事务所、坤元资产评估有限公司及其高管、合伙人、签字人员无关联关系、无委托持股或者其他协议安排。

⑦申报前 12 个月新增股东海通新动能声明如下：

合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“发行人”）本次首次公开发行股票并上市的保荐机构（主承销商）海通证券股份有限公司控股子公司海通开元投资有限公司为本企业有限合伙人，同时本企业的执行事务合伙人海通新能源私募股权投资管理有限公司为海通开元投资有限公司的控股子公司。

除此之外，本企业与本次首次公开发行并上市的其他中介机构及其负责人、高级管理人员、合伙人、经办人员之间无关联关系、无委托持股或者其他协议安排。

6、关于转贷事项的承诺

①发行人控股股东扬州新瑞连承诺如下：

公司及控股子公司通过转贷获得的贷款资金主要用于支付采购款等生产经营活动，涉及转贷的银行借款均已正常还本付息，相关借款合同均已履行完毕，未发生逾期还款或其他违约行为，在资金周转过程中，不存在相互输送利益或者损害各方利益的情形，亦未产生任何纠纷或潜在纠纷。

如未来公司或控股子公司因转贷事宜受到有权部门的处罚或被第三方追究任何形式的法律责任，本企业将无条件代公司承担全部费用，或在公司及其控股

子公司必须先行支付该等费用的情况下及时向公司及其控股子公司给予全额补偿，以确保公司及其控股子公司不会因此受到任何损失，并承诺日后不会就此事向公司进行追偿。

本企业保证本承诺真实、有效，并愿意承担由于承诺不实给汇成股份及其他利益相关者造成的相关损失。

②发行人实际控制人郑瑞俊、杨会就公司转贷事宜承诺如下：

公司及控股子公司通过转贷获得的贷款资金主要用于支付采购款等生产经营活动，涉及转贷的银行借款均已正常还本付息，相关贷款合同均已履行完毕，未发生逾期还款或其他违约行为，在资金周转过程中，不存在相互输送利益或者损害各方利益的情形，亦未产生任何纠纷或潜在纠纷。

如未来公司或控股子公司因转贷事宜受到有权部门的处罚或被第三方追究任何形式的法律责任，本人将无条件代公司承担全部费用，或在公司及其控股子公司必须先行支付该等费用的情况下及时向公司及其控股子公司给予全额补偿，以确保公司及其控股子公司不会因此受到任何损失，并承诺日后不会就此事向公司进行追偿。

本人保证本承诺真实、有效，并愿意承担由于承诺不实给汇成股份及其他利益相关者造成的相关损失。

7、关于劳务派遣事项的承诺

发行人实际控制人郑瑞俊、杨会就劳务派遣事项承诺如下：

如公司及子公司因首次公开发行股票并上市前未能遵守劳动与社会保障、住房公积金等有关法律法规而被有权政府部门要求缴纳罚款、补缴相关款项、滞纳金以及被要求承担其他经济赔偿责任的，本人将在公司及子公司收到有权政府部门的生效决定后，及时、足额地将等额与公司及子公司被要求缴纳、补缴的罚款、款项、滞纳金以及其他赔偿款支付给有关政府部门或公司及子公司，以避免公司及子公司遭受经济损失。如本人违反上述承诺导致公司及子公司发生经济损失的，公司有权等额扣留应向本人支付的薪酬及/或分红款用于弥补损失。

本人保证本承诺真实、有效，并愿意承担由于承诺不实给汇成股份及其他利益相关者造成的相关损失。

第十一节 其他重大事项

一、重要合同

公司及下属子公司已履行和正在履行的对公司生产经营活动、未来发展或财务状况具有重要影响的合同如下：

（一）采购合同

1、原材料采购

报告期内，发行人及其子公司与原材料供应商通过订单方式交易，并根据需求下原材料采购订单，原材料供应商根据订单组织生产。截至本招股说明书签署日，发行人及其子公司与供应商签订的已履行完毕或正在履行的金额在 1,000 万元以上的原材料采购订单的相关情况如下：

序号	供应商名称	订单金额	签订日期	采购主要内容	履行情况
1	光洋化学	219.42 万美元	2020/3/2	金盐	已履行完毕
2	光洋化学	220.93 万美元	2020/9/15	金盐	已履行完毕
3	光洋化学	199.41 万美元	2019/10/28	金盐	已履行完毕
4	光洋化学	202.77 万美元	2020/1/3	金盐	已履行完毕
5	光洋化学	1,163.59 万元	2021/1/29	金盐	已履行完毕
6	光洋化学	1,333.92 万元	2020/12/7	金盐	已履行完毕
7	光洋化学	1,245.20 万元	2021/3/12	金盐	已履行完毕
8	光洋化学	1,661.95 万元	2021/4/26	金盐	已履行完毕
9	光洋化学	1,878.21 万元	2021/5/25	金盐	已履行完毕
10	光洋化学	2,245.09 万元	2021/7/21	金盐	已履行完毕
11	田中贵金属	18,407.70 万日元	2021/7/9	含金电镀液 电镀亚硫酸金补充剂	已履行完毕
12	田中贵金属	25,691.76 万日元	2021/4/15	含金电镀液 电镀亚硫酸金补充剂	已履行完毕
13	田中贵金属	19,217.74 万日元	2020/12/9	含金电镀液 电镀亚硫酸金补充剂	已履行完毕

2、设备采购

报告期内，发行人及其子公司与设备供应商通过订单方式交易，并根据需求

下设备采购订单。截至本招股说明书签署日，发行人及其子公司与设备供应商签订的已履行完毕或正在履行的金额在 3,000 万元以上的设备采购订单的相关情况如下：

序号	供应商名称	订单金额	签订日期	采购主要内容	履行情况
1	ADVANTEST	191,650.00 万日元	2018/12/5	测试机	已履行完毕
2	ADVANTEST	170,680.00 万日元	2020/9/9	测试机	已履行完毕
3	ADVANTEST	170,680.00 万日元	2021/2/3	测试机	正在履行
4	ADVANTEST	116,166.35 万日元	2019/9/27	测试机	已履行完毕
5	K-SHINE TECHNOLOGY CORP.	750.00 万美元	2018/3/20	探针卡、测试机、 探针台等	已履行完毕
6	ADVANTEST	49,054.01 万日元	2019/9/27	测试机	已履行完毕
7	京隆科技（苏州）有限公司	3,600.00 万元	2018/3/8	测试机	已履行完毕

（二）销售合同

报告期内，发行人及其子公司与主要客户签署框架合同的方式建立业务合作关系，并通过订单方式交易，客户根据需求下单，发行人及其子公司根据客户订单组织生产。发行人及其子公司与报告期内前五大客户签署的已履行完毕和正在履行的重要框架合同如下：

序号	合同对方	合同有效期	合同服务内容	签订主体	履行情况
1	天钰科技股份有限公司	2018/6/25-2021/6/24	显示驱动芯片封装测试	汇成股份	已履行完毕
		2018/6/25-2021/6/24	显示驱动芯片封装测试	江苏汇成	已履行完毕
	合肥捷达微电子有限公司	2018/3/16-2021/3/15	显示驱动芯片封装测试	汇成股份	已履行完毕
		2021/3/16-2024/3/15	显示驱动芯片封装测试	汇成股份	正在履行
		2020/8/1-2023/7/31	显示驱动芯片封装测试	江苏汇成	正在履行
2	联咏科技股份有限公司	2018/2/22-2021/2/21	显示驱动芯片封装测试	汇成股份	已履行完毕
		2020/12/10-2023/12/9	显示驱动芯片封装测试	汇成股份	正在履行
3	奇景光电股份有限公司	2018/7/1-长期	显示驱动芯片封装测试	汇成股份	正在履行
		2013/11/10-长期	显示驱动芯片封装测试	江苏汇成	正在履行
4	瑞鼎科技股份有限公司	2020/1/1-2021/12/31	显示驱动芯片封装测试	汇成股份	正在履行
		2020/1/1-2021/12/31	显示驱动芯片封装测试	江苏汇成	正在履行
5	矽创电子股份有限公司	2019/1/1-长期	显示驱动芯片封装测试	汇成股份	正在履行
		2016/12/18-长期	显示驱动芯片封装测试	江苏汇成	正在履行
6	晶门科技有限公司	2020/5/1-2025/4/30	显示驱动芯片封装测试	汇成股份	正在履行

	晶门科技（中国）有限公司	2017/6/1-2022/5/31	显示驱动芯片封装测试	江苏汇成	正在履行
7	深圳市爱协生科技有限公司	2020/3/5-2023/3/4	显示驱动芯片封装测试	汇成股份	正在履行
		2020/3/5-2023/3/4	显示驱动芯片封装测试	汇成股份	正在履行
		2020/3/5-2023/3/4	显示驱动芯片封装测试	汇成股份	正在履行

（三）授信、借款和抵押合同

1、授信合同

截至本招股说明书签署日，公司取得的已履行完毕和正在履行的所有重大金融机构授信合同情况如下：

序号	授信合同	借款人	授信方	授信金额	合同约定授信期限
1	《年度借款框架协议》	汇成股份	合肥市产投小微企业融资服务有限公司	9,000.00 万元	自合同签订日起一年
2	《额度授信合同》 (195100 授 129)	汇成股份	兴业银行股份有限公司 合肥分行	4,000.00 万元	2019/4/16 至 2020/4/15
3	《授信协议》 (551XY2021007941)	汇成股份	招商银行股份有限公司 合肥分行	10,000.00 万元	2021/3/29 至 2022/3/28
4	《最高额融资合同》 (HF11(高融)20210002/ HF11(高融)20210002-补1)	汇成股份	华夏银行股份有限公司 合肥高新区支行	7,000.00 万元	2021/5/17 至 2022/5/17
5	《额度授信合同》 (215302 授 620)	汇成股份	兴业银行股份有限公司 合肥分行	5,000.00 万元	2021/10/19 至 2022/9/15
6	《综合授信合同》 (2015 扬综字第 00087 号)	江苏汇成	中信银行股份有限公司 扬州分行	7,200.00 万元	2015/3/17 至 2018/3/17
7	《综合授信合同》 (2018 扬综字第 00003 号)	江苏汇成	中信银行股份有限公司 扬州分行	3,000.00 万元	2018/1/10 至 2023/1/10
8	《授信额度协议》 (266552318E15012001)	江苏汇成	中国银行股份有限公司 扬州邗江支行	3,500.00 万元	2015/1/20 至 2018/1/19
9	《授信额度协议》 (266552318E180608)	江苏汇成	中国银行股份有限公司 扬州邗江支行	3,500.00 万元	2018/6/22 至 2023/6/21
10	《最高额综合授信合同》 (SX093519000767)	江苏汇成	江苏银行股份有限公司 扬州分行	4,000.00 万元	2019/5/7 至 2022/4/28
11	《授信协议》 (2021 年授字第 210800396 号)	江苏汇成	招商银行股份有限公司 扬州分行	3,000.00 万元	2021/9/26 至 2022/9/25
12	《最高额综合授信合同》 (SX091121003851)	江苏汇成	江苏银行股份有限公司 扬州分行	5,000.00 万元	2021/9/8 至 2024/7/2

2、借款合同

截至本招股说明书签署日，公司已履行完毕和正在履行的对发行人有重大影响的、单笔金额超过人民币 2,000.00 万元的主要借款合同如下：

序号	合同名称及编号	借款方	贷款方	实际履行期限	合同约定金额	担保及抵押情况	是否履行完毕
1	《委托贷款借款合同》 (HF2410720170100)	汇成股份	委托人：合肥市国正资产经营有限公司。受托人：华夏银行股份有限公司合肥高新区支行	2017/9/18 至 2018/9/18	2,000.00 万元	瑞成建筑、扬州新瑞连、郑瑞俊、杨会提供担保	已履行完毕
2	《委托贷款合同》（2018 年委借字第 0027 号）	汇成股份	委托人：合肥市国正资产经营有限公司。受托人：合肥科技农村商业银行股份有限公司红旗市场支行	2018/12/13 至 2019/3/13	4,000.00 万元	江苏汇成、瑞成建筑、扬州新瑞连、郑瑞俊、杨会提供担保	已履行完毕
3	《委托贷款借款合同》 (HF2410720180120)	汇成股份	委托人：合肥市国正资产经营有限公司。受托人：华夏银行股份有限公司合肥高新区支行	2018/12/12 至 2019/12/12	2,000.00 万元	江苏汇成、瑞成建筑、扬州新瑞连、郑瑞俊、杨会提供担保	已履行完毕
4	《借款合同》（2018 年借字第 1847 号）	汇成股份	合肥产投小微企业融资服务有限公司	2018/11/16 至 2019/5/5	2,000.00 万元	江苏汇成、瑞成建筑、扬州新瑞连、郑瑞俊、杨会提供担保	已履行完毕
5	《委托贷款借款合同》 (195100 委借 002)	汇成股份	委托人：合肥市创新科技风险投资有限公司。受托人：兴业银行股份有限公司合肥分行	2019/4/22 至 2019/9/3	4,000.00 万元	瑞成建筑、扬州新瑞连、郑瑞俊、杨会提供担保	已履行完毕
6	《委托贷款合同》（2019 年委借字第 0006 号）	汇成股份	委托人：合肥市国正资产经营有限公司。受托人：合肥科技农村商业银行股份有限公司红旗市场支行	2019/4/26 至 2020/4/26	3,000.00 万元	江苏汇成、瑞成建筑、扬州新瑞连、郑瑞俊、杨会提供担保	已履行完毕
7	《委托贷款协议》 (XAKC2019011)	汇成股份	委托人：合肥市国正资产经营有限公司。受托人：安徽新安银行股份有限公司	2019/5/30 至 2020/5/28	2,000.00 万元	江苏汇成、瑞成建筑、扬州新瑞连、郑瑞俊、杨会提供	已履行完毕

						担保	
8	《委托贷款借款合同》 (HF2410720200020)	汇成股份	委托人:合肥市国正资产经营有限公司。受托人:华夏银行股份有限公司合肥高新区支行	2020/4/30 至 2021/4/30	3,000.00 万元	江苏汇成、瑞成建筑、扬州新瑞连、郑瑞俊、杨会提供担保	已履行完毕
9	《委托贷款借款合同》 (HF2410720200026)	汇成股份	委托人:合肥市国正资产经营有限公司。受托人:华夏银行股份有限公司合肥高新区支行	2020/6/10 至 2021/6/1	4,000.00 万元	江苏汇成、瑞成建筑、扬州新瑞连、郑瑞俊、杨会提供担保	已履行完毕
10	《固定资产贷款合同》(城东(2017)1271002)	汇成股份	中国建设银行股份有限公司	2017/9/22 至 2023/9/21	6,800.00 万元	郑瑞俊、杨会、合肥鑫城国有资产经营有限公司提供担保	正在履行
11	《固定资产贷款合同》(城东(2018)1271003)	汇成股份	中国建设银行股份有限公司	2018/9/29 至 2023/9/18	8,200.00 万元	郑瑞俊、杨会、合肥鑫城国有资产经营有限公司提供担保	正在履行
12	《委托贷款合同》(城东(2017)1950001)	汇成股份	委托人:合肥鑫城国有资产经营有限公司。代理人:中国建设银行股份有限公司	2017/1/16 至 2020/1/15	5,000.00 万元	郑瑞俊提供担保,发行人固定资产抵押	已履行完毕
	《委托贷款展期合同》(城东委贷展(2020)001)	汇成股份	委托人:合肥鑫城国有资产经营有限公司。代理人:中国建设银行股份有限公司	2020/1/16 至 2020/7/15	5,000.00 万元	郑瑞俊提供担保,发行人固定资产抵押	已履行完毕
	《委托贷款展期合同》(城东委贷展(2020)002)	汇成股份	委托人:合肥鑫城国有资产经营有限公司。代理人:中国建设银行股份有限公司	2020/7/16 至 2020/11/30	5,000.00 万元	郑瑞俊提供担保,发行人固定资产抵押	已履行完毕
13	《委托贷款合同》(城东(2016)1950003)	汇成股份	委托人:合肥鑫城国有资产经营有限公司。代理人:中国建设银行股份有限公司	2016/9/30 至 2019/9/30	5,000.00 万元	发行人固定资产抵押	已履行完毕
	《委托贷款展期合同》(城	汇成股份	委托人:合肥鑫城国有	2019/10/1	4,000.00 万	发行人固定	已履行完毕

	东委贷展期（新汇成2019）001号）		资产经营有限公司。代理人：中国建设银行股份有限公司	至 2020/5/29	元	资产抵押	
14	《固定资产借款合同》（东银（9350）2019年固贷字第008558号）	汇成股份	东莞银行股份有限公司合肥分行	2019/7/3 至 2021/5/17	6,200.00万元	郑瑞俊、江苏汇成提供担保，安徽盛兴置业有限公司、杨格格提供固定资产抵押	已履行完毕
15	《借款合同》（2019年借字第1892号）	汇成股份	合肥产投小微企业融资服务有限公司	2019/12/12 至 2020/4/30	2,000.00万元	江苏汇成、瑞成建筑、扬州新瑞连、郑瑞俊、杨会提供担保	已履行完毕
16	《借款合同》（2020年借字第0643号）	汇成股份	合肥产投小微企业融资服务有限公司	2020/4/26 至 2020/5/19	3,000.00万元	江苏汇成、瑞成建筑、扬州新瑞连、郑瑞俊、杨会提供担保	已履行完毕
17	《借款合同》（2020年借字第1028号）	汇成股份	合肥产投小微企业融资服务有限公司	2020/5/28 至 2020/6/11	4,000.00万元	江苏汇成、瑞成建筑、扬州新瑞连、郑瑞俊、杨会提供担保	已履行完毕
18	《借款合同》（2020年借字第1267号）	汇成股份	合肥产投小微企业融资服务有限公司	2020/6/17 至 2020/12/29	2,000.00万元	江苏汇成、瑞成建筑、扬州新瑞连、郑瑞俊、杨会提供担保	已履行完毕
19	《固定资产借款合同》（HTZ340440000GDZC202000011）	汇成股份	中国建设银行股份有限公司	2020/5/28 至 2023/9/21	7,000.00万元	合肥市中小企业融资担保有限公司提供担保	正在履行
20	《委托贷款借款合同》（HF2410720210032）	汇成股份	委托人：合肥市国正资产经营有限公司。受托人：华夏银行股份有限公司合肥高新区支行	2021/6/21 至 2022/6/21	4,000.00万元	江苏汇成、瑞成建筑、扬州新瑞连、郑瑞俊、杨会提供担保	正在履行

21	《委托贷款借款合同》 (HF2410720210011)	汇成股份	委托人:合肥市国正资产经营有限公司。受托人:华夏银行股份有限公司合肥分行	2021/5/10 至 2022/5/10	3,000.00 万元	江苏汇成、瑞成建筑、扬州新瑞连、郑瑞俊、杨会提供担保	正在履行
22	《流动资金借款合同》 (HF2410120210026)	汇成股份	华夏银行股份有限公司合肥高新区支行	2021/5/28 至 2022/5/28	600.00 万美元	江苏汇成、郑瑞俊、杨会提供担保	正在履行
23	《固定资产借款合同》 (JK093519000029)	江苏汇成	江苏银行股份有限公司扬州分行	2019/6/18 至 2021/6/4	3,000.00 万元	郑瑞俊、汇成股份提供担保,江苏汇成提供固定资产抵押	已履行完毕

3、抵押合同

截至本招股说明书签署日,发行人及其控股子公司正在履行的与借款相关的抵押合同如下:

序号	合同名称	担保人	担保权人	担保金额 (万元)	担保方式	履行情况
1	最高额抵押合同	汇成股份	招商银行股份有限公司合肥分行	10,000.00	抵押担保	正在履行
2	最高额抵押合同	汇成股份	中国农业银行股份有限公司合肥新站高新区支行	6,000.00	抵押担保	正在履行
3	最高额抵押合同	江苏汇成	中国银行股份有限公司扬州邗江支行	3,500.00	抵押担保	正在履行
4	最高额抵押合同	江苏汇成	江苏银行股份有限公司扬州分行	5,000.00	抵押担保	正在履行

2021年5月6日,汇成股份与中国农业银行股份有限公司合肥新站高新区支行签订最高额抵押合同,汇成股份将其拥有的5项不动产权(具体信息参见本招股说明书“第六节 业务与技术”之“五、发行人主要固定资产、无形资产等资源要素”之“(一)主要固定资产情况”之“3、房屋建筑物”之“(1)房屋所有权”)抵押给中国农业银行股份有限公司合肥新站高新区支行,以用于人民币/外币借款业务。抵押担保的最高额为6,000万元,抵押担保期间为2021年5月6日至2022年5月5日。

2018年6月22日,江苏汇成与中国银行股份有限公司扬州邗江支行签订最

高额抵押合同，江苏汇成将其拥有的房屋所有权（证书编号：扬房权证邗江字第 2012015390 号）和土地使用权（证书编号：扬邗国用（2012）第 2012004 号）抵押给中国银行股份有限公司扬州邗江支行，抵押担保的最高额为 3,500 万元，以担保双方签订的授信额度协议（协议编号：266552318E180608），该授信额度协议期间为 2018 年 6 月 22 日至 2023 年 6 月 21 日，主要用于短期借款业务。

二、对外担保事项

报告期内，公司作为担保方的重大对外担保事项参见本招股说明书“第十三节 附表二：关联担保”之“（二）公司作为担保方的关联担保”。

三、诉讼或仲裁事项

（一）发行人涉及的重大诉讼或仲裁事项

截至本招股说明书签署日，发行人不存在尚未了结的或可预见的对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生重大影响的诉讼或仲裁事项。

（二）发行人控股股东或实际控制人、控股子公司、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员的重大诉讼或仲裁事项

截至本招股说明书签署日，发行人控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员不存在作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项。

四、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员涉及行政处罚、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查的情况

截至本招股说明书签署日，发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员最近三年不存在涉及行政处罚、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查的情况。

五、公司控股股东、实际控制人重大违法的情况

截至本招股说明书签署日，发行人控股股东、实际控制人最近三年不存在重大违法行为。

第十二节 声明

一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：



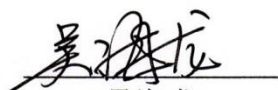
郑瑞俊



沈建伟



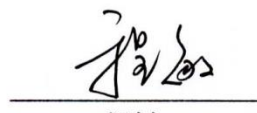
赵亚彬




吴海龙



杨辉



程敏



蔺智挺

合肥新汇成微电子股份有限公司

2021年10月30日

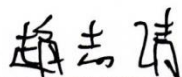
一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体监事签名：



杨欢



赵志清



程红艳

合肥新汇成微电子股份有限公司

2024年10月30日



一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体高级管理人员签名：


郑瑞俊


林文浩


钟玉玄


马行天


施周峰

合肥新汇成微电子股份有限公司

2021年10月30日



二、发行人控股股东、实际控制人声明

本公司/本人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。



控股股东：_____ 扬州新瑞连投资合伙企业（有限合伙）

控股股东执行事务合伙人签字：_____ 杨会

实际控制人签名：_____ 郑瑞俊

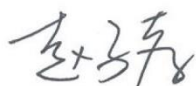
_____ 杨会

2021年10月30日

三、保荐机构（主承销商）声明（一）

本公司已对招股说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

项目协办人签名：



赵子馨

保荐代表人签名：



何立



吴俊

保荐机构总经理签名：



李军

保荐机构董事长、法定代表人签名：



周杰



海通证券股份有限公司

2021年10月30日

三、保荐机构（主承销商）声明（二）

本人已认真阅读合肥新汇成微电子股份有限公司招股说明书的全部内容，确认招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对招股说明书真实性、准确性、完整性、及时性承担相应法律责任。

保荐机构总经理签名：



李军

保荐机构董事长签名：



周杰




2021年10月30日

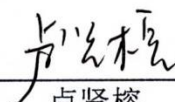
四、发行人律师声明

本所及经办律师已阅读招股说明书，确认招股说明书与本所出具的法律意见书无矛盾之处。本所及经办律师对发行人在招股说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

律师事务所负责人：


卢贤榕

经办律师：


卢贤榕


陈磊


孙静



安徽天禾律师事务所

2021年10月30日



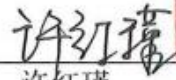



地址：杭州市钱江路1366号
邮编：310020
电话：(0571) 8821 6888
传真：(0571) 8821 6999

审计机构声明

本所及签字注册会计师已阅读《合肥新汇成微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》（以下简称招股说明书），确认招股说明书与本所出具的《审计报告》（天健审（2021）10318号）、《内部控制的鉴证报告》（天健审（2021）10319号）及经本所鉴证的非经常性损益明细表的内容无矛盾之处。本所及签字注册会计师对合肥新汇成微电子股份有限公司在招股说明书中引用的上述审计报告、内部控制的鉴证报告及经本所鉴证的非经常性损益明细表的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对引用的上述内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册会计师：





 向晓三 许红瑾

天健会计师事务所负责人：



 王国海

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二一年十月十日

资产评估机构声明

本公司及签字资产评估师已阅读《合肥新汇成微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》（以下简称招股说明书），确认招股说明书与本公司出具的《资产评估报告》（坤元评报（2021）624号）的内容无矛盾之处。本公司及签字资产评估师对合肥新汇成微电子股份有限公司在招股说明书中引用的上述评估报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对引用的上述内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签名资产评估师：


潘文夫 33000005

张武 33090002

法定代表人：


俞华开





地址：杭州市钱江路1366号
邮编：310020
电话：(0571) 8821 6888
传真：(0571) 8821 6999

验资机构声明

本所及签字注册会计师已阅读《合肥新汇成微电子股份有限公司首次公开发行股票并科创板上市招股说明书》（以下简称招股说明书），确认招股说明书与本所出具的《验资报告》（天健验（2021）465号、天健验（2021）469号）的内容无矛盾之处。本所及签字注册会计师对合肥新汇成微电子股份有限公司在招股说明书中引用的上述报告的内容无异议，确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对引用的上述内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册会计师：

   
向晓三 许红瑾

天健会计师事务所负责人：

 
王国海

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二一年十月三十日



第十三节 附件

一、备查文件

- （一）发行保荐书；
- （二）上市保荐书；
- （三）法律意见书；
- （四）财务报告及审计报告；
- （五）公司章程（草案）；
- （六）发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的承诺事项；
- （七）内部控制鉴证报告；
- （八）经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表；
- （九）中国证监会同意发行人本次公开发行注册的文件；
- （十）其他与本次发行有关的重要文件。

二、查阅时间和地点

- （一）发行人：合肥新汇成微电子股份有限公司

联系地址：合肥市新站高新区合肥综合保税区项王路 8 号

查阅时间：工作日上午 9:00-12:00，下午 1:30-5:00

联系人：施周峰

联系电话：0551-63821697

- （二）保荐机构：海通证券股份有限公司

联系地址：上海市广东路 689 号

查阅时间：工作日上午 9:00-12:00，下午 1:30-5:00

联系人：何立

联系电话：021-23219000

除以上查阅地点外，投资者可以登录证监会和证券交易所指定网站，查阅《招股说明书》正文及相关附录。

附表一：专利

截至本招股说明书签署日，发行人已拥有 259 项授权专利，其中发明专利 15 项，实用新型 244 项，具体情况如下：

序号	专利名称	专利权人	专利类型	专利号	申请日	专利权保护期限	取得方式	他项权利
1	一种晶圆研磨前裂片异常的处理方法	汇成股份	发明专利	ZL202010434613.1	2020.05.21	20 年	原始取得	无
2	一种全自动贴胶机用工作盘装置	汇成股份	发明专利	ZL202010370518.X	2020.05.06	20 年	原始取得	无
3	一种基于内引脚接合机用拆装方便的黏轮安装装置	汇成股份	发明专利	ZL202010273698.X	2020.04.09	20 年	原始取得	无
4	一种应对真空异常的晶圆切割处理方法	汇成股份	发明专利	ZL201911051044.6	2019.10.31	20 年	原始取得	无
5	一种 FOUP 开启器	汇成股份	发明专利	ZL201910321851.9	2019.04.22	20 年	原始取得	无
6	一种 Prober 点墨器的新型调节打点稳定装置	江苏汇成	发明专利	ZL202011460367.3	2020.12.11	20 年	原始取得	无
7	一种 COF 封装用涂胶针头回收清洗平台	江苏汇成	发明专利	ZL202011335520.X	2020.11.25	20 年	原始取得	无
8	一种可降低 Tape Bonding 工艺过程中抖动的机构	江苏汇成	发明专利	ZL202011335523.3	2020.11.25	20 年	原始取得	无
9	一种晶圆的三面切割方法	江苏汇成	发明专利	ZL201910541212.3	2019.06.21	20 年	原始取得	无
10	一种自动化晶圆转移方法	江苏汇成	发明专利	ZL201811492066.1	2018.12.07	20 年	原始取得	无
11	一种集成电路芯片的金凸块制造工艺	江苏汇成	发明专利	ZL201810431710.8	2018.05.08	20 年	原始取得	无
12	洗除氧化钨的洗液及清洗附着有氧化钨生产工具的方法	江苏汇成	发明专利	ZL201810093214.6	2018.01.31	20 年	原始取得	无
13	一种用于微结构三维形变和位移测试的干涉测量系统	江苏汇成	发明专利	ZL201410064678.6	2014.02.25	20 年	受让取得	无
14	一种柔性电路板表面微尘清除器	江苏汇成	发明专利	ZL201310055567.4	2013.02.21	20 年	原始取得	无
15	晶圆测试探针卡	江苏汇成	发明专利	ZL201210527894.0	2012.12.11	20 年	原始取得	无

序号	专利名称	专利权人	专利类型	专利号	申请日	专利权保护期限	取得方式	他项权利
16	一种内引脚接合机之轴心保护盖装置	汇成股份	实用新型	ZL202020870666.3	2020.05.22	10年	原始取得	无
17	一种内引脚接合机之导轮机构	汇成股份	实用新型	ZL202020870268.1	2020.05.22	10年	原始取得	无
18	一种内引脚接合机传送带用盖板结构	汇成股份	实用新型	ZL202020870687.5	2020.05.22	10年	原始取得	无
19	一种内引脚接合机开关控制箱保护壳装置	汇成股份	实用新型	ZL202020716295.3	2020.05.06	10年	原始取得	无
20	一种晶粒拾取手臂水平校正装置	汇成股份	实用新型	ZL202020716084.X	2020.05.06	10年	原始取得	无
21	一种基于内引脚接合机的保护放料端承接板	汇成股份	实用新型	ZL202020508945.5	2020.04.09	10年	原始取得	无
22	一种基于内引脚接合机用卡锁装置	汇成股份	实用新型	ZL202020508956.3	2020.04.09	10年	原始取得	无
23	一种用于内引脚接合机的吸嘴安装座装置	汇成股份	实用新型	ZL202020338509.8	2020.03.17	10年	原始取得	无
24	一种用于内引脚接合机的单排顶针座装置	汇成股份	实用新型	ZL202020338536.5	2020.03.17	10年	原始取得	无
25	一种用于内引脚接合机的胡椒罐装置	汇成股份	实用新型	ZL202020338540.1	2020.03.17	10年	原始取得	无
26	一种新型顶针帽机构	汇成股份	实用新型	ZL202020332477.0	2020.03.17	10年	原始取得	无
27	一种用于内引脚接合机的双排顶针座装置	汇成股份	实用新型	ZL202020338528.0	2020.03.17	10年	原始取得	无
28	一种修正齿轮运转偏心的制具	汇成股份	实用新型	ZL201921021348.3	2019.07.03	10年	原始取得	无
29	一种晶圆共用背检平台	汇成股份	实用新型	ZL201921021380.1	2019.07.03	10年	原始取得	无
30	一种集成电路生产用排风节能设备	汇成股份	实用新型	ZL201920704792.9	2019.05.17	10年	原始取得	无
31	一种实验室研磨台排水装置	汇成股份	实用新型	ZL201920704779.3	2019.05.17	10年	原始取得	无
32	一种检测治具	汇成股份	实用新型	ZL201920517746.8	2019.04.17	10年	原始取得	无
33	一种提篮反向装置	汇成股份	实用新型	ZL201920517569.3	2019.04.17	10年	原始取得	无
34	一种光刻胶放置桶	汇成股份	实用新型	ZL201920517747.2	2019.04.17	10年	原始取得	无
35	一种 Coater 机台作业腔体真空环境形成装置	汇成股份	实用新型	ZL201920499407.1	2019.04.15	10年	原始取得	无

序号	专利名称	专利权人	专利类型	专利号	申请日	专利权保护期限	取得方式	他项权利
36	一种机器自动安全门装置	汇成股份	实用新型	ZL201920444259.3	2019.04.03	10年	原始取得	无
37	一种晶圆转换器的定位装置	汇成股份	实用新型	ZL201920444750.6	2019.04.03	10年	原始取得	无
38	一种真空吸笔测量仪	汇成股份	实用新型	ZL201920444253.6	2019.04.03	10年	原始取得	无
39	一种槽位定位标识设备	汇成股份	实用新型	ZL201920444266.3	2019.04.03	10年	原始取得	无
40	一种 Koyo 烤箱门锁防呆装置	汇成股份	实用新型	ZL201920378175.4	2019.03.25	10年	原始取得	无
41	一种具有产品保护的风刀导轮	汇成股份	实用新型	ZL201920378158.0	2019.03.25	10年	原始取得	无
42	一种对凸块粗糙度改善的电流密度电镀装置	汇成股份	实用新型	ZL201920363202.0	2019.03.21	10年	原始取得	无
43	一种电镀辅助盐的分析装置	汇成股份	实用新型	ZL201920363635.6	2019.03.21	10年	原始取得	无
44	一种蚀刻槽体中的新型晶舟承载装置	汇成股份	实用新型	ZL201920359607.7	2019.03.21	10年	原始取得	无
45	一种蚀刻夹爪作业装置	汇成股份	实用新型	ZL201920350531.1	2019.03.20	10年	原始取得	无
46	一种可消除气泡的电镀槽	汇成股份	实用新型	ZL201821921711.2	2018.11.21	10年	原始取得	无
47	一种具有防气泡效果的光刻胶缓冲罐	汇成股份	实用新型	ZL201821921679.8	2018.11.21	10年	原始取得	无
48	一种蚀刻制程中的新型铁氟龙治具	汇成股份	实用新型	ZL201821921713.1	2018.11.21	10年	原始取得	无
49	一种用于显微镜观察的操作装置	汇成股份	实用新型	ZL201821922403.1	2018.11.21	10年	原始取得	无
50	一种带真空传感器的显微镜	汇成股份	实用新型	ZL201821922365.X	2018.11.21	10年	原始取得	无
51	一种光刻制程中的新型光阻去边喷嘴结构	汇成股份	实用新型	ZL201821921716.5	2018.11.21	10年	原始取得	无
52	一种风淋防护推车	汇成股份	实用新型	ZL201821953475.2	2018.11.21	10年	原始取得	无
53	一种蚀刻设备管路排水优化系统	汇成股份	实用新型	ZL201821921712.7	2018.11.21	10年	原始取得	无
54	一种用于晶圆转换的工治具	汇成股份	实用新型	ZL201821718689.1	2018.10.22	10年	原始取得	无
55	一种专用于 12 寸金属提篮运送的推车	汇成股份	实用新型	ZL201821718690.4	2018.10.22	10年	原始取得	无

序号	专利名称	专利权人	专利类型	专利号	申请日	专利权保护期限	取得方式	他项权利
56	一种用于对胶膜进行切割的工具	汇成股份	实用新型	ZL201821718688.7	2018.10.22	10年	原始取得	无
57	一种防撞型标准提篮	汇成股份	实用新型	ZL201821718686.8	2018.10.22	10年	原始取得	无
58	一种晶粒挑拣机 Tray Cover 盘放置平台	汇成股份	实用新型	ZL201821708795.1	2018.10.22	10年	原始取得	无
59	一种半导体晶圆湿法蚀刻装置	汇成股份	实用新型	ZL201821708415.4	2018.10.22	10年	原始取得	无
60	一种用于显示器固定的支架	汇成股份	实用新型	ZL201821718675.X	2018.10.22	10年	原始取得	无
61	一种用于半导体晶圆包装的承载台	汇成股份	实用新型	ZL201721237986.X	2017.09.26	10年	原始取得	无
62	一种半导体晶圆封装结构	汇成股份	实用新型	ZL201721238104.1	2017.09.26	10年	原始取得	无
63	一种半导体晶圆的切割装置	汇成股份	实用新型	ZL201721238001.5	2017.09.26	10年	原始取得	无
64	一种半导体晶圆级封装结构	汇成股份	实用新型	ZL201721238003.4	2017.09.26	10年	原始取得	无
65	一种半导体晶圆快速冷却控制装置	汇成股份	实用新型	ZL201721238101.8	2017.09.26	10年	原始取得	无
66	一种专用于半导体晶圆运送的推车	汇成股份	实用新型	ZL201721238328.2	2017.09.26	10年	原始取得	无
67	一种半导体晶圆传输装置	汇成股份	实用新型	ZL201721238004.9	2017.09.26	10年	原始取得	无
68	一种半导体晶圆减薄装置	汇成股份	实用新型	ZL201721238327.8	2017.09.26	10年	原始取得	无
69	一种半导体晶圆清洗装置	汇成股份	实用新型	ZL201721238357.9	2017.09.26	10年	原始取得	无
70	一种半导体晶圆的检测装置	汇成股份	实用新型	ZL201721238078.2	2017.09.26	10年	原始取得	无
71	一种半导体晶圆电镀夹持装置	汇成股份	实用新型	ZL201721238359.8	2017.09.26	10年	原始取得	无
72	一种拆卸蓝膜辅助治具	江苏汇成	实用新型	ZL202120927212.X	2021.04.30	10年	原始取得	无
73	一种用于库房包装缠膜多功能包装台	江苏汇成	实用新型	ZL202120927884.0	2021.04.30	10年	原始取得	无
74	一种料盘快速量测治具	江苏汇成	实用新型	ZL202120883405.X	2021.04.27	10年	原始取得	无
75	一种软性电路板散热贴比对卡	江苏汇成	实用新型	ZL202120883605.5	2021.04.27	10年	原始取得	无

序号	专利名称	专利权人	专利类型	专利号	申请日	专利权保护期限	取得方式	他项权利
76	一种内引脚接合机放料端防料带粘黏装置	江苏汇成	实用新型	ZL202120747178.8	2021.04.13	10年	原始取得	无
77	一种用于点胶头拔针治具	江苏汇成	实用新型	ZL202120733271.3	2021.04.12	10年	原始取得	无
78	一种料盘垂直存放架	江苏汇成	实用新型	ZL202120733164.0	2021.04.12	10年	原始取得	无
79	一种可调配重式张力轮机构	江苏汇成	实用新型	ZL202120722842.3	2021.04.09	10年	原始取得	无
80	一种可调料带导向机构	江苏汇成	实用新型	ZL202120722848.0	2021.04.09	10年	原始取得	无
81	一种卷带手持裁切器	江苏汇成	实用新型	ZL202120667281.1	2021.04.01	10年	原始取得	无
82	一种防反向捡晶机 tray 盘定位机构	江苏汇成	实用新型	ZL202120654266.3	2021.03.31	10年	原始取得	无
83	一种高效率料盘清洁机	江苏汇成	实用新型	ZL202120654632.5	2021.03.31	10年	原始取得	无
84	一种内引脚接合机料盘扩张轮机构	江苏汇成	实用新型	ZL202120628338.7	2021.03.29	10年	原始取得	无
85	一种改良的内引脚接合机轨道	江苏汇成	实用新型	ZL202120628500.5	2021.03.29	10年	原始取得	无
86	一种软性电路板打孔比对卡	江苏汇成	实用新型	ZL202120478334.5	2021.03.05	10年	原始取得	无
87	一种用于 IC 拼盘的固定治具	江苏汇成	实用新型	ZL202120423619.9	2021.02.26	10年	原始取得	无
88	一种用于运输 COF 卷带的推车	江苏汇成	实用新型	ZL202120255879.X	2021.01.29	10年	原始取得	无
89	一种晶圆多功能包装台	江苏汇成	实用新型	ZL202120255113.1	2021.01.29	10年	原始取得	无
90	一种 COF 卷带存储货架	江苏汇成	实用新型	ZL202120255155.5	2021.01.29	10年	原始取得	无
91	一种快速检测料盘宽度治具	江苏汇成	实用新型	ZL202023308025.8	2020.12.31	10年	原始取得	无
92	一种 COF 卷带运输推车	江苏汇成	实用新型	ZL202023307972.5	2020.12.31	10年	原始取得	无
93	一种流程卡规范放置收纳装置	江苏汇成	实用新型	ZL202023291054.8	2020.12.31	10年	原始取得	无
94	一种半导体仓储多功能包装桌	江苏汇成	实用新型	ZL202023307900.0	2020.12.31	10年	原始取得	无
95	一种用于 IC 封装点胶针头清洗的治具	江苏汇成	实用新型	ZL202023291018.1	2020.12.31	10年	原始取得	无

序号	专利名称	专利权人	专利类型	专利号	申请日	专利权保护期限	取得方式	他项权利
96	一种卷带烘烤支撑载具	江苏汇成	实用新型	ZL202022864704.7	2020.12.03	10年	原始取得	无
97	一种涂胶针头清洗平台	江苏汇成	实用新型	ZL202022858732.8	2020.12.03	10年	原始取得	无
98	一种涂胶机涂胶区防落尘装置	江苏汇成	实用新型	ZL202022858749.3	2020.12.03	10年	原始取得	无
99	一种涂胶机台连接处防落尘装置	江苏汇成	实用新型	ZL202022698969.4	2020.11.20	10年	原始取得	无
100	一种涂胶机马达弹簧保护装置	江苏汇成	实用新型	ZL202022706221.4	2020.11.20	10年	原始取得	无
101	一种涂胶机目检区防护装置	江苏汇成	实用新型	ZL202022706258.7	2020.11.20	10年	原始取得	无
102	一种便捷式辅助工具箱	江苏汇成	实用新型	ZL202022655855.1	2020.11.17	10年	原始取得	无
103	一种防刮蹭的内引脚接合机料带导轨	江苏汇成	实用新型	ZL202022655801.5	2020.11.17	10年	原始取得	无
104	一种内引脚接合机急停按钮防误触保护罩	江苏汇成	实用新型	ZL202022658643.9	2020.11.17	10年	原始取得	无
105	一种辅助晶圆模组挑拣IC的光照装置	江苏汇成	实用新型	ZL202022620291.8	2020.11.13	10年	原始取得	无
106	一种束带机计数装置	江苏汇成	实用新型	ZL202022605513.9	2020.11.12	10年	原始取得	无
107	一种捡晶机顶针安装治具	江苏汇成	实用新型	ZL202022609234.X	2020.11.12	10年	原始取得	无
108	一种合框撕胶一体机传感器安全防护装置	江苏汇成	实用新型	ZL202022609235.4	2020.11.12	10年	原始取得	无
109	一种捡晶机离子风枪防撞架	江苏汇成	实用新型	ZL202022605511.X	2020.11.12	10年	原始取得	无
110	一种内引脚接合机台开关防误触装置	江苏汇成	实用新型	ZL202022543711.7	2020.11.06	10年	原始取得	无
111	一种料带出货方向比对检测机台	江苏汇成	实用新型	ZL202022515514.4	2020.11.04	10年	原始取得	无
112	一种内引脚接合机弹簧组件承接保护装置	江苏汇成	实用新型	ZL202022517144.8	2020.11.04	10年	原始取得	无
113	一种内引脚接合机料带标记料位识别机构	江苏汇成	实用新型	ZL202022515538.X	2020.11.04	10年	原始取得	无
114	一种内引脚接合机保护带导向机构	江苏汇成	实用新型	ZL202022517124.0	2020.11.04	10年	原始取得	无
115	一种轴向位置可调的放料端料盘	江苏汇成	实用新型	ZL202022279844.8	2020.10.14	10年	原始取得	无

序号	专利名称	专利权人	专利类型	专利号	申请日	专利权保护期限	取得方式	他项权利
116	一种防粘料的料带放料装置	江苏汇成	实用新型	ZL202022279897.X	2020.10.14	10年	原始取得	无
117	一种内引脚接合机台颗粒排除装置	江苏汇成	实用新型	ZL202022199948.8	2020.09.30	10年	原始取得	无
118	一种机台固定料盘专用治具	江苏汇成	实用新型	ZL202022169144.3	2020.09.28	10年	原始取得	无
119	一种旋转轴心金属颗粒收集防护装置	江苏汇成	实用新型	ZL202022167395.8	2020.09.28	10年	原始取得	无
120	一种晶圆移动抓取机构	江苏汇成	实用新型	ZL202021854447.2	2020.08.31	10年	原始取得	无
121	一种内引脚接合机收料端料盘定位组件	江苏汇成	实用新型	ZL202021854314.5	2020.08.31	10年	原始取得	无
122	一种卷带封装成品摆放运送推车	江苏汇成	实用新型	ZL202021854436.4	2020.08.31	10年	原始取得	无
123	一种顶针安装校正装置	江苏汇成	实用新型	ZL202021854557.9	2020.08.31	10年	原始取得	无
124	一种新型捡晶机摆臂结构	江苏汇成	实用新型	ZL202021822661.X	2020.08.27	10年	原始取得	无
125	一种研磨机主轴转速传感器保护装置	江苏汇成	实用新型	ZL202021822687.4	2020.08.27	10年	原始取得	无
126	一种捡晶机双面 tray 盘定位装置	江苏汇成	实用新型	ZL202021822624.9	2020.08.27	10年	原始取得	无
127	一种贴膜机换刀治具	江苏汇成	实用新型	ZL202021777679.2	2020.08.24	10年	原始取得	无
128	一种捡晶机光源安装固定支架	江苏汇成	实用新型	ZL202021777620.3	2020.08.24	10年	原始取得	无
129	一种换胶辅助支架治具	江苏汇成	实用新型	ZL202021777617.1	2020.08.24	10年	原始取得	无
130	一种机台维修晶圆防护专用治具	江苏汇成	实用新型	ZL202021759705.9	2020.08.21	10年	原始取得	无
131	一种封装卷带产品存储和搬运两用货架	江苏汇成	实用新型	ZL202021759709.7	2020.08.21	10年	原始取得	无
132	一种下料用料盘扩张治具	江苏汇成	实用新型	ZL202021760230.5	2020.08.21	10年	原始取得	无
133	一种料带检测机台防脱轨专用观察治具	江苏汇成	实用新型	ZL202021760252.1	2020.08.21	10年	原始取得	无
134	一种料带接合器专用转运装置	江苏汇成	实用新型	ZL202021709037.9	2020.08.17	10年	原始取得	无
135	一种针头清洗专用工作台	江苏汇成	实用新型	ZL202021557718.8	2020.07.31	10年	原始取得	无

序号	专利名称	专利权人	专利类型	专利号	申请日	专利权保护期限	取得方式	他项权利
136	一种多功能包装储物工作桌	江苏汇成	实用新型	ZL202021559994.8	2020.07.31	10年	原始取得	无
137	一种IC应力量测机安全防护和断晶收集装置	江苏汇成	实用新型	ZL202021543265.3	2020.07.30	10年	原始取得	无
138	一种防OTP产品接触紫外线的治具	江苏汇成	实用新型	ZL202021544906.7	2020.07.30	10年	原始取得	无
139	一种可移动式晶背切割IC滴水检验治具	江苏汇成	实用新型	ZL202021545530.1	2020.07.30	10年	原始取得	无
140	一种tray盘包装出货输送装置	江苏汇成	实用新型	ZL202021295545.7	2020.07.06	10年	原始取得	无
141	一种可循环使用的tray盘覆盖治具	江苏汇成	实用新型	ZL202021296692.6	2020.07.06	10年	原始取得	无
142	一种便携式卷带盘放置架	江苏汇成	实用新型	ZL202021222665.4	2020.06.29	10年	原始取得	无
143	一种防止产品摔落放置货架	江苏汇成	实用新型	ZL202021222767.6	2020.06.29	10年	原始取得	无
144	一种胶材快速回温装置	江苏汇成	实用新型	ZL202021223679.8	2020.06.29	10年	原始取得	无
145	一种卷带垂直放置双层运输装置	江苏汇成	实用新型	ZL202021222742.6	2020.06.29	10年	原始取得	无
146	一种卷绕机台料带防尘装置	江苏汇成	实用新型	ZL202020872237.X	2020.05.22	10年	原始取得	无
147	一种具有速度测报警功能的手动卷绕机	江苏汇成	实用新型	ZL202020872376.2	2020.05.22	10年	原始取得	无
148	一种防掉料的保护带回收装置	江苏汇成	实用新型	ZL202020873431.X	2020.05.22	10年	原始取得	无
149	一种切割刀片背面刮痕处理装置	江苏汇成	实用新型	ZL202020859610.8	2020.05.21	10年	原始取得	无
150	一种库房用手动缠膜机	江苏汇成	实用新型	ZL202020554764.6	2020.04.15	10年	原始取得	无
151	一种高稳定性多功能COF卷带运输推车	江苏汇成	实用新型	ZL202020554474.1	2020.04.15	10年	原始取得	无
152	一种仓库用重型载物手推车	江苏汇成	实用新型	ZL202020554484.5	2020.04.15	10年	原始取得	无
153	一种组合式打印机标签货架	江苏汇成	实用新型	ZL202020531218.0	2020.04.13	10年	原始取得	无
154	一种用于库房晶圆包装的功能性操作桌	江苏汇成	实用新型	ZL202020531816.8	2020.04.13	10年	原始取得	无
155	一种出货封口机电子秤平台	江苏汇成	实用新型	ZL202020531228.4	2020.04.13	10年	原始取得	无

序号	专利名称	专利权人	专利类型	专利号	申请日	专利权保护期限	取得方式	他项权利
156	一种入库封口机打印机专用平台	江苏汇成	实用新型	ZL202020531743.2	2020.04.13	10年	原始取得	无
157	一种自动化晶圆上下料装置	江苏汇成	实用新型	ZL202020394874.0	2020.03.25	10年	原始取得	无
158	提高驱动芯片可靠度的电浆源表面处理装置	江苏汇成	实用新型	ZL202020394875.5	2020.03.25	10年	原始取得	无
159	一种减小凸块底切的结构	江苏汇成	实用新型	ZL202020224706.7	2020.02.28	10年	原始取得	无
160	一种缩小凸块底切的结构	江苏汇成	实用新型	ZL202020224822.9	2020.02.28	10年	原始取得	无
161	一种卷带收料编辑改善治具	江苏汇成	实用新型	ZL202020205251.4	2020.02.25	10年	原始取得	无
162	一种柔性软带电路板放料装置	江苏汇成	实用新型	ZL202020205272.6	2020.02.25	10年	原始取得	无
163	一种卷带封装注胶治具	江苏汇成	实用新型	ZL202020191460.8	2020.02.21	10年	原始取得	无
164	一种IC封装称胶重辅助装置	江苏汇成	实用新型	ZL202020191434.5	2020.02.21	10年	原始取得	无
165	一种IC封装点胶组件高度辅助调节装置	江苏汇成	实用新型	ZL202020191433.0	2020.02.21	10年	原始取得	无
166	一种晶圆撕胶废膜回收装置	江苏汇成	实用新型	ZL202020136736.2	2020.01.21	10年	原始取得	无
167	一种切割机换刀用弹性三角夹具	江苏汇成	实用新型	ZL202020137028.0	2020.01.21	10年	原始取得	无
168	一种捡晶机侧挡板托盘	江苏汇成	实用新型	ZL202020102066.2	2020.01.17	10年	原始取得	无
169	一种自动束带机卡套	江苏汇成	实用新型	ZL202020103292.2	2020.01.17	10年	原始取得	无
170	一种晶圆铁环放置推车	江苏汇成	实用新型	ZL201921805345.9	2019.10.25	10年	原始取得	无
171	一种用于驱动IC仓储货架ESD防护的设备	江苏汇成	实用新型	ZL201921805006.0	2019.10.25	10年	原始取得	无
172	一种料带传输完成自动报警装置	江苏汇成	实用新型	ZL201921785377.7	2019.10.23	10年	原始取得	无
173	一种料带清洁箱	江苏汇成	实用新型	ZL201921785304.8	2019.10.23	10年	原始取得	无
174	一种自动清洁保护带的装置	江苏汇成	实用新型	ZL201921785283.X	2019.10.23	10年	原始取得	无
175	一种用于调整红外检测装置的反光镜	江苏汇成	实用新型	ZL201921639049.6	2019.09.29	10年	原始取得	无

序号	专利名称	专利权人	专利类型	专利号	申请日	专利权保护期限	取得方式	他项权利
176	一种可调整的不良 IC 产品检测装置	江苏汇成	实用新型	ZL201921639010.4	2019.09.29	10 年	原始取得	无
177	一种内引脚接合机轨道机构	江苏汇成	实用新型	ZL201921614298.X	2019.09.26	10 年	原始取得	无
178	一种防掉料目检机	江苏汇成	实用新型	ZL201921614708.0	2019.09.26	10 年	原始取得	无
179	一种内引脚接合机放料机构	江苏汇成	实用新型	ZL201921285137.0	2019.08.09	10 年	原始取得	无
180	一种包装机用压板	江苏汇成	实用新型	ZL201921222729.8	2019.07.31	10 年	原始取得	无
181	一种无尘室专用钻孔加工辅助治具	江苏汇成	实用新型	ZL201921109400.0	2019.07.16	10 年	原始取得	无
182	一种带吹屑装置的捡晶机	江苏汇成	实用新型	ZL201920914298.5	2019.06.18	10 年	原始取得	无
183	一种束带机抽风装置	江苏汇成	实用新型	ZL201920914280.5	2019.06.18	10 年	原始取得	无
184	一种用于清洁治具的工作桌	江苏汇成	实用新型	ZL201920914554.0	2019.06.18	10 年	原始取得	无
185	一种捡晶机载盘载台定位机构	江苏汇成	实用新型	ZL201920914278.8	2019.06.18	10 年	原始取得	无
186	一种 tray 盘入料堆栈区定位装置	江苏汇成	实用新型	ZL201920914535.8	2019.06.18	10 年	原始取得	无
187	一种驱动 IC 异常品自动分类收集盒	江苏汇成	实用新型	ZL201920492296.1	2019.04.12	10 年	原始取得	无
188	一种集成电路芯片光阻去除装置	江苏汇成	实用新型	ZL201920494127.1	2019.04.12	10 年	原始取得	无
189	一种保护带自动清洁卷绕机	江苏汇成	实用新型	ZL201920492263.7	2019.04.12	10 年	原始取得	无
190	一种 COF 卷带运输推车	江苏汇成	实用新型	ZL201920396801.2	2019.03.27	10 年	原始取得	无
191	一种产品包装封口作业操作桌	江苏汇成	实用新型	ZL201920396942.4	2019.03.27	10 年	原始取得	无
192	一种用于库房晶圆包装的多功能操作桌	江苏汇成	实用新型	ZL201920396987.1	2019.03.27	10 年	原始取得	无
193	一种 COF 卷带立式存储货架	江苏汇成	实用新型	ZL201920396988.6	2019.03.27	10 年	原始取得	无
194	一种用于驱动 IC 晶粒包装多功能性工作桌	江苏汇成	实用新型	ZL201920396755.6	2019.03.27	10 年	原始取得	无
195	一种用于 COF 卷带入库传输窗口内的传输工具	江苏汇成	实用新型	ZL201920396684.X	2019.03.27	10 年	原始取得	无

序号	专利名称	专利权人	专利类型	专利号	申请日	专利权保护期限	取得方式	他项权利
196	一种 COF 卷盘活动放置架	江苏汇成	实用新型	ZL201920396751.8	2019.03.27	10 年	原始取得	无
197	一种晶圆包装作业操作装置	江苏汇成	实用新型	ZL201920397436.7	2019.03.27	10 年	原始取得	无
198	一种保护带磁铁装置	江苏汇成	实用新型	ZL201920253486.8	2019.02.28	10 年	原始取得	无
199	一种带漏涂侦测功能的涂胶装置	江苏汇成	实用新型	ZL201920240031.2	2019.02.26	10 年	原始取得	无
200	一种带防护装置的晶圆载台	江苏汇成	实用新型	ZL201920239753.6	2019.02.26	10 年	原始取得	无
201	一种捡晶机顶针安装治具	江苏汇成	实用新型	ZL201920223065.0	2019.02.22	10 年	原始取得	无
202	一种硅片封装结构	江苏汇成	实用新型	ZL201920223070.1	2019.02.22	10 年	原始取得	无
203	一种螺旋式光阻涂布结构及其制备装置	江苏汇成	实用新型	ZL201920214825.1	2019.02.20	10 年	原始取得	无
204	一种增加输入和输出凸点数量的集成电路芯片	江苏汇成	实用新型	ZL201920161638.1	2019.01.30	10 年	原始取得	无
205	一种可调整式 IC 应力测试装置	江苏汇成	实用新型	ZL201920120628.3	2019.01.24	10 年	原始取得	无
206	一种晶圆研磨胶膜撕胶用加热型压板	江苏汇成	实用新型	ZL201920121314.5	2019.01.24	10 年	原始取得	无
207	一种晶圆贴底膜装置	江苏汇成	实用新型	ZL201920038411.8	2019.01.10	10 年	原始取得	无
208	一种晶圆用合框装置	江苏汇成	实用新型	ZL201920038462.0	2019.01.10	10 年	原始取得	无
209	一种晶圆研磨抛光设备	江苏汇成	实用新型	ZL201920038412.2	2019.01.10	10 年	原始取得	无
210	一种晶圆合框防二次撕胶装置	江苏汇成	实用新型	ZL201920038245.1	2019.01.10	10 年	原始取得	无
211	一种外定位框环贴底膜装置	江苏汇成	实用新型	ZL201920038244.7	2019.01.10	10 年	原始取得	无
212	一种晶圆合框撕胶装置	江苏汇成	实用新型	ZL201920038280.3	2019.01.10	10 年	原始取得	无
213	一种 tray 盘翻盘治具	江苏汇成	实用新型	ZL201822111836.5	2018.12.17	10 年	原始取得	无
214	一种晶圆胶膜抽水装置	江苏汇成	实用新型	ZL201822111814.9	2018.12.17	10 年	原始取得	无
215	一种自动化晶圆转移装置	江苏汇成	实用新型	ZL201822047584.4	2018.12.07	10 年	原始取得	无

序号	专利名称	专利权人	专利类型	专利号	申请日	专利权保护期限	取得方式	他项权利
216	一种晶舟转盘	江苏汇成	实用新型	ZL201822048068.3	2018.12.07	10年	原始取得	无
217	一种晶圆送料定位装置	江苏汇成	实用新型	ZL201822048086.1	2018.12.07	10年	原始取得	无
218	一种晶圆专用读刻号装置	江苏汇成	实用新型	ZL201822048157.8	2018.12.07	10年	原始取得	无
219	一种高位加药装置	江苏汇成	实用新型	ZL201822021104.7	2018.12.04	10年	原始取得	无
220	一种集成电路封测凸块供气管路	江苏汇成	实用新型	ZL201821996488.8	2018.11.30	10年	原始取得	无
221	一种捡晶机模组定位机构	江苏汇成	实用新型	ZL201821879865.X	2018.11.15	10年	原始取得	无
222	一种捡晶机 tray 盘定位模组	江苏汇成	实用新型	ZL201821879681.3	2018.11.15	10年	原始取得	无
223	一种干式晶圆自动清洁机	江苏汇成	实用新型	ZL201821688068.3	2018.10.18	10年	原始取得	无
224	一种捡晶机顶针夹	江苏汇成	实用新型	ZL201821613263.X	2018.09.30	10年	原始取得	无
225	一种检测料带传送脱轨的装置	江苏汇成	实用新型	ZL201821447092.8	2018.09.05	10年	原始取得	无
226	一种吸芯顶针机构	江苏汇成	实用新型	ZL201821447142.2	2018.09.05	10年	原始取得	无
227	一种捡晶机滑块安装治具	江苏汇成	实用新型	ZL201821261885.0	2018.08.07	10年	原始取得	无
228	一种切割机换刀防护工具	江苏汇成	实用新型	ZL201821235709.X	2018.08.02	10年	原始取得	无
229	一种晶圆框架平整度检测治具	江苏汇成	实用新型	ZL201821179642.2	2018.07.25	10年	原始取得	无
230	一种预防自动打拔器卡死结构	江苏汇成	实用新型	ZL201820769771.0	2018.05.23	10年	原始取得	无
231	一种结构经过改进的漏真空检测盒	江苏汇成	实用新型	ZL201820725616.9	2018.05.16	10年	原始取得	无
232	一种提篮用防晶圆掉落装置	江苏汇成	实用新型	ZL201820279703.6	2018.02.28	10年	原始取得	无
233	一种用于切割机进料手臂的吸料装置	江苏汇成	实用新型	ZL201820279791.X	2018.02.28	10年	原始取得	无
234	一种厚度量测仪量测治具	江苏汇成	实用新型	ZL201820143581.8	2018.01.29	10年	原始取得	无
235	一种抛光磨轮保养防护装置	江苏汇成	实用新型	ZL201820143588.X	2018.01.29	10年	原始取得	无

序号	专利名称	专利权人	专利类型	专利号	申请日	专利权保护期限	取得方式	他项权利
236	一种晶圆观察检测装置	江苏汇成	实用新型	ZL201820074444.3	2018.01.17	10年	原始取得	无
237	一种切割机防反向拿取装置	江苏汇成	实用新型	ZL201820074059.9	2018.01.17	10年	原始取得	无
238	一种防撞提篮	江苏汇成	实用新型	ZL201820074107.4	2018.01.17	10年	原始取得	无
239	一种芯片卷带料盘修复模具	江苏汇成	实用新型	ZL201720232240.3	2017.03.10	10年	原始取得	无
240	一种防刮伤晶圆转移装置	江苏汇成	实用新型	ZL201720080657.2	2017.01.22	10年	原始取得	无
241	一种 UV 机灯管照度检测装置	江苏汇成	实用新型	ZL201720080940.5	2017.01.22	10年	原始取得	无
242	一种打磨油石安装座	江苏汇成	实用新型	ZL201720080419.1	2017.01.22	10年	原始取得	无
243	一种用于半导体晶圆的便携提篮	江苏汇成	实用新型	ZL201720080677.X	2017.01.22	10年	原始取得	无
244	一种提篮反向装置	江苏汇成	实用新型	ZL201620611335.1	2016.06.21	10年	原始取得	无
245	一种用于固定 tray 盘的盒子	江苏汇成	实用新型	ZL201620357207.9	2016.04.26	10年	原始取得	无
246	一种微间距驱动芯片金凸块结构	江苏汇成	实用新型	ZL201620159958.X	2016.03.03	10年	原始取得	无
247	一种多段式保护层液晶面板驱动芯片封装凸块结构	江苏汇成	实用新型	ZL201620029828.4	2016.01.13	10年	原始取得	无
248	两段式液晶面板驱动芯片封装凸块结构	江苏汇成	实用新型	ZL201420706092.0	2014.11.21	10年	原始取得	无
249	多段式液晶面板驱动芯片封装凸块结构	江苏汇成	实用新型	ZL201420706075.7	2014.11.21	10年	原始取得	无
250	一种芯片涂胶机的涂胶平台	江苏汇成	实用新型	ZL201420668554.4	2014.11.11	10年	原始取得	无
251	晶圆测试机晶舟盒承载平台	江苏汇成	实用新型	ZL201420669400.7	2014.11.11	10年	原始取得	无
252	IC 晶粒防刮伤吸取装置	江苏汇成	实用新型	ZL201420668953.0	2014.11.11	10年	原始取得	无
253	IC 芯片检查辅助载具	江苏汇成	实用新型	ZL201420668892.8	2014.11.11	10年	原始取得	无
254	COF 覆晶结合前柔性电路板及芯片表面微尘清除器	江苏汇成	实用新型	ZL201420008630.9	2014.01.07	10年	原始取得	无

序号	专利名称	专利权人	专利类型	专利号	申请日	专利权保护期限	取得方式	他项权利
255	覆晶芯片与柔性电路板间的封胶前除尘装置	江苏汇成	实用新型	ZL201420008413.X	2014.01.07	10年	原始取得	无
256	一种柔性电路板表面微尘清除器	江苏汇成	实用新型	ZL201320080278.5	2013.02.21	10年	原始取得	无
257	晶圆测试探针卡	江苏汇成	实用新型	ZL201220676323.9	2012.12.11	10年	原始取得	无
258	切割机刀片侦测装置	江苏汇成	实用新型	ZL201220668978.1	2012.12.07	10年	原始取得	无
259	驱动IC封装凸块及封装结构	江苏汇成	实用新型	ZL201220409071.3	2012.08.17	10年	原始取得	无

注1：发明专利保护期限为20年，实用新型专利保护期限为10年，自申请之日起算。

注2：一种用于微结构三维形变和位移测试的干涉测量系统（ZL201410064678.6）系江苏汇成自西安电子科技大学处受让取得，具体情况参见招股说明书之“第六节 业务与技术”之“六、发行人核心技术及研发情况”之“（六）公司合作研发情况”。

附表二：关联担保

报告期内，汇成股份及江苏汇成发生的关联担保情况如下：

（一）公司作为被担保方的关联担保

1、报告期内汇成股份作为被担保方的关联担保

序号	债权人	担保方	主债权金额 (万元)	主债权期限	担保方式	是否履行完毕
1	中国建设银行股份有限公司	扬州新瑞连	6,800.00	2017.09.22-2023.09.21	为担保人合肥鑫城提供股权质押反担保	否
		郑瑞俊			为担保人合肥鑫城提供连带责任保证反担保	
		扬州新瑞连	8,200.00	2018.09.29-2023.09.18	为担保人合肥鑫城提供股权质押反担保	否
		郑瑞俊、杨会	最高额 24,200.00	主债权发生期间 2017.08.02-2020.08.01	最高额连带责任保证	否
2	中国建设银行股份有限公司	郑瑞俊、杨会、瑞成建筑、安徽创新融资担保有限公司 ^(注1)	7,000.00	2020.05.28-2023.09.21	为担保人合肥市中小企业融资担保有限公司提供连带责任保证反担保	否

序号	债权人	担保方	主债权金额 (万元)	主债权期限	担保方式	是否履行完毕
		郑瑞俊、杨会、瑞成建筑			为反担保人安徽创新融资担保有限公司提供连带责任保证反担保	否
3	合肥鑫城（委托中国建设银行股份有限公司贷款）	郑瑞俊	5,000.00	2016.09.30-2020.05.29	连带责任保证	是
		扬州新瑞连			以其持有的汇成股份股权设定质押担保	是
		郑瑞俊	5,000.00	2017.01.16-2020.11.30	连带责任保证	是
		扬州新瑞连			以其持有的汇成股份股权设定质押担保	是
4	东莞银行股份有限公司合肥分行	郑瑞俊	最高额 8,060.00	主债权发生期间 2019.07.03-2025.07.02	最高额连带责任保证	否
5	合肥市国正资产经营有限公司（委托华夏银行股份有限公司合肥高新区支行贷款）	郑瑞俊、杨会、扬州新瑞连、瑞成建筑	1,000.00	2017.09.18-2018.03.19	连带责任保证	是
			2,000.00	2017.09.18-2018.09.18	连带责任保证	是
			1,000.00	2018.01.23-2018.07.23	连带责任保证	是
			1,000.00	2018.04.11-2019.01.11	连带责任保证	是
			1,000.00	2018.08.21-2019.08.21	连带责任保证	是
			1,000.00	2018.10.08-2019.10.08	连带责任保证	是
			2,000.00	2018.12.12-2019.12.12	连带责任保证	是
			1,000.00	2019.02.02-2020.02.10	连带责任保证	是
			1,000.00	2019.08.26-2020.05.28	连带责任保证	是
			1,000.00	2019.10.18-2020.10.19	连带责任保证	是

序号	债权人	担保方	主债权金额 (万元)	主债权期限	担保方式	是否履行完毕
			1,000.00	2020.01.21-2021.01.21	连带责任保证	是
			3,000.00	2020.04.30-2021.04.30	连带责任保证	是
			4,000.00	2020.06.10-2021.06.01	连带责任保证	是
			1,000.00	2021.02.26-2022.02.26	连带责任保证	否
			3,000.00	2021.05.10-2022.05.10	连带责任保证	否
			4,000.00	2021.06.21-2022.06.21	连带责任保证	否
6	合肥市国正资产经营有限公司（委托合肥科技农村商业银行股份有限公司红旗市场支行贷款）	郑瑞俊、杨会、扬州新瑞连、瑞成建筑	4,000.00	2018.12.13-2019.03.13	连带责任保证	是
			3,000.00	2019.04.26-2020.04.26	连带责任保证	是
7	合肥市国正资产经营有限公司（委托安徽新安银行股份有限公司贷款）	郑瑞俊、杨会、扬州新瑞连、瑞成建筑	2,000.00	2019.05.30-2020.05.28	连带责任保证	是
			1,000.00	2019.05.31-2020.05.28	连带责任保证	是
8	合肥市创新科技风险投资有限公司（委托兴业银行股份有限公司合肥分行贷款）	郑瑞俊、杨会、扬州新瑞连、瑞成建筑	4,000.00	2019.04.22-2019.09.03	连带责任保证	是
9	合肥产投小微企业融资服务有限公司	郑瑞俊、杨会、扬州新瑞连、瑞成建筑	2,000.00	2018.11.16-2019.05.05	连带责任保证	是
			2,000.00	2019.12.12-2020.04.30	连带责任保证	是
			1,000.00	2020.02.13-2020.05.06	连带责任保证	是

序号	债权人	担保方	主债权金额 (万元)	主债权期限	担保方式	是否履行完毕
			3,000.00	2020.04.26-2020.05.19	连带责任保证	是
			4,000.00	2020.05.28-2020.06.11	连带责任保证	是
			2,000.00	2020.06.17-2020.12.29	连带责任保证	是
10	合肥兴泰商业保理有限公司	郑瑞俊、杨会	保理总额度 2,000.00	额度有效期 2020.09.18-2021.09.17	连带责任保证	是
11	合肥市兴泰担保行业保障金运营有限公司 (注2)	郑瑞俊	1,000.00	2017.12.18-2018.01.24	连带责任保证	是
			1,000.00	2018.07.23-2018.08.22	连带责任保证	是
			2,000.00	2018.09.18-2018.10.15	连带责任保证	是
			1,000.00	2019.01.11-2019.02.02	连带责任保证	是
			4,000.00	2019.03.13-2019.05.31	连带责任保证	是
			1,000.00	2019.08.21-2019.08.27	连带责任保证	是
			1,000.00	2019.10.08-2019.10.22	连带责任保证	是
			1,000.00	2020.10.16-2020.12.04	连带责任保证	是
12	志道投资	郑瑞俊、杨会	4,000.00	2020.04.08-2020.12.07	连带责任保证	是
			1,500.00	2020.05.12-2020.07.09	连带责任保证	是
13	合肥兴泰科技融资租赁有限公司	郑瑞俊、杨会	4,500.00	2019.02.01-2021.07.02	以个人名下房产提供抵押担保;连带责任保证	是
14	Spirox Cayman Corporation	扬州新瑞连、郑瑞俊	5,000.00	2019.03.28-2020.12.16	连带责任保证	是
			3,500.00	2019.09.12-2020.12.16	连带责任保证	是
15	Strong Lion Limited	扬州新瑞连、郑瑞俊	1,000.00	2019.04.02-2020.12.28	连带责任保证	是

序号	债权人	担保方	主债权金额 (万元)	主债权期限	担保方式	是否履行完毕
16	Worth Plus Holdings Limited	扬州新瑞连、郑瑞俊	1,000.00	2019.04.02-2020.12.30	连带责任保证	是
17	苏明德	扬州新瑞连、郑瑞俊	500.00	2019.03.29-2020.11.25	连带责任保证	是
18	语音基金	郑瑞俊、杨会	4,000 ^(注3)	2019.09.02-2020.12.28	连带责任保证	是
19	中国农业银行股份有限公司合肥新站高新区支行	郑瑞俊、杨会	最高额 10,000.00	主债权发生期间 2021.05.06-2022.05.05	最高额连带责任保证	否
20	招商银行股份有限公司合肥分行	郑瑞俊、杨会	最高额 10,000.00	主债权发生期间 2021.03.29-2022.03.28	最高额连带责任保证	否
21	华夏银行股份有限公司合肥高新区支行	郑瑞俊、杨会	最高额 7,000.00	主债权发生期间 2021.05.17-2022.05.17	以个人名下房产提供抵押担保;最高额连带责任保证	否
22	上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行	郑瑞俊、杨会	最高额 4,000.00	主债权发生期间 2021.05.24-2022.04.29	最高额连带责任保证	否

注 1：安徽创新融资担保有限公司系持股 5% 以上股东志道投资的关联公司；

注 2：合肥市兴泰担保行业保障金运营有限公司现已更名为合肥市兴泰担保资产管理有限公司；

注 3：根据语音基金可转债投资协议，郑瑞俊、杨会为该协议项下公司对语音基金的付款义务（包括但不限于清偿贷款本金及利息、清算财产分配）提供连带责任保证。

2、报告期内江苏汇成作为被担保方的关联担保

序号	债权人	担保方	被担保最高 债权额（万 元）	主债权发生期间	担保方式	是否履 行完毕
1	江苏银行股份有限 公司扬州分行	郑瑞俊	4,000.00	2019.05.07-2021. 09.07	最高额连带责任保 证	是
2	中信银行股份有限 公司扬州分行	郑瑞俊	7,200.00	2015.03.23-2018. 03.23	最高额连带责任保 证	是
		瑞成建筑	7,200.00	2016.08.03-2019. 08.03	最高额连带责任保 证	是
		郑瑞俊	3,000.00	2018.04.19-2021. 04.19	最高额连带责任保 证	是
3	中国银行股份有限 公司扬州邗江支行	郑瑞俊	3,500.00	2015.01.20-2018. 01.19 ^{（注1）}	最高额连带责任保 证	是
		郑瑞俊	3,500.00	2018.06.22-2023. 06.21 ^{（注2）}	最高额连带责任保 证	否
		瑞成建筑	3,500.00	2021.06.01-2026. 05.31 ^{（注3）}	最高额连带责任保 证	否
4	正奇国际商业保理 有限公司	郑瑞俊、 杨会	3,000.00	额度有效期 2020.07.30-2021. 01.30	连带责任保证	是

注 1：根据保证合同的相关约定，在 2015 年 1 月 20 日前债务人与债权人之间实际发生的债权也属于该项担保的被担保主债权；

注 2：根据保证合同的相关约定，在 2018 年 6 月 22 日前债务人与债权人之间实际发生的债权也属于该项担保的被担保主债权；

注 3：根据保证合同的相关约定，在 2021 年 6 月 1 日前债务人与债权人之间实际发生的债权也属于该项担保的被担保主债权。

（二）公司作为担保方的关联担保

报告期内，公司曾作为担保方为扬州新瑞连支付合肥创投股权转让款事项提供担保，截至本招股说明书签署日，上述担保事项已解除，本招股说明书具体情况如下：

2018 年 10 月 15 日，扬州新瑞连与合肥创投签署股权转让协议，约定合肥创投将其持有的汇成有限 16.93% 股权（对应出资额 6,800 万元）转让给扬州新瑞连，股权转让价格为合肥创投取得该等股权时对应的投资款 17,000 万元附加相应的利息，股权转让款项应在 2021 年 12 月 27 日前付清，公司曾为上述事项提

供担保。截至本招股说明书签署日，公司上述担保事项已解除。

担保事项相关信息如下表所示：

被担保人名称	扬州新瑞连	
注册资本	50 万元	
实收资本	50 万元	
住所	扬州高新技术产业开发区纵一路与横三路交界处管委会大楼内 12 楼 1202 室	
生产经营情况	股权投资平台	
与发行人关系	发行人控股股东	
财务数据	2021.6.30/2021 年 1-6 月	2020.12.31/2020 年度
总资产（万元）	39,802.72	38,306.74
净资产（万元）	52.02	52.03
净利润（万元）	-0.02	0.15
主债务的种类	股权收购款及对应利息	
主债务的金额	股权收购款 17,000 万元及对应利息	
合同约定履行债务的期限	2018 年 10 月 15 日至 2021 年 12 月 27 日	
担保方式	无限连带责任保证	
担保范围	扬州新瑞连向合肥创投收购 6,800 万股本的交易对价 17,000 万元及对应利息	
约定担保期间	2018 年 10 月 15 日至 2021 年 12 月 27 日	
解决争议的方法	依法承担违约责任	
其他对担保人有重大影响的条款	合肥创投、扬州新瑞连、汇成股份与瑞成建筑于 2021 年 9 月签订了补充协议，约定由瑞成建筑作为担保方，发行人不再承担担保义务	
担保履行情况	截至本招股说明书签署日，上述担保已解除	
是否存在反担保	不存在	
该等担保对发行人业务经营与财务状况的影响	上述担保已解除，对发行人不存在不利影响	